

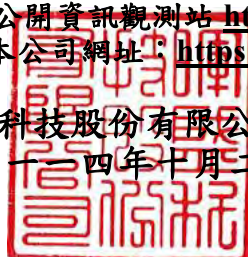
暉盛科技股份有限公司 NANO ELECTRONICS AND MICRO SYSTEM TECHNOLOGIES, INC.

公開說明書

(現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用)

- 一、公司名稱：暉盛科技股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用。
 - (一)股票來源：現金增資發行新股。
 - (二)種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。
 - (三)股數：現金增資發行新股 2,165,000 股。
 - (四)金額：新台幣 21,650,000 元整。
 - (五)發行條件：
 1. 本次現金增資發行新股 2,165,000 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 21,650,000 元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣 67.92 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，本次競價拍賣得標總金額為新臺幣 187,557 千元；各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為每股新臺幣 101.88 元，惟均價高於最低承銷價格之 1.06 倍，故公開承銷價格以每股新臺幣 72 元溢價發行。
 2. 依公司法第 267 條規定，保留發行新股 15%計 324,000 股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘 85%計 1,841,000 股全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷。
 3. 本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
 - (六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數之 85%，共計 1,841,000 股。
 - (七)承銷及配售方式：採全數競價拍賣方式辦理承銷。
- 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第 66 頁。
- 四、本次發行之相關費用：
 - (一)承銷費用：包括上市輔導費及承銷手續費等費用，約新台幣 500 萬元整。
 - (二)上市審查費用：新台幣 50 萬元整。
 - (三)其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用，約新台幣 235 萬元整。
- 五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項：請參閱本公開說明書第 2-5 頁。
- 八、本公開說明書，適用於初次申請有價證券創板上市，並計劃以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理創板上市前之公開銷售。
- 九、本公司係創板上市公司，相關營運風險較高。
- 十、創板初次上市承銷案件，掛牌後首五個交易日應無漲跌幅限制，投資人應注意交易之風險。
- 十一、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。
- 十二、本公司係依上市審查準則第二十九條第一項之規定申請股票在創板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，且所營業務具有相當之風險性，請投資人特別注意。
- 十三、本公司於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起一個月內委任其他證券承銷商繼任。
- 十四、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>
本公司網址：<https://www.nemstek.com.tw>

暉盛科技股份有限公司 編製
中華民國十四年十月二十三日刊印



本公司申請普通股 28,859,776 股上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」審查，同意俟股票公開銷售完畢後，列為創新板上市股票，並以 114 年 9 月 2 日臺證上二字第 1141703553 號函報金融監督管理委員會備查。

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新台幣元；%

實收資本來源	金額	占實收資本額之比率
設立資本	32,000,000	9.24
現金增資	67,003,550	19.35
盈餘轉增資	221,273,760	63.89
員工酬勞轉增資	26,040,000	7.52
合計	346,317,310	100.00

二、公開說明書之分送計畫：

- (一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司以供查詢。
- (二)分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定之方式辦理。
- (三)索取方法：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢及下載。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：

- 名稱：福邦證券股份有限公司 網址：<https://www.gfortune.com.tw>
- 地址：臺北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 7 樓 電話：(02)2383-6888
- 名稱：元大證券股份有限公司 網址：<https://www.yuanta.com.tw>
- 地址：臺北市中山區南京東路 3 段 219 號 11 樓 電話：(02)2718-1234

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

- 名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部 網址：<https://www.gfortune.com.tw>
- 地址：臺北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 6 樓 電話：(02)2371-1658

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

- 會計師姓名：謝仁耀、李國銘會計師
- 事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所 網址：<https://www.crowe.tw>
- 地址：高雄市苓雅區四維三路 6 號 27 樓之 1 電話：(07)331-2133

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

- 複核律師：彭義誠律師 網址：<http://www.fsi-law.com>
- 事務所名稱：翰辰法律事務所 電話：(02)2345-0016
- 地址：臺北市信義區松德路 6 號 12 樓

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

- 發言人：邱冠陸 職稱：行銷部經理
- 電話：(06)291-5500 電子郵件信箱：nems_service@nemstek.com.tw
- 代理發言人：蔡郁仁 職稱：財會部經理
- 電話：(06)291-5500 電子郵件信箱：nems_service@nemstek.com.tw

十三、公司網址：<https://www.nemstek.com.tw>

發行人之產業、營運及其他重要風險

一、產業風險

(一)營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

本公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此本公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應對策：

- (1) 本公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。
- (2) 本公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

(二)技術及產品變化之風險

全球半導體技術迭代迅速，包括AI晶片、先進封裝、Chiplet架構與第三代半導體材料持續突破，終端應用需求亦快速轉變。若本公司未能同步升級核心技術，產品規格或製程能力未能即時滿足客戶需求，恐面臨產品被取代或喪失技術領先地位之風險，訂單取得與市場滲透率亦將受影響，尤以先進封裝、高頻載板與環保設備領域為甚。

因應對策：

- (3) 本公司每年投入約營業收入5%作為研發支出，確保持續性創新動能，並與生產部電控及機構設計單位密切合作，積極強化高彈性客製化產品設計能力，導入製程即服務(PaaS)模式以提升市場變動適應速度與彈性，並藉由客戶客製需求，共同開發新產品，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化並同步累積特殊材料或應用端Know-how。此外，本公司核心團隊所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，以對市場敏銳度積極投入新產品研發以推出符合市場需求之產品，同時積極申請專利保護，並發展具差異化的技術方案，如ABF全乾式蝕刻與高溫電漿火炬系統，形塑技術壁壘，提升市場競爭力。

二、營運風險

(一)專業人才取得與留任面臨挑戰

本公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，本公司之規模及品牌不及該區域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為本公司挑戰及努力的方向。

因應措施：

本公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對本公司的認可與向心力，以降低員工流動率。本公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

(二)匯率風險

本公司主要外銷占比約五~六成且以美元交易為主，故衍生一定程度之匯率波動風險，美元之匯率波動對本公司獲利有一定之影響。

因應措施：

本公司對匯率風險之因應，主要視營運資金需求，選擇適當時機將現金部位轉換為美元部位，以降低換匯需求。此外，本公司財務人員亦與主要往來銀行密切聯繫，定期檢視外匯市場，依必要性調整銷貨價格，以適時反應匯率變動情形，並適量保留外幣存款資產，積極了解外匯避險工具，未來如收付部位相差較大，將另行評估是否將採用衍生性商品進行避險，以將低外匯風險影響公司獲利。

三、其他重要風險

本公司其他重要風險請詳本公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

綜上所述，就本公司所面臨之產業、營運及其他風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，本公司已具備因應相關風險之能力，各項因應措施尚屬穩當，尚可有效降低相關之風險。

暉盛科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：346,317,310 元		公司地址：臺南市安南區科技五路 100 號		電話：(06)291-5500	
設立日期：91 年 6 月 11 日			網址：https://www.nemstek.com.tw		
上市日期：不適用		上櫃日期：不適用		公開發行日期：112 年 12 月 6 日	
		管理股票日期：不適用			
負責人：董事長：宋俊毅 總經理：許嘉元			發言人：邱冠陸 職稱：行銷部經理 代理發言人：蔡郁仁 職稱：財會部經理		
股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部			電話：(02)2371-1658 網址：https://www.gfortune.com.tw 地址：臺北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 6 樓		
股票承銷機構：福邦證券股份有限公司			電話：(02)2383-6888 網址：https://www.gfortune.com.tw 地址：臺北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 7 樓		
元大證券股份有限公司			電話：(02)2718-1234 網址：https://www.yuanta.com.tw 地址：臺北市中山區南京東路 3 段 219 號 11 樓		
最近年度簽證會計師：國富浩華聯合會計師事務所 謝仁耀、李國銘會計師			電話：(07)331-2133 網址：https://www.crowe.tw 地址：高雄市苓雅區四維三路 6 號 27 樓之 1		
複核律師：翰辰法律事務所 彭義誠律師			電話：(02)2345-0016 網址：http://www.fsi-law.com 地址：臺北市信義區松德路 6 號 12 樓		
信用評等機構：不適用			電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用		
評等標的		發行公司：不適用 無■；有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用			
		本次發行公司債：不適用 無■；有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用			
董事選任日期：112 年 5 月 30 日，任期：3 年			監察人選任日期：不適用，本公司設置審計委員會		
全體董事持股比例：37.85% (114 年 9 月 30 日)			全體監察人持股比率：不適用，本公司設置審計委員會		
董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：37.85% (114 年 9 月 30 日)					
職 稱	姓 名	持股比例	職 稱	姓 名	持股比例
董事長暨 持股超過 10% 股東	宋俊毅	11.14%	獨立董事	顏盟峯	0.00%
董 事 暨 持股超過 10% 股東	基丞科技(股)公司	15.12%	獨立董事	何志文	0.00%
	代表人：江少杰	0.00%			
董 事	曾坤燦	7.27%	獨立董事	黃蕙玲	0.00%
董 事	許嘉元	4.32%			
工廠地址：臺南市安南區科技五路 100 號			電話：(06)291-5500		
主要產品：各式電漿設備		市場結構(113 年度)：內銷 47.77% 外銷 52.23%		參閱本文之頁次 第 48 頁	
風 險 事 項	請參閱本公開說明書公司概況之風險事項			參閱本文之頁次 第 2~5 頁	
去 (1 1 3) 年 度	營業收入：547,630 千元 稅前純益：112,983 千元 每股盈餘(稅後)：3.01 元			參閱本文之頁次 第 77 頁	
本次募集發行有價證券種類及金額			請參閱本公開說明書封面		
發行條件			請參閱本公開說明書封面		
募集資金用途及預計產生效益概述			請參閱本公開說明書第 66 頁		
主辦證券承銷商執行過額配售及價格穩定之相關資訊			本公司已與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議書約定 相關事宜		
本次公開說明書刊印日期：114 年 10 月 23 日			刊印目的：現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨 股票初次上市用		
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄					

暉盛科技股份有限公司

公開說明書目錄

壹、公司概況	1
一、公司簡介	1
(一)設立日期	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話	1
(三)公司沿革	1
二、風險事項	2
(一)風險因素	2
(二)訴訟或非訟事件	6
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響	6
(四)發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第三條第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明	6
(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施	6
(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施	6
(七)發行公司以創業投資公司申請上市者，應增列敘明其投資標的中未上市櫃公司之公允價值欠缺透明度、其投資標的組合可能產生重大變動等風險事項及因應措施	10
(八)其他重要事項	10
三、公司組織	11
(一)組織系統	11
(二)關係企業圖	13
(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管	14
(四)董事及獨立董事	15
(五)發起人	19
(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	20
(七)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性	23
(八)發行公司之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形，另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任	24

(九) 本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷.....	24
四、資本及股份.....	25
(一) 股份種類.....	25
(二) 股本形成經過.....	25
(三) 最近股權分散情形.....	25
(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	29
(五) 公司股利政策及執行狀況.....	30
(六) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	30
(七) 員工、董事及監察人酬勞.....	30
(八) 公司買回本公司股份情形.....	31
五、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	31
六、特別股辦理情形.....	31
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	31
八、員工認股權憑證辦理情形.....	32
(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證截至公開說明書刊印日止辦理情形及對股東權益之影響.....	32
(二) 累積至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形.....	32
(三) 最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形.....	32
九、限制員工權利新股辦理情形.....	32
十、併購辦理情形.....	32
十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	32
貳、營運概況.....	33
一、公司之經營.....	33
(一) 業務內容.....	33
(二) 市場及產銷概況.....	48
(三) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數.....	56
(四) 環保支出資訊.....	57
(五) 勞資關係.....	57
(六) 資通安全管理.....	58
(七) 有無因應景氣變動之能力.....	59
(八) 發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理...59	59
(九) 基層員工範圍及最近一個會計年度基層員工月平均經常性薪資之平均數，平均數如未達該年度每月基本工資一點三倍者，尚應敘明原因及具體改善措施.....	59
(十) 本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項.....	59
二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產應記載事項.....	63
(一) 自有資產.....	63
(二) 使用權資產.....	63
(三) 各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率.....	63

三、轉投資事業.....	64
(一) 轉投資事業概況.....	64
(二) 綜合持股比例.....	64
(三) 上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響.....	64
(四) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數.....	65
四、重要契約.....	65
參、發行計畫及執行情形.....	66
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項.....	66
二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項.....	66
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項.....	74
四、本次併購發行新股應記載事項.....	74
肆、財務概況.....	75
一、最近五年度簡明財務資料.....	75
(一) 簡明資產負債表及綜合損益表.....	75
(二) 影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響.....	78
(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見.....	78
(四) 財務分析.....	79
(五) 會計項目重大變動說明.....	83
(六) 本國發行公司自公開發行後最近連續七年，或外國發行公司最近連續七年財務報告皆由相同會計師查核簽證者，應說明未更換會計師之原因、目前簽證會計師之獨立性暨公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施.....	86
(七) 外國發行公司得僅列示最近三年度簡明財務資料.....	86
(八) 外國發行公司列示之財務報表為最近兩年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告，如係申請創新板第一上市者，為最近一年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告.....	86
二、財務報告應記載事項.....	87
(一) 發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告.....	87
(二) 最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表.....	87
(三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師	

查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露	87
三、財務概況其他重要事項	87
(一) 公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響	87
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露之資訊	87
(三) 期後事項	87
(四) 其他	87
四、財務狀況及經營結果檢討分析	88
(一) 財務狀況	88
(二) 財務績效	89
(三) 現金流量	90
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	90
(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	91
(六) 其他重要事項	91
伍、特別記載事項	92
一、內部控制制度執行狀況	92
(一) 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議	92
(二) 最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形	92
(三) 內部控制制度聲明書	92
(四) 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形	92
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告	92
三、證券承銷商評估總結意見	92
四、律師法律意見書	92
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	92
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形	92
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項	92
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形	92
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容	92
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形	92
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書	92

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書.....	93
十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專業審查取具之報告書.....	93
十四、發行公司之公司治理運作情形.....	93
十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易.....	93
十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估.....	93
十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度.....	93
十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人.....	93
十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項.....	93
二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊.....	93
二一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會.....	93
二二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列之事項.....	93
二三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	93
二四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響.....	93
二五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、第二十八條之一第五項、第六項、第二十九條第一項、第二項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項.....	93
二六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見.....	93
二七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書.....	94
二八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定抵觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露.....	94
二九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明.....	94
三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見.....	94
三一、其他必要補充說明事項.....	94
三二、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項.....	95

(一) 董事會運作情形資訊	95
(二) 審計委員會運作情形資訊	101
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	104
(四) 薪資報酬委員會運作情形資訊	108
(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	108
(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	112
(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式	114
(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、 內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總	114
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	114
陸、重要決議、公司章程及相關法規	115
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)	115
(一)與本次發行有關之董事會議事錄	115
(二)公司章程及章程新舊條文對照表	115
(三)盈餘分配表	115
二、未來股利發放政策	115
三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響事項	115
四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資 新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召 集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容	115
附件一、民國 113 年度合併財務報告暨會計師查核報告	
附件二、民國 114 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告	
附件三、民國 113 年度個體財務報告暨會計師查核報告	
附件四：內部控制制度聲明書	
附件五：內部控制制度審查確信報告	
附件六：證券承銷商評估總結意見	
附件七：律師法律意見書	
附件八：不得退還或收取承銷相關費用之聲明書	
附件九：不受理特定對象投標聲明書	
附件十：財務業務往來無非常規交易情事之聲明書	
附件十一：承銷價格計算書	
附件十二：與本次發行有關之決議文	
附件十三：公司章程及新舊條文對照表	
附件十四：盈餘分配表	
附件十五：其他必要補充說明事項	
附件十六：股票初次申請創板上市證券承銷商評估報告	
附件十七：創板上市前現金增資發行新股證券承銷商評估報告	

壹、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期：91年6月11日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

- 1.總公司暨工廠地址：台南市安南區科技五路100號
- 2.總公司暨工廠電話：(06)291-5500
- 3.分公司地址及電話：無

(三)公司沿革

年度	重要紀事
91年	1.公司成立，實收資本額為新台幣32,000千元。 2.以開發先進電漿(Plasma)技術及製作各式電漿設備為營運主軸。初期以半導體及印刷電路板等電子領域客戶為銷售對象。
92年	1.現金增資24,530千元，實收資本額56,530千元。 2.跨足並銷售電漿設備至平面顯示器等光電領域。
93年	成功開發多款大氣式電漿設備並開始進行量產。
94年	連續式電漿清洗機開發成功並開始銷售。
95年	1.盈餘轉增資5,653千元，實收資本額62,183千元。 2.開始將電漿技術及設備引進非電子及民生工業，如塑膠及車用部品製造領域。
96年	成功銷售電漿設備至生化醫學領域。
97年	引進電漿設備至觸控螢幕製程應用。
98年	進行電漿殺菌、廢氣處理及空氣淨化等應用之開發。
99年	首度銷售電漿設備至美國半導體大廠，並獲得各項製程與安全認證，行銷網首度觸及亞洲以外領土；開啟高爾夫球製造製程中電漿應用與設備銷售。
100年	現金增資6,210千元，實收資本額68,393千元。
101年	1.盈餘轉增資20,518千元，實收資本額88,911千元。 2.成功開發連續式及捲對捲式電漿去膠渣機，並銷售至IC載板及軟板大廠。
102年	成功引進並銷售電漿技術與設備於製鞋工業。
103年	提供新式且低能耗電漿解決方案於太陽能產業，有效解決發電效率衰減問題。
104年	盈餘轉增資17,782千元，實收資本額106,693千元。
106年	1.盈餘轉增資21,339千元，實收資本額128,032千元。 2.成功將電漿技術導入5G手機天線供應鏈之應用，並大量將電漿機台應用在LCP等高頻材料之製程；跨足歐洲市場之電漿設備銷售。

年度	重要紀事
107 年	開發獨特電漿極化技術，成功地將此電漿技術應用於 5G 手機屏下指紋辨識晶片製造製程，並獲得美國半導體大廠之電漿設備認證
108 年	1.盈餘轉增資 64,016 千元，實收資本額 192,048 千元。 2.現金增資 36,263 千元，實收資本額 228,311 千元。 3.取得 ISO 9001 關於生產製造、設計開發、測試、設備銷售之組織管理系統認證；先進高溫電漿火炬技術開發完成，開始應用於固態廢棄物與廢油之處理，提供環保減廢之絕佳方案。
109 年	成功銷售各式高效能電漿蝕刻機(包含微波電漿蝕刻機以及反應性離子電漿蝕刻機)於晶圓及 IC 載板製程領域，特別是應用於各式高分子材料或金屬蝕刻。
110 年	針對晶圓提供數項的電漿解決方案，包括晶圓再生、電漿晶圓切割、電漿晶圓薄化，持續取得客戶的認證。
111 年	1.盈餘轉增資 34,247 千元，實收資本額 262,558 千元。 2.台南科技工業區新廠落成並啟用；開發電漿減碳應用。
112 年	1.員工認股權憑證執行轉增資 26,040 千元，實收資本額 288,598 千元。 2.經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行，股票代號：7730。
113 年	1.基於全球 ESG 環保永續經營的議題與需求，全力發展電漿全乾法製程的解決方案。 2.針對玻璃基板面板級封裝(PLP)各式製程，開發先進電漿解決方案，並陸續取得國際大廠的認證與訂單。 3.開發並提出先進晶圓級封裝(WLP)之 3-D 堆疊封裝製程之電漿解決方案。
114 年	1.持續地針對混合鍵合(Hybrid Bonding)/直接鍵合(Direct Bonding)發表電漿解決方案新技術。 2.針對電漿創造乾淨新能源進行應用市場之開發。 3.盈餘轉增資 57,720 千元，實收資本額 346,318 千元。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 113 年度及 114 年前二季利息收入分別為 4,112 千元及 2,393 千元，占當期營業收入淨額比率分別為 0.75%及 0.94%，主要係銀行存款利息收入，因利息收入占營收淨額比率較少，故對公司整體影響不大。

本公司 113 年度及 114 年前二季利息費用分別為 3,300 千元及 1,637 千元，占當期營業收入淨額比率分別為 0.60%及 0.64%，主要係銀行借款之財務成本。公司資金規劃係以保守穩健為依循，且持續關注利率走勢，適時調整資金運用方式，考量公司未

來營運規模及獲利能力提升，公司將持續與金融機構保持良好往來關係，並適時爭取最適利率以降低利息支出，以因應利率變動產生之財務風險。目前公司財務穩定，債信良好，預計未來利率變動對公司整體營運應不致產生重大影響。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 113 年度及 114 年前二季兌換淨利(淨損)分別為 22,349 千元及(19,429)千元，占當期營業收入淨額比率分別為 4.08%及(7.60)%，顯示匯率變動對本公司損益影響尚屬有限。本公司因應匯率變動之避險措施如下：

- A.本公司部分採取外幣應收付款項相互沖抵，以降低曝險部位達到自然避險效果降低匯率風險。
- B.財務部門與金融機構保持密切關係，藉由銀行提供之匯率變動分析及諮詢服務，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，同時隨時密切注意匯率變化資訊及持續觀察國際總體經濟情勢，除採適度保留外幣資產以支應外幣需求外，配合公司資金需求，適時換匯調節外幣部位。
- C.本公司依股東會決議通過之「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性金融商品相關作業程序，必要時得視外幣部位及匯率變動情形由財務主管採取適當避險措施，承作適當的金融商品，以降低本公司業務經營所產生之匯率風險。

(3)通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司於報價時即已盡量將成本波動適時轉嫁予客戶，經客戶與本公司議價後在本公司可以接受的銷售毛利範圍內接單，因此通貨膨脹對本公司損益尚未產生重大影響，且本公司將隨時注意市場價格波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，並採取必要之因應措施，以避免通貨膨脹對本公司損益造成之風險。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司一向專注本業發展同時秉持務實原則經營事業，財務政策也以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，且最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品之情形。本公司經董事會通過不擬從事資金貸與他人及背書保證，未來因業務需要欲從事資金貸與他人或背書保證，將依規定訂定管理辦法，並經股東會決議通過。另本公司未來倘若從事衍生性商品交易將依據本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫

核心策略	計畫目標說明
擴展核心製程技術深度	強化奈米級清洗、蝕刻與表面能控制能力，以支援先進封裝需求
跨材料整合與異材製程	佈局多元材料組合之製程挑戰，發展具選擇性與高精度控制能力的電漿蝕刻技術，針對不同介面結構進行有效處理
綠色製程技術創新	推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、氫能火炬、高 GWP 尾氣處理設備商品化
智慧製造導入	建立製程參數 AI 學習模型，導入虛擬量產平台與智慧維運 (e-maintenance)

(2)預計投入之研發費用

本公司每年投入約 5%營收作為研發預算，主要係依新產品及新技術開發計畫編列。未來視市場需求、營運狀況、技術開發狀況及功能性產品推出規劃，逐步增加研發經費的投入，以確保公司核心競爭力。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵循國內外相關法令，採取適當經營方針，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖，且本公司之管理階層亦隨時注意國內外重要政策發展及法規變動等相關趨勢與資訊，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，適時調整本公司營運策略。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並未受到國內外之重要政策及法律變動，而對本公司財務及業務有重大影響情事。

5.科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，以迅速掌握產業動態，持續開發新技術，適時調整產品組合以符合市場需求，維持公司之競爭力，另本公司已建立資訊安全相關內部控制及程序，以確保資訊系統及資料安全。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無因科技改變及產業變化而對公司財務業務產生重大影響之情形。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無發生因企業形象改變而產生重要影響之情事。公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險發生及對公司之影響。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無併購他公司之計畫。若將來有涉及併購之情事或計畫，則將依各項法令規定作業，進行各種效益之評估及風險之控管，以確實保障公司利益及股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無擴充廠房之計畫。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司與各原物料供應商均建立長期合作關係，並多方取得市場訊息，以合理價格取得供料貨源，料源供應對象多元化且具彈性，各項原物料均有兩家以上之供應來源，各供應商供貨情況良好，尚不曾發生供貨中斷而影響生產之情事。公司亦持續進行各種相關可行性評估，考量品質、成本、交期及供貨穩定性等條件，積極尋找新供應商，以降低現有供應商可能產生供貨短缺或交期延宕之風險。本公司 113 年度及 114 年前二季最大進貨廠商分別占當年度進貨比例分別為 12.94%及 13.17%，尚無進貨集中之風險。

(2)銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司銷售對象主要為國內外半導體先進封裝、IC 載板製造業者等均為知名上市櫃公司，公司除設備機台銷售外，亦積極投入零備件售後服務領域，藉此擴展海內、外不同產品別客戶。本公司 113 年度及 114 年前二季最大銷售客戶占當年度銷貨收入比例分別為 14.36%及 14.14%，尚無銷貨集中之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東未有股權之大量移轉或更換之情事。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，並無經營權改變之情事。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四) 發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第三條第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明：本公司之子公司並未達重要子公司標準，故不適用。

(五) 外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。

(六) 本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

1. 關鍵核心技術

電漿乾式清洗工藝在 PCB 製造與半導體先進封裝製程中，能提供卓越的清潔與表面活化效果，對確保高精度製程的良率與可靠性至關重要。相較於傳統濕式清洗方式，容易產生清洗劑殘留，且受限於液體表面張力，難以深入微細孔洞與複雜結構，電漿技術則具備高度穿透性與均勻性，能有效覆蓋 3D 結構並清潔微奈米間隙，是確保先進製程品質不可或缺的關鍵步驟。

本公司以高密度電漿乾式表面處理技術為核心，由研發團隊自主設計涵蓋基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空系統與溫控單元等關鍵子系統，並依應用需求彈性整合成高模組化、可擴展的設備平台，可針對不同產業領域進行模組重組與製程優化。其相關設計均已申請專利保護，專利技術涵蓋機構模組、電漿腔體設計、等離子生成模組、氣

體流場控制、感測監控機制等，皆為本公司研發團隊開創擁有，為設備製造關鍵門檻，其中包含 1 項新型專利、9 項發明專利及 3 項申請中專利。核心技術包括：

(1) ICP-RIE 電漿蝕刻系統(感應耦合電漿反應式離子蝕刻)

本公司自研高密度電漿源結構，並導入多階段電場控制技術。相較同業普遍採用單輸出電源，易受限於製程均勻性與參數調控彈性，本公司創新設計多輸出電源模組，可分區動態調整電漿密度與功率分佈，依不同蝕刻階段精準調控，大幅提升製程穩定性與蝕刻均勻度，滿足高精度、大面積與高難度製程需求。

(2) 常壓電漿極化

本公司為某美系半導體大廠唯一委託開發該項技術的供應商，專用於 PVDF(聚偏二氟乙烯)與 PZT(鋅鈦酸鉛)等壓電材料表面改性。透過電漿處理改變材料表面電子排列，造成壓電效應，此技術已成功應用於超音波指紋辨識模組之製程(如：智慧型手機中的螢幕下指紋感測器)。電漿極化技術可有效活化壓電材料性能，使感測訊號更清晰，辨識更準確。此外，常壓電漿亦可應用於電子元件散熱，無須額外風扇或液冷元件的被動式散熱方式，可有效降低系統功耗與體積。

(3) Hybrid Bonding(混合鍵合技術)－大氣電漿處理技術

Hybrid Bonding 為先進封裝製程關鍵技術之一，本公司為因應 Hybrid Bonding 先進封裝所需開發之大氣電漿處理，將預計於 2025 年 9 月底在美國聖地牙哥舉行的 IMAPS 國際會議正式發表。該技術將應用於晶片堆疊前之表面清潔與活化處理，針對 SiO₂-SiO₂ 與 Cu-Cu 介面進行低損傷乾式去氧化與表面活化，可顯著增強晶片鍵合強度與傳輸效能，並有效解決封裝過程中界面污染問題，支撐新一代封裝技術之可靠性與性能需求。

(4) 高效電漿火焰技術(Microwave Thermal Plasma)

由中研院委託本公司研發，協助能源機構建構應對減碳挑戰之先進設備。透過微波電磁場耦合模組與氣旋式腔體設計，實現甲烷(天然氣)裂解產生氫之高效反應路徑。傳統碳捕捉多屬「事後處理」技術，常以氣體形式收集二氧化碳，再進行儲存或處理，面臨高壓壓縮與儲存瓶頸，該技術於反應初期即直接將碳轉化為穩定固體形式，簡化後段處理流程。未來亦可應用於裂解半導體製程中產生的溫室氣體(如 SF₆、NF₃、CF₄)，以實現更具環境效益的製程減排方案。

2. 創新能力或創新經營模式

本公司之創新能力主要體現在自主開發的高密度電漿乾式表面處理技術架構，並以此核心開發出一系列具高度可擴展性的模組化系統設備，提供客戶完整製程解決方案及技術服務。本公司持續投入創新研發及前瞻性應用開發，並憑藉電漿技術在半導體製程中具備低污染、高效率製程處理等優勢，持續拓展應用層面，在全球推動 ESG 永續發展的潮流趨勢下，逐步取代傳統高污染及高耗能的製程設備。

(1)本公司現有核心技術之突破性應用

A.卷對卷式電漿去膠設備

將電漿應用在 3C 與行動裝置軟性電路板的表面清潔及去膠處理，已為科技大廠其軟性電路板供應商指定使用。

B.ABF 載板乾式蝕刻與表面處理

領先同業於載板製程導入 ICP-RIE 及高效電漿火焰處理技術，具備高蝕刻選擇性與高均勻性，能精準處理 ABF 基板中之 SiO₂ 填料與環氧基質，有效克服傳統濕式蝕刻難以達成之精細控制，目前可處理尺寸最大已達 850×750mm。

C.Hybrid Bonding(混合鍵合技術) —技術上之領先更新

本系統具 320mm 大面積有效處理範圍，可於單一製程步驟內同時完成多重處理，大幅縮短製程處理時間，並能無縫整合於下游封裝製程，提升整體生產效率。另外，不同於傳統微波或 RF 電漿系統，本公司採用中頻常壓介電阻擋放電(MF AP-DBD)技術，突破業界對高成本氬氣的依賴，成功實現以高濃度氮氣(N₂)作為主要工作氣體，不僅具備等效甚至優於傳統系統之處理效果，也大幅降低營運成本。

D.先進封裝電漿處理設備應用 (FOWLP/FOPLP)

針對晶圓級(FOWLP)與面板級(FOPLP)封裝技術日益精細之需求，本公司開發對應的低損傷電漿表面活化與蝕刻設備，可有效改善封裝層間附著力與金屬導通孔(RDL)清潔品質。設備支援 300mm 晶圓及 610×610mm 面板，具備大面積均勻性、高重現性與製程彈性，已成功導入多家先進封裝客戶之製程產線，協助提升封裝良率與可靠度，並可依不同材料堆疊需求進行多氣體、階段式或選擇性處理，滿足未來高頻、高密度、高散熱的異質整合封裝技術挑戰。

E.再生晶圓薄膜去除

結合 ICP-RIE 及高效電漿火焰處理技術，開發出低損傷乾式清膜模組，有效降低再生製程成本並提升再生晶圓品質，目前已獲台灣晶圓封測大廠採用。

(2)前瞻性應用

A.第三代半導體應用延伸(SiC 蝕刻/GaN 表面處理)：已完成初步模組開發，計畫配合功率晶片製造擴展應用。

B.微型感測器與 PVDF(聚偏二氟乙烯)與 PZT(鈹鈦酸鉛)電漿極化封裝技術：支援次世代智慧穿戴裝置之壓電模組封裝。

C.工業廢氣/醫療廢棄物電漿即時裂解設備：應用高效電漿火焰模組實現 ESG 減碳需求。

D.AI 製程參數學習平台：建構預測性良率模組，預計進一步商業化至數據服務平台。

(3)減碳排廢應用的創新實踐

本公司除了在半導體及電子資訊產業持續著墨於綠色製程技術的研發與應用外，在減碳排廢應用上同樣展現創新作為。

A.減廢製氫能源應用創新及永續設備設計

面對全球減碳趨勢，本公司投入電漿裂解甲烷製氫技術之研發，不僅減少溫室氣體排放，同時開創潔淨能源生產新路徑。此技術提供了一種低碳的氫能生產方案，符合未來氫經濟的綠色發展方向；此外，本公司亦已研發出直流電漿火炬系統，採用熱效率電極設計，可延長電漿設備電極使用壽命，使設備能長時間穩定運行且維護成本低，強化企業 ESG 表現。

B.工業廢氣與製程尾氣裂解處理

本公司研發工業污染氣體電漿防治設備，可串接於製程排氣系統中解決工業製程中的廢氣，將廢氣中的有害成分高效分解降低污染物排放，協助企業符合環保法規並減輕環境負荷。

C.低碳製程替代方案

針對傳統濕式化學製程的高污染與高耗能問題，本公司研發全乾式電漿去膠渣及蝕刻製程，成功取代需耗用大量化學藥劑的傳統製程。此乾式製程不僅符合半導體高精度製程需求，亦大幅降低製程廢液及能源消耗，符合節能減碳與綠色製造趨勢。

3.因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

(1)技術及產品變化之風險

全球半導體技術迭代迅速，包括 AI 晶片、先進封裝、Chiplet 架構與第三代半導體材料持續突破，終端應用需求亦快速轉變。若本公司未能同步升級核心技術，產品規格或製程能力未能即時滿足客戶需求，恐面臨產品被取代或喪失技術領先地位之風險，訂單取得與市場滲透率亦將受影響，尤以先進封裝、高頻載板與環保設備領域為甚。

因應對策：

本公司每年投入約營業收入 5%作為研發支出，確保持續性創新動能，並與生產部電控及機構設計單位密切合作，積極強化高彈性客製化產品設計能力，導入製程即服務(PaaS)模式以提升市場變動適應速度與彈性，並藉由客戶客製需求，共同開發新產品，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化並同步累積特殊材料或應用端 Know-how。此外，本公司核心團隊所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，以對市場敏銳度積極投入新產品研發以推出符合市場需求之產品，同時積極申請專利保護，並發展具差異化的技術方案，如 ABF 全乾式蝕刻與高溫電漿火炬系統，形塑技術壁壘，提升市場競爭力。

(2)政策與貿易變化風險

中美貿易局勢不確定性高，美方若針對晶片製造或設備產品提高關稅，或將本土化壓力轉嫁至供應鏈，本公司所供應之設備或其客戶產品可能間接受影響，進而衝擊營運表現。

因應對策：

指定窗口密切關注美國相關機構之政策公告，掌握第一手關稅與出口管制動向，確保對應製程、產品或客戶交易行為符合最新規範，並留意主要客戶應用產品之關稅變化可能造成之後續影響，降低法律與商業風險。結合 ERP/CRM 系統即時回饋進口稅率、運費與原物料價格變動對產品售價的影響，讓銷售團隊與財務部門可依據區域與客戶別調整報價策略，避免毛利率大幅波動。此外，配合地緣政治變化，加速全球非美市場多元化策略，重點佈局東南亞(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈，透過與當地專業經銷商合作，提升在地即時支援能力。

(3)核心技術人員變動風險

若關鍵研發人員離職，可能影響新技術開發及現有技術整合及發展。

因應對策：

本公司持續積極培養核心技術相關人才，所有研發專案皆採「雙人制度」與交叉備援機制，以分散關鍵技術集中風險，確保技術傳承不中斷。研發人員在職期間所產出的技術成果均已全面專利化，並導入文件加密與權限控管系統，有效保障智慧財產安全，即便核心技術人員離職，對公司整體營運影響尚屬有限。在內部人才培育方面，本公司已建構知識系統化平台，並定期進行技術交接與內部經驗分享，此外，本公司同時實施具吸引力之獎酬與留才制度，以進一步提升人才的穩定性。

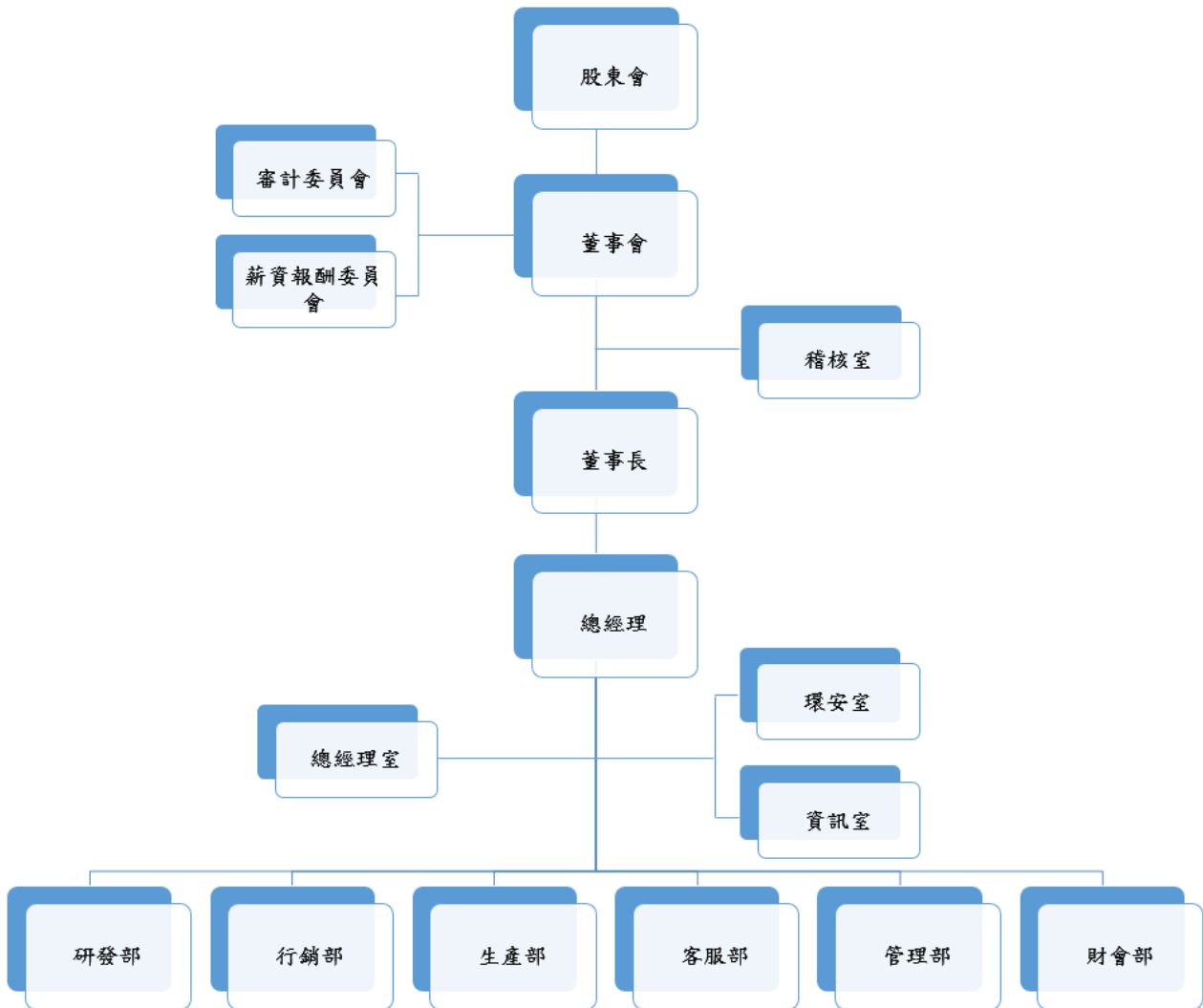
(七)發行公司以創業投資公司申請上市者，應增列敘明其投資標的中未上市櫃公司之公允價值欠缺透明度、其投資標的組合可能產生重大變動等風險事項及因應措施：不適用。

(八)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1.組織結構

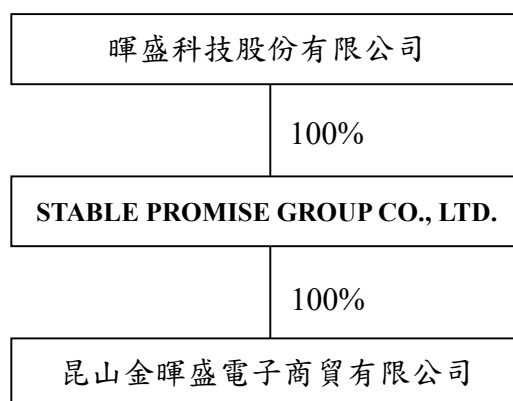


2.各主要部門所營業務

部 門	工作職掌
稽 核 室	<ul style="list-style-type: none"> ■檢視制度設計完備性及執行有效性 ■獨立評估內部風險控制制度 ■確保遵循公司政策程序及政府法令規章
總 經 理 室	<ul style="list-style-type: none"> ■策略規劃、經營方針與目標之擬定及推動 ■新事業發展及專案事項之規劃與管理
環 安 室	<ul style="list-style-type: none"> ■制定工作安全規範 ■勞工安全衛生工作、環境污染防治、消防安全之規劃、執行、管理與監督
資 訊 室	<ul style="list-style-type: none"> ■電腦軟體及硬體之管理及維護 ■網路資訊系統之備份及安全管理 ■電腦病毒與惡意軟體之防範
研 發 部	<ul style="list-style-type: none"> ■新技術與新產品之研發規劃、原型機測試及導入生產製程 ■協助生產製程及產品品質改進 ■協助技術發展優化及智慧財產權之申請 ■針對現行真空型、大氣行電漿設備之效能提升及問題改進
行 銷 部	<ul style="list-style-type: none"> ■產品之銷售及推廣 ■各項行銷企劃專案、行銷推廣企劃與執行 ■售後服務及相關產品諮詢
生 產 部	<ul style="list-style-type: none"> ■產品之生產製造 ■生產製造計劃之安排與管理 ■製程良率及品質良率之掌控與改善
客 服 部	<ul style="list-style-type: none"> ■客戶端設備維修、改裝及測試 ■售後服務及客戶關係維護
管 理 部	<ul style="list-style-type: none"> ■原物料採購及供應管理 ■人事總務規劃與執行 ■品質系統之建立及產品品質、安全相關之檢測
財 會 部	<ul style="list-style-type: none"> ■財務規劃及資金調度與管理 ■財務報表製作、成本及經營績效分析、稅務結算申報 ■年度預算彙總及執行結果分析

(二)關係企業圖

1.關係企業組織圖



2.與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額

114年6月30日；單位：新台幣千元；千股

關係企業名稱	與本公司關係	本公司對關係企業之持股			關係企業持有本公司股份		
		投資比例	持有股數	投資金額	投資比例	持有股數	投資金額
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.	子公司	100%	500	USD 500	—	—	—
昆山金暉盛電子商貿有限公司	孫公司	100%	註	USD 500	—	—	—

資料來源：經會計師核閱之合併財務報告

註：非為股份有限公司，故無股數，本公司透過 100%持有之 Stable Promise Group CO., LTD.，間接持有 100%昆山金暉盛電子商貿有限公司。

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

114年9月30日；單位：股，%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理	許嘉元	男	中華民國	91.06.11	1,495,980	4.32	27,600	0.08	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士	-	-	-	-	-	
生產部 部經理	符永豪	男	馬來西亞	91.06.11	300,000	0.87	1,185,697	3.42	-	-	成功大學資源工程系研究所碩士 鈦昇科技(股)公司研發工程師	-	-	-	-	-	
行銷部 部經理	邱冠陸	男	中華民國	91.08.14	1,300,000	3.75	-	-	-	-	成功大學航太研究所碩士 成大嚴慶齡中心專案經理	-	-	-	-	參閱本公	
研發部 資深經理	梁國超	男	中華民國	108.06.03	288,008	0.83	-	-	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士 核能研究所副研員	-	-	-	-	開說明書 壹、八之	
客服部 經理	劉一儒	女	中華民國	114.02.01	15,700	0.05	7,560	0.02	-	-	南台科技大學休閒事業管理系	-	-	-	-	員工認股 權憑證辦	
財會部經理兼 公司治理主管	蔡郁仁	男	中華民國	111.12.22	126,120	0.36	-	-	-	-	政治大學會計系研究所碩士 阜奕管理顧問(股)公司財務協理	-	-	-	-	理情形	
稽核主管	曾雅綉	女	中華民國	111.12.22	31,000	0.09	-	-	-	-	淡江大學會計系 國泰綜合證券(股)公司業務經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理	-	-	-	-	-	

(四)董事及獨立董事

1.姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、經(學)歷、持有股份及性質(本公司已設置審計委員會，故不適用監察人制度)

114年9月30日；單位：股，%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	宋俊毅	男 61~70歲	中華民國	91.05.27	112.05.30	3	1,581,973	6.03	3,859,197	11.14	368,769	1.06	-	-	國立臺灣科技大學電子系 基丞科技(股)公司總經理	昆山金暉盛電子商貿有限公司 董事長	-	-	-	-
董事	代表人董 事: 江少杰	男 61~70	中華民國	91.05.27	112.05.30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	內湖高工機械科	新群科技(股)公司董事長 新杰科技(股)公司董事長 基丞科技(股)公司董事長	-	-	-	-
	所代表之 法人: 基丞科技 (股)公司	-	中華民國	91.05.27	112.05.30	3	4,617,756	17.59	5,235,307	15.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	曾坤燦	男 61~70歲	中華民國	91.05.27	112.05.30	3	1,522,235	5.80	2,519,082	7.27	-	-	-	-	正修科大電子工程學系 江陰新杰科技有限公司總經理 江陰新基電子設備有限公司總經理 基丞科技(股)公司副總經理	-	-	-	-	
董事 暨 總經理	許嘉元	男 51~60歲	中華民國	91.05.27	112.05.30	3	1,089,650	4.15	1,495,980	4.32	27,600	0.08	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士	本公司總經理	-	-	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	顏盟峯	男 51~60 歲	中 華 民 國	113.01.26	113.01.26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	英國雷汀大學財務金融博士 中華郵政股份有限公司外部專家董事 國立成功大學會計學系系主任兼財務 金融研究所所長 國立成功大學會計學系兼財務金融研 究所副教授	國立成功大學會計學系兼財務 金融研究所教授 戴德森醫療財團法人嘉義基督 教醫院董事 申豐特用應材股份有限公司獨 立董事	-	-	-	-
獨立 董事	何志文	男 61~70 歲	中 華 民 國	113.01.26	113.01.26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學機械工程研究所材料組 碩士 飛信半導體(股)公司副總經理、總經 理	-	-	-	-	
獨立 董事	黃蕙玲	女 51~60 歲	中 華 民 國	113.01.26	113.01.26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	高雄第一科技大學財務管理系碩士 元山科技(股)公司總管理處處長兼財 務長 寶來證券(股)公司資深經理 台新證券(股)公司資深協理 綠甯能源(股)公司財務長	怡和國際能源(股)公司財會處長 綠盛能源工程(股)公司監察人 綠盛一能源工程(股)公司監察人 怡和綠能(股)公司監察人 昱豐事業(股)公司董事 利豐能源(股)公司董事 城七能源(股)公司董事	-	-	-	-

2.法人股東之主要股東

114年9月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
基丞科技(股)公司	江少杰 33.46%、李欽全 6.25%、江明奇 5.65%、江明源 5.65%、常菁菁 4.55%、曾坤燦 3.52%、葉卉妍 2.94%、陳仕舫 2.73%、陳傳男 2.73%、宋俊毅 2.70%

3.法人股東之主要股東為法人者，其主要股東：無

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	
宋俊毅		董事專業資格與經驗請參閱本公開說明書「(四)1.董事及獨立董事」(第15頁) 所有董事皆未有公司法第30條各款情事(註1)	不適用	-	
基丞科技(股)公司 代表人:江少杰				-	
曾坤燦				-	
許嘉元				-	
顏盟峯				所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒定之證券交易法第十四條之二暨公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註2)相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。	1
何志文				-	
黃蕙玲				-	

註1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

- 1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 2.曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
- 4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
- 6.無行為能力或限制行為能力者。
- 7.受輔助宣告尚未撤銷。

註2：1.非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1)公司或其關係企業之受僱人。
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。
- (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

依本公司「公司治理實務守則」第23條之規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- B.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，亦考量董事候選人誠信正直之聲譽，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力。

本公司董事會由7席董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，獨立董事占比42.86%；現有董事會成員皆產業界之賢達，具備製造、技術研究、財務與金融、化學工程及管理等多元互補之產業經驗。本公司向來關注董事會成員性別平等，目前7位董事中含有女性董事1名，女性董事比率14.29%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員落實多元化情形如下：

姓名	基本組成						具備之能力							
	國籍	性別	具員工身分	年齡			營運判斷力	分析能力及財務力	危機處理能力	經營管理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				40-50	51-60	61-70								
宋俊毅	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
基丞科技(股)公司 代表人:江少杰	中華民國	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾坤燦	中華民國	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
許嘉元	中華民國	男	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顏盟峯	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化核心 姓名	基本組成						具備之能力								
	國 籍	性 別	具 員 工 身 分	年 齡			營 運 判 斷 力	分 析 能 力	會 計 及 財 務 力	危 機 處 理 能 力	經 營 管 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
				40-50	51-60	61-70									
何志文	中 華 民 國	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃蕙玲	中 華 民 國	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2)管理目標及達成情形

本公司現任董事會由7位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管 理 目 標	達 成 情 形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事任期未逾3屆	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(3)董事會獨立性

本公司設有獨立董事三名，占董事會成員比重42.86%，每位獨立董事均具超然獨立身份，其且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定及第4項規定情事，全體董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱本公開說明書「壹、三、(四)之1董事及獨立董事資料及4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

(五)發起人：不適用。

(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度(113 年度)支付董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益 之比例(%)	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)		本公司	財務報告內 所有公司	薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞 (G)						本公司	財務報告內 所有公司
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司			本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額				
董事長	宋俊毅	5,058	5,058	—	—	440	440	—	—	5,498 6.32%	5,498 6.32%	—	—	—	—	—	—	—	—	5,498 6.32%	5,498 6.32%		
董事	基丞科 技(股) 公司 代表人: 江少杰	20	20	—	—	380	380	—	—	400 0.46%	400 0.46%	—	—	—	—	—	—	—	—	400 0.46%	400 0.46%		
董事	曾坤燦	18	18	—	—	380	380	—	—	398 0.46%	398 0.46%	—	—	—	—	—	—	—	—	398 0.46%	398 0.46%		
董事	許嘉元	15	15	—	—	572	572	—	—	587 0.68%	587 0.68%	5,504	5,504	108	108	950	—	950	—	7,149 8.22%	7,149 8.22%		
獨立 董事	顏盟峯	463	463	—	—	—	—	—	—	463 0.53%	463 0.53%	—	—	—	—	—	—	—	—	463 0.53%	463 0.53%		
獨立 董事	何志文	466	466	—	—	—	—	—	—	466 0.54%	466 0.54%	—	—	—	—	—	—	—	—	466 0.54%	466 0.54%		
獨立 董事	黃蕙玲	466	466	—	—	—	—	—	—	466 0.54%	466 0.54%	—	—	—	—	—	—	—	—	466 0.54%	466 0.54%		

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：不適用。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於 1,000,000 元	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、許嘉元、顏盟峯、何志文、黃蕙玲	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、許嘉元、顏盟峯、何志文、黃蕙玲	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、何志文、黃蕙玲	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、何志文、黃蕙玲
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	宋俊毅	宋俊毅	宋俊毅、許嘉元	宋俊毅、許嘉元
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

2.最近年度(113 年度)支付監察人之酬金：本公司已於民國 113 年 1 月 26 日成立審計委員會取代監察人職務。

3.最近年度(113 年度)支付總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	許嘉元	2,645	2,645	108	108	2,859	2,859	950	-	950	-	6,562 7.54%	6,562 7.54%	-

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	許嘉元	許嘉元
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	1 人	1 人

4.最近年度(113 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	許嘉元	-	2,793	2,793	3.21%
	生產部 部經理	符永豪				
	行銷部 部經理	邱冠陸				
	財會部 經理	蔡郁仁				

註：係按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

5.上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

(七)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣千元

年度 項目	112 年度				113 年度			
	酬金總額		總額占稅後純益 比例(%)		酬金總額		總額占稅後純益 比例(%)	
	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司
董事	4,026	4,026	3.02	3.02	8,278	8,278	9.52	9.52
監察人	300	300	0.23	0.23	-	-	-	-
執行長(註)及 總經理	11,420	11,420	8.57	8.57	6,562	6,562	7.55	7.55

註：宋俊毅 112/10/31 辭任執行長一職，專任董事長。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事及監察人：

本公司董事執行本公司職務時，其報酬係依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，由董事會參酌業界之水準議定之。酬金部分，如公司年度決算有獲利時，

依公司章程第二十五條規定，應提撥不高於百分之六為董事及監察人酬勞，惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。但公司尚有累積虧損時，應預先彌補虧損之數額後再行提撥，並經薪資報酬委員會審核及董事會通過後，提股東會報告。

(2)總經理：

包含薪資、獎金及員工酬勞，薪資水準係依對公司所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定，經提交薪酬委員會通過後，提請董事會決議；員工酬勞之分派標準係遵循公司章程，經提交薪酬委員會通過後，提請董事會決議並提報股東常會後發放。

訂定酬金之程序，除參考公司整體之營運績效，亦參考個人績效達成率及對公司績效之貢獻度，而給予合理的報酬。除上述外，本公司將未來營運風險之可能性降至最低，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求本公司永續經營與風險控管之平衡。綜上所述，本公司支付董事及總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

(八)發行公司之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形，另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任

本公司截至公開說明書刊印日止，並無實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務之非董事，故不適用。

(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷

姓名	部門及職稱	最高學歷	工作經驗	產業年資
許嘉元	總經理室 總經理	成功大學 化學工程學系 研究所博士	本公司總經理	25年
梁國超	研發部 資深經理	成功大學 化學工程學系研究 所博士	核能研究所副研 員	25年
符永豪	生產部 部經理	成功大學 資源工程所 碩士	鈦昇科技(股)公 司 研發工程師	25年

四、資本及股份

(一)股份種類

114年8月1日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	34,631,731	25,368,269	60,000,000	非上市(櫃)股票

(二)股本形成經過

1.最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

單位：新台幣千元；千股

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
111.10	10	28,000	280,000	26,256	262,558	盈餘轉增資34,247千元	無	註1
112.11	19	60,000	600,000	28,860	288,598	員工認股權轉換26,040千元	無	註2
114.08	10	60,000	600,000	34,632	346,318	盈餘轉增資57,720千元	無	註3

註1：111.10.05 府經工商字第 11100203850 號核准。

註2：112.11.08 府經商字第 11200316000 號核准。

註3：114.08.14 府經商字第 11400454350 號核准。

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

3.公司採總括申報方式發行新股：不適用。

(三)最近股權分散情形

1.股東結構

114年8月1日；單位：人；股

股東結構 數量	政 機	府 構	金 機	融 構	其他法人	個 人	外國機構 及外人	合 計
人 數	-	-	-	-	11	364	2	377
持有股數	-	-	-	-	9,423,192	24,907,339	301,200	34,631,731
持股比例%	-	-	-	-	27.21	71.92	0.87	100.00

2. 股權分散情形

114年8月1日；單位：人；股

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例%
1 至 999	91	10,037	0.03%
1,000 至 5,000	143	283,813	0.82%
5,001 至 10,000	33	232,862	0.67%
10,001 至 15,000	18	222,988	0.64%
15,001 至 20,000	6	102,901	0.30%
20,001 至 30,000	18	435,371	1.26%
30,001 至 40,000	7	240,500	0.69%
40,001 至 50,000	9	404,751	1.17%
50,001 至 100,000	12	863,573	2.49%
100,001 至 200,000	13	1,941,490	5.61%
200,001 至 400,000	12	3,593,712	10.38%
400,001 至 600,000	3	1,486,361	4.29%
600,001 至 800,000	0	0	0.00%
800,001 至 1,000,000	1	909,213	2.63%
1,000,001 以上	11	23,904,159	69.02%
合 計	377	34,631,731	100.00%

3. 主要股東名單(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

114年8月1日；單位：股

主要股東名稱	股份	持 有 股 數	持 股 比 例 %
基丞科技股份有限公司		5,235,307	15.12
宋俊毅		3,859,197	11.14
矽格聯測股份有限公司		3,021,708	8.73
曾坤燦		2,519,082	7.27
蔡秉儒		1,704,508	4.92
許嘉元		1,495,980	4.32
邱冠陸		1,320,000	3.81
宋晟豪		1,267,908	3.66
宋竑億		1,229,136	3.55
方淑卿		1,185,697	3.42

4. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形，所放棄之現金增資股洽關係人認購者，尚應揭露該關係人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數

本公司最近二年度及當年度未有辦理現金增資之情事，故無此情形。

5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	112 年度		113 年度		114 年截至 公開說明書刊印日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨 5%股東	宋俊毅	1,780,000	-	(146,000)	-	643,224	-
董事暨 5%股東	基丞科技 (股)公司	-	-	(255,000)	-	872,551	-
	代表人:江少杰	-	-	-	-	-	-
董事暨 5%股東	曾坤燦	400,000	-	(123,000)	-	419,847	-
董事	蔡秉儒	800,000	-	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
董事暨 總經理	許嘉元	230,000	-	(73,000)	-	249,330	-
監察人	李永然	-	-	(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)
監察人	李欽全	-	-	-	-	(註 3)	(註 3)
監察人	陳文魁	-	-	-	-	(註 3)	(註 3)
獨立董事	顏盟峯	(註 4)	(註 4)	-	-	-	-
獨立董事	黃蕙玲	(註 4)	(註 4)	-	-	-	-
獨立董事	何志文	(註 4)	(註 4)	-	-	-	-
生產部 部經理	符永豪	250,000	-	-	-	50,000	-
行銷部 部經理	邱冠陸	320,000	-	(75,000)	-	194,512	-
財會部 經理	蔡郁仁	100,000	-	1,200	-	24,920	-
研發部 經理	梁國超	250,000	-	(10,000)	-	48,008	-
超過 5% 之 股 東	矽格聯測(股) 公司	-	-	(146,000)	-	503,618	-
超過 5% 之 股 東	日立先端科技 (股)公司(註 5)	(3,595,308)	-	-	-	-	-

註1：該董事於112.12.11日辭任，故112年僅揭露其任職期間股數增減數。

註2：112.05.30全面改選後解任，故其股數增(減)統計至辭任日止。

註3：112.05.30全面改選後新任，任期至113.1.26股臨會增選獨立董事後解任，其股數增減僅

計算監察人任期。

註4：該等獨立董事於113.01.26就任，故其股數增(減)統計自就任起計算。

註5：112.09.22起非本公司超過百分之五以上之股東。

- (2)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊

單位：股；新台幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
曾坤燦	處分	112.02.13	曾柏嘉	本公司董事之子女	150,000	25
曾坤燦	處分	112.02.16	曾韻芬	本公司董事之子女	150,000	25
日立先端科技(股)公司	處分	112.09.22	宋俊毅	本公司董事長	1,600,000	21.63
	處分	112.09.22	許嘉元	本公司董事、經理人	70,000	21.63
	處分	112.09.22	曾坤燦	本公司董事	700,000	21.63
	處分	112.09.22	蔡秉儒	本公司董事	800,000	21.63
	處分	112.09.22	陳淑幸	本公司董事長之配偶	305,308	21.63
	處分	112.09.22	邱冠陸	本公司經理人	70,000	21.63
	處分	112.09.22	梁國超	本公司研發主管	50,000	21.63
許嘉元	贈與	112.11.16	許馨云	本公司董事之子女	90,000	-

- (3)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

6. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年8月1日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
基丞科技(股)公司 代表人:江少杰	5,235,307	15.12	-	-	-	-	-	-	-
宋俊毅	3,859,197	11.14	368,769	1.06	-	-	宋晟豪 宋竑億	一親等 一親等	-
矽格聯測(股)公司 代表人:黃興陽	3,021,708	8.73	-	-	-	-	-	-	-
曾坤燦	2,519,082	7.27	-	-	-	-	-	-	-
蔡秉儒	1,704,508	4.92	-	-	-	-	-	-	-
許嘉元	1,495,980	4.32	27,600	0.08	-	-	-	-	-
邱冠陸	1,320,000	3.81	-	-	-	-	-	-	-
宋晟豪	1,267,908	3.66	-	-	-	-	宋俊毅 宋竑億	一親等 二親等	-
宋竑億	1,229,136	3.55	-	-	-	-	宋俊毅 宋晟豪	一親等 二親等	-
方淑卿	1,185,697	3.42	300,000	0.87	-	-	-	-	-

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項目		年度	112 年度 (註 1)	113 年度 (註 1)	114 年截至 6 月 30 日止(註 1)
每股市價	最高		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	最低		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	平均		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		24.83	25.85	25.36
	分配後		22.83	20.71	尚未分配
每股盈餘 (註 2)	加權平均股數(千股)		26,641	34,632	34,632
	追溯調整前		5.00	3.01	0.44
	追溯調整後		5.00	2.51	-
每股股利	現金股利		2.00	1.00	-
	無償配股	盈餘配股	-	2.00	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	本利比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	現金股利殖利率		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)

註 1：上列財務資料業經會計師查核簽證或核閱。

註 2：業依盈餘轉增資比例追溯調整流通在外股數。

(五)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所定之股利政策

本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案。本項盈餘分派以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

2.本年度擬(已)議股利分派之情形

本公司113年度盈餘分配案，業經114年3月19日董事會及114年6月18日股東常會決議通過，每股配發股票股利2元及現金股利1元，自113年度可分配盈餘中提撥57,719,550元轉增資發行普通股及現金股利28,859,776元。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司114年3月19日董事會決議通過113年度盈餘分配案並於114年6月18日股東常會報告，配發股票股利5,772千股，由於採配發新股方式，將減少現金支出，保留營運資金，對本公司營業績效有正面之助益，且本公司未來營收及獲利穩定成長，本年度無償配股對每股盈餘之稀釋效果有限。

(七)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事酬勞與員工酬勞：(一)董事酬勞：不高於百分之六；惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。(二)員工酬勞：百分之二~十，前述員工酬勞總額中不低於百分之四十五應提撥為分派予基層員工之酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。董事酬勞及員工酬勞分派案應由董事會決議，並提股東會報告。

前項員工酬勞之發放得由董事會決議得以現金或股票為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司估列員工及董事酬勞係以當年度之獲利情況，依章程所訂之成數範圍估列，嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形

本公司113年度擬依公司法及公司章程規定分派員工酬勞9,782千元、董事酬勞1,772千元，均以現金方式發放，業已經114年3月19日董事會決議通過，並與113年度認列費用金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果

本公司於114年6月18日股東常會報告113年度員工及董事酬勞分派案，以現金分派員工酬勞新台幣9,782千元及董事酬勞新台幣1,772千元，與本公司113年度財報認列之員工及董事酬勞費用並無差異。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司112年度員工酬勞及董監酬勞業經113年3月27日董事會通過及113年6月28日股東常會報告，已於113年12月31日前發放112年度員工酬勞新台幣12,606千元及董監酬勞新台幣3,486千元完畢，與估列數並無差異。

(八) 公司買回本公司股份情形：無。

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證截至公開說明書刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無，已於112年度執行完成。

(二)累積至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114年9月30日；單位：千股；新台幣千元；%

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行			未執行				
					認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	執行長	宋俊毅 (註1)	1,030	3.57	1,030	19	19,570	3.57	-	-	-	-
	總經理	許嘉元										
	生產部部經理	符永豪										
	行銷部部經理	邱冠陸										
	財會部經理	蔡郁仁										
員工	資深經理	梁國超	920	3.19	920	19	17,480	3.19	-	-	-	-
	資深經理	呂肇原										
	經理	張世坤										
	經理	阮敬倫										
	經理	劉一儒										
	副理	陳威翔										
	副理	蔡宗益										
	副理	馬燕惠										
	副理	曾雅綉										
工程師	吳濟宇											

註1：112/10/31 辭任執行長一職，專任董事長。

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

貳、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司致力於提供半導體產業、ABF載板、印刷電路板(以下簡稱PCB)產業與新能源與環保應用各式製程間，所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質之解決方案與電漿設備等研發、生產及銷售。

(2)主要業務之營業比重

單位：新台幣千元；%

產品別	年度	112 年度		113 年度		114 年第二季	
		金額	%	金額	%	金額	%
機 台 銷 售		702,093	92.13	493,569	90.13	220,255	86.15
維 修 收 入		59,946	7.87	54,061	9.87	35,184	13.76
其 他		-	-	-	-	216	0.09
合 計		762,039	100.00	547,630	100.00	255,655	100.00

(3)公司目前之商品(服務)項目

產業	產品項目
半導體	電漿極化機、電漿清洗機、電漿去膠渣機、電漿蝕刻機
ABF 載板	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿鑽孔機
PCB	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿去膠渣機
新能源與環保應用	高效電漿火焰處理設備、電漿廢氣處理設備、全氟化物電漿分解處理機、電漿廢水處理設備、電漿高溫減廢設備

(4)計畫開發之新商品(服務)

產業	產品項目
半導體	晶圓再生電漿處理機、電漿晶圓薄化機、電漿晶圓切割機
ABF 載板	全乾法電漿蝕刻機
PCB	微細線路用非等向性蝕刻電漿方案
新能源與環保應用	電漿脫碳產氫系統、工業型電漿污染防制設備

2. 產業概況

(1) 產業之現況與發展

本公司成立於2002年，以開發先進電漿(Plasma)技術及製作各式電漿設備為營運主軸。電漿又稱做等離子體，是在固態、液態和氣態以外的第四大物質狀態。當氣體在高溫或強電磁場下，將促使氣體內的電子與中性原子互相撞擊，如此反覆撞擊並達到崩潰效應後，即形成由離子、電子與中性的原子或分子所組成的狀態，即為電漿。電漿具有高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，使得電漿在科學及工業技術中應用廣泛，包括半導體製程(蝕刻、清洗及表面改質等)、能源環保(核融合、廢氣廢水處理、創造乾淨新能源等)、醫療生技(醫材改質、消毒等)及日常消費性產品(如鞋業、高爾夫球、車用製品、紡織等)等各項領域。

本公司專注將電漿技術開發，憑藉優越的電漿製程及設備開發能力，專注於發展高效能的工業級表面處理解決方案，其產品應用於半導體產業，並聚焦於先進封裝領域，另亦專注於IC載板及印刷電路板(以下簡稱PCB)產業之應用，其他應用領域則有平面顯示器與LED等光電產業、新能源與環保產業、非電子業及民生工業等，並以各式製程間所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質為主。電漿清洗/蝕刻是一種經過驗證、有效、經濟且環保的關鍵表面處理方法，與傳統的濕式清潔方法相比，使用電漿進行離子清洗可藉由高溫或強電磁場使物質解離，釋放出離子和自由基，破壞樣品表面上有機污染物或無機物之鍵結，此時腔體中所通入的反應氣體離化產生正負離子、自由基等粒子，這些粒子會與有機污染物或無機物的鍵結結合，形成氣態之化合物如CO₂和H₂O，再藉由幫浦抽離腔體。電漿清洗優點在於不會造成環境污染，經電漿清洗，表面回歸未受污染狀態，可在無有害廢料情況下進行黏合或進一步製程。電漿蝕刻是製作半導體元件經常需要用到的技術，讓物件的表面用反應氣體來進行蝕刻，清除表面污染。表面的材料被蝕刻後，轉化為氣體並由真空系統去除，表面積增加可提高表面性能。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，半導體晶圓加工製程已由微米尺度微縮為奈米尺度之精準度，相關製程技術之規格亦愈來愈高。在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢，除於半導體製程不斷精進與突破之外，在ESG潮流趨勢下，乾式電漿蝕刻無污染之優勢，使其在其他新興產業之應用亦越趨廣泛。而電漿表面改質技術，則能於材料表面形成特定官能基，來達到黏合或接著度的需求。材料經電漿處理後，能於分子結構中，產生自由基，有助於改善材料表面之其他材料相容性。

茲就本公司所屬產業之現況與發展分析如下：

A. 半導體產業及設備

a. 半導體產業

半導體產業為現代科技與經濟發展的核心趨動力，並廣泛應用於消費電子、通訊、汽車、工業設備及人工智慧(AI)等領域，其發展趨勢受多重因素影響，包括技

術創新、材料科學、政策變遷、商業模式演變及終端用戶需求等。半導體產業需要鉅額資金投入研發和製造，同時依賴高度專業的技術知識，具有相當高的進入門檻。產業鏈包括上游的IC設計公司專注於高效能半導體晶片的研發設計，國際代表性公司如英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)及超微(AMD)等；中游的晶圓製造與代工公司負責通過先進的製造技術將設計圖轉換為實際的晶片，國際代表性公司如台積電(TSMC)及三星(Samsung)；下游的IC封裝測試公司如日月光(ASE)負責將晶片進行封裝，確保其在使用過程中的穩定性和耐用性，並進行測試以確認每個晶片的功能和性能均符合標準。半導體設備產業則是在半導體製造及封裝過程中所需的各種設備和工具的總稱，包括製程設備(如光刻機、蝕刻機、去膠機等)和測試設備(如測試儀器、封裝測試等)，近年成長主要受到新興技術驅動，包括人工智慧(AI)、5G、物聯網(IoT)和自動駕駛技術等，以及更先進半導體製程節點所對應之高精密度製造技術的需求，催生了對於更高效能、更低功耗的半導體器件的需求，進而推動半導體設備的需求。

2023年全球半導體產業進入景氣下行與調整期，隨著全球經濟放緩，終端市場需求顯著減弱，再加上供應鏈中的庫存過高，半導體市場呈現明顯衰退跡象，然而2024年隨著人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的蓬勃發展，NVIDIA、超微等AI伺服器用GPU需求仍強，而客製化的AI運算晶片以及支援AI運算的網通晶片也將成為高成長的產品；伴隨全球半導體景氣逐漸回溫，化合物半導體取其材料特性，在通訊、功率、車用、儲能等應用領域具備相當發展潛力。

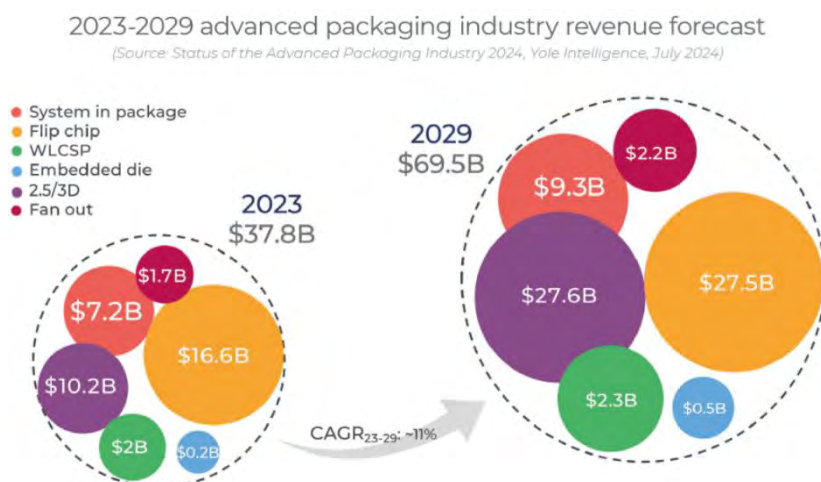
市場研究公司國際數據公司(IDC)2024年12月最新發布的《全球半導體供應鏈追蹤情報》報告顯示全球對AI和高效能運算(HPC)的需求將繼續上升，2025年全球半導體市場預估將增長超過15%，記憶體領域可望成長超過24%，主要動能來自AI加速器(AI Accelerator)需要搭配的HBM3、HBM3e等高階產品滲透率持續提升，以及新一代HBM4預計於2025年下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如AI伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。這意味著儘管整體半導體產業將持續擴展，但其增長重點將集中在高附加價值的技術領域，特別是記憶體和邏輯產品在未來的發展中將扮演更為關鍵的角色。全球半導體市場正逐步向先進技術轉型，未來幾年將進一步鞏固其在全球科技產業中的核心地位。

b. 先進封裝產業

先進封裝(Advanced Packaging)是將多個半導體晶片或器件整合到單一封裝中，與傳統封裝技術僅封裝單一晶片有所區別，並藉此提高系統性能、縮小體積、降低功耗、提升整合度。先進封裝技術可以透過在三個維度中排列多個晶片，並在晶片之間與過渡的積體電路中直接建立連接，以消除摩爾定律之製造瓶頸並降低成本，因此先進封裝技術在半導體產業中扮演著越來越重要的角色，尤其在需要高密度、高性能、高整合度的應用領域，如AI、高性能運算、高效能通信等。根據Yole

Group預估，2023年先進封裝市場規模為378億美元，占整體IC封裝市場的44%，但成長速度明顯放緩，預計至2029年達到695億美元，複合年增長率為11%(詳見圖一)。

圖一：2023-2029年先進封裝產值及年增率預估



資料來源：Yole Group，2024年7月

先進封裝市場參與者包括晶圓代工暨IDM廠，以及專業封裝測試（OSAT）廠商。台積電、英特爾、三星等領先晶圓廠投入巨資研發先進封裝技術（如台積電的CoWoS、英特爾Foveros等），大幅擴充先進封裝產能以承接HPC/AI訂單。同時，全球封裝代工產能主要集中於少數OSAT龍頭：日月光投控（ASE）為全球最大封測服務供應商，艾克爾（Amkor）與矽品（SPIL）分列第二、三位，前三大廠合計市占率約40%。這些龍頭廠商憑藉晶圓級封裝（WLP）、覆晶封裝（Flip-Chip）等先進製程的佈局，營收增速持續領先業界平均。展望未來，各大廠無不將先進封裝視為兵家必爭之地，積極擴產佈局以保持技術與產能領先

2023年，全球先進封裝市場面臨挑戰，主要是受到消費性電子需求減弱的影響，包括智慧型手機、個人電腦與伺服器領域。根據TechInsights的分析，2023年先進封裝市場收入下滑了16.3%，為近年來最大跌幅之一。歷經2023年庫存調整，隨著終端市場復甦，以及AI裝置與資料中心對高性能與高輸出能力的需求增加，2024年先進封裝市場規模成長3.7%。展望2025年，由於來自AI裝置與資料中心對高性能封裝解決方案的需求增加，TechInsights預測先進封裝市場將增長19.2%。Yole Group亦預估，2025年先進封裝市場規模將達到約475億美元，持續擴大在整體封裝市場的占比並達到51.03%。

本公司聚焦於先進封裝所需的電漿乾式製程設備，並應用於Hybrid Bonding、FOPLP等先進封裝製程。根據Yole Group報告顯示(詳見圖一)，由於AI、HPC、資料中心、感測器和行動裝置等領域需求提升，2.5D/3D封裝技術(Hybrid Bonding之應用)的市場規模預計從2023年的102億美元增至2029年的276億美元。此外，扇外型封裝（Fan-Out）技術的市場規模也將從2023年17億美元增至2029年22億美元。顯示本公司產品之應用具有極大潛力。

c. 半導體設備

根據國際半導體產業協會(SEMI)公布之全球晶圓廠預測報告指出，2024年全球半導體製造設備銷售額達1171億美元，成長10.2%(詳見圖二)，主要是受惠先進製程、成熟製程、先進封裝和高頻寬記憶體(HBM)擴產，以及中國大幅增加投資，2024年前段半導體設備市場顯著成長，晶圓製程設備銷售額增長9%，其他前段設備成長5%。後段設備部分，在人工智慧和HBM製造日趨複雜，以及需求不斷增加推升下，2024年後段設備銷售額強勁成長，封裝設備增長25%，測試設備增長20%。從地區來看，中國、韓國和台灣仍是半導體設備支出前三大市場，合計占全球市場達74%。中國產能積極擴張，加上政府強化晶片國內生產的各式計畫齊發，投資額達496億美元，較去年同比增長35%，穩居半導體設備市場領先地位；第二大市場韓國的設備支出則因記憶體市場趨於穩定以及高頻寬記憶體需求飆升，小幅成長3%，來到205億美元。相較之下，台灣設備銷售額受到新產能需求放緩影響，由2023年之196億美元下滑16%至2024年之166億美元(詳見表一)。

圖二：全球半導體設備市場



表一：各地區半導體設備市場規模比較

單位：十億美元

Region	2024	2023	(YoY) %
China	\$49.55	\$36.60	35%
Korea	\$20.47	\$19.94	3%
Taiwan	\$16.56	\$19.62	-16%
North America	\$13.69	\$12.05	14%
Japan	\$7.83	\$7.93	-1%
Europe	\$4.85	\$6.46	-25%
Rest of the World	\$4.19	\$3.65	15%
Total	\$117.14	\$106.25	10%

資料來源：SEMI 及 SEAJ；2025年4月

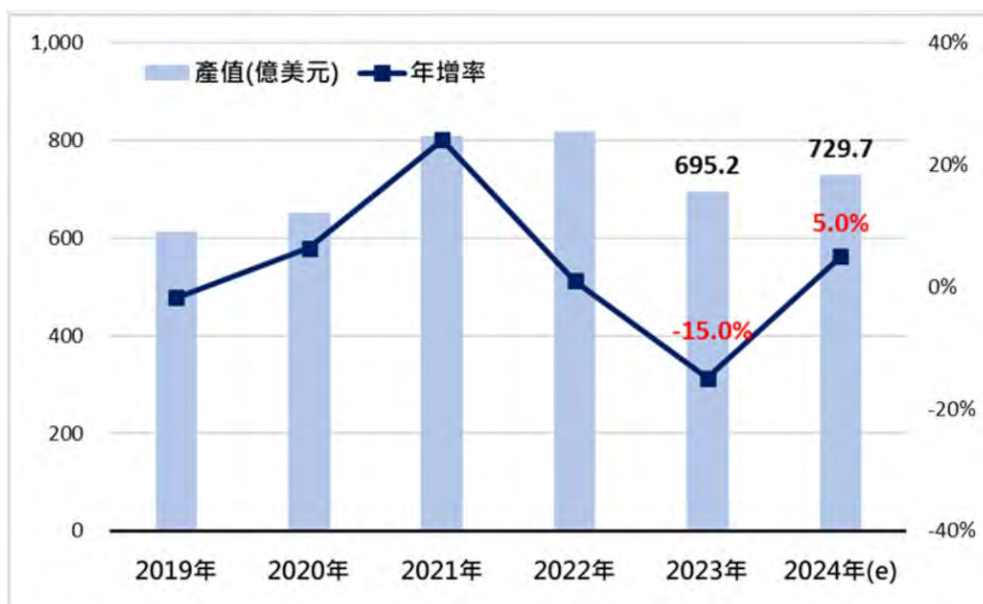
展望2025年，SEMI預估晶圓廠設備支出將達1,250億美元，成長6.7%，主要是因邏輯微元件（Logic & Micro）類別在2奈米製程和晶背供電技術（Backside Power Delivery Technology）等先進技術投資推波助瀾下，成為晶圓廠投資成長的關鍵驅動力。從地區來看，中國仍穩居全球半導體設備支出龍頭，然2025年總值為380億美元，較2024年總值500億美元下降24%，台灣則為了滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求，晶片廠持續加強先進技術及先進製程推進，2025年晶圓廠設備支出預估將達210億美元，較2024年總值166億美元成長26.51%。

B.PCB 產業及設備

a.PCB 產業

2022年下半年以來，全球終端電子產品市場需求轉趨下滑，促使印刷電路板等電子零組件廠商開始進入庫存調整階段。2023年面對終端消費意願疲弱，衝擊智慧手機、個人電腦等應用領域需求，IC載板市場供需轉而呈現供過於求，車用板價格競爭加劇，故2023年全球PCB產業產值為695.2億美元，降至疫情前的水準，並較2022年衰退15.0%(詳見圖三)。就2023年各項PCB產品產值表現觀之，IC載板因ABF載板市場供需出現明顯反轉，產值年減幅度近三成，表現最為弱勢，軟板、硬板因智慧手機、個人電腦應用需求下滑、車用板價格競爭加劇，產值年減幅度相對較大；HDI板雖受手機應用需求走弱，產值呈現衰退，但因車用需求相對具有支撐，AI伺服器應用漸趨浮現，產值衰退幅度相對緩和。

圖三：全球 PCB 產業產值及年增率走勢



資料來源：Prismark、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2024年8月

2024年有鑑於消費應用回補庫存需求漸趨浮現，且汽車電子、AI伺服器、AI PC及低軌衛星等新興應用需求轉趨增溫，帶動2024年全球PCB產業產值止跌回升，根據國際研究機構Prismark的估計，2024年全球PCB產業產值緩步回升至729.7億美

元，較2023年成長5%(詳見圖三)；其中HDI板、多層板因車用、AI應用及衛星應用需求增溫，估計2024年產值成長力道相對強勁；軟板及IC載板因手機復甦力道相對有限、市場供需仍未能回到平衡狀態，產值僅能呈現微幅反彈。

展望2025年，受惠於全球電動車市場規模持續成長、生成式AI應用風潮席捲全球，導入範圍逐步由伺服器、交換器等資料中心基礎設施設備逐步延伸至AI手機、AIPC等消費性終端裝置，加上網通設備應用需求漸趨回溫、美系廠商持續投入低軌衛星的部署下，有望推升2025年全球PCB產業需求明顯增溫。Prismark估計2025年全球PCB產值預估年增6.2%，其中HDI與IC載板的年複合成長率將達7.6%，顯示產品需求持續增長。產業趨勢方面，Intel與AMD將推出新一代平台—Birch Stream與Turin，預計於2025年上半年進入小量生產，下半年實現量產。屆時，CCL等級將升級至M7，板層數進一步提升至20層以上，帶來PCB產業的全面換代升級，將不僅滿足新一代伺服器的高效能需求，亦將顯著提升相關供應鏈廠商的產品價值與市場競爭力。

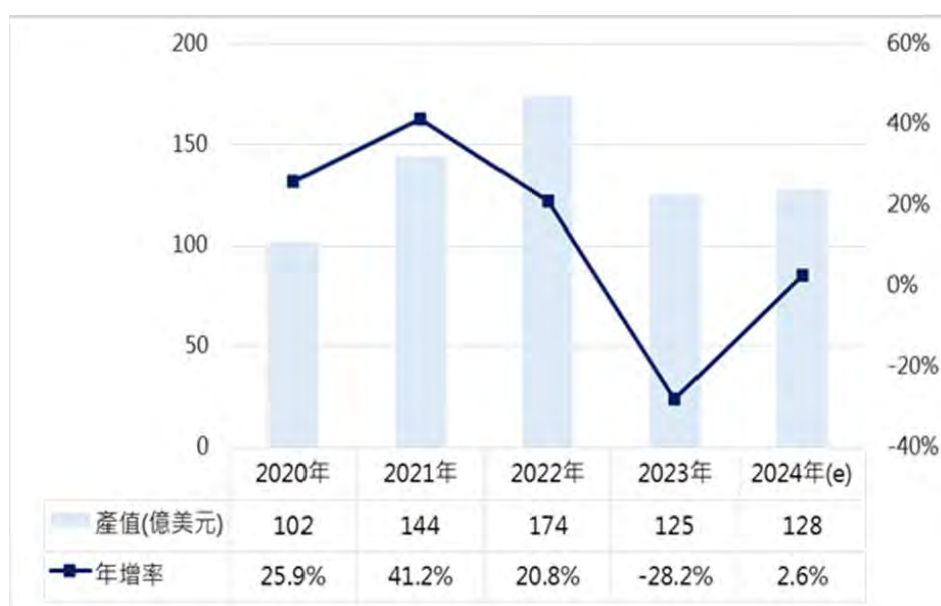
就我國PCB業在台灣境內生產之各細項產品銷售值變化趨勢分析，我國PCB製造業主要可區分為上游的銅箔基板，中游的印刷電路板、IC載板，以及下游的印刷電路板加工，其中印刷電路板可進一步區分為多層板、軟板、高密度互連板(HDI)等產品，主要應用產品包括智慧型手機、筆記型電腦、汽車、穿戴式裝置、伺服器等产品，其中HDI受到ADAS自駕系統與高速傳輸HPC需求帶動占比漸增，而IC載板則應用於CPU、GPU、記憶體、MCU等，主要可作為半導體封裝測試的上游零件組件，故我國PCB業銷售值比重主要以印刷電路板及IC載板占最大宗，根據台灣經濟研究院產經資料庫資料顯示，2024前三季分別達53.48%及29.28%，囊括八成以上的銷售市場。

綜觀IC載板的產品與應用，目前材質以ABF、BT為大宗，BT主要用在記憶體、手機等，ABF則是應用在客製化IC(ASIC)、顯示卡(GPU)、中央處理器(CPU)、大型高端晶片等。觀察全球IC載板製造業，由於HPC、5G、AI、資料中心使ABF載板需求激增，IC載板產業於2021~2022年進行大規模擴產與設備投資，然受到通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致PC、智慧手機等消費性應用需求自2022年下半年起明顯走弱，終端客戶進行嚴格的庫存修正，加上台廠新產能陸續開出，使得IC載板市場供需出現反轉，轉而呈現供過於求的態勢，而各國央行持續升息、全球經濟景氣成長力道放緩，科技大廠陸續進行裁員，導致企業下修資本支出，促使伺服器、網通設備等需求下修，更進一步衝擊IC載板市場需求。2024年受惠於生成式AI風潮席捲全球，主要雲端服務大廠積極導入AI伺服器，帶動AI伺服器及高頻寬記憶體(HBM)出貨漸趨放量，推升高階載板需求增溫，加上終端庫存去化告一段落，回補庫存需求浮現，加上品牌大廠競相推出AI手機有效刺激市場需求復甦，BT載板出貨表現呈現止跌回升，推升2024年全球IC載板產值止跌回穩。根據Prismark的估計，2024年全球IC載板產值緩步回升至128億美元，較2023年微幅成長2.6%(詳見圖四)，漸趨走出2023年大幅衰退的陰霾。ABF載板部分，2024年受到歐美電信商5G投資高峰已過，資本支出多聚焦於資料中心相關應用，電信設備投

資相對審慎，在庫存難以去化之下，網通應用需求明顯下滑，加上AIPC效應並未明顯發酵，PC應用需求仍顯疲弱，以致ABF載板市場仍持續面臨供過於求的挑戰，進而使得全球IC載板產值雖重回成長軌道，但復甦力道相對有限。

然有鑑於生成式AI風潮席捲全球，GPU效能不斷提升，引領AI伺服器逐步崛起，且AI應用逐步由伺服器延伸至高階交換器、AIPC、AI手機等。為滿足高階運算需求，驅使小晶片(Chiplet)、先進封裝需求隨之攀高，使得高階ABF載板面積放大至120mmx140mm，層數提升至28層以上，朝向大面積、多層數、細線路方向發展，顯見ABF載板生產難度明顯提高，在半導體先進製程中扮演的角色更顯重要，因而吸引Ibiden、SEMCO、臻鼎、欣興、南電等國內外IC載板廠商積極搶進，爭取高階ABF載板市場商機。展望2025年，受惠於各國積極鼓勵AI資料中心的建置，帶動Nvidia旗下GPU出貨持續增溫，加上AWS、Microsoft、Meta及Google等美系雲端服務大廠持續投入自研ASIC的開發，資料中心加速導入800G交換器，均有助於推升高階ABF載板需求的持續增溫。

圖四：全球 IC 載板產值及年增率走勢



資料來源：Prismark(2024.09)、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2025年1月

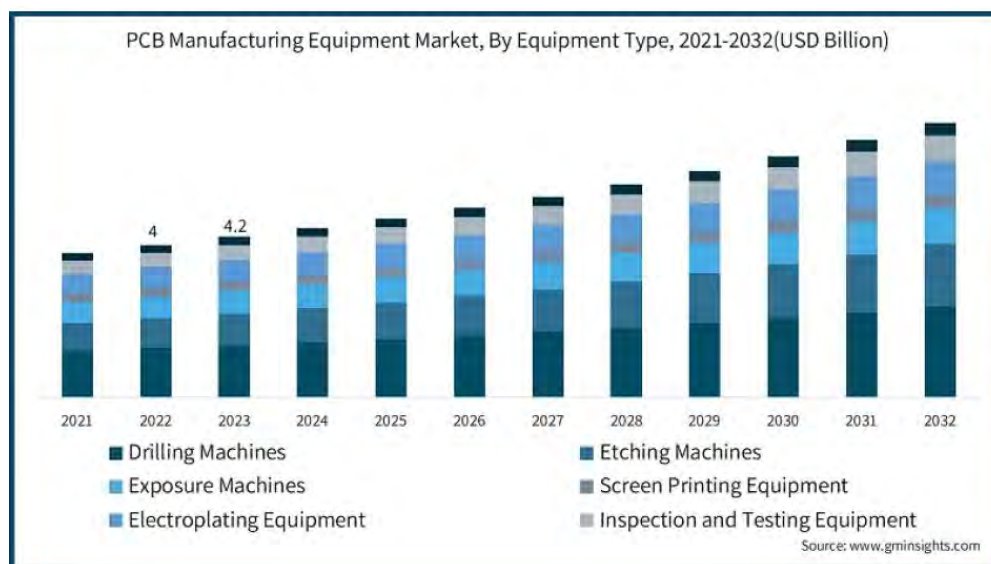
b.PCB 設備

隨著電子產品日益輕薄短小與功能複雜化，PCB產業持續升級轉型，帶動PCB設備市場穩定成長。根據Global Market Insights資料顯示，全球PCB設備市場規模在2024年達42億美元，預計在2024至2032年複合增長率為6.2%。成長動能主要來自5G通訊、高效運算(HPC)、電動車(EV)及先進封裝等新興應用領域。

PCB設備依製程階段可大致分為鑽孔機、蝕刻機、曝光機、電鍍與化學處理設備、AOI光學檢測系統、自動化搬運設備(如上下板機、輸送帶)等。近年來，以雷射鑽孔機、蝕刻機及LDI(Laser Direct Imaging)曝光機為代表的高階設備需求快速上升(詳見圖五)，特別是在HDI、載板(IC Substrate)、類載板(SLP)等製程

中扮演關鍵角色。其中蝕刻機為PCB製造過程中關鍵的核心設備之一，無論是傳統多層板製程或先進IC載板製程，皆高度依賴濕式與乾式蝕刻設備來精準移除導體層，形成精細電路圖形。隨著線寬微縮與高密度需求提升，蝕刻設備的自動化、均勻性控制與化學品管理能力成為投資重點。蝕刻設備廠商持續投入模組化蝕刻線與智慧製造技術，提升良率與產能效率，未來占比預期仍將維持高位。

圖五：各類PCB製造設備市場規模



資料來源：Global Market Insights，2024 年 11 月。

未來，隨著ABF載板產能擴張、AI伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階PCB設備的投資比重。設備商亦積極導入自動化、數位監控與智慧製造技術，提升產能效率並強化良率控管。整體而言，PCB設備市場正逐步由傳統標準機種轉向客製化與智能化發展，產業競爭力與技術門檻同步升高。

我國IC載板產業於2021~2022年進行大規模擴產與設備投資，自2022年下半年起受到全球通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致PC、智慧手機等消費性應用需求明顯走弱，呈現供過於求的態勢，導致企業下修資本支出。根據台灣印刷電路板協會(PCA)統計，我國2023年PCB設備產值為560億元，較2022年減少16.8%。來到2024年，隨著AI 應用之 PCB 製程設備對高層與高密度之需求提升，2024 年台灣 PCB 設備產值規模達 595 億元，年成長6.3%，有谷底復甦之態。展望2025年，在高階製程與東南亞新產能陸續量產推動下，2025 年我國PCB設備產值預估為新台幣639億元，年成長率達7.4%，我國PCB設備業預計將持續擴張。

C. 電漿設備

電漿由於其高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，因此在各項領域應用廣泛，然而由於電漿設備通常對於真空環境、電源供應穩定性要求高，導致設備成本造價昂貴，企業若未具一定資本門檻將難以大量採用，而隨著科技技術的進步，以及受電子、醫療保健和製造等行業對先進材料日益增長的需求推動，電漿技術廣泛的應用潛力逐步受到重視，全球電漿設備市場預計將逐步成長。

根據研調機構 VMR(Verified market Report)指出，2024 年電漿設備市場規模達 45 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 5.5%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 72 億美元。

依照各應用領域區分，根據 VMR 報告指出 2023 年電漿設備市場應用中，工業領域占比 50%，商業占比 30%、住宅占比 15%，其他應用占比 5%。其中工業領域涵蓋半導體、汽車、航空航太等工業科技產業。工業領域中，智慧型設備和自動化的興起進一步刺激了對電漿設備的需求。電漿技術的創新提高了電子設備所用組件的性能和效率，使製造商能夠生產出更小、更強大的設備。電漿處理製程是這一領域的關鍵，它可以改善材料的表面特性，確保更好的附著力、潤濕性和產品的整體性能。這項工藝在汽車、航空航太和包裝等各行業中都不可或缺。根據 VMR 報告，由於電子、航空航太、汽車和醫療保健等各行各業對高精度清潔解決方案的需求不斷增長，電漿表面處理設備於 2024 年市場規模為 12 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 9.2%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 25 億美元。

電漿技術的跨產業應用在電漿表面處理市場方面發揮重要的作用。在電子產業，電漿表面處理設備對於在組件組裝前去除基材上的污染物，以確保其可靠性能。在汽車行業，塗層和黏合過程之前，電漿可用於表面處理。在醫療保健領域，電漿表面處理設備用於準備手術器械和醫療器械，以確保無菌性和病患安全，在紡織業，低溫電漿在處理防護衣和無菌材料的親水化過程中發揮重要作用，有助於減少微生物。若按設備類型劃分，市場份額最大的是電漿蝕刻設備，約占 45%，其次是電漿改質清洗設備占 35%，電漿沉積濺鍍設備占 20%，其中電漿蝕刻及電漿改質清洗設備為半導體及 PCB 產業最為關鍵重要的製程之一，且由於晶片製造技術的進步，需要更為精密的表面處理技術，使半導體產業占有電漿表面處理設備市場的最大份額，占比約為 40%。

然而，由於電漿表面處理設備在輕量化材料和電動車零件中的應用日益增多，預計汽車產業將以最快的速度成長，2023 年至 2030 年的複合年增長率將達到 9%。此外，醫療保健產業在滅菌和醫療器材製造中對電漿技術的日益依賴，也推動了市場的成長，低溫電漿 (cold plasma) 由於能消滅細菌，尤其是抗藥性菌株，使得電漿成為有助於預防感染疾病和治療慢性傷口的解決方案。近年，隨著各行各業持續專注於永續發展，電漿表面處理製程提供比傳統清洗方法更環保的替代方案，可最大限度地減少浪費和有害化學品的使用，電漿技術更已擴展至新能源、綠色科技與環保應用，例如在氫能產業中，低溫電漿被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。為了遵守嚴格的行業法規和標準，越來越多的企業採用電漿表面處理解決方案，以確保最佳的表面處理和附著力，從而降低產品故障相關的風險，電漿表面處理設備市場需求及應用未來將更為廣泛。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

區段	定義	內容說明
上游	零組件、材料與模組供應商	<p>包含構成電漿設備所需之關鍵零組件與材料，為本公司設備研製的基礎來源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機構部品：真空腔體、機構骨架、加工零件等 ●電控部品：電源模組、電壓調變器、電子與控制單元 ●真空部品：真空泵浦、真空閥件、壓力感測與控制器 ●材料供應：射頻電極、等離子體腔體用高溫陶瓷、石英玻璃、特用合金、表面塗層材料等
中游	電漿設備之設計、整合與製造	<p>本公司自身所屬產業鏈位置，負責將原材料與零組件整合為應用於高階電子製造之設備。涵蓋：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●產品開發與工程設計（真空腔體、射頻模組、氣體混合系統等） ●電漿製程設備製造與模組整合：如真空電漿清洗機、蝕刻機、去膠機、極化設備、熱裂解設備等 ●AI智慧製程平台開發、高彈性客製化設備自動化開發
下游	設備最終應用產業客戶	<p>本公司設備之銷售對象，涵蓋電子與非電子產業的高附加價值應用場域。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●半導體產業：晶圓廠、封裝測試廠（先進封裝、晶圓再生、晶圓表面處理等） ●IC載板與印刷電路板產業：ABF、BT、高密度互連板（HDI）、軟硬結合板、IC Probe板等基板製造廠；HDI、多層板（MLB）、軟板與特殊應用板等製程設備需求。 ●新能源與環保產業：甲烷裂解產氫市場、固體廢棄物處理市場與半導體尾氣處理市場 ●其他利基應用：醫療耗材處理、生物感測、汽車零件塑膠件處理、化妝品界面改質等

(3) 產品之各種發展趨勢及競爭情形

A. 發展趨勢

a. 電漿技術應用新領域

電漿技術作為一種先進的材料表面處理與改質工具，廣泛應用於半導體製程、PCB製程、汽車工業、航太領域以及醫療領域中。隨著全球ESG趨勢及綠色產業發展，電漿技術正逐步擴展至新能源、綠色科技與環保應用。例如在氫能產業中，低溫電漿（Cold Plasma）被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處

理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。此外，柔性電子、顯示器、可撓式太陽能電池等新興材料與製程對低溫、非破壞性加工技術的需求日益上升，電漿技術的優勢更加明顯。未來隨著設備成本降低與應用技術成熟，電漿有望在更多高附加價值的領域發揮其潛力。

b. 先進製程驅動電漿製程需求倍增

隨著AI、5G技術裝置的快速發展，HPC需求增長推動更高效能及更低功耗的半導體製造技術，隨著摩爾定律在物理限制上瀕臨極限，各大半導體大廠轉向透過先進封裝技術及創新晶片架構等發展，其中先進封裝在一個封裝內整合多種晶片與元件，透過將晶片與其他元件緊密結合，減少互連的距離，從而降低延遲並提高數據傳輸速度和整體性能，為連接 IC及PCB尺度差異的關鍵技術，隨著2.5D/3D IC封裝技術、扇外型晶圓級封裝(FOWLP)、扇外型面板級封裝(FOPLP)及Chiplet架構快速發展，電漿技術由於其較高的介面附著力、以及可精準控制蝕刻深度與表面改質，將在多晶片整合、先進接合製程與低溫封裝應用中扮演更重要的角色，進一步提升半導體元件的性能與可靠度。根據市場調研機構YOLE的報告，先進封裝市場將於未來幾年快速成長，市場規模將由2023年378億美元至2029年達到695億美元，複合年增長率為11%。

另外，半導體製程不斷微縮，晶片運算速度更快、I/O(輸出入)數量更多、功耗與熱量管理要求更高，IC封裝載板必須具備更高密度、更精細線路與更優異的電氣特性才能配合。乾式電漿蝕刻技術相較傳統濕式技術可實現高度精確的蝕刻，可以在微米和奈米尺度上創建結構和圖案，提高訊號線寬及線距之精度，並支援微細圖形製程，因此在製程技術不斷提升下，各廠商對於電漿技術設備需求將持續增加。

c. 新產品應用需求旺盛

新產品應用需求正以空前速度成長，受惠於技術變革與市場需求的強力驅動。隨著智慧型手機持續向5G 普及化邁進，未來6G與7G技術將進一步推動手機功能與電池效能的升級，並結合人工智慧應用服務，帶動智慧型手機市場發展。同時，物聯網應用日益多元，從穿戴式裝置、醫療監測到智慧家庭與智慧城市等領域需求持續增加。電動車市場快速擴展，加上先進駕駛輔助系統(ADAS)與車用電子系統升級，使每輛車子半導體用量大幅攀升。這些新興應用皆需仰賴高效能半導體產品，亦推動高階IC載板需求持續成長。未來在高速運算、人工智慧及電動車等應用推動下，半導體及IC載板製程技術將持續升級，並為相關設備與材料供應商創造龐大商機。

B. 競爭情形

電漿表面處理技術已廣泛應用於半導體製造、半導體封裝、IC 載板及 PCB 製造領域，半導體製造業長期由國外設備大廠佔據市占，晶圓製造為奈米等級，技術及資本障礙高，且供應商一旦經半導體大廠認證即不易更換，新競爭者較難以切入。

本公司開發高彈性客製化之利基型產品，長期與國內外 PCB、IC 載板及封裝大廠維持良好合作關係，先進封裝的崛起為各板廠帶來新機會，眾多廠商紛紛切入先進封裝領域，本公司憑藉優越的電漿製程及設備開發能力，於 ABF 載板領域開發高均勻、高選擇及高精度之乾式蝕刻製程技術，可處理大面積 850×750mm 載板規格，領先業界 700x700mm 規格，同時亦切入 Hybrid Bonding 及再生晶圓薄膜去除技術，成功取得國內大廠採用。

3.技術及研發概況

(1)公司所營業務之技術層次及研究發展

本公司以自有電漿核心技術為基礎，發展具備高度自主性、模組化及跨應用整合能力的電漿設備平台，應用橫跨半導體、IC 載板、印刷電路板、新能源與環保產業，具備極高技術門檻與研發深度。以下為公司技術層次與研究發展重點分析：

A.技術層次說明

a.自主開發電漿製程核心模組平台

暉盛所有電漿設備之射頻系統、氣體導流、真空腔體結構、熱控機構與電磁場設計皆為原創開發，非仰賴國外OEM、ODM或標準化組裝廠，具備高端技術內涵。並可針對不同應用模組進行拆解與重組，形成具備靈活製程調變能力的整體平台架構。

b.覆蓋多項應用層級的製程能力

公司技術橫跨真空電漿（清洗、去膠、蝕刻、極化、高溫裂解）、常壓電漿（RF、Arc、Microwave、陣列式等）及高效電漿火焰（methane cracking、廢棄物處理），涵蓋製程包括晶圓再生、先進封裝、載板蝕刻與電漿極化（如 PZT、PVDF 等材料），並進入能源與環保設備（如甲烷裂解、PFC處理、醫療廢氣處理）等新興技術場域。

c.模組化與智慧製造能力

- 建立跨製程模組平台（模組/製程/控制分離設計）。
- 整合MES、AI製程監控與參數自學功能（建置中）。
- 可依照客戶需求快速開發「製程 + 機台 + 軟體 + 服務」全套解決方案。

B.研究發展實績與投入

a.研發投入強度

- 每年投入約營收5%為研發費用。
- 已建置跨領域團隊，整合電漿、材料科學、機構控制、熱流模擬、AI等領域專業。

b.國際合作與產學研聯盟

- 與台灣、日本、美國等國研究機構與大學建立產學合作計畫。

c.未來發展方向

發展面向	重點方向說明
技術創新深化	<ul style="list-style-type: none"> ●強化模組化電漿平台技術，提升高彈性客製化與應用多元性 ●發展新世代電漿火焰與高溫裂解系統（如氫能應用）
應用領域擴展	<ul style="list-style-type: none"> ●由半導體封裝與 PCB 擴大至綠能、氫能、廢氣與固廢處理等新領域 ●開發適用於 TGV、FOPLP、Hybrid Bonding 等關鍵製程
ESG技術布局	<ul style="list-style-type: none"> ●投入低碳電漿乾式製程開發，替代傳統濕製程 ●建構具備節能減碳與高效環保的解決方案（如氫能生產、尾氣分解）
國際市場擴張	<ul style="list-style-type: none"> ●強化與日、美、台一線晶圓廠、PCB 大廠協同開發 ●強化在地客戶需求整合，拓展海外據點
專利與智財保障	<ul style="list-style-type: none"> ●強化自主研發成果專利佈局，聚焦機構設計、電漿腔體、控制軟體等模組化設計 ●延伸專利應用至氫能與環保裝置
研發機制強化	<ul style="list-style-type: none"> ●每年投入約營收 5%於 R&D ●採用安索夫矩陣進行新產品/新市場發展，推動產品平台化與模組升級

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人

學歷		年度	112 年度		113 年度		114 年 9 月 30 日	
			人數	比重(%)	人數	比重(%)	人數	比重(%)
學歷分布	博士		2	22.22	2	20.00	2	20.00
	碩士		5	55.56	6	60.00	6	60.00
	學士		2	22.22	2	20.00	2	20.00
	合計		9	100.00	10	100.00	10	100.00
平均年資(年)			5.68		6.05		5.81	

(3)最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

A.最近五年度投入研發費用情形

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 第二季
研發費用	18,081	26,196	34,066	27,880	23,958	13,993
營業收入淨額	279,922	450,936	809,578	762,039	547,630	255,655
研發費用占營業收入淨額比率(%)	6.46	5.81	4.21	3.66	4.37	5.47

B.開發成功之技術或產品

年度	產品
109	◆ 晶圓背面高分子殘留物去除之大氣電漿設備 ◆ 用於非等向性乾式蝕刻製程之感應式高密度電漿-反應性離子蝕刻設備
110	◆ 用於金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備
111	◆ 用於甲烷裂解產氫之電弧式大氣電漿設備 ◆ 用於甲烷轉化之介電質放電式大氣電漿設備
112	◆ 寬幅型金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備 ◆ 用於甲烷裂解產氫之微波電漿火炬設備
113	◆ 大面積陣列式微波電漿系統
114	◆ 用於金屬氧化物去除之中頻大氣電漿設備

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期發展計畫

- A.5G通訊產業鏈電漿應用及市場開發
- B.連續式電漿設備硬體與軟體之推廣
- C.高效能電漿蝕刻應用之開發(半導體、IC載板、先進封裝、Micro-LED)
- D.因應電子產業ESG的殷切需求，全力開發全乾法電漿製程，解決濕製程、耗能製程在微細線路製程上的瓶頸及環境衝擊問題
- E.針對歐美日上游龍頭或系統大廠，進行重點式的合作

(2)長期發展計畫

- A.開發歐美、東南亞PCB及半導體後段市場應用，並加強應用廣度
- B.節能減碳新能源、空氣汙染防制(以工業用為主)之市場調查與開發
- C.利用電漿環保、低能耗的技術特性，提供減碳及永續經營的製程方案

D.提高產品品質並強化售後服務，在經營上持續秉持永續經營的理念，建立企業優良文化，並積極參與公益活動，重視社會責任。

E.掌握市場動向，擴大市場規模以開拓全球性電漿市場，並建立全球性之領導品牌

F.配合5G、AI高速網路及VR/AR應用等趨勢崛起，利用本公司專業技術結合其他專業領域，持續投入研發，並積極開發各項有利基之新產品，使產品多元化拓展更多市場應用。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元；%

年度 地區	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
台灣	293,679	38.54	261,590	47.77	148,278	58.00
中國大陸	303,803	39.87	236,825	43.25	55,144	21.57
美國	64,560	8.47	2,176	0.40	9,834	3.85
奧地利	50,151	6.58	23,681	4.32	438	0.17
泰國	3,409	0.44	1,161	0.21	22,722	8.89
其他	46,437	6.10	22,197	4.05	19,239	7.52
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	255,655	100.00

(2)市場占有率

本公司為生產各式電漿設備之專業廠商，主要應用於半導體先進封裝、IC載板、及PCB等電子產業，目前國內的競爭者有志聖、友威科、鈦昇及旭鼎等，國外則是有韓商Jesagi Hankook Ltd、美商Nordson March 及日商日新離子機械株式會社、中國商珠海寶丰堂半導體(股)公司。依研調機構VMR報告，2024年全球電漿蝕刻及電漿改質清洗設備市場規模達9.6億美元，根據美國國家稅務局(IRS)公布2024年平均匯率32.117換算為新台幣308億元，本公司2024年電漿設備銷售金額為4.9億元，在全球市場的市占率約為1.59%，整體而言仍有極大的成長空間。

(3)市場未來之供需狀況及成長性

A.半導體產業

本公司成立以來，半導體產業以後段封裝應用客戶為市場開發重點，近年來亦開發多款電漿蝕刻設備，逐漸將版圖擴展至半導體前段晶圓廠客戶。乾式電漿蝕刻技術於半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，相關製程技術之規格亦愈來愈高，隨著半導體廠商競爭先進製程研發，也使製程所

需設備成為大廠擴建產能的產業發展關鍵。根據國際半導體產業協會(SEMI)統計，由於高效能運算(HPC)和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動，更受惠於AI人工智慧整合度不斷提高，從而讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升，全球用於前端設施晶圓廠設備支出預估將在2025年成長2%至1,100億美元，2026年更將一舉成長至1,300億美元，成長18%。我國方面則受惠於高效能運算(HPC)應用帶動先進製程節點推進擴張和記憶體市場復甦，設備支出預計將從2024年的166億美元增加到2025年的210億美元，2026年更再增加至245億美元，因此在全球半導體業者資本支出增加下，以及國內業者競爭力提升下，預計2025年我國半導體生產用設備及零組件業的銷售值可望上揚。

半導體封裝方面，受惠於AI、智慧汽車、5G通訊等技術的發展，使得終端客戶對於高效能、低功耗晶片需求增加，進而帶動先進封裝需求顯著成長，根據工研院產科國際所估計，2025年先進封裝市場規模比重將超過傳統封裝，達51.0%，且比重將逐年增加，為了因應龐大需求，世界主要晶圓代工廠和封測廠正共同加速先進封裝技術的投資，晶圓龍頭大廠台積電宣布2025年資本支出達380~420億，其中10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。國內封測大廠日月光及力成等亦紛紛投入2.5D、3D、FOPLP等封裝技術，國外封測廠Amkor則預計2025年資本支出約8.5億美元，其中70%用於擴展2.5D、SiP、RDL等先進封裝技術，顯示該技術趨勢明確，半導體封測業者普遍加大2025年對先進封裝技術的投資。本公司所開發之電漿清洗設備及電漿蝕刻設備可應用於先進封裝基板之表面處理，隨著先進封裝市場持續擴大，對於公司業績可望帶來助益。

B. PCB 產業

本公司提供PCB製程的電漿表面處理與微蝕刻設備，並且針對ABF載板製造開發了全乾式電漿處理技術，包括電漿清洗設備、電漿鑽孔設備及電漿蝕刻設備。為了因應地緣政治的趨勢，大多數的PCB廠都已赴東南亞建廠，部分新廠已在2024年完工，2025年進入設備導入的支出高峰期，今年不少PCB廠商資本支出創下近年新高，新產能的貢獻在上半年陸續驗證後，下半年可望加入量產行列。PCB廠龍頭臻鼎泰國新廠第一期將於2025年試產，同時第二期廠房也將動土，再加上高雄AI園區及中國廠區再擴充，2025年估資本支出達約250億元。PCB大廠健鼎則隨著越南新廠的興建，以及既有廠的汰舊換新，2025年資本支出將提升至近50億元的水準。IC載板廠方面，由於2019-2022年的大幅度擴廠，2025年載板市場雖會自谷底回溫，但仍未完全復甦，包括欣興、南電、景碩資本支出都會較2024年減少，但以欣興來說，2025年資本支出仍有186億元的水準，載板約佔45%。

展望未來，隨著ABF載板產能擴張、AI伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階PCB設備的投資比重。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球PCB設備市場規模在2024年達42億美元，預計在2024至2032年複合增長率為6.2%。成長動能主要來自5G通訊、高效運算（HPC）、電動車（EV）及先進封裝等新興應用領域傳統。本公司專注於高階IC載板及HDI板之設備應用，未來市場需求仍然可期。

(4)競爭利基

A.研發團隊完整且經驗豐富

本公司目前經營及技術團隊在電漿技術領域已有20年以上之產業經驗，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，並充份了解產品製程所需面對之問題，即時提供客戶專業電漿技術解決方案，並建構專業實驗室，配備完整測試設備，全方位支援客戶進行樣品分析與製程研究，對本公司現有產品推廣、新產品開發具有相當助益。

B.自有先進電漿技術與專利

本公司以自主開發高密度電漿源結構、多階段電場控制系統、真空腔體設計與複雜製程整合，及高度複雜製程整合能力，涵蓋清洗、蝕刻、活化、極化及高溫裂解等應用，導入半導體晶圓、先進封裝、IC載板、PCB、感測器模組市場，並運用所開發之高效電漿火焰技術進入新能源產業及廢棄物處理等循環經濟領域之創新技術開發，另本公司於ABF載板領域開發高均勻、高選擇及高精度之乾式蝕刻製程技術，可處理大面積850x750mm載板規格，領先業界700x700mm規格，同時亦切入Hybrid Bonding及再生晶圓薄膜去除技術，並取得國內大廠採用。本公司各式電漿技術均積極取得相關專利與認證，並取得經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)認可並核定補助，以確保本公司電漿設備與技術領先業界，並持續開發符合市場趨勢之利基市場新產品，避免成熟領域削價競爭。

C.市場進入門檻高，供應鏈競爭居領先地位

本公司針對產業鏈的上游歐美或日本著名品牌客戶，於產品開發階段即密集進行電漿技術討論、測試、合作與認證，協同客戶共同開發合作取得設備的各式安規、環保、電氣法規認證，及早進入市場以提高競爭者的進入障礙，且一旦取得認證，客戶為確保製程穩定，亦不易更換供應商，以確保本公司在該產業鏈的銷售地位。

D.產品組合與跨領域應用

本公司以高密度電漿乾式表面處理製程技術平台為核心，將自主設計的基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空與溫控系統等依需求彈性，搭配結合成為高度可

擴展性的設備模組系統，並根據不同應用領域進行模組重組與流程優化。本公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域，同時在半導體先進封裝、IC載板及PCB乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使本公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用本公司電漿設備等實績中，顯示本公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

a.產品微細化

電漿解決方案為微米級，乃至於奈米級的乾式環保處理方式，隨著電子產品日趨精細，傳統濕式(酸液或鹼液)處理方式已逐漸無法因應，以印刷電路板產業為例，盲埋孔孔徑日漸縮小，酸液或鹼液進入孔內難度增高，因而無法完全將孔內膠渣清除乾淨。電漿係採用原子級的離子或自由基來進行膠渣的處理，因此電漿製程可以處理極小孔徑，引進電漿製程有其必要性。本公司為專業電漿技術及設備開發製造商，具有領先之電漿製程技術，先進製程產品為提高效能而走向奈米級，將可望持續提升電漿製程的重要性與絕對性。

b.半導體及先進封裝產業持續成長

受 AI、高效運算 (HPC)、5G、自駕車、物聯網 (IoT) 等應用驅動，全球半導體產值持續增長，在製程技術講究高效率及低能耗趨勢下，先進封裝技術需求擴大，本公司之產品如高效能電漿去膠渣機、晶圓清洗蝕刻機、極化處理模組等已具多國客戶導入實績，提前為下一代先進製程提供關鍵解決方案，隨著 FOPLP、FOWLP、CoWoS、Hybrid Bonding、晶圓再生、Chiplet 結構等先進封裝技術逐步導入量產，對乾式表面處理的需求持續上升。因此，即便全球總體經濟仍存在不確定性，隨著人類文明持續追求高度智慧化及便利性的科技產品，將提供半導體產業更大的商機及成長機會。

c.環保要求日益嚴格，電漿製程符合 ESG 趨勢

隨著各國政府日趨嚴格的環保政策，傳統濕式處理方式面臨廢液處理、化學品大量消耗、高能耗、佔地及人力需求大的不良因素，電漿處理方式是低能耗的製程方案，例如IC載板大廠目前針對ABF載板蝕刻係採乾溼製程並行，惟本公司針對ABF載板開發了全乾式電漿處理技術，可提升蝕刻速率，並可精確控制表面粗糙度，可有效降低能耗，減少了傳統化學濕製程對環境與良率的負面影響，因此未來IC載板廠採用全乾式電漿處理市場潛力龐大。除了降低能源損耗及碳排放外，本公司自研之高效電漿火焰處理設備可應用於甲烷裂解產氫與PFC廢氣分解、

醫療/工業廢棄物即時裂解等領域，可用來進行除碳創造乾淨能源，因此乾淨的乾式電漿處理方式可提供更環保的解決方案。因此，全球的節能減碳趨勢成為企業供應鏈選擇的重要指標，由於綠色製造與低碳技術需求增加，電漿應用有機會成為關鍵方案，將有助於本公司取得國際大廠的供應鏈機會。

d.工業 4.0 及生產監控需求

全球企業和供應鏈因應產品精細化避免汙染特性、生產有效管理、節能減碳及降低人力等需求，客戶逐漸重視工業4.0及生產監控的引進。本公司10多年前已進行生產監控標準的軟、硬體開發，可望迅速地滿足客戶關於生產監控的需求，並提高新的競爭者的跨入門檻。

e.各國半導體供應鏈在地化

半導體現今已成為重要戰略物資，各國紛紛推動晶片生產在地化，美國2022年推出規模達527億美元的晶片與科學法案(Chips and Science Act)，其中390億美元將用於補助興建半導體廠房及購置設備，132億美元用於先進製程的研發與人才培訓；歐盟則於2022年通過規模430億歐元的歐盟晶片法案(European Chips Act)，將用於半導體製程研發與建廠補貼；日本政府修訂了其半導體戰略，目標是到2030年，將國內生產的半導體銷售額增加兩倍至15兆日元以上，將晶片置於其經濟安全政策的核心位置；中國政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高10年免稅，全力推升成熟製程晶片市場的發展。因此在各國強力發展半導體產業下，對於半導體設備需求日漸升高，將對半導體設備廠商增添營運成長動能。

B.不利因素

a.人才取得及留任

本公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，公司之規模及品牌不及該區域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為公司挑戰及努力的方向。

因應對策：

本公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對公司的認可與向心力，以降低員工流動率。公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

b. 客戶對國產設備信心不足

國內半導體客戶過去習慣使用進口設備，對國產設備的信心度有待加強，對成熟製程更換設備的動機不足，對先進製程使用國產設備的信心不足，需要時間跟使用經驗逐步轉變觀念。

因應對策：

本公司在累積多年半導體設備經驗後，已自行研發出先進封裝感應耦合電漿蝕刻設備、自動化線上電漿製程系統及電漿晶圓清潔設備等設備，且生產過程中大多使用國內生產之原物料，供貨短缺或中斷的風險較低。本公司之設備，已成功打入各產業的標竿企業，建立市場形象及客戶信心，未來以標竿企業的口碑來進行業務推廣，將可進一步打開市占率。

c. 營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

本公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此本公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應對策：

I. 本公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。

II. 本公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

2. 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品用途

產品項目	重要用途
電漿清洗機	電子或非電子元件表面乾式清潔與改質，可適用於各式半導體、印刷電路板、光電、SMT、生醫、塑膠、車用部品等製程
電漿蝕刻機	高分子或金屬材料表面進行乾式蝕刻，以應用於半導體、先進封裝、IC載板、Micro-LED等製程

產品項目	重要用途
電漿極化機	電漿針對壓電材料進行極化處理，以應用於屏下指紋辨識 Sensor、散熱裝置、運動 Sensor、健康相關監控 Sensor 製作之製程
電漿表面處理機	針對各式電子或非電子產品，進行表面性質的改變(例如親水性提升、粗糙度改善)，以利後製程之良率提升(例如改善鍍膜或印刷品質、貼合拉力提升等)

(2)主要產品產製過程



3.主要原料之供應狀況

原料名稱	供應情形
電源供應器	良好
真空幫浦	良好
機構件	良好
流量計	良好
真空元件	良好

本公司主要原料皆至少維持二家以上供應商，以分散進料供應商原、物料短缺風險，並針對交期長且採購量大之原物料採一次性批量購買，並依生產排程及訂單交期分次進貨，以保障供貨品質及價格之穩定性，且本公司與各供應商均能維持良好合作關係，並未有供貨中斷或短缺之情事。

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

(1)最近二年度營業毛利率變化情形如下

單位：新台幣千元；%

項目/年度	112 年度	113 年度
銷貨收入淨額	762,039	547,630
銷貨毛利	291,503	214,940
毛利率	38.25	39.25
毛利率變動率	2.61%	

(2)毛利率變動率達 20%以上之說明：無。

(3)如為建設公司或有營建部門者，應列明申報年度及前一年度營建個案預定認列營業收入及毛利分析，說明個案別毛利率有無異常情事及已完工尚未出售之預計銷售情形：不適用。

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年第二季			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第二季進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	B1	36,704	14.92	無	B3	27,743	12.94	無	B3	16,161	13.17	無
2	B2	31,327	12.74	無	B4	24,485	11.43	無	B4	15,784	12.86	無
3	B3	27,617	11.23	無	B1	20,926	9.76	無	B1	12,087	9.85	無
4	B4	27,415	11.14	無	B2	12,414	5.79	無	B2	11,061	9.01	無
-	其他	122,933	49.97		其他	128,756	60.08		其他	67,652	55.11	
	進貨淨額	245,996	100.00		進貨淨額	214,324	100.00		進貨淨額	122,745	100.00	

增減變動說明：係因配合實際訂單需求而變化。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年第二季			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第二季銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A1	127,069	16.67	無	A11	78,619	14.36	無	A17	36,152	14.14	無
2	A2	107,190	14.07	無	A7	66,002	12.05	無	A2	28,096	10.99	無
3	A7	43,824	5.75	無	A1	42,662	7.79	無	A11	17,784	6.96	無
4	A11	19,008	2.49	無	A2	18,912	3.45	無	A1	15,090	5.90	無
5	A17	-	-	無	A17	-	-	無	A7	283	0.11	無
-	其他	464,948	61.02		其他	341,435	62.35		其他	158,250	61.90	
	銷貨淨額	762,039	100.00		銷貨淨額	547,630	100.00		銷貨淨額	255,655	100.00	

增減變動說明：係客戶資本支出變動，因此訂單需求而變動。

6.最近二年度生產量值

單位：台/新台幣千元

年度 生產量值 主要商品	112 年度			113 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
電漿設備	註 1	86	405,922	註 1	58	321,922

註 1：本公司所產製之設備係依客戶要求規格彈性客製化生產，每一設備所搭配之零組件各異，其產能數據不具比較性，故不適用。

增減變動說明：主係客戶需求變動，致生產產量隨之變動。

7.最近二年度銷售量值

單位：台/新台幣千元

年度 銷售量值 主要產品	112 年度				113 年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
電漿設備	38	250,485	50	451,773	35	218,629	19	274,940
維修收入	-	43,194	-	16,587	-	42,961	-	11,100
合計	38	293,679	50	468,360	35	261,590	19	286,040

增減變動說明：主係終端客戶之需求趨緩，故銷量減少。

(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數

年 度		112年度	113年度	114年截至 9月30日止
員工人數 (人)	經理人	4	4	4
	研發人員	9	10	10
	一般職員	27	29	32
	生產線員工	26	24	33
	合計	66	67	79
平均年歲 (歲)		40.12	40.63	40.99
平均服務年資 (年)		8.06	8.56	7.63
學歷分佈比率 (%)	博士	4.55	4.48	5.06
	碩士	18.18	23.88	21.52
	大學(專)	72.72	67.16	69.62
	高中/職	4.55	4.48	3.80

(四)環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形說明

本公司主要從事電漿設備之組裝及維修等業務，過程中並無特殊污染產生，毋須申請污染設施設置許可證或污染排放許可證，亦毋須繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。

- 2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- 3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- 4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(五)勞資關係

- 1.列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)員工福利措施、進修及訓練與其實施狀況

本公司一向關心及重視員工福利，依中華民國勞動基準法相關規定辦理勞工保險、全民健康及提撥退休金，並視公司營運成果辦理年終獎金發放、調薪。此外，依法提撥福利金，成立職工福利委員會，員工享有端午、中秋節獎金、定期免費員工健康檢查、團體保險、尾牙、不定期舉辦員工旅遊、婚喪喜慶補助金等。

為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質重視，配合政府企業人力資源提升計畫，依年度教育訓練計畫表執行教育訓練，以強化各機能別員工專業能力。

(2)退休制度與其實施狀況

A.本國員工：本公司依據勞工退休金條例(勞退新制)之退休金制度，依員工每月薪資提撥百分之六退休金至勞工保險局個人之退休金專戶，勞工達退休條件時得自行向主管機關提出申請領取該筆退休金，本公司員工退休辦法悉依勞動基準法及其相關法規訂定。

B.外籍員工：依勞動基準法有關規定辦理(舊制)，每月提撥退休金入台灣銀行專戶；員工退休金之支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休時前六個月之平均薪資計算。基數之計算係每位員工前十五年之服務，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，最高以四十五個基數為限。

(3)勞資間之協議情形與員工權益維護措施

本公司相當重視內部溝通，除定期召開勞資會議外，公司內部尚有各種溝通管道，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力。截至目前為止，勞資關係和諧互信且互動良好。

本公司依據相關法令規定，訂定勞資雙方聘僱合約、工作規則及各項管理規章，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護所有員工權益。

2.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(六)資通安全管理

1.敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)資通安全風險管理架構

A.本公司由資訊室負責資訊安全政策管理與規劃以及資訊安全相關事件處理與通報。

B.針對資訊安全之防毒、防災、防駭、防漏等之機制，定期向總經理進行彙整報告。

(2)資通安全政策

本公司制定電腦化資訊作業內控制度，內容包括系統分工與權限及資料備份與維護方式，使公司員工有所遵循。稽核人員每年依據內控規定對相關作業進行稽查，評估對各項風險控制及異常事項之規定是否確實執行，以降低相關資安風險。

(3)具體管理方案及投入資通安全管理之資源

防火牆等網路系統安全皆由專人即時更新維護及監控，並每半年對同仁進行資安宣導，加強同仁相關資安危機意識。

2.列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(七)有無因應景氣變動之能力

本公司業務係多以應用於半導體晶圓封測產業及PCB(IC載板)產業之電漿設備之研發、製造與銷售為主，所生產之電漿設備主係銷售予國內外半導體廠商與PCB製造大廠，故本公司業績較易受到半導體產業及PCB產業資本支出需求狀況影響。此外，受到全球通貨膨脹、俄烏戰爭與各國陸續升息等因素影響，消費性產品需求轉為疲弱，造成廠商庫存水位上升，半導體產業及PCB產業亦受到總體經濟環境影響而波動。惟本公司持續精進電漿設備應用於半導體封測設備及PCB製程設備之技術研發，延伸其產品應用，切入先進封裝及半導體蝕刻製程，加上未來5G、HPC、AI等技術發展使得半導體市場及PCB市場規模可望持續擴大，將帶動相關資本支出增加，有利於電漿設備出貨增長，且本公司持續開發電漿新應用，切入新能源製氫領域，以降低單一產業景氣影響，故本公司受景氣循環所面臨之營運風險應屬有限。

(八)發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理

本公司及子公司與關係人間交易條件無非常規交易情事，其交易事項請參閱本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告附註揭露。

(九)基層員工範圍及最近一個會計年度基層員工月平均經常性薪資之平均數，平均數如未達該年度每月基本工資一點三倍者，尚應敘明原因及具體改善措施

本公司基層員工薪資範圍係依「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準63千元，並經董事會通過，本公司113年度基層員工月平均薪資為44千元，超過該年度每月基本工資一點三倍。

(十)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項

1.市場及產銷部分，應增列產品核心技術分析暨持續發展之研究發展計畫

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保(專利權及所受法律保護狀況)與提升

A.產品生產開發技術之層次

本公司產品生產與技術開發的核心，建立於其自主研發的電漿乾式製程平台(Plasma Modular Processing Platform)之上。該平台整合高密度電漿生成模組、精密氣體流場設計、RF電場控制系統與真空腔體熱場整合機制，形成一套高度模組化、可擴展且具跨產業應用潛力的技術基礎。整體技術可分為三大核心層面：

a.自主電漿模組架構設計

本公司不依賴現有外部平台或進口設備改裝，而是完全自主設計與建構等離子體產生模組，涵蓋感應耦合電漿(ICP)、微波電漿(MTP)、大氣壓電漿(AP)等系列架構，並可依據不同製程需求，彈性設計腔體結構與能量分布控制系統。

b.多製程參數整合能力

本公司具備對氣體組成、腔體壓力、能量密度、電漿均勻性及材料熱衝擊等參數的協同控制能力，可靈活應用於多種乾式製程，包括清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理及高溫裂解等製程，顯示出技術應用層面之廣泛延展性。

c.先進封裝與精密加工的高度適配性

本公司產品具備處理 3D 結構及高深寬比結構的能力，對於奈米級線寬、表面粗糙度與蝕刻選擇性具備高解析調控能力，能有效支援先進晶圓封裝、ABF 載板蝕刻與 FPC 模組加工等關鍵核心製程，為高階半導體應用提供技術支撐。

B.產品生產開發技術之來源

本公司關鍵核心開發技術100%來自公司之研發團隊，以總經理為首帶領擁有產業豐富經驗，並涵蓋電漿物理、化學工程、機構設計、材料科學與系統整合等專業之團隊，以實務經驗及專業知識將設計思想轉變為具可實施性的產業技術。技術研發以電漿製程為主軸，且並非單一用途開發，而係以「核心平台+應用模組」方式設計，具備高度再利用與產業轉移能力，且技術基礎由研發部門統一維護，由研發單位人員與生產部電控設計單位依產業需求開展應用專案，確保既有核心可持續深化，亦能快速響應市場趨勢。而智慧財產專利權佈局則包含等離子體產生模組、射頻功率控制、氣體導流腔體設計、感測監控系統與多段製程控制架構等，均由本公司之經營及研發團隊完成。

C.產品生產開發技術之確保

本公司針對其自主開發之電漿乾式製程，已建構完善的技術保護策略。本公司已於內部控制制度之研發循環中訂定有關智慧財產權之取得、維護及運用作業予以規範，並於每一個新技術、新改善方案建立時，申請專利權保護或列為公司營業秘密完善保存，並建立智慧財產權清單定期更新盤點，其相關文件之傳遞、保存及銷毀均須依管理作業程序辦理，嚴格控管本公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，且本公司員工均有簽屬保密協議，藉以控管及保護本公司重要專利技術。除此之外亦透過資深研發人員之經驗傳承，同時積極延攬人才組建技術團隊，以確保核心技術持續提升。

D.產品生產開發技術之提升

本公司持續投入研發人力及經費於電漿多樣化應用領域(如：半導體先進封裝、IC載板、ESG能源環保等)之技術開發，以利本公司能於早期掌握產品關鍵技術，並確保持續領先同業推出更全方位之產品，同時本公司透過與國際大廠客戶建立協同開發計畫，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化，並透過產學合作進行前瞻研究，以促進技術進化。此外，本公司將積極延攬人才，並

輔以參考職務承擔責任及貢獻度發放獎酬，兼顧人才招募及留任，俾利本公司所具有之關鍵核心技術得以持續提升。

(2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計畫

A.現在主要產品之競爭優勢

a.專精利基與研發創新

本公司聚焦於電漿表面處理這一利基市場，投入高度研發創新，掌握高密度電漿源設計等核心技術。在先進封裝、IC載板等新興應用上推出創新解決方案。相較之下，國際大廠雖規模龐大，但產品線廣泛，未必能迅速客製因應這些特殊製程需求。本公司擁有專業電漿技術團隊與多項專利，加上高彈性客製化及製程整合能力，能依客戶製程需求提供專屬模組設計、製程參數優化與材料測試服務，滿足不同產業的特殊要求。

b.產品組合與跨領域應用

本公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域。例如，同業中的 Nordson /MARCH(美商諾信公司旗下電漿處理設備部門)主要專注於半導體封裝用真空電漿清洗，中國珠海寶豐堂半導體(股)公司偏重 PCB/半導體去膠蝕刻設備，而本公司同時在半導體、PCB、光電乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使本公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用本公司電漿設備等實績中，顯示本公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

B.現在主要產品之生命週期暨持續發展性

本公司旗下產品依據其技術成熟度與市場接受程度，主要可區分為三大生命週期階段：

a.成熟期產品

本公司部分傳統型電漿設備，如電漿清洗機、去膠渣機等通用型真空和常壓電漿設備，已進入產品生命週期之成熟階段。該類產品市場需求相對穩定，競爭者眾，產品同質性高。為維持競爭優勢，本公司將持續透過技術升級與高彈性客製化製程服務，延伸產品生命週期並鞏固客戶關係。

b.成長期產品

應用於先進封裝(如 FOWLP、FOPLP、Hybrid Bonding)、晶圓再生與 ABF 載板全乾式處理等新興應用所開發的電漿設備，目前正處於高速成長階段，尚無週期性之問題。隨著 AI、5G、高效運算(HPC)等科技發展推升半導體製程升級，相關需求持續擴大。本公司憑藉自主電漿模組設計能力，於此領域建立技術領先地位，提高市場滲透率。

c. 導入期產品

應用於新能源與環保領域之電漿設備，包括高溫電漿火炬(用於甲烷裂解產氫)、固體廢棄物處理及溫室氣體減排等系統，現階段尚處於導入初期。儘管市場尚未全面成熟，但因應全球能源轉型與淨零碳排目標，相關產業前景可期。本公司將持續投入研發與驗證資源，並積極拓展相關市場。

C. 新產品之研究發展計劃

本公司致力於擴展核心製程技術的深度與廣度，全面強化奈米級清洗、蝕刻與表面控制等關鍵能力，以因應先進封裝製程對精密度與材料適應性的高度要求。同時，本公司積極發展跨材料整合技術，導入適用於 Epoxy +SiO₂、Glass +Cu 等異質材料的複合材蝕刻與活化解決方案，提升設備對新型封裝結構的製程相容性。在綠色製程方面，本公司推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、高效率氫能火炬與高 GWP 尾氣處理等創新設備之商品化，強化 ESG 製程落實與碳排管理能力。此外，為加速數位轉型，本公司亦已導入智慧製造技術，包括建立製程參數 AI 學習模型、建置虛擬量產平台與智慧維運系統，提升製程穩定性、良率與運營效率。

- 2.如係屬生技醫療業者，應增列其核心產品之臨床實驗進度資訊：不適用。
- 3.最近二年度從業員工人數部分，增列經理人、技術及研究發展人員暨其他員工之流動情形：請參閱本公開說明書「貳、一、(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數」。

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產應記載事項

(一)自有資產

- 1.列明取得成本達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事。但公司股票為無面額或每股面額非屬新台幣十元者，前開有關達實收資本額百分之二十部分改以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之：

114年6月30日

不動產、廠房及設備名稱	單位	數量	取得年月	原始成本(千元)	重估增值	未折減餘額(千元)	利用狀況			保險情形	設定擔保及權利受限制之其他情事
							本公司使用部門	出租	閒置		
安南科工段734號土地	M ²	6,443.75	108.10	117,681	-	117,681	本公司	-	-	-	銀行借款擔保
主建築及附屬工程	式	1	111.04	133,724	-	112,789	本公司	-	-	已投保	銀行借款擔保

- 2.列明閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產名稱、面積、座落地點、取得日期、取得成本、重估增值、未折減餘額、公告現值或房屋評定價值、公允價值及預計未來處分或開發計畫：無。

(二)使用權資產

列明金額達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項：無。

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1.各生產工廠之使用狀況

114年8月31日

項目 工廠	建物面積 (m ²)	員工人數 (人)	生產商品種類	目前使用狀況
台南廠	2,728.62	72	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿極化機及電漿表面處理機等電漿設備	正常使用中

2.最近二年度設備產能利用率

單位：台；新台幣千元

年度 生產量值 主要產品	112 年度				113 年度			
	產能	產量	產能利 用率	產值	產能	產量	產能利 用率	產值
電漿設備	註 1	86	註 1	405,922	註 1	58	註 1	321,922

註 1：本公司所產製之設備係依客戶要求規格彈性客製化生產，每一設備所搭配之零組件各異，其產能數據不具比較性，故不適用。

三、轉投資事業

(一)轉投資事業概況

114 年 6 月 30 日；單位：新台幣/外幣千元；千股

轉投資事業	主要營業	投資 成本	帳面 價值	投資股份		股權 淨值	市價	會計處 理方法	最近年度(113)		持有 公司 股份 數額
				股數	股權 比例				投資 損益	報 酬 分 配 股 利	
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.	一般投資業	USD 500	4,715	500	100%	4,715	註 1	權益法	1,142	-	-
昆山金暉盛電子商 貿有限公司	電子零組件 貿易與售後 服務	USD 500	4,715	-	100%	4,715	註 1	權益法	1,142	-	-

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註1：係未上市櫃公司，故無市價。

(二)綜合持股比例

114 年 6 月 30 日；單位：千股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.	500	100%	-	-	500	100%
昆山金暉盛電子商貿有 限公司	註 1	100%	-	-	註 1	100%

註1：係有限公司。

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：不適用。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	國泰世華	111.02.20-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	國泰世華	109.10.12-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保；承諾於借款期間，自 112 年度財務報告日起，應維持流動比率不低於 150%及負債比率不高於 120%
授信合約	國泰世華	110.02.01-114.10.12	中期擔保借款	土地及廠房抵押擔保；承諾於借款期間，自 112 年度財務報告日起，應維持流動比率不低於 150%及負債比率不高於 120%
授信合約	永豐銀行	114.06.30-115.06.30	短期擔保借款 (週轉金)	依債務餘額徵十足定存單設質擔保
授信合約	元大銀行	113.11.18-114.11.17	短期擔保借款 (週轉金)	提供美元定期存單擔保
授信合約	元大銀行	113.11.18-114.11.17	衍生性金融商品(避險額度) 美元參拾萬元	-

參、發行計畫及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項：

本公司並無辦理併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債之情事，而前各次現金增資計畫實際完成日距申報時已逾三年以上，故不適用。

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項：

(一)本次計畫之資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

1.本次計畫所需資金總額：新台幣187,557千元。

2.本次計畫資金來源

本次現金增資發行普通股2,165,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣21,650,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣67.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，本次競價拍賣得標總金額為新臺幣187,557千元；各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為每股新臺幣101.88元，惟均價高於最低承銷價格之1.06倍，故公開承銷價格以每股新臺幣72元溢價發行。另員工認購募集資金為新臺幣23,328千元，本次增資募集總金額為新臺幣210,885千元。

3.計畫項目及預計資金運用進度

單位：新台幣千元

項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			114年度	115年
			第四季	第一季
充實營運資金	115年第一季	210,885	100,000	110,885

資料來源：該公司提供

4.預計可能產生之效益

本公司本次募集資金210,885千元擬全數用以充實營運資金，預計於114年第四季完成募集，於資金到位後隨即投入支應公司營運所需之相關資金需求，除可增加長期資金穩定性外，亦可強化財務結構、提升償債能力並降低公司經營風險，更有助於提高公司資金靈活調度之彈性及未來中長期發展，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

- (二)本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法。如有委託經本會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果。如附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：不適用。
- (三)本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。如附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法(含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬)：不適用。
- (四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。
- (五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市(櫃)計畫：本次辦理現金增資發行新股係供辦理創新版初次上市公開承銷，故不適用。
- (六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。
- (七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。
- (八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額

1.本次計畫之可行性評估

(1)法定程序上之可行性評估

本公司本次辦理創新版初次上市前現金增資發行新股計畫，業經113年6月28日股東常會決議通過全體股東放棄優先認購權，作為初次上市前公開承銷之股份來源，並於114年9月5日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，有關現金增資計畫之發行價格、發行條件及其他相關事宜，如因主管機關指示或基於客觀環境改變而需要修正時，已授權本公司董事長全權處理。經查閱其內容及決議程序，均符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令之規定，另參酌本公司委任之翰辰法律事務所彭義誠律師對本次現金增資發行新股計畫出具之法律意見書，顯示本次募集與發行有價證券計畫確已符合相關法令之規定，故本公司本次現金增資發行新股計畫於法定程序上應屬適法可行。

(2)資金募集完成之可行性評估

本公司本次辦理現金增資計畫發行普通股2,165千股，每股面額新臺幣10元，以每股新臺幣72元發行，募集總金額210,885千元。本次現金增資發行新股除依公司法第267條保留15%，計324千股由員工認購外，其餘1,841千股則依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第36條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第17條之1規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，並按證券交易法第28-1條規定，經113年6月28日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，排除公司法第267條第3項原股東優先認購之適用，全數委託承銷商辦理創新板上市前公開承銷。

本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股係採全數競價拍賣方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購之，而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保本次資金募集完成，故本公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

(3) 資金運用計畫之可行性評估

本公司本次辦理現金增資發行新股所募集金額為新台幣210,885千元，擬全數用於充實營運資金，考量主管機關審查與承銷作業時程，預計於114年第四季募集完成，旋即可將資金挹注於營運週轉需求，以因應本公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，除可強化本公司財務結構之外，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業之經營及健全財務結構均有正面助益，故本次籌資用於充實營運資金應屬合理可行。

2. 本次計畫之必要性評估

本次現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第36條規定，以現金增資發行新股方式，委託證券承銷商辦理創新板上市前公開承銷，另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第8條第3項及「中華民國證券商業同業公會發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」規定，得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

3. 本次計畫之合理性評估

(1) 資金運用計畫及預計進度之合理性

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理創新板初次上市前公開承銷之用，募集資金共計新台幣210,885千元，資金運用目的為充實營運資金，以因應本公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，並提高自有資本比率及強化財務結構，提升資金靈活調度之彈性，另考量主管機關之審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程，預計於114年第四季完成資金募集作業後，即依本次募集計畫之預定進度，於114年第四季及115年第一季投入充實營運資金，故本公司之資金運用計畫及預計進度應屬合理。

(2)預計可能產生效益之合理性

單位：%

項目		年度	籌資前 114年6月底	籌資後 (預估)(註)
財務結構	負債比率		31.89	26.66
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		336.74	417.34
償債能力	流動比率		405.28	514.28
	速動比率		365.78	474.78

註：係以114年第二季個體自結財務數字為基礎，按充實營運資金210,885千元後設算。

本公司本次辦理現金增資發行新股募集210,885千元，預計於114年第四季募集完成，並於114年第四季及115年第一季投入充實營運資金。若以該計畫募集完成後之財務結構及償債能力觀之，其負債比率可由增資前31.89%降至26.66%，長期資金占不動產、廠房及設備比率、流動比率及速動比率將分別上升至417.34%、514.28%及474.78%，將可強化財務結構及提升償債能力，故有助於本公司靈活調度資金，故本次現金增資計畫之效益應屬合理。

4.各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

本公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

本公司本次辦理現金增資發行普通股2,165千股，加計目前流通在外股數為34,632千股，辦理增資後股數為36,797千股，每股盈餘將因現金增資後股權稀釋比率為5.88%【 $2,165 \text{ 千股} / (34,632 \text{ 千股} + 2,165 \text{ 千股})$ 】，故本次辦理現金增資發行新股對本公司每股盈餘稀釋影響尚屬有限。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式。

請參閱附件十一、承銷價格計算書。

(十)資金運用概算及可能產生之效益

- 1.收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構(含總成本及單位成本)、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。
- 2.轉投資其他公司者，應列明相關事項：不適用。
- 3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所

需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A.公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形：不適用。

B.目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形

本公司目前營運資金均來自於自有資金，本次辦理現金增資發行新股用於充實營運資金，除可增加長期資金來源穩定度，有助於公司未來長期發展、提升經營績效外，並可強化財務體質、降低營運風險及增加資金靈活運用空間，以因應本公司未來營運資金所需，並可強化財務結構並提升市場競爭力。

本公司本次申報現金增資發行新股辦理創新板上市前現金增資發行新股募集金額為210,885千元，預計於114年第四季募集完成，並於114年第四季及115年第一季投入充實營運資金，故本公司之資金運用計畫及預計進度應屬合理。

D.列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

114 年度現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目/月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	458,858	462,693	463,483	458,323	475,594	445,394	442,656	411,575	391,390	380,737	299,572	493,640	458,858
加：非融資性收入													
應收帳款收現	60,910	34,318	31,011	50,008	12,738	49,343	79,321	51,049	37,474	62,778	32,985	32,051	533,986
其他	284	391	314	316	323	761	360	256	400	256	356	663	4,680
非融資性收入合計(2)	61,194	34,709	31,325	50,324	13,061	50,104	79,681	51,305	37,874	63,034	33,341	32,714	538,666
減：非融資性支出													
廠商付款	21,048	18,932	21,858	20,221	30,101	29,440	30,310	24,962	18,702	17,266	31,382	35,956	300,178
用人費用	25,361	4,051	6,018	6,425	7,896	8,181	6,342	6,871	6,485	12,971	6,584	6,584	103,769
所得稅費用	—	—	—	—	—	8,701	—	—	9,648	—	—	—	18,349
利息支出	276	276	266	274	268	276	265	236	236	236	236	236	3,081
取得不動產、廠房及設備	1,965	—	750	260	129	200	754	105	3,000	1,270	1,500	—	9,933
取得金融資產(3個月以上之定存)	—	—	—	—	—	—	60,285	—	—	36,000	—	36,000	132,285
其他	7,790	9,095	6,028	4,308	3,302	4,479	11,241	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	90,698
非融資性支出合計(3)	56,440	32,354	34,920	31,488	41,696	51,277	109,197	41,065	46,962	76,634	48,593	87,667	658,293
要求最低現金餘額(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
所需資金總額(5=3+4)	156,440	132,354	134,920	131,488	141,696	151,277	209,197	141,065	146,962	176,634	148,593	187,667	758,293
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6=1+2-5)	363,612	365,048	359,888	377,159	346,959	344,221	313,140	321,815	282,302	267,137	184,320	338,687	239,231
融資淨額													
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,885	—	210,885
發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	(28,860)	—	—	—	—	(28,860)
銀行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(919)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(67,565)	(1,565)	(1,565)	(84,134)
融資淨額合計(7)	(919)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(30,425)	(1,565)	(67,565)	209,320	(1,565)	97,891
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	462,693	463,483	458,323	475,594	445,394	442,656	411,575	391,390	380,737	299,572	493,640	437,122	437,122

115 年度現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目/月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	437,122	459,296	411,233	401,409	416,349	398,274	371,300	358,800	373,880	361,006	386,270	293,670	437,122
加：非融資性收入													
應收帳款收現	67,981	51,709	63,596	85,108	44,044	24,193	26,719	55,995	44,427	64,729	36,921	36,773	602,195
其他	255	255	255	255	255	660	255	255	255	255	255	660	3,870
非融資性收入合計(2)	68,236	51,964	63,851	85,363	44,299	24,853	26,974	56,250	44,682	64,984	37,176	37,433	606,065
減：非融資性支出													
廠商付款	26,827	24,399	19,477	15,271	22,338	31,484	17,800	22,577	21,507	19,857	36,090	41,350	298,977
用人費用	7,243	26,936	7,506	6,960	10,634	9,651	7,982	7,901	11,378	7,901	7,901	13,857	125,850
所得稅費用	—	—	—	—	16,710	—	—	—	13,179	—	—	—	29,889
利息支出	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	2,832
取得不動產、廠房及設備	1,300	2,000	—	1,500	2,000	—	3,000	—	800	1,270	1,500	—	13,370
取得金融資產(3個月以上之定存)	0	36,000	36,000	36,000	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000
其他	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	106,692
非融資性支出合計(3)	44,497	98,462	72,110	68,858	60,809	50,262	37,909	39,605	55,991	38,155	54,618	64,334	685,610
要求最低現金餘額(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
所需資金總額(5=3+4)	144,497	198,462	172,110	168,858	160,809	150,262	137,909	139,605	155,991	138,155	154,618	164,334	785,610
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6=1+2-5)	360,861	312,798	302,974	317,914	299,839	272,865	260,365	275,445	262,571	287,835	268,828	166,769	257,577
融資淨額													
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(73,593)	—	(73,593)
銀行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(18,780)
融資淨額合計(7)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(75,158)	(1,565)	(92,373)
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	459,296	411,233	401,409	416,349	398,274	371,300	358,800	373,880	361,006	386,270	293,670	265,204	265,204

(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因：

A.應收帳款收款與應付帳款付款政策

本公司應收帳款政策係依據個別客戶營運規模、信用紀錄及過去往來交易情形給予不同之授信條件，並視個別合約或訂單約定不同階段所需收取之訂金款、交機款、驗收款及保固款，主要收款條件國內依發票日，國外客戶依其通知起，月結30~180天收款。本公司預計114年及115年度對銷售客戶之收款政策變化不大，故以此作為預估114年9~12月及115年度現金收支預測表各月份應收帳款之收款情形，其編製基礎尚屬合理。

應付帳款部分，本公司購料支出主要係應付採購原物料之款項，目前與主要供應商之付款政策，係依產品之市場供需關係，與供應商訂定合理之付款條件。本公司目前主要供應商付款條件為月結30~120天付款為主，經考量備貨作業時間及實際付款情形及付款政策，本公司乃據以作為編制114年9~12月及115年度現金收支預測表之基礎，尚屬合理。

B.資本支出計畫

本公司之資本支出計畫係依公司未來經營策略及營運計畫予以擬定，以因應營運規模之擴展，本公司現金收支表之主要資本支出項係用於設備汰舊換新，而前述增添之設備資本支出所需資金係以自有資金支應，與本次募集資金用途並無直接關聯，故其現金收支預測表之編製基礎尚屬合理。

C.財務槓桿及負債比率

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	114 年前二季
財務槓桿度(倍)(註)	1.02	1.04	1.04
負債比率(%)	30.57	35.03	31.89

資料來源：112 及 113 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及 114 年前二季個體自結財務報表。
註：財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益影響之程度，該項指標數值愈高，表示公司所承擔之財務風險愈大。本公司112~113 年度及 114 年前二季之財務槓桿度分別為 1.02倍、1.04 倍及 1.04倍，顯示本公司之財務風險控管尚屬穩健；就財務結構而言，負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，本公司 112 年底、113 年底及 114 年第二季底之負債比率分別為 30.57%、35.03%及31.89%，其數值尚屬穩健，預計本次辦理現金增資發行新股充實營運資金後，可降低本公司負債比率及增加資金調度之彈性，亦可提升償債能力及改善財務結構，對於強化財務結構及降低營運風險均有正面之助益。

(3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形：

本公司本次辦理現金增資發行新股係用於充實營運資金，故不適用本項評估。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益

本公司本次募資計畫用於充實營運資金，依本公司編製之 114 及 115 年度現金收支預測表，本公司預估 114 年 9~12 月及 115 年度相關資本支出合計為 19,140 千元，未達本次募資金額之 60%，故不適用本項評估。

4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：

本公司本次辦理現金增資預計用途為充實營運資金，故不適用本項評估。

5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：

本公司本次辦理現金增資預計用途為充實營運資金，故不適用本項評估。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

四、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.簡明資產負債表

(1)國際財務報告準則-合併財務報表

單位：新台幣千元

	最近五年度財務資料					114年截至 6月30日 財務資料	
	109年	110年	111年	112年	113年		
流動資產	558,876	594,536	830,919	806,262	793,825	794,505	
不動產、廠房及設備	183,024	274,285	273,078	265,100	266,746	261,700	
無形資產	3,641	3,205	2,496	2,474	2,036	1,922	
其他資產	24,763	33,687	39,417	26,207	24,532	22,384	
資產總額	770,304	905,713	1,145,910	1,100,043	1,087,139	1,080,511	
流動負債	分配前	405,041	503,630	403,624	209,498	184,548	199,455
	分配後	427,872	526,461	429,880	267,218	213,408	尚未分配
非流動負債	1,329	-	191,386	173,856	156,539	149,199	
負債總額	分配前	406,370	503,630	595,010	383,354	341,087	348,654
	分配後	429,201	526,461	621,266	441,074	369,947	尚未分配
歸屬於母公司業主之 權益	363,934	402,083	550,900	716,689	746,052	731,857	
股本	228,311	228,311	262,558	288,598	288,598	346,318	
資本公積	22,600	22,600	22,600	55,390	55,390	55,390	
保留盈餘	分配前	113,104	151,344	265,822	372,827	402,047	330,615
	分配後	90,273	128,513	239,566	315,107	373,187	尚未分配
其他權益	(81)	(172)	(80)	(126)	17	(466)	
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	-	-	
權益總額	分配前	363,934	402,083	550,900	716,689	746,052	731,857
	分配後	341,103	379,252	524,644	658,969	717,192	尚未分配

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(2)國際財務報告準則-個體財務報表

單位：新台幣千元

項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料				
		109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
流 動 資 產		554,570	588,505	826,296	801,637	781,682
不 動 產、廠 房 及 設 備		183,017	274,230	273,071	265,071	266,698
無 形 資 產		3,641	3,205	2,496	2,474	2,036
其 他 資 產		28,671	39,489	43,920	26,182	30,500
資 產 總 額		769,899	905,429	1,145,783	1,095,364	1,080,916
流 動 負 債	分 配 前	404,636	503,346	403,497	204,166	178,325
	分 配 後	427,467	526,177	429,753	261,886	207,185
非 流 動 負 債		1,329	-	191,386	174,509	156,539
負 債 總 額	分 配 前	405,965	503,346	594,883	378,675	334,864
	分 配 後	428,796	526,177	621,139	436,395	363,724
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		363,934	402,083	550,900	716,689	746,052
股 本		228,311	228,311	262,558	288,598	288,598
資 本 公 積		22,600	22,600	22,600	55,390	55,390
保 留 盈 餘	分 配 前	113,104	151,344	265,822	372,827	402,047
	分 配 後	90,273	128,513	239,566	315,107	373,187
其 他 權 益		(81)	(172)	(80)	(126)	17
庫 藏 股 票		-	-	-	-	-
非 控 制 權 益		-	-	-	-	-
權 益 總 額	分 配 前	363,934	402,083	550,900	716,689	746,052
	分 配 後	341,103	379,252	524,644	658,969	717,192

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

2.簡明綜合損益表

(1)國際財務報導準則-合併財務報表

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料					114年截至6月 30日財務資料
	109年	110年	111年	112年	113年	
營業收入	279,922	450,936	809,578	762,039	547,630	255,655
營業毛利	110,858	171,875	313,543	291,503	214,940	111,142
營業損益	44,230	79,810	193,737	166,599	87,039	37,438
營業外收入及支出	(2,486)	(4,095)	21,985	5,344	25,944	(18,337)
稅前淨利	41,744	75,715	215,722	171,943	112,983	19,101
繼續營業單位 本期淨利	36,189	61,071	171,556	133,261	86,950	15,148
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	36,189	61,071	171,556	133,261	86,950	15,148
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	18	(91)	92	(46)	135	(483)
本期綜合損益總額	36,207	60,980	171,648	133,215	87,085	14,665
淨利歸屬於 母公司業主	36,189	61,071	171,556	133,261	86,950	15,148
淨利歸屬於非控制 權益	-	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於 母公司業主	36,207	60,980	171,648	133,215	87,085	14,665
綜合損益總額歸屬於 非控制權益	-	-	-	-	-	-
每股盈餘(元)	1.59	2.33	6.53	5.00	3.01	0.44

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(2)國際財務報導準則-個體財務報表

單位：新台幣千元

項 目	年 度	最近五年度財務資料				
		109年	110年	111年	112年	113年
營業收入		278,317	448,830	805,104	762,120	546,155
營業毛利		107,115	165,803	309,985	292,260	209,248
營業損益		43,757	77,620	194,903	171,779	86,090
營業外收入及支出		(2,024)	(1,956)	20,733	84	26,748
稅前淨利		41,733	75,664	215,636	171,863	112,838
繼續營業單位 本期淨利		36,189	61,071	171,556	133,261	86,950
停業單位損失		-	-	-	-	-
本期淨利(損)		36,189	61,071	171,556	133,261	86,950
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		18	(91)	92	(46)	135
本期綜合損益總額		36,207	60,980	171,648	133,215	87,085
淨利歸屬於 母公司業主		36,189	61,071	171,556	133,261	86,950
淨利歸屬於非控制權益		-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主		36,207	60,980	171,648	133,215	87,085
綜合損益總額歸屬於非控制權益		-	-	-	-	-
每股盈餘(元)		1.59	2.33	6.53	5.00	3.01

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響：無。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年 度	會 計 師 事 務 所	會 計 師 姓 名	查 核 意 見
109	國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀、李國銘	無保留意見
110	國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀、李國銘	無保留意見
111	國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀、李國銘	無保留意見
112	國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀、李國銘	無保留意見
113	國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀、李國銘	無保留意見

2.最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：無。

(四)財務分析

1.國際財務報導準則-合併財務報表

分析項目		最近五年度財務分析(註 1)					114 年截至 6 月 30 日財務資料(註 1)
		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	52.75	55.61	51.92	34.85	31.37	32.27
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	199.57	146.59	271.82	335.93	338.37	336.67
償債能力	流動比率(%)	137.98	118.05	205.86	384.85	430.15	398.34
	速動比率(%)	79.74	57.12	128.54	314.60	390.46	358.37
	利息保障倍數	37.46	161.41	151.43	54.80	35.24	12.67
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.72	4.98	4.57	2.73	2.14	2.10
	平均收現日數	135	74	80	134	171	174
	存貨週轉率(次)	0.87	1.06	1.70	2.21	3.33	4.52
	應付款項週轉率(次)	2.11	3.53	4.46	4.75	4.86	3.61
	平均銷貨日數	420	345	215	166	110	81
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.69	1.97	2.96	2.83	2.06	1.94
	總資產週轉率(次)	0.40	0.54	0.79	0.68	0.50	0.47
獲利能力	資產報酬率(%)	5.28	7.33	16.84	12.09	8.19	3.04
	權益報酬率(%)	10.13	15.95	36.00	21.03	11.89	4.10
	稅前純益占實收資本比率(%)	18.28	33.16	82.16	59.58	39.15	11.03
	純益率(%)	12.93	13.54	21.19	17.49	15.88	5.93
	每股盈餘(元)(追溯後)	1.59	2.33	6.53	5.00	3.01	0.44
現金流量	現金流量比率(%)	11.47	12.64	13.08	64.26	93.36	註 3
	現金流量允當比率(%)	註 2	註 2	註 2	註 2	104.98	133.23
	現金再投資比率(%)	5.65	8.90	3.92	11.72	12.09	註 3
槓桿度	營運槓桿度	1.31	1.17	1.09	1.91	2.50	2.75
	財務槓桿度	1.03	1.01	1.01	1.02	1.04	1.05
最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)							
1.速動比率增加：主係 113 年度營收及獲利下滑，致員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得應付款減少，致流動負債較 112 年底減少所致。							
2.利息保障倍數減少：主係 113 年度營收及獲利下滑所致。							
3.應收款項週轉率減少及平均收現日數增加：主係 113 年度訂單縮減及客戶資本支出計畫延							

宕，使營收下滑所致。

- 4.存貨週轉率增加及平均銷貨日數減少：主係 113 年度營業成本隨營業收入下滑，另考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，使存貨淨額減少，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度所致。
- 5.不動產、廠房及設備週轉率減少及總資產週轉率減少：主係 113 年度營收下滑所致。
- 6.資產報酬率、權益報酬率、稅前純益佔實收資本率與每股盈餘減少：主係 113 年度營收及獲利下滑所致。
- 7.現金流量比率增加：主係 113 年度營收及獲利下滑，致員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得應付款減少，而本公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加。
- 8.營運槓桿度增加：主係 113 年度訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營業收入下滑，而公司因規模固定，相關之固定費用變動不大，因而使營業利益減少幅度大於邊際貢獻幅度，致營運槓桿度增加。

註 1：上列財務資料業經會計師查核簽證或核閱。

註 2：本公司自 109 年度始採用國際財務報導準則之財務資料尚不滿 5 個年度，故無法計算。

註 3：114 年度前二季營業活動淨現金流量為流出數，故不予列示相關比率。

註 4：各財務比率計算公式如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

2. 國際財務報導準則-個體財務報表

分析項目		最近五年度財務分析(註 1)				
		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	52.73	55.59	51.92	34.57	30.98
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	199.58	146.62	271.83	336.21	338.43
償債能力	流動比率(%)	137.05	116.92	204.78	392.64	438.35
	速動比率(%)	79.26	56.89	128.02	321.88	400.19
	利息保障倍數	37.45	161.31	151.37	54.77	35.19
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.74	5.00	4.57	2.74	2.13
	平均收現日數	134	73	80	134	172
	存貨週轉率(次)	0.89	1.09	1.71	2.23	3.51
	應付款項週轉率(次)	2.16	3.59	4.45	4.74	4.92
	平均銷貨日數	411	335	214	164	104
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.68	1.96	2.94	2.83	2.05
	總資產週轉率(次)	0.40	0.54	0.79	0.68	0.50
獲利能力	資產報酬率(%)	5.28	7.34	16.84	12.12	8.23
	權益報酬率(%)	10.13	15.95	36.00	21.03	11.89
	稅前純益占實收資本比率(%)	18.28	33.14	82.13	59.55	39.10
	純益率(%)	13.00	13.61	21.31	17.49	15.92
	每股盈餘(元)(追溯後)	1.59	2.33	6.53	5.00	3.01
現金流量	現金流量比率(%)	11.62	12.48	13.21	65.21	97.08
	現金流量允當比率(%)	註 2	註 2	註 2	註 2	103.50
	現金再投資比率(%)	5.79	8.72	3.99	11.55	12.17
槓桿度	營運槓桿度	1.31	1.17	1.09	1.90	2.64
	財務槓桿度	1.03	1.01	1.01	1.02	1.04
<p>最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)</p> <p>1.速動比率增加：主係 113 年度營收及獲利下滑，致員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得應付款減少，致流動負債較 112 年底減少所致。</p> <p>2.利息保障倍數減少：主係 113 年度營收及獲利下滑所致。</p> <p>3.應收款項週轉率減少及平均收現日數增加：主係 113 年度訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營收下滑所致。</p> <p>4.存貨週轉率增加及平均銷貨日數減少：主係 113 年度營業成本隨營業收入下滑，另考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，使存貨淨額減少，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度所致。</p>						

- 5.不動產、廠房及設備週轉率減少及總資產週轉率減少：主係 113 年度營收下滑所致。
- 6.資產報酬率、權益報酬率、稅前純益佔實收資本率與每股盈餘減少：主係 113 年度營收及獲利下滑所致。
- 7.現金流量比率增加：主係 113 年度營收及獲利下滑，致員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得應付款減少，而本公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加。
- 8.營運槓桿度增加：主係 113 年度訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營業收入下滑，而公司因規模固定，相關之固定費用變動不大，因而使營業利益減少幅度大於邊際貢獻幅度，致營運槓桿度增加。

註 1：上列財務資料業經會計師查核簽證。

註 2：本公司自 109 年度始採用國際財務報導準則之財務資料尚不滿 5 個年度，故無法計算。

註 3：各財務比率計算公式如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2)速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3)利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2)權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3)純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4)每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2)淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3)現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2)財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

(五)會計項目重大變動說明

比較最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計項目，若金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，應詳予分析其變動原因如下表

1.國際財務報導準則-合併財務報表

單位：新台幣千元

會計項目	年度		增減變動		差異數說明
	112年度	113年度	金額	%	
現金及約當現金	385,537	465,474	79,937	20.73	113 年度較 112 年度增加，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，致現金較 112 年度增加。
應收帳款淨額	268,277	232,819	(35,458)	(13.22)	113 年度較 112 年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，致應收帳款隨營業收入下滑而減少所致。
存貨	136,942	62,614	(74,328)	(54.28)	113 年度較 112 年度減少，主係因客戶資本支出計畫延宕，考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，使存貨淨額較 112 年度減少。
其他金融資產-流動	—	16,395	16,395	—	主係為增加借款額度所質押擔保之定期存款。
其他應付款	65,646	53,563	(12,083)	(18.41)	主係 113 年度獲利較 112 年度減少，故年終獎金、員工紅利及董監酬勞提列較 112 年度減少。
本期所得稅負債	28,697	8,749	(19,948)	(69.51)	113 年度較 112 年度減少，係因稅前淨利隨營收下滑而減少，使本期所得稅減少所致。
長期借款	161,397	144,306	(17,091)	(10.59)	主係陸續償還借款所致。
法定盈餘公積	66,176	79,502	13,326	20.14	113 年度較 112 年度增加，係因本期保留盈餘依法提列法定盈餘公積所致。
營業收入	762,039	547,630	(214,409)	(28.14)	113 年度較 112 年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營業收入下滑，致相關營業成本、營業毛利及營業利益亦隨之減少。
營業成本	470,536	332,690	(137,846)	(29.30)	
營業毛利	291,503	214,940	(76,563)	(26.26)	
營業利益	166,599	87,039	(79,560)	(47.76)	

會計項目 \ 年度	112年度	113年度	增減變動		差異數說明
			金額	%	
其他利益及損失	3,313	22,667	19,354	584.18	113年度較112年度增加，主係美金匯率波動之影響產生淨兌換利益增加所致。
稅前淨利	171,943	112,983	(58,960)	(34.29)	113年度較112年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使業績下滑，致稅前淨利、所得稅費用及本期淨利隨之減少。
所得稅費用	38,682	26,033	(12,649)	(32.70)	
本期淨利	133,261	86,950	(46,311)	(34.75)	

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

2.國際財務報導準則-個體財務報表

單位：新台幣千元

會計項目	年度		增減變動		差異數說明
	112年度	113年度	金額	%	
現金及約當現金	383,553	458,858	75,305	19.63	113 年度較 112 年度增加，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，致現金較 112 年度增加。
應收帳款淨額	268,552	232,470	(36,082)	(13.44)	113 年度較 112 年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，致應收帳款隨營業收入下滑而減少所致。
存貨	134,253	57,610	(76,643)	(57.09)	主係 113 年度訂單陸續出機，以及目前在手訂單相對較少，備料及在製品亦同步減少之綜合影響
其他金融資產-流動	—	16,395	16,395	—	主係為增加借款額度所質押擔保之定期存款。
其他應付款	60,418	47,389	(13,029)	(21.56)	主係 113 年度獲利較 112 年度減少，故年終獎金、員工紅利及董監酬勞提列較 112 年度減少。
本期所得稅負債	28,639	8,700	(19,939)	(69.62)	113 年度較 112 年度減少，係因稅前淨利隨營收下滑而減少，使本期所得稅減少所致。
長期借款	161,397	144,306	(17,091)	(10.59)	主係陸續償還借款所致。
法定盈餘公積	66,176	79,502	13,326	20.14	113 年度較 112 年度增加，係因本期保留盈餘依法提列法定盈餘公積所致。
營業收入	762,120	546,155	(215,965)	(28.34)	113 年度較 112 年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營業收入下滑，致相關營業成本、營業毛利及營業利益亦隨之減少。
營業成本	469,860	336,907	(132,953)	(28.30)	
營業毛利	292,260	209,248	(83,012)	(28.40)	
營業利益	171,779	86,090	(85,689)	(49.88)	
其他利益及損失	3,384	22,348	18,964	560.40	113 年度較 112 年度增加，主係美金匯率波動之影響產生淨兌換利益增加所致。
稅前淨利	171,863	112,838	(59,025)	(34.34)	113 年度較 112 年度減少，主係訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使業績下滑，致稅前淨利、所得稅費用及本期淨利隨之減少。
所得稅費用	38,602	25,888	(12,714)	(32.94)	
本期淨利	133,261	86,950	(46,311)	(34.75)	

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

- (六)本國發行公司自公開發行後最近連續七年，或外國發行公司最近連續七年財務報告皆由相同會計師查核簽證者，應說明未更換會計師之原因、目前簽證會計師之獨立性暨公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：無此情形。
- (七)外國發行公司得僅列示最近三年度簡明財務資料：不適用。
- (八)外國發行公司列示之財務報表為最近兩年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告，如係申請創新板第一上市者，為最近一年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告：不適用。

二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

1.113 年度合併財務報告暨會計師查核報告：詳附件一。

2.114 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告：詳附件二。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表

1.113 年度個體財務報告暨會計師查核報告：詳附件三。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況其他重要事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無此情形。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露之資訊：無此情形。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		806,262	793,825	(12,437)	(1.54)
不動產、廠房及設備		265,100	266,746	1,646	0.62
無形資產		2,474	2,036	(438)	(17.70)
其他資產		26,207	24,532	(1,675)	(6.39)
資產總額		1,100,043	1,087,139	(12,904)	(1.17)
流動負債		209,498	184,548	(24,950)	(11.91)
非流動負債		173,856	156,539	(17,317)	(9.96)
負債總額		383,354	341,087	(42,267)	(11.03)
股本		288,598	288,598	0	0.00
資本公積		55,390	55,390	0	0.00
保留盈餘		372,827	402,047	29,220	7.84
其他權益		(126)	17	143	(113.49)
權益總額		716,689	746,052	29,363	4.10
1.重大變動項目說明(針對差異金額達 10,000 千元且變動比例達 20%者)：無。 2.影響重大者應說明未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利影響，且公司整體表現尚無重大異常，故無需擬定因應計畫。					

(二)財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

1.財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	762,039	547,630	(214,409)	(28.14)
營業成本	470,536	332,690	(137,846)	(29.30)
營業毛利	291,503	214,940	(76,563)	(26.26)
營業費用	124,904	127,901	2,997	2.40
營業利益	166,599	87,039	(79,560)	(47.76)
營業外收入及支出	5,344	25,944	20,600	385.48
稅前淨利	171,943	112,983	(58,960)	(34.29)
所得稅費用	38,682	26,033	(12,649)	(32.70)
本期淨利	133,261	86,950	(46,311)	(34.75)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(46)	135	181	393.48
本期綜合損益	133,215	87,085	(46,130)	(34.63)
1.重大變動項目說明(針對差異金額達 10,000 千元且變動比例達 20%者)：				
(1)營業收入、營業成本、營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本期綜合損益減少：主係 113 年度訂單縮減及客戶資本支出計畫延宕，使營業成本、營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本期綜合損益隨業績及獲利下滑而減少。				
(2)營業外收入及支出增加：主係受美元持續升值影響，使淨兌換利益增加所致。				

2.預期銷售數量與其依據對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司未公告財務預測，故不適用預期銷售數量及其依據，另公司財務結構尚屬健全，透過長期資金來源以支應相關支出，應無資金不足之情事，且公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

(三)現金流量

1.最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	變動金額	變動比例
營業活動	134,631	172,288	37,657	27.97
投資活動	(5,056)	(23,739)	(18,683)	369.52
融資活動	17,387	(68,755)	(86,142)	(495.44)

現金流量變動情形分析：

1.營業活動：113 年度淨流入較 112 年度增加，主係 113 年度營收及獲利下滑，致員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得應付款減少，而本公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款所致。

2.投資活動：113 年度淨流出較 112 年度增加，主係增加借款額度而質押擔保定期存款所致。

3.融資活動：113 年度淨流出較 112 年度增加，主係陸續償還長期借款與現金股利發放增加所致。

2.流動性不足之改善計畫

本公司112年度及113年度流動資產均大於流動負債，且112年度及113年度營業活動皆為淨現金流入，並無流動性不足之情事。

3.未來一年(114 年)現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營 業活動淨現 金流量 (2)	全年來自投 資活動淨現 金流量 (3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量 (4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之 補救措施	
					投資計畫	理財計畫
465,474	21,100	(142,218)	42,882	387,238	—	—

現金流量變動情形分析：

1.營業活動：因預計 114 年度因營收及獲利穩定，致營業活動產生淨現金流入。

2.投資活動：主係預計投資附買回票券、無塵室興建與相關設備投入計畫，致投資活動產生淨現金流出。

3.籌資活動：主係除本年度辦理現金增資外，預計提前清償高利率銀行借款，整體籌資活動仍產生淨現金流入。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司最近年度並未發生重大資本支出，因此對財務業務尚無重大影響。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.最近年度轉投資政策

本公司轉投資政策係基於永續經營及營運成長性考量，對本業發展或拓展業務範圍有利之事業，並訂有「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」，為公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關財務業務狀況。

2.最近年度獲利或虧損之主要原因及改善計畫

113年12月31日 單位：新台幣千元/外幣千元

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.	一般投資業	USD 500	6,212	1,142	主因 100%轉投資 昆山金暉盛獲利所致	—
昆山金暉盛電子商貿有限公司	電子零組件貿易與售後服務	USD 500	6,212	1,142	主因維修需求增加，以及人力與成本進行控管所致	—

3.未來一年投資計畫

本公司長期之轉投資政策，係以保守穩健為原則，並配合公司長期發展策略進行本業相關之投資佈局。公司將持續監督管理既有之轉投資公司，以達成預期之轉投資目標，強化整體投資績效。

(六)其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：無。

(二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形：無。

(三)內部控制制度聲明書：詳附件四。

(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：詳附件五。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：詳附件六。

四、律師法律意見書：詳附件七。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形：不適用。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項：不適用。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：不適用。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：詳附件八。

- 十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：因本公司採競價拍賣方式辦理承銷，故係出具不受理特定對象投標聲明書，請參閱附件九。
- 十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專業審查取具之報告書：詳附件四及附件五。
- 十四、發行公司之公司治理運作情形：請參閱本公開說明書「伍、三十二、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項」。
- 十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易：詳附件十。
- 十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估：無。
- 十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無。
- 十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無。
- 十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項：不適用。
- 二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊：不適用。
- 二一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：無。
- 二二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列之事項：不適用。
- 二三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式：詳附件十一。
- 二四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響：不適用。
- 二五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、第二十八條之一第五項、第六項、第二十九條第一項、第二項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項：不適用。
- 二六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣

出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見：不適用。

二七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書：不適用。

二八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定牴觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露：不適用。

二九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：無。

三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見：無。

三一、其他必要補充說明事項：附件十五。

三二、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項

(一)董事會運作情形資訊

本公司113年度及申請年度截至公開說明書刊印日止，董事會共開會12(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A)	備註
董事長	宋俊毅	12	-	100	
董事	曾坤燦	10	2	83	
董事	許嘉元	12	-	100	
董事	基丞科技股份有限公司：代表人江少杰	7	5	58	
獨立董事	顏盟峯	11	1	92	
獨立董事	何志文	12	-	100	
獨立董事	黃蕙玲	12	-	100	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理					
(一)證交法第14條之3所列事項					
董事會日期 (期別)	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理		
113.03.27 (第八屆第七次)	1.本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 2.通過本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 3.本公司 112 年度盈餘分配案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。 7.新訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 8.本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 9.本公司擬申請股票上市(櫃)案。 10.本公司擬辦理現金增資發行新股為初	無意見	不適用		

	<p>次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。</p> <p>11.訂定召開本公司一一三年股東常會召集事由。</p> <p>12.永豐銀行額度展期案。</p> <p>13.審查本公司應提交薪酬委員會進行審查之適用經理人範圍及其薪資案。</p>		
113.06.05 (第八屆第八次)	<p>1.本公司訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>2.本公司從事衍生性商品交易之授權案。</p> <p>3.本公司修訂投資循環內控制度案。</p> <p>4.本公司新訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策審核辦法」及民國113年預先核准之非確信服務清單案。</p> <p>5.本公司112年度董監事酬勞分派金額案。</p> <p>6.本公司經理人112年度第一次員工酬勞分派金額案。</p> <p>7.元大銀行額度申請案。</p>	無意見	不適用
113.08.07 (第八屆第九次)	<p>1.本公司113年第二季合併財務報表案。</p> <p>2.元大銀行金融交易額度申請案。</p>	無意見	不適用
113.09.11 (第八屆第十次)	<p>1.本公司經理人112年度第二次員工酬勞分派金額案。</p>	無意見	不適用
113.12.25 (第八屆第十一次)	<p>1.增修訂本公司各項管理辦法案。</p> <p>2.本公司公司治理主管任命案。</p> <p>3.本公司114年度營運計畫及預算案。</p> <p>4.本公司114年度稽核計畫案。</p> <p>5.本公司經理人112年度第三次員工酬勞及113年度年終獎金個人分派金額案。</p> <p>6.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國114年預先核准之非確信服務清單案。</p>	無意見	不適用
114.03.19 (第八屆第十二次)	<p>1.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>2.通過本公司113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。</p> <p>3.本公司113年度盈餘分配案。</p> <p>4.本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>5.訂定本公司基層員工範圍案。</p> <p>6.本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>7.本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」</p>	無意見	不適用

	<p>案。</p> <p>8.本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長 114 年度薪資報酬)案。</p> <p>9.本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人 114 年度薪資報酬)案。</p> <p>10.訂定召開本公司一一四年股東常會召集事由。</p> <p>11.永豐銀行額度展期案。</p>		
114.05.13 (第八屆 第十三次)	<p>1.本公司 114 年第一季合併財務報表案。</p> <p>2.本公司 113 年度董事酬勞分派金額案。</p> <p>3.本公司經理人 113 年度第一次員工酬勞分派金額案。</p> <p>4.檢討本公司「薪資酬勞委員會組織規程」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」案</p>	無意見	不適用
114.06.11 (第八屆 第十四次)	<p>1.本公司申請股票創新板上市案。</p> <p>2.本公司財務報告編製能力評估案。</p> <p>3.本公司 114 年第二季及第三季財務預測案。</p> <p>4.本公司公司治理評鑑自評案。</p> <p>5.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</p> <p>6.本公司 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>7.本公司修訂薪工循環內控制度案。</p>	無意見	不適用
114.07.09 (第八屆 第十五次)	<p>1.本公司授權董事長訂定配股增資基準日、配息基準日及發放日案。</p>	無意見	不適用
114.07.11 (第八屆 第十六次)	<p>1.本公司 114 年第一季合併財務報表修改案。</p>	無意見	不適用
114.08.08 (第八屆 第十七次)	<p>1.本公司 114 年第二季合併財務報表修改案。</p> <p>2.元大銀行額度展期案。</p>	無意見	不適用
114.09.05 (第八屆 第十八次)	<p>1.本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。</p> <p>2.本公司擬通過自上市掛牌起三個會計年度委任主辦承銷商之保薦契約案。</p> <p>3.訂定現金增資員工認股辦法。</p> <p>4.本公司現金增資員工認股案。</p>	無意見	不適用

		5.本公司經理人 113 年度第二次員工酬勞分派金額案。		
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。				
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:				
董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.03.27	許嘉元	審查本公司應提交薪酬委員會進行審查之適用經理人範圍及其薪資案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
113.06.05	宋俊毅、許嘉元、曾坤燦、江少杰	本公司 112 年度董事酬勞分派金額案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事宋俊毅、許嘉元、曾坤燦、江少杰先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
113.06.05	許嘉元	本公司經理人 112 年度第一次員工酬勞分派金額案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
113.09.11	許嘉元	本公司經理人 112 年度第二次員工酬勞分派金額案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
113.12.25	許嘉元	本公司經理人 112 年度第三次員工酬勞分派金額案及 113 年度年終獎金個人分派金額案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
114.03.19	宋俊毅、顏盟峯、黃蕙玲、何志文	本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長 114 年度薪資報酬)案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事宋俊毅、顏盟峯、黃蕙玲、何志文先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
114.03.19	許嘉元	本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人 114 年度薪資報酬)案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出席董事無異議照案通過。
114.05.13	宋俊毅、許嘉元、曾坤燦、江少杰	本公司 113 年度董事酬勞分派金額案	涉及自身利益關係,應依法迴避,未參與討論與表決	本案董事宋俊毅、許嘉元、曾坤燦、江少杰先生依法個別迴避未參與討論及表決,其餘出

				席董事無異議照案通過。
114.05.13	許嘉元	本公司經理人 113 年度第一次員工酬勞分派金額案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
114.09.05	許嘉元	本公司現金增資員工認股案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
114.09.05	許嘉元	本公司經理人 113 年度第二次員工酬勞分派金額案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案董事許嘉元先生依法個別迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會	議事單位評估	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共45項衡量指標。	93分
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	個別董事成員	董事會成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共23項衡量指標。	92分
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	審計委員會	委員會自評	對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共23項衡量指標。	99分
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	薪資報酬委員會	委員會自評	對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共21項衡量指標。	100分

(一)本公司已完成民國113年度董事會績效自評，評估結果並提送114.03.19董事會報告，作為檢討及改進之依據。

- (二)評估結果分為「優於標準以上」(得分90分以上)、「標準以上」(得分為80分至89分)、「達常規標準」(得分為70分至79分)、「未達標準」(得分為60分至69分)及「有待加強」(得分未滿60分)。
- (三)整體董事會績效自評評估結果為「優於標準以上」；個別董事成員績效自評評估結果為「優於標準以上」；功能性委員會自評結果為「優於標準以上」。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
- (一)本公司為健全公司治理及加強董事會相關職能，於113年01月26日股東臨時會增選三席獨立董事(7席董事含3席獨立董事)，以建立本公司良好董事會治理制度、健全監督及強化董事會功能。
- (二)本公司每年定期安排董事進修課程，進修範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、內部控制制度、財務報告責任、企業社會責任等，並鼓勵董事會成員於新任或任期中持續參加公司治理主題相關課程，俾使董事會成員具備不同專業職能，落實董事多元化政策。
- (三)本公司致力提昇資訊透明度，除指定發言人及代理發言人，並有專人負責公開資訊揭露等相關事宜，另本公司網站設有投資人專區保持公司訊息更新等，投資大眾均可即時獲得本公司之相關資訊。

(二)審計委員會運作情形資訊

本公司113年度及申請年度截至公開說明書刊印日止，審計委員會共開會10(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A)	備註
獨立董事	顏盟峯	9	1	90	召集人
獨立董事	何志文	10	-	100	
獨立董事	黃蕙玲	10	-	100	
其他應記載事項：					
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。					
(一)證交法第14條之5所列事項					
審計委員會日期 (期別)	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理		
113.03.27 (第一屆第一次)	1.通過本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司 112 年度盈餘分配。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。 6.本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.本公司擬申請股票上市(櫃)案。 8.本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。	無意見	不適用		
113.06.05 (第一屆第二次)	1.本公司訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 2.本公司從事衍生性商品交易之授權案。 3.本公司修訂投資循環內控制度案。 4.本公司新訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策審核辦法」及民國 113 年預先核准之非確信服務清單。	無意見	不適用		
113.08.07 (第一屆第三次)	1.本公司 113 年第二季合併財務報表案。 2.元大銀行金融交易額度申請案。	無意見	不適用		

113.12.25 (第一屆第四次)	1.增修訂本公司各項管理辦法案。 2.本公司 114 年度營運計劃及預算案。 3.本公司 114 年度稽核計畫案。 4.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國 114 年預先核准之非確信服務清單案。 5.擬選舉審計委員會代表人案。	無意見	不適用
114.03.19 (第一屆第五次)	1.通過本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司 113 年度盈餘分配案。 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	無意見	不適用
114.05.13 (第一屆第六次)	1.本公司 114 年第一季合併財務報表案。	無意見	不適用
114.06.11 (第一屆第七次)	1.本公司申請股票創新板上市案。 2.本公司財務報告編製能力評估案。 3.本公司 114 年第二季及第三季財務預測案。 4.本公司公司治理評鑑自評案。 5.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 6.本公司 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日內部控制制度聲明書討論案。 7.本公司修訂薪工循環內控制度案。	無意見	不適用
114.07.11 (第一屆第八次)	1.本公司 114 年第一季合併財務報表修改案。	無意見	不適用
114.08.08 (第一屆第九次)	1.本公司 114 年第二季合併財務報表修改案。 2.元大銀行額度展期案。	無意見	不適用
114.09.05 (第一屆第十次)	1.本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。 2.本公司擬通過自上市掛牌起三個會計年度委任主辦承銷商之保薦契約案。	無意見	不適用

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1.本公司內部稽核主管除將稽核報告及查核缺失、改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管於審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其

追蹤情形說明，依其指示加強稽核工作內容，確保內部控制制度的有效性，並與獨立董事溝通情形良好。

2.稽核主管與獨立董事得視需要以電子郵件、電話或當面方式等直接聯繫，溝通管道暢通。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形

1.本公司簽證會計師每年至少一次，針對當季及年度本公司及海外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響列方式充分溝通。

2.會計師與獨立董事得於審計委員會或視需要以電子郵件、電話或當面方式等進行溝通。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司訂有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等皆有相關規範，有關公司公司治理實務守則，請至本公司官網查詢。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	✓	本公司除委託專職股務代理機構處理股東相關事務外，並訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並設有專責人員處理股東建議或糾紛。 本公司已委由股務代理機構負責，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定按月申報董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股異動情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	✓	本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司之監督及管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。 本公司已訂定「內線交易防制辦法」及控制重點，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以防範內線交易之發生。	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司業已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，就董事會成員擬定多元化方針並落實執行本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事7位包含1位女性董事，比率達14.29%。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓	✓	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	✓	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓	✓	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	✓	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司官網已揭露財務業務及公司治理資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司落實發言人制度，並依資訊揭露規定將公司營運資訊公開，且已架設英文網站，股東會相關資訊均定時於公司網站更新。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	本公司已於規定期限前公告並申報財務報告與各月營運情形。未來將視公司營運情形及相關法令規定提前公告並申報年度財務報告。	均依法規定期限內公告，並已逐步提前公告
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		<p>1.員工權益： 本公司對員工權益除依勞基法及相關法令辦理，設立職工福利委員會，依法提撥職工福利金及員工退休金。</p> <p>2.僱員關懷： 公司定期實施員工健康檢查及提供醫療諮詢，以維護員工身心健康，並持續改善員工工作環境皆能滿足國際性規範之需求。故所有員工均能依其意願達成與公司約定之工作，不礙生理或心理之脅迫，並且不因任何種族、性別、年齡、宗教或政治傾向受到歧視。</p> <p>3.投資者關係： 設有股務單位及發言人，負責處理相關股務事宜及股東建議及糾紛等問題。</p> <p>4.供應商關係： 本公司與供應商維持平等及良好之關係。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	
			<p>5.利害關係人之權利： 本公司設有發言人，利害關係人如有需求除可透過公司專屬窗口聯繫外，亦可藉由本公司網頁登載之公司聯絡資訊，隨時與本公司聯絡，以維護利害關係人之權益。</p> <p>6.董事及監察人之進修情形： 本公司董事均具備相關專業知識並依法令規定每年持續進修相關之課程時數。</p> <p>7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司內部控制風險管理制度及重要管理規章辦法之制修訂均經由董事會核決並依相關規章辦法執行。</p> <p>8.客戶政策之執行情形： 本公司與客戶維持良好之關係。</p> <p>9.公司為董事購買責任保險之情形： 本公司業已為董事購買責任保險，以配合公司治理強化股東權益之保障。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。</p>			

(四)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 1.本公司薪資報酬委員會成員計 3 人，皆由獨立董事組成，成員資料可參閱「壹、三、公司組織(四)董事及獨立董事資料」。
- 2.本屆委員任期：112年12月27日至115年05月29日，113年度及114年度截至公開說明書刊印日止薪資報酬委員會共開會7(A)次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	顏盟峯	7	-	100	召集人
獨立董事	何志文	7	-	100	
獨立董事	黃蕙玲	7	-	100	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

- 3.提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設立提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司訂有「永續發展實務守則」，由董事會不定期審視公司治理內容，並推動企業社會責任觀念。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司已訂定「永續發展實務守則」，追求永續經營與獲利之同時，亦重視環境保護、社會責任與公司治理之平衡，將其納入公司管理方針與日常營運活動中，積極參與推動社會公益、加強企業社會責任資訊揭露。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>本公司之產業特性並無環境污染問題。</p> <p>本公司除設有資源分類回收筒，亦努力宣導資源回收之社會責任。</p> <p>本公司投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，並揭露投資金額及設備項目，以及節能或減碳之量化數據。</p> <p>1. 節能設備：99.99kW(峰瓦) 太陽能光電設備</p> <p>2. 投資金額：3,660,000 元 (新台幣)</p> <p>3. 實際節能數據：113 年度實際發電 148,080 度，148,080 度 * 0.474 公斤 CO₂e/度碳排放量=減量約 70 噸 CO₂。</p> <p>本公司將全力支持政府所提倡之各項節能減碳之環保政策，並密切注意氣候變遷對營運活動之影響。</p> <p>本公司積極配合政府提倡之各項節能減碳環保政策，持續進行無紙化作業之推動，降低年度用紙量。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，並遵循勞動法規，訂定工作規則、員工手冊等相關人事規範，確保同仁之合法權益。</p> <p>本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	<p>利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度、績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。此外，依本公司董事會已通過修改章程如下「本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥員工酬勞：百分之二~十，前述員工酬勞總額中不低於百分之四十五應提撥為分派予基層員工之酬勞。」，適當將公司經營績效或成果反映於員工薪酬。本公司並重視職場多元化與平等，落實男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，女性主管職占比 25%，另也進用身障同仁人數並符合法規標準，提供身障同仁友善的工作職務及環境設施。</p> <p>本公司依照規定，於有安全或職災疑慮之環境或設施，加以警示或配發防護器材，本公司全體員工每三年一次必須接受一般職安教育訓練，以提升員工安全意識、預防災害發生，並定期辦理員工健康檢查，本公司113年度員工職災及火災件數皆為零。</p>	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	<p>本公司由各單位針對員工的專業及能力規劃與執行職涯培育發展計畫。</p>	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	<p>本公司所提供之產品屬高彈性客製化產品，故對於客戶要求之規格及製作條件皆按照合約內容執行並且保密。本公司訂有「個人資料保護管理辦法」，落實客戶個人資料之保護、管理及利用，另遵照保密合約之協議保護交易資訊不外洩。如有客訴事件，本公司官網有「利害關係人」及「聯絡我們」專區，提供公司服務電話跟意見箱，服務不漏接。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂有「供應商及代工廠商管理作業」及「供應商企業社會責任管理辦法」，規範供應商在環境保護及安全衛生之要求，增進對社會與環境之責任，與供應商共同致力於綠色環保科技，且每年度定期進行供應商評鑑。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司未來將依照國際通用之報告書編製準則標準並遵循「新版公司治理藍圖」相關期程編制永續報告書。	本公司並未編製永續報告書，但配合法令逐步實施。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有「永續發展實務守則」，其運作與守則差異情形如上所述。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
<p>1. 回饋社會</p> <p>暉盛秉持回饋社會的精神，定期舉辦關懷低收入戶公益活動，主動提供生活物資與關懷禮金，為弱勢家庭增添溫暖與希望，活動由公司同仁熱情參與，傳遞企業關懷與溫暖。</p> <p>2. 社區關懷</p> <p>暉盛長期關注在地關懷，盼透過實際行動，營造溫馨、互助的社區氛圍，定期於重要節慶前夕致贈禮品予社區長者，傳遞溫暖與關懷，由同仁親自前往發放，並與長輩們互動交流，展現企業善盡社會責任的精神。</p> <p>3. 「用愛扶持」喜憨兒</p> <p>暉盛響應公益，以實際行動支持喜憨兒基金會，採購其精心製作的美味禮品，包括手工肉乾、風味干貝醬與傳統手作肉粽作為企業贈禮，傳遞愛與關懷，期盼為憨兒們創造穩定工作機會，提升其自立能力與生活尊嚴，實踐共好理念，落實企業社會責任。暉盛未來持續關注弱勢族群，擴大公益參與，攜手共築友善、包容且有溫度的社會，發揮企業正向影響力。</p> <p>請參考本公司網站企業社會責任相關資訊，網址：https://www.nemstek.com.tw。</p>				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		無重大差異
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		無重大差異
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公開資訊觀測站及公司官網揭露 (https://www.nemstek.com.tw)。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。			

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式

本公司已訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規章，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nemstek.com.tw>)。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

本公司網站：<https://www.nemstek.com.tw>

陸、重要決議、公司章程及相關法規

一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)

- (一)與本次發行有關之董事會議事錄：詳附十二。
- (二)公司章程及章程新舊條文對照表：詳附件十三。
- (三)盈餘分配表：詳附件十四。

二、未來股利發放政策

依本公司章程規定，本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案。本項盈餘分派以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響事項

本公司未來現金增資發行價格之訂定，主要係考量產業前景、公司競爭利基、未來營運狀況及發行市場環境等因素後，與證券承銷商協商後共同訂定承銷價格，而實際發行價格，則待主管機關核准之，再由本公司與證券承銷商視當時市場之狀況及最近期之營運情形，並經董事會議定之。惟本公司對未來營收及獲利狀況尚屬可期，故未來本公司辦理現金增資對每股獲利能力之稀釋程度應尚屬有限。

四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容：不適用。

附件一

民國 113 年度合併財務報告暨
會計師查核報告

【股票代號：7730】

暉盛科技股份有限公司及其子公司
合併財務報告暨會計師查核報告
民國 113 及 112 年度

公司地址：台南市安南區台南科技工業區科技五路 100 號
公司電話：06-2915500

目 錄

項 目	頁 次
一、封面	1
二、目錄	2
三、聲明書	3
四、會計師查核報告	4
五、合併資產負債表	5
六、合併綜合損益表	6
七、合併權益變動表	7
八、合併現金流量表	8
九、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	9
(二)通過財務報告之日期及程序	9
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	9~12
(四)重大會計政策之彙總說明	12~21
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	22~23
(六)重要會計項目之說明	23~39
(七)關係人交易	39~40
(八)質押之資產	40
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	41
(十)重大之災害損失	41
(十一)重大之期後事項	41
(十二)其他	41~46
(十三)附註揭露事項	47
1. 重大交易事項相關資訊	48~49
2. 轉投資事業相關資訊	50
3. 大陸投資資訊	51~52
(十四)部門資訊	53~54

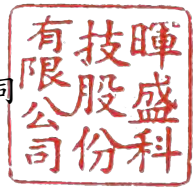
暉盛科技股份有限公司
聲 明 書

本公司民國113年度(自113年1月1日至113年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：暉盛科技股份有限公司

負責人：宋俊毅



中 華 民 國 114 年 3 月 19 日

會計師查核報告

暉盛科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

暉盛科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱暉盛集團)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達暉盛集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與暉盛集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對暉盛集團民國 113 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對暉盛集團民國 113 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請參閱合併財務報告附註四(十八)；收入認列之會計估計及假設不確定性請參閱合併財務報告附註五(一)1. 及五(二)1.；收入認列說明請參閱合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標，暉盛集團之產品因客戶需求而有不同的客製化程度，導致訂單或合約條件有所差異。由於收入認列之時點及金額是否正確對財務報告之影響實屬重大，因此將收入認列之測試認定為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性，檢視重要客戶訂單；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。

其他事項

暉盛科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估暉盛集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算暉盛集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

暉盛集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對暉盛集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使暉盛集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致暉盛集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

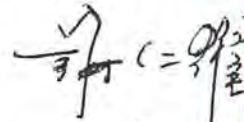
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對暉盛集團民國 113 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：謝 仁 耀



會計師：李 國 銘

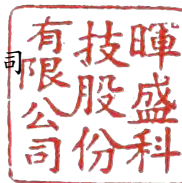


核准文號：金管證審字第 10200032833 號

金管證審字第 1100145994 號

民國 114 年 3 月 19 日

暉盛科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 465,474	42	\$ 385,537	36
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	5,445	1	5,026	-
1150	應收票據淨額(附註六(三))	195	-	47	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	232,819	21	268,277	24
1200	其他應收款	267	-	191	-
130x	存貨(附註六(五))	62,614	6	136,942	12
1410	預付款項(附註六(六))	10,616	1	10,242	1
1476	其他金融資產-流動(附註八)	16,395	2	-	-
11xx	流動資產合計	793,825	73	806,262	73
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、八)	266,746	24	265,100	25
1780	無形資產(附註六(八))	2,036	-	2,474	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十三))	6,674	1	9,717	1
1920	存出保證金	1,463	-	1,137	-
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	16,395	2	15,353	1
15xx	非流動資產合計	293,314	27	293,781	27
1xxx	資產總計	\$ 1,087,139	100	\$ 1,100,043	100

(接次頁)

(承前頁)

代碼	負債及權益	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2130	合約負債-流動(附註六(十七))	\$ 28,712	3	\$ 34,631	3
2170	應付帳款	71,895	6	65,070	6
2200	其他應付款(附註六(九))	53,563	5	65,646	6
2230	本期所得稅負債	8,749	1	28,697	3
2250	負債準備-流動(附註六(十))	4,007	-	4,420	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一))	17,622	2	11,034	1
21xx	流動負債合計	184,548	17	209,498	19
	非流動負債				
2540	長期借款(附註六(十一))	144,306	13	161,397	15
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十三))	704	-	-	-
2630	長期遞延收入(附註六(十一))	11,513	1	12,459	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	16	-	-	-
25xx	非流動負債合計	156,539	14	173,856	16
2xxx	負債總計	341,087	31	383,354	35
	權益				
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六(十三))				
3110	普通股股本	288,598	27	288,598	26
3200	資本公積(附註六(十四))	55,390	5	55,390	5
3300	保留盈餘(附註六(十六))				
3310	法定盈餘公積	79,502	7	66,176	6
3320	特別盈餘公積	126	-	80	-
3350	未分配盈餘	322,419	30	306,571	28
3400	其他權益	17	-	(126)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	746,052	69	716,689	65
3xxx	權益總計	746,052	69	716,689	65
	負債及權益總計	\$ 1,087,139	100	\$ 1,100,043	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅



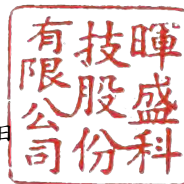
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	\$ 547,630	100	\$ 762,039	100
5000	營業成本(附註六(五)、十二(六))	(332,690)	(61)	(470,536)	(62)
5900	營業毛利(毛損)	214,940	39	291,503	38
	營業費用				
6100	推銷費用(附註十二(六))	(40,868)	(7)	(37,613)	(5)
6200	管理費用	(65,218)	(12)	(62,764)	(7)
6300	研究發展費用	(23,958)	(4)	(27,880)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益(附註六(四))	2,143	-	3,353	-
6000	營業費用合計	(127,901)	(23)	(124,904)	(16)
6900	營業利益(損失)	87,039	16	166,599	22
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註六(十九))	4,112	1	2,837	-
7010	其他收入(附註六(二十))	2,465	-	2,390	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十一))	22,667	5	3,313	1
7050	財務成本(附註六(二十二))	(3,300)	(1)	(3,196)	-
7000	營業外收入及支出合計	25,944	5	5,344	1
7900	稅前淨利(淨損)	112,983	21	171,943	23
7950	所得稅(費用)利益(附註六(二十三))	(26,033)	(5)	(38,682)	(5)
8200	本期淨利(淨損)	86,950	16	133,261	18
	其他綜合損益(附註六(二十四))				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(10)	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	2	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	143	-	(46)	-
8300	其他綜合損益(淨額)	135	-	(46)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 87,085	16	\$ 133,215	18
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 86,950	16	\$ 133,261	18
8620	非控制權益(淨利/損)	-	-	-	-
		\$ 86,950	16	\$ 133,261	18
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 87,085	16	\$ 133,215	18
8720	非控制權益(綜合損益)	-	-	-	-
		\$ 87,085	16	\$ 133,215	18
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註六(二十五))	\$ 3.01		\$ 5.00	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(二十五))	\$ 2.96		\$ 4.84	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅



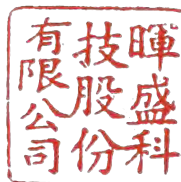
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁佳



暉盛科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益								
	保留盈餘					其他權益項目			權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益 總計		
112年1月1日餘額	\$ 262,558	\$ 22,600	\$ 56,085	\$ -	\$ 209,737	\$ (80)	\$ 550,900	\$ 550,900	
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	10,091	-	(10,091)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	80	(80)	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(26,256)	-	(26,256)	(26,256)	
112年度淨利(淨損)	-	-	-	-	133,261	-	133,261	133,261	
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(46)	(46)	(46)	
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	133,261	(46)	133,215	133,215	
股份基礎給付交易	26,040	32,790	-	-	-	-	58,830	58,830	
112年12月31日餘額	288,598	55,390	66,176	80	306,571	(126)	716,689	716,689	
追溯適用之影響數	-	-	-	-	(2)	-	(2)	(2)	
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	13,326	-	(13,326)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	46	(46)	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(57,720)	-	(57,720)	(57,720)	
113年度淨利(淨損)	-	-	-	-	86,950	-	86,950	86,950	
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	(8)	143	135	135	
113年度綜合損益總額	-	-	-	-	86,942	143	87,085	87,085	
113年12月31日餘額	\$ 288,598	\$ 55,390	\$ 79,502	\$ 126	\$ 322,419	\$ 17	\$ 746,052	\$ 746,052	

董事長：宋俊毅



(請參閱合併財務報告附註)

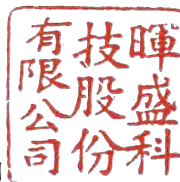
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元


項 目	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 112,983	\$ 171,943
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	13,020	12,245
攤銷費用	1,660	1,480
預期信用減損損失(利益)數	(2,143)	(3,353)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損 失(利益)	(419)	(236)
利息費用	3,300	3,196
利息收入	(4,112)	(2,837)
股份基礎給付酬勞成本	-	9,354
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	43	-
其他項目	(946)	(946)
收益費損項目合計	10,403	18,903
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	(148)	(4)
應收帳款(增加)減少	37,601	9,451
其他應收款(增加)減少	(76)	811
存貨(增加)減少	63,769	151,926
預付款項(增加)減少	(374)	12,978
與營業活動相關之資產之淨變動合計	100,772	175,162
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(5,919)	(118,118)
應付帳款增加(減少)	6,825	(68,188)
其他應付款增加(減少)	(11,479)	(49)
負債準備增加(減少)	(413)	(758)
淨確定福利負債增加(減少)	4	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,982)	(187,113)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	89,790	(11,951)
調整項目合計	100,193	6,952
營運產生之現金流入(流出)	213,176	178,895
收取之利息	4,112	2,837
支付之利息	(2,768)	(2,594)
退還(支付)之所得稅	(42,232)	(44,507)
營業活動之淨現金流入(流出)	172,288	134,631
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(4,946)	(3,663)


(接次頁)


(承前頁)

項 目	113年度	112年度
處分不動產、廠房及設備	\$ 192	\$ -
存出保證金增加	(326)	-
存出保證金減少	-	63
取得無形資產	(1,222)	(1,458)
其他金融資產增加	(17,437)	-
其他金融資產減少	-	2
投資活動之淨現金流入(流出)	(23,739)	(5,056)
籌資活動之現金流量		
償還長期借款	(11,035)	(5,833)
發放現金股利	(57,720)	(26,256)
員工執行認股權	-	49,476
籌資活動之淨現金流入(流出)	(68,755)	17,387
匯率變動對現金及約當現金之影響	143	(46)
本期現金及約當現金增加(減少)數	79,937	146,916
期初現金及約當現金餘額	385,537	238,621
期末現金及約當現金餘額	\$ 465,474	\$ 385,537

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅 

經理人：許嘉元 

會計主管：蔡郁仁 

暉盛科技股份有限公司及其子公司
合併財務報告附註
民國113年及112年1月1日至12月31日
(金額除特別註明者外，均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱本公司)成立於91年6月，主要營業項目為電子材料批發、機械材料批發、電器批發、國際貿易、其他機械器具批發(電漿清潔器)、其他電機及電子機械器材製造(電漿清潔器)。110年11月本公司營運據點搬遷至台南科技工業園區。113年3月18日本公司普通股登錄為興櫃股票，開始於興櫃買賣交易。本公司及本公司之子公司(以下簡稱為本集團)之主要營運活動，請參閱附註四(三)2.之說明。另本公司並無最終母公司。

本公司之功能性貨幣及合併財務報告之表達貨幣均為新台幣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於114年3月19日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「IFRSs」)之影響

下表彙列金管會認可之113年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024年1月1日(註)
IAS 1 之修正「負債之流動或非流動分類」	2024年1月1日(註)
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024年1月1日(註)
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024年1月1日(註)

註：於2024年1月1日以後開始之年度報導期間適用此項修正。

1. IFRS 16之修正「售後租回中之租賃負債」

此修正闡明，對於售後租回之交易，若資產之移轉依IFRS 15之規定係以銷售處理者，賣方兼承租人因租回所產生之負債應依IFRS 16有關租賃負債之規定處理；惟若涉及非取決於指數或費率之變動租賃給付時，賣方兼承租人仍應以不認列與所保留使用權有關之損益之方式決定並認列該等變動給付所產生之租賃負債，後續實際之租賃給付金額與減少之租賃負債帳面金額間之差額係認列於損益。

2. IAS 1之修正「負債之流動或非流動分類」

此修正闡明，判斷負債是否分類為非流動時，應評估企業於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少12個月之權利。若企業於報導期間結束日具有該權利，則無論企業是否預期將行使該權利，該負債應分類為非流動。若企業必須遵循特定條件始具有將清償遞延之權利，則必須於報導期間結

東日已遵循該等特定條件，始能將該負債分類為非流動，即使債權人係於較晚日期檢測企業是否遵循該等條件。

此外，此修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本集團之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本集團之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

3. IAS 1之修正「具合約條款之非流動負債」

此修正進一步闡明，僅有報導期間結束日以前須遵循之合約條款會影響該日負債之分類。報導期間後12個月內須遵循之合約條款並不影響負債之分類，惟企業對於報導期間結束日分類為非流動負債，若可能無法遵循合約條款而須於報導期間後12個月內清償者，應於附註揭露相關事實及情況。

4. IAS 7 及 IFRS 7之修正「供應商融資安排」

供應商融資安排係由一個或多個融資提供者代企業支付帳款予供應商，而企業同意依據與供應商約定之付款日或較晚之日期付款予融資提供者。IAS 7之修正係規定企業應揭露其供應商融資安排之資訊，以使財務報表使用者能夠評估該等安排對企業之負債、現金流量及流動性風險暴險之影響。IFRS 7之修正則於其應用指引中，納入企業於揭露如何管理金融負債流動性風險時，亦可能考量其是否透過供應商融資安排已取得或可取得融資額度，以及該等安排是否可能導致流動性風險集中之情況。

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二) 尚未採用經金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之114年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日

1. IAS 21之修正「缺乏可兌換性」

此修正定義可兌換性，並提供當某一貨幣缺乏可兌換性時，企業如何決定衡量日之即期匯率之相關應用指引。另此修正要求企業於某一貨幣不可兌換為另一貨幣時，於其財務報表中提供更有用之資訊。

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三) 國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「金融工具之分類與衡量之修正」	2026 年 1 月 1 日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「涉及自然電力的合約」	2026 年 1 月 1 日
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之未定資產出售或投入」	

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 17「保險合約」	2023年1月1日
IFRS 17「保險合約」之修正	2023年1月1日
IFRS 17之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023年1月1日
IFRS 18「財務報表之表達與揭露」	2027年1月1日
IFRS 19「不具公共課責性之子公司：揭露」	2027年1月1日
IFRS 之年度改善—第 11 冊	2026年1月1日

1. IFRS 9及 IFRS 7之修正「金融工具之分類與衡量之修正」此修正分別說明如下：

- (1) 釐清某些金融資產和負債的認列和除列之日期，新增在使用電子支付系統以現金交割金融負債(或部分金融負債)時，當且僅當企業發起支付指令並導致以下情況時，允許企業在交割日前視為將金融負債解除：
 - A. 企業不具有撤銷、停止或取消支付指定之能力；
 - B. 企業因該支付指令而不具有取得用於交割之現金之實際能力；
 - C. 與該電子支付系統相關之交割風險並不重大。
- (2) 釐清並增加評估金融資產是否符合僅支付本金和利息(SPPI)標準的進一步指引，範圍包括根據或有事件改變現金流量的合約條款(例如，與ESG目標連結的利率)、無追索權特性之工具，及合約連結工具。
- (3) 新增為某些具有可改變現金流量的合約條款的工具(例如某些具有與實現環境、社會和治理(ESG)目標相關的特徵的工具)，應揭露或有事項性質之質性描述；有關可能來自該等合約條款之合約現金流量變動範圍之量化資訊；及於該等合約條款下金融資產之總帳面金額及金融負債之攤銷後成本。
- (4) 更新透過不可撤銷之選擇指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(FVTOCI)應按每一種類揭露其公允價值，無須再按每一標的揭露其公允價值資訊。另應揭露於報導期間認列於其他綜合損益之公允價值損益金額，分別列示於報導期間內除列之投資有關之公允價值損益金額，及於報導期間結束日仍持有之投資有關之公允價值損益金額；以及於報導期間除列投資而於報導期間移轉至權益之累積損益。

2. IFRS 9及 IFRS 7之修正「涉及自然電力的合約」

此修正就企業涉及因發電來源取決於不可控的自然條件(如天氣)的基礎，產生電量變化的合約，分別說明如下：

- (1) 釐清企業購買或銷售自然電力的合約對於「自用」要求的應用：

當合約規定企業有義務在發電時購買並接收電力，且合約電力交易市場的設計和營運要求企業在規定時間內出售任何數量的未使用電力，則企業須考量有關其在不超過12個月合理時間內對於過去、當前和預期未來電力交易的合理且有支持的資訊，當其購買足夠的電力來抵消在其售電的同一市場中銷售的任何未使用的電力，則該企業是電力的淨購買者。新增應用修正案為自用之涉及自然電力的合約，須揭露：

 - A. 企業面臨基礎電量的變化以及企業可能被要求在無法使用電力的交付間隔期間購買電力的風險；
 - B. 未確認的合約承諾，包括根據這些合約購電預計的未來現金流量；

C. 合約於報告期間內對企業財務績效的影響。

(2) 釐清指定涉及自然電力的合約為避險工具如何得以適用避險會計：

得將被避險項目指定為預測電力交易的可變名義金額，該金額與預期由避險工具中提及的發電設施交付的自然電力的可變金額一致。另當避險工具的現金流量企業在現金流量避險關係中，當指定涉及自然電力的合約作為避險工具，是以指定的預期交易的發生為條件，則該預期交易被推定為極有可能發生。

對於將涉及自然電力的合約指定為避險工具之企業，應按IFRS 7 依風險類別進行分類之避險工具揭露其條款及條件。

3. IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

此修正解決了現行IFRS 10及IAS 28的不一致。投資者出售(投入)資產與其關聯企業或合資之交易，視出售(投入)資產之性質決定認列全部或部份處分損益：

(1) 當出售(投入)之資產符合「業務」時，認列全部處分損益；

(2) 當出售(投入)之資產不符合「業務」時，僅能認列與非關係投資者對關聯企業或合資之權益範圍內之部分處分損益。

4. IFRS 18 「財務報表之表達與揭露」

IFRS 18 「財務報表之表達與揭露」取代IAS 1並更新綜合損益表之架構，及新增管理績效衡量之揭露，並強化運用於主要財務報表及附註之彙總及細分原則。

5. IFRS 19 「不具公共課責性之子公司：揭露」

此準則允許合格子公司適用減少揭露要求之 IFRS 會計準則。

除上述影響外，截至本合併財務報告發布日止，本集團仍持續評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本合併財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。

(二) 編製基礎

1. 除下列重要項目外，本合併財務報告係按歷史成本編製：

(1) 按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(2) 按退休基金資產與確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

2. 編製符合金管會認可之IFRSs之合併財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)合併基礎

1. 合併財務報告編製原則：

- (1) 本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體)，當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告，於喪失控制之日起終止合併。
- (2) 集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本集團採用之政策一致。
- (3) 損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益；綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益，即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。
- (4) 對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列於權益。
- (5) 當喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為損益。

2. 列入合併財務報告之子公司如下：

子 公 司	主要營業項目	持股或出資比例	
		113.12.31	112.12.31
Stable Promise Group Co., Ltd.	一般投資業	100%	100%
昆山金暉盛電子商貿有限公司	電子器材進出口及相關服務	100%	100%

- (1) 上列編入合併財務報告之子公司均屬非重要子公司，其財務報告均經會計師查核。
 - (2) 合併子公司增減情形：無。
3. 未列入合併財務報告之子公司：無。
 4. 子公司會計期間不同之調整及處理方式：無。
 5. 重大限制：無。
 6. 子公司持有母公司發行證券之內容：無。
 7. 具重大非控制權益之子公司資訊：無。

(四)外幣換算

1. 本集團內每一個體之財務報表所列之項目，均係以該個體營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。
2. 編製各合併個體之個體財務報表時，以該個體功能性貨幣以外之貨幣(外幣)交易者，係以交易日匯率換算認列，於報導期間結束日，外幣貨幣性項目以該日即期匯率重新換算，兌換差額於發生當期認列為損益。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當年度損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。
3. 為編製合併財務報表，國外營運機構之資產及負債係以報導期間結束日之即期匯率換算為新台幣；收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額認列為其他綜合損益，並累計於權益項下之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(並適當地分配予非控制權益)。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

1. 資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：
 - (1) 預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
 - (2) 主要為交易目的而持有者。
 - (3) 預期於資產負債表日後十二個月內將實現者。
 - (4) 現金及約當現金，但於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受到其他限制者除外。

本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2. 負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：
 - (1) 預期將於正常營業週期中清償者。
 - (2) 主要為交易目的而承擔者。
 - (3) 須於資產負債表日後十二個月內清償者(即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債)。
 - (4) 於資產負債表日不具有實質權利可將清償期限至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(六)現金及約當現金

現金及約當現金包括庫存現金、銀行存款及隨時可轉換成定額現金且價值風險變動甚小之短期並具高度流動性之投資(包括原始到期日在三個月內之定期存款)。

(七)金融工具

金融資產與金融負債應於本集團成為該金融工具合約條款之一方時認列。

金融資產與金融負債原始認列時，係按公允價值衡量。原始認列時，直接可歸屬於金融資產與金融負債(除分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債外)取得或發行之交易成本，應從該金融資產或金融負債之公允價值加計或減除。直接可歸屬於透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本集團所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融工具投資。

A. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括本集團未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，及不符合分類為按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，所產生之股利、利息係認列為其他收入，再衡量產生之利益或損失則係認列於其他利益及損失。公允價值之決定方式請參閱附註十二。

B. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本集團投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- (a) 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- (b) 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- (a) 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- (b) 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，利息收入係以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。

(2) 金融資產減損

A. 本集團於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產(含應收帳款)、透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資、應收租賃款及合約資產之減損損失。

- B. 應收帳款、合約資產及應收租賃款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他債務工具投資係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按12個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。
- C. 預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後12個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。
- D. 所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本集團於符合下列情況之一時，將除列金融資產：

- A. 來自金融資產現金流量之合約之權利失效。
- B. 移轉收取金融資產現金流量之合約權利，且業已移轉金融資產所有權之幾乎所有風險及報酬。
- C. 既未移轉亦未保留金融資產所有權之幾乎所有風險及報酬，惟未保留對金融資產之控制。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資整體除列時，其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本集團發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

權益工具係指表彰某一企業於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本集團發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

本集團僅於義務解除、取消或失效時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）之差額認列為損益。

4. 金融工具之修改

當金融工具之合約現金流量發生重新協商或修改時，若未導致應除列該金融工具，則本集團以修改後之合約現金流量按原始有效利率折現重新計算金融

資產之總帳面金額或金融負債之攤銷後成本，並將修改利益或損失認列於損益；所發生之成本或費用則作為修改後金融工具帳面金額之調整，並於修改後剩餘期間攤銷。若該重新協商或修改導致應除列該金融工具時，則依除列規定處理。

(八)存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者為衡量基礎，採永續盤存制，成本依加權平均法決定。製成品及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用(按正常產能分攤)，惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入估計之成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(九)不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。建造中之不動產、廠房及設備於達預期使用狀態前，測試該等資產能否正常運作時所生產之樣品係以成本與淨變現價值孰低衡量，其銷售價款及成本係認列於損益。
2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本集團，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。
3. 土地不提列折舊。其他不動產、廠房及設備採成本模式，按估計耐用年限以直線法計提折舊。本集團於每一財務年度結束日對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

建築物

廠房主建物	50年
其他	5年
機器設備	2至5年
運輸設備	5年
辦公設備	3至5年
其他設備	2至15年

4. 於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備除列。除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間差額，並且認列於當期損益。

(十)租賃

本集團係於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。對於合約包含一項租賃組成部分以及一項或多項之額外租賃或非租賃組成部分者，本集團以每一租賃組成部分之相對單獨價格及非租賃組成部分之彙總單獨價格為基礎，將合約中之對價分攤至該租賃組成部分。

1. 本集團為承租人

除低價值標的資產之租賃及短期租賃按直線基礎認列費用外，本集團對其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊，惟若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付等）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、標的資產購買選擇權之評估、殘值保證下預期支付之金額或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本集團再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係以單行項目列報於合併資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租賃給付係於發生當期認列為費用。

2. 本集團為出租人

租賃如移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬，則分類為融資租賃；反之，則分類為營業租賃。

融資租賃下，租賃給付包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付等。租賃投資淨額係按應收租賃給付及未保證殘值兩者之現值總和，並表達為應收融資租賃款。本集團採有系統且合理之基礎將融資收益分攤於租賃期間，以反映本集團未到期之租賃投資淨額於各期間可獲得之固定報酬率。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎認列租賃收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本係加計至標的資產之帳面金額，按直線基礎於租賃期間認列為費用。

(十一) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產係以成本減除累計攤銷及累計減損列示。電腦軟體設計費之攤銷金額係依直線法按1-5年分攤。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時除列無形資產。除列無形資產所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當期損益。

(十二)非金融資產減損

本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度認列資產減損之情況不存在時，則在以前年度提列損失金額之範圍內予以迴轉。

(十三)負債準備

負債準備係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(十四)員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列費用。

2. 退休金

(1) 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2) 確定福利計畫

A. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值列示。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債(於資產負債表日)之市場殖利率。

B. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

3. 員工酬勞及董監酬勞

員工酬勞及董監酬勞係於具法定或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

4. 離職福利

離職福利係於正常退休日前終止對員工之聘僱或當員工決定接受公司之福利邀約以換取聘僱之終止而提供之福利。本集團係於不再能撤銷離職福利之要

約或於認列相關重組成本之孰早時認列費用。不預期在資產負債表日後12個月全部清償之福利應予以折現。

(十五)股本

普通股分類為權益。特別股之分類係對合約協議之實質及金融負債與權益工具之定義，就附於特別股之特定權利予以評估，當展現金融負債之基本特性則分類為負債，否則分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本於權益中列為價款減項。

(十六)股份基礎給付

1. 以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務，於既得期間認列為酬勞成本，並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整，直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。
2. 以現金交割之股份基礎給付協議，係以所承擔負債之公允價值，於既得期間內認列為酬勞成本及負債，並於各個資產負債表日及交割日按所給與權益商品之公允價值衡量，任何變動認列為當期損益。

(十七)所得稅

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。
2. 當期所得稅根據本集團營運及產生應課稅所得之所在國家，採用在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。依我國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形認列所得稅費用。
3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於合併資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易(不包括企業合併)中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公司產生之暫時性差異，本集團可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率(及稅法)為準。
4. 遞延所得稅資產於暫時性差異、未使用之課稅損失及未使用所得稅抵減很有可能於未來課稅所得可供使用之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
5. 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；當有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，且遞延所得

稅資產及負債由同一稅捐機關課徵所得稅之同一納稅主體、或不同納稅主體產生但各主體意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將遞延所得稅資產及負債互抵。

6. 因購置設備或技術、研究發展支出、人才培訓支出及股權投資等所產生之租稅優惠採用所得稅抵減會計。

(十八) 收入認列

本集團來自客戶合約之收入認列原則，係以下列步驟認列收入：

1. 辨認客戶合約；
2. 辨認合約中之履約義務；
3. 決定交易價格；
4. 將交易價格分攤至合約中之履約義務；及
5. 於滿足履約義務時認列收入。

移轉商品或勞務與收取對價之時間間隔在1年以內之合約，其重大財務組成部分不予調整交易價格。

(1) 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自機台設備等產品之銷售。銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，因客戶對商品已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風險，本集團係於該時點認列收入及應收帳款；並以扣除銷貨退回、數量折扣及折讓之淨額表達。

去料加工時，加工產品所有權之控制並未移轉，是以去料時不認列收入。

(2) 維修收入

維修係依相關協議內容於勞務提供時認列。

(十九) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(二十) 政府補助

政府補助於可合理確信本集團將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，始按公允價值予以認列。

政府補助係於其意圖補償之相關成本於本集團認列為費用之期間內，按有系統之基礎認列於損益。若政府補助係用於補償已發生之費用或損失，或係以給與本集團立即財務支援為目的且無未來相關成本，則於其可收取之期間認列於損益。與不動產、廠房及設備有關之政府補助，認列為非流動負債，並按相關資產之估計耐用年限以直線法認列為當期損益。

本集團所取得低於市場利率之政府貸款，所收取之貸款金額與依當時市場利率計算之貸款公允價值兩者間之差額係認列為政府補助。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團將氣候變遷及相關政府政策及法規所造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，並將持續檢視基本假設及估計。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

本集團編製本合併財務報告時，所作會計政策採用之重要判斷、重大會計估計及假設如下：

(一)會計政策採用之重大判斷

1. 收入認列

本集團依IFRS 15判斷於移轉特定商品或勞務予客戶前是否已取得或未取得該等商品或勞務之控制，而將為該交易中之主理人或代理人，若判斷為交易之代理人時，則認列交易淨額為收入。

若有下列情況之一，本集團為主理人：

- (1) 商品或其他資產移轉予客戶前，本集團先自另一方取得該商品或資產之控制；或
- (2) 本集團控制由另一方提供勞務之權利，以具有主導該方代本集團提供勞務予客戶之能力；或
- (3) 本集團向另一方取得商品或勞務之控制，用以與其他商品或勞務結合，以提供特定之商品或勞務予客戶。

用以協助判斷本集團於移轉特定商品或勞務予客戶前是否控制該商品或勞務之指標包含(但不限於)：

- (1) 本集團對完成提供特定商品或勞務之承諾負有主要責任。
- (2) 本集團於特定商品或勞務移轉予客戶之前後承擔存貨風險，或於控制移轉予客戶後承擔存貨風險(例如，若客戶具有退貨權)。
- (3) 本集團具有訂定價格之裁量權。

2. 金融資產分類之經營模式判斷

本集團依據反映金融資產群組為達成特定經營目的而共同管理之層級，評估金融資產所屬經營模式。此評估需考量所有攸關證據，包括資產績效衡量方式、影響績效之風險及相關經理人之薪酬決定方式，且需運用判斷。本集團持續評估其經營模式判斷是否適當，並為此監控於到期日前除列之按攤銷後成本衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資，瞭解其處分原因以評估該處分是否與經營模式之目標一致。若發現經營模式已有變更，本集團依IFRS 9之規定重分類金融資產，並自重分類日起推延適用。

(二)重要會計估計及假設

1. 收入認列

銷貨收入係於移轉商品或勞務之控制予客戶而滿足履約義務時認列，並扣除估計之相關銷貨退回、折扣及其他類似之折讓。該等銷貨退回及折讓係依歷史經驗及其他已知原因估計，且本集團定期檢視估計之合理性。

2. 金融資產之估計減損

應收帳款之估計減損係基於本集團對於違約率及預期損失率之假設。本集團考量歷史經驗、現時市場情況及前瞻性資訊，以作成假設並選擇減損評估之

輸入值。所採用重要假設及輸入值請參閱附註六(四)，若未來實際現金流量少於預期，可能會產生重大減損損失。

3. 公允價值衡量及評價流程

當採公允價值衡量之資產及負債於活絡市場無市場報價時，本集團依相關法令或依判斷決定是否委外估價並決定適當之公允價值評價技術。

若估計公允價值時無法取得第一等級輸入值，本集團係參考對被投資者財務狀況與營運結果之分析、最近交易價格、相同權益工具於非活絡市場之報價、類似工具於活絡市場之報價及可比公司評價乘數等資訊；對衍生工具則係參考市場價格或利率及衍生工具特性等資訊決定輸入值，若未來輸入值實際之變動與預期不同，可能會產生公允價值變動，本集團定期依市場情況更新各項輸入值，以監控公允價值衡量是否適當。

公允價值評價技術及輸入值之說明，請參閱附註十二(三)。

4. 有形資產及無形資產減損評估

資產減損評估過程中，本集團需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及產業特性，決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損，任何由於經濟狀況之變遷或集團策略所帶來的估計改變均可能在未來造成重大減損。

5. 遞延所得稅資產之可實現性

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、免稅期間、可使用之所得稅抵減、稅務規劃等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

6. 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本集團必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。本集團評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。

六、重要會計項目之說明

(一) 現金及約當現金

項 目	113年12月31日	112年12月31日
庫存現金	\$ 206	\$ 512
活期存款	346,577	287,434
外幣存款	118,691	97,591
合 計	<u>\$ 465,474</u>	<u>\$ 385,537</u>

1. 本集團往來之金融機構信用品質良好，且本集團與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。
2. 本集團之現金及約當現金未有提供質押之情形。

(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
非衍生金融資產		
基金受益憑證	\$ 5,445	\$ 5,026

1. 本集團於113及112年度認列之淨(損)益分別為419仟元及236仟元。
2. 本集團未有將透過損益按公允價值衡量之金融資產提供質押之情形。
3. 相關信用風險管理及評估方式請詳附註十二(二)之說明。

(三) 應收票據淨額

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
按攤銷後成本衡量		
應收票據	\$ 195	\$ 47
減：備抵損失	-	-
應收票據淨額	\$ 195	\$ 47

1. 本集團未有將應收票據提供質押之情形。
2. 有關應收票據備抵損失之相關揭露，詳附註六(四)之說明

(四) 應收帳款淨額

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款	\$ 236,942	\$ 274,566
減：備抵損失	(4,123)	(6,289)
應收帳款淨額	\$ 232,819	\$ 268,277

1. 本集團未逾期且未減損之應收帳款均符合依據交易對手之產業特性、營業規模及獲利情況所訂定之授信標準，平均授信期間為3至6個月(保固款除外，保固款一般約10%~20%，收款從其約定，通常為保固期滿後)。
2. 本集團未有將應收帳款提供質押之情形。
3. 本集團採用簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收票據及應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務及產經狀況等。因本集團之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

4. 本集團依準備矩陣衡量應收票據及應收帳款之備抵損失如下：

113年12月31日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%~0.05%	\$ 141,051	\$ -	\$ 141,051
30天以下	0%~1%	23,562	(230)	23,332
31~90天	0%~1%	37,142	(362)	36,780
91~180天	0%~5%	17,910	(407)	17,503
181~365天	0%~20%	4,240	(573)	3,667
逾期超過一年	0%~50%	13,226	(2,545)	10,681
已有減損跡象	100%	6	(6)	-
合計		\$ 237,137	\$ (4,123)	\$ 233,014

112年12月31日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%~0.05%	\$ 214,191	\$ (53)	\$ 214,138
30天以下	0%~1%	-	-	-
31~90天	0%~1%	7,556	-	7,556
91~180天	0%~5%	13,005	(609)	12,396
181~365天	0%~20%	7,310	(751)	6,559
逾期超過一年	0%~50%	32,524	(4,849)	27,675
已有減損跡象	100%	27	(27)	-
合計		\$ 274,613	\$ (6,289)	\$ 268,324

5. 應收票據及帳款備抵損失變動表如下：

	113年度	112年度
期初餘額	\$ 6,289	\$ 9,704
減：減損損失迴轉	(2,143)	(3,353)
減：無法回收而沖銷	(23)	(62)
期末餘額	\$ 4,123	\$ 6,289

6. 若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本集團無法合理預期可回收金額，本集團直接沖銷相關應收款項，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。本集團於113及112年度沖銷合約金額之應收款項分別為23仟元及62仟元。

7. 相關信用風險管理及評估方式，請參閱附註十二之說明。

(五)存貨及營業成本

項 目	113年12月31日	112年12月31日
原 料	\$ 23,917	\$ 29,814
商 品	5,004	2,689
在 製 品	33,237	102,458
製 成 品	456	1,981
淨 額	\$ 62,614	\$ 136,942

1. 當期認列為營業成本之存貨相關(損)益如下：

	113 年 度	112 年 度
出售存貨成本	\$ 303,221	\$ 419,142
維修成本	30,808	33,943
存貨盤(盈)虧	27	1,271
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(1,366)	16,180
營業成本合計	\$ 332,690	\$ 470,536

2. 本集團113及112年度列入各類存貨成本減項之備抵跌價及呆滯損失變動如下：

	113 年 度	112 年 度
期 初 餘 額	\$ 17,661	\$ 7,896
加：本期提列	(1,366)	16,180
減：本期報廢沖銷	(3,202)	(6,415)
期 末 餘 額	\$ 13,093	\$ 17,661

3. 截至113年12月31日止，本集團未有將存貨提供質押之情形。

(六)預付款項

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
預 付 貨 款	\$ 3,137	\$ 5,269
預 付 費 用	6,298	2,592
進 項 稅 額	1	2
留 抵 稅 額	1,180	2,379
合 計	\$ 10,616	\$ 10,242

(七)不動產、廠房及設備

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
土 地	\$ 117,681	\$ 117,681
房 屋 及 建 築	133,724	134,713
機 器 設 備	45,776	35,617
運 輸 設 備	7,762	5,627
辦 公 設 備	1,248	1,251
其 他 設 備	5,241	4,166
未完工程及待驗設備	669	-
成 本 合 計	\$ 312,101	\$ 299,055
減：累計折舊	(45,355)	(33,955)
淨 額	\$ 266,746	\$ 265,100

成 本	未完工程及					合 計
	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備(註)	待驗設備	
113.1.1 餘額	\$ 117,681	\$ 134,713	\$ 35,617	\$ 11,044	\$ -	\$ 299,055
增 添	-	-	-	128	4,214	4,342
處 分	-	-	(400)	(1,455)	-	(1,855)
重 分 類	-	(989)	-	4,534	(3,545)	-
存貨轉入	-	-	10,559	-	-	10,559
113.12.31 餘額	\$ 117,681	\$ 133,724	\$ 45,776	\$ 14,251	\$ 669	\$ 312,101
累計折舊						
113.1.1 餘額	\$ -	\$ 11,588	\$ 19,165	\$ 3,202	\$ -	\$ 33,955
折舊費用	-	6,728	4,839	1,453	-	13,020
處 分	-	-	(400)	(1,220)	-	(1,620)
重 分 類	-	(605)	-	605	-	-
113.12.31 餘額	\$ -	\$ 17,711	\$ 23,604	\$ 4,040	\$ -	\$ 45,355

成 本	未完工程及					合 計
	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備(註)	待驗設備	
112.1.1 餘額	\$ 117,681	\$ 134,234	\$ 35,617	\$ 7,256	\$ -	\$ 294,788
增 添	-	479	-	3,788	-	4,267
112.12.31 餘額	\$ 117,681	\$ 134,713	\$ 35,617	\$ 11,044	\$ -	\$ 299,055
累計折舊						
112.1.1 餘額	\$ -	\$ 4,877	\$ 14,055	\$ 2,778	\$ -	\$ 21,710
折舊費用	-	6,711	5,110	424	-	12,245
112.12.31 餘額	\$ -	\$ 11,588	\$ 19,165	\$ 3,202	\$ -	\$ 33,955

註：係包括運輸設備、辦公設備及其他設備。

1. 本期增添與現金流量表取得不動產、廠房及設備調節如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
不動產、廠房及設備增加數	\$ 4,342	\$ 4,267
應付設備款(增)減	604	(604)
購買不動產、廠房及設備支付現金數	\$ 4,946	\$ 3,663

2. 不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：請詳附註六(二十二)之說明。

3. 不動產、廠房及設備減損情形：無。

4. 以不動產、廠房及設備提供質押之情形，請參閱附註八之說明。

(八)無形資產

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
電腦軟體成本	\$ 7,220	\$ 5,998
減：累計攤提	(5,184)	(3,524)
淨 額	\$ 2,036	\$ 2,474

	113 年 度		112 年 度	
成 本				
期初餘額	\$	5,998	\$	4,944
增 添		1,222		1,458
到期除列		-		(404)
期末餘額	\$	7,220	\$	5,998
累計攤提				
期初餘額	\$	3,524	\$	2,448
攤銷費用		1,660		1,480
到期除列		-		(404)
期末餘額	\$	5,184	\$	3,524

(九)其他應付款

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
薪 獎	\$ 25,737	\$ 37,099
員 工 酬 勞	9,782	12,606
應付董監酬勞	1,772	3,486
應付退休金	3,033	2,317
應付保險費	3,924	3,068
應付勞務費	1,877	1,372
應付設備款	-	604
代收款項	555	964
應付其他	6,883	4,130
合 計	\$ 53,563	\$ 65,646

(十)負債準備—流動

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
售後保固準備	\$ 3,384	\$ 3,324
員 工 福 利	623	1,096
合 計	\$ 4,007	\$ 4,420

項 目	113 年 度		
	售後保固準備	員 工 福 利	合 計
1 月 1 日餘 額	\$ 3,324	\$ 1,096	\$ 4,420
當期新增之負債準備	8,631	623	9,254
當期迴轉之負債準備	(8,571)	(1,096)	(9,667)
12 月 31 日餘額	\$ 3,384	\$ 623	\$ 4,007

項 目	112 年 度		
	售後保固準備	員 工 福 利	合 計
1 月 1 日餘 額	\$ 4,095	\$ 1,083	\$ 5,178
當期新增之負債準備	3,494	1,096	4,590
當期迴轉之負債準備	(4,265)	(1,083)	(5,348)
12 月 31 日餘額	\$ 3,324	\$ 1,096	\$ 4,420

1. 本集團提供產品售後保固，依歷史經驗及管理階層之判斷估計，估列可能發生之售後保固負債準備，並於相關產品出售當期認列為費損。
2. 員工福利負債準備係員工既得短期服務休假權利之估列。

(十一) 長期借款及一年或一營業週期內到期長期負債

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
抵押借款	\$ 173,441	\$ 184,890
減：一年內到期	(17,622)	(11,034)
轉列遞延政府補助利益-低利貸款	(11,513)	(12,459)
合 計	\$ 144,306	\$ 161,397
利率區間	0.955%~2.15%	0.83%~2.02%

1. 遞延政府補助利益(列入長期遞延收入)本期變動如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
期 初 餘 額	\$ 12,459	\$ 13,405
本 期 攤 銷(註)	(946)	(946)
期 末 餘 額	\$ 11,513	\$ 12,459

(註)本期攤銷帳列營業外收入及支出—其他收入。

2. 上述長期借款之擔保品，請參閱附註八之說明。
3. 本公司部分長期借款為適用中小企業加速投資行動方案之政府補助低利貸款，依該借款合同規定，本公司於借款期間，自112年度財務報告日起，應維持流動比率不低於150%及負債比率不高於120%之財務承諾，前述之財務比率每年審閱一次，以每年會計師查核簽證之財務報表為計算基準。本公司依113及112年度財務報告計算所約定財務比率已達標準。

(十二) 退職後福利計畫

1. 確定提撥計畫

- (1) 本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
- (2) 本集團於113及112年度依照確定提撥計畫中明定比例應提撥之金額已於綜合損益表認列費用總額分別為4,174仟元及4,542仟元。

2. 確定福利計畫

- (1) 本公司所適用我國「勞動基準法」之退休金制度，係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額依法提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該等委員會名義存入臺灣銀行之專戶。年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

(2) 本公司因確定福利計畫所產生之義務列入資產負債表之金額如下：

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
確定福利義務現值	\$ 16	\$ -
計畫資產公允價值	-	-
淨確定福利負債（資產）	\$ 16	\$ -

(3) 淨確定福利負債之變動列示如下：

項 目	113 年 度		
	確定福利計畫義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1 月 1 日餘額	\$ 2	\$ -	\$ 2
服務成本			
當期服務成本	4	-	4
認列於損益	\$ 4	\$ -	\$ 4
再衡量數			
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)	\$ -	\$ -	\$ -
精算(利益)損失-經驗調整	10	-	10
認列於其他綜合損益	\$ 10	\$ -	\$ 10
12 月 31 日餘額	\$ 16	\$ -	\$ 16

(4) 本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

A. 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內(外)權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

B. 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

C. 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

(5) 本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算。衡量日之重大假設列示如下：

項 目	衡 量 日	
	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
折 現 率	1.50%	1.50%
薪資預期增加率	3.00%	3.00%
確定福利義務平均到期期間	34.3 年	38.4 年

- A. 對於未來死亡率之假設係採用台灣年金保險生命表。
 B. 若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加(減少)之金額如下：

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
折 現 率		
增加 0.25%	\$ (2)	\$ -
減少 0.25%	\$ 1	\$ -
薪資預期增加率		
增加 1%	\$ 6	\$ -
減少 1%	\$ (5)	\$ -

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

(6) 本公司於114年度預計支付予退休計畫之提撥金為0仟元。

(十三)股本

本公司普通股期初與期末流通在外股數及金額調節如下：

	113 年 度	
	股數(仟股)	金 額
12 月 31 日	28,860	\$ 288,598
	112 年 度	
	股數(仟股)	金 額
1 月 1 日	26,256	\$ 262,558
員工認股權	2,604	26,040
12 月 31 日	28,860	\$ 288,598

- 截至113年12月31日止，本公司額定資本額為600,000仟元，分為60,000仟股。
- 本公司於112年8月11日發行酬勞性員工認股選擇權計劃2,620個單位，每單位認股權憑證得認購普通股股數均為1,000股(請參閱附註六(十五))。於112年度已向本公司請求行使認股權為2,604仟股，並已於112年11月完成變更登記。

(十四)資本公積

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
普通股股票發行溢價	\$ 55,333	\$ 55,333
已失效認股權	57	57
合 計	\$ 55,390	\$ 55,390

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，得按股東原有股份之比例發給新股或現金。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。因採用權益法之投資所產生之資本公積，不得作為任何用途。

(十五) 股份基礎給付

1. 員工認股權-112年8月發行

本公司於112年8月11日發行酬勞性員工認股選擇權計劃2,620個單位，每單位認股權憑證得認購普通股股數均為1,000股，其認股價格為每股新台幣19元。認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股價格不予調整。發行之認股權憑證之存續期間為112年8月24日至112年10月23日，員工自被授予認股權憑證後即得依員工認股權憑證發行及認股辦法行使認股權利。本公司酬勞性員工認股選擇權112年度認列之酬勞成本為9,354仟元。

(1) 112年度酬勞性員工認股選擇權計劃之認股選擇權數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下：

	112 年 度	
	數量(仟股)	加權平均行使價格
期初流通在外	-	-
本期給與	2,620	19.00
本期行使	(2,604)	19.00
本期註銷	(16)	-
期末流通在外	-	-
期末可行使之認股選擇權	-	-

(2) 本公司給與之股份基礎給付交易使用Black-Scholes選擇權評價模式，估計給與日認股選擇權之公平價值，相關資訊如下：

給與日	112年8月11日
股利率	0%
預期波動率	25.77%
無風險利率	0.96%
預期存續期間	0.08年
每股履約價格	19.00元
認股選擇權每股公平價值	3.57元

(十六) 保留盈餘及股利政策

- 依本公司章程規定，本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積後，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘數再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之。
- 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

3. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之。惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部份為限。
4. 本公司於113年6月及112年5月經股東會決議通過之112及111年度盈餘分配案及每股股利如下：

項 目	盈餘分配案		每股股利(元)	
	112 年度	111 年度	112 年度	111 年度
法定公積	\$ 13,326	\$ 10,091		
特別盈餘公積提列	46	80		
普通股現金股利	57,720	26,256	2.00	1.00
合 計	\$ 71,092	\$ 36,427		

5. 本公司於114年3月19日董事會擬議113年度盈餘分配案如下：

項 目	盈餘分配案	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 8,694	
特別盈餘公積提列(轉回)	(126)	
普通股現金股利	28,860	1.00
普通股股票股利	57,720	2.00
合 計	\$ 95,148	

有關113年度之盈餘分派案，尚待114年6月召開之股東常會決議。

6. 有關本公司董事會提議及股東會決議盈餘分派情形，請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(十七)營業收入

項 目	113 年 度	112 年 度
客戶合約之收入		
出售產品收入	\$ 493,569	\$ 706,984
維修收入	54,106	59,946
客戶合約銷貨收入總額	\$ 547,675	\$ 766,930
減：銷貨退回	-	(4,665)
銷貨折讓	(45)	(226)
客戶合約營業收入淨額	\$ 547,630	\$ 762,039

1. 客戶合約之說明

係機械產品及其零組件之銷售收入，主要對象為電子業廠商，係以合約約定價格銷售。

2. 客戶合約收入之細分

本集團之收入可細分為下列主要服務線及地理區域：

113年度：

	出售產品收入	維修收入	合 計
主要地區市場			
台 灣	\$ 218,629	\$ 42,961	\$ 261,590
中國大陸	233,684	3,141	236,825
美 國	-	2,176	2,176
奧 地 利	21,541	2,140	23,681
其他國家	19,715	3,643	23,358
合 計	<u>\$ 493,569</u>	<u>\$ 54,061</u>	<u>\$ 547,630</u>
主要服務線			
台 南 廠	\$ 484,069	\$ 54,061	\$ 538,130
大陸昆山市	9,500	-	9,500
合 計	<u>\$ 493,569</u>	<u>\$ 54,061</u>	<u>\$ 547,630</u>
收入認列時點			
於某一時點滿足履約義務	\$ 493,569	\$ 54,061	\$ 547,630
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-
合 計	<u>\$ 493,569</u>	<u>\$ 54,061</u>	<u>\$ 547,630</u>

112年度：

	出售產品收入	維修收入	合 計
主要地區市場			
台 灣	\$ 250,485	\$ 43,194	\$ 293,679
中國大陸	298,177	5,626	303,803
美 國	58,465	6,095	64,560
奧 地 利	49,700	451	50,151
其他國家	45,431	4,415	49,846
合 計	<u>\$ 702,258</u>	<u>\$ 59,781</u>	<u>\$ 762,039</u>
主要服務線			
台 南 廠	\$ 700,166	\$ 59,781	\$ 759,947
大陸昆山市	2,092	-	2,092
合 計	<u>\$ 702,258</u>	<u>\$ 59,781</u>	<u>\$ 762,039</u>
收入認列時點			
於某一時點滿足履約義務	\$ 702,258	\$ 59,781	\$ 762,039
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-
合 計	<u>\$ 702,258</u>	<u>\$ 59,781</u>	<u>\$ 762,039</u>

3. 合約餘額

本集團認列客戶合約收入相關之應收款項、合約資產及合約負債如下：

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日
應收款項(註)	\$ 233,014	\$ 268,324	\$ 274,418
合約資產	-	-	-
合 計	\$ 233,014	\$ 268,324	\$ 274,418
合約負債—流動	\$ 28,712	\$ 34,631	\$ 152,749

(註)係包含應收票據及應收帳款。

(1) 合約資產及合約負債的重大變動

合約資產及合約負債之變動主要係來自滿足履約義務之時點與客戶付款時點之差異，並無其他重大變動。

(2) 來自期初合約負債及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

當期認列為收入之金額	113 年 度	112 年 度
來自期初合約負債商品銷貨	\$ 34,631	\$ 147,493
來自前期已滿足之履約義務	\$ -	\$ -

(十八) 員工福利、折舊及攤銷費用

性 質 別	113 年 度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利			
薪資費用	\$ 33,202	\$ 48,899	\$ 82,101
勞健保費用	3,315	3,263	6,578
退休金費用	2,387	1,791	4,178
董事酬金	-	1,772	1,772
其他員工福利費用	3,287	3,680	6,967
折舊費用	245	12,775	13,020
攤銷費用	527	1,133	1,660
合 計	\$ 42,963	\$ 73,313	\$ 116,276

性 質 別	112 年 度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利			
薪資費用	\$ 45,535	\$ 55,856	\$ 101,391
勞健保費用	4,056	3,815	7,871
退休金費用	3,064	1,478	4,542
董事酬金	-	3,186	3,186
其他員工福利費用	3,363	3,160	6,523
折舊費用	196	12,049	12,245
攤銷費用	281	1,199	1,480
合 計	\$ 56,495	\$ 80,743	\$ 137,238

1. 依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥2%至10%為員工酬勞及不得高於6%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。113及112年度估列員工酬勞分別為9,782仟元及12,606仟元，係按前述稅前利益之2%至10%內估列；113及112年度估列董監酬勞分別為1,772仟元及3,486仟元，係按前述稅前利益之不高於6%估列。年度財務報告通過日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理於次一年度調整入帳。
2. 本公司於114年3月19日及113年3月27日董事會決議通過113及112年度員工酬勞及董監酬勞，以及財務報告認列之相關金額如下：

項 目	113 年 度		112 年 度	
	員工酬勞	董事酬勞	員工酬勞	董監酬勞
決議配發金額	\$ 9,782	\$ 1,772	\$ 12,606	\$ 3,486
年度財務報告認列金額	9,782	1,772	12,606	3,486
差異金額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

上列員工酬勞均係以現金形式發放。

3. 本公司董事會通過之員工酬勞及董監酬勞相關資訊，請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(十九)利息收入

項 目	113 年 度	112 年 度
銀行存款利息	\$ 4,112	\$ 2,837

(二十)其他收入

項 目	113 年 度	112 年 度
補助收入－低利貸款補助	\$ 946	\$ 946
補助收入－其他補助	354	375
售電收入	721	667
其 他	444	402
合 計	\$ 2,465	\$ 2,390

(二十一)其他利益及損失

項 目	113 年 度	112 年 度
淨外幣兌換利益(損失)	\$ 22,349	\$ 3,170
透過損益按公允價值衡量金融資產評價(損)益	419	236
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	(43)	-
其 他	(58)	(93)
合 計	\$ 22,667	\$ 3,313

(二十二)財務成本

項 目	113 年 度	112 年 度
銀行借款之利息費用	\$ 3,300	\$ 3,196
減：符合要件之資產資本化金額	-	-
利息費用	\$ 3,300	\$ 3,196

(二十三)所得稅

1. 所得稅費用(利益)

(1) 所得稅費用組成部分：

	113 年 度	112 年 度
<u>當期所得稅</u>		
當期所產生之所得稅	\$ 19,362	\$ 26,023
以前年度所得稅高低估	149	37
未分配盈餘加徵稅額	2,773	2,939
當期所得稅總額	\$ 22,284	\$ 28,999
<u>遞延所得稅</u>		
暫時性差異之原始產生及迴轉	\$ 3,749	\$ 9,683
遞延所得稅總額	\$ 3,749	\$ 9,683
所得稅費用(利益)	\$ 26,033	\$ 38,682

(2) 與其他綜合損益相關之所得稅費用(利益)：

項 目	113 年 度	112 年 度
確定福利計畫之再衡量數	\$ (2)	\$ -

2. 當年度會計所得與認列於損益之所得稅費用調節如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
稅前淨利(損)	\$ 112,983	\$ 171,943
稅前淨利按法定稅率計算之稅額	\$ 22,632	\$ 34,242
調整項目之稅額影響數：		
計算課稅所得時不予計入項目之影響數		
未實現存貨損失(迴轉利益)	(330)	2,928
銷貨收入認列時點差異	(451)	(16,226)
未(已)實現兌換損益	(1,818)	4,576
未(已)實現保固準備	12	(154)
其他調整	(683)	657
以前年度所得稅高低估	149	37
遞延所得稅淨變動數		
暫時性差異	3,749	9,683
未分配盈餘加徵稅額	2,773	2,939
認列於損益之所得稅費用	\$ 26,033	\$ 38,682

本公司適用之所得稅稅率為20%，未分配盈餘所適用之稅率為5%；其他轄區所產生之稅額係依各相關轄區適用之稅率計算。

我國於108年7月經總統公布修正產業創新條例，新增以107年度起之未分配盈餘再投資於特定資產或技術達一定金額者，該投資金額得列為計算未分配盈餘之減除項目。本公司於計算未分配盈餘稅時，業已減除以未分配盈餘進行再投資之資本支出金額。

3. 因暫時性差異而產生之遞延所得稅資產或負債：

項 目	113 年 度			
	期初餘額	認列於(損)益	認列於其他 綜合(損)益	期末餘額
遞延所得稅資產：				
暫時性差異				
未實現保固準備	\$ 665	\$ 12	\$ -	\$ 677
未實現呆帳損失	705	(357)	-	348
未實現兌換損失	1,114	(1,114)	-	-
未實現不休假獎金	220	(95)	-	125
收入認列時間差異	1,764	(451)	-	1,313
採權益法之國外 投資損失	2,025	(228)	-	1,797
未實現存貨損失	3,224	(971)	-	2,253
其 他	-	158	-	158
淨確定福利負債	-	1	2	3
小 計	\$ 9,717	\$ (3,045)	\$ 2	\$ 6,674
遞延所得稅負債：				
暫時性差異				
未實現兌換利益	\$ -	\$ (704)	\$ -	\$ (704)
小 計	\$ -	\$ (704)	\$ -	\$ (704)
合 計	\$ 9,717	\$ (3,749)	\$ 2	\$ 5,970

項 目	112 年 度			
	期初餘額	認列於(損)益	認列於其他 綜合(損)益	期末餘額
遞延所得稅資產：				
暫時性差異				
未實現保固準備	\$ 819	\$ (154)	\$ -	\$ 665
未實現呆帳損失	1,295	(590)	-	705
未實現兌換損失	-	1,114	-	1,114
未實現不休假獎金	217	3	-	220
收入認列時間差異	17,990	(16,226)	-	1,764
採權益法之國外 投資損失	962	1,063	-	2,025
未實現存貨損失	1,579	1,645	-	3,224
小 計	\$ 22,862	\$ (13,145)	\$ -	\$ 9,717
遞延所得稅負債：				
暫時性差異				
未實現兌換利益	\$ (3,462)	\$ 3,462	\$ -	\$ -
小 計	\$ (3,462)	\$ 3,462	\$ -	\$ -
合 計	\$ 19,400	\$ (9,683)	\$ -	\$ 9,717

4. 未認列為遞延所得稅資產之項目：無。

5. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至111年度。

(二十四)其他綜合損益

項 目	113 年 度		
	稅前	所得稅(費用)利 益	稅後淨額
不重分類至損益之項目：			
確定福利計畫之再衡量數	\$ (10)	\$ 2	\$ (8)
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 143	\$ -	\$ 143
認列於其他綜合損益	\$ 133	\$ 2	\$ 135

項 目	112 年 度		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ (46)	\$ -	\$ (46)
認列於其他綜合損益	\$ (46)	\$ -	\$ (46)

(二十五)普通股每股盈餘

項 目	113 年 度	112 年 度
A. 基本每股盈餘：		
本期淨利(A)	\$ 86,950	\$ 133,261
本期流通在外加權平均股數(仟股)(B)	28,860	26,641
基本每股盈餘(稅後)(元)(A)/(B)	\$ 3.01	\$ 5.00
B. 稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ 86,950	\$ 133,261
具稀釋作用之潛在普通股之影響	-	-
計算稀釋每股盈餘之本期淨利(C)	\$ 86,950	\$ 133,261
本期流通在外加權平均股數(仟股)	28,860	26,641
員工酬勞影響數(註)	499	864
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股)(D)	29,359	27,505
稀釋每股盈餘(稅後)(元)(C)/(D)	\$ 2.96	\$ 4.84

(註)若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者：

本公司為本集團之最終控制者。

(二)關係人名稱及關係：

關係人名稱	與本公司之關係
欣大宇室內裝修工程行	其他關係人

(三)與關係人間之重大交易事項

1. 營業收入：無。
2. 進貨：無。
3. 合約資產：無。
4. 合約負債：無。
5. 應收關係人款項：無。
6. 應付關係人款項（不含向關係人借款）：

關係人類別/名稱	113年12月31日	112年12月31日
其他應付款		
其他關係人	\$ -	\$ 668

7. 預付款項：無。
8. 財產交易

(1) 取得不動產、廠房及設備

113年度：無。

112年度：

關係人類別/名稱	交易內容	交易金額
其他關係人	隔間、水電工程等	\$ 575

上開交易價格係經雙方議價決定，截至112年12月31日止，交易價款尚未付清。

9. 其他：

(1) 各項費用

關係人類別	113年度	112年度	交易性質
其他關係人	\$ 126	\$ 64	修繕費用等

(四)主要管理階層薪酬資訊

關係人類別/名稱	113年度	112年度
薪資及其他短期員工福利	\$ 14,732	\$ 15,338
退職後福利	108	108
合計	\$ 14,840	\$ 15,446

八、質押之資產

下列資產已提供為借款之擔保品：

項目	113年12月31日	112年12月31日
不動產、廠房及設備	\$ 237,101	\$ 243,266
其他金融資產-流動(註)	16,395	-
其他金融資產-非流動(註)	16,395	15,353
合計	\$ 269,891	\$ 258,619

(註)係因借款額度而設質之定期存款。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)截至113年及112年12月31日止，本集團因銷售機台保固款而開立之保證票據分別為489仟元及0仟元，帳列存出保證票據及應付保證票據科目。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

(一)資本風險管理

由於本集團須維持足夠資本，以支應擴建及提升廠房及設備所需。因此本集團之資本管理係以確保具有必要之財務資源及營運計畫，以支應未來12個月所需之營運資金、資本支出及債務償還等需求。

(二)金融工具

1. 金融工具之財務風險

財務風險管理政策

本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險（包括匯率風險、利率風險及價格風險）、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本集團致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對集團財務績效之潛在不利影響。

本集團之重要財務活動，係經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計畫執行期間，本集團必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

重大財務風險之性質及程度

(1) 市場風險

A. 匯率風險

(A) 本集團暴露於非以本公司之功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易與國外營運機構淨投資所產生之匯率風險。本集團之功能性貨幣以新台幣為主。該等交易主要計價之貨幣計有美金、人民幣及日幣，為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，本集團透過管理未來同幣別之外幣收付款時點或使用外幣借款來減輕匯率風險，惟仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

由於國外營運機構淨投資係為策略性投資，是故本集團並未對其進行避險。

(B) 匯率暴險及敏感度分析

		113年12月31日				
		帳列金額 (新台幣)	敏感度分析			
外幣	匯率		變動幅度	損益影響	權益影響	
(外幣:功能性貨幣)						
金融資產						
貨幣性項目						
美金:新台幣	7,530	32.785	246,880	升值1%	2,469	-
金融負債						
貨幣性項目						
美金:新台幣	315	32.785	10,335	升值1%	(103)	-
		112年12月31日				
		帳列金額 (新台幣)	敏感度分析			
外幣	匯率		變動幅度	損益影響	權益影響	
(外幣:功能性貨幣)						
金融資產						
貨幣性項目						
美金:新台幣	10,450	30.705	320,871	升值1%	3,209	-
金融負債						
貨幣性項目						
美金:新台幣	50	30.705	1,588	升值1%	(15)	-

新台幣之幣值若相對於上述貨幣升值時，若所有其他之變動因子維持不變，於113年及112年12月31日反映於上述貨幣之金額會有相等但相反方向之影響。

(C) 本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於113及112年度認列之全部兌換(損)益(含已實現及未實現)彙總金額分別為22,349仟元及3,170仟元。

B. 價格風險

由於本集團持有之金融工具投資於資產負債表中係分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產，因此本集團暴露於金融工具之價格風險。

本集團主要投資於國外基金受益憑證，此等金融工具之價格會因該投資標的未來價值之不確定性而受影響。若該等金融工具價格上升1%，而其他所得因素維持不變之情況下，對113及112年度稅後損益因來自透過損益按公允價值衡量之金融資產之公允價值上升而分別增加54仟元及50仟元。

C. 利率風險

本集團於報導日有關附息金融工具之利率概述如下：

項 目	帳 面 金 額	
	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
具公允價值利率風險：		
金融資產	\$ 32,790	\$ 15,353
金融負債	-	-
淨 額	\$ 32,790	\$ 15,353
具現金流量利率風險：		
金融資產	\$ 465,268	\$ 385,025
金融負債	(161,928)	(172,431)
淨 額	\$ 303,340	\$ 212,594

(A) 具公允價值利率風險之敏感度分析：

本集團未將任何固定利率之金融資產及負債分類為透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，亦未指定衍生工具(利率交換)作為公允價值避險會計模式下之避險工具。因此，報導日利率之變動將不會影響損益及其他綜合淨利。

(B) 具現金流量利率風險之敏感度分析：

本集團之變動利率之金融工具係屬浮動利率之資產(債務)，故市場利率變動將使其有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動。市場利率每變動1%，將使113及112年度淨利分別變動3,033仟元及2,126仟元。

(2) 信用風險

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本集團造成財務損失之風險。本集團之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項，及投資活動產生之銀行存款及其他金融工具。營運相關信用風險與財務信用風險係分別管理。

A. 營運相關信用風險

為維持應收帳款的品質，本集團已建立營運相關信用風險管理之程序。個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、本集團內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。

B. 財務信用風險

銀行存款及其他金融工具之信用風險，係由本集團財務部門衡量並監控。由於本集團之交易對象及履約他方均係信用良好之銀行及具投資等級以上之金融機構、公司組織及政府機關，無重大之履約疑慮，故無重大之信用風險。另本集團並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

(A) 信用集中風險：

截至113年及112年12月31日，前十大客戶之應收帳款餘額占本集團應收帳款餘額之百分比分別為76%及73%，有信用集中風險，其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

(B) 預期信用減損損失之衡量

(a) 應收帳款：係採簡化作法，請參閱附註六(四)之說明。

(b) 信用風險是否顯著增加之判斷依據：無(本集團並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資)。

(C) 持有擔保品及其他信用增強來規避金融資產之信用風險：

合併資產負債表所認列之金融資產及本集團所持有作為擔保之擔保品、淨額交割總約定及其他信用增強對信用風險最大暴險金額有關之財務影響相關資訊如下表所示：

113年12月31日	信用風險最大曝險減少金額				
	帳面金額	擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	合計
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,445	-	-	-	-
合計	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

112年12月31日	信用風險最大曝險減少金額				
	帳面金額	擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	合計
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,026	-	-	-	-
合計	\$ 5,026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(3) 流動性風險

A. 概述：

本集團管理流動性風險之目標，係為維持營運所需之現金及約當現金及足夠的銀行融資額度等，以確保本集團具有充足的財務彈性。

下表係按到期日及未折現之到期金額彙總列示本集團已約定還款期間之金融負債分析：

非衍生金融負債	113年12月31日						
	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 71,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,895	\$ 71,895
其他應付款	53,563	-	-	-	-	53,563	53,563
長期借款(一年內到期)	9,392	8,230	14,138	42,413	99,268	173,441	161,928
合計	\$ 134,850	\$ 8,230	\$ 14,138	\$ 42,413	\$ 99,268	\$ 298,899	\$ 287,386

非衍生金融負債	112年12月31日						
	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 65,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,070	\$ 65,070
其他應付款	65,646	-	-	-	-	65,646	65,646
長期借款(一年內到期)	5,517	5,517	16,976	42,413	114,467	184,890	172,431
合計	\$ 136,233	\$ 5,517	\$ 16,976	\$ 42,413	\$ 114,467	\$ 315,606	\$ 303,147

本集團並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

2. 金融工具之種類

本集團各項金融資產及金融負債之帳面金額如下：

	113年12月31日	112年12月31日
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	\$ 464,474	\$ 385,537
應收票據及帳款(含關係人)	233,014	268,324
其他應收款	267	191
其他金融資產-流動	16,395	-
存出保證金	1,463	1,137
其他金融資產-非流動	16,395	15,353
透過損益按公允價值衡量之	5,445	5,026
金融資產-流動		
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
應付帳款	71,895	65,070
其他應付款	53,563	65,646
一年或一營業週期內	17,622	11,034
到期長期借款		
長期借款	144,306	161,397

(三) 公允價值資訊

1. 本集團非以公允價值衡量之金融資產及金融負債之公允價值資訊請詳附註十二(三)3. 說明。

2. 公允價值之三等級定義：

第一等級：

該等級之輸入值係指工具於活絡市場中，相同工具之活絡市場公開報價。活絡市場係指符合以下所有條件之市場：在市場交易之商品具同質性；隨時可於市場中尋得具意願之買賣雙方且價格資訊可為大眾取得。

第二等級：

該等級之輸入值除活絡市場公開報價以外之可觀察價格，包括直接（如價格）或間接（如自價格推導而來）自活絡市場取得之可觀察輸入值。

第三等級：

該等級之輸入值係指衡量公允價值之投入參數並非根據市場可取得之可觀察輸入值。

3. 非按公允價值衡量之金融工具：

本集團非以公允價值衡量之金融工具，如現金及約當現金、應收款項、存出保證金、其他金融資產、應付款項、其他應付款及長期借款(含一年內)之帳面金額，係公允價值合理之近似值。

4. 公允價值之等級資訊：

本集團之以公允價值衡量之金融工具係皆以重複性為基礎按公允價值衡量。本集團之公允價值等級資訊如下表所示：

項 目	113年12月31日			合 計
	第一等級	第二等級	第三等級	
資產：				
重複性公允價值				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國外基金受益憑證	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ 5,445

項 目	112年12月31日			合 計
	第一等級	第二等級	第三等級	
資產：				
重複性公允價值				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國外基金受益憑證	\$ 5,026	\$ -	\$ -	\$ 5,026

5. 以公允價值衡量之工具的公允價值評價技術：

(1) 本集團採用活絡市場公開報價作為公允價值輸入值者：

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市(櫃)權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

本集團持有之金融工具如屬有活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

A. 開放型基金：淨值。

(2) 除有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。

6. 第一等級與第二等級間之移轉：無。

7. 第三等級之變動明細表：無。

(四) 金融資產之移轉：無。

(五) 金融資產及金融負債之互抵：無。

(六) 為配合113年度財務報表之表達方式，擬將112年度部分會計項目予以重分類，列示如下：

會 計 項 目	重 分 類 前	重 分 類	重 分 類 後
營業成本	\$ 478,511	\$ (7,975)	\$ 470,536
營業費用			
推銷費用	29,638	7,975	37,613

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊(合併沖銷前)

1. 資金貸與他人者：無。
2. 他人背書保證者：無。
3. 期末持有有價證券情形：附表一。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
9. 從事衍生工具交易：無。
10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：附表二。

(二)轉投資事業相關資訊：附表三。

(三)大陸投資資訊：附表四。

附表一

暉盛科技股份有限公司及子公司
 期末持有有價證券情形
 民國 113 年 12 月 31 日

單位：仟股/單位；新台幣仟元

持有之 公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
暉盛科技 (股)公司	基金受益憑證/摩根環球高 收益債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	1	2,847	-	2,847	
	基金受益憑證/安聯收益成 長基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	9	2,598	-	2,598	
		合 計				5,445		5,445

附表二

暉盛科技股份有限公司及子公司
母子公司間業務關係及重要交易往來情形
民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

個別交易金額未達 100 萬元以上，不予以揭露；另以資產面及收入面為揭露方式，其相對交易不再揭露。

編號 (註一)	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係(註二)	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(註三)
0	暉盛科技(股)公司	昆山金暉盛電子商貿有限公司	1	維修零件收入	8,025	價格與一般客戶相當，收款條件為 3 至 4 個月內收款。	1.47%
				應收帳款	1,806		0.17%
1	昆山金暉盛電子商貿有限公司	暉盛科技(股)公司	2	勞務收入	10,772	價格與一般客戶相當，收款條件為 3 至 4 個月內收款。	1.97%

註一：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

1. 母公司填 0。
2. 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註二：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：

1. 母公司對子公司。
2. 子公司對母公司。
3. 子公司對子公司。

註三：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債科目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益科目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註四：上述母子公司間交易業已沖銷。

附表三

暉盛科技股份有限公司及子公司
轉投資事業相關資訊
民國 113 年 12 月 31 日

單位：仟股；外幣仟元；新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額		
暉盛科技(股)公司	Stable Promise Group Co., Ltd.	塞席爾群島	一般投資業	15,178 (USD 500)	9,598 (USD 320)	500	100%	6,212 (USD 189)	1,142 (USD 36)	1,142 (USD 36)

註：上述母子公司間之交易業已沖銷。

附表四

暉盛科技股份有限公司及子公司
大陸投資資訊
民國 113 年 12 月 31 日

單位：外幣仟元；新台幣仟元

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註 1)	本期期初自 台灣匯出累積 投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資公司本期 損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列 投資損益 (註 2)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回台灣之投 資收益
					匯出	收回						
昆山金暉盛 電子商貿有 限公司	電子零組件貿 易與售後服務	15,178 (RMB 3,318) (註 4)	(2)	9,598 (USD 320)	5,580 (USD 180)	-	15,178 (USD 500)	1,142 (RMB 256)	100%	1,142 (RMB 256) (2).B	6,212 (RMB 1,383)	-
本期期末累計自台灣匯 出赴大陸地區投資金額				經濟部投審會 核准投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額		本期期末已處分(含出售、清算、解散、被 併購、破產等)之大陸子公司自台灣累計投 資金額	截至本期止處分(含出售、清算解散、被併購、 破產等)之大陸子公司已匯回投資收益				
15,178(USD 500)				16,393(USD 500)	447,631		-	-				

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸(請參閱附表三)
- (3) 其他方式

註 2：本期認列投資損益欄中：

- (1) 若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明
- (2) 投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明
 - A. 經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表
 - B. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表
 - C. 其他。

註 3：本表相關數字應以新台幣列示。

註 4：本期認列投資損益係依平均匯率 1 美元=32.120 新台幣核算；期末投資帳面價值係依期末匯率 1 美元=32.785 新台幣核算。

註 5：本公司 113 年度與大陸被投資公司之重大交易事項列示如下：

與大陸被投資公司之重大交易事項：詳附註十三附表二。

註 6：上述母子公司間交易業已沖銷。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊：

為管理之目的，本集團之營運決策者依據地區別劃分營運單位，並分為下列應報導部門：

1. 暉盛科技：主要從事設備機台製造與銷售；
2. 昆山金暉盛：主要從事設備機台相關調整及維修業務與商品買賣；
3. 其他部門：主要從事一般投資業。

(二)衡量基礎：

合併公司營運決策者個別監督各營運單位之營運結果，以制定資源分配與績效評估之決策。部門之績效係根據營業損益予以評估，並採與合併財務報表中營業損益一致之方式衡量。然而，合併財務報表之財務成本和財務收益，及所得稅係以集團為基礎進行管理，並未分攤至營運部門。

(三)部門財務資訊：

113年度：

項 目	單位：新台幣仟元					合 計
	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除		
收 入						
來自外部客戶收入	\$ 538,130	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ 547,630	
部門間收入	8,025	10,789	1,142	(19,956)	-	
收入合計	\$ 546,155	\$ 20,289	\$ 1,142	\$ (19,956)	\$ 547,630	
折舊與攤銷	\$ 14,657	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ 14,680	
部門損益	\$ 86,090	\$ 949	\$ 1,142	\$ (1,142)	\$ 87,039	
採用權益法之投資	\$ 6,212	\$ -	\$ 6,212	\$ (12,424)	\$ -	
非流動資產資本支出	\$ 5,522	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ 5,564	
部門資產	\$ 1,080,916	\$ 14,241	\$ 6,212	\$ (14,230)	\$ 1,087,139	
部門負債	\$ 334,864	\$ 8,029	\$ -	\$ (1,806)	\$ 341,087	

112年度：

項 目	單位：新台幣仟元					合 計
	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除		
收 入						
來自外部客戶收入	\$ 759,947	\$ 2,092	\$ -	\$ -	\$ 762,039	
部門間收入	2,173	12,050	-	(14,223)	-	
收入合計	\$ 762,120	\$ 14,142	\$ -	\$ (14,223)	\$ 762,039	
折舊與攤銷	\$ 13,724	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 13,725	
部門損益	\$ 171,779	\$ (5,180)	\$ (5,316)	\$ 5,316	\$ 166,599	
採用權益法之投資	\$ (653)	\$ -	\$ (653)	\$ 1,306	\$ -	
非流動資產資本支出	\$ 5,702	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ 5,725	
部門資產	\$ 1,095,364	\$ 5,747	\$ -	\$ (1,068)	\$ 1,100,043	
部門負債	\$ 378,675	\$ 6,400	\$ 653	\$ (2,374)	\$ 383,354	

(四)產品別資訊：合併公司主要從事設備機台製造買賣，為單一產業，不再另行揭露產品別資訊。

(五)地區別資訊：

1. 來自外部客戶收入(係以客戶所在國家為基礎歸類)：

項 目	113 年 度	112 年 度
台 灣	\$ 261,590	\$ 293,679
中國大陸	236,825	303,803
美 國	2,176	64,560
奧 地 利	23,681	50,151
其他國家	23,358	49,846
合 計	<u>\$ 547,630</u>	<u>\$ 762,039</u>

2. 非流動資產：

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
台 灣	<u>\$ 268,734</u>	<u>\$ 267,545</u>
大陸地區	<u>\$ 48</u>	<u>\$ 29</u>

(六)重要客戶資訊：

項 目	113 年 度	
	金 額	佔銷貨淨額 %
甲公司	\$ 78,619	14.36%
乙公司	65,425	11.95%
丙公司	46,202	8.44%
合 計	<u>\$ 190,246</u>	

項 目	112 年 度	
	金 額	佔銷貨淨額 %
甲公司	\$ 127,069	16.67%
乙公司	107,190	14.07%
丙公司	67,666	8.88%
合 計	<u>\$ 301,925</u>	

附件二

民國 114 年第二季合併財務報告暨
會計師核閱報告

【股票代號：7730】

暉盛科技股份有限公司及其子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國 114 及 113 年第 2 季

公司地址：台南市安南區台南科技工業區科技五路 100 號
公司電話：06-2915500

目 錄

項 目	頁 次
一、封面	1
二、目錄	2
三、會計師核閱報告	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~10
(四)重大會計政策之彙總說明	10~12
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	12
(六)重要會計項目之說明	12~29
(七)關係人交易	29~30
(八)質押之資產	30
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	30
(十)重大之災害損失	30
(十一)重大之期後事項	30
(十二)其他	31~37
(十三)附註揭露事項	37
1. 重大交易事項相關資訊	38~39
2. 轉投資事業相關資訊	40
3. 大陸投資資訊	41
(十四)部門資訊	42~43

會計師核閱報告

暉盛科技股份有限公司 公鑒：

前言

暉盛科技股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 6 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併綜合損益表、民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

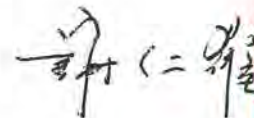
本會計師係依照核閱準則 2410 號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

結論

依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製，致無法允當表達暉盛科技股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 6 月 30 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務績效及民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併現金流量之情事。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：謝仁耀



會計師：李國銘



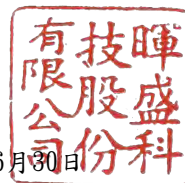
核准文號：金管證審字第 10200032833 號

核准文號：金管證審字第 1100145994 號

民國 114 年 8 月 8 日

暉盛科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國114年6月30日、民國113年12月31日及113年6月30日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	114年6月30日		113年12月31日		113年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 449,499	43	\$ 465,474	42	\$ 454,727	42
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	4,891	-	5,445	1	5,302	-
1150	應收票據淨額(附註六(三))	-	-	195	-	271	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	245,629	23	232,819	21	215,393	20
1200	其他應收款	116	-	267	-	157	-
1220	本期所得稅資產	4	-	-	-	-	-
130x	存貨(附註六(五))	65,162	6	62,614	6	94,159	9
1410	預付款項(附註六(六))	14,554	1	10,616	1	15,049	1
1476	其他金融資產-流動(附註八)	14,650	1	16,395	2	-	-
11xx	流動資產合計	794,505	74	793,825	73	785,058	72
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、八)	261,700	23	266,746	24	273,149	25
1780	無形資產(附註六(八))	1,922	-	2,036	-	2,883	-
1840	遞延所得稅資產	5,982	1	6,674	1	6,816	1
1920	存出保證金	1,327	-	1,463	-	1,093	-
1975	淨確定福利資產-非流動	75	-	-	-	-	-
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	15,000	2	16,395	2	16,213	2
15xx	非流動資產合計	286,006	26	293,314	27	300,154	28
1xxx	資產總計	\$ 1,080,511	100	\$ 1,087,139	100	\$ 1,085,212	100

(接次頁)

(承前頁)

代碼	負債及權益	114年6月30日		113年12月31日		113年6月30日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債						
2130	合約負債-流動(附註六(十六))	\$ 12,168	1	\$ 28,712	3	\$ 23,517	2
2170	應付帳款	88,225	9	71,895	6	66,237	6
2200	其他應付款(附註六(九))	75,764	7	53,563	5	103,045	11
2230	本期所得稅負債	3,736	-	8,749	1	11,043	1
2250	負債準備-流動(附註六(十))	4,263	-	4,007	-	3,744	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註六(十一))	15,299	1	17,622	2	14,909	1
21xx	流動負債合計	199,455	18	184,548	17	222,495	21
	非流動負債						
2540	長期借款(附註六(十一))	138,159	13	144,306	13	152,277	14
2570	遞延所得稅負債	-	-	704	-	-	-
2630	長期遞延收入(附註六(十一))	11,040	1	11,513	1	11,986	1
2640	淨確定福利負債-非流動	-	-	16	-	-	-
25xx	非流動負債合計	149,199	14	156,539	14	164,263	15
2xxx	負債總計	348,654	32	341,087	31	386,758	36
	權益						
	歸屬於母公司業主之權益						
3100	股本(附註六(十三))						
3110	普通股股本	288,598	27	288,598	27	288,598	27
3150	待分配股票股利	57,720	5	-	-	-	-
3200	資本公積(附註六(十四))	55,390	5	55,390	5	55,390	5
3300	保留盈餘(附註六(十五))						
3310	法定盈餘公積	88,196	8	79,502	7	79,502	7
3320	特別盈餘公積	-	-	126	-	126	-
3350	未分配盈餘	242,419	23	322,419	30	274,873	25
3400	其他權益	(466)	-	17	-	(35)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	731,857	68	746,052	69	698,454	64
3xxx	權益總計	731,857	68	746,052	69	698,454	64
	負債及權益總計	\$ 1,080,511	100	\$ 1,087,139	100	\$ 1,085,212	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅



經理人：許嘉元

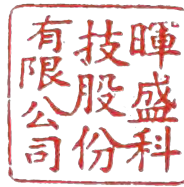


會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國114年及113年1月1日至6月30日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	114年4月1日 至6月30日		113年4月1日 至6月30日		114年1月1日 至6月30日		113年1月1日 至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(十六))	\$ 172,524	100	\$ 105,787	100	\$ 255,655	100	\$ 263,460	100
5000	營業成本(附註六(五))	(96,644)	(55)	(60,245)	(57)	(144,513)	(57)	(158,125)	(61)
5900	營業毛利(毛損)	75,880	45	45,542	43	111,142	43	105,335	39
	營業費用								
6100	推銷費用	(14,768)	(9)	(2,657)	(3)	(26,465)	(10)	(21,395)	(8)
6200	管理費用	(16,589)	(10)	(16,426)	(15)	(33,147)	(14)	(35,128)	(13)
6300	研究發展費用	(7,710)	(4)	(5,103)	(5)	(13,993)	(5)	(11,243)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益(附註六(四))	1,964	1	(1,152)	(1)	(99)	-	(4,541)	(2)
6000	營業費用合計	(37,103)	(22)	(25,338)	(24)	(73,704)	(29)	(72,307)	(27)
6900	營業利益(損失)	38,777	23	20,204	19	37,438	14	33,028	12
	營業外收入及支出								
7100	利息收入(附註六(十八))	1,400	1	1,386	1	2,393	1	2,101	1
7010	其他收入(附註六(十九))	415	-	471	-	959	-	1,140	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十))	(24,316)	(15)	5,037	6	(20,052)	(7)	19,040	8
7050	財務成本(附註六(二十一))	(818)	-	(829)	(1)	(1,637)	(1)	(1,633)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(23,319)	(14)	6,065	6	(18,337)	(7)	20,648	8
7900	稅前淨利(淨損)	15,458	9	26,269	25	19,101	7	53,676	20
7950	所得稅(費用)利益(附註六(二十二))	(3,189)	(2)	(8,955)	(8)	(3,953)	(2)	(14,282)	(5)
8200	本期淨利(淨損)	12,269	7	17,314	17	15,148	5	39,394	15
	其他綜合損益(附註六(二十三))								
8360	後續可能重分類至損益之項目								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(610)	-	24	-	(483)	-	91	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(610)	-	24	-	(483)	-	91	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 11,659	7	\$ 17,338	17	\$ 14,665	5	\$ 39,485	15
8600	淨利(損)歸屬於：								
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 12,269	7	\$ 17,314	17	\$ 15,148	5	\$ 39,394	15
8620	非控制權益(淨利/損)	-	-	-	-	-	-	-	-
		\$ 12,269	7	\$ 17,314	17	\$ 15,148	5	\$ 39,394	15
8700	綜合損益總額歸屬於：								
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 11,659	7	\$ 17,338	17	\$ 14,665	5	\$ 39,485	15
8720	非控制權益(綜合損益)	-	-	-	-	-	-	-	-
		\$ 11,659	7	\$ 17,338	17	\$ 14,665	5	\$ 39,485	15
	每股盈餘								
9750	基本每股盈餘(附註六(二十四))	\$ 0.35		\$ 0.50		\$ 0.44		\$ 1.14	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(二十四))	\$ 0.35		\$ 0.50		\$ 0.43		\$ 1.12	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅



經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁





暉盛科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國114年及113年1月1日至6月30日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益									
	股本			保留盈餘			其他權益項目			
	普通股股本	待分配股票股利	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財務 報表換算之兌換差 額	歸屬於母公司業主 權益總計	非控制權益	權益總額
113年1月1日餘額	\$ 288,598	\$ -	\$ 55,390	\$ 66,176	\$ 80	\$ 306,571	\$ (126)	\$ 716,689	\$ -	\$ 716,689
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	13,326	-	(13,326)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	46	(46)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(57,720)	-	(57,720)	-	(57,720)
113年1月1日至6月30日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	-	39,394
113年1月1日至6月30日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	91	91	-	91
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	39,394	91	39,485	-	39,485
113年6月30日餘額	\$ 288,598	\$ -	\$ 55,390	\$ 79,502	\$ 126	\$ 274,873	\$ (35)	\$ 698,454	\$ -	\$ 698,454
114年1月1日餘額	288,598	-	55,390	79,502	126	322,419	17	746,052	-	746,052
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	8,694	-	(8,694)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(126)	126	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(28,860)	-	(28,860)	-	(28,860)
普通股股票股利	-	57,720	-	-	-	(57,720)	-	-	-	-
114年1月1日至6月30日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	15,148	-	15,148	-	15,148
114年1月1日至6月30日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(483)	(483)	-	(483)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	15,148	(483)	14,665	-	14,665
114年6月30日餘額	\$ 288,598	\$ 57,720	\$ 55,390	\$ 88,196	\$ -	\$ 242,419	\$ (466)	\$ 731,857	\$ -	\$ 731,857

董事長：宋俊毅



(請參閱合併財務報告附註)

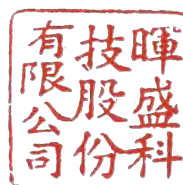
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國114年及113年1月1日至6月30日



單位：新台幣仟元


項 目	114年1月1日 至6月30日	113年1月1日 至6月30日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 19,101	\$ 53,676
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	7,694	6,186
攤銷費用	839	813
預期信用減損損失(利益)數	99	4,541
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	554	(276)
利息費用	1,637	1,633
利息收入	(2,393)	(2,101)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(2)
其他項目	(473)	(473)
收益費損項目合計	7,957	10,321
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	195	(224)
應收帳款(增加)減少	(12,909)	48,343
其他應收款(增加)減少	151	34
存貨(增加)減少	(2,548)	32,224
預付款項(增加)減少	(3,938)	(4,807)
其他營業資產(增加)減少	(75)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(19,124)	75,570
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(16,544)	(11,114)
應付帳款增加(減少)	16,330	1,167
其他應付款增加(減少)	(7,319)	(19,717)
負債準備增加(減少)	256	(676)
淨確定福利負債增加(減少)	(16)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,293)	(30,340)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,417)	45,230
調整項目合計	(18,460)	55,551
營運產生之現金流入(流出)	641	109,227
收取之利息	2,393	2,101
支付之利息	(1,366)	(1,360)
退還(支付)之所得稅	(8,982)	(29,035)
營業活動之淨現金流入(流出)	(7,314)	80,933
投資活動之現金流量		


(接次頁)


(承前頁)

項 目	114年1月1日 至6月30日	113年1月1日 至6月30日
取得不動產、廠房及設備	\$ (2,240)	\$ (4,280)
處分不動產、廠房及設備	-	2
存出保證金減少	136	44
取得無形資產	(473)	(1,222)
其他金融資產增加	-	(860)
其他金融資產減少	3,140	-
投資活動之淨現金流入(流出)	563	(6,316)
籌資活動之現金流量		
償還長期借款	(8,741)	(5,518)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(8,741)	(5,518)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(483)	91
本期現金及約當現金增加(減少)數	(15,975)	69,190
期初現金及約當現金餘額	465,474	385,537
期末現金及約當現金餘額	\$ 449,499	\$ 454,727

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：宋俊毅 

經理人：許嘉元 

會計主管：蔡郁仁 

暉盛科技股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國114年及113年1月1日至6月30日
(金額除特別註明者外，均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱本公司)成立於91年6月，主要營業項目為電子材料批發、機械材料批發、電器批發、國際貿易、其他機械器具批發(電漿清潔器)、其他電機及電子機械器材製造(電漿清潔器)。110年11月本公司營運據點搬遷至台南科技工業園區。113年3月18日本公司普通股登錄為興櫃股票。本公司及本公司之子公司(以下簡稱為本集團)之主要營運活動，請參閱附註四(三)2.之說明。另本公司並無最終母公司。

本公司之功能性貨幣及合併財務報告之表達貨幣均為新台幣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於114年8月8日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「IFRSs」)之影響

下表彙列金管會認可之114年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用經金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響：

下表彙列金管會認可之114年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「金融工具之分類與衡量之修正」	2026 年 1 月 1 日

部分修正內容

1. 金管會認可此修正中允許企業單獨提前適用 IFRS 9 第4.1節(金融資產之分類)之應用指引，並同時適用 IFRS 7 第20B、20C 及20D 段規定，此修正分別說明如下：

- (1) 釐清並增加評估金融資產是否符合僅支付本金和利息(SPPI)標準的進一步指引，範圍包括根據或有事件改變現金流量的合約條款(例如與ESG目標連結的利率)、無追索權特性之工具，及合約連結工具。
- (2) 新增為某些具有可改變現金流量的合約條款的工具(例如某些具有與實現環境、社會和治理(ESG)目標相關的特徵之工具)，應揭露或有事項性質之質性

描述；有關可能來自該等合約條款之合約現金流量變動範圍之量化資訊；及於該等合約條款下，金融資產之總帳面金額及金融負債之攤銷後成本。

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及影響：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「金融工具之分類與衡量之修正」	2026 年 1 月 1 日
部分修正內容	
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「涉及自然電力的合約」	2026 年 1 月 1 日
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17「保險合約」之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」	2027 年 1 月 1 日
IFRS 19「不具公共課責性之子公司：揭露」	2027 年 1 月 1 日
IFRS 之年度改善-第 11 冊	2026 年 1 月 1 日

1. IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「金融工具之分類與衡量之修正」部分修正內容

金管會認可此修正中之部分內容，尚未認可之部分內容分別說明如下：

- (1) 釐清某些金融資產和負債的認列和除列之日期，新增在使用電子支付系統以現金交割金融負債(或部分金融負債)時，當且僅當企業發起支付指令並導致以下情況時，允許企業在交割日前視為將金融負債解除：
 - A. 企業不具有撤銷、停止或取消支付指定之能力；
 - B. 企業因該支付指令而不具有取得用於交割之現金之實際能力；
 - C. 與該電子支付系統相關之交割風險並不重大。
- (2) 更新透過不可撤銷之選擇指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (FVTOCI) 應按每一種類揭露其公允價值，無須再按每一標的揭露其公允價值資訊。另應揭露於報導期間認列於其他綜合損益之公允價值損益金額，分別列示於報導期間內除列之投資有關之公允價值損益金額，以及於報導期間結束日仍持有之投資有關之公允價值損益金額；以及於報導期間除列投資而於報導期間移轉至權益之累積損益。

2. IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「涉及自然電力的合約」

此修正就企業涉及因發電來源取決於不可控的自然條件(如天氣)的基礎，產生電量變化的合約，分別說明如下：

- (1) 釐清企業購買或銷售自然電力的合約對於「自用」要求的應用：

當合約規定企業有義務在發電時購買並接收電力，且合約電力交易市場的設計和營運要求企業在規定時間內出售任何數量的未使用電力，則企業須考量有關其在不超過12個月合理時間內對於過去、當前和預期未來電力交易的合理且有支持的資訊，當其購買足夠的電力來抵消在其售電的同一市

場中銷售的任何未使用的電力，則該企業是電力的淨購買者。新增應用修正案為自用之涉及自然電力的合約，須揭露：

- A. 企業面臨基礎電量的變化以及企業可能被要求在無法使用電力的交付間隔期間購買電力的風險；
- B. 未認列的合約承諾，包括根據這些合約購電預計的未來現金流量；及
- C. 合約於報告期間內對企業財務績效的影響。

(2) 釐清指定涉及自然電力的合約為避險工具如何得以適用避險會計：

得將被避險項目指定為預測電力交易的可變名義金額，該金額與預期由避險工具中提及的發電設施交付的自然電力的可變金額一致。另當避險工具的現金流量企業在現金流量避險關係中，當指定涉及自然電力的合約作為避險工具，是以指定的預期交易的發生為條件，則該預期交易被推定為極有可能發生。

對於將涉及自然電力的合約指定為避險工具之企業，應按IFRS 7依風險類別進行分類之避險工具揭露其條款及條件。

3. IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

此修正解決了現行IFRS 10及IAS 28的不一致。投資者出售(投入)資產與其關聯企業或合資之交易，視出售(投入)資產之性質決定認列全部或部份處分損益：

- (1) 當出售(投入)之資產符合「業務」時，認列全部處分損益；
- (2) 當出售(投入)之資產不符合「業務」時，僅能認列與非關係投資者對關聯企業或合資之權益範圍內之部分處分損益。

4. IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」

IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」取代IAS 1並更新綜合損益表之架構，及新增管理績效衡量之揭露，並強化運用於主要財務報表及附註之彙總及細分原則。

5. IFRS 19「不具公共課責性之子公司：揭露」

此準則允許合格子公司適用減少揭露要求之 IFRS 會計準則。

除上述影響外，截至本合併財務報告發布日止，本集團仍持續評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

重大會計政策除遵循聲明、編製基礎、合併基礎及新增部分說明如下，餘與113年度合併財務報告附註四相同。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告應併同113年度合併財務報告閱讀。

(二) 編製基礎

1. 除下列重要項目外，本合併財務報告係按歷史成本編製：

- (1) 按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產。
- (2) 按退休基金資產與確定福利義務現值之淨額認列之確定福利資產或負債。

2. 編製符合金管會認可之IFRSs之合併財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)合併基礎

1. 合併財務報告編製原則：

- (1) 本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體)，當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告，於喪失控制之日起終止合併。
- (2) 集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本集團採用之政策一致。
- (3) 損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益；綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益，即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。
- (4) 對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列於權益。
- (5) 當集團喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為損益。

2. 列入合併財務報告之子公司如下：

子 公 司	主要營業項目	持股或出資比例		
		114.6.30	113.12.31	113.6.30
Stable Promise Group Co., Ltd.	一般投資業	100%	100%	100%
大陸昆山金暉盛電子商貿有限公司	電子器材進出口及相關服務	100%	100%	100%

- (1) 上列編入合併財務報告之子公司均屬非重要子公司，其財務報告均經會計師核閱。
- (2) 合併子公司增減情形：無。
3. 未列入合併財務報告之子公司：無。
4. 子公司會計期間不同之調整及處理方式：無。
5. 重大限制：無。
6. 子公司持有母公司發行證券之內容：無。
7. 具重大非控制權益之子公司資訊：無。

(四)所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。期中期間之所得稅係以年度為基礎進行評估，以預期年度總盈餘所適用之稅率，就期中稅前利益予以計算。期中期間因稅法修正發生之稅率變動影響係與產生租稅後果之交易本身會計處理原則一致，於發生當期一次認列。

(五)退職後福利

期中期間之退休金成本係採用前一財務年度結束日依精算決定之退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算。並針對本期之重大市場波動及重大計畫修正、清償或其他重大一次性事項加以調整。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團編製本合併財務報告時，所作之重大判斷、重大會計估計及假設不確定性之主要來源與113年度合併財務報告之附註五一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，餘請參閱113年度合併財務報告附註六。

(一)現金及約當現金

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
庫存現金	\$ 680	\$ 206	\$ 337
活期存款	417,231	346,577	312,379
外幣存款	28,590	118,691	142,011
約當現金			
三個月內到期之附買回債券	2,998	-	-
合 計	<u>\$ 449,499</u>	<u>\$ 465,474</u>	<u>\$ 454,727</u>

1. 本集團往來之金融機構信用品質良好，且本集團與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。
2. 本集團未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
非衍生金融資產			
基金受益憑證	<u>\$ 4,891</u>	<u>\$ 5,445</u>	<u>\$ 5,302</u>

1. 本集團於114及113年4至6月與114及113年1至6月透過損益按公允價值衡量之金融資產認列之淨(損)益分別為(468)仟元及28仟元與(554)仟元及276仟元。
2. 本集團未有將透過損益按公允價值衡量之金融資產提供質押之情形。
3. 相關信用風險管理及評估方式請詳附註十二(三)之說明。

(三) 應收票據淨額

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
按攤銷後成本衡量			
應收票據	\$ -	\$ 195	\$ 271
減：備抵損失	-	-	-
應收票據淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 195</u>	<u>\$ 271</u>

1. 本集團未有將應收票據提供質押之情形。
2. 有關應收票據備抵損失之相關揭露，請參閱附註六(四)之說明。

(四) 應收帳款淨額

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
按攤銷後成本衡量			
應收帳款	\$ 249,851	\$ 236,942	\$ 226,223
減：備抵損失	(4,222)	(4,123)	(10,830)
應收帳款淨額	<u>\$ 245,629</u>	<u>\$ 232,819</u>	<u>\$ 215,393</u>

1. 本集團未逾期且未減損之應收帳款均符合依據交易對手之產業特性、營業規模及獲利情況所訂定之授信標準，平均授信期間為3至6個月(保固款除外，保固款一般約10%~20%，收款從其約定，通常為保固期滿後)。
2. 本集團未有將應收帳款提供質押之情形。
3. 本集團採用簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收票據及應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務及產經狀況等。本集團按客戶所在地區之貿易信用風險特性將對客戶之應收款項分組，並以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。
4. 本集團依準備矩陣衡量應收票據及應收帳款之備抵損失如下：

114年6月30日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%	\$ 217,858	\$ -	\$ 217,858
30天以下	0%~1%	14,927	(12)	14,915
31~90天	0%~1%	66	-	66
91~180天	0%~5%	2,768	(138)	2,630
181~365天	0%~20%	8,628	(1,725)	6,903
逾期超過一年	0%~100%	5,598	(2,341)	3,257
已有減損跡象	100%	6	(6)	-
合 計		<u>\$ 249,851</u>	<u>\$ (4,222)</u>	<u>\$ 245,629</u>

113年12月31日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期 間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%~0.05%	\$ 141,051	\$ -	\$ 141,051
30天以下	0%~1%	23,562	(230)	23,332
31~90天	0%~1%	37,142	(362)	36,780
91~180天	0%~5%	17,910	(407)	17,503
181~365天	0%~20%	4,240	(573)	3,667
逾期超過一年	0%~50%	13,226	(2,545)	10,681
已有減損跡象	100%	6	(6)	-
合計		\$ 237,137	\$ (4,123)	\$ 233,014

113年6月30日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期 間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%	\$ 168,370	\$ -	\$ 168,370
30天以下	0%~1%	-	-	-
31~90天	0%~1%	17,407	(174)	17,233
91~180天	0%~5%	12,646	(633)	12,013
181~365天	0%~20%	12,557	(2,511)	10,046
逾期超過一年	0%~50%	15,485	(7,483)	8,002
已有減損跡象	100%	29	(29)	-
合計		\$ 226,494	\$ (10,830)	\$ 215,664

5. 應收票據及帳款備抵損失變動表如下：

項 目	114年1月至6月	113年1月至6月
期初餘額	\$ 4,123	\$ 6,289
加：減損損失提列	99	4,541
減：減損損失迴轉	-	-
期末餘額	\$ 4,222	\$ 10,830

6. 若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本集團無法合理預期可回收金額，本集團直接沖銷相關應收款項，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。本集團於114及113年1至6月沖銷合約金額之應收款項均為0仟元。

7. 相關信用風險管理及評估方式，請參閱附註十二之說明。

(五)存貨及營業成本

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
原 料	\$ 24,176	\$ 23,917	\$ 30,483
商 品	3,144	5,004	3,342
在 製 品	37,842	33,237	59,605
製 成 品	-	456	729
淨 額	\$ 65,162	\$ 62,614	\$ 94,159

1. 當期認列為營業成本之存貨相關損(益)如下：

項 目	114年4至6月	113年4至6月
出售存貨成本	\$ 87,543	\$ 51,300
維修成本	11,087	8,290
加工成本	137	-
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(2,123)	655
營業成本合計	\$ 96,644	\$ 60,245

項 目	114年1至6月	113年1至6月
出售存貨成本	\$ 125,047	\$ 142,550
維修成本	18,691	16,180
加工成本	141	-
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(1,112)	(605)
少分攤直接人工及製造費用	1,746	-
營業成本合計	\$ 144,513	\$ 158,125

2. 本集團114及113年4至6月與1至6月列入各類存貨成本減項之備抵跌價及呆滯損失變動如下：

	114年1至6月	113年1至6月
期初餘額	\$ 13,093	\$ 17,661
加：本期提列(迴轉)	(1,112)	(605)
減：本期沖銷	(1,007)	(3,202)
期末餘額	\$ 10,974	\$ 13,854

3. 本集團於114及113年4至6月與114及113年1至6月將存貨沖減至淨變現價值或因消化庫存及市場行情回穩，致存貨淨變現價值回升，因而認列存貨跌價及呆滯損失(回升利益)分別為(2,123)仟元及655仟元與(1,112)仟元及(605)仟元。

4. 本集團未有將存貨提供質押之情形。

(六)預付款項

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
預付貨款	\$ 5,886	\$ 3,137	\$ 8,824
預付費用	5,996	6,298	5,138
進項稅額	53	1	9
留抵稅額	2,619	1,180	1,078
合 計	\$ 14,554	\$ 10,616	\$ 15,049

(七)不動產、廠房及設備

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
土 地	\$ 117,681	\$ 117,681	\$ 117,681
房屋及建築	133,724	133,724	134,713
機器設備	45,976	45,776	46,176
運輸設備	7,762	7,762	5,627
辦公設備	1,262	1,248	1,252
其他設備	8,344	5,241	4,252
未完工程及待驗設備	-	669	3,545
成本合計	\$ 314,749	\$ 312,101	\$ 313,246
減：累計折舊	(53,049)	(45,355)	(40,097)
淨 額	\$ 261,700	\$ 266,746	\$ 273,149

成 本	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備(註)	未完工程及待驗設備	合 計
114.1.1 餘額	\$ 117,681	\$ 133,724	\$ 45,776	\$ 14,251	\$ 669	\$ 312,101
增 添	-	-	200	2,448	-	2,648
重 分 類	-	-	-	669	(669)	-
114.6.30 餘額	\$ 117,681	\$ 133,724	\$ 45,976	\$ 17,368	\$ -	\$ 314,749
累計折舊						
114.1.1 餘額	\$ -	\$ 17,711	\$ 23,604	\$ 4,040	\$ -	\$ 45,355
折舊費用	-	3,224	3,304	1,166	-	7,694
114.6.30 餘額	\$ -	\$ 20,935	\$ 26,908	\$ 5,206	\$ -	\$ 53,049

成 本	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備(註)	未完工程及待驗設備	合 計
113.1.1 餘額	\$ 117,681	\$ 134,713	\$ 35,617	\$ 11,044	\$ -	\$ 299,055
增 添	-	-	-	131	3,545	3,676
處 分	-	-	-	(44)	-	(44)
存貨轉入	-	-	10,559	-	-	10,559
113.6.30 餘額	\$ 117,681	\$ 134,713	\$ 46,176	\$ 11,131	\$ 3,545	\$ 313,246
累計折舊						
113.1.1 餘額	\$ -	\$ 11,588	\$ 19,165	\$ 3,202	\$ -	\$ 33,955
折舊費用	-	3,400	2,221	565	-	6,186
處 分	-	-	-	(44)	-	(44)
113.6.30 餘額	\$ -	\$ 14,988	\$ 21,386	\$ 3,723	\$ -	\$ 40,097

(註)係包括運輸設備、辦公設備、租賃改良及其他設備。

1. 本期增添與現金流量表取得不動產、廠房及設備調節如下：

項 目	114年1至6月	113年1至6月
不動產、廠房及設備增加數	\$ 2,648	\$ 3,676
應付設備款(增)減	(408)	604
購買不動產、廠房及設備支付現金數	\$ 2,240	\$ 4,280

2. 不動產、廠房及設備借款成本資本化情形：無。

3. 不動產、廠房及設備減損情形：無。

4. 以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請參閱附註八之說明。

(八) 無形資產

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
電腦軟體成本	\$ 7,061	\$ 7,220	\$ 7,220
減：累計攤提	(5,139)	(5,184)	(4,337)
淨 額	\$ 1,922	\$ 2,036	\$ 2,883

成 本	電腦軟體成本		電腦軟體成本	
	成 本	成 本	成 本	成 本
114.1.1 餘額	\$ 7,220	113.1.1 餘額	\$ 5,998	
增 添	725	增 添	1,222	
到期除列	(884)	到期除列	-	
114.6.30 餘額	\$ 7,061	113.6.30 餘額	\$ 7,220	
累計攤銷		累計攤銷		
114.1.1 餘額	\$ 5,184	113.1.1 餘額	\$ 3,524	
攤銷費用	839	攤銷費用	813	
到期除列	(884)	到期除列	-	
114.6.30 餘額	\$ 5,139	113.6.30 餘額	\$ 4,337	

1. 本期增添與現金流量表取得無形資產調節如下：

項 目	114年1至6月	113年1至6月
無形資產增加數	\$ 725	\$ 1,222
應付無形資產(增)減	(252)	-
購買無形資產支付現金數	\$ 473	\$ 1,222

(九) 其他應付款

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
薪 獎	\$ 12,200	\$ 25,737	\$ 14,748
應付員工酬勞-本期	2,170	9,782	5,966
應付員工酬勞-上期	7,719	-	9,779
應付董事酬勞-本期	447	1,772	1,315
應付董監酬勞-上期	-	-	500
應付設備款	408	-	-
股 利	28,860	-	57,720
應付退休金	3,054	3,033	2,542
應付勞務費	6,818	1,877	2,452
應付保險費	4,209	3,924	3,588
應付無形資產	252	-	-
應付其他	9,627	7,438	4,435
合 計	\$ 75,764	\$ 53,563	\$ 103,045

(十) 負債準備—流動

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
售後保固準備	\$ 3,179	\$ 3,384	\$ 2,887
員工福利	1,084	623	857
合 計	\$ 4,263	\$ 4,007	\$ 3,744

項 目	114年1至6月		
	售後保固準備	員工福利	合 計
1月1日餘額	\$ 3,384	\$ 623	\$ 4,007
當期新增之負債準備	3,130	1,084	4,214
當期迴轉之負債準備	(3,335)	(623)	(3,958)
6月30日餘額	\$ 3,179	\$ 1,084	\$ 4,263

項 目	113年1至6月		
	售後保固準備	員工福利	合 計
1月1日餘額	\$ 3,324	\$ 1,096	\$ 4,420
當期新增之負債準備	5,237	857	6,094
當期迴轉之負債準備	(5,674)	(1,096)	(6,770)
6月30日餘額	\$ 2,887	\$ 857	\$ 3,744

1. 本集團提供產品保固，依歷史經驗及管理階層之判斷估計，估列可能發生之產品保固負債準備，並於相關產品出售當期認列為費損。
2. 員工福利負債準備係員工既得短期服務休假權利之估列。

(十一) 長期借款及一年或一營業週期內到期長期負債

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
抵押借款	\$ 164,498	\$ 173,441	\$ 179,172
減：一年內到期	(15,299)	(17,622)	(14,909)
轉列遞延政府補助利益	(11,040)	(11,513)	(11,986)
-低利貸款			
合 計	\$ 138,159	\$ 144,306	\$ 152,277
利率區間	0.955%~2.15%	0.955%~2.15%	0.955%~2.15%

1. 遞延政府補助利益(列入長期遞延收入)本期變動如下：

項 目	114年1至6月	113年1至6月
期初餘額	\$ 11,513	\$ 12,459
本期攤銷(註)	(473)	(473)
期末餘額	\$ 11,040	\$ 11,986

(註)本期攤銷帳列營業外收入及支出—其他收入。

2. 上述長期借款之擔保品，請參閱附註八之說明。

3. 本公司部分長期借款為適用中小企業加速投資行動方案之政府補助低利貸款，依該借款合同規定，本公司於借款期間，自112年度財務報告日起，應維持流動比率不低於150%及負債淨值比率不高於120%之財務承諾，前述之財務比率每年審閱一次，以每年會計師查核簽證之財務報表為計算基準。本公司依113及112年度財務報告計算所約定財務比率已達標準。

(十二) 退職後福利計畫

1. 確定提撥計畫

- (1) 本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶；而在中華民國境外之子公司已參加由當地政府辦理之確定提撥辦法，並按月提撥退休金給當地政府。
- (2) 本集團於114及113年4至6月與114及113年1至6月依照確定提撥計畫中明定比例應提撥之金額已於綜合損益表認列費用總額分別為1,118仟元及1,057仟元與2,127仟元及2,080仟元。

2. 確定福利計畫

- (1) 本集團於114及113年4至6月與114及113年1至6月認列之確定福利計畫相關退休金費用分別為4仟元及0仟元與9仟元及0仟元，上述係採用113年及112年12月31日精算決定之退休金成本率計算。

(十三) 普通股股本及待分配股票股利

項 目	114年6月30日		113年6月30日	
	股數(仟股)	金 額	股數(仟股)	金 額
股本	28,860	\$ 288,598	28,860	\$ 288,598
待分配股票股利	5,772	57,720	-	-

1. 截至114年6月30日止，本公司額定資本額為600,000仟元，分為60,000仟股。
2. 本公司於114年6月18日經股東常會通過辦理盈餘轉增資57,720仟元，上開盈餘轉增資案業於114年7月4日經行政院金融監督管理委員會核准在案，發行普通股股票5,772仟股，每股面額10元。增資除權基準日為114年8月1日。

(十四) 資本公積

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
普通股股票發行溢價	\$ 55,333	\$ 55,333	\$ 55,333
已失效認股權	57	57	57
合 計	\$ 55,390	\$ 55,390	\$ 55,390

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，得按股東原有股份之比例發給新股或現金。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。因採用權益法之投資所產生之資本公積，不得作為任何用途。

(十五)保留盈餘及股利政策

1. 依本公司章程規定，本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積後，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案。本項盈餘分派以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。
2. 分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部分，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。
3. 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。
4. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之。惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部份為限。
5. 本公司於114年6月及113年6月經股東會決議通過之113及112年度盈餘分配案及每股股利如下：

項 目	盈餘分配案		每股股利(元)	
	113 年度	112 年度	113 年度	112 年度
法定公積	\$ 8,694	\$ 13,326		
特別盈餘公積提列 (轉回)	(126)	46		
普通股現金股利(註)	28,860	57,720	1.00	2.00
普通股股票股利	57,720	-	2.00	-
合 計	<u>\$ 95,148</u>	<u>\$ 71,092</u>		

(註)決議分配之股利與現金流量表發放現金股利調節如下：

項 目	114 年 1 至 6 月	113 年 1 至 6 月
本期現金股利	\$ 28,860	\$ 57,720
應付現金股利(增)減	(28,860)	(57,720)
本期股利支付現金數	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(十六)營業收入

項 目	114年4至6月	113年4至6月
客戶合約之收入		
出售產品收入	\$ 153,257	\$ 89,085
維修收入	19,073	16,702
加工收入	200	-
客戶合約銷貨收入總額	\$ 172,530	\$ 105,787
減：銷貨折讓	(6)	-
客戶合約營業收入淨額	\$ 172,524	\$ 105,787

項 目	114年1至6月	113年1至6月
客戶合約之收入		
出售產品收入	\$ 220,255	\$ 232,894
維修收入	35,190	30,566
加工收入	216	-
客戶合約銷貨收入總額	\$ 255,661	\$ 263,460
減：銷貨折讓	(6)	-
客戶合約營業收入淨額	\$ 255,655	\$ 263,460

1. 客戶合約之說明

係機械產品及其零組件之銷售收入，主要對象為電子業廠商，係以合約約定價格銷售。

2. 客戶合約收入之細分如下：

本集團之收入可細分為下列主要服務線及地理區域：

114年4至6月：

	出售產品收入	維修收入	加工收入	合 計
主要地區市場				
台 灣	\$ 68,811	\$ 14,508	\$ 200	\$ 83,519
中國大陸	52,394	662	-	53,056
泰 國	22,286	336	-	22,622
美 國	9,766	67	-	9,833
其他國家	-	3,494	-	3,494
合 計	\$ 153,257	\$ 19,067	\$ 200	\$ 172,524
主要服務線				
台 南 廠	\$ 151,962	\$ 19,067	\$ 200	\$ 171,229
大陸昆山市	1,295	-	-	1,295
合 計	\$ 153,257	\$ 19,067	\$ 200	\$ 172,524
收入認列時點				
於某一時點滿足履約義務	\$ 153,257	\$ 19,067	\$ 200	\$ 172,524
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-	-
合 計	\$ 153,257	\$ 19,067	\$ 200	\$ 172,524

113年4至6月：

	出售產品收入	維修收入	加工收入	合 計
<u>主要地區市場</u>				
台 灣	\$ 33,777	\$ 13,837	\$ -	\$ 47,614
中國大陸	55,308	613	-	55,921
泰 國	-	220	-	220
美 國	-	259	-	259
其他國家	-	1,773	-	1,773
合 計	<u>\$ 89,085</u>	<u>\$ 16,702</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 105,787</u>
<u>主要服務線</u>				
台 南 廠	\$ 87,778	\$ 16,702	\$ -	\$ 104,480
大陸昆山市	1,307	-	-	1,307
合 計	<u>\$ 89,085</u>	<u>\$ 16,702</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 105,787</u>
<u>收入認列時點</u>				
於某一時點滿足履約義務	\$ 89,085	\$ 16,702	\$ -	\$ 105,787
合 計	<u>\$ 89,085</u>	<u>\$ 16,702</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 105,787</u>

114年1至6月：

	出售產品收入	維修收入	加工收入	合 計
<u>主要地區市場</u>				
台 灣	\$ 119,776	\$ 28,286	\$ 216	\$ 148,278
中國大陸	54,097	1,047	-	55,144
泰 國	22,286	436	-	22,722
美 國	9,765	69	-	9,834
其他國家	14,331	5,346	-	19,677
合 計	<u>\$ 220,255</u>	<u>\$ 35,184</u>	<u>\$ 216</u>	<u>\$ 255,655</u>
<u>主要服務線</u>				
台 南 廠	\$ 217,257	\$ 35,184	\$ 216	\$ 252,657
大陸昆山市	2,998	-	-	2,998
合 計	<u>\$ 220,255</u>	<u>\$ 35,184</u>	<u>\$ 216</u>	<u>\$ 255,655</u>
<u>收入認列時點</u>				
於某一時點滿足履約義務	\$ 220,255	\$ 35,184	\$ 216	\$ 255,655
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 220,255</u>	<u>\$ 35,184</u>	<u>\$ 216</u>	<u>\$ 255,655</u>

113年1至6月：

	出售產品收入	維修收入	加工收入	合 計
<u>主要地區市場</u>				
台 灣	\$ 106,236	\$ 23,861	\$ -	\$ 130,097
中國大陸	123,583	1,139	-	124,722
泰 國	-	916	-	916
美 國	-	2,032	-	2,032
其他國家	3,075	2,618	-	5,693
合 計	<u>\$ 232,894</u>	<u>\$ 30,566</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 263,460</u>
<u>主要服務線</u>				
台 南 廠	\$ 226,913	\$ 30,566	\$ -	\$ 257,479
大陸昆山市	5,981	-	-	5,981
合 計	<u>\$ 232,894</u>	<u>\$ 30,566</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 263,460</u>
<u>收入認列時點</u>				
於某一時點滿足履約義務	\$ 232,894	\$ 30,566	\$ -	\$ 263,460
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 232,894</u>	<u>\$ 30,566</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 263,460</u>

3. 合約餘額

本集團認列客戶合約收入相關之應收款、合約資產及合約負債如下：

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日	113年1月1日
應收款項(註)	\$ 245,629	\$ 233,014	\$ 215,664	\$ 268,324
合約資產	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 245,629</u>	<u>\$ 233,014</u>	<u>\$ 215,664</u>	<u>\$ 268,324</u>
合約負債—流動	<u>\$ 12,168</u>	<u>\$ 28,712</u>	<u>\$ 23,517</u>	<u>\$ 34,631</u>

(註)係包含應收票據及應收帳款。

(1) 合約資產及合約負債的重大變動

合約資產及合約負債之變動主要係來自滿足履約義務之時點與客戶付款時點之差異，並無其他重大變動。

(2) 來自期初合約負債及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

當期認列為收入之金額	114年1至6月	113年1至6月
來自期初合約負債商品銷貨	\$ 26,992	\$ 19,792
來自前期已滿足之履約義務	\$ -	\$ -

(十七)員工福利、折舊及攤銷費用

性 質 別	114 年 4 至 6 月		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利費用			
薪資費用	\$ 6,788	\$ 9,640	\$ 16,428
勞健保費用	903	902	1,805
退休金費用	615	507	1,122
董事酬金	-	2,018	2,018
其他員工福利費用	1,123	1,226	2,349
折舊費用	235	3,638	3,873
攤銷費用	186	248	434
合 計	\$ 9,850	\$ 18,179	\$ 28,029

性 質 別	113 年 4 至 6 月		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利費用			
薪資費用	\$ 8,066	\$ 8,900	\$ 16,966
勞健保費用	858	762	1,620
退休金費用	620	437	1,057
董事酬金	-	2,017	2,017
其他員工福利費用	873	2,531	3,404
折舊費用	18	3,180	3,198
攤銷費用	113	290	403
合 計	\$ 10,548	\$ 18,117	\$ 28,665

性 質 別	114 年 1 至 6 月		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利費用			
薪資費用	\$ 14,481	\$ 21,100	\$ 35,581
勞健保費用	1,704	1,716	3,420
退休金費用	1,167	969	2,136
董事酬金	-	3,767	3,767
其他員工福利費用	1,876	2,164	4,040
折舊費用	458	7,236	7,694
攤銷費用	343	496	839
合 計	\$ 20,029	\$ 37,448	\$ 57,477

性 質 別	113 年 1 至 6 月		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利費用			
薪資費用	\$ 17,944	\$ 21,969	\$ 39,913
勞健保費用	1,678	1,714	3,392
退休金費用	1,200	880	2,080
董事酬金	-	4,510	4,510
其他員工福利費用	1,510	3,341	4,851
折舊費用	50	6,136	6,186
攤銷費用	213	600	813
合 計	\$ 22,595	\$ 39,150	\$ 61,745

1. 依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥2%至10%為員工酬勞(員工酬勞總額中不低於45%應提撥為分派予基層員工之酬勞)及不得高於6%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。114及113年4至6月與114及113年1至6月估列員工酬勞分別為1,758仟元及2,903仟元與2,170仟元及5,966仟元，係按前述稅前利益之2%至10%內估列；114及113年4至6月與114及113年1至6月估列董事酬勞分別為347仟元及371仟元與447仟元及1,315仟元，係按前述稅前利益之不高於6%估列。年度財務報告通過日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理於次一年度調整入帳。
2. 本公司於114年3月19日及113年3月27日董事會決議通過113及112年度員工酬勞及董監酬勞，以及財務報告認列之相關金額如下：

	113 年 度		112 年 度	
	員工酬勞	董事酬勞	員工酬勞	董監酬勞
決議配發金額	\$ 9,782	\$ 1,772	\$ 12,606	\$ 3,486
年度財務報告認列金額	9,782	1,772	12,606	3,486
差異金額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

上列員工酬勞均係以現金形式發放。

3. 本公司董事會通過之員工酬勞及董監酬勞相關資訊，請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(十八)利息收入

項 目	114 年 4 至 6 月	113 年 4 至 6 月
銀行存款利息	\$ 1,400	\$ 1,386

項 目	114 年 1 至 6 月	113 年 1 至 6 月
銀行存款利息	\$ 2,393	\$ 2,101

(十九)其他收入

項 目	114年4至6月	113年4至6月
補助收入—低利貸款補助	\$ 236	\$ 236
售電收入	127	125
其 他	52	110
合 計	\$ 415	\$ 471

項 目	114年1至6月	113年1至6月
補助收入—低利貸款補助	\$ 473	\$ 473
售電收入	302	328
其 他	184	339
合 計	\$ 959	\$ 1,140

(二十)其他利益及損失

項 目	114年4至6月	113年4至6月
淨外幣兌換利益(損失)	\$ (23,786)	\$ 5,014
透過損益按公允價值衡量金融資產評 價(損)益	(468)	28
其他支出	(62)	(5)
合 計	\$ (24,316)	\$ 5,037

項 目	114年1至6月	113年1至6月
淨外幣兌換利益(損失)	\$ (19,429)	\$ 18,811
透過損益按公允價值衡量金融資產評 價(損)益	(554)	276
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	-	2
其他支出	(69)	(49)
合 計	\$ (20,052)	\$ 19,040

(二十一)財務成本

項 目	114年4至6月	113年4至6月
銀行借款之利息	\$ 818	\$ 829
減：符合要件之資產資本化金額	-	-
利息費用	\$ 818	\$ 829

項 目	114年1至6月	113年1至6月
銀行借款之利息	\$ 1,637	\$ 1,633
減：符合要件之資產資本化金額	-	-
利息費用	\$ 1,637	\$ 1,633

(二十二)所得稅

1. 所得稅費用(利益)

(1) 所得稅費用組成部分：

	114年4至6月	113年4至6月
<u>當期所得稅</u>		
當期所產生之所得稅	\$ 3,146	\$ 6,622
以前年度所得稅高低估	-	149
未分配盈餘加徵稅額	-	2,927
當期所得稅總額	\$ 3,146	\$ 9,698
<u>遞延所得稅</u>		
暫時性差異之原始產生及迴轉	\$ 43	\$ (743)
遞延所得稅總額	43	(743)
所得稅費用(利益)	\$ 3,189	\$ 8,955

	114年1至6月	113年1至6月
<u>當期所得稅</u>		
當期所產生之所得稅	\$ 3,965	\$ 8,305
以前年度所得稅高低估	-	149
未分配盈餘加徵稅額	-	2,927
當期所得稅總額	\$ 3,965	\$ 11,381
<u>遞延所得稅</u>		
暫時性差異之原始產生及迴轉	\$ (12)	\$ 2,901
遞延所得稅總額	(12)	2,901
所得稅費用(利益)	\$ 3,953	\$ 14,282

(2) 與其他綜合損益相關之所得稅費用(利益)：無。

本公司適用之所得稅稅率為20%，未分配盈餘所適用之稅率為5%；其他轄區所產生之稅額係依各相關轄區適用之稅率計算。

2. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至111年度。

(二十三)其他綜合損益

項 目	114年4至6月		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ (610)	\$ -	\$ (610)
認列於其他綜合損益	\$ (610)	\$ -	\$ (610)

項 目	113年4至6月		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 24	\$ -	\$ 24
認列於其他綜合損益	\$ 24	\$ -	\$ 24

項 目	114 年 1 至 6 月		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ (483)	\$ -	\$ (483)
認列於其他綜合損益	\$ (483)	\$ -	\$ (483)

項 目	113 年 1 至 6 月		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 91	\$ -	\$ 91
認列於其他綜合損益	\$ 91	\$ -	\$ 91

(二十四) 普通股每股盈餘

項 目	114 年 4 至 6 月	113 年 4 至 6 月
A. 基本每股盈餘：		
本期淨利(A)	\$ 12,269	\$ 17,314
本期流通在外加權平均股數(仟股)(B)	34,632	28,860
追溯調整後加權平均股數(仟股)(B)	34,632	34,632
基本每股盈餘(稅後)(元)(A)/(B)	0.35	0.50
B. 稀釋每股盈餘：		
本期淨利(C)	\$ 12,269	\$ 17,314
具稀釋作用之潛在普通股之影響	-	-
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ 12,269	\$ 17,314
追溯調整後加權平均股數(仟股)	34,632	34,632
員工酬勞影響數(註)	83	144
計算稀釋每股盈餘之追溯調整後加權平均股數(仟股)(D)	34,715	34,776
稀釋每股盈餘(稅後)(元)(C)/(D)	\$ 0.35	\$ 0.50

項 目	114 年 1 至 6 月	113 年 1 至 6 月
A. 基本每股盈餘：		
本期淨利(A)	\$ 15,148	\$ 39,394
本期流通在外加權平均股數(仟股)	34,632	28,860
追溯調整後加權平均股數(仟股)(B)	34,632	34,632
基本每股盈餘(稅後)(元)(A)/(B)	0.44	1.14
B. 稀釋每股盈餘：		
本期淨利(C)	\$ 15,148	\$ 39,394
具稀釋作用之潛在普通股之影響	-	-
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ 15,148	\$ 39,394

追溯調整後加權平均股數(仟股)	34,632	34,632
員工酬勞影響數(註)	299	588
計算稀釋每股盈餘之追溯調整後加權平均股數(仟股)(D)	34,931	35,220
稀釋每股盈餘(稅後)(元)(C)/(D)	\$ 0.43	\$ 1.12

本公司於114年6月18日股東常會通過以盈餘轉增資發行新股5,772仟股，113年1至6月追溯調整後股數為34,632仟股。

(註)若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者：

本公司為本集團之最終控制者。

(二) 關係人名稱及關係：

關係人名稱	與合併公司之關係
欣大宇室內裝修工程行	其他關係人

(三) 與關係人間之重大交易事項：

- 營業收入：無。
- 進貨：無。
- 合約資產：無。
- 合約負債：無。
- 應收關係人款項：無。
- 應付關係人款項（不含向關係人借款）：

項 目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
其他應付款			
其他關係人	\$ 266	\$ -	\$ 40

7. 預付款項：無。

8. 財產交易

(1) 取得不動產、廠房及設備

114年1至6月：

關係人類別/名稱	交易內容	交易金額
其他關係人	配電工程等	\$ 750

上開交易價格係經雙方議價決定，截至114年6月30日止，價款已全數付清。

113年1至6月：無。

9. 其他：

(1) 各項費用

關係人類別	114年4至6月	113年4至6月	交易性質
其他關係人	\$ 262	\$ 113	修繕費用等

關係人類別	114年1至6月	113年1至6月	交易性質
其他關係人	\$ 318	\$ 125	修繕費用等

(四) 主要管理階層薪酬資訊

關係人類別/名稱	114年4至6月	113年4至6月
薪資及其他短期員工福利	\$ 2,921	\$ 3,946
退職後福利	27	27
合計	\$ 2,948	\$ 3,973

關係人類別/名稱	114年1至6月	113年1至6月
薪資及其他短期員工福利	\$ 6,231	\$ 8,292
退職後福利	54	54
合計	\$ 6,285	\$ 8,346

八、質押之資產

下列資產已提供為借款之擔保品：

項目	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
不動產、廠房及設備	\$ 233,714	\$ 237,101	\$ 240,551
其他金融資產-流動(註)	14,650	16,395	-
其他金融資產-非流動(註)	15,000	16,395	16,213
合計	\$ 263,364	\$ 269,891	\$ 256,764

(註) 係因借款額度而設質之定期存款。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一) 截至114年6月30日、113年12月31日及113年6月30日止，本集團因銷售機台而開立之保證票據分別為489仟元、489仟元及0仟元，帳列存出保證票據及應付保證票據科目。

(二) 截至114年6月30日、113年12月31日及113年6月30日，本集團因外銷機台，客戶要求開立銀行保函分別為美金0仟元、美金0仟元及美金61仟元。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

(一)期中營運之季節性或週期性之解釋

本集團之營運不受季節性或週期性因素影響。

(二)資本風險管理

本集團資本風險管理之方式與113年度合併財務報告所述者並無重大變動，相關說明請參閱113年度合併財務報告附註十二(一)。

(三)金融工具

1. 金融工具之財務風險

財務風險管理政策

本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險（包括匯率風險、利率風險及價格風險）、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本集團致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對集團財務績效之潛在不利影響。

本集團之重要財務活動，係經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計畫執行期間，本集團必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

重大財務風險之性質及程度

(1) 市場風險

A. 匯率風險

(A) 重大財務風險之性質及程度，與113年度合併財務報告所述者，並無重大變動，相關說明請參閱113年度合併財務報告附註十二(二)。

(B) 匯率暴險及敏感度分析

		114年6月30日					
				帳列金額	敏感度分析		
		外幣	匯率	(新台幣)	變動幅度	損益影響	權益影響
(外幣：功能性貨幣)							
<u>金融資產</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金：新台幣	5,939	29.30	174,065	升值1%	1,741	-	
<u>金融負債</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金：新台幣	157	29.30	4,618	升值1%	(46)	-	
		113年12月31日					
				帳列金額	敏感度分析		
		外幣	匯率	(新台幣)	變動幅度	損益影響	權益影響
(外幣：功能性貨幣)							
<u>金融資產</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金：新台幣	7,530	32.785	246,880	升值1%	2,469	-	
<u>金融負債</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金：新台幣	315	32.785	10,335	升值1%	(103)	-	

113年6月30日

(外幣：功能性貨幣)	外幣	匯率	帳列金額 (新台幣)	敏感度分析		
				變動幅度	損益影響	權益影響
金融資產						
貨幣性項目						
美金：新台幣	9,700	32.45	314,748	升值1%	3,147	-
日幣：新台幣	74,294	0.2017	14,985	升值1%	150	-
金融負債						
貨幣性項目						
美金：新台幣	213	32.45	6,918	升值1%	(69)	-

新台幣之幣值若相對於上述貨幣升值時，若所有其他之變動因子維持不變，於114年及113年6月30日反映於上述貨幣之金額會有相等但相反方向之影響。

- (C) 本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於114及113年4至6月與114及113年1至6月認列之全部兌換淨(損)益(含已實現及未實現)彙總金額分別為(23,786)仟元及5,014仟元與(19,429)仟元及18,811仟元。

B. 價格風險

由於本集團持有之金融工具投資於資產負債表中係分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產，因此本集團暴露於金融工具之價格風險。

本集團主要投資於國外基金受益憑證，此等金融工具之價格會因該投資標的未來價值之不確定性而受影響。若該等金融工具價格變動1%，而其他所得因素維持不變之情況下，對114及113年1至6月稅後損益因來自透過損益按公允價值衡量之金融資產之公允價值上升而分別增加為49仟元及53仟元。

C. 利率風險

本集團於報導日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

項 目	帳 面 金 額		
	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
具公允價值利率風險：			
金融資產	\$ 32,648	\$ 32,790	\$ 16,213
金融負債	-	-	-
淨 額	\$ 32,648	\$ 32,790	\$ 16,213
具現金流量利率風險：			
金融資產	\$ 445,821	\$ 465,268	\$ 454,390
金融負債	(153,458)	(161,928)	(167,186)
淨 額	\$ 292,363	\$ 303,340	\$ 287,204

(A) 具公允價值利率風險之敏感度分析：

本集團未將任何固定利率之金融資產及負債分類為透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，亦未指定衍生工具(利率交換)作為公允價值避險會計模式下之避險工具。因此，報導日利率之變動將不會影響損益及其他綜合淨利。

(B) 具現金流量利率風險之敏感度分析：

本集團之變動利率之金融工具係屬浮動利率之資產(債務)，故市場利率變動將使其有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動。市場利率每變動1%，將使114及113年1至6月淨利(損)分別變動1,462仟元及1,436仟元。

(2) 信用風險

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本集團造成財務損失之風險。本集團之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項，及投資活動產生之銀行存款及其他金融工具。營運相關信用風險與財務信用風險係分別管理。

A. 營運相關信用風險

為維持應收帳款的品質，本集團已建立營運相關信用風險管理之程序。個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、本集團內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。

B. 財務信用風險

銀行存款及其他金融工具之信用風險，係由本集團財務部門衡量並監控。由於本集團之交易對象及履約他方均係信用良好之銀行及具投資等級以上之金融機構、公司組織及政府機關，無重大之履約疑慮，故無重大之信用風險。另本集團並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

(A) 信用集中風險：

截至114年6月30日、113年12月31日及113年6月30日，前十大客戶之應收帳款餘額占本集團應收帳款餘額之百分比分別為65%、76%及71%，有信用集中風險，其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

(B) 預期信用減損損失之衡量

(a) 應收帳款：係採簡化作法，請參閱附註六(四)之說明。

(b) 信用風險是否顯著增加之判斷依據：無。(本集團並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資)

(C) 持有擔保品及其他信用增強來規避金融資產之信用風險：

合併資產負債表所認列之金融資產及本集團所持有作為擔保之擔保品、淨額交割總約定及其他信用增強對信用風險最大暴險金額有關之財務影響相關資訊如下表所示：

114年6月30日	信用風險最大曝險減少金額				
	帳面金額	擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	合計
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,891	-	-	-	-
合計	\$ 4,891	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

113年12月31日	信用風險最大暴險減少金額				
	帳面金額	擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	合計
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,445	-	-	-	-
合計	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

113年6月30日	信用風險最大曝險減少金額				
	帳面金額	擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	合計
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,302	-	-	-	-
合計	\$ 5,302	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(3) 流動性風險

A. 概述：

本集團管理流動性風險之目標與政策，與113年度合併財務報告所述者無重大變動，相關說明請參詳113年度合併財務報告附註十二(二)。

下表係按到期日及未折現之到期金額彙總列示本集團已約定還款期間之金融負債分析：

非衍生金融負債	114年6月30日						
	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 88,225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,225	\$ 88,225
其他應付款	67,595	8,169	-	-	-	75,764	75,764
長期借款(一年內到期)	8,230	7,069	14,138	42,413	92,648	164,498	153,458
合計	\$ 164,050	\$ 15,238	\$ 14,138	\$ 42,413	\$ 92,648	\$ 328,487	\$ 317,447

非衍生金融負債	113年12月31日						
	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 71,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,895	\$ 71,895
其他應付款	53,563	-	-	-	-	53,563	53,563
長期借款(一年內到期)	9,392	8,230	14,138	42,413	99,268	173,441	161,928
合計	\$ 134,850	\$ 8,230	\$ 14,138	\$ 42,413	\$ 99,268	\$ 298,899	\$ 287,386

非衍生金融負債	113年6月30日					合約現金流量	帳面金額
	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年		
應付帳款	\$ 66,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,237	\$ 66,237
其他應付款	85,199	17,846	-	-	-	103,045	103,045
長期借款(含一年內到期)	5,517	9,392	15,299	42,413	106,551	179,172	167,186
合計	\$ 156,953	\$ 27,238	\$ 15,299	\$ 42,413	\$ 106,551	\$ 348,454	\$ 336,468

本集團並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

2. 金融工具之種類

本集團各項金融資產及金融負債之帳面金額如下：

	114年6月30日	113年12月31日	113年6月30日
<u>金融資產</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產			
現金及約當現金	\$ 449,499	\$ 464,474	\$ 454,727
應收票據及帳款(含關係人)	245,629	233,014	215,664
其他應收款	116	267	157
其他金融資產－流動	14,650	16,395	-
存出保證金	1,327	1,463	1,093
其他金融資產－非流動	15,000	16,395	16,213
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,891	5,445	5,302
<u>金融負債</u>			
按攤銷後成本衡量之金融負債			
應付帳款	88,225	71,895	66,237
其他應付款	75,764	53,563	103,045
一年或一營業週期內到期長期借款	15,299	17,622	14,909
長期借款	138,159	144,306	152,277

(四)公允價值資訊

1. 本集團非以公允價值衡量之金融資產及金融負債之公允價值資訊請詳附註十二(四)3.說明。

2. 公允價值之三等級定義：

第一等級：

該等級之輸入值係指工具於活絡市場中，相同工具之活絡市場公開報價。活絡市場係指符合以下所有條件之市場：在市場交易之商品具同質性；隨時可於市場中尋得具意願之買賣雙方且價格資訊可為大眾取得。

第二等級：

該等級之輸入值除活絡市場公開報價以外之可觀察價格，包括直接（如價格）或間接（如自價格推導而來）自活絡市場取得之可觀察輸入值。

第三等級：

該等級之輸入值係指衡量公允價值之投入參數並非根據市場可取得之可觀察輸入值。

3. 非按公允價值衡量之金融工具：

本集團非以公允價值衡量之金融工具，如現金及約當現金、應收款項、其他金融資產、存出保證金、應付款項、其他應付款及長期借款(含一年內)之帳面金額，係公允價值合理之近似值。

4. 公允價值之等級資訊：

本集團之以公允價值衡量之金融工具係皆以重複性為基礎按公允價值衡量。本集團之公允價值等級資訊如下表所示：

項 目	114年6月30日			
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
資產：				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國內基金受益憑證	\$ 4,891	\$ -	\$ -	\$ 4,891

項 目	113年12月31日			
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
資產：				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國內基金受益憑證	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ 5,445

項 目	113年6月30日			
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
資產：				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國內基金受益憑證	\$ 5,302	\$ -	\$ -	\$ 5,302

5. 以公允價值衡量之工具的公允價值評價技術：

(1) 本集團採用活絡市場公開報價作為公允價值輸入值者：

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市(櫃)權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

本集團持有之金融工具如屬有活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

A. 開放型基金：淨值。

6. 第一等級與第二等級間之移轉：無。

7. 第三等級之變動明細表：無。

(五)金融資產之移轉：無。

(六)金融資產及金融負債之互抵：無。

(七)為配合114年第二季財務報表之表達方式，擬將113年第二季部分會計項目予以重分類，列示如下：

會計項目	重分類前	重分類	重分類後
營業成本	\$ 164,291	\$ (6,166)	\$ 158,125
推銷費用	15,229	6,166	21,395

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊(合併沖銷前)

1. 資金貸與他人者：無。

2. 他人背書保證者：無。

3. 期末持有之重大有價證券者：附表一。

4. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

5. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

6. 母子公司間業務關係交易往來情形：附表二。

(二)轉投資事業相關資訊：附表三。

(三)大陸投資資訊：附表四。

附表一

暉盛科技股份有限公司及子公司
 期末持有之重大有價證券
 民國 114 年 6 月 30 日

單位：仟股/單位；新台幣仟元

持有之 公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
暉盛科技 (股)公司	基金受益憑證/摩根環球高 收益債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	1	2,573	-	2,573	
	基金受益憑證/安聯收益成 長基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	9	2,318	-	2,318	
		合 計				4,891		4,891

附表二

暉盛科技股份有限公司及子公司
母子公司間業務關係及重要交易往來情形
民國 114 年 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

個別交易金額未達 100 萬元以上，不予以揭露；另以資產面及收入面為揭露方式，其相對交易不再揭露。

編號 (註一)	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之 關係(註二)	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營收或總 資產之比率(註三)
0	暉盛科技(股)公 司	昆山金暉盛電子商 貿有限公司	1	維修零件收入	1,601	價格與一般客戶相當，收款 條件為 3 至 4 個月內收款。	0.63%
				應收帳款	1,048		0.10%
1	昆山金暉盛電子 商貿有限公司	暉盛科技(股)公司	2	勞務收入	5,069	價格與一般客戶相當，收款 條件為 3 至 4 個月內收款。	1.98%

註一：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

1. 母公司填 0。
2. 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註二：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：

1. 母公司對子公司。
2. 子公司對母公司。
3. 子公司對子公司。

註三：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債科目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益科目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註四：上述母子公司間交易已沖銷。

附表三

暉盛科技股份有限公司及子公司
轉投資事業相關資訊
民國 114 年 6 月 30 日

單位：仟股；外幣仟元；新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額		
暉盛科技(股)公司	Stable Promise Group Co., Ltd.	塞席爾群島	一般投資業	15,178 (USD 500)	15,178 (USD 500)	500	100%	4,715 (USD 161)	(1,013) (USD -32)	(1,013) (USD -32)

註：上述母子公司間之交易已沖銷。

附表四

暉盛科技股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國 114 年 6 月 30 日

單位：外幣仟元；新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註 1)	本期期初自 台灣匯出累積 投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資公司本期 損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列 投資損益 (註 2)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回台灣之投 資收益
					匯出	收回						
昆山金暉盛 電子商貿有 限公司	電子零組件貿 易與售後服務	15,178 (RMB 3,318)	(2)	15,178 (USD 500)	-	-	15,178 (USD 500)	(1,013) (RMB -231)	100%	(1,013) (RMB -231) (2).B	4,715 (RMB 1,153)	-

本期期末累計自台灣匯 出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會 核准投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
15,178(USD 500)	14,650(USD 500)	439,114

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸(請參閱附表三)
- (3) 其他方式

註 2：本期認列投資損益欄中：

- (1) 若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明
- (2) 投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明
 - A. 經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表
 - B. 經台灣母公司簽證會計師查核(核閱)簽證之財務報表
 - C. 其他。

註 3：本表相關數字應以新台幣列示。

註 4：本期認列投資損益係依平均匯率 1 美元=31.8237 新台幣核算；期末投資帳面價值係依期末匯率 1 美元=29.3 新台幣核算。

註 5：本公司 114 年 1 至 6 月與大陸被投資公司之重大交易事項列示如下：

與大陸被投資公司之重大交易事項：詳附註十三附表二。

註 6：上述母子公司間交易業已沖銷。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊：

為管理之目的，本集團之營運決策者依據地區別劃分營運單位，並分為下列應報導部門：

1. 暉盛科技：主要從事設備機台製造與銷售；
2. 昆山金暉盛：主要從事設備機台相關調整及維修業務與商品買賣；
3. 其他部門：主要從事一般投資業。

(二)衡量基礎：

合併公司營運決策者個別監督各營運單位之營運結果，以制定資源分配與績效評估之決策。部門之績效係根據營業損益予以評估，並採與合併財務報表中營業損益一致之方式衡量。然而，合併財務報表之財務成本和財務收益，及所得稅係以集團為基礎進行管理，並未分攤至營運部門。

(三)部門財務資訊：

114年4至6月：

單位：新台幣仟元

項 目	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$ 171,229	\$ 1,295	\$ -	\$ -	\$ 172,524
部門間收入	1,076	2,460	(744)	(2,792)	-
收入合計	\$ 172,305	\$ 3,755	\$ (744)	\$ (2,792)	\$ 172,524
折舊與攤銷	\$ 4,306	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 4,307
部門營業損益	\$ 39,352	\$ (575)	\$ (744)	\$ 744	\$ 38,777
採用權益法之投資	\$ 4,715	\$ -	\$ 4,715	\$ (9,430)	\$ -
非流動資產資本支出	\$ 1,308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,308
部門資產	\$ 1,074,524	\$ 11,775	\$ 4,715	\$ (10,503)	\$ 1,080,511
部門負債	\$ 342,667	\$ 7,060	\$ -	\$ (1,073)	\$ 348,654

113年4至6月：

單位：新台幣仟元

項 目	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$ 104,480	\$ 1,307	\$ -	\$ -	\$ 105,787
部門間收入	1,113	2,689	(359)	(3,443)	-
收入合計	\$ 105,593	\$ 3,996	\$ (359)	\$ (3,443)	\$ 105,787
折舊與攤銷	\$ 3,587	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ 3,601
部門營業損益	\$ 20,524	\$ (320)	\$ (359)	\$ 359	\$ 20,204
採用權益法之投資	\$ 6,255	\$ -	\$ 6,255	\$ (12,510)	\$ -
非流動資產資本支出	\$ 4,397	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 4,422
部門資產	\$ 1,080,013	\$ 12,592	\$ 6,255	\$ (13,648)	\$ 1,085,212
部門負債	\$ 381,559	\$ 6,337	\$ -	\$ (1,138)	\$ 386,758

114年1至6月：

單位：新台幣仟元

項 目	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$ 252,657	\$ 2,998	\$ -	\$ -	\$ 255,655
部門間收入	1,601	5,097	(1,013)	(5,685)	-
收入合計	\$ 254,258	\$ 8,095	\$ (1,013)	\$ (5,685)	\$ 255,655
折舊與攤銷	\$ 8,527	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ 8,533
部門營業損益	\$ 38,309	\$ (871)	\$ (1,013)	\$ 1,013	\$ 37,438
採用權益法之投資	\$ 4,715	\$ -	\$ 4,715	\$ (9,430)	\$ -
非流動資產資本支 出	\$ 3,358	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ 3,373
部門資產	\$ 1,074,524	\$ 11,775	\$ 4,715	\$ (10,503)	\$ 1,080,511
部門負債	\$ 342,667	\$ 7,060	\$ -	\$ (1,073)	\$ 348,654

113年1至6月：

單位：新台幣仟元

項 目	暉盛科技	昆山金暉盛	其他	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$ 257,479	\$ 5,981	\$ -	\$ -	\$ 263,460
部門間收入	4,163	5,338	1,238	(10,739)	-
收入合計	\$ 261,642	\$ 11,319	\$ 1,238	\$ (10,739)	\$ 263,460
折舊與攤銷	\$ 6,983	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ 6,999
部門營業損益	\$ 31,841	\$ 1,187	\$ 1,238	\$ (1,238)	\$ 33,028
採用權益法之投資	\$ 6,255	\$ -	\$ 6,255	\$ (12,510)	\$ -
非流動資產資本支 出	\$ 4,852	\$ 46	\$ -	\$ -	\$ 4,898
部門資產	\$ 1,080,013	\$ 12,592	\$ 6,255	\$ (13,648)	\$ 1,085,212
部門負債	\$ 381,559	\$ 6,337	\$ -	\$ (1,138)	\$ 386,758

(四)產品別資訊：期中財務報告得免揭露。

(五)地區別資訊：期中財務報告得免揭露。

(六)重要客戶資訊：期中財務報告得免揭露。

附件三

民國 113 年度個體財務報告暨 會計師查核報告

【股票代號：7730】

暉盛科技股份有限公司
個體財務報告暨會計師查核報告
民國 113 及 112 年度

地址：台南市安南區台南科技工業區科技五路 100 號
電話：06-2915500

目 錄

項 目	頁次
一、封面	1
二、目錄	2
三、會計師查核報告	3
四、個體資產負債表	4
五、個體綜合損益表	5
六、個體權益變動表	6
七、個體現金流量表	7
八、個體財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~11
(四)重大會計政策之彙總說明	11~20
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	20~22
(六)重要會計項目之說明	22~40
(七)關係人交易	40~41
(八)質押之資產	42
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	42
(十)重大之災害損失	42
(十一)重大之期後事項	42
(十二)其他	42~48
(十三)附註揭露事項	48
1. 重大交易事項相關資訊	49
2. 轉投資事業相關資訊	50
3. 大陸投資資訊	51~52
(十四)部門資訊	53
九、重要會計項目明細表	54~70

會計師查核報告

暉盛科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

暉盛科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達暉盛科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與暉盛科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對暉盛科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對暉盛科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請參閱個體財務報告附註四(十八)；收入認列之會計估計及假設不確定性請參閱個體財務報告附註五(一)1.及五(二)1.；收入認列說明請參閱個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標，暉盛科技股份有限公司之產品因客戶需求而有不同的客製化程度，導致訂單或合約條件有所差異。由於收入認列之時點及金額是否正確對財務報告之影響實屬重大，因此將收入認列之測試認定為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性，檢視重要客戶訂單；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估暉盛科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算暉盛科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

暉盛科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對暉盛科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使暉盛科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致暉盛科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於暉盛科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成暉盛科技股份有限公司查核意見。

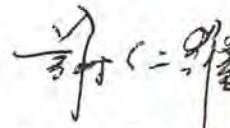
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對暉盛科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：謝 仁 耀



會計師：李 國 銘

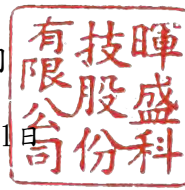


核准文號：金管證審字第 10200032833 號

金管證審字第 1100145994 號

民國 114 年 3 月 19 日

暉盛科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 458,858	41	\$ 383,553	35
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	5,445	1	5,026	-
1150	應收票據淨額(附註六(三))	195	-	47	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	232,470	22	268,552	25
1200	其他應收款	267	-	-	-
130x	存貨(附註六(五))	57,610	5	134,253	12
1410	預付款項(附註六(六))	10,442	1	10,206	1
1476	其他金融資產-流動(附註八)	16,395	2	-	-
11xx	流動資產合計	781,682	72	801,637	73
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	6,212	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八))	266,698	24	265,071	24
1780	無形資產(附註六(九))	2,036	-	2,474	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十四))	6,674	1	9,717	1
1920	存出保證金	1,219	-	1,112	-
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	16,395	2	15,353	2
15xx	非流動資產合計	299,234	28	293,727	27
1xxx	資產總計	\$ 1,080,916	100	\$ 1,095,364	100

(接次頁)

(承前頁)

代碼	負債及權益	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2130	合約負債-流動(附註六(十八))	\$ 28,712	3	\$ 34,631	3
2170	應付帳款	71,895	7	65,024	6
2200	其他應付款(附註六(十))	47,389	4	60,418	6
2230	本期所得稅負債	8,700	1	28,639	3
2250	負債準備-流動(附註六(十一))	4,007	-	4,420	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二))	17,622	2	11,034	1
21xx	流動負債合計	178,325	17	204,166	19
	非流動負債				
2540	長期借款(附註六(十二))	144,306	13	161,397	15
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十四))	704	-	-	-
2630	長期遞延收入(附註六(十二))	11,513	1	12,459	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十三))	16	-	-	-
2670	其他非流動負債-其他(附註六(七))	-	-	653	-
25xx	非流動負債合計	156,539	14	174,509	16
2xxx	負債總計	334,864	31	378,675	35
	權益				
3100	股本(附註六(十四))				
3110	普通股股本	288,598	27	288,598	26
3200	資本公積(附註六(十五))	55,390	5	55,390	5
3300	保留盈餘(附註六(十七))				
3310	法定盈餘公積	79,502	7	66,176	6
3320	特別盈餘公積	126	-	80	-
3350	未分配盈餘	322,419	30	306,571	28
3400	其他權益	17	-	(126)	-
3xxx	權益總計	746,052	69	716,689	65
	負債及權益總計	\$ 1,080,916	100	\$ 1,095,364	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：宋俊毅



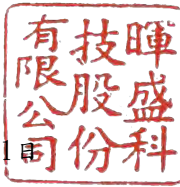
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	\$ 546,155	100	\$ 762,120	100
5000	營業成本(附註六(五)、十二(六))	(336,907)	(62)	(469,860)	(61)
5900	營業毛利(毛損)	209,248	38	292,260	39
	營業費用				
6100	推銷費用(附註十二(六))	(40,548)	(7)	(37,508)	(5)
6200	管理費用	(60,793)	(11)	(58,352)	(7)
6300	研究發展費用	(23,958)	(4)	(27,880)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益(附註六(四))	2,141	-	3,259	-
6000	營業費用合計	(123,158)	(22)	(120,481)	(16)
6900	營業利益(損失)	86,090	16	171,779	23
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註六(二十))	4,106	1	2,835	-
7010	其他收入(附註六(二十一))	2,452	-	2,377	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十二))	22,348	5	3,384	-
7050	財務成本(附註六(二十三))	(3,300)	(1)	(3,196)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	1,142	-	(5,316)	-
7000	營業外收入及支出合計	26,748	5	84	-
7900	稅前淨利(淨損)	112,838	21	171,863	23
7950	所得稅(費用)利益(附註六(二十四))	(25,888)	(5)	(38,602)	(5)
8200	本期淨利(淨損)	86,950	16	133,261	18
	其他綜合損益(附註六(二十五))				
	不重分類至損益之項目				
8310	確定福利計畫之再衡量數	(10)	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	2	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	143	-	(46)	-
8300	其他綜合損益(淨額)	135	-	(46)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 87,085	16	\$ 133,215	18
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註六(二十六))	\$ 3.01		\$ 5.00	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(二十六))	\$ 2.96		\$ 4.84	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：宋俊毅



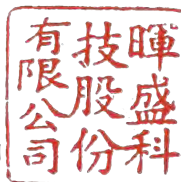
經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁




暉盛科技股份有限公司
 個體權益變動表
 民國113年及112年1月1日至12月31日





單位：新台幣仟元

	保留盈餘					其他權益項目		權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
112年1月1日餘額	\$ 262,558	\$ 22,600	\$ 56,085	\$ -	\$ 209,737	\$ (80)	\$ 550,900	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	10,091	-	(10,091)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	80	(80)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(26,256)	-	(26,256)	
112年度淨利(淨損)	-	-	-	-	133,261	-	133,261	
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(46)	(46)	
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	133,261	(46)	133,215	
股份基礎給付交易	26,040	32,790	-	-	-	-	58,830	
112年12月31日餘額	288,598	55,390	66,176	80	306,571	(126)	716,689	
追溯適用之影響數	-	-	-	-	(2)	-	(2)	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	13,326	-	(13,326)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	46	(46)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(57,720)	-	(57,720)	
113年度淨利(淨損)	-	-	-	-	86,950	-	86,950	
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	(8)	143	135	
113年度綜合損益總額	-	-	-	-	86,942	143	87,085	
113年12月31日餘額	\$ 288,598	\$ 55,390	\$ 79,502	\$ 126	\$ 322,419	\$ 17	\$ 746,052	

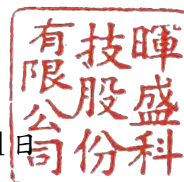
(請參閱個體財務報告附註)

董事長：宋俊毅 

經理人：許嘉元 

會計主管：蔡郁仁 

暉盛科技股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 112,838	\$ 171,863
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	12,997	12,244
攤銷費用	1,660	1,480
預期信用減損損失(利益)數	(2,141)	(3,259)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損 失(利益)	(419)	(236)
利息費用	3,300	3,196
利息收入	(4,106)	(2,835)
股份基礎給付酬勞成本	-	9,354
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失 (利益)之份額	(1,142)	5,316
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	45	-
其他項目	(946)	(946)
收益費損項目合計	9,248	24,314
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	(148)	(4)
應收帳款(增加)減少	38,223	7,202
其他應收款(增加)減少	(267)	1,000
存貨(增加)減少	66,084	152,371
預付款項(增加)減少	(236)	12,900
與營業活動相關之資產之淨變動合計	103,656	173,469
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(5,919)	(118,118)
應付帳款增加(減少)	6,871	(68,250)
其他應付款增加(減少)	(12,425)	(5,170)
負債準備增加(減少)	(413)	(758)
淨確定福利負債增加(減少)	4	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,882)	(192,296)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	91,774	(18,827)
調整項目合計	101,022	5,487
營運產生之現金流入(流出)	213,860	177,350
收取之利息	4,106	2,835
支付之利息	(2,768)	(2,594)
退還(支付)之所得稅	(42,078)	(44,449)
營業活動之淨現金流入(流出)	173,120	133,142

(接次頁)

(承前頁)

項 目	113年度	112年度
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	\$ (5,580)	\$ -
取得不動產、廠房及設備	(4,904)	(3,640)
處分不動產、廠房及設備	190	-
存出保證金增加	(107)	(118)
取得無形資產	(1,222)	(1,458)
其他金融資產增加	(17,437)	-
其他金融資產減少	-	2
投資活動之淨現金流入(流出)	(29,060)	(5,214)
籌資活動之現金流量		
償還長期借款	(11,035)	(5,833)
發放現金股利	(57,720)	(26,256)
員工執行認股權	-	49,476
籌資活動之淨現金流入(流出)	(68,755)	17,387
本期現金及約當現金增加(減少)數	75,305	145,315
期初現金及約當現金餘額	383,553	238,238
期末現金及約當現金餘額	\$ 458,858	\$ 383,553

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：宋俊毅



經理人：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



暉盛科技股份有限公司

個體財務報告附註

民國113年及112年1月1日至12月31日

(除另予註明外，所有金額均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱本公司)成立於91年6月，主要營業項目為電子材料批發、機械材料批發、電器批發、國際貿易、其他機械器具批發(電漿清潔器)、其他電機及電子機械器材製造(電漿清潔器)。110年11月本公司營運據點搬遷至台南科技工業園區。113年3月18日本公司普通股登錄為興櫃股票，開始於興櫃買賣交易。

本公司之功能性貨幣及個體財務報告之表達貨幣均為新台幣。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於114年3月19日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「IFRSs」)之影響

下表彙列金管會認可之113年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024年1月1日(註)
IAS 1 之修正「負債之流動或非流動分類」	2024年1月1日(註)
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024年1月1日(註)
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024年1月1日(註)

註：於2024年1月1日以後開始之年度報導期間適用此項修正。

1. IFRS 16之修正「售後租回中之租賃負債」

此修正闡明，對於售後租回之交易，若資產之移轉依IFRS 15之規定係以銷售處理者，賣方兼承租人因租回所產生之負債應依IFRS 16有關租賃負債之規定處理；惟若涉及非取決於指數或費率之變動租賃給付時，賣方兼承租人仍應以不認列與所保留使用權有關之損益之方式決定並認列該等變動給付所產生之租賃負債，後續實際之租賃給付金額與減少之租賃負債帳面金額間之差額係認列於損益。

2. IAS 1之修正「負債之流動或非流動分類」

此修正闡明，判斷負債是否分類為非流動時，應評估企業於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少12個月之權利。若企業於報導期間結束日具有該權利，則無論企業是否預期將行使該權利，該負債應分類為非流動。若企業必須遵循特定條件始具有將清償遞延之權利，則必須於報導期間結束日已遵循該等特定條件，始能將該負債分類為非流動，即使債權人係於較晚日期檢測企業是否遵循該等條件。

此外，此修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

3. IAS 1之修正「具合約條款之非流動負債」

此修正進一步闡明，僅有報導期間結束日以前須遵循之合約條款會影響該日負債之分類。報導期間後12個月內須遵循之合約條款並不影響負債之分類，惟企業對於報導期間結束日分類為非流動負債，若可能無法遵循合約條款而須於報導期間後12個月內清償者，應於附註揭露相關事實及情況。

4. IAS 7及IFRS 7之修正「供應商融資安排」

供應商融資安排係由一個或多個融資提供者代企業支付帳款予供應商，而企業同意依據與供應商約定之付款日或較晚之日期付款予融資提供者。IAS 7之修正係規定企業應揭露其供應商融資安排之資訊，以使財務報表使用者能夠評估該等安排對企業之負債、現金流量及流動性風險暴險之影響。IFRS 7之修正則於其應用指引中，納入企業於揭露如何管理金融負債流動性風險時，亦可能考量其是否透過供應商融資安排已取得或可取得融資額度，以及該等安排是否可能導致流動性風險集中之情況。

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用經金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響：

下表彙列金管會認可之114年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IAS21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日

1. IAS 21之修正「缺乏可兌換性」

此修正定義可兌換性，並提供當某一貨幣缺乏可兌換性時，企業如何決定衡量日之即期匯率之相關應用指引。另此修正要求企業於某一貨幣不可兌換為另一貨幣時，於其財務報表中提供更有用之資訊。

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及影響：

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「金融工具之分類與衡量之修正」	2026 年 1 月 1 日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「涉及自然電力的合約」	2026 年 1 月 1 日
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 17「保險合約」	2023年1月1日
IFRS 17「保險合約」之修正	2023年1月1日
IFRS 17之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023年1月1日
IFRS 18「財務報表之表達與揭露」	2027年1月1日
IFRS 19「不具公共課責性之子公司：揭露」	2027年1月1日
IFRS 之年度改善-第11冊	2026年1月1日

1. IFRS 9及 IFRS 7之修正「金融工具之分類與衡量之修正」此修正分別說明如下：

- (1) 釐清某些金融資產和負債的認列和除列之日期，新增在使用電子支付系統以現金交割金融負債(或部分金融負債)時，當且僅當企業發起支付指令並導致以下情況時，允許企業在交割日前視為將金融負債解除：
 - A. 企業不具有撤銷、停止或取消支付指定之能力；
 - B. 企業因該支付指令而不具有取用將用於交割之現金之實際能力；
 - C. 與該電子支付系統相關之交割風險並不重大。
- (2) 釐清並增加評估金融資產是否符合僅支付本金和利息(SPPI)標準的進一步指引，範圍包括根據或有事件改變現金流量的合約條款(例如，與ESG目標連結的利率)、無追索權特性之工具，及合約連結工具。
- (3) 新增為某些具有可改變現金流量的合約條款的工具(例如某些具有與實現環境、社會和治理(ESG)目標相關的特徵的工具)，應揭露或有事項性質之質性描述；有關可能來自該等合約條款之合約現金流量變動範圍之量化資訊；及於該等合約條款下金融資產之總帳面金額及金融負債之攤銷後成本。
- (4) 更新透過不可撤銷之選擇指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(FVTOCI)應按每一種類揭露其公允價值，無須再按每一標的揭露其公允價值資訊。另應揭露於報導期間認列於其他綜合損益之公允價值損益金額，分別列示於報導期間內除列之投資有關之公允價值損益金額，及於報導期間結束日仍持有之投資有關之公允價值損益金額；以及於報導期間除列投資而於報導期間移轉至權益之累積損益。

2. IFRS 9及 IFRS 7之修正「涉及自然電力的合約」

此修正就企業涉及因發電來源取決於不可控的自然條件(如天氣)的基礎，產生電量變化的合約，分別說明如下：

- (1) 釐清企業購買或銷售自然電力的合約對於「自用」要求的應用：

當合約規定企業有義務在發電時購買並接收電力，且合約電力交易市場的設計和營運要求企業在規定時間內出售任何數量的未使用電力，則企業須考量有關其在不超過12個月合理時間內對於過去、當前和預期未來電力交易的合理且有支持的資訊，當其購買足夠的電力來抵消在其售電的同一市場中銷售的任何未使用的電力，則該企業是電力的淨購買者。新增應用修正案為自用之涉及自然電力的合約，須揭露：

- A. 企業面臨基礎電量的變化以及企業可能被要求在無法使用電力的交付間隔期間購買電力的風險；
- B. 未確認的合約承諾，包括根據這些合約購電預計的未來現金流量；

C. 合約於報告期間內對企業財務績效的影響。

(2) 釐清指定涉及自然電力的合約為避險工具如何得以適用避險會計：

得將被避險項目指定為預測電力交易的可變名義金額，該金額與預期由避險工具中提及的發電設施交付的自然電力的可變金額一致。另當避險工具的現金流量企業在現金流量避險關係中，當指定涉及自然電力的合約作為避險工具，是以指定的預期交易的發生為條件，則該預期交易被推定為極有可能發生。

對於將涉及自然電力的合約指定為避險工具之企業，應按IFRS 7 依風險類別進行分類之避險工具揭露其條款及條件。

3. IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

此修正解決了現行IFRS 10及IAS 28的不一致。投資者出售(投入)資產與其關聯企業或合資之交易，視出售(投入)資產之性質決定認列全部或部份處分損益：

(1) 當出售(投入)之資產符合「業務」時，認列全部處分損益；

(2) 當出售(投入)之資產不符合「業務」時，僅能認列與非關係投資者對關聯企業或合資之權益範圍內之部分處分損益。

4. IFRS 18 「財務報表之表達與揭露」

IFRS 18將取代IAS 1並更新綜合損益表之架構，及新增管理績效衡量之揭露，並強化運用於主要財務報表及附註之彙總及細分原則。

5. IFRS 19 「不具公共課責性之子公司：揭露」

此準則允許合格子公司適用減少揭露要求之 IFRS 會計準則。

除上述影響外，截至本個體財務報告發布日止，本公司仍持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本個體財務報告所採用之主要會計政策說明如下，除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

1. 除下列重要項目外，本個體財務報告係按歷史成本編製：

(1) 按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(2) 按退休基金資產與確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

2. 編製符合金管會認可之IFRSs之個體財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

3. 本公司於編製個體財務報告時，對投資子公司、關聯企業或合資係採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同，個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之

子公司、關聯企業及合資損益份額」、「採用權益法之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三)外幣換算

1. 外幣交易及餘額

- (1) 外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣。
- (2) 外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
- (3) 外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益；屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目；屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。

2. 國外營運機構之換算

- (1) 功能性貨幣與表達貨幣不同之所有子公司、關聯企業及聯合控制個體，其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣：
 - A. 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率換算。
 - B. 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算。
 - C. 所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。
- (2) 當部分處分或出售之國外營運機構為關聯企業或聯合控制個體時，將於其他綜合損益項下之兌換差額按比例重分類於當期損益作為出售利益或損失之一部分。惟當本公司即使仍保留對前關聯企業或聯合控制個體之部分權益，但已喪失對國外營運機構屬關聯企業之重大影響或已喪失對國外營運機構屬聯合控制個體之聯合控制，則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。
- (3) 當部分處分或出售之國外營運機構為子公司時，係按比例將認列為其他綜合損益之累計兌換差額重新歸屬予該國外營運機構之非控制權益。惟當本公司即使仍保留對前子公司之部分權益，但已喪失對國外營運機構屬子公司之控制，則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

1. 資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

- (1) 預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
- (2) 主要為交易目的而持有者。
- (3) 預期於報導期間結束日後十二個月內將實現者。
- (4) 現金及約當現金，但於報導期間結束日後逾十二個月用以交換、清償負債或受到其他限制者除外。

本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2. 負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

- (1) 預期將於正常營業週期中清償者。
- (2) 主要為交易目的而持有者。

- (3) 須於資產負債表日後十二個月內清償者。(即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債)
- (4) 於資產負債表日不具有實質權利可將清償期限至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(五)現金及約當現金

現金及約當現金包括庫存現金、銀行存款及隨時可轉換成定額現金且價值風險變動甚小之短期並具高度流動性之投資(包括原始到期日在三個月內之定期存款)。

(六)金融工具

金融資產與金融負債應於本公司成為該金融工具合約條款之一方時認列。

金融資產與金融負債原始認列時，係按公允價值衡量。原始認列時，直接可歸屬於金融資產與金融負債(除分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債外)取得或發行之交易成本，應從該金融資產或金融負債之公允價值加計或減除。直接可歸屬於透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融工具投資。

A. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括本公司未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，及不符合分類為按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，所產生之股利、利息係認列為其他收入，再衡量產生之利益或損失則係認列於其他利益及損失。公允價值之決定方式請參閱附註十二。

B. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- (a) 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- (b) 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- (a) 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- (b) 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，利息收入係以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。

(2) 金融資產減損

- A. 本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產(含應收帳款)、透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資、應收租賃款及合約資產之減損損失。
- B. 應收帳款、合約資產及應收租賃款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他債務工具投資係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按12個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。
- C. 預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後12個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。
- D. 所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司於符合下列情況之一時，將除列金融資產：

- A. 來自金融資產現金流量之合約之權利失效。
- B. 移轉收取金融資產現金流量之合約權利，且業已移轉金融資產所有權之幾乎所有風險及報酬。
- C. 既未移轉亦未保留金融資產所有權之幾乎所有風險及報酬，惟未保留對金融資產之控制。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資整體除列時，其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

權益工具係指表彰某一企業於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

本公司僅於義務解除、取消或失效時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）之差額認列為損益。

4. 金融工具之修改

當金融工具之合約現金流量發生重新協商或修改時，若未導致應除列該金融工具，則本公司以修改後之合約現金流量按原始有效利率折現重新計算金融資產之總帳面金額或金融負債之攤銷後成本，並將修改利益或損失認列於損益；所發生之成本或費用則作為修改後金融工具帳面金額之調整，並於修改後剩餘期間攤銷。若該重新協商或修改導致應除列該金融工具時，則依除列規定處理。

(七) 存 貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者為衡量基礎，採永續盤存制，成本依加權平均法決定。製成品及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用（按正常產能分攤），惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入估計之成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(八) 採用權益法之投資/子公司及關聯企業

1. 子公司指受本公司控制之個體（包括結構型個體），當本公司暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本公司即控制該個體。
2. 本公司與子公司間交易所產生之未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本公司採用之政策一致。
3. 本公司對子公司取得後之損益份額認列為當期損益，對其取得後之其他綜合損益份額則認列為其他綜合損益。如本公司對子公司所認列之損失份額等於或超過在該子公司之權益時，本公司繼續按持股比例認列損失。
4. 依「證券發行人財務報告編製準則」規定，個體財務報告當期損益及其他綜合損益應與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，個體財務報告業主權益應與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

(九) 不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。建造中之不動產、廠房及設備於達預期使用狀態前，測試該等資產能否正

常運作時所生產之樣品係以成本與淨變現價值孰低衡量，其銷售價款及成本係認列於損益。

2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本公司，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。
3. 土地不提列折舊。其他不動產、廠房及設備採成本模式，按估計耐用年限以直線法計提折舊。本公司於每一財務年度結束日對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

建築物

廠房主建物	50年
其他	5年
機器設備	2至5年
運輸設備	5年
辦公設備	3至5年
其他設備	2至15年

4. 於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備除列。除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間差額，並且認列於當期損益。

(十)租賃

本公司係於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。對於合約包含一項租賃組成部分以及一項或多項之額外租賃或非租賃組成部分者，本公司以每一租賃組成部分之相對單獨價格及非租賃組成部分之彙總單獨價格為基礎，將合約中之對價分攤至該租賃組成部分。

1. 本公司為承租人

除低價值標的資產之租賃及短期租賃按直線基礎認列費用外，本公司對其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊，惟若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付等）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、標的資產購買選擇權之評估、殘值保證下預期支付之金額或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係以單行項目列報於個體資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租賃給付係於發生當期認列為費用。

2. 本公司為出租人

租賃如移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬，則分類為融資租賃；反之，則分類為營業租賃。

融資租賃下，租賃給付包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付等。租賃投資淨額係按應收租賃給付及未保證殘值兩者之現值總和，並表達為應收融資租賃款。本公司採有系統且合理之基礎將融資收益分攤於租賃期間，以反映本公司未到期之租賃投資淨額於各期間可獲得之固定報酬率。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎認列租賃收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本係加計至標的資產之帳面金額，按直線基礎於租賃期間認列為費用。

(十一) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產係以成本減除累計攤銷及累計減損列示。電腦軟體設計費之攤銷金額係依直線法按1-5年分攤。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時除列無形資產。除列無形資產所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當期損益。

(十二) 非金融資產減損

本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減出售成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度認列資產減損之情況不存在時，則在以前年度提列損失金額之範圍內予以迴轉。

(十三) 負債準備

負債準備係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映

目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(十四) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列費用。

2. 退休金

(1) 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2) 確定福利計畫

A. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值列示。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

B. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

3. 員工及董監事酬勞

員工及董監事酬勞係於具法定或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

4. 離職福利

離職福利係於正常退休日前終止對員工之聘僱或當員工決定接受公司之福利要約以換取聘僱之終止而提供之福利。本公司係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早時認列費用。不預期在資產負債表日後12個月全部清償之福利應予以折現。

(十五) 股本

普通股分類為權益。特別股之分類係對合約協議之實質及金融負債與權益工具之定義，就附於特別股之特定權利予以評估，當展現金融負債之基本特性則分類為負債，否則分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本於權益中列為價款減項。

(十六) 股份基礎給付

1. 以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務，於既得期間認列為酬勞成本，並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整，直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。

2. 以現金交割之股份基礎給付協議，係以所承擔負債之公允價值，於既得期間內認列為酬勞成本及負債，並於各個資產負債表日及交割日按所給與權益商品之公允價值衡量，任何變動認列為當期損益。

(十七)所得稅

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。
2. 當期所得稅根據本公司營運產生之應課稅所得，採用在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。依我國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形認列所得稅費用。
3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易(不包括企業合併)中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公司產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時間點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率(及稅法)為準。
4. 遞延所得稅資產於暫時性差異、未使用之課稅損失及未使用所得稅抵減很有可能於未來課稅所得可供使用之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
5. 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；當有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，且遞延所得稅資產及負債由同一稅捐機關課徵所得稅之同一納稅主體、或不同納稅主體產生但各主體意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將遞延所得稅資產及負債互抵。
6. 因購置設備或技術、研究發展支出、人才培訓支出及股權投資等所產生之租稅優惠採用所得稅抵減會計。

(十八)收入認列

本公司來自客戶合約之收入認列原則，係以下列步驟認列收入：

- (1) 辨認客戶合約；
- (2) 辨認合約中之履約義務；
- (3) 決定交易價格；
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務；及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

移轉商品或勞務與收取對價之時間間隔在1年以內之合約，其重大財務組成部分不予調整交易價格。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自機台設備等產品之銷售。銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，因客戶對商品已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風險，本公司係於該時點認列收入及應收帳款；並以扣除銷貨退回、數量折扣及折讓之淨額表達。

去料加工時，加工產品所有權之控制並未移轉，是以去料時不認列收入。

2. 維修收入

維修收入係依相關協議內容於勞務提供時認列。

(十九) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(二十) 政府補助

政府補助於可合理確信本公司將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，始按公允價值予以認列。

政府補助係於其意圖補償之相關成本於本公司認列為費用之期間內，按有系統之基礎認列於損益。若政府補助係用於補償已發生之費用或損失，或係以給與本公司立即財務支援為目的且無未來相關成本，則於其可收取之期間認列於損益。與不動產、廠房及設備有關之政府補助，認列為非流動負債，並按相關資產之估計耐用年限以直線法認列為當期損益。

本公司所取得低於市場利率之政府貸款，所收取之貸款金額與依當時市場利率計算之貸款公允價值兩者間之差額係認列為政府補助。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司將氣候變遷及相關政府政策及法規所造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，並將持續檢視基本假設及估計。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

本公司編製個體財報告時，所作會計政策採用之重要判斷、重要會計估計及假設如下：

(一) 會計政策採用之重要判斷

1. 收入認列

本公司依IFRS 15判斷於移轉特定商品或勞務予客戶前是否已取得或未取得該等商品或勞務之控制，而將為該交易中之主理人或代理人，若判斷為交易之代理人時，則認列交易淨額為收入。

若有下列情況之一，本公司為主理人：

- (1) 商品或其他資產移轉予客戶前，本公司先自另一方取得該商品或資產之控制；或

- (2) 本公司控制由另一方提供勞務之權利，以具有主導該方代本公司提供勞務予客戶之能力；或
- (3) 本公司向另一方取得商品或勞務之控制，用以與其他商品或勞務結合，以提供特定之商品或勞務予客戶。

用以協助判斷本公司於移轉特定商品或勞務予客戶前是否控制該商品或勞務之指標包含（但不限於）：

- (1) 本公司對完成提供特定商品或勞務之承諾負有主要責任。
- (2) 本公司於特定商品或勞務移轉予客戶之前後承擔存貨風險，或於控制移轉予客戶後承擔存貨風險（例如，若客戶具有退貨權）。
- (3) 本公司具有訂定價格之裁量權。

2. 金融資產分類之經營模式判斷

本公司依據反映金融資產群組為達成特定經營目的而共同管理之層級，評估金融資產所屬經營模式。此評估需考量所有攸關證據，包括資產績效衡量方式、影響績效之風險及相關經理人之薪酬決定方式，且需運用判斷。本公司持續評估其經營模式判斷是否適當，並為此監控於到期日前除列之按攤銷後成本衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資，瞭解其處分原因以評估該處分是否經營模式之目標一致。若發現經營模式已有變更，本公司依IFRS 9之規定重分類金融資產，並自重分類日起推延適用。

(二) 重要會計估計及假設

1. 收入認列

銷貨收入係於移轉商品或勞務之控制予客戶而滿足履約義務時認列，並扣除估計之相關銷貨退回、折扣及其他類似之折讓。該等銷貨退回及折讓係依歷史經驗及其他已知原因估計，且本公司定期檢視估計之合理性。

2. 金融資產之估計減損

應收帳款之估計減損係基於本公司對於違約率及預期損失率之假設。本公司考量歷史經驗、現時市場情況及前瞻性資訊，以作成假設並選擇減損評估之輸入值。所採用重要假設及輸入值請參閱附註六(四)，若未來實際現金流量少於預期，可能會產生重大減損損失。

3. 公允價值衡量及評價流程

當採公允價值衡量之資產及負債於活絡市場無市場報價時，本公司依相關法令或依判斷決定是否委外估價並決定適當之公允價值評價技術。

若估計公允價值時無法取得第一等級輸入值，本公司係參考對被投資者財務狀況與營運結果之分析、最近交易價格、相同權益工具於非活絡市場之報價、類似工具於活絡市場之報價及可比公司評價乘數等資訊；對衍生工具則係參考市場價格或利率及衍生工具特性等資訊決定輸入值，若未來輸入值實際之變動與預期不同，可能會產生公允價值變動，本公司定期依市場情況更新各項輸入值，以監控公允價值衡量是否適當。

公允價值評價技術及輸入值之說明，請參閱附註十二(三)。

4. 有形資產及無形資產減損評估

資產減損評估過程中，本公司需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及產業特性，決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損，任何由於經濟狀況之變遷或公司策略所帶來的估計改變均可能在未來造成重大減損。

5. 採用權益法之投資減損評估

當有減損跡象顯示某項採權益法之投資可能已經減損致帳面金額無法被回收，本公司隨即評估該項投資之減損。本公司係依據享有被投資公司預期未來現金流量之折現值或預期可收到現金股利及處分投資所產生未來現金流量之折現值，評估可回收金額，並分析其相關假設之合理性。

6. 遞延所得稅資產之可實現性

遞延所得稅資產係於未來很有可能具有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、免稅期間、可使用之所得稅抵減、稅務規劃等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

7. 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者評價，故本公司必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。本公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。

六、重要會計項目之說明

(一) 現金及約當現金

項 目	113年12月31日	112年12月31日
庫 存 現 金	\$ 124	\$ 478
活 期 存 款	343,634	287,026
外 幣 存 款	115,100	96,049
合 計	<u>\$ 458,858</u>	<u>\$ 383,553</u>

1. 本公司往來之金融機構信用品質良好，且本公司與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。
2. 本公司之現金及約當現金未有提供質押之情形。

(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動

項 目	113年12月31日	112年12月31日
非衍生金融資產		
基金受益憑證	<u>\$ 5,445</u>	<u>\$ 5,026</u>

1. 本公司於113及112年度認列之淨(損)益分別為419仟元及236仟元。
2. 本公司未有將透過損益按公允價值衡量之金融資產提供質押之情形。
3. 相關信用風險管理及評估方式請詳附註十二(二)之說明。

(三) 應收票據淨額

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
按攤銷後成本衡量		
應收票據	\$ 195	\$ 47
減：備抵損失	-	-
應收票據淨額	<u>\$ 195</u>	<u>\$ 47</u>

1. 本公司未有將應收票據提供質押之情形。
2. 有關應收票據備抵損失之相關揭露，詳附註六(四)之說明。

(四) 應收帳款淨額

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款	\$ 236,587	\$ 274,833
減：備抵損失	(4,117)	(6,281)
應收帳款淨額	<u>\$ 232,470</u>	<u>\$ 268,552</u>

1. 本公司未逾期且未減損之應收帳款均符合依據交易對手之產業特性、營業規模及獲利情況所訂定之授信標準，平均授信期間為3至6個月(保固款除外，保固款一般約10%~20%，收款從其約定，通常為保固期滿後)。
2. 本公司未有將應收帳款提供質押之情形。
3. 其中屬關係人交易者，請參閱附註七(三)之說明。
4. 本公司採用簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收票據及應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務及產經狀況等。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。
5. 本公司依準備矩陣衡量應收票據及應收帳款之備抵損失(含關係人)如下：

113 年 12 月 31 日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%~0.05%	\$ 140,732	\$ -	\$ 140,732
30 天以下	0%~1%	23,532	(230)	23,302
31~90 天	0%~1%	37,142	(362)	36,780
91~180 天	0%~5%	17,910	(407)	17,503
181~365 天	0%~20%	4,240	(573)	3,667
逾期超過一年	0%~50%	13,226	(2,545)	10,681
已有減損跡象	100%	-	-	-
合 計		<u>\$ 236,782</u>	<u>\$ (4,117)</u>	<u>\$ 232,665</u>

112年12月31日	預期信用損失率	總帳面金額	備抵損失(存續期間預期信用損失)	攤銷後成本
未逾期	0%~0.05%	\$ 214,488	\$ (53)	\$ 214,435
30天以下	0%~1%	-	-	-
31~90天	0%~1%	7,556	-	7,556
91~180天	0%~5%	12,981	(608)	12,373
181~365天	0%~20%	7,310	(750)	6,560
逾期超過一年	0%~50%	32,524	(4,849)	27,675
已有減損跡象	100%	21	(21)	-
合計		\$ 274,880	\$ (6,281)	\$ 268,599

6. 應收票據及帳款備抵損失(含關係人)變動表如下:

項 目	113 年 度	112 年 度
期 初 餘 額	\$ 6,281	\$ 9,540
減：減損損失迴轉	(2,141)	(3,259)
減：無法回收而沖銷	(23)	-
期 末 餘 額	\$ 4,117	\$ 6,281

7. 若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，本公司直接沖銷相關應收款項，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。本公司於113及112年度沖銷合約金額之應收款項分別為23仟元及0仟元。

8. 相關信用風險管理及評估方式，請參閱附註十二之說明。

(五)存貨及營業成本

項 目	113年12月31日	112年12月31日
原 料	\$ 23,917	\$ 29,814
在 製 品	33,237	102,458
製 成 品	456	1,981
淨 額	\$ 57,610	\$ 134,253

1. 當期認列為營業成本之存貨相關(損)益如下:

	113 年 度	112 年 度
出售存貨成本	\$ 314,719	\$ 431,422
維修成本	23,813	22,528
存貨盤(盈)虧	27	1,271
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(1,652)	14,639
營業成本合計	\$ 336,907	\$ 469,860

2. 本公司113及112年度列入各類存貨成本減項之備抵跌價及呆滯損失變動如下：

	113 年 度	112 年 度
期 初 餘 額	\$ 16,120	\$ 7,896
加：本期提列(迴轉)	(1,652)	14,639
減：本期沖銷	(3,202)	(6,415)
期 末 餘 額	<u>\$ 11,266</u>	<u>\$ 16,120</u>

3. 截至113年及112年12月31日止，本公司未有將存貨提供質押之情形。

(六)預付款項

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
預付貨款	\$ 3,137	\$ 5,269
預付費用	6,124	2,556
進項稅額	1	2
留抵稅額	1,180	2,379
合 計	<u>\$ 10,442</u>	<u>\$ 10,206</u>

(七)採用權益法之投資

被投資公司	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
採用權益法之投資		
投資子公司		
Stable Promise Group Co., Ltd.	<u>\$ 6,212</u>	<u>\$ -</u>
權益法投資貸餘（列入其他非流動負債）		
投資子公司		
Stable Promise Group Co., Ltd.	<u>\$ -</u>	<u>\$ 653</u>

1. 本公司對子公司投資之權益之性質及範圍列示如下：

被投資公司名稱	主要營業項目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
子公司			
Stable Promise Group Co., Ltd.	一般投資業	100%	100%

本公司採用權益法之投資無公開市場報價，子公司Stable Promise Group Co., Ltd.之註冊地為塞席爾群島。

2. 本公司113年及112年對子公司所享有之損益份額及其他綜合損益份額列示如下：

	Stable Promise Group Co., Ltd.	
	113 年 度	112 年 度
營業收入（成本）	\$ 1,142	\$ (5,316)
本期淨利(損)	\$ 1,142	\$ (5,316)
其他綜合損益	143	(46)
本期綜合損益總額	\$ 1,285	\$ (5,362)
自子公司收取之股利	\$ -	\$ -

3. 子公司財務資訊彙整如下：

	Stable Promise Group Co., Ltd.	
	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
流動資產	\$ 6,212	\$ -
非流動資產	-	-
流動負債	-	-
非流動負債	-	(653)
權 益	\$ 6,212	\$ (653)
占子公司淨資產之份額	\$ 6,212	\$ (653)
權益法長投帳面價值	\$ 6,212	\$ (653)

4. 採用權益法之投資及本公司對其所享有之損益及其他綜合損益份額，係按經會計師查核之財務報表計算。
5. 本公司經投審會核准透過第三地區投資設立 Stable Promise Group Co., Ltd.，再轉投資大陸地區昆山金暉盛電子商貿有限公司。本公司董事會於112年11月8日決議透過子公司Stable Promise Group Co., Ltd. 增資大陸地區孫公司昆山金暉盛電子商貿有限公司USD 180仟元，前述交易已於113年1月匯出增資款項，並於113年3月1日經投審會經授審字第11320568190號函核備。截至113年及112年12月31日止，核准投資金額及實際投資金額分別為USD 500仟元及USD 320仟元，均佔各該公司增資後股本之100%。

(八)不動產、廠房及設備

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
土 地	\$ 117,681	\$ 117,681
房 屋 及 建 築	133,724	134,713
機 器 設 備	45,776	35,617
運 輸 設 備	7,762	5,627
辦 公 設 備	1,120	1,120
其 他 設 備	5,241	4,166
未完工程及待驗設備	669	-
成 本 合 計	\$ 311,973	\$ 298,924
減：累計折舊	(45,275)	(33,853)
淨 額	\$ 266,698	\$ 265,071

成 本						未完工程及	合 計
	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備 (註)	待驗設備		
113.1.1 餘額	\$117,681	\$134,713	\$ 35,617	\$ 10,913	\$ -	\$298,924	
增 添	-	-	-	86	4,214	4,300	
處 分	-	-	(400)	(1,410)	-	(1,810)	
重 分 類	-	(989)	-	4,534	(3,545)	-	
存貨轉入	-	-	10,559	-	-	10,559	
113.12.31 餘額	\$117,681	\$133,724	\$ 45,776	\$ 14,123	\$ 669	\$311,973	
累計折舊							
113.1.1 餘額	\$ -	\$ 11,588	\$ 19,165	\$ 3,100	\$ -	\$ 33,853	
折舊費用	-	6,728	4,838	1,431	-	12,997	
處 分	-	-	(400)	(1,175)	-	(1,575)	
重 分 類	-	(605)	-	605	-	-	
113.12.31 餘額	\$ -	\$ 17,711	\$ 23,603	\$ 3,961	\$ -	\$ 45,275	

成 本						未完工程及	合 計
	土 地	房屋及建築	機器設備	其他設備 (註)	待驗設備		
112.1.1 餘額	\$117,681	\$134,234	\$ 35,617	\$ 7,148	\$ -	\$294,680	
增 添	-	479	-	3,765	-	4,244	
112.12.31 餘額	\$117,681	\$134,713	\$ 35,617	\$ 10,913	\$ -	\$298,924	
累計折舊							
112.1.1 餘額	\$ -	\$ 4,877	\$ 14,055	\$ 2,677	\$ -	\$ 21,609	
折舊費用	-	6,711	5,110	423	-	12,244	
112.12.31 餘額	\$ -	\$ 11,588	\$ 19,165	\$ 3,100	\$ -	\$ 33,853	

註：係包括運輸設備、辦公設備及其他設備。

1. 本期增添與現金流量表取得不動產、廠房及設備調節如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
不動產、廠房及設備增加數	\$ 4,300	\$ 4,244
應付設備款(增)減	604	(604)
購買不動產、廠房及設備支付現金數	\$ 4,904	\$ 3,640

2. 不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：請詳附註六(二十三)之說明。

3. 不動產、廠房及設備減損情形：無。

4. 以不動產、廠房及設備提供質押之情形，請參閱附註八之說明。

(九)無形資產

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
電腦軟體成本	\$ 7,220	\$ 5,998
減：累計攤提	(5,184)	(3,524)
淨 額	\$ 2,036	\$ 2,474

成 本	113 年 度		112 年 度	
期初餘額	\$	5,998	\$	4,944
增 添		1,222		1,458
到期除列		-		(404)
期末餘額	\$	7,220	\$	5,998
累 計 攤 提				
期初餘額	\$	3,524	\$	2,448
攤銷費用		1,660		1,480
到期除列		-		(404)
期末餘額	\$	5,184	\$	3,524

(十)其他應付款

項 目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
薪 獎	\$	24,356	\$	35,206
員 工 酬 勞		9,782		12,606
董 監 酬 勞		1,772		3,486
應付保險費		1,445		1,327
應付勞務費		1,877		1,372
應付設備款		-		604
代 收 款 項		555		964
應 付 其 他		7,602		4,853
合 計	\$	47,389	\$	60,418

(十一)負債準備—流動

項 目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
售後保固準備	\$	3,384	\$	3,324
員 工 福 利		623		1,096
合 計	\$	4,007	\$	4,420

項 目	113 年 度		
	售後保固準備	員 工 福 利	合 計
1 月 1 日 餘 額	\$ 3,324	\$ 1,096	\$ 4,420
當期新增之負債準備	8,631	623	9,254
當期迴轉之負債準備	(8,571)	(1,096)	(9,667)
12 月 31 日 餘 額	\$ 3,384	\$ 623	\$ 4,007

項 目	112 年 度		
	售後保固準備	員 工 福 利	合 計
1 月 1 日 餘 額	\$ 4,095	\$ 1,083	\$ 5,178
當期新增之負債準備	3,494	1,096	4,590
當期迴轉之負債準備	(4,265)	(1,083)	(5,348)
12 月 31 日 餘 額	\$ 3,324	\$ 1,096	\$ 4,420

1. 本公司提供產品保固，依歷史經驗及管理階層之判斷估計，估列可能發生之產品保固負債準備，並於相關產品出售當期認列為費損。
2. 員工福利負債準備係員工既得短期服務休假權利之估列。

(十二) 長期借款及一年或一營業週期內到期長期負債

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
抵 押 借 款	\$ 173,441	\$ 184,890
減：一年內到期	(17,622)	(11,034)
轉列遞延政府補助利益-低利貸款	(11,513)	(12,459)
合 計	\$ 144,306	\$ 161,397
利 率 區 間	0.955%~2.15%	0.83%~2.02%

1. 遞延政府補助利益(列入長期遞延收入)本期變動如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
期 初 餘 額	\$ 12,459	\$ 13,405
本 期 攤 銷(註)	(946)	(946)
期 末 餘 額	\$ 11,513	\$ 12,459

(註)本期攤銷帳列營業外收入及支出—其他收入。

2. 上述長期借款之擔保品，請參閱附註八之說明。
3. 本公司部分長期借款為適用中小企業加速投資行動方案之政府補助低利貸款，依該借款合同規定，本公司於借款期間，自112年度財務報告日起，應維持流動比率不低於150%及負債比率不高於120%之財務承諾，前述之財務比率每年審閱一次，以每年會計師查核簽證之財務報表為計算基準。本公司依113及112年度財務報告計算所約定財務比率均符合標準。

(十三) 退休金

1. 確定提撥計畫

- (1) 本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
- (2) 本公司於113及112年度依照確定提撥計畫中明定比例應提撥之金額已於綜合損益表認列費用總額分別為3,330仟元及2,820仟元。

2. 確定福利計畫

- (1) 本公司所適用我國「勞動基準法」之退休金制度，係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前6個月平

均工資計算。本公司按員工每月薪資總額依法提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該等委員會名義存入臺灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

(2) 本公司因確定福利計畫所產生之義務列入資產負債表之金額如下：

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
確定福利義務現值	\$ 16	\$ -
計畫資產公允價值	-	-
淨確定福利負債（資產）	\$ 16	\$ -

(3) 淨確定福利負債之變動列示如下：

項 目	113 年 度		
	確定福利計畫義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1 月 1 日餘額	\$ 2	\$ -	\$ 2
服務成本			
當期服務成本	4	-	4
認列於損益	\$ 4	\$ -	\$ 4
再衡量數			
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)	\$ -	\$ -	\$ -
精算(利益)損失-經驗調整	10	-	10
認列於其他綜合損益	\$ 10	\$ -	\$ 10
12 月 31 日餘額	\$ 16	\$ -	\$ 16

(4) 本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

A. 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內(外)權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

B. 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

C. 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

(十五) 資本公積

項 目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
普通股股票發行溢價	\$ 55,333	\$ 55,333
已失效認股權	57	57
合 計	\$ 55,390	\$ 55,390

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，得按股東原有股份之比例發給新股或現金。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。因採用權益法之投資所產生之資本公積，不得作為任何用途。

(十六) 股份基礎給付

1. 員工認股權-112年8月發行

本公司於112年8月11日發行酬勞性員工認股選擇權計劃2,620個單位，每單位認股權憑證得認購普通股股數均為1,000股，其認股價格為每股新台幣19元。認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股價格不予調整。發行之認股權憑證之存續期間為112年8月24日至112年10月23日，員工自被授予認股權憑證後即得依員工認股權憑證發行及認股辦法行使認股權利。本公司酬勞性員工認股選擇權112年度認列之酬勞成本為9,354仟元。

(1) 112年度酬勞性員工認股選擇權計劃之認股選擇權數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下：

	112 年 度	
	數量(仟股)	加權平均行使價格
期初流通在外	-	-
本期給與	2,620	19.00
本期行使	(2,604)	19.00
本期註銷	(16)	-
期末流通在外	-	-
期末可行使之認股選擇權	-	-

(2) 本公司給與之股份基礎給付交易使用Black-Scholes選擇權評價模式，估計給與日認股選擇權之公平價值，相關資訊如下：

給與日	112年8月11日
股利率	0%
預期波動率	25.77%
無風險利率	0.96%
預期存續期間	0.08年
每股履約價格	19.00元
認股選擇權每股公平價值	3.57元

(十七)保留盈餘及股利政策

1. 依本公司章程規定，本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積後，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘數再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之。
2. 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。
3. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之。惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部份為限。
4. 本公司於113年6月及112年5月經股東會決議通過之112及111年度盈餘分配案及每股股利如下：

項 目	盈餘分配案		每股股利(元)	
	112 年度	111 年度	112 年度	111 年度
法定公積	\$ 13,326	\$ 10,091		
特別盈餘公積提列	46	80		
普通股現金股利	57,720	26,256	2.00	1.00
合 計	\$ 71,092	\$ 36,427		

5. 本公司於114年3月19日董事會擬議113年度盈餘分配案如下：

項 目	盈餘分配案	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 8,694	
特別盈餘公積提列(轉回)	(126)	
普通股現金股利	28,860	1.00
普通股股票股利	57,720	2.00
合 計	\$ 95,148	

有關113年度之盈餘分派案，尚待114年6月召開之股東常會決議。

6. 有關本公司董事會提議及股東會決議盈餘分派情形，請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(十八)營業收入

項 目	113 年 度	112 年 度
客戶合約之收入		
出售產品收入	\$ 484,069	\$ 704,892
維修收入	62,131	62,119
客戶合約銷貨收入總額	\$ 546,200	\$ 767,011
減：銷貨退回	-	(4,665)
減：銷貨折讓	(45)	(226)
客戶合約營業收入淨額	\$ 546,155	\$ 762,120

1. 客戶合約之說明

係機械產品及其零組件之銷售收入，主要對象為電子業廠商，係以合約約定價格銷售。

2. 客戶合約收入之細分

本公司之收入可細分為下列主要服務線及地理區域：

113年度：

	出售產品收入	維修收入	合 計
<u>主要地區市場</u>			
台 灣	\$ 218,629	\$ 42,961	\$ 261,590
中國大陸	224,184	11,166	235,350
美 國	-	2,176	2,176
奧 地 利	21,541	2,140	23,681
其他國家	19,715	3,643	23,358
合 計	\$ 484,069	\$ 62,086	\$ 546,155
<u>主要服務線</u>			
台 南 廠	\$ 484,069	\$ 62,086	\$ 546,155
<u>收入認列時點</u>			
於某一時點滿足履約義務	\$ 484,069	\$ 62,086	\$ 546,155
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-
合 計	\$ 484,069	\$ 62,086	\$ 546,155

112年度：

	出售產品收入	維修收入	合 計
<u>主要地區市場</u>			
台 灣	\$ 250,485	\$ 43,194	\$ 293,679
中國大陸	296,085	7,799	303,884
美 國	58,465	6,095	64,560
奧 地 利	49,700	451	50,151
其他國家	45,431	4,415	49,846
合 計	\$ 700,166	\$ 61,954	\$ 762,120

主要服務線	出售產品收入	維修收入	合 計
台 南 廠	\$ 700,166	\$ 61,954	\$ 762,120
收入認列時點			
於某一時點滿足履約義務	\$ 700,166	\$ 61,954	\$ 762,120
隨時間逐步滿足履約義務	-	-	-
合 計	\$ 700,166	\$ 61,954	\$ 762,120

3. 合約餘額

本公司認列客戶合約收入相關之應收款項、合約資產及合約負債如下：

項 目	113年12月31日	112年12月31日	112年1月1日
應收款項(註)	\$ 232,665	\$ 268,599	\$ 272,538
合約資產	-	-	-
合 計	\$ 232,665	\$ 268,599	\$ 272,538
合約負債—流動	\$ 28,712	\$ 34,631	\$ 152,749

(註)係包含應收票據及應收帳款。

(1) 合約資產及合約負債的重大變動

合約資產及合約負債之變動主要係來自滿足履約義務之時點與客戶付款時點之差異，並無其他重大變動。

(2) 來自期初合約負債及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

當期認列為收入之金額	113 年 度	112 年 度
來自期初合約負債商品銷貨	\$ 34,631	\$ 147,493
來自前期已滿足之履約義務	\$ -	\$ -

(十九) 員工福利、折舊及攤銷費用

性 質 別	113 年 度		合 計
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	
員工福利			
薪資費用	\$ 29,451	\$ 48,354	\$ 77,805
勞健保費用	2,441	3,263	5,704
退休金費用	1,543	1,791	3,334
董事酬金	-	1,772	1,772
其他員工福利費用	2,282	2,716	4,998
折舊費用	245	12,752	12,997
攤銷費用	527	1,133	1,660
合 計	\$ 36,489	\$ 71,781	\$ 108,270

性質別	112 年 度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
員工福利			
薪資費用	\$ 39,744	\$ 55,206	\$ 94,950
勞健保費用	2,170	3,815	5,985
退休金費用	1,342	1,478	2,820
董事酬金	-	3,186	3,186
其他員工福利費用	2,101	2,867	4,968
折舊費用	196	12,048	12,244
攤銷費用	281	1,199	1,480
合 計	\$ 45,834	\$ 79,799	\$ 125,633

1. 依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥2%至10%為員工酬勞及不得高於6%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。113及112年度估列員工酬勞分別為9,782仟元及12,606仟元，係按前述稅前利益之2%至10%內估列；113及112年度估列董監酬勞分別為1,772仟元及3,486仟元，係按前述稅前利益之不高於6%估列。年度財務報告通過日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理於次一年度調整入帳。
2. 本公司於114年3月19日及113年3月27日董事會決議通過113及112年度員工酬勞及董監酬勞，以及財務報告認列之相關金額如下：

項 目	113 年 度		112 年 度	
	員工酬勞	董事酬勞	員工酬勞	董監酬勞
決議配發金額	\$ 9,782	\$ 1,772	\$ 12,606	\$ 3,486
年度財務報告認列金額	9,782	1,772	12,606	3,486
差異金額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

上列員工酬勞均係以現金形式發放。

3. 本公司董事會通過之員工酬勞及董監酬勞相關資訊，請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(二十)利息收入

項 目	113 年 度	112 年 度
銀行存款利息	\$ 4,106	\$ 2,835

(二十一)其他收入

項 目	113 年 度	112 年 度
補助收入—低利貸款補助	\$ 946	\$ 946
補助收入—其他補助	354	375
售電收入	721	667
其 他	431	389
合 計	\$ 2,452	\$ 2,377

(二十二)其他利益及損失

項 目	113 年 度	112 年 度
淨外幣兌換利益(損失)	\$ 22,011	\$ 3,148
透過損益按公允價值衡量金融資產評價 (損)益	419	236
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	(45)	-
其 他	(37)	-
合 計	\$ 22,348	\$ 3,384

(二十三)財務成本

項 目	113 年 度	112 年 度
銀行借款之利息費用	\$ 3,300	\$ 3,196
減：符合要件之資產資本化金額	-	-
利 息 費 用	\$ 3,300	\$ 3,196

(二十四)所得稅

1. 所得稅費用(利益)

(1) 所得稅費用組成部分：

	113 年 度	112 年 度
<u>當期所得稅</u>		
當期所產生之所得稅	\$ 19,297	\$ 25,943
以前年度所得稅高低估	69	37
未分配盈餘加徵稅額	2,773	2,939
當期所得稅總額	\$ 22,139	\$ 28,919
<u>遞延所得稅</u>		
暫時性差異之原始產生及迴轉	\$ 3,749	\$ 9,683
遞延所得稅總額	3,749	9,683
所得稅費用(利益)	\$ 25,888	\$ 38,602

(2) 與其他綜合損益相關之所得稅費用(利益)：

項 目	113 年 度	112 年 度
確定福利計畫之再衡量數	\$ (2)	\$ -

2. 當年度會計所得與認列於損益之所得稅費用調節如下：

項 目	113 年 度	112 年 度
稅前淨利(損)	\$ 112,838	\$ 171,863
稅前淨利按法定稅率計算之稅額	\$ 22,568	\$ 34,372
調整項目之稅額影響數：		
計算課稅所得時不予計入項目之影響數		
未實現存貨損失(迴轉利益)	(330)	2,928
權益法認列投資損(益)	(228)	1,063
銷貨收入認列時點差異	(451)	(16,226)
未(已)實現兌換損益	(1,818)	4,576
未(已)實現保固準備	12	(154)
其他調整	(456)	(616)
以前年度所得稅高低估	69	37
遞延所得稅淨變動數		
暫時性差異	3,749	9,683
未分配盈餘加徵稅額	2,773	2,939
認列於損益之所得稅費用	\$ 25,888	\$ 38,602

本公司適用所得稅稅率為20%，未分配盈餘所適用之稅率為5%。

我國於108年7月經總統公布修正產業創新條例，新增以107年度起之未分配盈餘再投資於特定資產或技術達一定金額者，該投資金額得列為計算未分配盈餘之減除項目。本公司於計算未分配盈餘稅時，業已減除以未分配盈餘進行再投資之資本支出金額。

3. 因暫時性差異而產生之遞延所得稅資產或負債：

項 目	113 年 度			
	期初餘額	認列於(損)益	認列於其他 綜合(損)益	期末餘額
遞延所得稅資產：				
暫時性差異				
未實現保固準備	\$ 665	\$ 12	\$ -	\$ 677
未實現呆帳損失	705	(357)	-	348
未實現兌換損失	1,114	(1,114)	-	-
未實現不休假獎金	220	(95)	-	125
收入認列時間差異	1,764	(451)	-	1,313
採權益法之國外投 資損失	2,025	(228)	-	1,797
未實現存貨損失	3,224	(971)	-	2,253
其 他	-	158	-	158
淨確定福利負債	-	1	2	3
小 計	\$ 9,717	\$ (3,045)	\$ 2	\$ 6,674

項 目	113 年 度			
	期初餘額	認列於(損)益	認列於其他 綜合(損)益	期末餘額
遞延所得稅負債：				
暫時性差異				
未實現兌換利益	\$ -	\$ (704)	\$ -	\$ (704)
小 計	\$ -	\$ (704)	\$ -	\$ (704)
合 計	\$ 9,717	\$ (3,749)	\$ 2	\$ 5,970

項 目	112 年 度			
	期初餘額	認列於(損)益	認列於其他 綜合(損)益	期末餘額
遞延所得稅資產：				
暫時性差異				
未實現保固準備	\$ 819	\$ (154)	\$ -	\$ 665
未實現呆帳損失	1,295	(590)	-	705
未實現兌換損失	-	1,114	-	1,114
未實現不休假獎金	217	3	-	220
收入認列時間差異	17,990	(16,226)	-	1,764
採權益法之國外 投資損失	962	1,063	-	2,025
未實現存貨損失	1,579	1,645	-	3,224
小 計	\$ 22,862	\$ (13,145)	\$ -	\$ 9,717
遞延所得稅負債：				
暫時性差異				
未實現兌換利益	\$ (3,462)	\$ 3,462	\$ -	\$ -
小 計	\$ (3,462)	\$ 3,462	\$ -	\$ -
合 計	\$ 19,400	\$ (9,683)	\$ -	\$ 9,717

4. 未認列為遞延所得稅資產之項目：無。

5. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至111年度。

(二十五)其他綜合損益

項 目	113 年 度		
	稅前	所得稅(費用)利 益	稅後淨額
不重分類至損益之項目：			
確定福利計畫之再衡量數	\$ (10)	\$ 2	\$ (8)
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	143	-	143
認列於其他綜合損益	\$ 133	\$ 2	\$ 135

項 目	112 年 度		
	稅 前	所得稅(費用)利益	稅後淨額
後續可能重分類至損益之項目：			
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ (46)	\$ -	\$ (46)
認列於其他綜合損益	\$ (46)	\$ -	\$ (46)

(二十六) 普通股每股盈餘

項 目	113 年 度	112 年 度
A. 基本每股盈餘：		
本期淨利(A)	\$ 86,950	\$ 133,261
本期流通在外加權平均股數(仟股)	28,860	26,641
基本每股盈餘(稅後)(A)/(B)(元)	\$ 3.01	\$ 5.00
B. 稀釋每股盈餘：		
本期淨利(C)	\$ 86,950	\$ 133,261
具稀釋作用之潛在普通股之影響	-	-
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ 86,950	\$ 133,261
本期流通在外加權平均股數(仟股)	28,860	26,641
員工酬勞影響數(註)	499	864
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股)(D)	29,359	27,505
稀釋每股盈餘(稅後)(元)(C)/(D)	\$ 2.96	\$ 4.84

(註)若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者：

本公司為本集團之最終控制者。

(二) 關係人名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
Stable Promise Group Co., Ltd.	子 公 司
昆山金暉盛電子商貿有限公司	孫 公 司
欣大宇室內裝修工程行	其他關係人

(三) 與關係人間之重大交易事項

1. 營業收入

帳 列 項 目	關係人類別	113 年 度	112 年 度
維修零件收入	孫 公 司	\$ 8,025	\$ 2,173

本公司對上開公司之銷貨係按一般銷貨條件辦理，收款條件則為3至4個月內收款，與一般客戶無重大差異。

2. 進貨

關係人類別	113 年 度	112 年 度
孫 公 司	\$ 20	\$ -

上開進貨價格與一般客戶相當，付款條件則為3至4個月內付款。

3. 合約資產：無。

4. 合約負債：無。

5. 應收關係人款項（不含對關係人放款及合約資產）：

關係人類別/名稱	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
應收帳款		
孫 公 司	\$ 1,806	\$ 1,068

6. 應付關係人款項（不含向關係人借款）：

關係人類別/名稱	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
其他應付款		
其他關係人	\$ -	\$ 668

7. 預付款項：無。

8. 財產交易

(1) 取得不動產、廠房及設備

113年度：無。

112年度：

關係人類別/名稱	交 易 內 容	交 易 金 額
其他關係人	隔間、水電工程等	\$ 575

上開交易價格係經雙方議價決定，截至112年12月31日止，交易價款尚未付清。

9. 其 他：

(1) 各項費用

關係人類別	113 年 度	112 年 度	交 易 性 質
孫 公 司	\$ 11,495	\$ 12,050	勞務費
其他關係人	126	64	修繕費
合 計	\$ 11,621	\$ 12,114	

(四) 主要管理階層薪酬資訊

關係人類別/名稱	113 年 度	112 年 度
薪資及其他短期員工福利	\$ 14,732	\$ 15,338
退職後福利	108	108
合 計	\$ 14,840	\$ 15,446

八、質押之資產

下列資產已提供為各項履約保證之擔保品：

項 目	113年12月31日	112年12月31日
不動產、廠房及設備	\$ 237,101	\$ 243,266
其他金融資產-流動(註)	16,395	-
其他金融資產-非流動(註)	16,395	15,353
合 計	\$ 269,891	\$ 258,619

(註)係因借款額度而設質之定期存款。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)截至113年及112年12月31日止，本公司因銷售機台保固款而開立之保證票據分別為489仟元及0仟元，帳列存出保證票據及應付保證票據科目。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

(一)資本風險管理

由於本公司須維持足夠資本，以支應擴建及提升廠房及設備所需。因此本公司之資本管理係以確保具有必要之財務資源及營運計畫，以支應未來12個月所需之營運資金、資本支出及債務償還等需求。

(二)金融工具

1. 金融工具之財務風險

財務風險管理政策

本公司日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險（包括匯率風險、利率風險及價格風險）、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司之重要財務活動，係經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計畫執行期間，本公司必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

重大財務風險之性質及程度

(1) 市場風險

A. 匯率風險

(A) 本公司暴露於非以本公司之功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易與國外營運機構淨投資所產生之匯率風險。本公司之功能性貨幣為新台幣。該等交易主要計價之貨幣計有美金、人民幣及日幣，為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，本

公司透過管理未來同幣別之外幣收付款時點或使用外幣借款來減輕匯率風險，惟仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

由於國外營運機構淨投資係為策略性投資，是故本公司並未對其進行避險。

(B) 匯率暴險及敏感度分析

		113年12月31日				
		帳列金額 (新台幣)	敏感度分析			
外幣	匯率		變動幅度	損益影響	權益影響	
(外幣:功能性貨幣)						
金融資產						
貨幣性項目						
美金:新台幣	7,585	32.785	248,685	升值1%	2,487	-
非貨幣性項目						
美金:新台幣	189	32.785	6,212	升值1%	-	62
金融負債						
貨幣性項目						
美金:新台幣	315	32.785	10,335	升值1%	(103)	-

		112年12月31日				
		帳列金額 (新台幣)	敏感度分析			
外幣	匯率		變動幅度	損益影響	權益影響	
(外幣:功能性貨幣)						
金融資產						
貨幣性項目						
美金:新台幣	10,458	30.705	321,939	升值1%	3,219	-
非貨幣性項目						
美金:新台幣	(21)	30.705	(653)	升值1%	-	(7)
金融負債						
貨幣性項目						
美金:新台幣	50	30.705	1,538	升值1%	(15)	-

新台幣之幣值若相對於上述貨幣升值時，若所有其他之變動因子維持不變，於113年及112年12月31日反映於上述貨幣之金額會有相等但相反方向之影響。

(C) 本公司貨幣性項目因匯率波動具重大影響於113及112年度認列之全部兌換(損)益(含已實現及未實現)彙總金額分別為22,011仟元及3,148仟元。

B. 價格風險

由於本公司持有之金融工具投資於資產負債表中係分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產，因此本公司暴露於金融工具之價格風險。

本公司主要投資於國外基金受益憑證，此等金融工具之價格會因該投資標的未來價值之不確定性而受影響。若該等金融工具價格上升1%，

而其他所得因素維持不變之情況下，對113及112年度稅後損益因來自透過損益按公允價值衡量之金融資產之公允價值上升而分別增加54仟元及50仟元。

C. 利率風險

本公司於報導日有關附息金融工具之利率概述如下：

項 目	帳 面 金 額	
	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
具公允價值利率風險：		
金融資產	\$ 32,790	\$ 15,353
金融負債	-	-
淨 額	\$ 32,790	\$ 15,353
具現金流量利率風險：		
金融資產	\$ 458,734	\$ 383,075
金融負債	(161,928)	(172,431)
淨 額	\$ 296,806	\$ 210,644

(A) 具公允價值利率風險之敏感度分析：

本公司未將任何固定利率之金融資產及負債分類為透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，亦未指定衍生工具(利率交換)作為公允價值避險會計模式下之避險工具。因此，報導日利率之變動將不會影響損益及其他綜合淨利。

(B) 具現金流量利率風險之敏感度分析：

本公司之變動利率之金融工具係屬浮動利率之資產(債務)，故市場利率變動將使其有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動。市場利率每變動1%，將使113及112年度淨利分別變動2,968仟元及2,106仟元。

(2) 信用風險

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項，及投資活動產生之銀行存款及其他金融工具。營運相關信用風險與財務信用風險係分別管理。

A. 營運相關信用風險

為維持應收帳款的品質，本公司已建立營運相關信用風險管理之程序。個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。

B. 財務信用風險

銀行存款及其他金融工具之信用風險，係由本公司財務部門衡量並監控。由於本公司之交易對象及履約他方均係信用良好之銀行及具投資等級以上之金融機構、公司組織及政府機關，無重大之履約疑慮，故無

重大之信用風險。另本公司並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

(A) 信用集中風險：

截至113年及112年12月31日止，前十大客戶之應收帳款餘額占本公司應收帳款餘額之百分比分別為76%及73%，有信用集中風險，其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

(B) 預期信用減損損失之衡量

(a) 應收帳款：係採簡化作法，請參閱附註六(四)之說明。

(b) 信用風險是否顯著增加之判斷依據：無(本公司並無分類為按攤銷後成本及分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資)。

(C) 持有擔保品及其他信用增強來規避金融資產之信用風險：

個體資產負債表所認列之金融資產及本公司所持有作為擔保之擔保品、淨額交割總約定及其他信用增強對信用風險最大暴險金額有關之財務影響相關資訊如下表所示：

113年12月31日	帳面金額	信用風險最大暴險減少金額			合計
		擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,445	-	-	-	-
合計	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

112年12月31日	帳面金額	信用風險最大暴險減少金額			合計
		擔保品	淨額交割總約定	其他信用增強	
適用 IFRS 9 減損規定且已信用減損之金融工具	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
不適用 IFRS 9 減損規定之金融工具：					
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,026	-	-	-	-
合計	\$ 5,026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(3) 流動性風險

A. 概述：

本公司管理流動性風險之目標，係為維持營運所需之現金及約當現金及足夠的銀行融資額度等，以確保本公司具有充足的財務彈性。

下表係按到期日及未折現之到期金額彙總列示本公司已約定還款期間之金融負債分析：

113年12月31日							
非衍生金融負債	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 71,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,895	\$ 71,895
其他應付款	47,389	-	-	-	-	47,389	47,389
長期借款(一年內到期)	9,392	8,230	14,138	42,413	99,268	173,441	161,928
合計	\$ 128,676	\$ 8,230	\$ 14,138	\$ 42,413	\$ 99,268	\$ 292,726	\$ 281,212

112年12月31日							
非衍生金融負債	6個月以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年	合約現金流量	帳面金額
應付帳款	\$ 65,024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,024	\$ 65,024
其他應付款	60,418	-	-	-	-	60,418	60,418
長期借款(一年內到期)	5,517	5,517	16,976	42,413	114,467	184,890	172,431
合計	\$ 130,959	\$ 5,517	\$ 16,976	\$ 42,413	\$ 114,467	\$ 310,332	\$ 297,873

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

2. 金融工具之種類

本公司各項金融資產及金融負債之帳面金額如下：

	113年12月31日	112年12月31日
金融資產		
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	\$ 458,858	\$ 383,553
應收票據及帳款(含關係人)	232,665	268,599
其他應收款	267	-
其他金融資產-流動	16,395	-
存出保證金	1,219	1,112
其他金融資產-非流動	16,395	15,353
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	5,445	5,026
金融負債		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
應付帳款	71,895	65,024
其他應付款	47,389	60,418
一年或一營業週期內到期長期借款	17,622	11,034
長期借款	144,306	161,397

(三)公允價值資訊

1. 本公司非以公允價值衡量之金融資產及金融負債之公允價值資訊請詳附註十二(三)3.說明。

2. 公允價值之三等級定義：

第一等級：

該等級之輸入值係指工具於活絡市場中，相同工具之活絡市場公開報價。活絡市場係指符合以下所有條件之市場：在市場交易之商品具同質性；隨時可於市場中尋得具意願之買賣雙方且價格資訊可為大眾取得。

第二等級：

該等級之輸入值除活絡市場公開報價以外之可觀察價格，包括直接（如價格）或間接（如自價格推導而來）自活絡市場取得之可觀察輸入值。

第三等級：

該等級之輸入值係指衡量公允價值之投入參數並非根據市場可取得之可觀察輸入值。

3. 非按公允價值衡量之金融工具：

本公司非以公允價值衡量之金融工具，如現金及約當現金、應收款項、存出保證金、其他金融資產、應付款項、其他應付款及長期借款(含一年內)之帳面金額，係公允價值合理之近似值。

4. 公允價值之等級資訊：

本公司之以公允價值衡量之金融工具係皆以重複性為基礎按公允價值衡量。本公司之公允價值等級資訊如下表所示：

項 目	113年12月31日			
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
資產：				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國外基金受益憑證	\$ 5,445	\$ -	\$ -	\$ 5,445

項 目	112年12月31日			
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
資產：				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值衡量之				
金融資產				
國外基金受益憑證	\$ 5,026	\$ -	\$ -	\$ 5,026

5. 以公允價值衡量之工具的公允價值評價技術：

(1) 本公司採用活絡市場公開報價作為公允價值輸入值者：

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市(櫃)權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

本公司持有之金融工具如屬有活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

A. 開放型基金：淨值。

(2) 除有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。

6. 第一等級與第二等級間之移轉：無。

7. 第三等級之變動明細表：無。

(四) 金融資產之移轉：無。

(五) 金融資產及金融負債之互抵：無。

(六) 為配合113年度財務報表之表達方式，擬將112年度部分會計項目予以重分類，列示如下：

會計項目	重分類前	重分類	重分類後
營業成本	\$ 477,835	\$ (7,975)	\$ 469,860
營業費用			
推銷費用	29,533	7,975	37,508

十三、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊：

1. 資金貸與他人者：無。

2. 他人背書保證者：無。

3. 期末持有有價證券情形：附表一。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

9. 從事衍生工具交易：無。

(二) 轉投資事業相關資訊：附表二。

(三) 大陸投資資訊：附表三。

附表一

暉盛科技股份有限公司
 期末持有有價證券情形
 民國 113 年 12 月 31 日

單位：仟股/單位；新台幣仟元

持有之 公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
暉盛科技 (股)公司	基金受益憑證/摩根環球高 收益債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	1	2,847	-	2,847	
	基金受益憑證/安聯收益成 長基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	9	2,598	-	2,598	
		合 計				5,445		5,445

附表二

暉盛科技股份有限公司
轉投資事業相關資訊
民國 113 年 12 月 31 日

單位：仟股；外幣仟元；新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額		
暉盛科技(股)公司	Stable Promise Group Co., Ltd.	塞席爾群島	一般投資業	15,178 (USD 500)	9,598 (USD 320)	500	100%	6,212 (USD 189)	1,142 (USD 36)	1,142 (USD 36)

附表三

暉盛科技股份有限公司
大陸投資資訊
民國 113 年 12 月 31 日

單位：外幣仟元；新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註 1)	本期期初自 台灣匯出累積 投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資公司本期 損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列 投資損益 (註 2)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回台灣之投 資收益
					匯出	收回						
昆山金暉盛 電子商貿有 限公司	電子零組件貿 易與售後服務	15,178 (RMB3,318) (註 4)	(2)	9,598 (USD 320)	5,580 (USD 180)	-	15,178 (USD 500)	1,142 (RMB 256)	100.00%	1,142 (RMB 256) (2).B	6,212 (RMB 1,383)	-
本期期末累計自台灣匯 出赴大陸地區投資金額				經濟部投審會 核准投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額		本期期末已處分(含出售、清算、解散、被 併購、破產等)之大陸子公司自台灣累計投 資金額	截至本期止處分(含出售、清算解散、被併購、 破產等)之大陸子公司已匯回投資收益				
15,178(USD 500)				16,393(USD500)	447,631		-	-				

註1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資。
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸(請參閱附表二)。
- (3) 其他方式。

註2：本期認列投資損益欄中：

- (1) 若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明。
- (2) 投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明。
 - A. 經與中華民國會計師事務所合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
 - B. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。
 - C. 其他。

註3：本表相關數字應以新台幣列示。

註4：本期認列投資損益係依平均匯率1美元=32.120新台幣核算；期末投資帳面價值係依期末匯率1美元=32.785新台幣核算。

註5：本公司113年度與大陸被投資公司之重大交易事項列示如下：

大陸被投資公司名稱	交易類型 進(銷)貨	進、銷貨		交易條件			應收(付)票據、帳款	
		金額	百分比	價格	付款條件	與一般交易之比較	餘額	百分比
昆山金暉盛電子商貿有限公司	維修零件收入	8,025	1.47%	與一般客戶相當	3至4個月	一般銷貨條件	1,806	0.78%
	勞務支出	11,495	3.41%	與一般客戶相當	3至4個月	一般銷貨條件	—	—

十四、部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此不再於個體財務報告中揭露。

附件四

內部控制聲明書

暉盛科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年6月11日

本公司民國 113 年 10 月 1 日至 114 年 3 月 31 日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年3月31日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為申請創新板上市之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國114年6月11日董事會通過，出席董事七人皆同意本聲明書之內容，併此聲明。

暉盛科技股份有限公司

董事長：宋俊毅

總經理：許嘉元



暉盛科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年03月19日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月19日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

暉盛科技股份有限公司



董事長：宋俊毅

總經理：許嘉元



附件五

內部控制制度審查確信報告

暉盛科技股份有限公司
內部控制制度審查會計師合理確信報告

暉盛科技股份有限公司公鑒：

後附暉盛科技股份有限公司民國 114 年 6 月 11 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 114 年 3 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行合理確信審查程序竣事。

確信標的、標的資訊與適用標準

本確信案件之標的及標的資訊係暉盛科技股份有限公司重大營運循環及管理程序之內部控制制度包括「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「印鑑使用之管理」、「取得或處分資產作業」及「財務報表編製流程之管理」於民國 114 年 3 月 31 日之設計及執行情形，及暉盛科技股份有限公司於民國 114 年 6 月 11 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書（以下併稱確信標的）。

用以衡量或評估上開確信標的之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故暉盛科技股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達表示結論。

獨立性及品質管制規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及盡專業上應有之注意、保密及專業態度。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用法令規範相關之政策及程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關確信標的之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之結論提供合理之依據。

確信結論


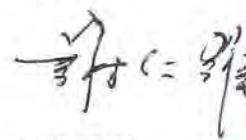
依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目判斷，第二段所述暉盛科技股份有限公司之重大營運循環及管理程序於民國 114 年 3 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；暉盛科技股份有限公司於民國 114 年 6 月 11 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

強調事項

暉盛科技股份有限公司業已依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，針對取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理及對子公司監督與管理訂定相關作業程序。本會計師未因此修正確信結論。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：謝仁耀



會計師：李國銘



中華民國 114 年 6 月 24 日

附件六

證券承銷商評估總結意見

承銷商總結意見

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」或「暉盛公司」)本次為辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股 2,165 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總面額為新台幣 21,650 仟元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地瞭解暉盛公司之營運狀況，與該公司董事、經理人及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，暉盛公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

福邦證券股份有限公司



負責人：黃炳鈞



承銷部門主管：藍順得



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

附件七

律師法律意見書

律師法律意見書

暉盛科技股份有限公司本次為申請股票於創新板上市，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申請股票於創新板上市交易。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」、「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」、「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」、「臺灣證券交易所股份有限公司初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，暉盛科技股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票於創新板上市，並未發現有違反法令致影響股票於創新板上市之情事。

此致

暉盛科技股份有限公司

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：彭義誠



中華民國 114 年 6 月 25 日

律師法律意見書

暉盛科技股份有限公司本次為辦理初次創新板上市前現金增資發行新股，募集與發行普通股 2,165,000 股，每股面額新臺幣 10 元，發行總金額為新臺幣 21,650,000 元整，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，暉盛科技股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

暉盛科技股份有限公司

翰辰法律事務所

彭義誠律師



中華民國 一 一 四 年 九 月 十 日

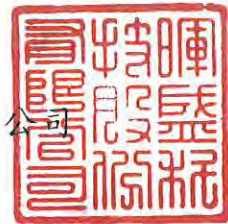
附件八

不得退還或收取承銷相關費用
之聲明書

聲 明 書

本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司辦理初次創新版上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲 明 人：暉盛科技股份有限公司



負 責 人：宋 俊 毅



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任董事長，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：宋俊毅



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本公司擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事：基丞科技股份有限公司



負責人：江少杰



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事代表人(基丞科技股份有限公司法人代表)，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：江少杰



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任董事，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：曾坤燦



中華民國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任董事暨總經理，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事暨總經理：許嘉元



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任獨立董事，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：顏 盟 峯



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任獨立董事，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：何志文



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲明書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之現任獨立董事，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之其他董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：黃蕙玲



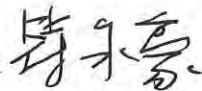
中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之經理人，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人

部經理(生產主管)：符永豪



部經理(業務主管)：邱冠陸



財會經理(會計主管、財務主管)：蔡郁仁



中 華 民 國

114

年

9

月

10

日

聲 明 書

本人擔任暉盛科技股份有限公司(以下簡稱該公司)之受僱人，就該公司辦理初次創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人、該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管，以及與該公司本次現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人



馬燕輝

蔡嘉霖

張憶芸 劉一偉

李日樺

梁國超



高驊厚

薛世坤

許曉雲

鍾秉晃

中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司受暉盛科技股份有限公司（下稱暉盛公司）委託，擔任暉盛公司辦理初次創新版上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、暉盛公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：福邦證券股份有限公司



負責人：黃炳鈞



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司受暉盛科技股份有限公司（下稱暉盛公司）委託，擔任暉盛公司辦理初次創新版上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、暉盛公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

申請人：暉盛科技股份有限公司



負責人：宋俊毅



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任董事長，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董事長：宋俊毅



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司為暉盛科技股份有限公司現任法人董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事：基丞科技股份有限公司



負責人：江少杰



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任法人董事代表人(基丞科技股份有限公司法人代表)，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事代表人：江少杰



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董事：曾坤燦



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任董事暨總經理，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董事暨總經理：許嘉元



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：黃蕙玲



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：何志文



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：顏盟峯



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司現任經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

總經理：許嘉元



部經理(生產主管)：符永豪

符永豪

部經理(業務主管)：邱冠陸



財會經理(會計主管、財務主管)：蔡郁仁



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本人為暉盛科技股份有限公司之受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任：




- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予暉盛公司及其董事、經理人、受僱人或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

受僱人：

  蔡嘉霖  劉一偉

李昭權    呂澤原

  辛世坤

中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷暉盛科技股份有限公司申請有價證券創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

主辦證券承銷商：福邦證券股份有限公司

負責人：黃炳鈞



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷暉盛科技股份有限公司申請有價證券創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券商承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 10 日

聲明書

本律師承辦暉盛科技股份有限公司申請臺灣創新板有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、 絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：彭義誠



中華民國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本律師承辦暉盛科技股份有限公司申請臺灣創新板有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、 絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此 致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：莊植焜律師事務所



律 師：莊植焜律師



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

本會計師承辦暉盛科技股份有限公司申請有價證券創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

會計師事務所：國富浩華聯合會計師事務所

會計師：謝仁耀 會計師



會計師：李國銘 會計師



中華民國 1 1 4 年 9 月 10 日

附件九

不受理特定對象投標聲明書

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理初次創板上市前現金增資發行新股案，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

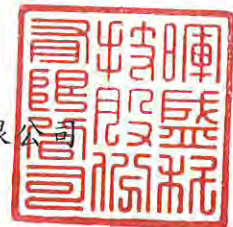
特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：暉盛科技股份有限公司

負責人：宋俊毅



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資發行新股案，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：福邦證券股份有限公司

負責人：黃炳鈞



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

茲聲明本公司元大證券股份有限公司本次辦理暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資發行新股案，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司



聲明人：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

附件十

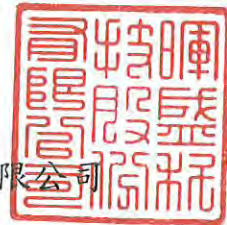
財務業務往來無非常規交易情事之 聲明書

聲 明 書

茲聲明本公司與同屬集團企業之昆山金暉盛電子商貿有限公司有財務、業務往來者，悉遵循常規辦理，無非常規交易之情事。另本公司與同屬集團企業之 Stable Promise Group Co., Ltd. 並無財務、業務往來之情事，若未來有財務業務往來，將依本公司財務業務往來等規範辦理，並承諾將無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明人：暉盛科技股份有限公司



負責人：宋俊毅



中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

茲聲明本公司與暉盛科技股份有限公司並無財務、業務往來之情事，若未來有財務業務往來，將依本公司財務業務往來等規範辦理，並承諾將無非常規交易之情事。

特此聲明

聲明人：Stable Promise Group Co., Ltd.

代表人：宋俊毅

For and on behalf of
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.

宋俊毅

Authorized Signature(s)

中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

聲 明 書

茲聲明本公司與暉盛科技股份有限公司有財務、業務往來者，悉
遵循常規辦理，無非常規交易之情事。

特此聲明



聲明人：昆山金暉盛電子商貿有限公司

代表人：宋俊毅

宋俊毅

中 華 民 國 114 年 9 月 10 日

附件十一

承銷價格計算書

暉盛科技股份有限公司

承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)已發行股數總數

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛或該公司)申請股票於創新板上市時之實收資本額為新台幣 288,597,760 元，每股面額新台幣壹拾元整，已發行股數為 28,859,776 股，另加計該公司盈餘轉增資 5,771,955 股，增資後已發行股數為 34,631,731 股。該公司擬於股票初次申請創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 2,165,000 股，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，預計股票上市掛牌時，已發行股份總數為 36,796,731 股，實收資本額為 367,967,310 元。

(二)承銷股數及來源

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條，本國發行公司初次申請普通股在創新板上市，應先將其上市申請書件所記載之股份總額，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之提撥比率，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法第 71 條第 1 項包銷有價證券規定，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。而依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17-1 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條所規定之「提撥比率」，為不得低於擬上市股份總額百分之五，且不得低於八十萬股，並以募集發行之普通股股票為限。

該公司依上述規定預計辦理現金增資發行新股 2,165,000 股，並依公司法第 267 條之規定，保留發行總股數之 15%，計 324,000 股供員工認購，其餘 1,841,000 股則依證券交易法第 28-1 條規定，經 113 年 6 月 28 日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，全數委託承銷商辦理創新板上市前公開承銷。該公司本次提出公開承銷股數 1,841,000 股已高於擬上市掛牌股份總額 36,796,731 股之 5%，符合前揭規定。

(三)過額配售

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度內，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。該公司於 114 年 6 月 11 日經董事會決議通過與主辦承銷商簽訂「股票創新板初次上市過額配售及股東自願集保協議書」，承諾該公司將協調其股東提供已發行普通

股股票供主辦承銷商做為過額配售之股份來源，以執行穩定價格操作。

(四)股權分散

該公司截至 114 年 8 月 1 日止，記名股東人數共計 377 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數 367 人，且其所持股份總額合計 18,193,979 股，占目前發行股份總額 52.54%，業符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 29 條有關登錄創新板之股權分散標準。

(五)綜上所述，該公司預計辦理現金增資發行新股 2,165,000 股，扣除依公司法規定，該公司本次發行新股預計保留 15%計 324,000 股供員工認購後，餘 1,841,000 股，占擬上市股份總額 36,797 千股之 5%，全數委託承銷商辦理創新板上市前公開承銷。另依主辦承銷商與該公司簽定之過額配售協議，該公司應協調其股東提出對外公開承銷股數百分之十五之額度內，供主辦承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，屆時本證券承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格說明

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用之方法、原則及計算方式

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法 (Price/Earnings ratio, P/E ratio)、股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，透過已公開的資訊，和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法則係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎；另收益法則重視未來公司創造現金流量。茲將本益比法、股價淨值比法、成本法及收益法等計算方式、優缺點列示如下：

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
市場法	本益比法	1. 最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2. 所估算之價值與市場的股價較接近。 3. 較能反映市場研判多空氣氛及投資價值認定。 4. 市場價格資料容易取得。	1. 盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3. 企業盈餘為負或少於1時不適用。 4. 使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來績效	適合評估風險水準、成長率及股利政策穩定的公司。
	股價淨值	依據公司之財務資料，計算每股淨值，並擇取	1. 淨值係長期且穩定之指標。	1. 帳面價值受會計方法之選擇所影響。

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
比法	上市、櫃公司或產業性質相近之同業平均股價淨值比估算股價，最後再進行溢、折價調整，以允當反映受評公司與同業公司間之差異。	2.當盈餘為負時之替代評估法。 3.市場價格資料容易取得。	2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來績效。	幅度較大或盈餘為負數時的公司。
成本法-淨值法	以帳面之歷史成本資料為公司價值之評估基礎，即以資產負債表之帳上資產總額減去負債總額。最後，再考量資產及負債之市場價格進行帳面價值之調整，以允當反映受評公司之價值。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較困難。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。
收益法-現金流量折現法	依據公司預估之未來年度現金流量，並佐以風險等級相稱之折現率，進行折現加總，據以評估受評公司之公司價值。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同的關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。	1.使用程式繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，主要係參考市場法、成本法、收益法及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價方式，以作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，復參酌該公司最近二年度及申請年度之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定本次暫定承銷價格。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司主要從事開發先進電漿技術及研發、生產及銷售各式電漿設備，提供半導體產業、IC載板與印刷電路板產業、平面顯示器與LED等光電產業、非電子業、民生工業及綠能產業等各式製程所需的電漿清潔、蝕刻以及表面改質之解決方案。綜觀目前國內已上市、上櫃公司中，並無完全與該公司所營事業及產品比重相似之公司，經綜合考量營運規模、產品類型及應用領域後，選取較為相似之志聖工業(股)公司(上市股票代號：2467，以下簡稱：志聖)、友威科技(股)公司(上櫃股票代號：3580，以下簡稱：友威科)及鈦昇科技(股)公司(上櫃

股票代號：8027，以下簡稱：鈦昇)為其採樣同業。

志聖主要從事研發及生產紫外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程設備，應用於 PCB 電路板、IC 載板、FPD 面板及半導體高階封裝生產製程；友威科主要從事真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，應用於 IC 載板封裝電漿濺鍍、電漿蝕刻處理及光學 5G 蓋板、載板、汽車、各類銅製程鍍膜；鈦昇主要從事半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與 SMD 包裝材料設計與製造，應用於 IC 製造及封測、LED 封測之雷射加工及電漿清洗、蝕刻處理。

(2)市場法

A.本益比法

由於該公司產品應用領域以半導體相關產業應用最廣，茲就採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月(114 年 7 月至 9 月)之本益比區間列示如下：

單位：倍

期間	採樣同業			上市		上櫃	
	志聖 (2467)	友威科 (3580)	鈦昇 (8027)	半導體 類股	大盤平均	半導體 類股	大盤平均
114 年 7 月	31.32	11.56	—(註 1)	23.06	18.89	28.82	26.00
114 年 8 月	42.75	16.22	—(註 1)	21.33	20.05	35.15	33.95
114 年 9 月	40.23	14.37	—(註 1)	23.68	21.37	38.97	34.65

資料來源：臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理。

註 1：因該公司最近 4 季稅後純益為負數，故不計算本益比。

由上表得知，其採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月本益比區間介於 11.56 倍~42.75 倍之間，若以該公司最近四季(113 年下半年~114 年上半年)經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之稅後淨利 62,704 千元，以擬上市股數 36,797 千股推算後，每股盈餘為 1.70 元，每股參考價格區間約在 19.65 元~72.68 元之間，而本證券承銷商與該公司共同議定之暫訂承銷價格為 72 元，符合前述參考價格區間內，尚屬合理。

B.股價淨值比法

由於該公司產品應用領域以半導體相關產業應用最廣，茲就採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月(114 年 7 月至 9 月)之股價淨值比區間列示如下：

單位：倍

期間	採樣同業			上市		上櫃	
	志聖 (2467)	友威科 (3580)	鈦昇 (8027)	半導體 類股	大盤平均	半導體 類股	大盤平均
114年7月	5.64	2.30	3.06	5.29	2.49	2.78	2.54
114年8月	7.45	2.95	3.75	5.36	2.74	3.12	2.92
114年9月	7.01	2.61	3.66	5.95	2.92	3.46	2.99

資料來源：臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理。

由上表得知，其採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月股價淨值比介於 2.30 倍至 7.45 倍之間。依該公司 114 年第二季經會計師核閱之財務報告中權益總額為 731,857 千元，及擬上市掛牌股數 36,797 千股，計算該公司之每股淨值為 19.89 元，並以前段所述之股價淨值比區間計算該公司之參考價格區間介於 45.75 元~148.18 元之間，惟股價淨值法係以公司淨值為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策，股東權益內容結構等非獲利性因素影響，且並未考量未來成長性，對於成長型公司較不具參考性，故本證券承銷商不擬採用此法作為暫定承銷價格參考之依據。

(3)成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，即以資產負債表上之資產總額減去總負債金額來評定公司之價值，其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價格} = (\text{總資產} - \text{總負債}) / \text{普通股流通在外總數}$$

帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包括債權人、普通股投資人及特別股投資人等，其中股票價值即為對公司之請求權價值，係公司資產總額扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，而公司價值係以創造未來獲利能力之經濟價值評定，以此評價方法將可能低估公司之企業價值，且在評定資產總額及負債總額時，尚需考慮到資產及負債之市價，而取得市價資訊不易，又未考慮資產與負債之市價，忽略市場環境因素，無法表達資產實際經濟價值，因此以成本法評價初次上市(櫃)公司之企業價值者並不多見。

依該公司 114 年第二季經會計師核閱之財務報告之歸屬於母公司業主權益 731,857 千元及依擬上市掛牌股數 36,797 千股計算，每股淨值為 19.89 元，即為依成本法計算之參考價格，與興櫃市場交易價格差異甚大，且此法未考慮公司未來獲利能力及成長性，由此法所計算得出之價格尚需經過調整，故本證券承銷商不擬採用本法為暫定承銷價格之參考依據。

(4)收益法

收益法之方法為現金流量折現法，係依據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考量實質現金及貨幣之時間價值來進

行估算，茲將收益法之基本假設及評估參數分述如下：

A. 模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \left(\sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^t} \right) + \left(\sum_{t=n+1}^m \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{t-n}} \right) + \left(\frac{FCFF_{m+1}}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{m-n} \times (K_3 - g)} \right)$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{Tax Rate}) + \text{Dep}_t - \text{Capital Exp}_t - \Delta NWC_t$$

$$K_i = D / (D+E) \times K_d \times (1 - \text{Tax Rate}) + E / (D+E) \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j (R_m - R_f)$$

P_0 = 每股價值

V = 企業總體價值 = $V_E + V_D$ = 股東權益價值 + 淨負債價值(不含計入營業活動現金流量之負債)

N = 擬上市股數 36,797 千股

$FCFF_t$ = 第 t 期自由現金流量

K_i = 加權平均資金成本， $i = 1, 2, 3$

G = 營業收入淨額成長率

$n = 5$ ，係第一階段之經營年限，例：114~118 年度

$m = 10$ ，係第二階段之經營年限，例：119~123 年度

$EBIT_t$ 第 t 期之息前稅前淨利

Tax Rate_t = 第 t 期之稅率

Dep_t & Amo_t = 第 t 期之折舊與攤銷費用

Capital Exp_t = 第 t 期之資本支出

= 第 t 期之購置不動產、廠房及設備支出

ΔNWC_t = 第 t 期之淨營運資金 - 第 $t-1$ 期之淨營運資金

= (第 t 期之流動資產 - 不付息流動負債) - (第 $t-1$ 期之流動資產 - 不付息流動負債)

$D / (D + E)$ = 付息負債資產比

$E / (D + E)$ = 權益資產比 = $1 - D / (D + E)$

K_d = 負債資金成本率

K_e = 權益資金成本率

R_f = 無風險利率

R_m = 市場平均報酬率

β_j = 系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

B.股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
T	$t \leq n, n=5$	$n+1 \leq t \leq m, m=10$	$t \geq m+1$	依據該公司狀況分為三期間： 期間I：114~118 年度 期間II：119~123 年度 期間III：124年度後(永續經營期)
$D/(D+E)$	17.3337%	16.1669%	15.0000%	由於預期該公司未來將繼續穩定發展，且為維持財務結構，該公司將會由資本市場募集資金，避免提高負債比率，假設期間 I 仍能維持114年6月底之財務結構，而期間 III 進入永續經營期後，假設公司營運穩定良好，隨著營業活動現金流入，營運資金尚為充裕，負債比率得以降低，維持在適當資本結構，假設為15%；期間II則取期間I與期間III之平均值。
$E/(D+E)$	82.6663%	83.8331%	85.0000%	
K_d	1.6034%	1.7922%	1.9810%	配合財務結構之假設，期間I係以該公司114年第二季財務報告之平均借款利率；期間III 係採最近十年本國銀行之借款平均利率算之；期間II之平均借款利率則取期間I與期間III之平均值。
$Tax\ rate$	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以財政部營利事業的所得稅率20%估算。
R_f	1.3710%	1.3710%	1.3710%	採用櫃檯買賣中心114年9月公告發行之10年期中央政府央債甲3(A14103)之加權平均殖利率。
R_m	9.4856%	9.4856%	9.4856%	採用104~113年度(最近十年)台灣集中市場加權股價指數各年度投資報酬率之幾何平均數。
B_j	1.3288	1.1644	1.0000	期間I之系統風險係以上市半導體最近5年度對大盤之平均風險係數之平均數，估計該公司之系統風險；而期間III預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為1；期間II之Beta值則取期間I與期間III之平均值。
K_e	12.1536%	10.8196%	9.4856%	$=R_f+B_j*(R_m-R_f)$ 。其中 R_f ：無風險報酬率； B_j ：類股與大盤走勢之相關係數； R_m ：市場風險報酬率
K_i	10.2693%	9.3022%	8.3004%	加權平均資金成本。 $K_i=E/(D+E)*K_e+D/(D+E)*K_d(1-稅率)$

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
G (樂觀)	18.65%	10.50%	2.36%	期間I：係以該公司111~114年(114年為預估值)之平均營業收入成長率估計。 期間II：假設營收成長率介於期間I及期間III之間。 期間III：考量永續經營及產品行銷全球，目前尚無法合理預估成長率，故係以世界銀行全球經濟展望報告過去五年度全球平均GDP成長率估計。
G (保守)	2.36%	2.36%	2.36%	考量永續經營及產品行銷全球，目前尚無法合理預估成長率，故係以世界銀行全球經濟展望報告過去五年度全球平均GDP成長率估計。
$EBIT_t / Sales_t$	19.7880%	19.7880%	19.7880%	係以該公司111~113年度及114年前二季之平均息前稅前淨利率。
$Dept\& Amot / FA_t$	4.0419%	4.0419%	4.0419%	係以該公司111~113年度及114年前二季之平均折舊費用占折舊資產比率估計。
$Capital Expt / Sales_t$	1.5781%	1.5781%	1.5781%	係以該公司111~113年度及114年前二季之平均資本支出占該公司營業收入比率估計。
$\Delta NWC_t / Sales_t$	9.6616%	4.8308%	0.0000%	期間I：係以該公司111~113年度及114年前二季平均淨增加營運資金占該公司營業收入比率來估計。 期間II：假設淨營運資金變動介於期間I及期間III之間。 期間III：依永續經營之淨營運資金變動趨近於0。

D.每股價值之計算

(A)樂觀情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (3,088,573 - 153,458 \text{ 千元}) / 36,797 \text{ 千股} \\
 &= 79.77 \text{ 元 / 股}
 \end{aligned}$$

(B)保守情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (1,373,879 - 153,458 \text{ 千元}) / 36,797 \text{ 千股} \\
 &= 33.17 \text{ 元 / 股}
 \end{aligned}$$

該公司依據上述假設及公式計算之參考價格區間為33.17元~79.77元，然因收益法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多為預估性質，在永續經營假設下，

產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故在未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握情況下，且相關參數之參考價值相對較為主觀之情形下，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)發行公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1.財務狀況

單位：新台幣千元；%

分析項目		年度	112 年底	113 年底	114 年第二季底
		公司別			
財務結構	負債占資產比率(%)	暉盛	34.85	31.37	32.27
		志聖	57.34	51.26	60.48
		友威科	50.58	35.49	43.45
		鈦昇	43.51	32.65	37.00
	長期資金占固定資產比率(%)	暉盛	335.93	338.37	336.67
		志聖	650.72	719.74	456.57
		友威科	300.66	292.90	242.93
		鈦昇	481.08	294.26	245.11

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經福邦證券計算整理

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底之負債占資產比率分別為 34.85%、31.37%及 32.27%。113 年底較 112 年底下降，主係因陸續償還長期借款，及受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致負債總額較 112 年底減少所致；114 年第二季底較 113 年底上升，主係該公司客戶下單動能逐漸恢復，依訂單交期持續投產使原物料採購增加，致應付款項增加，及分配發放現金股利，使得應付股利增加，故負債總額較 113 年底上升，經評估其變動情形尚屬合理。

與採樣公司相較，該公司及其子公司負債占資產比率 112~113 年底及 114 年第二季底比率均優於採樣同業，該公司及其子公司負債占資產比率尚屬健全，且未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情事，經評估尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占固定資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 335.93%、338.37%及 336.67%。該公司及其子公司之長期資金占不動產、廠房及設備比率各年度變化不大，主係該公司及子公司營運持續穩定獲利以及陸續償還長期借款，使得長期資金僅微幅變動所致，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司相較，該公司及其子公司 112 年底長期資金占不動產、廠房及設備比率優於友威科及同業平均而低於志聖及鈦昇；113 年底及 114 年第二季底僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，且各年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆優於 100%，顯示其長期資金足以支應資本支出及營運所需，長期資金結構尚屬健全，經評估無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底財務結構各項財務指標變化情形尚屬合理，財務結構尚屬健全，經評估尚無重大異常之情事。

2.獲利能力

單位：新台幣千元；%

分析項目		年度				
		公司別	112 年度	113 年度	114 年第二季	
獲利能力	資產報酬率 (%)	暉盛	12.09	8.19	3.04	
		志聖	6.88	8.50	7.28	
		友威科	5.30	11.66	4.85	
		鈦昇	0.92	(1.02)	(8.54)	
	權益報酬率 (%)	暉盛	21.03	11.89	4.10	
		志聖	15.38	17.46	15.57	
		友威科	11.05	20.29	7.51	
		鈦昇	0.95	(2.27)	(13.61)	
	占實收資本比率	營業利益	暉盛	57.73	30.16	21.62
			志聖	25.69	40.57	57.80
			友威科	31.18	24.95	28.94
			鈦昇	1.71	(10.97)	(22.03)
		稅前純益	暉盛	59.58	39.15	11.03
			志聖	37.26	62.49	64.70
			友威科	33.78	33.60	26.58
			鈦昇	3.89	(4.92)	(37.44)
純益率 (%)	暉盛	17.49	15.88	5.93		
	志聖	14.62	15.70	13.46		
	友威科	13.73	30.02	18.64		
	鈦昇	1.52	(3.58)	(26.55)		
每股盈餘(元)	暉盛	5.00	3.01	0.44		
	志聖	3.12	4.80	2.38		
	友威科	2.63	5.08	0.96		
	鈦昇	0.32	(0.51)	(1.71)		

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經福邦證券計算整理

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第二季之資產報酬率分別為 12.09%、8.19%及 3.04%；權益報酬率分別為 21.03%、11.89%及 4.10%；營業利益占實收資本比率分別為 57.73%、30.16%及 21.62%；稅前純益占實收資本額比率分別為 59.58%、39.15%及 11.03%；純益率分別為 17.49%、15.88%及 5.93%，每股盈餘分別為 5.00 元、3.01 元及 0.44 元。該公司及其子公司各項獲利能力呈現下滑趨勢，

主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，使營業收入下滑；114 年前二季隨著產業景氣逐步回溫，營業收入已逐步成長，然因拓展業務支出及研發新型設備致營業費用增加，以及受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使營業利益及稅前純益減少。

與採樣公司相較，資產報酬率及權益報酬率部分，該公司及其子公司 112 年度資產報酬率及權益報酬率均優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年前二季均優於鈦昇而低於志聖及友威科；營業利益及稅前純益占實收資本額比率部分，該公司及其子公司 112 年度營業利益及稅前純益占實收資本額比率均優於採樣同業；113 年度僅低於志聖而優於友威科及鈦昇；114 年前二季優於鈦昇而低於志聖及友威科；純益率部分，該公司及其子公司 112 年度純益率優於採樣同業及同業平均；113 年度僅低於友威科而優於志聖及鈦昇；114 年前二季優於鈦昇而低於志聖及友威科；每股稅後盈餘部分，112 年度每股稅後盈餘優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年前二季均優於鈦昇而低於志聖及友威科。經評估尚無發現有重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季獲利能力各項指標之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

3.本益比

請詳前述「二、(一)、2、(2)、A.本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論。

本次承銷價格議定並無參考專家意見或鑑價機構之鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料。

單位：新台幣元/股

月份	平均股價(元)	成交金額(元)	成交量(股)
114.9.23~114.10.22	129.67	198,925,803	1,534,113

資料來源：財團法人中華民國櫃檯買賣中心。

該公司於 113 年 3 月 18 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(114.9.23~114.10.22)之月平均股價為 129.67 元，總成交量為 1,534,113 股。另最近一個月每日成交均價介於 119.66 元~ 138.93 元，每日最高及最低成交均價差異 16.10%，尚無價格波動過大之情事。經查詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「興櫃一般板公布注意股票資訊」、「興櫃一般板處置股票資訊」及「興櫃交易時間內股價異常波動達暫停交易標準之股票查詢」，該公司非為「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，且無「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫

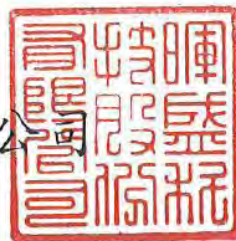
停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，尚無發現有重大異常之情事。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見。

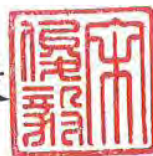
本證券承銷商與該公司議定之暫訂承銷價格，係依一般市場承銷價格訂定方式，參考全體上市(櫃)公司、上市(櫃)半導體類股及採樣同業之本益比及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價、初次上市流動性風險貼水等，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據；再參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況，由本證券承銷商與該公司共同議定之暫訂承銷價格為每股新臺幣 72 元，介於上列參考價格區間，本次公開承銷之價格應尚屬合理。

另該公司預計初次上市前現金增資案之對外募資金額將循競價拍賣之方式承銷，故依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，應以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為最低承銷價格之上限，及同辦法第 16 條規定，承銷價格最高不得超過最低承銷價格之 1.3 倍，故以 114 年 10 月 13 日(不含當日)往前推算興櫃有成交之 30 個營業日(114 年 8 月 27 日至 114 年 10 月 9 日)其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數 124.72 元，七成為 87.30 元，爰議定最低承銷價格(競價拍賣底標)為 67.92 元，承銷價格最高不得超過最低承銷價格之 1.06 倍為 72 元。依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；另依同辦法第 16 條規定，承銷價格以競價拍賣各得標單之價格及其數量加權平均所得價格新臺幣 101.88 元為之，惟該均價高於本證券承銷商與該公司議定最低承銷價格之 1.06 倍，故每股承銷價格以新臺幣 72 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：暉盛科技股份有限公司



負責人：宋 俊 毅



(本用印僅限於暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 1 1 4 年 1 0 月 2 3 日

證券承銷商：福邦證券股份有限公司



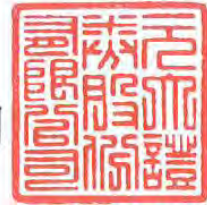
負責人：黃炳鈞



(本用印僅限於暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 1 1 4 年 1 0 月 2 3 日

證券承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳 修 偉



(本用印僅限於暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 1 1 4 年 1 0 月 2 3 日

附件十二

與本次發行有關之決議文

暉盛科技股份有限公司
第八屆第七次董事會議事錄(節錄)



會議時間：中華民國 113 年 03 月 27 日(星期三)上午十時三十分整

會議地點：台南市安南區科技五路 100 號 暉盛科技會議室

出席董事：董事長宋俊毅、法人代表董事江少杰、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯、獨立董事黃蕙玲、獨立董事何志文共七名。

缺席董事：無。

請假董事：無。

列席人員：行銷部經理邱冠陸、財會部經理蔡郁仁、稽核主管曾雅綉、財會副理馬燕惠、福邦證券業務協理謝灼梅、福邦證券業務副理林瑋薇、國富浩華謝仁耀會計師、國富浩華李國銘會計師，共八名。

主席：宋俊毅董事長

記錄：馬燕惠



壹、報告事項：略。

討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第九案：本公司擬申請股票上市(櫃)案，提請 討論。

說 明：

- 1、本公司為長期經營發展、建立公司形象，提高知名度、延攬優秀專業人才，及達到公司永續經營之目的，擬授權董事長於未來擇適當時機向主管機關提出股票上市(櫃)之申請。
- 2、相關上市(櫃)作業及時程事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。
- 3、本案業經113年3月27日審計委員會通過在案。
- 4、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案：本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合股票申請上市(櫃)相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)提出公開承銷之股份來源。

- 2、本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定，保留 10%~15%由本公司員工認購外，其餘 85%~90%擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。若本公司員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 3、本次增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
- 4、本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項)，如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 5、本案業經 113 年 3 月 27 日審計委員會通過在案。
- 6、本案經董事會通過後，提請 113 年股東常會討論。
- 7、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

貳、臨時動議：無

參、散會

暉盛科技股份有限公司
第八屆第十二次董事會議事錄(節錄)



會議時間：中華民國 114 年 03 月 19 日(星期三)下午四時三十分整

會議地點：台南市安南區科技五路 100 號 暉盛科技會議室

出席董事：董事長宋俊毅、法人代表董事江少杰、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯、獨立董事黃蕙玲、獨立董事何志文共七名。

缺席董事：無。

請假董事：無。

列席人員：行銷部經理邱冠陸、財會部經理蔡郁仁、稽核主管曾雅綉、財會部副理馬燕惠、人資部專員張雅雯、福邦證券業務協理謝灼梅、福邦證券業務副理林瑋薇、國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師、國富浩華聯合會計師事務所李國銘會計師，共九名。

主席：宋俊毅董事長



記錄：蔡郁仁



壹、報告事項：

四、其他重要報告事項。

第一案：董事與重要職員責任保險報告案。

說明：本公司依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第十六條規定，已與國泰世紀產物保險股份有限公司投保董事與重要職員責任保險，並於 114 年 2 月 1 日開始生效，請參閱附件三。

貳、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第三案：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

1、本公司 113 年度稅後淨利為新台幣(以下同)86,950,142 元，加計期初未分配盈餘 235,480,711 元、淨確定福利負債追溯適用調整數-2,000 元、精算損益本期變動數-7,928 元、減除依法提撥 10%法定盈餘公積 8,694,021 元及迴轉特別盈餘公積 126,029 元後，本期可供分配盈餘為 313,852,933 元，擬自可供分配盈餘中提撥股東紅利 86,579,326 元，其中 28,859,776 元發放現金股利，餘數 57,719,550 元轉增資以股票股利發放。本次現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發 1 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司其他收入，盈

餘分配表請參閱下表。

- 2、本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長辦理相關調整事宜。
- 3、本案授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 4、本案業經114年3月19日審計委員會通過在案。
- 5、本案經董事會通過後，依法提請114年股東常會報告及承認。
- 6、謹提請 討論。

暉盛科技股份有限公司

113年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	235,480,711
保留盈餘其他調整數	(2,000)
精算損益本期變動數	(7,928)
113年稅後淨利	86,950,142
提列法定公積10%	(8,694,021)
特別盈餘公積轉回	126,029
可供分配盈餘	313,852,933
分配項目：	
分配股東現金股利(每股1.0元)	28,859,776
分配股東股票股利(每股2.0元)	57,719,550
期末未分配盈餘	227,273,607

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說 明：

- 1、配合法令修訂及公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件七。
- 2、本案業經114年3月19日審計委員會通過在案。
- 3、本案經董事會決議後，依法提請114年股東常會討論。
- 4、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：無
肆、散會

暉盛科技股份有限公司
第八屆第十四次董事會議事錄(節錄)



會議時間：中華民國 114 年 06 月 11 日(星期三)上午十一時三十分整

會議地點：台南市安南區科技五路 100 號 暉盛科技會議室

出席董事：董事長宋俊毅、法人代表董事江少杰、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯、獨立董事黃蕙玲、獨立董事何志文共七名。

缺席董事：無。

請假董事：無。

列席人員：行銷部經理邱冠陸、財會部經理蔡郁仁、稽核主管曾雅綉、財會部副理馬燕惠、福邦證券業務協理謝灼梅、福邦證券業務副理林瑋薇、國富浩華聯合會計師事務所李國銘會計師，共七名。

主 席：宋俊毅董事長



記錄：蔡郁仁



壹、報告事項：略。

貳、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司申請股票創新板上市案，提請 討論。

說 明：

- 1、為長期營運發展及吸引專業優秀人才，擬授權董事長於長期考量內外環境，於未來擇適當時機向台灣證券交易所股份有限公司提出股票創新板上市申請。
- 2、有關實際上市相關作業及時程事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。
- 3、本案業經 114 年 6 月 11 日審計委員會通過在案。
- 4、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案：本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合股票上市掛牌後執行價格之穩定措施，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，本公司應於股票創新板初次上市前與主辦承銷商福邦證券股份有限公司簽訂「股票創新板初次上市過額配售及股東自願集保協議書」，以辦理股東自願集保及過額配售

相關事宜，協議書請參閱附件九。

- 2、擬授權董事長協調股東配合辦理自願集保及過額配售相關事宜，如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
- 3、本案業經 114 年 6 月 11 日審計委員會通過在案。
- 4、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案：本公司 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日內部控制制度聲明書討論案，提請 討論。

說 明：

- 1、因應本公司申請股票上市，業已完成 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日之內部控制制度自行評估作業。
- 2、擬依評估結果出具「內部控制制度聲明書」，以表示本公司內部控制制度之設計及執行均屬有效。該聲明書將作為公開說明書之重要內容，並對外揭露，請參閱附件十。
- 3、本公司並委託國富浩華聯合會計師事務所查核內部控制制度，暨出具專案審查報告。
- 4、本案業經 114 年 6 月 11 日審計委員會通過在案。
- 5、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散會

暉盛科技股份有限公司
第八屆第十八次董事會議事錄(節錄)

會議時間：中華民國 114 年 09 月 05 日(星期五)上午十一時整

會議地點：台南市安南區科技五路 100 號 暉盛科技會議室

出席董事：董事長宋俊毅、法人代表董事江少杰(委託出席)、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯、獨立董事黃蕙玲、獨立董事何志文共七名。

缺席董事：無。

請假董事：無。

列席人員：略。

主 席：宋俊毅董事長

記錄：蔡郁仁

壹、報告事項：略。

貳、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

- 1、本公司業於 113 年 06 月 28 日經股東常會決議通過，為配合公司股票初次上市前辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准上市案後，於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，並授權董事會全權處理現金增資相關事宜。
- 2、本公司股票初次上市申請案，業經台灣證券交易所於 114 年 08 月 06 日上市審議委員會及 114 年 08 月 26 日董事會決議通過。
- 3、本公司擬辦理現金增資發行普通股 2,165 仟股，每股面額新台幣 10 元，現金增資發行價格暫定為每股新台幣 85 元，預計募集總金額為新台幣 184,025 仟元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
- 4、本次募集與發行有價證券之資金運用計劃項目及預計可能產生效益，請參閱附件四。
- 5、本次現金增資發行之新股，除依公司法第 267 條規定保留增資發行股數之 15%計 324 仟股由員工認購外，其餘 85%計 1,841 仟股為配合辦理上市需要，原股東全部放棄認購，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第 267 條依照

原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

- 6、本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
- 7、本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。
- 8、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
- 9、本案業經 114 年 9 月 5 日審計委員會通過在案。
- 10、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散會

暉盛科技股份有限公司
一百一十三年股東常會議事錄



時間：中華民國一百一十三年六月二十八日(星期五)上午十時整

地點：台南市安南區台南科技工業區科技五路 100 號(本公司會議室)

出席：出席及代理出席股東所代表之股份計 24,365,669 股，佔本公司已發行股份總數 28,859,776 股之 84.42%，已達法定開會股數。

出席董事：董事長宋俊毅、基丞科技股份有限公司(指派宋俊毅董事長)、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯，共五名。

主席：董事長宋俊毅

紀錄：馬燕惠



- 一、宣佈開會：出席及委託出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：略。
- 四、承認事項：略。
- 五、討論事項：

第三案(董事會提)

案由：本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。

說明：(一) 1、為配合股票申請上市(櫃)相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)提出公開承銷之股份來源。

2、本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定，保留 10%~15%由本公司員工認購外，其餘 85%~90%擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。若本公司員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

3、本次增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

4、本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項)，如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(二)本案經董事會通過後，依法提請股東常會討論。

(三)敬請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 1,089,112 權)共計

24,365,669 權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	24,225,818 權 (954,261 權)	99.42%
反對權數(其中電子投票權數)	134,851 權 (134,851 權)	0.55%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	5,000 權 (0 權)	0.02%

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會(同日上午 10 時 30 分)。


暉盛科技股份有限公司
一百一十四年股東常會議事錄(節錄)

時間：中華民國一百一十四年六月十八日(星期三)上午十時整

地點：台南市安南區科技五路 100 號(本公司會議室)

出席：出席及代理出席股東所代表之股份計 23,412,568 股，佔本公司已發行股份總數 28,859,776 股之 81.12%，已達法定開會股數。

出席董事：董事長宋俊毅、基丞科技股份有限公司(指派宋俊毅董事長)、董事許嘉元、董事曾坤燦、獨立董事顏盟峯，共五名。

列席：國富浩華聯合會計師事務所李國銘會計師

主席：董事長宋俊毅

紀錄：蔡郁仁



一、宣佈開會：出席及委託出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第三案

案由：113 年度現金股利分派情形報告。

說明：1、依本公司章程第 26 條規定辦理，本案業經 114 年 3 月 19 日董事會通過在案，擬配發股東現金股利新台幣 28,859,776 元，請參閱附件三。

2、本次現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發 1 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司其他收入。

3、本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長辦理相關調整事宜。

4、本案經董事會決議通過並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜，敬請鑒察。

股東發言與提問：無。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：1、配合法令修訂及公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件五。

2、本案業經 114 年 3 月 19 日董事會決議通過，依法提請股東常會討論。

3、敬請討論。

股東發言與提問：無。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 1,061,078 權)共計

23,412,568 權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子 投票權數)	23,412,564 權 (1,061,074 權)	99.99%
反對權數(其中電子 投票權數)	1 權 (1 權)	0.00%
無效權數(其中電子 投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其 中電子投票權數)	3 權 (3 權)	0.00%

第二案(董事會提)

案 由：113 年度盈餘分配案。

說 明：1、本公司 113 年度盈餘分派案，依本公司章程擬具盈餘分配表，業經 114 年 3 月 19 日董事會決議通過，請參閱附件三，敬請 承認。

股東發言與提問：無。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 1,061,078 權)共計 23,412,568 權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子 投票權數)	23,412,564 權 (1,061,074 權)	99.99%
反對權數(其中電子 投票權數)	1 權 (1 權)	0.00%
無效權數(其中電子 投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其 中電子投票權數)	3 權 (3 權)	0.00%

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會(同日上午 10 時 27 分)

附件十三

公司章程及新舊條文對照表

暉盛科技股份有限公司章程



第一章 總則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「暉盛科技股份有限公司」。

本公司英文名稱為 Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc.。

第二條 本公司所營事業如下：

01.F119010 電子材料批發業

02.F113010 機械批發業

03.F113020 電器批發業

04.F401010 國際貿易業

05.CA04010 表面處理業

06.CA03010 熱處理業

07.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業

08.F107010 漆料、塗料批發業

09.F113030 精密儀器批發業

10.F113100 污染防治設備批發業

11.F113990 其他機械器具批發業

12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一 本公司轉投資不受公司法第十三條有關轉投資總額不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第三條 本公司設於台南市，必要時，得經董事會決議，於國內外各地設立分公司。

第四條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條 本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中伍佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，得依董事會決議分次發行。

- 第五條之一 本公司發行之員工認股權憑證、庫藏股轉讓予員工、發行新股依法應保留一定比例由員工承購，以及發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。
- 第六條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，再經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 股東名簿記載之變更，依公司法第一六五條規定辦理。
- 第八條 本公司股務之處理，除法令或證券規章另有規定外，悉依主管機關所訂之「公開發行公司股票股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

- 第九條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之，臨時會於必要時，依法召集之。
本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。
- 第十條 股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十一條 股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其它召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
本公司於興櫃及上市(櫃)期間，召開股東會時，應依公司法第一七七條之一規定，將電子方式列為股東表決權行使管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
- 第十四條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並依公司法第一八三條規定辦理。

第十四條之一 非經股東會決議，不得辦理撤銷股票公開發行。

前項於本公司興櫃期間或上市(櫃)期間不得變動之。

第四章 董事及審計委員會

第十五條 本公司設置董事五至九人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，不得為單一性別，任期均為三年，連選均得連任。

前項董事名額中應設置獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名及其他應遵循事項依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成；有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，以審計委員會組織規程另訂之。

第十六條 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十七條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本公司得於董事任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十八條 董事會每季至少召集乙次，董事會之召集依公司法第二〇四條規定辦理。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。董事遇有缺額時，依法補選，但補選就任之董事之任期，以補足原任期限為限。

第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之並為主席，董事長不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第二十條 董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十二條 本公司董事之報酬，授權董事會參酌其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準，議定之，並得給付相當之交通費或其他津貼。

第二十二條之一 本公司董事會得因業務運作之需要，設置各類功能性委員會，其組織規程由董事會依據相關法令訂定之。

第五章 經理人

第二十三條 本公司得設經理人各若干人，其任免及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意為之。

第六章 決算

第二十四條 本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，並依法定程序提出於股東常會請求承認：

- (一)營業報告書
- (二)財務報表
- (三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊。

第二十五條 本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事酬勞與員工酬勞：

- (一)董事酬勞：不高於百分之六；惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。
- (二)員工酬勞：百分之二~十，前述員工酬勞總額中不低於百分之四十五應提撥為分派予基層員工之酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。董事酬勞及員工酬勞分派案應由董事會決議，並提股東會報告。

第一項員工酬勞之發放得由董事會決議得以現金或股票為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第二十六條 本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案。本項盈餘分派以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不

低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

第七章 附則

- 第二十七條 本公司就業務之需要，得為對外保證業務。
- 第二十八條 刪除
- 第二十九條 本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第三十條 刪除
- 第三十一條 本章程訂立於中華民國 91 年 05 月 27 日。
第一次修正於民國 91 年 08 月 10 日。
第二次修正於民國 92 年 01 月 27 日。
第三次修正於民國 95 年 06 月 26 日。
第四次修正於民國 100 年 08 月 01 日。
第五次修正於民國 101 年 06 月 26 日。
第六次修正於民國 101 年 11 月 27 日。
第七次修正於民國 104 年 05 月 25 日。
第八次修正於民國 105 年 06 月 06 日。
第九次修正於民國 106 年 05 月 31 日。
第十次修正於民國 108 年 04 月 22 日。
第十一次修正於民國 112 年 05 月 30 日。
第十二次修正於民國 113 年 06 月 28 日。
第十三次修正於民國 114 年 06 月 18 日。

暉盛科技股份有限公司



董事長：宋 俊 毅



暉盛科技股份有限公司
章程修正條文對照表



條次	修正前條文	修正後條文
第二十二條之一	無。	本公司董事會得因業務運作之需要，設置各類功能性委員會，其組織規程由董事會依據相關法令訂定之。
第二十五條	<p>本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事酬勞與員工酬勞：</p> <p>(一)董事酬勞：不高於百分之六；惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。</p> <p>(二)員工酬勞：百分之二~十。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。董事酬勞及員工酬勞分派案應由董事會決議，並提股東會報告。</p> <p>第一項員工酬勞之發放得由董事會決議得以現金或股票為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事酬勞與員工酬勞：</p> <p>(一)董事酬勞：不高於百分之六；惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。</p> <p>(二)員工酬勞：百分之二~十，<u>前述員工酬勞總額中不低於百分之四十五應提撥為分派予基層員工之酬勞。</u></p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。董事酬勞及員工酬勞分派案應由董事會決議，並提股東會報告。</p> <p>第一項員工酬勞之發放得由董事會決議得以現金或股票為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p>
第三十一條	<p>本章程訂立於中華民國九十一年五月廿七日。</p> <p>第一次修正於民國九十一年八月十日。</p> <p>第二次修正於民國九十二年一月廿七日。</p> <p>第三次修正於民國九十五年六月二十六日。</p> <p>第四次修正於民國一〇〇年八月一日。</p> <p>第五次修正於民國一〇一年六月二十六日。</p> <p>第六次修正於民國一〇一年十一月二十七日。</p> <p>第七次修正於民國一〇四年五月二十五日。</p> <p>第八次修正於民國一〇五年六月六日。</p> <p>第九次修正於民國一〇六年五月三十一日。</p> <p>第十次修正於民國一〇八年四月二十二日。</p> <p>第十一次修正於民國一一二年五月三十日。</p> <p>第十二次修正於民國一一三年六月二十八日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國 91 年 05 月 27 日。</p> <p>第一次修正於民國 91 年 08 月 10 日。</p> <p>第二次修正於民國 92 年 01 月 27 日。</p> <p>第三次修正於民國 95 年 06 月 26 日。</p> <p>第四次修正於民國 100 年 08 月 01 日。</p> <p>第五次修正於民國 101 年 06 月 26 日。</p> <p>第六次修正於民國 101 年 11 月 27 日。</p> <p>第七次修正於民國 104 年 05 月 25 日。</p> <p>第八次修正於民國 105 年 06 月 06 日。</p> <p>第九次修正於民國 106 年 05 月 31 日。</p> <p>第十次修正於民國 108 年 04 月 22 日。</p> <p>第十一次修正於民國 112 年 05 月 30 日。</p> <p>第十二次修正於民國 113 年 06 月 28 日。</p> <p>第十三次修正於民國 114 年 6 月 18 日。</p>

(加蓋公司印章)



附件十四

盈餘分配表



暉盛科技股份有限公司
2024年盈餘分配表

單位：元

項目	金額	
	小計	合計
可供分配盈餘		-
上期末分配盈餘		235,480,711
保留盈餘其他調整數		(2,000)
精算損益本期變動數		(7,928)
本期稅後淨利		86,950,142
法定盈餘公積(提列)		(8,694,021)
特別盈餘公積(提列)轉回		126,029
可供分配盈餘		313,852,933
分配項目：		
股東現金股利(每股1元)	28,859,776	
股東股票股利(每股2元)	57,719,550	
分配數合計		86,579,326
期末未分配盈餘		227,273,607

董事長：



經理人：



主辦會計：



附件十五

其他必要補充說明事項

暉盛科技股份有限公司申請股票上市案其他必要補充說明事項

依據臺灣證券交易所股份有限公司 114 年 9 月 2 日臺證上二字第 1141703553 號，應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

壹、最近二年度與截至最近期業績變化之合理性。

【公司說明】：

一、本公司最近二年度及申請(2025)年度第 1 季損益情形：

單位：新台幣千元

項目	2023 年度		2024 年度		2024 年第 1 季		2025 年第 1 季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	762,039	100.00	547,630	100.00	157,673	100.00	83,131	100.00
營業成本	470,536	61.75	332,690	60.75	97,880	62.08	47,869	57.58
營業毛利	291,503	38.25	214,940	39.25	59,793	37.92	35,262	42.42
營業費用	124,904	16.39	127,901	23.36	46,969	29.79	36,601	44.03
營業利益(損失)	166,599	21.86	87,039	15.89	12,824	8.13	(1,339)	(1.61)
營業外收入及支出	5,344	0.70	25,944	4.74	14,583	9.25	4,982	5.99
稅前淨利	171,943	22.56	112,983	20.63	27,407	17.38	3,643	4.38
所得稅費用	38,682	5.08	26,033	4.75	5,327	3.38	764	0.92
本期淨利	133,261	17.49	86,950	15.88	22,080	14.00	2,879	3.46
每股盈餘(元)	5.00		3.01		0.77		0.10	

資料來源：本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(一) 營業收入

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業收入分別為 762,039 千元、547,630 千元及 83,131 千元，營業收入分別較 2023 年度及 2024 年第 1 季減少 28.14%及 47.28%。本公司專注開發與製造電漿乾式表面處理設備，提供半導體晶圓製造、先進封裝、IC 載板、PCB、再生晶圓及新能源生產等產業製程所需之電漿設備，主要客戶為國內外半導體、IC 載板、PCB 等製造大廠或其供應鏈廠商。本公司 IC 載板廠客戶以生產 ABF 載板居多，2023 年度受消費性電子市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板及印刷電路板業績下滑，尤其 ABF 載板先前因大多集中於 2022~2023 年度擴產，以致 2023 年底起開始出現供過於求使得 IC 載板及印刷電路板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自 2023 年度起出現訂單推遲現象，2024 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因本公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，且 2025 年第 1 季因部分客戶交機檢驗時程延遲，致本公司 2024 年度及 2025 年第 1 季營業收入皆較比較同期減少。

(二) 營業毛利

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業毛利分別為 291,503 千元、214,940 千元及 35,262 千元，營業毛利率分別為 38.25%、39.25%及 42.42%，本公司最近二年度及最近期之營業毛利主係隨著營業收入變動而呈現同向變動之趨勢，2025 年第 1 季雖營業

毛利隨營收減少，惟因 2025 年第 1 季銷售以毛利率較高之機種(如手動式電漿設備及真空電漿清洗機)為主，高毛利產品營收比重提升，使得整體毛利率提升至 42.42%。本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業毛利率均穩定維持在 38%至 42%區間，毛利結構具一定穩定性。

(三) 營業費用及營業利益

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業費用分別為 124,904 千元、127,901 千元及 36,601 千元，2024 年度營業費用較 2023 年度略為增加，主係本公司因積極參展、拍攝形象影片之廣告費及拓展業務支付之佣金費用及勞務費增加所致；2025 年第 1 季則因本公司擲節支出，營業費用較去年同期減少 10,368 千元。

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業利益(損失)分別為 166,599 千元、87,039 千元及(1,339)千元。2024 年度營業利益較 2023 年度大幅減少，主要係受到產業景氣低迷影響，導致全年設備銷售數量較 2023 年度下滑，進而使營業毛利金額減少，且在營業費用較 2023 年度略增下，使得營業利益率降至 15.89%；2025 年第 1 季，相較 2024 年同期營業利益減少 14,163 千元，主係受客戶資本支出仍保守且交機檢驗時程延遲，營業毛利隨營業收入減少，雖營業費用較去年同期減少 10,368 千元，但在營業收入下降幅度較大的情況下，使得營業費用占營收比重反而增加達 44.03%，並產生 1,339 千元之營業損失，營業利益率降為(1.61)%。

(四) 營業外收入及支出

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業外收入(支出)分別為 5,344 千元、25,944 千元及 4,982 千元，本公司營業外收入及支出內容包含其他收入、外幣兌換損益、銀行利息收入及費用等，而主要之波動係受外幣兌換損益影響。本公司外銷占比約五~六成且主要以美元為計價幣別，採購付款幣別主要以新台幣為主，故外幣收入遠大於外幣支出，並以美元資產部位為主，因此新台幣兌美元對本公司獲利衍生出一定程度之波動。2023 年度因美國聯準會採取升息政策趨勢放緩，使美元兌新台幣呈現先升後貶，致 2023 年度產生淨兌換利益 3,170 千元；2024 年度因全球通貨膨脹降溫緩慢，美國聯準會延後降息，美元仍維持強勢，致 2024 年度產生淨兌換利益 22,349 千元；2025 年第 1 季因美國聯準會升息政策，美元持續強勢，致 2025 年第 1 季產生淨兌換利益 4,357 千元。

(五) 稅前淨利及稅後淨利

本公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之稅前淨利分別為 171,943 千元、112,983 千元及 3,643 千元；本期淨利則分別為 133,261 千元、86,950 千元及 2,879 千元，本公司之稅前淨利及本期淨利逐期遞減，主要係因營業收入減少所致。

【承銷商說明】：

該公司主要專注電漿技術之開發，憑藉優越的電漿製程及設備開發能力，專注於發展高效能的工業級表面處理解決方案，並以各式製程間所需之電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質應用為主。

一、產業概況

乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢，除於半導體製程不斷精進與突破之外，在 ESG 潮流趨勢下，乾式電漿蝕刻無污染之優勢，使其在其他新興產業之應用亦越趨廣泛。

(一) 半導體設備

根據國際半導體產業協會(SEMI)公布之全球晶圓廠預測報告指出，2024 年全球半導體製造設備銷售額達 1171 億美元，成長 10.2%(詳見圖 1)，主要是受惠先進製程、成熟製程、先進封裝和高頻寬記憶體(HBM)擴產，以及中國大幅增加投資，2024 年前段半導體設備市場顯著成長，晶圓製程設備銷售額增長 9%，其他前段設備成長 5%。後段設備部分，在人工智慧和 HBM 製造日趨複雜，以及需求不斷增加推升下，2024 年後段設備銷售額強勁成長，封裝設備增長 25%，測試設備增長 20%。從地區來看，中國、韓國和台灣仍是半導體設備支出前三大市場，合計占全球市場達 74%。中國產能積極擴張，加上政府強化晶片國內生產的各式計畫齊發，投資額達 496 億美元，較去年同比增長 35%，韓國的設備支出則因記憶體市場趨於穩定以及高頻寬記憶體需求飆升，小幅成長 3%，相較之下，惟台灣設備銷售額受到新產能需求放緩影響，由 2023 年之 196 億美元下滑 16% 至 2024 年之 166 億美元。

圖 1：全球半導體設備市場

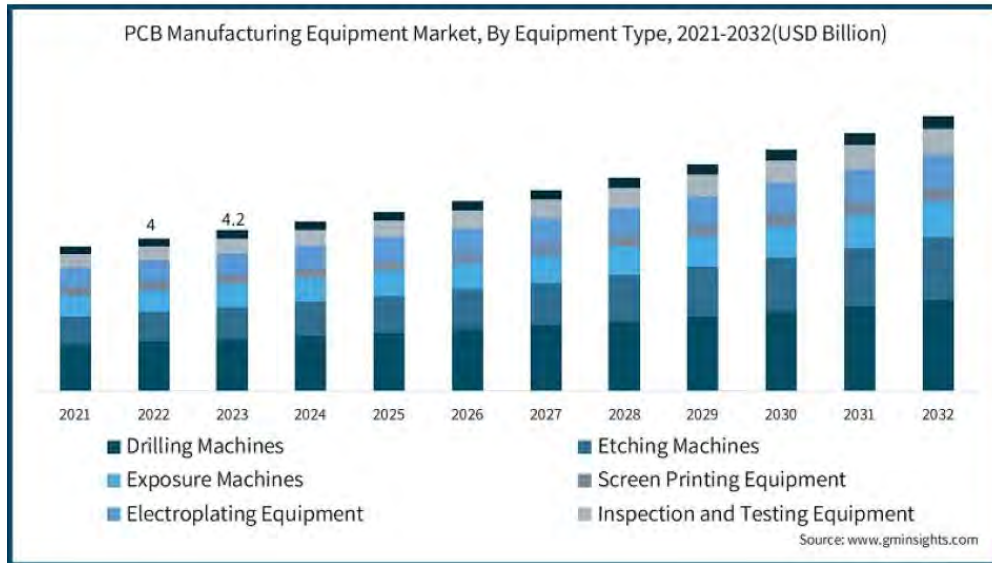


(二) IC 載板及 PCB 設備

隨著電子產品日益輕薄短小與功能複雜化，PCB 產業持續升級轉型，帶動 PCB 設備市場穩定成長。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球 PCB 設備市場規模在 2024 年達 42 億美元，預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算(HPC)、電動車(EV)及先進封裝等新興應用領域。

近年來，PCB 設備以雷射鑽孔機、蝕刻機及 LDI(Laser Direct Imaging)曝光機為代表的高階設備需求快速上升(詳見圖 3)，特別是在 HDI、載板(IC Substrate)、類載板(SLP)等製程中扮演關鍵角色。其中蝕刻機為 PCB 製造過程中關鍵的核心設備之一，無論是傳統多層板製程或先進 IC 載板製程，皆高度依賴濕式與乾式蝕刻設備來精準移除導體層，形成精細電路圖形。隨著線寬微縮與高密度需求提升，蝕刻設備的自動化、均勻性控制與化學品管理能力成為投資重點。蝕刻設備廠商持續投入模組化蝕刻線與智慧製造技術，提升良率與產能效率，未來占比預期仍將維持高位。

圖 3：各類 PCB 製造設備市場規模



資料來源：Global Market Insights，2024 年 11 月

未來，隨著 ABF 載板產能擴張、AI 伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階 PCB 設備的投資比重。

我國 IC 載板產業於 2021~2022 年進行大規模擴產與設備投資，自 2022 年下半年起受到全球通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致 PC、智慧手機等消費性應用需求明顯走弱，呈現供過於求的態勢，導致企業下修資本支出。

根據台灣印刷電路板協會(PCA)統計，我國 2023 年 PCB 設備產值為 560 億元，較 2022 年減少 16.8%。來到 2024 年，隨著 AI 應用之 PCB 製程設備對高層與高密度之需求提升，2024 年台灣 PCB 設備產值規模達 595 億元，有谷底復甦之態，而在高階製程與東南亞新產能陸續量產推動下，2025 年我國 PCB 設備產值預估為新台幣 639 億元。

二、最近二年度與截至最近期業績變化之合理性

(一) 茲將該公司最近二年度及申請(2025)年度第 1 季依產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明如下：

1. 主要產品別營業收入變動表

單位：新台幣千元；%

產品別	2023 年度		2024 年度		2024 年第 1 季		2025 年第 1 季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備收入	700,166	91.88	484,069	88.40	139,135	88.24	65,295	78.55
其他收入	61,873	8.12	63,561	11.60	18,538	11.76	17,836	21.45
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	157,673	100.00	83,131	100.00

資料來源：該公司提供。

2. 主要產品別營業成本變動表

單位：新台幣千元；%

產品別	2023 年度		2024 年度		2024 年第 1 季		2025 年第 1 季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備收入	435,482	92.56	302,439	90.91	89,825	91.77	38,105	79.60
其他收入	35,054	7.44	30,251	9.09	8,055	8.23	9,764	20.40
合計	470,536	100.00	332,690	100.00	97,880	100.00	47,869	100.00

資料來源：該公司提供。

3. 主要產品別營業毛利變動表

單位：新台幣千元；%

產品別	2023 年度		2024 年度		2024 年第 1 季		2025 年第 1 季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備收入	264,684	90.80	181,630	84.50	49,310	82.47	27,190	77.11
其他收入	26,819	9.20	33,310	15.50	10,483	17.53	8,072	22.89
合計	291,503	100.00	214,940	100.00	59,793	100.00	35,262	100.00

資料來源：該公司提供。

4. 主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明

該公司主要係從事各式客製化電漿設備之設計及製造，茲就各主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形分析說明如下：

(1) 電漿設備收入

該公司電漿設備包含電漿去膠渣機、電漿蝕刻機、常壓/真空電漿清洗機、電漿極化機及其他各式電漿相關設備。該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季電漿設備之營業收入金額分別為 700,166 千元、484,069 千元及 65,295 千元，占整體營收比重分別為 91.88%、88.40%及 78.55%。另將該公司 2023~2024 年度及 2025 年度第 1 季電漿設備收入依產業應用別之營業收入金額、比重及變動原因說明如下：

單位：新台幣千元

應用產業	2023 年度		2024 年度		2025 年第 1 季	
	金額	%	金額	%	金額	%
半導體	135,200	19.31	142,641	29.47	14,823	22.70
IC 載板	501,310	71.60	291,365	60.19	—	—
PCB	42,709	6.10	38,140	7.88	50,472	77.30
其他	20,947	2.99	11,923	2.46	—	—
電漿設備收入	700,166	100.00	484,069	100.00	65,295	100.00

資料來源：該公司提供

A. 半導體製程設備

半導體製程方面可提供之設備產品包含電漿極化機、電漿清洗機、電漿去膠渣機及電漿蝕刻機等。2023~2024 年度及 2025 年第 1 季半導體製程設備銷售金額分別為 135,200 千元、142,641 千元及 14,823 千元，占設備營收比重分別為 19.31%、29.47%及 22.70%，2024 年度及 2025 年第 1 季營收分別較比較同期增加 7,441 千元及 4,729 千元，產品營收占比皆較比較同期增加。該公司近年聚焦於先進封裝所需的電漿乾式製程設備，並應用於 Hybrid Bonding、玻璃基板、FOPLP 等先進封裝製程，以及晶圓再生製程。半導體設備產業近年成長主要受到新興技術驅動，包括人工智慧(AI)、5G、物聯網(IoT)和自動駕駛技術等，以及更先進半導體製程節點所對應之高精密度製造技術的需求，進而催生了對於更高效能、更低功耗的半導體器件及半導體設備的需求。

B. IC載板製程設備

IC 載板製程方面可提供之設備包含電漿清洗機、電漿蝕刻機及電漿鑽孔機。2023 及 2024 年度 IC 載板製程設備銷售金額分別為 501,310 千元及 291,365 千元，占設備營收比重分別為 71.60%及 60.19%，2024 年度營收較 2023 年度減少 209,945 千元，產品營收占比亦減少，2025 年第 1 季則尚無相關營收。2023 年度受終端市場(PC、手機)需求疲軟，加上半導體庫存調整影響，IC 載板產業呈現供過於求，使得 IC 載板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自 2023 年度起出現訂單推遲現象，2024 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，且 2025 年第 1 季因部分客戶交機檢驗時程延遲，致該公司 2024 年度及 2025 年第 1 季營業收入皆較比較同期減少。

C. PCB製程設備

PCB 製程方面可提供之設備包含電漿清洗機、電漿蝕刻機及電漿去膠渣機。2023~2024 年度及 2025 年第 1 季 PCB 製程設備銷售金額分別為 42,709 千元、38,140 千元及 50,472 千元，占營收比重分別為 6.10%、7.88%及 77.30%，2024 年度及 2025 年第 1 季營收分別較比較同期減少 4,569 千元及增加 35,943 千元。2023 年面對終端消費意願疲弱，衝擊市場需求，軟板、硬板及 HDI 板因應用需求下滑產值呈現衰退，2024 年有鑑於消費應用回補庫存需求漸趨浮現，2023 及 2024 年度應用於 PCB 製程設備收入金額變化不大，2025 年受惠於 AI、低軌衛星等市場需求漸趨回溫，推升 2025 年 PCB 產業需求明顯增溫，因製程精密度要求越高，

因此 2025 年第 1 季應用 PCB 產業金額明顯成長。

D.其他產業製程設備

其他產業部分，過去銷售客戶群包含光電產業、橡膠工業、新能源與環保應用產業等等，目前新能源與環保應用產業可提供之設備包含高效電漿火焰處理設備、電漿廢氣處理設備、全氟化物電漿分解處理機、電漿廢水處理設備、電漿高溫減廢設備等。2023~2024 年度其他產業製程設備占營收比重約 2~3% 占比，各年度差異主要源自各產業市場需求變動之影響。

在營業成本與營業毛利部分，該公司於 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之電漿設備之營業成本分別為 435,482 千元、302,439 千元及 38,105 千元，營業毛利金額分別為 264,684 千元、181,630 千元及 27,190 千元，毛利率則分別為 37.80%、37.52% 及 41.64%。由於該公司採訂單式生產，各期產品成本金額主係受公司營運訂單增減所變動，而設備客製化程度復又因客戶需求不同而異，其中產品成本結構中以直接原物料占最大宗，主要原物料組成爲客製化機構元件、真空元件與幫浦及電源供應器等，平均約八成左右，會隨銷售產品組合及設計規劃的不同而波動。整體而言，各主要產品之成本結構略有不同主要係因不同項目產品之原物料價格波動、製程及人力投入等各項因素而略有差異，惟該公司毛利率維持 38% 至 42% 之間，毛利率變動幅度不大。

綜上所述，該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之電漿設備之營業收入、營業成本及毛利變化情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

(2)其他收入

其他產品項目主要包含維修、售後服務及相關零配件等營業收入。該公司於 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季來自該項目的營業收入分別為 61,873 千元、63,561 千元及 17,836 千元，占整體營業收入比重分別為 8.12%、11.60% 及 21.45%；對應之營業成本分別為 35,054 千元、30,251 千元及 9,764 千元，營業毛利為 26,819 千元、33,310 千元及 8,072 千元，毛利率則分別為 43.35%、52.41% 及 45.26%。

各期營業收入、營業成本及營業毛利之變動，主要係依客戶機台維護與服務需求波動而有所增減。由於該類產品涵蓋零件品項繁多、單價差異大，且維修服務難易度不同，報價亦有所差異，故各期間之毛利率亦有所變化，經評估尚無重大異常情事。

(二)營業費用及營業利益

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	2023年度		2024年度		2024年第1季		2025年第1季	
	金額	占營收比例	金額	占營收比例	金額	占營收比例	金額	占營收比例
推銷費用	37,613	4.93	40,868	7.46	18,738	11.88	11,697	14.07
管理費用	62,764	8.24	65,218	11.91	18,702	11.86	16,558	19.92
研發費用	27,880	3.66	23,958	4.38	6,140	3.89	6,283	7.56
預期信用減損損失(利益)	(3,353)	(0.44)	(2,143)	(0.39)	3,389	2.15	2,063	2.48
營業費用合計	124,904	16.39	127,901	23.36	46,969	29.79	36,601	44.03
營業利益(損失)	166,599	21.86	87,039	15.89	12,824	8.13	(1,339)	(1.61)

資料來源：該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業費用分別為 124,904 千元、127,901 千元及 36,601 千元，營業費用率分別為 16.39%、23.36%及 44.03%。茲就推銷費用、管理費用及研發費用之變動說明如下：

1. 推銷費用

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之推銷費用分別為 37,613 千元、40,868 千元及 11,697 千元。2024 年度推銷費用較 2023 年度增加，主係 2024 年度因積極參展之廣告費、拓展業務支付之佣金性質費用增加所致；2025 年第 1 季推銷費用較 2024 年同期減少 37.58%，係受業績減少影響，提列之員工酬勞及年終獎金減少，以及佣金性質支出減少所致，其變動情形尚無重大異常之情事。

2. 管理費用

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之管理費用分別為 62,764 千元、65,218 千元及 16,558 千元。2024 年度管理費用與 2023 年度相較略為增加，係因 2024 年度拍攝形象影片使廣告費增加；2025 年第 1 季之管理費用較去年同期減少 11.46%，主係受業績減少影響，提列之員工酬勞及年終獎金減少，且無大額廣告費產生所致，其變動情形尚無重大異常之情事。

3. 研發費用

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之研發費用分別為 27,880 千元、23,958 千元及 6,283 千元。2024 年度研發費用較 2023 年度減少，主係受業績減少影響，提列之員工酬勞及年終獎金減少；2025 年第 1 季研發費用與去年同期相比尚無重大差異，其變動情形尚無重大異常之情事。

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之營業利益分別為 166,599 千元、87,039 千元及(1,339)千元，營業利益率分別為 21.86%、15.89%及(1.61)%。整體而言，營業利益之變動主要仍受營業毛利下滑所影響，以致 2025 年第 1 季之營業利益下降並產生損失，經評估該公司最近二年度及最近期之營業利益(損失)變動尚屬合理。

(三)營業外收入及支出

單位：新台幣千元

年度	2023 年度	2024 年度	2025 年第 1 季	
利息收入	2,837	4,112	993	
其他收入	補助收入—低利貸款補助	946	946	237
	補助收入—其他補助	375	354	—
	售電收入	667	721	175
	其他	402	444	132
	其他收入小計	2,390	2,465	544
其他利益及損失	淨外幣兌換利益	3,170	22,349	4,357
	透過損益按公允價值衡量金融資產評價(損)益	236	419	(86)
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	—	(43)	—
	其他	(93)	(58)	(7)
	其他利益及損失小計	3,313	22,667	4,264
財務成本	(3,196)	(3,300)	(819)	
合計	5,344	25,944	4,982	

資料來源：該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

1. 利息收入：主係銀行存款所產生之利息收入，屬營運活動所衍生之收益項目。

2. 其他收入

(1) 補助收入—低利貸款補助：係依 IAS20 第 12 段規定，政府補助應於其意圖補償之相關成本於企業認列為費用之期間內，依有系統之基礎認列於損益。該公司係依前述規定，將優惠建廠融資貸款低於市場利率之利益 13,405 千元按剩餘借款期間按月認列。

(2) 其餘其他收入尚包含申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)與勞動部企業人力資源提升計畫所獲補助款之補助收入及該公司自行裝置太陽能板產生之售電收入等等。

3. 其他利益及損失

主係各年度淨外幣兌換利益(損失)及投資基金受益憑證所認列之淨(損)益。兌換利益(損失)方面，該公司外銷占比約五~六成且主要以美元為計價幣別，少部分採人民幣及日幣計價，採購付款幣別則以新台幣為主，少部分為美元、歐元及日幣計價，故外幣收入遠大於外幣支出，並以美元資產部位為主，因此新台幣兌美元對該公司獲利衍生出一定程度之波動。2023 年度因美國聯準會採取升息政策趨勢放緩，使美元兌新台幣呈現先升後貶，致 2023 年度產生淨兌換利益 3,170 千元；2024 年度因全球通貨膨脹降溫緩慢，美國聯準會延後降息，美元仍維持強勢，致 2024 年度產生淨兌換利益 22,349 千元；2025 年第 1 季因美國聯準會升息政策，美元持續強勢，致 2025 年第 1 季產生淨兌換利益 4,357 千元。

4. 財務成本：主係銀行借款之利息，2023~2024 年度及 2025 年第 1 季未有重大差異。

(四)稅前淨利及每股盈餘

單位：新台幣千元；%

項目	2023年度		2024年度		2025年第1季	
	金額	占營收比例	金額	占營收比例	金額	占營收比例
稅前淨利	171,943	22.56	112,983	20.63	3,643	4.38
本期淨利	133,261	17.49	86,950	15.88	2,879	3.46
期末資本額	288,598	—	288,598	—	288,598	—
每股盈餘	5.00	—	3.01	—	0.10	—

資料來源：該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季之稅前淨利分別為 171,943 千元、112,983 千元及 3,643 千元；本期淨利則分別為 133,261 千元、86,950 千元及 2,879 千元，該公司之稅前淨利及本期淨利與營業毛利呈相同變動趨勢。2023~2024 年度及 2025 年第 1 季稅前淨利及本期淨利逐期減少，主係受到產業景氣影響半導體、IC 載板及 PCB 等產業大廠之資本支出計畫，致電漿設備營收及毛利逐期減少所影響。

綜上說明，該公司最近二年度及申請(2025)年度第 1 季業績變化應屬合理，尚無重大異常。

【會計師說明】：

一、最近二年度與截至最近期合併營業收入及毛利率變動說明如下：

單位：新台幣千元

項目/年度	2023年度	2024年度	2025第1季
合併營收（千元）	762,039	547,630	83,131
合併毛利率（%）	38.25	39.25	42.42

暉盛公司主要核心業務係各式電漿設備之銷售，經檢視其主要客戶為半導體、PCB及IC載板、網通等業者。業績變動之主要原因分析如下：

- 2023及2024年與2025年第1季對前十大客戶之銷售金額分別為596,779千元、410,350千元及78,755千元，佔合併營收淨額之比率分別為78.31%、74.93%及94.74%。
- 2023年度之合併營收主要來自半導體封裝載板廠與電路板廠等客戶。近年因中美貿易戰及新冠疫情後復甦，中國大陸積極發展半導體及晶片國產自主，並補助企業擴廠與建置產能。暉盛公司亦受惠於此政策發展，自2021年起陸續接獲中國地區此類客戶訂單。台灣地區客戶則因中美貿易戰、疫情期間的轉單紅利，以及AI產業帶動高階晶片、載板及封裝的發展，使電路板及IC載板業者近年來積極擴廠，進而向暉盛公司下單採購。
- 2024年度之合併營收主要來自半導體設備代理商、半導體封裝載板廠、電路板廠及低軌衛星設備廠等客戶，惟合併營收較2023年下滑，主係第2.點所述擴廠及新設產線的下單動能減弱，以及2023年第四季起受消費性電子市場需求轉弱，ABF及PCB產業的庫存去化不如預期，各業者的資本支出計畫亦隨之延遲或下修之綜合影響。

4. 2025年第1季之合併營收主要來自於電路板廠客戶，除少數客戶因營運狀況回升或庫存去化完畢開始下單外，整體營運仍受消費性電子市場需求尚未回溫之影響。
5. 綜上所述，暉盛公司之營收變化趨勢與電子業終端需求高度相關，產業景氣將影響客戶的資本支出規劃及交機驗收時程。依經濟部2024年4月發布之製造業投資及營運概況調查報告，2023年度第4季起受全球經濟放緩，以及疫情期間電子商務快速發展墊高基期等因素影響，電子零組件業固定資產的增購金額年減約54.2%，主因終端電子產品消費動能疲弱，半導體業者設備投資續呈緊縮，加以上年同期比較基期偏高所致。暉盛公司之營收變動於2024年至2025年第1季亦呈現相同趨勢，評估尚無重大異常。
6. 2023及2024年度與2025年第1季之合併毛利率並無重大變動，顯示公司的機台設備與維修服務具備穩定的獲利能力。

二、最近二年度與截至最近期合併營業費用變動說明如下：

單位：新台幣千元

項目/年度	2023年度	2024年度	2025第1季
推銷費用	37,613	40,868	11,697
管理費用	62,764	65,218	16,558
研發費用	27,880	23,958	6,283
預期信用損失(利益)	(3,353)	(2,143)	2,093
營業費用率(%)	16.39	23.36	44.03

1. 2024年度營業費用率較2023年度提高，主係營收下滑導致計算之結果提高，惟整體營業費用2024年度僅較2023年度增加約2,997千元(+2.4%)。營業費用未隨營收同步減少，經檢視各功能別項目變動，2024年度推銷費用增加主係參展次數增加導致廣告費及差旅費較同期增加，另因2024年度外銷比重較同期提高，因此相關出口費用亦較同期增加。管理費用增加主係配合申請上市櫃拍攝形象影片及更新公司網站設計等相關支出增加所致。2024年度研發費用下降，主係公司較同期業績衰退，相關之獎金亦隨之減發。
2. 2025年第1季之營業費用經檢視各項目並無重大異常變動，惟因營收下降幅度變大，導致計算結果費用率提高幅度增加，惟整體與2024年度之1/4(單季)比較，並無異常變動。

三、最近二年度與截至最近期合併營業外收入及支出變動說明如下：

單位：新台幣千元

項目/年度	2023年度	2024年度	2025第1季
利息收入	2,837	4,112	993
其他收入	2,390	2,465	544
其他利益及損失	3,313	22,667	4,264
財務成本	(3,196)	(3,300)	(819)
合計	5,344	25,944	4,982

1. 2024年度利息收入與其他利益及損失較2023年度增加，主係2024年度應收帳款陸續回收後，帳上美金活存及定存部位所產生之利息收入增加，以及美元匯率自2023年底的30.705持續升值至32.785，導致外幣淨兌換利益較同期增加約19,179千元。其餘項目經檢視明細帳並無重大異常變動。
2. 2025年第1季之合併營業外收入及支出經檢視各項目並無重大異常變動，

四、會計師對合併營業收入、營業成本、營業費用暨營業外收入及支出所執行之主要查核程序分別敘明如下：

1.營業收入認列真實性

- (1)瞭解及測試與銷貨收入認列真實性攸關之內部控制制度設計及執行是否有效，經抽樣檢視銷貨收入認列相關之內控作業程序及相關內控表單，包括訂單作業、交貨作業、收款作業及銷貨退回及折讓作業等。
- (2)就機台銷貨收入明細選取樣本執行細項測試（關鍵查核事項），經抽查前十大客戶之銷售合約及裝機完成確認單，並於期末執行收入之截止測試，收入認列時點係屬允當。另經核應收帳款收款金額及沖轉記錄尚無不符，未發現有收款對象與銷售對象不同之情事。
- (3)應收帳款餘額選樣執行函證程序，驗證帳列餘額之存在性。
- (4)查詢分析前十大銷售客戶與去年同期比較之變化情況及合理性。
- (5)新增為前十大銷貨客戶者，查詢及檢視客戶基本資料表，另查閱該客戶之公司登記資訊或網站資訊，並抽樣檢視交易流程之資料，包含客戶訂單、銷貨/出貨單、發票及收款金額等相關憑證。
- (6)分析兩期毛利率變動之合理性。

2.營業成本

- (1) 覆核營業成本表內容，核算加總並與總分類帳及相對之存貨紀錄勾稽核對。
- (2) 查詢分析前十大供應商與去年同期比較之變化情況及合理性。
- (3) 新增為前十大供應商者，查詢及檢視供應商調查表，另查閱該供應商之公司登記資訊或網站資訊，並抽樣檢視交易流程之資料，包含請購單、採購單、進貨單、發票及付款金額等相關憑證。
- (4) 自年度進貨明細抽核相關憑證，並針對應付款項餘額選樣發函詢證，驗證帳列餘額之完整性。

3.營業費用

- (1) 對營業費用之變動合理性執行分析性覆核程序、詢問管理階層，及抽核相關憑證進行驗證，並與帳載紀錄核對。
- (2) 自年度費用明細抽核相關憑證驗證與帳載記錄一致。

4.營業外收入及支出

對營業外收入及支出內容及其變動執行分析覆核、詢問管理階層及抽核相關憑證，並與帳載紀錄核對。

綜上所述，針對暉盛公司最近二年度與截至最近期之合併營業收入、營業成本、營業費用及營業外收入及支出內容，依本會計師執行內部控制測試及證實性測試之結果，並無重大異常情事，經評估尚屬合理。

貳、公司營運易受產業景氣波動及主要客戶資本支出變化影響，且競爭對手為國際大廠，請說明

1. 面臨營運穩定性之風險及具體因應措施；
2. 國際情勢變化之影響暨因應對策；
3. 未來產品發展方向及成長動能。

【公司說明】：

本公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象涵蓋半導體、IC 載板及印刷電路板(PCB)產業之上中下游之供應鏈廠商，為其製程設備供應鏈中重要一環，由於本公司之產品與客戶製程高度連結，故接單狀況與相關產業景氣變化息息相關，營運表現易受相關產業景氣循環及終端客戶資本支出變化所影響。

一、面臨營運穩定性之風險及具體因應措施

1. 產品多元應用及跨產業發展

由於電漿其高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，因此在各項領域中展現出廣泛應用潛力。隨著科技日益進步，以及電子、醫療保健與製造等產業對先進材料需求的持續增加，電漿技術的發展與應用逐步受到重視，尤其在電漿表面處理領域，其跨產業應用價值更顯重要。

相較於高度依賴單一產業或少數大型客戶之企業模式，本公司以高密度電漿乾式表面處理核心技術為基礎，積極推動產品於多元產業之應用，建構具彈性且具前瞻性的營運布局。本公司產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，並於多個產業領域均有技術布局，展現出跨產業的技術服務能力。

目前本公司既有客戶群涵蓋半導體、載板、面板、封裝、PCB、Mini/Micro LED 及生醫等多元領域，近年更善用電漿無污染技術優勢，跨入綠色製程及符合 ESG 發展趨勢之減碳排廢相關應用之研發創新，持續擴大業務版圖，強化橫跨多領域產業應用的深度與廣度，此多元化發展策略有助於分散營運風險，可有效降低單一產業景氣循環所帶來之波動衝擊，提升整體營運穩定性與競爭力。

2. 產品多為國際大廠製程所認證之關鍵設備，具高度技術門檻且掌握產業關鍵技術

本公司透過與客戶產業鏈下游之國際大廠客戶共同開發特規製程，提升高附加價值應用之導入成功率，並可藉由大廠客戶推薦，進一步拓展至其供應鏈體系之合作廠商。產品自開發初期階段即與客戶密集進行電漿技術之討論、測試、合作與認證作業，雙方協同開發合作，確保設備能順利取得各項安規、環保、電氣相關法規認證；由於設備一經完成認證，若更換設備供應商即須重新進行完整認證流程，將產生高成本與生產風險，因此客戶在無重大因素下，通常不會輕易更換既有合格廠商。故本公司產品一經通過國際大廠認證，不僅有助於穩固長期合作關係外，更可形成有效且具高度技術門檻之市場進入障礙，強化本公司在產業中的競爭優勢。

3. 產品附加服務—售後服務與維護

本公司持續強化設備之維運服務與耗材銷售模式，透過建立完善之售後服務機制與耗材供應體系，於設備銷售完成後持續提供客戶技術支援、定期維護、系統升級與原廠耗材供應等全方位延伸服務，可有助於提升客戶滿意度與品牌黏著度，亦可延長設備生命週期，並創造穩定的後續收益，強化本公司整體營運韌性與獲利結構。

二、國際情勢變化之影響暨因應對策

1. 對本公司之影響

近年來國際政治局勢動盪，中美貿易戰、關稅政策及川普美國製造政策，牽動全球供應鏈海外布局，2025年4月美國總統川普宣布對所有進口產品徵收10%基準關稅，並擬對18個經濟體實施課徵對等關稅措施，其中對台灣關稅稅率為32%，惟對等關稅後續宣布暫緩實施，並進入各國協商談判階段。

本公司產品為各式電漿設備，主要應用於半導體及PCB(含IC載板)產業。根據美國公告第14257號附件II所列豁免清單，並未涵蓋電漿設備及PCB(含IC載板)，因此目前本公司對美銷售適用之關稅為10%，倘若未來對等關稅措施正式實施，對美銷售將課徵32%稅率；其中下游PCB客戶對美銷售亦將面臨為32%關稅，而半導體客戶則列入豁免範圍。

本公司2023~2024年度及2025年第1季銷售美國地區營業收入分別為64,560千元、2,176千元及2千元，占各期總營業收入分別為8.47%、0.40%及0.00%，金額占比微小，且交易模式係採FOB條件，關稅風險係由客戶自行承擔，故美國關稅政策對本公司財務之直接影響非常有限。此外，製程設備若已導入製程產線，為維持製程產線穩定性，客戶通常不易隨易更換設備供應商，因關稅因素而更換供應商並重新開發與調整產線之風險相對較低。

針對下游客戶方面，PCB客戶短期內可能因關稅壓力導致利潤受壓，進而考慮成本轉嫁，然而，本公司產品屬於製程設備，非屬客戶生產所需之原材料，故實際面臨成本轉嫁之風險不高，然下游客戶仍可能因應關稅政策被迫調整採購路徑或轉單，長期亦可能因配合美系終端客戶重新配置供應鏈，而調整生產基地，進一步導入美國在地供應體系。屆時，台灣設備供應商將面臨隨客戶產線區域調整所帶來的競爭力與交貨能力之挑戰。

2. 因應對策

針對上述情勢可能之變化，本公司之因應措施如下：

- (1)強化產品競爭力：持續強化自身產品之競爭力，精進核心電漿技術之深度與廣度，並開發利基型高毛利產品，以預留因美國關稅政策變動，可能對本公司獲利空間造成之影響。
- (2)關稅政策即時追蹤：本公司已指定專責窗口，密切關注國際情勢政策相關公告，即時掌握關稅與出口管制等最新動向。

(3)提升海外服務品質與彈性：透過彈性技術人力派遣、遠端製程參數平台及與當地系統整合商合作，建立即時服務的國際化支援模式。

(4)拓展非美國市場佈局：配合地緣政治變化，本公司積極布局東南亞地區(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈體系，以分散地緣政治風險，降低單一市場過度集中所帶來之不確定性。

三、未來產品發展方向及成長動能

隨著科技產品持續進化，半導體、IC 載板及 PCB 等產業之製程設備亦不斷升級，配合智能化製造的發展，電漿設備將朝向自動化控制和智能化管理，以因應更加精細和複雜的工藝要求，同時，全球對減碳議題日益重視，進一步推動設備朝高效率、低能耗及綠色製程方向演進。鑒於上述趨勢帶動電漿設備於相關製程中的重要性與日俱增，未來產業前景看好，本公司將持續投入設備技術升級及創新開發，以因應高科技製程需求，並實踐環境永續發展目標。

本公司未來產品發展方向將聚焦於以下重點領域：

1. 先進封裝需求擴大

隨著高階封裝技術的演進，晶圓級封裝(WLP)、面板級封裝(PLP)以及混合鍵合(Hybrid Bonding)已逐步成為先進製程之主流趨勢，廣泛應用於先進製程中，以因應晶片小型化、高效能及異質整合等需求。在此發展背景下，電漿處理技術於封裝貼合前處理階段扮演關鍵角色，主要應用於去除氧化層、表面極化與材料活化等步驟，能有效提升鍵合品質與製程良率，尤其是在 PLP 領域，由於其封裝基板尺寸較大且結構複雜，對於表面處理的一致性與均勻性要求更為嚴苛，因而更仰賴穩定且高效之電漿處理技術以確保製程品質。

本公司專注於電漿設備之研發與製造，產品已成功導入多家國內外一線封裝大廠，並通過 PLP 相關製程驗證後使用，展現出本公司在該領域之技術可靠性已獲高度肯定。隨著半導體產業於 3D 封裝與異質整合方向持續擴產，並因微間隙封裝與超細間距結構日益普及，以及降低晶圓研磨損傷之製程需求提升，預期將帶動本公司 Hybrid Bonding 製程所需電漿設備、ECR 高密度電漿設備及深孔蝕刻用 ICP-RIE 技術設備之成長動能。此外，本公司亦將推動 300mm 晶圓拋光減薄技術，導入乾式電漿取代傳統研磨製程，以提升薄化製程之良率與精度。隨著第三代半導體應用逐步擴展，針對 SiC 晶圓之電漿蝕刻與清洗需求亦將同步推進，以因應先進封裝對製程精度與可靠性日益嚴格之要求。

鑒於電漿處理為影響良率之關鍵步驟，對製程參數、設備穩定性與操作精準度要求甚高，具備相當技術門檻，且須與客戶製程深度整合，導入後轉換供應商成本高，形成有效之進入障礙。此優勢不僅有助於本公司與客戶建立長期且穩固之合作關係，更提升本公司在高階封裝市場中的競爭地位。

2. IC 載板領域之 AI 應用需求

隨著 AI 晶片運算能力之提升，封裝技術正朝向高頻寬、低延遲與多層異質整合

的方向發展，帶動 IC 載板在高密度互連(HDI)與高導熱材料的需求快速成長。本公司所提供之電漿表面處理與清潔技術，能有效對應 IC 載板製程中對表面粗化、清潔控制、孔底去膠及低損傷清潔等關鍵環節之要求，特別在高階 ABF 載板、BT 載板及玻璃基板與次微米級導線結構方面展現高度技術優勢及競爭力，如 ABF 載板全乾式電漿去膠渣及蝕刻製程技術，取代傳統耗用大量化學藥劑的濕製程。透過與國內外 IC 載板大廠合作，跨入 AI 應用之製程，在未來 AI 與高速運算晶片帶動先進載板需求下，預期將帶動本公司在 AI 封裝產業鏈之營收成長。

3. ESG 與淨零碳排放政策驅動

本公司所開發之氣體分解系統及高效火焰電漿設備，未來可應用於半導體尾氣淨化、製氫、醫療廢棄物分解等 ESG 導向之減碳市場，屬於政策支持下具發展潛力之新興成長應用領域。

4. 再生晶圓市場擴大

本公司開發之高良率、低損傷乾式清洗及薄膜去除技術，已成功導入台灣主要晶圓封測廠製程，並持續拓展至東亞地區市場，對於建立穩定之再生設備出貨基礎具實質助益，亦有助強化本公司於該領域之市場布局與技術影響力。

綜上，雖本公司屬設備供應商，受下游客戶資本支出策略波動影響，但藉由多元應用拓展、平台技術深化、海外市場拓展與大廠共同開發等策略，已建立具韌性與成長潛力的營收結構。未來在先進封裝趨勢與 ESG 政策推動下，本公司營收可望維持穩定成長態勢，且本公司產品口碑已漸為市場所知，具備明確且可持續之成長動能。

【承銷商說明】：

一、面臨營運穩定性之風險及具體因應措施

該公司其產品主要應用於半導體產業，並聚焦於先進封裝領域，另亦專注於 IC 載板及印刷電路板(以下簡稱 PCB)等產業之應用，因此該公司之接單狀況與所屬產業景氣變化息息相關，營運易受所屬產業景氣及產業鏈製造商資本支出需求狀況所影響。而本承銷商根據產業研究報告顯示，半導體設備部分，SEMI 預估 2025 年晶圓廠設備支出將達 1,250 億美元，成長 6.7%；Global Market Insights 資料顯示，全球 IC 載板及 PCB 設備市場規模預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算 (HPC)、電動車 (EV) 及先進封裝等新興應用領域；而根據研調機構 VMR(Verified market Report)指出，全球電漿設備市場預計 2026 年至 2033 年將以 5.5%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 72 億美元，顯示所屬產業製程設備需求成長無虞。

為因應市場需求變化，該公司積極開發多元產業應用，以降低景氣循環及單一產業波動風險。目前該公司產業客戶群涵蓋半導體、IC 載板、封裝、面板、PCB、Mini/Micro LED 及生醫等領域，並同步拓展設備銷售後的維修與技術服務。由於半導體、IC 載板及 PCB 等產業製程設備具備高資本投入及運行複雜特性，維修服務對於確保設備穩定運行至關重要，該業務因此成為該公司營收中相對穩定的來源。此外，

該公司針對客戶產業鏈下游大型品牌客戶，於產品開發階段即展開電漿技術討論、測試與認證，以確保產品符合高階製程要求。此策略有助於及早切入市場、提升競爭門檻，並在產業導入初期即取得關鍵銷售地位，有利強化該公司於供應鏈中之優勢。

而面對外部環境變化快速，該公司將積極開發東南亞、印度、歐洲等地區業務，以分散單一國別風險，並建立製程即服務模式、技術顧問 FAE 團隊以提升適應速度與彈性，貼近客戶研發節奏。經評估該公司維持其競爭優勢之策略主要為持續深化其研發量能，建立技術壁壘，同時申請專利保護，風險因應措施維持應屬合理可行。

二、國際情勢變化之影響暨因應對策

該公司之電漿產品關稅代碼為 84798991108，經檢視美國公告第 14257 號附件 II，該公司產品並未在國對國對等關稅豁免名單，然經查閱 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司 2023~2024 年度及 2025 年第 1 季對美銷售金額分別為 64,560 千元、2,176 千元及 2 千元，占營業收入分別為 8.47%、0.40%及 0.00%，占比微小，且製程設備產線穩定性為客戶生產優先考量，尚不致因關稅政策更換產線設備，顯示美國關稅政策對該公司直接影響極小。

該公司設備主要應用於 PCB、IC 載板及半導體封裝等產業，經檢視美國公告第 14257 號附件 II，美國針對半導體產品(處理器、記憶體、零件等)列入豁免名單，IC 載板及 PCB 則未列入關稅豁免清單，若下游客戶銷美占比較高，則將導致下游客戶銷美產品利潤縮減，然而該公司之產品為 PCB 及 IC 載板廠之製程設備，並非產品直接原材料，共同承擔關稅成本風險不高，然下游客戶仍可能應美系終端客戶要求被迫調整採購路徑或重新配置供應來源或轉單，長期則可能調整生產基地而進入美國供應鏈，則該公司因應下游客戶生產線區域調整之交貨及服務能力將受到考驗。

有鑒於此情勢，該公司持續精進電漿技術之應用，各式電漿技術均積極取得相關專利與認證，並取得經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)認可並核定補助，以確保該公司電漿設備與技術領先業界，持續提升公司產品競爭力避免利潤遭壓縮或轉單，其銷貨模式則採用 FOB 模式對美接單，可將稅務義務轉嫁至買方，降低直接稅務風險，並保留交易談判空間。其次，該公司將指定窗口掌握第一手關稅與出口管制動向，確保公司產品交易合規，降低關稅變化可能產生之風險，並結合 ERP/CRM 系統即時回饋進口稅率、運費與原物料價格變動對產品售價的影響，讓銷售團隊與財務部門可依據區域與客戶別調整報價策略，避免毛利率大幅波動。此外，配合地緣政治變化，加速全球非美市場多元化策略，重點佈局東南亞(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈，經檢視該公司 114 年第 1 季銷售東南亞國家之占比增長至 19.59%，東南亞佈局已逐漸顯現，該公司將透過彈性技術人力派遣、遠端製程參數平台及在地代理/系統整合商合作，提升在地即時支援能力，除可降低建廠龐大的成本與耗時，亦可有效維持與國際大廠合作關係之穩定與黏著度，另外亦積極取得產品各項國際認證，確保主要客戶調整生產國別仍可順利導入。

整體而言，國際情勢變化及關稅政策對該公司財務業務直接影響尚屬微小，惟該公司針對中長期潛在風險所採取適當之因應措施，尚可降低未來相關風險所造成之影

響，經評估尚屬合理及可行。

三、未來產品發展方向及成長動能

該公司致力於擴展核心製程技術的深度與廣度，全面強化奈米級清洗、蝕刻與表面控制等關鍵能力，以因應先進封裝製程對精密度與材料適應性的高度要求。同時，該公司積極發展跨材料整合技術，導入適用於 Epoxy+SiO₂、Glass+Cu 等異質材料的複合材蝕刻與活化解決方案，提升設備對新型封裝結構的製程相容性。在綠色製程方面，該公司全乾式去膠、低耗能蝕刻、高效率氫能火炬與高 GWP 尾氣處理等創新設備之商品化，強化 ESG 製程落實與碳排管理能力。此外，為加速數位轉型，該公司亦已導入智慧製造技術，包括建立製程參數 AI 學習模型、建置虛擬量產平台與智慧維運系統，提升製程穩定性、良率與運營效率。

隨著科技產品持續演進，半導體、IC 載板及 PCB 等相關產業之製程設備亦不斷升級。該公司產品應用領域廣泛，除既有半導體、PCB 及光電產業外，近期亦積極拓展至能源與綠色環保等新興應用領域，以因應 ESG 與淨零碳排之全球趨勢。ABF 載板全乾式電漿去膠渣及蝕刻製程技術可取代耗用大量化學藥劑的濕製程，相關之氣體分解與火焰電漿設備具備高度應用潛力，再生晶圓市場亦因該公司高良率、低損傷乾式清洗及薄膜去除技術而受惠。面對日益精細與複雜之製程需求及全球減碳壓力，製程設備正朝向高效率、低能耗與綠色製程方向發展，電漿設備在先進製程中之關鍵性亦日益提升，預期將成為該公司未來營運成長之重要動能。

附件十六

股票初次申請創新板上市證券承銷 商評估報告

暉盛科技股份有限公司

股票初次申請創新板上市
證券承銷商評估報告
(稿本)

主辦證券承銷商：福邦證券股份有限公司



協辦證券承銷商：元大證券股份有限公司



中華民國 114 年 6 月 25 日

發行人之產業、營運及其他重要風險

一、產業風險

(一)營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

該公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此該公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應對策：

- (1) 該公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。
- (2) 該公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

(二)技術及產品變化之風險

全球半導體技術迭代迅速，包括 AI 晶片、先進封裝、Chiplet 架構與第三代半導體材料持續突破，終端應用需求亦快速轉變。若該公司未能同步升級核心技術，產品規格或製程能力未能即時滿足客戶需求，恐面臨產品被取代或喪失技術領先地位之風險，訂單取得與市場滲透率亦將受影響，尤以先進封裝、高頻載板與環保設備領域為甚。

因應對策：

該公司每年投入約營業收入 5%作為研發支出，確保持續性創新動能，並與生產部電控及機構設計單位密切合作，積極強化高彈性客製化產品設計能力，導入製程即服務(PaaS)模式以提升市場變動適應速度與彈性，並藉由客戶客製需求，共同開發新產品，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化並同步累積特殊材料或應用端 Know-how。此外，該公司核心團隊所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，以對市場敏銳度積極投入新產品研發以推出符合市場需求之產品，同時積極申請專利保護，並發展具差異化的技術方案，如 ABF 全乾式蝕刻與高溫電漿火炬系統，形塑技術壁壘，提升市場競爭力。

二、營運風險

(一)專業人才取得與留任面臨挑戰

該公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，該公司之規模及品牌不及該區

域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為該公司挑戰及努力的方向。

因應措施：

該公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對該公司的認可與向心力，以降低員工流動率。該公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

(二)匯率風險

該公司主要外銷占比約五~六成且以美元交易為主，故衍生一定程度之匯率波動風險，美元之匯率波動對該公司獲利有一定之影響。

因應措施：

該公司對匯率風險之因應，主要視營運資金需求，選擇適當時機將現金部位轉換為美元部位，以降低換匯需求。此外，該公司財務人員亦與主要往來銀行密切聯繫，定期檢視外匯市場，依必要性調整銷貨價格，以適時反應匯率變動情形，並適量保留外幣存款資產，積極了解外匯避險工具，未來如收付部位相差較大，將另行評估是否將採用衍生性商品進行避險，以將低外匯風險影響公司獲利。

三、其他重要風險

請詳評估報告「貳、二、發行公司營運風險」說明。

綜上所述，就該公司之產業、營運及其他重要風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，該公司已具備因應相關風險之能力，各項因應措施尚屬妥適。

目 錄

壹、評估報告總評	1
一、承銷總股數說明	1
二、承銷價格說明	2
三、承銷風險因素	11
四、總結	13
貳、產業狀況及營運風險	16
一、發行公司所屬行業營運風險	16
二、發行公司營運風險	28
參、業務狀況	59
一、營業概況	59
二、存貨概況	82
三、最近期及最近二個會計年度之業績概況	88
四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素	97
肆、財務狀況	98
一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力	98
二、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響	110
三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性	111
四、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之轉投資事業	112
五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見	118
六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響	118
七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見	118
八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額	118
九、承銷商應評估外國發行公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響。	119
伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估	119

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素....	119
一、發行公司是否違反相關法令規章	119
二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使	120
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權	120
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件	120
五、重大勞資糾紛或污染環境事件	120
柒、列明申請創新板上市之發行公司有無臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見.....	121
一、申請創新板上市之發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見	121
二、該公司並無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事，評估意見請參閱附件一。	121
捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定.....	122
一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定	122
二、評估是否符合建設公司、投資控股公司、金融控股公司或其他特定組織型態公司申請股票上市之規定。	126
玖、評估發行公司是否依臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....	127
拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估.....	128
拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見.....	128
拾貳、本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市(櫃)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施.....	128
拾參、其他補充揭露事項.....	129
附件一、依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見.....	130

壹、評估報告總評

一、承銷總股數說明

(一)已發行股數總數

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛或該公司)申請股票於創新板上市時之實收資本額為新台幣 288,598 千元，每股面額新台幣壹拾元整，已發行股數為 28,860 千股，經 114 年 3 月 19 日董事會通過，並經 114 年 6 月 18 日股東會討論通過，預計辦理盈餘轉增資 5,772 千股，增資後已發行股數將為 34,632 千股。該公司擬於股票初次申請創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 2,165 千股(暫訂)，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，預計股票上市掛牌時，已發行股份總數為 36,797 千股及實收資本額為 367,967 千元。

(二)承銷股數及來源

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條，本國發行公司初次申請普通股在創新板上市，應先將其上市申請書件所記載之股份總額，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之提撥比率，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法第 71 條第 1 項包銷有價證券規定，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。而依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17-1 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條所規定之「提撥比率」，為不得低於擬上市股份總額百分之五，且不得低於八十萬股，並以募集發行之普通股股票為限。該公司依上述規定預計辦理現金增資發行新股 2,165 千股，並依公司法第 267 條之規定，保留發行總股數之 15%(暫定)，計 324 千股供員工認購，其餘 1,841 千股則依證券交易法第 28-1 條規定，經 113 年 6 月 28 日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，全數委託承銷商辦理創新板上市前公開承銷。

(三)過額配售

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度內，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。該公司於 114 年 6 月 11 日經董事會決議通過與主辦承銷商簽訂「股票創新板初次上市過額配售及股東自願集保協議書」，承諾該公司將協調其股東提供已發行普通股股票供主辦承銷商做為過額配售之股份來源，以執行穩定價格操作。

(四)股權分散

該公司截至 114 年 4 月 20 日止，記名股東人數共計 359 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數 349 人，且其所持股份總額合計 15,163,585 股，占目前發行股份總額 52.54%，業符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 29 條有關登錄創新板之股權分散標準。

(五)綜上所述，該公司預計辦理現金增資發行新股 2,165 千股，扣除依公司法規定，該公司本次發行新股預計保留 15%(暫定)計 324 千股供員工認購後，餘 1,841 千股，占擬上市股份總額 36,797 千股之 5%，全數委託承銷商辦理創新板上市前公開承銷。另依主辦承銷商與該公司簽定之過額配售協議，該公司應協調其股東提出對外公開承銷股數百分之十五之額度內，供主辦承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，屆時本證券承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格說明

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用之方法、原則及計算方式

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法 (Price/Earnings ratio, P/E ratio)、股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，透過已公開的資訊，和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法則係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎；另收益法則重視未來公司創造現金流量。茲將本益比法、股價淨值比法、成本法及收益法等計算方式、優缺點列示如下：

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
市場法	本益比法 依據公司之財務資料，計算每股盈餘，並擇取上市、櫃公司或產業性質相近之同業平均本益比估算股價，最後進行溢、折價調整，以允當反映受評公司與同業公司間之差異。	1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所估算之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業盈餘為負或少於1時不適用。 4.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來績效	適合評估風險水準、成長率及股利政策穩定的公司。
	股價淨值比法 依據公司之財務資料，計算每股淨值，並擇取上市、櫃公司或產業性質相近之同業平均股價淨值比估算股價，最後	1.淨值係長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負時之替代評估法。 3.市場價格資料容易	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當	評估產業具有獲利波動幅度較大或盈餘為負數時的公司。

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
	再進行溢、折價調整，以允當反映受評公司與同業公司間之差異。	取得。	差異。 3.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來績效。	
成本法-淨值法	以帳面之歷史成本資料為公司價值之評估基礎，即以資產負債表之帳上資產總額減去負債總額。最後，再考量資產及負債之市場價格進行帳面價值之調整，以允當反映受評公司之價值。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較困難。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。
收益法-現金流量折現法	依據公司預估之未來年度現金流量，並佐以風險等級相稱之折現率，進行折現加總，據以評估受評公司之公司價值。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同的關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。	1.使用程式繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，主要係參考市場法、成本法、收益法及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價方式，以作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，復參酌該公司最近二年度之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定本次暫定承銷價格。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司主要從事開發先進電漿技術及研發、生產及銷售各式電漿設備，提供半導體產業、IC載板與印刷電路板產業、平面顯示器與LED等光電產業、非電子業、民生工業及綠能產業等各式製程所需的電漿清潔、蝕刻以及表面改質之解決方案。綜觀目前國內已上市、上櫃公司中，並無完全與該公司所營事業及產品比重相似之公司，經綜合考量營運規模、產品類型及應用領域後，選取較為相似之志聖工業(股)公司(上市股票代號：2467，以下簡稱：志聖)、友威科技(股)公司(上櫃股票代號：3580，以下簡稱：友威科)及鈦昇科技(股)公司(上櫃股票代號：8027，以下簡稱：鈦昇)為其採樣同業。

志聖主要從事研發及生產紫外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程設備，應用於PCB電路板、IC載板、FPD面板及半導體高階封裝生產製

程；友威科主要從事真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，應用於 IC 載板封裝電漿濺鍍、電漿蝕刻處理及光學 5G 蓋板、載板、汽車、各類銅製程鍍膜；鈦昇主要從事半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與 SMD 包裝材料設計與製造，應用於 IC 製造及封測、LED 封測之雷射加工及電漿清洗、蝕刻處理。

(2)市場法

A.本益比法

由於該公司產品應用領域以半導體相關產業應用最廣，茲就採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月(114 年 3 月至 5 月)之本益比區間列示如下：

單位：倍

期間	採樣同業			上市		上櫃	
	志聖 (2467)	友威科 (3580)	鈦昇 (8027)	半導體 類股	大盤平均	半導體 類股	大盤平均
114 年 3 月	35.92	15.57	—(註 1)	20.55	17.28	25.13	24.94
114 年 4 月	27.34	12.36	—(註 1)	20.36	16.89	24.46	24.01
114 年 5 月	31.71	13.12	—(註 1)	19.62	17.05	28.07	25.40

資料來源：臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理。

註 1：因該公司最近 4 季稅後純益為負數，故不計算本益比。

由上表得知，其採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月本益比區間介於 12.36 倍~35.92 倍之間，若以該公司最近四季(113 年第二季~114 年第一季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之稅後淨利 67,749 千元，以擬上市股數 36,797 千股推算後，每股盈餘為 1.84 元，每股參考價格區間約在 22.74 元~66.09 元之間，而本證券承銷商與該公司共同議定之暫訂承銷價格為 58 元，符合前述參考價格區間內，尚屬合理。

B.股價淨值比法

由於該公司產品應用領域以半導體相關產業應用最廣，茲就採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月(114 年 3 月至 5 月)之股價淨值比區間列示如下：

單位：倍

期間	採樣同業			上市		上櫃	
	志聖 (2467)	友威科 (3580)	鈦昇 (8027)	半導體 類股	大盤平均	半導體 類股	大盤平均
114 年 3 月	5.15	2.90	3.16	4.47	2.18	2.63	2.48
114 年 4 月	4.05	2.30	2.67	4.41	2.13	2.55	2.38
114 年 5 月	5.52	2.53	3.01	4.48	2.23	2.66	2.48

資料來源：臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理。

由上表得知，其採樣同業、上市(櫃)半導體類股及上市(櫃)大盤平均最近三個月股價淨值比介於 2.13 倍至 5.52 倍之間。依該公司 114 年第一季經會計師核閱之財務報告中權益總額為 720,198 千元，及擬上市掛牌股數 36,797 千股，計算該公司之每股淨值為 19.57 元，並以前段所述之股價淨值比區間計算該公司之參考價格區間介於 41.68 元~108.02 元之間，惟股價淨值法係以公司淨值為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策，股東權益內容結構等非獲利性因素影響，且並未考量未來成長性，對於成長型公司較不具參考性，故本證券承銷商不擬採用此法作為暫定承銷價格參考之依據。

(3)成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，即以資產負債表上之資產總額減去總負債金額來評定公司之價值，其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價格} = (\text{總資產} - \text{總負債}) / \text{普通股流通在外總數}$$

帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包括債權人、普通股投資人及特別股投資人等，其中股票價值即為對公司之請求權價值，係公司資產總額扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，而公司價值係以創造未來獲利能力之經濟價值評定，以此評價方法將可能低估公司之企業價值，且在評定資產總額及負債總額時，尚需考慮到資產及負債之市價，而取得市價資訊不易，又未考慮資產與負債之市價，忽略市場環境因素，無法表達資產實際經濟價值，因此以成本法評價初次上市(櫃)公司之企業價值者並不多見。

依該公司 114 年第一季經會計師核閱之財務報告之歸屬於母公司業主權益 720,198 千元及依擬上市掛牌股數 36,797 千股計算，每股淨值為 19.57 元，即為依成本法計算之參考價格，與興櫃市場交易價格差異甚大，且此法未考慮公司未來獲利能力及成長性，由此法所計算得出之價格尚需經過調整，故本證券承銷商不擬採用本法為暫定承銷價格之參考依據。

(4)收益法

收益法之方法為現金流量折現法，係依據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考量實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，茲將收益法之基本假設及評估參數分述如下：

A.模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \left(\sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^t} \right) + \left(\sum_{t=n+1}^m \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{t-n}} \right) + \left(\frac{FCFF_{m+1}}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{m-n} \times (K_3 - g)} \right)$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{Tax Rate}) + \text{Dep}_t - \text{Capital Exp}_t - \Delta NWC_t$$

$$K_i = D / (D+E) \times K_d \times (1 - \text{Tax Rate}) + E / (D+E) \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j (R_m - R_f)$$

P_0 = 每股價值

V = 企業總體價值 = $V_E + V_D$ = 股東權益價值 + 淨負債價值 (不含計入營業活動現金流量之負債)

N = 擬上市股數 36,797 千股

$FCFF_t$ = 第 t 期自由現金流量

K_i = 加權平均資金成本, $i = 1, 2, 3$

G = 營業收入淨額成長率

$n = 5$, 係第一階段之經營年限, 例: 114~118 年度

$m = 10$, 係第二階段之經營年限, 例: 119~123 年度

$EBIT_t$ 第 t 期之息前稅前淨利

Tax Rate_t = 第 t 期之稅率

Dep_t & Amo_t = 第 t 期之折舊與攤銷費用

Capital Exp_t = 第 t 期之資本支出

= 第 t 期之購置不動產、廠房及設備支出

ΔNWC_t = 第 t 期之淨營運資金 - 第 $t-1$ 期之淨營運資金

= (第 t 期之流動資產 - 不付息流動負債) - (第 $t-1$ 期之流動資產 - 不付息流動負債)

$D / (D + E)$ = 付息負債資產比

$E / (D + E)$ = 權益資產比 = $1 - D / (D + E)$

K_d = 負債資金成本率

K_e = 權益資金成本率

R_f = 無風險利率

R_m = 市場平均報酬率

β_j = 系統風險; 衡量公司風險相對於市場風險之指標

B. 股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
T	$t \leq n, n = 5$	$n + 1 \leq t \leq m, m = 10$	$t \geq m + 1$	依據該公司狀況分為三期間： 期間I：114~118 年度 期間II：119~123 年度 期間III：124年度後(永續經營期)

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
$D/(D+E)$	16.8833%	15.9417%	15.0000%	由於預期該公司未來將繼續穩定發展，且為維持財務結構，該公司將會由資本市場募集資金，避免提高負債比率，假設期間 I 仍能維持114年3月底之財務結構，而期間 III 進入永續經營期後，假設公司營運穩定良好，隨著營業活動現金流入，營運資金尚為充裕，負債比率得以降低，維持在適當資本結構，假設為15%；期間II則取期間I與期間III之平均值。
$E/(D+E)$	83.1167%	84.0583%	85.0000%	
K_d	1.5991%	1.7901%	1.9810%	配合財務結構之假設，期間I係以該公司114年第一季財務報告之平均借款利率；期間III 係採最近十年本國銀行之借款平均利率算之；期間II之平均借款利率則取期間I與期間III之平均值。
<i>tax rate</i>	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以財政部營利事業的所得稅率20%估算。
R_f	1.4662%	1.4662%	1.4662%	採用櫃檯買賣中心114年5月公告發行之10年期中央政府公債甲4(A14104)之加權平均殖利率。
R_m	9.4856%	9.4856%	9.4856%	採用104~113年度(最近十年)台灣集中市場加權股價指數各年度投資報酬率之幾何平均數。
B_j	1.33	1.17	1.00	期間I之系統風險係以上市半導體最近5年度對大盤之平均風險係數之平均數，估計該公司之系統風險；而期間III預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為1；期間II之Beta值則取期間I與期間III之平均值。
K_e	12.1520%	10.8188%	9.4856%	$=R_f+B_j*(R_m-R_f)$ 。其中 R_f ：無風險報酬率； B_j ：類股與大盤走勢之相關係數； R_m ：市場風險報酬率
K_i	10.3163%	9.3224%	8.3004%	加權平均資金成本。 $K_i=E/(D+E)*K_e+D/(D+E)*K_d(1-稅率)$

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
G (樂觀)	18.65%	10.45%	2.26%	期間I：係以該公司111~114年(114年為預估值)之平均營業收入成長率估計。 期間II：假設營收成長率介於期間I及期間III之間。 期間III：考量永續經營及產品行銷全球，目前尚無法合理預估成長率，故係以世界銀行全球經濟展望報告過去五年度全

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
				球平均GDP成長率估計。
G (保守)	2.26%	2.26%	2.26%	考量永續經營及產品行銷全球，目前尚無法合理預估成長率，故係以世界銀行全球經濟展望報告過去五年度全球平均GDP成長率估計。
$EBIT_t / Sales_t$	19.1019%	19.1019%	19.1019%	係以該公司111~113年度及114年第一季之平均息前稅前淨利率。
$Dept\& Amot / FA_t$	4.0359%	4.0359%	4.0359%	係以該公司111~113年度及114年第一季之平均折舊費用占折舊資產比率估計。
$Capital Expt / Sales_t$	1.9402%	1.9402%	1.9402%	係以該公司111~113年度及114年第一季之平均資本支出占該公司營業收入比率估計。
$\Delta NWC_t / Sales_t$	11.5606%	5.7803%	0.0000%	期間I：係以該公司111~113年度及114年第一季平均淨增加營運資金占該公司營業收入比率來估計。 期間II：假設淨營運資金變動介於期間I及期間III之間。 期間III：依永續經營之淨營運資金變動趨近於0。

D.每股價值之計算

(A)樂觀情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (2,724,667 - 158,017 \text{千元}) / 36,797 \text{千股} \\
 &= 69.75 \text{元 /股}
 \end{aligned}$$

(B)保守情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (1,188,393 - 158,017 \text{千元}) / 36,797 \text{千股} \\
 &= 28.00 \text{元 /股}
 \end{aligned}$$

該公司依據上述假設及公式計算之參考價格區間為28.00元~69.75元，然因收益法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多為預估性質，在永續經營假設下，產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故在未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握情況下，且相關參數之參考價值相對較為主觀之情形下，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)發行公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1.財務狀況

單位：新台幣千元；%

分析項目		年度	112 年底	113 年底	114 年第一季底
		公司別			
財務結構	負債占資產比率(%)	暉盛	34.85	31.37	35.17
		志聖	57.34	51.26	61.44
		友威科	50.58	35.49	35.20
		鈦昇	43.51	32.65	33.50
	長期資金占固定資產比率(%)	暉盛	335.93	338.37	329.88
		志聖	650.72	719.74	467.12
		友威科	300.66	292.90	293.19
		鈦昇	481.08	294.26	275.20

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經福邦證券計算整理

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之負債占資產比率分別為 34.85%、31.37%及 35.17%。113 年底較 112 年底下降，主係因陸續償還長期借款，及受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致負債總額較 112 年底減少所致；114 年第一季底較 113 年底上升，主係該公司陸續接單收取訂金款及依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使合約負債及應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，故負債總額較 113 年底上升，經評估其變動情形尚屬合理。

與採樣公司相較，該公司及其子公司負債占資產比率 112~113 年底均優於採樣同業，114 年第一季底僅遜於鈦昇而優於志聖及友威科，該公司及其子公司負債占資產比率尚屬健全，且未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情事，經評估尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占固定資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 335.93%、338.37%及 329.88%。該公司及其子公司之長期資金占不動產、廠房及設備比率各年度變化不大，主係該公司及子公司營運持續穩定獲利使整體權益金額增加所致，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司相較，該公司及其子公司 112 年底長期資金占不動產、廠房及設備比率優於友威科而低於志聖及鈦昇；113 年底及 114 年第一季底僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，且各年底長期資金占不動產、廠房及設備比率皆優於 100%，顯示其長期資金足以支應資本支出及營運所需，長期資金結構尚屬健全，

經評估無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底財務結構各項財務指標變化情形尚屬合理，財務結構尚屬健全，經評估尚無重大異常之情事。

2.獲利能力

單位：新台幣千元；%

分析項目		年度	112 年度	113 年度	114 年第一季	
		公司別				
獲利能力	資產報酬率 (%)	暉盛	12.09	8.19	1.29	
		志聖	6.88	8.50	6.33	
		友威科	5.30	11.66	3.67	
		鈦昇	0.92	(1.02)	(5.59)	
	權益報酬率 (%)	暉盛	21.03	11.89	1.57	
		志聖	15.38	17.46	13.58	
		友威科	11.05	20.29	5.20	
		鈦昇	0.95	(2.27)	(8.90)	
	占實收資本比率	營業利益	暉盛	57.73	30.16	(1.86)
			志聖	25.69	40.57	46.02
			友威科	31.18	24.95	12.32
			鈦昇	1.71	(10.97)	(27.85)
		稅前純益	暉盛	59.58	39.15	5.05
			志聖	37.26	62.49	61.17
			友威科	33.78	33.60	18.65
			鈦昇	3.89	(4.92)	(23.18)
純益率 (%)	暉盛	17.49	15.88	3.46		
	志聖	14.62	15.70	12.37		
	友威科	13.73	30.02	15.36		
	鈦昇	1.52	(3.58)	(19.80)		
每股盈餘(元)	暉盛	5.00	3.01	0.10		
	志聖	3.12	4.80	1.00		
	友威科	2.63	5.08	0.36		
	鈦昇	0.32	(0.51)	(0.57)		

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經福邦證券計算整理

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之資產報酬率分別為 12.09%、8.19%及 1.29%；權益報酬率分別為 21.03%、11.89%及 1.57%；營業利益占實收資本比率分別為 57.73%、30.16%及(1.86)%；稅前純益占實收資本額比率分別為 59.58%、39.15%及 5.05%；純益率分別為 17.49%、15.88%及 3.46%，每股盈餘分別為 5.00 元、3.01 元及 0.10 元。該公司及其子公司之各項獲利能力呈現逐步下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，使營業收入持續下滑，致 112~113 年度及 114 年第一季各項獲利能力比率均較比較同期下滑。

與採樣公司相較，資產報酬率及權益報酬率部分，該公司及其子公司 112 年度均優於採樣同業，113 年度及 114 年第一季均優於鈦昇而低於志聖及友威科；營業利益及稅前純益占實收資本額比率部分，該公司及其子公司 112 年度均優於採樣同業，113 年度僅低於志聖而優於友威科及鈦昇；114 年第一季優於鈦昇而低於志聖及友威科；純益率部分，該公司及其子公司 112 年度優於採樣同業，113 年度僅低於友威科而優於志聖及鈦昇；114 年第一季優於鈦昇而低於志聖及友威科；每股稅後盈餘部分，112 年度每股稅後盈餘優於採樣同業；113 年度及 114 年第一季均優於鈦昇而低於志聖及友威科。經評估尚無發現有重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季獲利能力各項指標之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

3.本益比

請詳本評估報告「壹、二、(一)、2、(2)、A.本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論。

本次承銷價格議定並無參考專家意見或鑑價機構之鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料。

單位：新台幣元/股

月份	平均股價(元)	成交金額(元)	成交量(股)
114 年 5 月份	97.41	5,663,716	58,144

資料來源：財團法人中華民國櫃檯買賣中心。

該公司於 113 年 3 月 18 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(114 年 5 月)之月平均股價為 97.41 元，總成交量為 58,144 股。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見。

本證券承銷商與該公司議定之暫訂承銷價格，係依一般市場承銷價格訂定方式，參考全體上市(櫃)公司、上市(櫃)半導體類股及採樣同業之本益比及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價、初次上市流動性風險貼水等，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據；再參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況，由本證券承銷商與該公司共同議定之暫訂承銷價格為每股新臺幣 58 元，介於上列參考價格區間，本次公開承銷之價格應尚屬合理。

由於該公司未來之業務計畫及財務狀況等經營條件假設，可能受到不確定因素影響，致使實際結果與現在預期情形有所差異，故本證券承銷商擬於該公司申請股票初次創新板上市獲得證券主管機關同意後，於辦理公開銷售前，視當時整體經濟環境、產業前景及市場供需變化、公司營運狀況及其最近期財務報告等資訊，依採行之承銷方式發現市場價格後，再與該公司另行議定合理之承銷價格。

三、承銷風險因素

本次承銷相關風險依股價變化過鉅、穩定價格策略、此次承銷之相關費用及承銷

手續費率、新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利等因素分別評估說明如下：

(一)股價變化過鉅

為使初次上市股票於訂定承銷價格時能有效評估企業價值並反映市場現況，避免因訂價偏離市場預期使股價波動過劇，本承銷商議定之承銷價格係考量該公司經營績效、產業現況、資本市場現況及採樣同業狀況等因素後，加以評估調整所得，本承銷價格應可合理反應該公司之市場價值。惟臺灣證券市場易受政治因素、經濟景氣、國際經濟局勢、外交情勢及投資人預期心理等因素影響，且依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」第 63 條第 2 項之規定，初次上市普通股除上櫃轉上市者外，自上市買賣日起五個交易日採無升降幅度限制，因此該公司股票上市掛牌交易後，若上述因素發生重大變動，均有可能造成該公司股價鉅幅變化，故此本承銷商將依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，與該公司協議辦理過額配售並執行穩定價格操作，應可有效降低股價鉅幅變動之風險。

(二)穩定價格策略

為降低掛牌前五日無漲跌幅限制而造成股價波動過大的投資風險，依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售及價格穩定協議書，由該公司協調其股東，視市場狀況應提出上市前辦理公開銷售股數之 15% 額度內所得價款，作為主辦承銷商辦理過額配售，於該公司股價異常於大盤或同業時，將適度穩定該公司之股價。另該公司已依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 35 條之規定提出強制集保之股份，且本證券承銷商亦與特定股東約定，約定於掛牌日起不少於三個月但不超過六個月之期間內，該特定股東自願將股票存入臺灣集中保管結算所(股)公司，並承諾不得出售，以維持股票初次上市交易後股票價格之穩定。

(三)承銷之相關費用及承銷手續費率

本證券承銷商所需之公開說明書印製費用、相關承銷書件印製費用、聘請會計師針對內部控制出具意見、律師及相關專家表示意見、上市審查費、集保劃撥及投資人資料建檔、召開法人說明會等有關事宜及費用，概由該公司負擔。其中承銷手續費率將參酌市場行情由本證券承銷商與發行公司議定之，惟依國際財務報導準則實務指引(IFRS Manual of Accounting)及參酌 IAS 32 第 37 段之說明，企業於發行或取得本身之權益工具時，通常會發生各種成本，此權益交易之交易成本應按扣除所有相關所得稅利益後之淨額作權益之減項處理，但以直接可歸屬該權益交易之可避免增額成本為限，而本次承銷手續費係可直接歸屬於該權益交易之可避免增額成本，對該公司之獲利能力尚不致產生重大影響。

(四)新股承銷是否導致股本膨脹稀釋獲利

該公司為申請股票初次創新版上市，預估將辦理現金增資發行新股 2,165 千股(暫訂)，占發行前股數(含預計盈轉增資股數 5,772 千股)共計 34,632 千股之 6.25%，然考量該公司未來業績與獲利之成長動能，本證券承銷商與該公司訂定承銷價格時業

已考量此次發行新股之稀釋效果，對該公司獲利之稀釋影響尚屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開承銷股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理創板上市前公開銷售，經評估本次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於本次議定承銷價格時納入考量，另本證券承銷商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

四、總結

(一)承銷商依據本身評估結果及專家意見後，總結評估說明該發行公司之營運風險、財務風險及潛在風險等風險事項，作為投資人投資之風險預告：

1.營運風險

(1)營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

該公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此該公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應措施：

A.該公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。

B.該公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

(2)專業人才取得與留任面臨挑戰

該公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，該公司之規模及品牌不及該區域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為該公司挑戰及努力的方向。

因應措施：

A.該公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以

及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對該公司的認可與向心力，以降低員工流動率。該公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

2.財務風險

(1)匯率風險

該公司主要外銷占比約五~六成且以美元交易為主，故衍生一定程度之匯率波動風險，美元之匯率波動對該公司獲利有一定之影響。

因應措施：

A.該公司對匯率風險之因應，主要視營運資金需求，選擇適當時機將現金部位轉換為美元部位，以降低換匯需求。此外，該公司財務人員亦與主要往來銀行密切聯繫，定期檢視外匯市場，依必要性調整銷貨價格，以適時反應匯率變動情形，並適量保留外幣存款資產，積極了解外匯避險工具，未來如收付部位相差較大，將另行評估是否將採用衍生性商品進行避險，以將低外匯風險影響公司獲利。

3.潛在風險

(1)美國關稅政策之影響

2025年4月2日川普以各國對美龐大貿易逆差為由，實施10%的全面進口關稅，同時公佈約60個國家的進口貨品將加徵對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。如若關稅實施，將推高該公司產品在美國市場的售價，削弱價格競爭力。

因應對策：

A.指定窗口密切關注美國相關機構之政策公告，掌握第一手關稅與出口管制動向，確保對應製程、產品或客戶交易行為符合最新規範，並留意主要客戶應用產品之關稅變化可能造成之後續影響，降低法律與商業風險。結合ERP/CRM系統即時回饋進口稅率、運費與原物料價格變動對產品售價的影響，讓銷售團隊與財務部門可依據區域與客戶別調整報價策略，避免毛利率大幅波動。此外，配合地緣政治變化，加速全球非美市場多元化策略，重點佈局東南亞(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈，透過與當地專業經銷商合作，提升在地即時支援能力。

綜上所述，該公司已就營運風險、財務風險及潛在風險三方予以綜合之評估，本證券承銷商認為該公司已具備降低或分散風險之能力。

(二)承銷商總結評估說明外國發行公司申請股票第一上市案件之風險事項時，並應列示其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估說明外國發行公司所採行因應措施之適當性。

該公司非屬外國發行公司申請股票第一上市案件，故不適用本項評估。

(三)依據對發行公司整體評估之結果，作為是否推薦發行公司上市之依據。

綜上所述，本證券承銷商對該公司所處行業之營運風險、財務風險及潛在風險綜合評估，該公司已具備降低或分散風險之能力，且其經營穩健，歷年獲利情況尚屬穩定，應不致對其營運狀況產生重大不利影響。本證券承銷商於輔導期間對該公司綜合評估產業狀況、營運風險、業務狀況、財務狀況及不宜創新板上市之查核，據此評估該公司已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」所規定之創新板上市標準，且其產業未來前景及發展應屬可期，該公司可藉由申請創新板上市，透過資本市場募集長期發展所需之資金，並提高公司知名度及延攬優秀人才，對該公司永續經營及社會廣大投資人均有所助益，故本證券承銷商推薦該公司申請股票創新板上市。

貳、產業狀況及營運風險

一、發行公司所屬行業營運風險

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛公司或該公司)，成立於2002年，以開發先進電漿(Plasma)技術及製作各式電漿設備為營運主軸。電漿又稱做等離子體，是在固態、液態和氣態以外的第四大物質狀態。當氣體在高溫或強電磁場下，將促使氣體內的電子與中性原子互相撞擊，如此反覆撞擊並達到崩潰效應後，即形成由離子、電子與中性的原子或分子所組成的狀態，即為電漿。電漿具有高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，使得電漿在科學及工業技術中應用廣泛，包括半導體製程(蝕刻、清洗及表面改質等)、能源環保(核融合、廢氣廢水處理、創造乾淨新能源等)、醫療生技(醫材改質、消毒等)及日常消費性產品(如鞋業、高爾夫球、車用製品、紡織等)等各項領域。

該公司專注將電漿技術開發，憑藉優越的電漿製程及設備開發能力，專注於發展高效能的工業級表面處理解決方案，其產品應用於半導體產業，並聚焦於先進封裝領域，另亦專注於IC載板及印刷電路板(以下簡稱PCB)產業之應用，其他應用領域則有平面顯示器與LED等光電產業、新能源與環保產業、非電子業及民生工業等，並以各式製程間所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質為主。電漿清洗/蝕刻是一種經過驗證、有效、經濟且環保的關鍵表面處理方法，與傳統的濕式清潔方法相比，使用電漿進行離子清洗可藉由高溫或強電磁場使物質解離，釋放出離子和自由基，破壞樣品表面上有機污染物或無機物之鍵結，此時腔體中所通入的反應氣體離化產生正負離子、自由基等粒子，這些粒子會與有機污染物或無機物的鍵結結合，形成氣態之化合物如CO₂和H₂O，再藉由幫浦抽離腔體。電漿清洗優點在於不會造成環境污染，經電漿清洗，表面回歸未受污染狀態，可在無有害廢料情況下進行黏合或進一步製程。電漿蝕刻是製作半導體元件經常需要用到的技術，讓物件的表面用反應氣體來進行蝕刻，清除表面污染。表面的材料被蝕刻後，轉化為氣體並由真空系統去除，表面積增加可提高表面性能。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，半導體晶圓加工製程已由微米尺度微縮為奈米尺度之精準度，相關製程技術之規格亦愈來愈高。在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢，除於半導體製程不斷精進與突破之外，在ESG潮流趨勢下，乾式電漿蝕刻無污染之優勢，使其在其他新興產業之應用亦越趨廣泛。而電漿表面改質技術，則能於材料表面形成特定官能基，來達到黏合或接著度的需求。材料經電漿處理後，能於分子結構中，產生自由基，有助於改善材料表面之其他材料相容性。

茲就該公司及其子公司所屬產業概況及行業營運風險說明如下：

(一)產業現況

1. 半導體產業及設備

(1) 半導體產業

半導體產業為現代科技與經濟發展的核心趨動力，並廣泛應用於消費電子、通訊、汽車、工業設備及人工智慧(AI)等領域，其發展趨勢受多重因素影響，包

括技術創新、材料科學、政策變遷、商業模式演變及終端用戶需求等。半導體產業需要鉅額資金投入研發和製造，同時依賴高度專業的技術知識，具有相當高的進入門檻。產業鏈包括上游的 IC 設計公司專注於高效能半導體晶片的研發設計，國際代表性公司如英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)及超微(AMD)等；中游的晶圓製造與代工公司負責通過先進的製造技術將設計圖轉換為實際的晶片，國際代表性公司如台積電(TSMC)及三星(Samsung)；下游的 IC 封裝測試公司如日月光(ASE)負責將晶片進行封裝，確保其在使用過程中的穩定性和耐用性，並進行測試以確認每個晶片的功能和性能均符合標準。半導體設備產業則是在半導體製造及封裝過程中所需的各種設備和工具的總稱，包括製程設備(如光刻機、蝕刻機、去膠機等)和測試設備(如測試儀器、封裝測試等)，近年成長主要受到新興技術驅動，包括人工智慧(AI)、5G、物聯網(IoT)和自動駕駛技術等，以及更先進半導體製程節點所對應之高精密度製造技術的需求，催生了對於更高效能、更低功耗的半導體器件的需求，進而推動半導體設備的需求。

2023 年全球半導體產業進入景氣下行與調整期，隨著全球經濟放緩，終端市場需求顯著減弱，再加上供應鏈中的庫存過高，半導體市場呈現明顯衰退跡象，然而 2024 年隨著人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的蓬勃發展，NVIDIA、超微等 AI 伺服器用 GPU 需求仍強，而客製化的 AI 運算晶片以及支援 AI 運算的網通晶片也將成為高成長的產品；伴隨全球半導體景氣逐漸回溫，化合物半導體取其材料特性，在通訊、功率、車用、儲能等應用領域具備相當發展潛力。

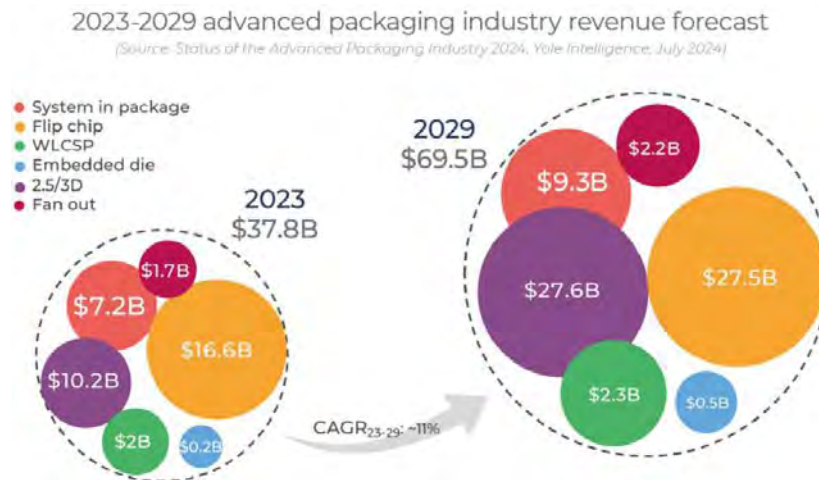
市場研究公司國際數據公司(IDC)2024 年 12 月最新發布的《全球半導體供應鏈追蹤情報》報告顯示全球對 AI 和高效能運算(HPC)的需求將繼續上升，2025 年全球半導體市場預估將增長超過 15%，記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI 加速器(AI Accelerator)需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 年下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。這意味著儘管整體半導體產業將持續擴展，但其增長重點將集中在高附加價值的技術領域，特別是記憶體和邏輯產品在未來的發展中將扮演更為關鍵的角色。全球半導體市場正逐步向先進技術轉型，未來幾年將進一步鞏固其在全球科技產業中的核心地位。

(2)先進封裝產業

先進封裝(Advanced Packaging)是將多個半導體晶片或器件整合到單一封裝中，與傳統封裝技術僅封裝單一晶片有所區別，並藉此提高系統性能、縮小體積、降低功耗、提升整合度。先進封裝技術可以透過在三個維度中排列多個晶片，並在晶片之間與過渡的積體電路中直接建立連接，以消除摩爾定律之製造瓶頸並降低成本，因此先進封裝技術在半導體產業中扮演著越來越重要的角色，尤其在需要高密度、高性能、高整合度的應用領域，如 AI、高性能運算、高效能通信等。根據 Yole Group 預估，2023 年先進封裝市場規模為 378 億美元，占

整體 IC 封裝市場的 44%，但成長速度明顯放緩，預計至 2029 年達到 695 億美元，複合年增長率為 11%(詳見圖一)。

圖一：2023-2029 年先進封裝產值及年增率預估



資料來源：Yole Group，2024 年 7 月

先進封裝市場參與者包括晶圓代工暨 IDM 廠，以及專業封裝測試(OSAT)廠商。台積電、英特爾、三星等領先晶圓廠投入巨資研發先進封裝技術(如台積電的 CoWoS、英特爾 Foveros 等)，大幅擴充先進封裝產能以承接 HPC/AI 訂單。同時，全球封裝代工產能主要集中於少數 OSAT 龍頭：日月光投控(ASE)為全球最大封測服務供應商，艾克爾(Amkor)與矽品(SPIL)分列第二、三位，前三大廠合計市占率約 40%。這些龍頭廠商憑藉晶圓級封裝(WLP)、覆晶封裝(Flip-Chip)等先進製程的佈局，營收增速持續領先業界平均。展望未來，各大廠無不將先進封裝視為兵家必爭之地，積極擴產佈局以保持技術與產能領先

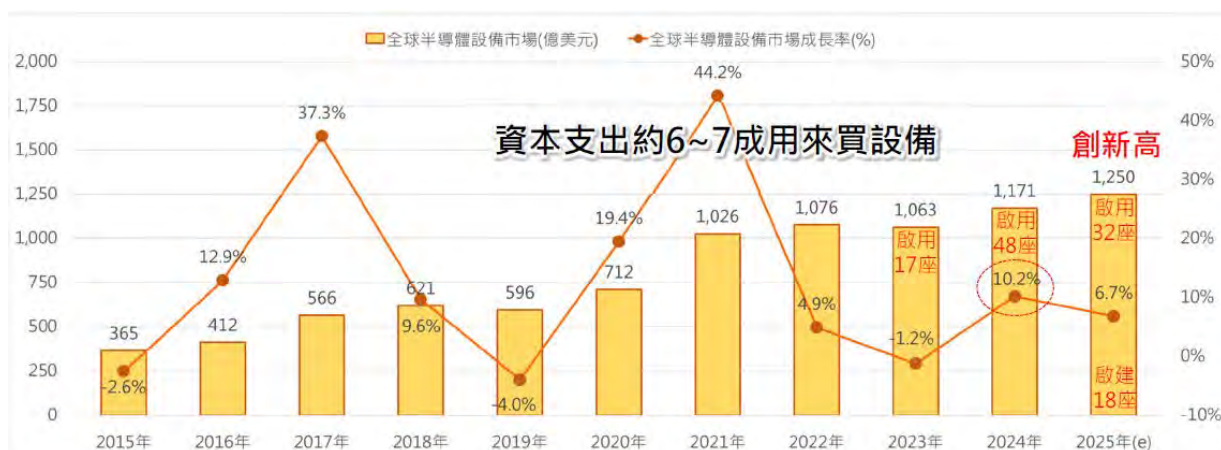
2023 年，全球先進封裝市場面臨挑戰，主要是受到消費性電子需求減弱的影響，包括智慧型手機、個人電腦與伺服器領域。根據 TechInsights 的分析，2023 年先進封裝市場收入下滑了 16.3%，為近年來最大跌幅之一。歷經 2023 年庫存調整，隨著終端市場復甦，以及 AI 裝置與資料中心對高效能與高輸出入能力的需求增加，2024 年先進封裝市場規模成長 3.7%。展望 2025 年，由於來自 AI 裝置與資料中心對高效能封裝解決方案的需求增加，TechInsights 預測先進封裝市場將增長 19.2%。Yole Group 亦預估，2025 年先進封裝市場規模將達到約 475 億美元，持續擴大在整體封裝市場的占比並達到 51.03%。

該公司聚焦於先進封裝所需的電漿乾式製程設備，並應用於 Hybrid Bonding、FOPLP 等先進封裝製程。根據 Yole Group 報告顯示(詳見圖一)，由於 AI、HPC、資料中心、感測器和行動裝置等領域需求提升，2.5D/3D 封裝技術(Hybrid Bonding 之應用)的市場規模預計從 2023 年的 102 億美元增至 2029 年的 276 億美元。此外，扇外型封裝(Fan-Out)技術的市場規模也將從 2023 年 17 億美元增至 2029 年 22 億美元。顯示該公司產品之應用具有極大潛力。

(3) 半導體設備

根據國際半導體產業協會(SEMI)公布之全球晶圓廠預測報告指出，2024 年全球半導體製造設備銷售額達 1171 億美元，成長 10.2%(詳見圖二)，主要是受惠先進製程、成熟製程、先進封裝和高頻寬記憶體(HBM)擴產，以及中國大幅增加投資，2024 年前段半導體設備市場顯著成長，晶圓製程設備銷售額增長 9%，其他前段設備成長 5%。後段設備部分，在人工智慧和 HBM 製造日趨複雜，以及需求不斷增加推升下，2024 年後段設備銷售額強勁成長，封裝設備增長 25%，測試設備增長 20%。從地區來看，中國、韓國和台灣仍是半導體設備支出前三大市場，合計占全球市場達 74%。中國產能積極擴張，加上政府強化晶片國內生產的各式計畫齊發，投資額達 496 億美元，較去年同比增長 35%，穩居半導體設備市場領先地位；第二大市場韓國的設備支出則因記憶體市場趨於穩定以及高頻寬記憶體需求飆升，小幅成長 3%，來到 205 億美元。相較之下，台灣設備銷售額受到新產能需求放緩影響，由 2023 年之 196 億美元下滑 16%至 2024 年之 166 億美元(詳見表一)。

圖二：全球半導體設備市場



資料來源：SEMI·MIC整理·2025年5月

表一：各地區半導體設備市場規模比較

單位：十億美元

Region	2024	2023	(YoY) %
China	\$49.55	\$36.60	35%
Korea	\$20.47	\$19.94	3%
Taiwan	\$16.56	\$19.62	-16%
North America	\$13.69	\$12.05	14%
Japan	\$7.83	\$7.93	-1%
Europe	\$4.85	\$6.46	-25%
Rest of the World	\$4.19	\$3.65	15%
Total	\$117.14	\$106.25	10%

資料來源：SEMI 及 SEAJ；2025 年 4 月

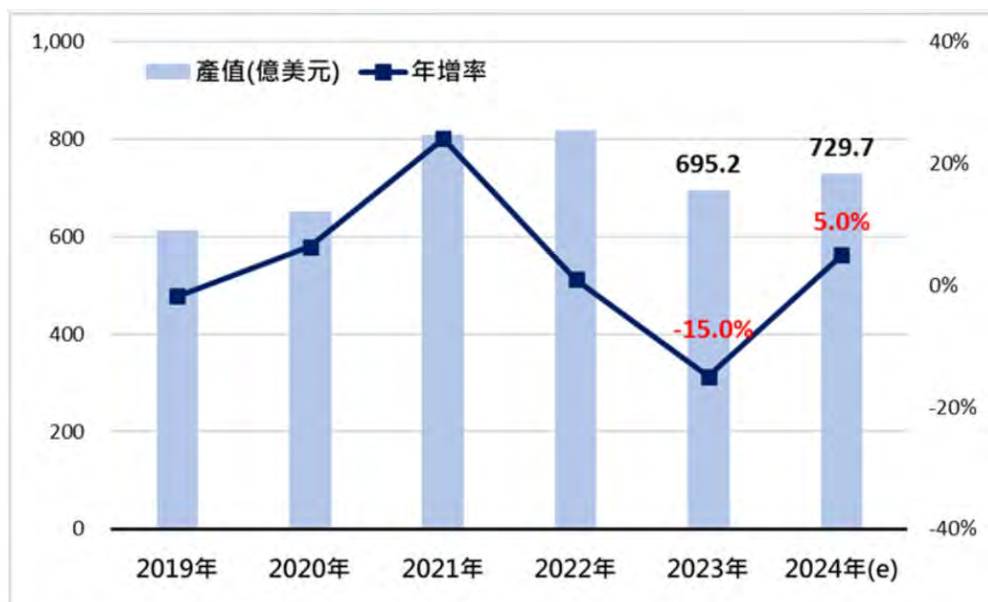
展望 2025 年，SEMI 預估晶圓廠設備支出將達 1,250 億美元，成長 6.7%，主要是因邏輯微元件(Logic & Micro)類別在 2 奈米製程和晶背供電技術(Backside Power Delivery Technology)等先進技術投資推波助瀾下，成為晶圓廠投資成長的關鍵驅動力。從地區來看，中國仍穩居全球半導體設備支出龍頭，然 2025 年總值為 380 億美元，較 2024 年總值 500 億美元下降 24%，台灣則為了滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求，晶片廠持續加強先進技術及先進製程推進，2025 年晶圓廠設備支出預估將達 210 億美元，較 2024 年總值 166 億美元成長 26.51%。

2.PCB 產業及設備

(1)PCB 產業

2022 年下半年以來，全球終端電子產品市場需求轉趨下滑，促使印刷電路板等電子零組件廠商開始進入庫存調整階段。2023 年面對終端消費意願疲弱，衝擊智慧手機、個人電腦等應用領域需求，IC 載板市場供需轉而呈現供過於求，車用板價格競爭加劇，故 2023 年全球 PCB 產業產值為 695.2 億美元，降至疫情前的水準，並較 2022 年衰退 15.0%(詳見圖三)。就 2023 年各項 PCB 產品產值表現觀之，IC 載板因 ABF 載板市場供需出現明顯反轉，產值年減幅度近三成，表現最為弱勢，軟板、硬板因智慧手機、個人電腦應用需求下滑、車用板價格競爭加劇，產值年減幅度相對較大；HDI 板雖受手機應用需求走弱，產值呈現衰退，但因車用需求相對具有支撐，AI 伺服器應用漸趨浮現，產值衰退幅度相對緩和。

圖三：全球 PCB 產業產值及年增率走勢



資料來源：Prismark、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2024 年 8 月

2024 年有鑑於消費應用回補庫存需求漸趨浮現，且汽車電子、AI 伺服器、AI PC 及低軌衛星等新興應用需求轉趨增溫，帶動 2024 年全球 PCB 產業產值止跌回升，根據國際研究機構 Prismark 的估計，2024 年全球 PCB 產業產值緩

步回升至 729.7 億美元，較 2023 年成長 5%(詳見圖三)；其中 HDI 板、多層板因車用、AI 應用及衛星應用需求增溫，估計 2024 年產值成長力道相對強勁；軟板及 IC 載板因手機復甦力道相對有限、市場供需仍未能回到平衡狀態，產值僅能呈現微幅反彈。

展望 2025 年，受惠於全球電動車市場規模持續成長、生成式 AI 應用風潮席捲全球，導入範圍逐步由伺服器、交換器等資料中心基礎設施設備逐步延伸至 AI 手機、AIPC 等消費性終端裝置，加上網通設備應用需求漸趨回溫、美系廠商持續投入低軌衛星的部署下，有望推升 2025 年全球 PCB 產業需求明顯增溫。Prismark 估計 2025 年全球 PCB 產值預估年增 6.2%，其中 HDI 與 IC 載板的年複合成長率將達 7.6%，顯示產品需求持續增長。產業趨勢方面，Intel 與 AMD 將推出新一代平台—Birch Stream 與 Turin，預計於 2025 年上半年進入小量生產，下半年實現量產。屆時，CCL 等級將升級至 M7，板層數進一步提升至 20 層以上，帶來 PCB 產業的全面換代升級，將不僅滿足新一代伺服器的高效能需求，亦將顯著提升相關供應鏈廠商的產品價值與市場競爭力。

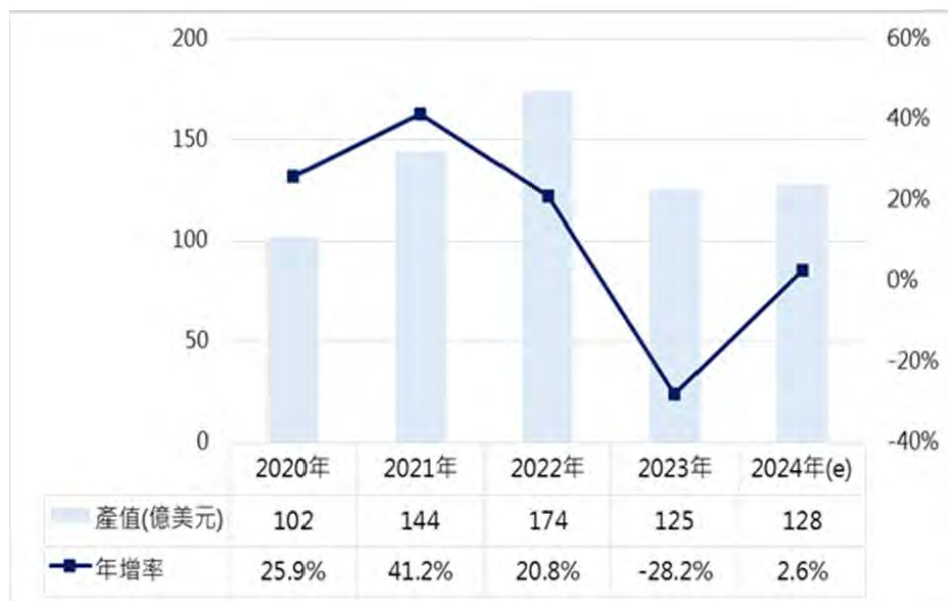
就我國 PCB 業在台灣境內生產之各細項產品銷售值變化趨勢分析，我國 PCB 製造業主要可區分為上游的銅箔基板，中游的印刷電路板、IC 載板，以及下游的印刷電路板加工，其中印刷電路板可進一步區分為多層板、軟板、高密度互連板(HDI)等產品，主要應用產品包括智慧型手機、筆記型電腦、汽車、穿戴式裝置、伺服器等產品，其中 HDI 受到 ADAS 自駕系統與高速傳輸 HPC 需求帶動占比漸增，而 IC 載板則應用於 CPU、GPU、記憶體、MCU 等，主要可作為半導體封裝測試的上游零件組件，故我國 PCB 業銷售值比重主要以印刷電路板及 IC 載板占最大宗，根據台灣經濟研究院產經資料庫資料顯示，2024 前三季分別達 53.48%及 29.28%，囊括八成以上的銷售市場。

綜觀 IC 載板的產品與應用，目前材質以 ABF、BT 為大宗，BT 主要用在記憶體、手機等，ABF 則是應用在客製化 IC(ASIC)、顯示卡(GPU)、中央處理器(CPU)、大型高端晶片等。觀察全球 IC 載板製造業，由於 HPC、5G、AI、資料中心使 ABF 載板需求激增，IC 載板產業於 2021~2022 年進行大規模擴產與設備投資，然受到通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致 PC、智慧手機等消費性應用需求自 2022 年下半年起明顯走弱，終端客戶進行嚴格的庫存修正，加上台廠新產能陸續開出，使得 IC 載板市場供需出現反轉，轉而呈現供過於求的態勢，而各國央行持續升息、全球經濟景氣成長力道放緩，科技大廠陸續進行裁員，導致企業下修資本支出，促使伺服器、網通設備等需求下修，更進一步衝擊 IC 載板市場需求。2024 年受惠於生成式 AI 風潮席捲全球，主要雲端服務大廠積極導入 AI 伺服器，帶動 AI 伺服器及高頻寬記憶體(HBM)出貨漸趨放量，推升高階載板需求增溫，加上終端庫存去化告一段落，回補庫存需求浮現，加上品牌大廠競相推出 AI 手機有效刺激市場需求復甦，BT 載板出貨表現呈現止跌回升，推升 2024 年全球 IC 載板產值止跌回穩。根據 Prismark 的估計，2024 年全球 IC 載板產值緩步回升至 128 億美元，較 2023 年微幅成長

2.6%(詳見圖四)，漸趨走出 2023 年大幅衰退的陰霾。ABF 載板部分，2024 年受到歐美電信商 5G 投資高峰已過，資本支出多聚焦於資料中心相關應用，電信設備投資相對審慎，在庫存難以去化之下，網通應用需求明顯下滑，加上 AIPC 效應並未明顯發酵，PC 應用需求仍顯疲弱，以致 ABF 載板市場仍持續面臨供過於求的挑戰，進而使得全球 IC 載板產值雖重回成長軌道，但復甦力道相對有限。

然有鑑於生成式 AI 風潮席捲全球，GPU 效能不斷提升，引領 AI 伺服器逐步崛起，且 AI 應用逐步由伺服器延伸至高階交換器、AIPC、AI 手機等。為滿足高階運算需求，驅使小晶片(Chiplet)、先進封裝需求隨之攀高，使得高階 ABF 載板面積放大至 120mmx140mm，層數提升至 28 層以上，朝向大面積、多層數、細線路方向發展，顯見 ABF 載板生產難度明顯提高，在半導體先進製程中扮演的角色更顯重要，因而吸引 Ibsiden、SEMCO、臻鼎、欣興、南電等國內外 IC 載板廠商積極搶進，爭取高階 ABF 載板市場商機。展望 2025 年，受惠於各國積極鼓勵 AI 資料中心的建置，帶動 Nvidia 旗下 GPU 出貨持續增溫，加上 AWS、Microsoft、Meta 及 Google 等美系雲端服務大廠持續投入自研 ASIC 的開發，資料中心加速導入 800G 交換器，均有助於推升高階 ABF 載板需求的持續增溫。

圖四：全球 IC 載板產值及年增率走勢



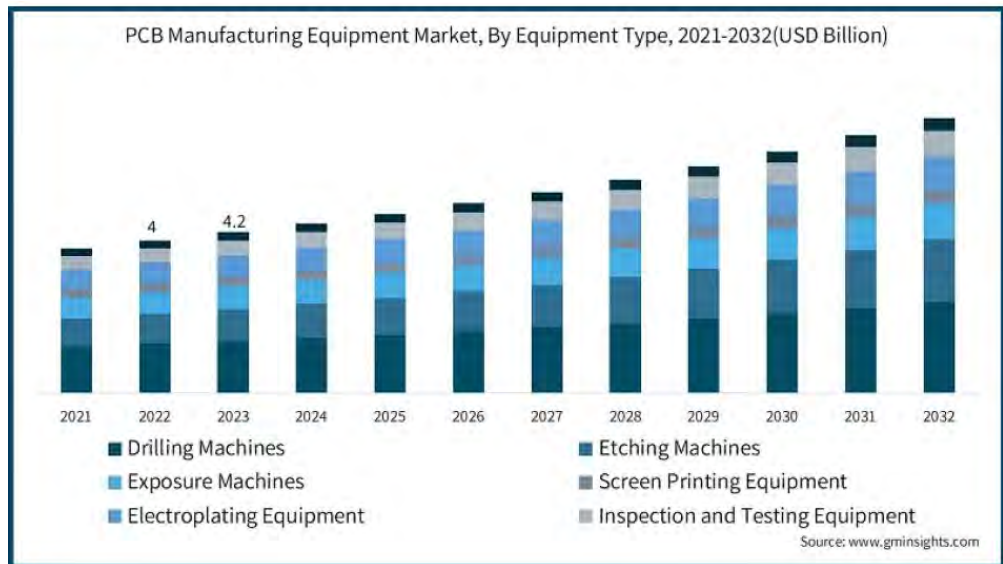
資料來源：Prismark(2024.09)、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2025 年 1 月

(2)PCB 設備

隨著電子產品日益輕薄短小與功能複雜化，PCB 產業持續升級轉型，帶動 PCB 設備市場穩定成長。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球 PCB 設備市場規模在 2024 年達 42 億美元，預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算(HPC)、電動車(EV)及先進封裝等新興應用領域。

PCB 設備依製程階段可大致分為鑽孔機、蝕刻機、曝光機、電鍍與化學處理設備、AOI 光學檢測系統、自動化搬運設備(如上下板機、輸送帶)等。近年來，以雷射鑽孔機、蝕刻機及 LDI(Laser Direct Imaging)曝光機為代表的高階設備需求快速上升(詳見圖五)，特別是在 HDI、載板(IC Substrate)、類載板(SLP)等製程中扮演關鍵角色。其中蝕刻機為 PCB 製造過程中關鍵的核心設備之一，無論是傳統多層板製程或先進 IC 載板製程，皆高度依賴濕式與乾式蝕刻設備來精準移除導體層，形成精細電路圖形。隨著線寬微縮與高密度需求提升，蝕刻設備的自動化、均勻性控制與化學品管理能力成為投資重點。蝕刻設備廠商持續投入模組化蝕刻線與智慧製造技術，提升良率與產能效率，未來占比預期仍將維持高位。

圖五：各類 PCB 製造設備市場規模



資料來源：Global Market Insights，2024 年 11 月。

未來，隨著 ABF 載板產能擴張、AI 伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階 PCB 設備的投資比重。設備商亦積極導入自動化、數位監控與智慧製造技術，提升產能效率並強化良率控管。整體而言，PCB 設備市場正逐步由傳統標準機種轉向客製化與智能化發展，產業競爭力與技術門檻同步升高。

我國 IC 載板產業於 2021~2022 年進行大規模擴產與設備投資，自 2022 年下半年起受到全球通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致 PC、智慧手機等消費性應用需求明顯走弱，呈現供過於求的態勢，導致企業下修資本支出。根據台灣印刷電路板協會(PCA)統計，我國 2023 年 PCB 設備產值為 560 億元，較 2022 年減少 16.8%。來到 2024 年，隨著 AI 應用之 PCB 製程設備對高層與高密度之需求提升，2024 年台灣 PCB 設備產值規模達 595 億元，年成長 6.3%，有谷底復甦之態。展望 2025 年，在高階製程與東南亞新產能陸續量產推動下，2025 年我國 PCB 設備產值預估為新台幣 639 億元，年成長率達 7.4%，我國 PCB 設備業預計將持續擴張。

3. 電漿設備

電漿由於其高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，因此在各項領域應用廣泛，然而由於電漿設備通常對於真空環境、電源供應穩定性要求高，導致設備成本造價昂貴，企業若未具一定資本門檻將難以大量採用，而隨著科技技術的進步，以及受電子、醫療保健和製造等行業對先進材料日益增長的需求推動，電漿技術廣泛的應用潛力逐步受到重視，全球電漿設備市場預計將逐步成長。根據研調機構 VMR(Verified market Report)指出，2024 年電漿設備市場規模達 45 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 5.5%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 72 億美元。

依照各應用領域區分，根據 VMR 報告指出 2023 年電漿設備市場應用中，工業領域占比 50%，商業占比 30%、住宅占比 15%，其他應用占比 5%。其中工業領域涵蓋半導體、汽車、航空航太等工業科技產業。工業領域中，智慧型設備和自動化的興起進一步刺激了對電漿設備的需求。電漿技術的創新提高了電子設備所用組件的性能和效率，使製造商能夠生產出更小、更強大的設備。電漿處理製程是這一領域的關鍵，它可以改善材料的表面特性，確保更好的附著力、潤濕性和產品的整體性能。這項工藝在汽車、航空航太和包裝等各行業中都不或缺。根據 VMR 報告，由於電子、航空航太、汽車和醫療保健等各行各業對高精度清潔解決方案的需求不斷增長，電漿表面處理設備於 2024 年市場規模為 12 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 9.2%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 25 億美元。

電漿技術的跨產業應用在電漿表面處理市場方面發揮重要的作用。在電子產業，電漿表面處理設備對於在組件組裝前去除基材上的污染物，以確保其可靠性能。在汽車行業，塗層和黏合過程之前，電漿可用於表面處理。在醫療保健領域，電漿表面處理設備用於準備手術器械和醫療器械，以確保無菌性和病患安全，在紡織業，低溫電漿在處理防護衣和無菌材料的親水化過程中發揮重要作用，有助於減少微生物。若按設備類型劃分，市場份額最大的是電漿蝕刻設備，約占 45%，其次是電漿改質清洗設備占 35%，電漿沉積濺鍍設備占 20%，其中電漿蝕刻及電漿改質清洗設備為半導體及 PCB 產業最為關鍵重要的製程之一，且由於晶片製造技術的進步，需要更為精密的表面處理技術，使半導體產業占有電漿表面處理設備市場的最大份額，占比約為 40%。

然而，由於電漿表面處理設備在輕量化材料和電動車零件中的應用日益增多，預計汽車產業將以最快的速度成長，2023 年至 2030 年的複合年增長率將達到 9%。此外，醫療保健產業在滅菌和醫療器材製造中對電漿技術的日益依賴，也推動了市場的成長，低溫電漿(cold plasma)由於能消滅細菌，尤其是抗藥性菌株，使得電漿成為有助於預防感染疾病和治療慢性傷口的解決方案。近年，隨著各行各業持續專注於永續發展，電漿表面處理製程提供比傳統清洗方法更環保的替代方案，可最大限度地減少浪費和有害化學品的使用，電漿技術更已擴展至新能源、綠色科技與環保應用，例如在氫能產業中，低溫電漿被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。為了

遵守嚴格的行業法規和標準，越來越多的企業採用電漿表面處理解決方案，以確保最佳的表面處理和附著力，從而降低產品故障相關的風險，電漿表面處理設備市場需求及應用未來將更為廣泛。

(二)所屬行業之營運風險

茲就該公司提供之服務及產品所屬行業，分別說明景氣循環、行業上下游變化、行業未來發展及產品可替代性等對其之營運風險如下：

1.景氣循環之營運風險

該公司業務係多以應用於半導體晶圓封測產業及 PCB(IC 載板)產業之電漿設備之研發、製造與銷售為主，所生產之電漿設備主係銷售予國內外半導體廠商與 PCB 製造大廠，故該公司業績較易受到半導體產業及 PCB 產業資本支出需求狀況影響。此外，受到全球通貨膨脹、俄烏戰爭與各國陸續升息等因素影響，消費性產品需求轉為疲弱，造成廠商庫存水位上升，半導體產業及 PCB 產業亦受到總體經濟環境影響而波動。惟該公司持續精進電漿設備應用於半導體封測設備及 PCB 製程設備之技術研發，延伸其產品應用，切入先進封裝及半導體蝕刻製程，加上未來 5G、HPC、AI 等技術發展使得半導體市場及 PCB 市場規模可望持續擴大，將帶動相關資本支出增加，有利於電漿設備出貨增長，且該公司持續開發電漿新應用，切入新能源製氫領域，以降低單一產業景氣影響，故該公司受景氣循環所面臨之營運風險尚屬有限。

2.所屬行業上、中、下游變化之營運風險

電漿設備之上游為材料供應商，其零組件依據功能別可概分機構部品、電控部品、真空部品及加工部品，其中又以機構部品所占產值較大，包含真空腔體及骨架等，中游則為電漿設備設計、開發、製造及組裝，再銷售至下游半導體晶圓廠、封測廠、PCB 廠、新能源與環保產業及其他產業等，詳細之產業關聯圖如下圖所示：

上游

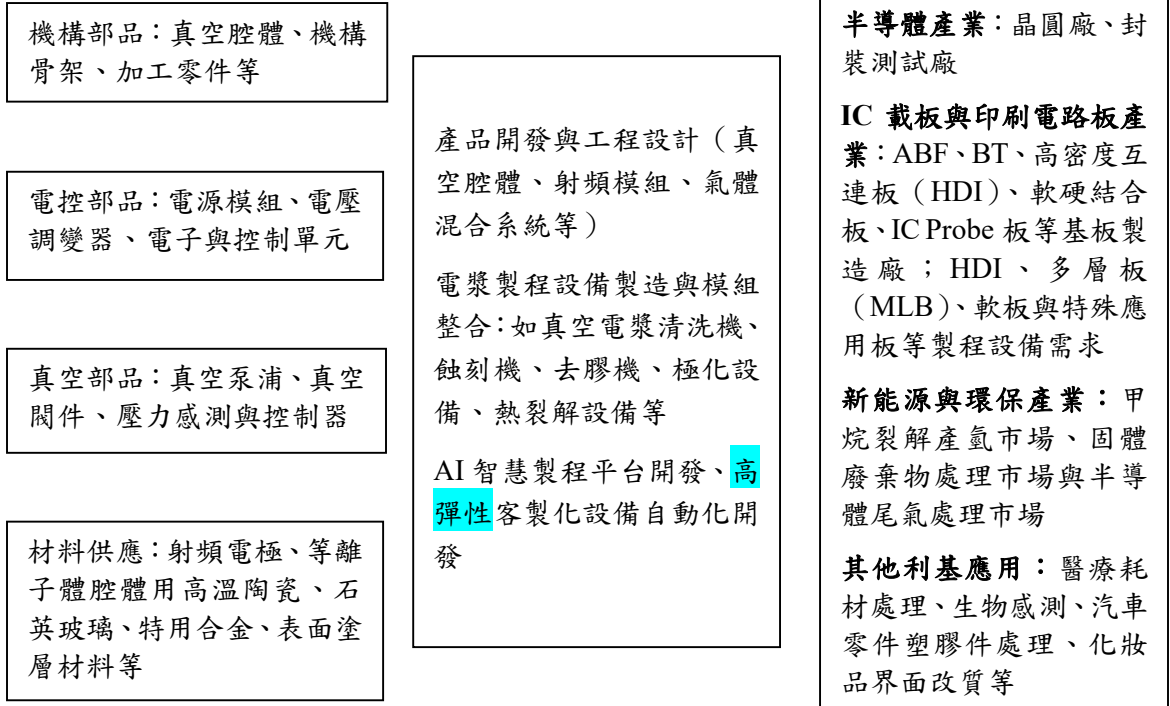
中游

下游

零組件、材料與模組供應商

電漿設備之設計、整合與製造

銷售對象



資料來源：該公司提供

3. 該行業未來發展之趨勢

該公司致力於電漿表面處理技術開發及電漿設備製造，其產品應用聚焦半導體先進封裝產業及 PCB 產業，近年亦開發新能源與環保產業應用領域，其電漿設備主要係用於各式製程間所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質。茲就其各應用領域之未來發展趨勢說明如下：

(1) 電漿技術應用新領域

電漿技術作為一種先進的材料表面處理與改質工具，廣泛應用於半導體製程、PCB 製程、汽車工業、航太領域以及醫療領域中。隨著全球 ESG 趨勢及綠色產業發展，電漿技術正逐步擴展至新能源、綠色科技與環保應用。例如在氫能產業中，低溫電漿(Cold Plasma)被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。此外，柔性電子、顯示器、可撓式太陽能電池等新興材料與製程對低溫、非破壞性加工技術的需求日益上升，電漿技術的優勢更加明顯。未來隨著設備成本降低與應用技術成熟，電漿有望在更多高附加價值的領域發揮其潛力。

(2) 先進製程持續演進

隨著 AI、5G 技術裝置的快速發展，HPC 需求增長推動更高效能及更低功耗的半導體製造技術，隨著摩爾定律在物理限制上瀕臨極限，各大半導體大廠

轉向透過先進封裝技術及創新晶片架構等發展，其中先進封裝在一個封裝內整合多種晶片與元件，透過將晶片與其他元件緊密結合，減少互連的距離，從而降低延遲並提高數據傳輸速度和整體性能，為連接 IC 及 PCB 尺度差異的關鍵技術，隨著 2.5D/3D IC 封裝技術、扇外型晶圓級封裝(FOWLP)、扇外型面板級封裝(FOPLP)及 Chiplet 架構快速發展，電漿技術由於其較高的介面附着力、以及可精準控制蝕刻深度與表面改質，將在多晶片整合、先進接合製程與低溫封裝應用中扮演更重要的角色，進一步提升半導體元件的性能與可靠度。根據市場調研機構 YOLE 的報告，先進封裝市場將於未來幾年快速成長，市場規模將由 2023 年 378 億美元至 2029 年達到 695 億美元，複合年增長率為 11%(詳見圖一)。

過往 PCB 及 IC 載板產業在載板封裝過程中對於精度要求較低，乾式製程由於成本高、生產效率較低，業界普遍採用傳統濕製程，隨 AI、5G 熱潮崛起，為滿足高階運算需求，驅使小晶片(Chiplet)、先進封裝需求隨之攀高，使得高階 ABF 載板朝向大面積、多層數、細線路方向發展，必須具備更高密度、更精細線路與更優異的電氣特性才能配合。乾式電漿蝕刻技術相較傳統濕式技術可實現高度精確的蝕刻，可以在微米和奈米尺度上創建結構和圖案，提高訊號線寬及線距之精度，並支援微細圖形製程，逐漸為 IC 載板廠所採用；PCB 產業在邁向高階 HDI/mSAP 板領域所用電路需要非常細小的微盲孔，化學液體難以完全清洗，常造成殘膠與污染，乾式去膠渣由於可深入孔洞清潔，因此乾式製程亦逐漸被導入，因此在製程技術不斷提升下，各廠商對於電漿技術設備需求將持續增加。

(3)新產品應用需求旺盛

新產品應用需求正以空前速度成長，受惠於技術變革與市場需求的強力驅動。隨著智慧型手機持續向 5G 普及化邁進，未來 6G 與 7G 技術將進一步推動手機功能與電池效能的升級，並結合人工智慧應用服務，帶動智慧型手機市場發展。同時，物聯網應用日益多元，從穿戴式裝置、醫療監測到智慧家庭與智慧城市等領域需求持續增加。電動車市場快速擴展，加上先進駕駛輔助系統(ADAS)與車用電子系統升級，使每輛車子半導體用量大幅攀升。這些新興應用皆需仰賴高效能半導體產品，亦推動高階 IC 載板需求持續成長。未來在高速運算、人工智慧及電動車等應用推動下，半導體及 IC 載板製程技術將持續升級，並為相關設備與材料供應商創造龐大商機。

4.產品可替代性之營運風險

電漿技術於現代工業應用極廣，尤其在半導體產業及 PCB 產業中扮演關鍵角色，其主要應用於表面處理、清潔、蝕刻及薄膜沉積等製程，與傳統的濕式技術相比，電漿技術具備環保無污染、高精度控制、低溫製程及材料選擇性高等特點，由於全球 ESG 趨勢發展下各國政府訂立日趨嚴格的環保政策，電漿技術逐漸成為製程首選。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，半導體為追求元件積集密度並降低功耗而不斷微縮，

相關製程技術之規格亦愈來愈高，在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢下，乾式電漿蝕刻技術相較濕式技術可實現高度精確的蝕刻，可以在微米和奈米尺度上創建結構和圖案，因此逐漸成為半導體廠首選。在未來 AI、5G 技術、物聯網(IoT)、電動車、高效能運算(HPC)及新能源等新興技術蓬勃發展，以及 ESG 潮流帶動下，電漿技術應用將更為廣泛，其相關產品尚無被替代之風險。

二、發行公司營運風險

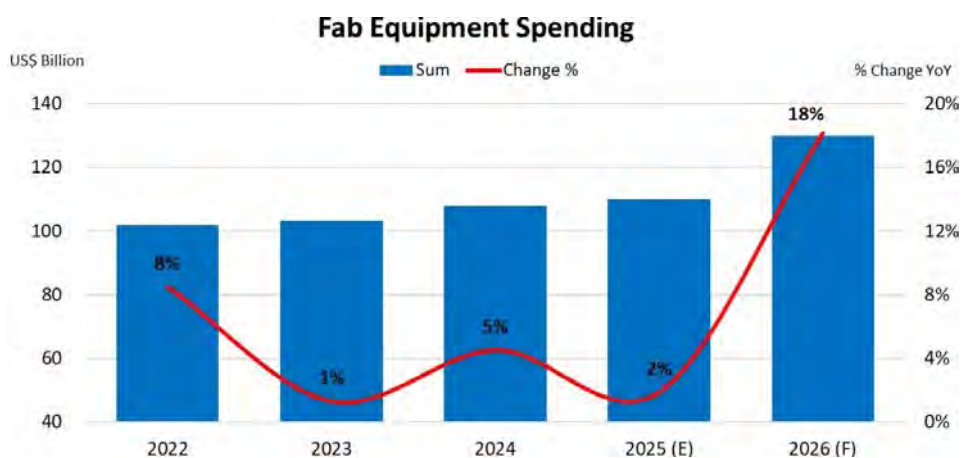
(一)業務之營運風險

1.市場未來供需變化情形

(1)半導體產業

該公司成立以來，半導體產業以後段封裝應用客戶為市場開發重點，近年來亦開發多款電漿蝕刻設備，逐漸將版圖擴展至半導體前段晶圓廠客戶。乾式電漿蝕刻技術於半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，相關製程技術之規格亦愈來愈高，隨著半導體廠商競爭先進製程研發，也使製程所需設備成為大廠擴建產能的產業發展關鍵。根據國際半導體產業協會(SEMI)統計(詳見圖六)，由於高效能運算(HPC)和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動，更受惠於 AI 人工智慧整合度不斷提高，從而讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升，全球用於前端設施晶圓廠設備支出預估將在 2025 年成長 2%至 1,100 億美元，2026 年更將一舉成長至 1,300 億美元，成長 18%。我國方面則受惠於高效能運算(HPC)應用帶動先進製程節點推進擴張和記憶體市場復甦，設備支出預計將從 2024 年的 166 億美元增加到 2025 年的 210 億美元，2026 年更再增加至 245 億美元，因此在全球半導體業者資本支出增加下，以及國內業者競爭力提升下，預計 2025 年我國半導體生產用設備及零組件業的銷售值可望上揚。

圖六：全球晶圓廠設備支出及成長率預估

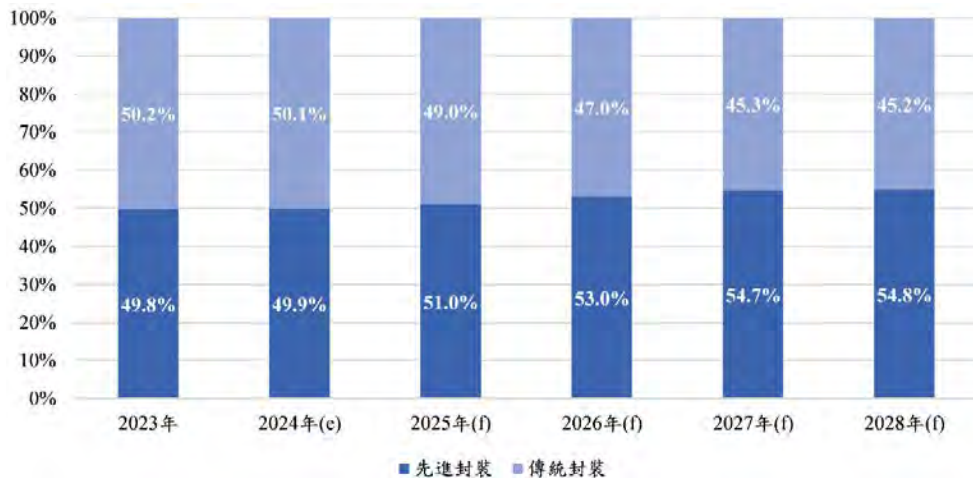


資料來源：SEMI，2025 年 3 月

半導體封裝方面，受惠於 AI、智慧汽車、5G 通訊等技術的發展，使得終端客戶對於高效能、低功耗晶片需求增加，進而帶動先進封裝需求顯著成長，根據工研院產科國際所估計，2025 年先進封裝市場規模比重將超過傳統封裝，達

51.0%，且比重將逐年增加(詳見圖七)，為了因應龐大需求，世界主要晶圓代工廠和封測廠正共同加速先進封裝技術的投資，晶圓龍頭大廠台積電宣布 2025 年資本支出達 380~420 億，其中 10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。國內封測大廠日月光及力成等亦紛紛投入 2.5D、3D、FOPLP 等封裝技術，國外封測廠 Amkor 則預計 2025 年資本支出約 8.5 億美元，其中 70%用於擴展 2.5D、SiP、RDL 等先進封裝技術，顯示該技術趨勢明確，半導體封測業者普遍加大 2025 年對先進封裝技術的投資。該公司所開發之電漿清洗設備及電漿蝕刻設備可應用於先進封裝基板之表面處理，隨著先進封裝市場持續擴大，對於公司業績可望帶來助益。

圖七：全球半導體封裝市場規模比重分布概況



資料來源:工研院產科國際所，台經院產經資料庫整理，2024 年 10 月

(2)PCB 產業

該公司提供 PCB 製程的電漿表面處理與微蝕刻設備，並且針對 ABF 載板製造開發了全乾式電漿處理技術，包括電漿清洗設備、電漿鑽孔設備及電漿蝕刻設備。為了因應地緣政治的趨勢，大多數的 PCB 廠都已赴東南亞建廠，部分新廠已在 2024 年完工，2025 年進入設備導入的支出高峰期，新產能的貢獻在上半年陸續驗證後，下半年可望加入量產行列。PCB 廠龍頭臻鼎泰國新廠第一期將於 2025 年試產，同時第二期廠房也將動土，再加上高雄 AI 園區及中國廠區再擴充，2025 年估資本支出達約 250 億元。PCB 廠高技為迎合快速增長的急單需求和長期訂單積極擴充產能，預計 2025 年資本支出約 10 億元，較 2024 年大幅增加三倍以上。IC 載板廠方面，由於 2019-2022 年的大幅度擴廠，2025 年載板市場雖會自谷底回溫，但仍未完全復甦，包括欣興、南電、景碩資本支出都會較 2024 年減少，但以欣興來說，2025 年資本支出仍有 186 億元的水準，載板約占 45%。

展望未來，隨著 ABF 載板產能擴張、AI 伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階 PCB 設備的投資比重。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球 PCB 設備市場規模在 2024 年達 42 億美元，預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算(HPC)、電動車

(EV)及先進封裝等新興應用領域傳統。該公司專注於高階 IC 載板及 HDI 板之設備應用，未來市場需求仍然可期。

2.該公司在同業間之地位及市場占有率

(1)市場占有率

該公司為生產各式電漿設備之專業廠商，主要應用於半導體先進封裝、IC 載板、及 PCB 等電子產業，目前國內的競爭者有志聖、友威科、鈦昇及燿鼎等，國外則是有韓商 Jesagi Hankook Ltd、美商 Nordson March 及日商日新離子機械株式會社、中國商珠海寶豐堂半導體(股)公司。依研調機構 VMR 報告，2024 年全球電漿蝕刻及電漿改質清洗設備市場規模達 9.6 億美元，根據美國國家稅務局(IRS)公布 2024 年平均匯率 32.117 換算為新台幣 308 億元，該公司 2024 年電漿設備銷售金額為 4.9 億元，在全球市場的市占率約為 1.59%，整體而言仍有極大的成長空間。

(2)該公司在同業間之地位

該公司主要核心業務係各式電漿設備之研發、生產及銷售，綜觀目前國內公開發行以上之公司，尚無與其從事完全相同業務之同業公司可供比較參考，故就該公司之產品性質、營運模式及應用領域等因素予以綜合考量後，僅能選取產品性質及應用領域較為類似之上櫃及上市同業，包括志聖、友威科及鈦昇之三家公司，惟各廠商之經營模式、專精領域、營運規模皆有所不同，整體觀之，以該公司 113 年度及 114 年第一季之營收成長率觀之，均低於採樣同業，主要是 IC 載板客戶積極擴廠後供過於求，使得其供應鏈之 IC 載板產業景氣亦隨之受影響，相關資本支出計劃亦隨之延宕，致該公司整體營業收入下滑。

單位：新台幣千元；%

公司名稱	主要產品	資本額 (114 年 3 月底)	合併營業額				
			112 年度	113 年度		114 年第一季	
			金額	金額	成長率	金額	成長率
暉盛(7730)	各式電漿設備之研發、生產及銷售、各式電漿設備之零配件銷售	288,598	762,039	547,630	(28.14)	83,131	(47.28)
志聖(2467)	生產電漿製程、紫外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈及濕製程設備之生產及銷售	1,567,553	3,625,801	4,818,209	32.89	1,309,089	21.21
友威科(3580)	真空濺鍍設備及真空鍍膜代工	394,707	744,579	660,171	(11.34)	91,433	(10.84)
鈦昇(8027)	自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務	1,083,814	1,549,374	1,644,908	6.17	314,912	9.40

資料來源：各公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核或核閱簽證之合併財務報告。

3.影響該公司未來發展之有利與不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

A.產品微細化

電漿解決方案為微米級，乃至於奈米級的乾式環保處理方式，隨著電子產品日趨精細，傳統濕式(酸液或鹼液)處理方式已逐漸無法因應，以印刷電路板產業為例，盲埋孔孔徑日漸縮小，酸液或鹼液進入孔內難度增高，因而無法完全將孔內膠渣清除乾淨。電漿係採用原子級的離子或自由基來進行膠渣的處理，因此電漿製程可以處理極小孔徑，引進電漿製程有其必要性。該公司為專業電漿技術及設備開發製造商，具有領先之電漿製程技術，先進製程產品為提高效能而走向奈米級，將可望持續提升電漿製程的重要性。

B.半導體及先進封裝產業持續成長

受AI、高效運算(HPC)、5G、自駕車、物聯網(IoT)等應用驅動，全球半導體產值持續增長，在製程技術講究高效率及低能耗趨勢下，先進封裝技術需求擴大，該公司之產品如高效能電漿去膠渣機、晶圓清洗蝕刻機、極化處理模組等已具多國客戶導入實績，提前為下一代先進製程提供關鍵解決方案，隨著FOPLP、FOWLP、CoWoS、Hybrid Bonding、晶圓再生、Chiplet結構等先進封裝技術逐步導入量產，對乾式表面處理的需求持續上升。因此，即便全球總體經濟仍存在不確定性，隨著人類文明持續追求高度智慧化及便利性的科技產品，將提供半導體產業更大的商機及成長機會。

C.環保要求日益嚴格，電漿製程符合ESG趨勢

隨著各國政府日趨嚴格的環保政策，傳統濕式處理方式面臨廢液處理、化學品大量消耗、高能耗、佔地及人力需求大的不良因素，電漿處理方式是低能耗的製程方案，例如IC載板大廠目前針對ABF載板蝕刻係採乾溼製程並行，惟該公司針對ABF載板開發了全乾式電漿處理技術，可提升蝕刻速率，並可精確控制表面粗糙度，可有效降低能耗，減少了傳統化學濕製程對環境與良率的負面影響，因此未來IC載板廠採用全乾式電漿處理市場潛力龐大。除了降低能源損耗及碳排放外，該公司自研之高效電漿火焰處理設備可應用於甲烷裂解產氫與PFC廢氣分解、醫療/工業廢棄物即時裂解等領域，可用來進行除碳創造乾淨能源，因此乾淨的乾式電漿處理方式可提供更環保的解決方案。因此，全球的節能減碳趨勢成為企業供應鏈選擇的重要指標，由於綠色製造與低碳技術需求增加，電漿應用有機會成為關鍵方案，將有助於該公司取得國際大廠的供應鏈機會。

D.工業4.0及生產監控需求

全球企業和供應鏈因應產品精細化避免污染特性、生產有效管理、節能減碳及降低人力等需求，客戶逐漸重視工業4.0及生產監控的引進。該公司10多年前已進行生產監控標準的軟、硬體開發，可望迅速地滿足客戶關於生產

監控的需求，並提高新的競爭者的跨入門檻。

E.各國半導體供應鏈在地化

半導體現今已成為重要戰略物資，各國紛紛推動晶片生產在地化，美國2022年推出規模達527億美元的晶片與科學法案(Chips and Science Act)，其中390億美元將用於補助興建半導體廠房及購置設備，132億美元用於先進製程的研發與人才培訓；歐盟則於2022年通過規模430億歐元的歐盟晶片法案(European Chips Act)，將用於半導體製程研發與建廠補貼；日本政府修訂了其半導體戰略，目標是到2030年，將國內生產的半導體銷售額增加兩倍至15兆日元以上，將晶片置於其經濟安全政策的核心位置；中國政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高10年免稅，全力推升成熟製程晶片市場的發展。因此在各國強力發展半導體產業下，對於半導體設備需求日漸升高，將對半導體設備廠商增添營運成長動能。

(2)不利因素及因應對策

A.人才取得及留任

該公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，公司之規模及品牌不及該區域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為公司挑戰及努力的方向。

因應對策：

該公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對公司的認可與向心力，以降低員工流動率。公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

B.客戶對國產設備信心不足

國內半導體客戶過去習慣使用進口設備，對國產設備的信心度有待加強，對成熟製程更換設備的動機不足，對先進製程使用國產設備的信心不足，需要時間跟使用經驗逐步轉變觀念。

因應對策：

該公司在累積多年半導體設備經驗後，已自行研發出先進封裝感應耦合電漿蝕刻設備、自動化線上電漿製程系統及電漿晶圓清潔設備等設備，且生產過程中大多使用國內生產之原物料，供貨短缺或中斷的風險較低。該公司之設備，已成功打入各產業的標竿企業，建立市場形象及客戶信心，未來以標竿企業的口碑來進行業務推廣，將可進一步打開市占率。

C.營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

該公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此該公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應對策：

(A)該公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。

(B)該公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

4.競爭利基

(1)研發團隊完整且經驗豐富

該公司目前經營及技術團隊在電漿技術領域已有 20 年以上之產業經驗，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，並充份了解產品製程所需面對之問題，即時提供客戶專業電漿技術解決方案，並建構專業實驗室，配備完整測試設備，全方位支援客戶進行樣品分析與製程研究，對該公司現有產品推廣、新產品開發具有相當助益。

(2)自有先進電漿技術與專利

該公司以自主開發高密度電漿源結構、多階段電場控制系統、真空腔體設計與複雜製程整合，及高度複雜製程整合能力，涵蓋清洗、蝕刻、活化、極化及高溫裂解等應用，導入半導體晶圓、先進封裝、IC 載板、PCB、感測器模組市場，並運用所開發之高效電漿火焰技術進入新能源產業及廢棄物處理等循環經濟領域之創新技術開發，另該公司於 ABF 載板領域開發高均勻、高選擇及高精度之乾式蝕刻製程技術，可處理大面積 850×750mm 載板規格，領先業界 700x700mm 規格，同時亦切入 Hybrid Bonding 及再生晶圓薄膜去除技術，並取得國內大廠採用。該公司各式電漿技術均積極取得相關專利與認證，並取得經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)認可並核定補助，以確保該公司電漿設備與技術領先業界，並持續開發符合市場趨勢之利基市場新產品，避免成熟領域削價競爭。

(3)市場進入門檻高，供應鏈競爭居領先地位

該公司針對產業鏈的上游歐美或日本著名品牌客戶，於產品開發階段即密集進行電漿技術討論、測試、合作與認證，協同客戶共同開發合作取得設備的各式安規、環保、電氣法規認證，及早進入市場以提高競爭者的進入障礙，且一旦取得認證，客戶為確保製程穩定，亦不易更換供應商，以確保該公司在該產業鏈的銷售地位。

(4)產品組合與跨領域應用

該公司以高密度電漿乾式表面處理製程技術平台為核心，將自主設計的基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空與溫控系統等依需求彈性，搭配結合成為高度可擴展性的設備模組系統，並根據不同應用領域進行模組重組與流程優化。該公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域，同時在半導體先進封裝、IC 載板及 PCB 乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使該公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用該公司電漿設備等實績中，顯示該公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

(二)技術能力、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見佐證

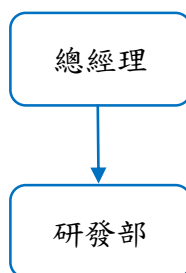
本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就其技術研發能力出具意見或報告，故不適用。

2.研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近期及最近二個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對發行公司之營運風險

(1)研究發展部門之沿革及組織

該公司成立於民國 91 年，專注於半導體與印刷電路板等產業之電漿設備應用開發，向來重視核心技術能力的研發與創新，並積極延攬具專業背景之研發人才。研發團隊由總經理親自領軍，成員涵蓋化學工程、電子工程、材料科學工程等領域之專家，長期深耕於電漿技術應用的研究與創新，並積極拓展新興應用領域。在產品設計與開發方面，研發部門亦與生產部門之電控及機構設計單位密切合作，透過跨部門協同研討，共同推動能靈活匹配客戶製程參數需求之產品開發與技術應用。以下為該公司研發單位之組織架構與主要職掌說明：

A.研發部門組織圖



資料來源：該公司提供

B.研發單位職掌

部門	工作職掌
研發部	<ul style="list-style-type: none"> ◆新技術與新產品之研發規劃、原型機測試及導入生產製程 ◆協助生產製程及產品品質改進 ◆協助技術發展優化及智慧財產權之申請 ◆針對現行真空型、大氣行電漿設備之效能提升及問題改進

資料來源：該公司提供。

(2)研發人員學歷分佈、平均年資、流動情形及離職率暨評估研發人員離職對該公司之營運風險

單位：人；%

項目		年度	112 年度	113 年度	114 年截至 5 月底
期初人數			9	9	10
本期新進			1	2	2
部門調入			—	—	—
部門調出			—	—	—
本期離職			1	1	2
資遣及退休人員			—	—	—
期末人數			9	10	10
平均服務年資(年)			5.68	6.05	5.98
離職率(%)(註 1)			10.00%	9.09%	16.67%
學歷分佈	博士		2	2	2
	碩士		5	6	6
	大學(專)		2	2	2
	高中職(含)以下		—	—	—

資料來源：該公司提供

註 1：離職率=(離職人數+退休及資遣人數)/(期末人數+離職人數+退休及資遣人數)

註 2：新進、離職及資遣人員不包含試用期未滿即離職者。

該公司致力於各式電漿設備之研發、生產及銷售。該公司 112~113 年底及 114 年截至 5 月底之研發人員分別為 9 人、10 人及 10 人，平均年資則分別為 5.68 年、6.05 年及 5.98 年，研發人員之學歷皆為大學(專)以上，該公司以聘任大學(專)學歷以上之研發人員及具備相關資歷專長人員為主，其中擁有碩博士學

歷者更高達八成以上，顯示該公司對於研發部門之發展及研發人員之素質相當重視。

研發人員異動情形部分，112~113 年底及 114 年截至 5 月底離職率分別為 10.00%、9.09%及 16.67%，114 年截至 5 月底離職率提升，主係包括一入職，未達半年即離職之人員，該公司研發離職人員主係因員工個人生涯規劃或家庭因素等因而自行離職，且人員遞補及訓練上尚無困難，另該公司針對新進研發人員皆要求簽署保密協議，不得以任何方式洩漏予第三人或對外發表，且研發人員在職期間之相關研發成果皆屬該公司所擁有。為避免人員流動造成研發中斷風險，該公司之研發工作均已建立資料保存管理制度，離職人員需依部門要求進行工作及資料交接，且研發人員離職後之工作皆由適任人選銜接。此外，該公司主要研發主管於具備資深學經歷背景，研發團隊對該公司產品、研究及開發等亦已累積豐富經驗，有利於該公司研發能量之積累與傳承，故研發人員之工作異動尚不致對該公司核心研發能力產生負面影響，對該公司之營運亦無重大影響。

(3)最近期及最近二個會計年度研發費用

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112年度	113年度	114年第一季
研發費用	27,880	23,958	6,283
營業收入	762,039	547,630	83,131
占當年度營業收入比率(%)	3.66	4.37	7.56

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司之研發費用主要包括研發人員的薪資、獎金、差旅費、研發設備之折舊及研發消耗品等支出，112~113 年度及 114 年第一季之研發費用分別為 27,880 千元、23,958 千元及 6,283 千元，占各年度營業收入淨額之比率分別為 3.66%、4.37%及 7.56%。該公司對於研究開發投入相當重視，各年度皆有一定比重之研發支出投入，而因 112~113 年度及 114 年第一季營收規模受景氣影響而下滑，致研發費用占營業收入比重逐年上升，經評估其變動情形尚無重大異常之情事。

(4)重要研發成果

該公司自成立以來，即不斷要求提升自身研發能力，憑藉自身完整的研發能力及製造能力，持續取得國內多項專利肯定，其研發成果均來自自行研發。茲將該公司最近二年度及最近期截至評估報告出具日止之重要研發成果相關內容列示如下：

年度	研發成果/產品別
109 年	◆晶圓背面高分子殘留物去除之大氣電漿設備 ◆用於非等向性乾式蝕刻製程之感應式高密度電漿-反應性離子蝕刻設備
110 年	◆用於金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備

年度	研發成果/產品別
111 年	◆用於甲烷裂解產氫之電弧式大氣電漿設備 ◆用於甲烷轉化之介電質放電式大氣電漿設備
112 年	◆寬幅型金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備 ◆用於甲烷裂解產氫之微波電漿火炬設備
113 年	◆大面積陣列式微波電漿系統

資料來源：該公司提供。

3. 主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司認為只有不斷創新獨特的設計，才有持續突破的創造技術，主要技術來源係該公司之研發團隊所開發之自有專利技術，以其專業且豐富之學經歷知識，並汲取過去產業經驗及彙整該公司之研發經驗，開發適用於各產業製程設備等相關產品。截至評估報告出具日止，並無與他人簽訂重要技術授權合作契約，亦無支付技術報酬金或權利金之情事。

4. 研發工作未來發展方向

隨著科技產品不斷演進，半導體、PCB 等產業製程設備不斷升級更新，隨智能化製造的發展，電漿設備將更強調自動化控制和智能化管理，以適應更加精細和複雜的工藝要求，此外，減碳議題亦受到各國高度重視，因此該公司為配合高科技製程需求及追求環境永續發展，致力於設備技術升級及開發，目前主要進行中研發之計畫包括以下項目：

核心策略	計畫目標說明
擴展核心製程技術深度	強化奈米級清洗、蝕刻與表面能控制能力，以支援先進封裝需求
跨材料整合與異材製程	佈局多元材料組合之製程挑戰，發展具選擇性與高精度控制能力的電漿蝕刻技術，針對不同介面結構進行有效處理
綠色製程技術創新	推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、氫能火炬、高 GWP 尾氣處理設備商品化
智慧製造導入	建立製程參數 AI 學習模型，導入虛擬量產平台與智慧維運 (e-maintenance)

資料來源：該公司提供。

5. 目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權等情事，暨因應措施是否合理有效

截至評估報告出具日止，該公司並無因侵權而有訴訟之情形，亦無因涉及違反專利權、商標權及著作權而對其財務、業務有重大影響之情事。茲就該公司截至評估報告出具日止，已取得及申請中之專利權及商標權列示如下：

(1)專利權

A.截至評估報告出具日止，該公司已取得之專利權如下：

項次	專利名稱	申請國家	專利類型	專利權號	申請日	專利權迄日
1	空氣清淨機	台灣	新型	M531565	105/5/27	115/5/26
2	空氣汙染處理設備及其高壓電極管	台灣	新型	M512207	104/8/17	114/8/16
3	自動化線上電漿製程系統	台灣	發明	I457972	101/10/12	121/10/11
4	電漿晶圓清潔機及使用其清潔晶圓的方法	台灣	發明	I748741	109/11/11	129/11/10
5	卷對卷式電漿去膠渣機	台灣	發明	I789144	110/12/3	130/12/2
6	壓電材料卷對卷極化設備	台灣	發明	I805299	111/3/31	131/3/30
7	壓電材料極化設備	台灣	發明	I814323	111/3/31	131/3/30
8	氣體分解裝置(一)	台灣	發明	I842523	112/5/11	132/5/10
9	氣體分解裝置(二)	台灣	發明	I842524	112/5/11	132/5/10
10	感應耦合電漿蝕刻設備及其多迴圈式電極	台灣	發明	I863178	112/3/21	132/3/20

資料來源：該公司提供。





B.截至評估報告出具日止，該公司申請中之專利權如下：

項次	專利名稱	申請國家	專利類型	專利申請日
1	電漿晶圓清潔設備(一)	台灣	發明	113/03/12
2	氣體分解裝置(三)	台灣	發明	113/09/26
3	真空電漿蝕刻之薄板定位裝置	台灣	發明	113/12/27
4	電漿氧化還原裝置及方法	台灣	發明	114/04/11

資料來源：該公司提供。

(2)商標權

截至評估報告出具日止，該公司無申請中商標權，已取得商標權列示如下：

序號	商標名稱	商標權名稱及圖樣	國家/地區	商標註冊號	專用期限
1	NEMS tek 設計圖		台灣	01041913	122/4/30
2	NEMS tek 設計圖		台灣	00182253	122/05/31
3	NEMS tek 設計圖		台灣	00182252	122/05/31
4	NEMS tek 設計圖		台灣	00184847	122/07/31

序號	商標名稱	商標權名稱及圖樣	國家/地區	商標註冊號	專用期限
5	暉盛		台灣	00182251	122/05/31
6	暉盛		台灣	00184846	122/07/31
7	暉盛		台灣	01041912	122/04/30
8	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02270156	121/12/15
9	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02268200	121/12/15
10	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02279227	122/01/31

資料來源：該公司提供

(3)著作權

該公司最近二年度及申請年度截至最近期止，並無取得或申請中的著作權。

6.取得重要技術合作契約，就其內容評估對發行公司之營運風險

契約名稱	合作對象	契約起迄日	內容摘要	技術權利金及費用支付方式及金額	對營運之影響或限制條款
委託合約書	國立虎尾科技大學	114.06.01~ 114.12.31	共濺鍍銀—鈦合金薄膜製作與特性分析之研究	計畫經費計新台幣500千元，尚未支付。	該計畫之研究成果及智慧財產權歸屬虎尾科技大學，暉盛擁有技術移轉優先授權之權利。

該公司之核心技術主要來自研發部門自行開發，114 年度與國立虎尾科技大學進行產學合作研究計畫，針對封測產業探針產品之鍍膜技術進行合作研究開發，上述重要技術合作契約對公司營運發展應有正面助益。

7.以科技事業、文化創意事業申請上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

該公司非屬科技事業、文化創意事業申請上市，故不適用此項評估。

- 8.以科技事業、文化創意事業申請上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司非屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用此項評估。

- 9.以創新版申請上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施加以評估

(1)關鍵核心技術

電漿乾式清洗工藝在 PCB 製造與半導體先進封裝製程中，能提供卓越的清潔與表面活化效果，對確保高精度製程的良率與可靠性至關重要。相較於傳統濕式清洗方式，容易產生清洗劑殘留，且受限於液體表面張力，難以深入微細孔洞與複雜結構，電漿技術則具備高度穿透性與均勻性，能有效覆蓋 3D 結構並清潔微奈米間隙，是確保先進製程品質不可或缺的關鍵步驟。

該公司以高密度電漿乾式表面處理技術為核心，由研發團隊自主設計涵蓋基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空系統與溫控單元等關鍵子系統，並依應用需求彈性整合成高模組化、可擴展的設備平台，可針對不同產業領域進行模組重組與製程優化。其相關設計均已申請專利保護，專利技術涵蓋機構模組、電漿腔體設計、等離子生成模組、氣體流場控制、感測監控機制等，皆為該公司研發團隊開創擁有，為設備製造關鍵門檻，其中包含 2 項新型專利、8 項發明專利及 4 項申請中專利。核心技術包括：

A.ICP-RIE 電漿蝕刻系統(感應耦合電漿反應式離子蝕刻)：

該公司自研高密度電漿源結構，並導入多階段電場控制技術。相較同業普遍採用單輸出電源，易受限於製程均勻性與參數調控彈性，該公司創新設計多輸出電源模組，可分區動態調整電漿密度與功率分佈，依不同蝕刻階段精準調控，大幅提升製程穩定性與蝕刻均勻度，滿足高精度、大面積與高難度製程需求。

B.常壓電漿極化：

該公司為某美系半導體大廠唯一委託開發該項技術的供應商，專用於PVDF(聚偏二氟乙烯)與PZT(鋅鈦酸鉛)等壓電材料表面改性。透過電漿處理改變材料表面電子排列，造成壓電效應，此技術已成功應用於超音波指紋辨識模組之製程(如：智慧型手機中的螢幕下指紋感測器)。電漿極化技術可有效活化壓電材料性能，使感測訊號更清晰，辨識更準確。

此外，常壓電漿亦可應用於電子元件散熱，無須額外風扇或液冷元件的被動式散熱方式，可有效降低系統功耗與體積。

C. Hybrid Bonding(混合鍵合技術)—大氣電漿處理技術：

Hybrid Bonding為先進封裝製程關鍵技術之一，該公司為因應Hybrid Bonding先進封裝所需開發之大氣電漿處理，將預計於2025年9月底在美國聖地牙哥舉行的IMAPS國際會議正式發表。該技術將應用於晶片堆疊前之表面清潔與活化處理，針對SiO₂-SiO₂與Cu-Cu介面進行低損傷乾式去氧化與表面活化，可顯著增強晶片鍵合強度與傳輸效能，並有效解決封裝過程中界面污染問題，支撐新一代封裝技術之可靠性與性能需求。

D. 高效電漿火焰技術(Microwave Thermal Plasma)：

由中研院委託該公司研發，協助能源機構建構應對減碳挑戰之先進設備。透過微波電磁場耦合模組與氣旋式腔體設計，實現甲烷(天然氣)裂解產生氫之高效反應路徑。傳統碳捕捉多屬「事後處理」技術，常以氣體形式收集二氧化碳，再進行儲存或處理，面臨高壓壓縮與儲存瓶頸，該技術於反應初期即直接將碳轉化為穩定固體形式，簡化後段處理流程。未來亦可應用於裂解半導體製程中產生的溫室氣體(如SF₆、NF₃、CF₄)，以實現更具環境效益的製程減排方案。

該公司擁有電漿表面處理關鍵核心技術，憑藉多年研發積累取得多項電漿相關專利技術，建立起明確的技術門檻與壁壘。目前所開發之高密度電漿設備已廣泛應用於高階半導體、先進封裝及新興綠色製程中，具有他人難以替代的獨特性。此外，該公司分別於109年及111年通過經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)機械領域核定補助名單，該計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營，顯示該公司技術創新獲得認可。

(2) 創新能力或創新營運模式

該公司之創新能力主要體現在自主開發的高密度電漿乾式表面處理技術架構，並以此核心開發出一系列具高度可擴展性的模組化系統設備，提供客戶完整製程解決方案及技術服務。該公司持續投入創新研發及前瞻性應用開發，並憑藉電漿技術在半導體製程中具備低污染、高效率製程處理等優勢，持續拓展應用層面，在全球推動ESG永續發展的潮流趨勢下，逐步取代傳統高污染及高耗能的製程設備。

A. 暉盛公司現有核心技術之突破性應用：

(A) 卷對卷式電漿去膠設備：

將電漿應用在3C與行動裝置軟性電路板的表面清潔及去膠處理，已為科技大廠其軟性電路板供應商指定使用。

(B)ABF載板乾式蝕刻與表面處理：

領先同業於載板製程導入ICP-RIE及高效電漿火焰處理技術，具備高蝕刻選擇性與高均勻性，能精準處理ABF基板中之SiO₂填料與環氧基質，有效克服傳統濕式蝕刻難以達成之精細控制，目前可處理尺寸最大已達850×750mm。

(C)Hybrid Bonding(混合鍵合技術)—技術上之領先更新：

本系統具320mm大面積有效處理範圍，可於單一製程步驟內同時完成多重處理，大幅縮短製程處理時間，並能無縫整合於下游封裝製程，提升整體生產效率。另外，不同於傳統微波或RF電漿系統，該公司採用中頻常壓介電阻擋放電(MF AP-DBD)技術，突破業界對高成本氬氣的依賴，成功實現以高濃度氮氣(N₂)作為主要工作氣體，不僅具備等效甚至優於傳統系統之處理效果，也大幅降低營運成本。

(D)先進封裝電漿處理設備應用(FOWLP/FOPLP)

針對晶圓級(FOWLP)與面板級(FOPLP)封裝技術日益精細之需求，該公司開發對應的低損傷電漿表面活化與蝕刻設備，可有效改善封裝層間附著力與金屬導通孔(RDL)清潔品質。設備支援300mm晶圓及610×610mm面板，具備大面積均勻性、高重現性與製程彈性，已成功導入多家先進封裝客戶之製程產線，協助提升封裝良率與可靠度，並可依不同材料堆疊需求進行多氣體、階段式或選擇性處理，滿足未來高頻、高密度、高散熱的異質整合封裝技術挑戰。

(E)再生晶圓薄膜去除：

結合ICP-RIE及高效電漿火焰處理技術，開發出低損傷乾式清膜模組，有效降低再生製程成本並提升再生晶圓品質，目前已獲台灣晶圓封測大廠採用。

B.前瞻性應用：

(A)第三代半導體應用延伸(SiC蝕刻/GaN表面處理)：已完成初步模組開發，計畫配合功率晶片製造擴展應用。

(B)微型感測器與PVDF(聚偏二氟乙烯)與PZT(銻鈦酸鉛)電漿極化封裝技術：支援次世代智慧穿戴裝置之壓電模組封裝。

(C)工業廢氣/醫療廢棄物電漿即時裂解設備：應用高效電漿火焰模組實現ESG減碳需求。

(D)AI製程參數學習平台：建構預測性良率模組，預計進一步商業化至數據服務平台。

C.減碳排廢應用的創新實踐

該公司除了在半導體及電子資訊產業持續著墨於綠色製程技術的研發與

應用外，在減碳排廢應用上同樣展現創新作為。

(A)減廢製氫能源應用創新及永續設備設計：

面對全球減碳趨勢，該公司投入電漿裂解甲烷製氫技術之研發，不僅減少溫室氣體排放，同時開創潔淨能源生產新路徑。此技術提供了一種低碳的氫能生產方案，符合未來氫經濟的綠色發展方向；此外，該公司亦已研發出直流電漿火炬系統，採用熱效率電極設計，可延長電漿設備電極使用壽命，使設備能長時間穩定運行且維護成本低，強化企業ESG表現。

(B)工業廢氣與製程尾氣裂解處理：

該公司研發工業污染氣體電漿防治設備，可串接於製程排氣系統中解決工業製程中的廢氣，將廢氣中的有害成分高效分解降低污染物排放，協助企業符合環保法規並減輕環境負荷。

(C)低碳製程替代方案：

針對傳統濕式化學製程的高污染與高耗能問題，該公司研發全乾式電漿去膠渣及蝕刻製程，成功取代需耗用大量化學藥劑的傳統製程。此乾式製程不僅符合半導體高精度製程需求，亦大幅降低製程廢液及能源消耗，符合節能減碳與綠色製造趨勢。

綜上所述，該公司掌握高密度電漿源設計等核心技術，展現出持續創新能力、能靈活匹配客戶製程參數需求，因應客戶特殊製程需求推出創新解決方案及跨產業應用拓展力與國際競爭力，不僅擁有關鍵核心技術，更具備技術領先性與產業影響力。

(3)因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施：

A.技術及產品變化之風險

全球半導體技術迭代迅速，包括AI晶片、先進封裝、Chiplet架構與第三代半導體材料持續突破，終端應用需求亦快速轉變。若該公司未能同步升級核心技術，產品規格或製程能力未能即時滿足客戶需求，恐面臨產品被取代或喪失技術領先地位之風險，訂單取得與市場滲透率亦將受影響，尤以先進封裝、高頻載板與環保設備領域為甚。

因應對策：

該公司每年投入約營業收入5%作為研發支出，確保持續性創新動能，並與生產部電控及機構設計單位密切合作，積極強化高彈性客製化產品設計能力，導入製程即服務(PaaS)模式以提升市場變動適應速度與彈性，並藉由客戶客製需求，共同開發新產品，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化並同步累積特殊材料或應用端Know-how。此外，該公司核心團隊所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，以對市場敏銳度積極投入新產

品研發以推出符合市場需求之產品，同時積極申請專利保護，並發展具差異化的技術方案，如ABF全乾式蝕刻與高溫電漿火炬系統，形塑技術壁壘，提升市場競爭力。

B.政策與貿易變化風險

2025年4月2日川普以各國對美龐大貿易逆差為由，實施10%的全面進口關稅，同時公佈約60個國家的進口貨品將加徵對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。如若關稅實施，將推高公司產品在美國市場的售價，削弱價格競爭力。

因應對策：

指定窗口密切關注美國相關機構之政策公告，掌握第一手關稅與出口管制動向，確保對應製程、產品或客戶交易行為符合最新規範，並留意主要客戶應用產品之關稅變化可能造成之後續影響，降低法律與商業風險。結合ERP/CRM系統即時回饋進口稅率、運費與原物料價格變動對產品售價的影響，讓銷售團隊與財務部門可依據區域與客戶別調整報價策略，避免毛利率大幅波動。此外，配合地緣政治變化，加速全球非美市場多元化策略，重點佈局東南亞(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈，透過與當地專業經銷商合作，提升在地即時支援能力。

C.核心技術人員變動風險

若關鍵研發人員離職，可能影響新技術開發及現有技術整合及發展。

因應對策：

該公司持續積極培養核心技術相關人才，所有研發專案皆採「雙人制度」與交叉備援機制，以分散關鍵技術集中風險，確保技術傳承不中斷。研發人員在職期間所產出的技術成果均已全面專利化，並導入文件加密與權限控管系統，有效保障智慧財產安全，即便核心技術人員離職，對公司整體營運影響尚屬有限。在內部人才培育方面，該公司已建構知識系統化平台，並定期進行技術交接與內部經驗分享，此外，該公司同時實施具吸引力之獎酬與留才制度，以進一步提升人才的穩定性。

10.以創新板申請上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升

A.產品生產開發技術之層次

該公司產品生產與技術開發的核心，建立於其自主研發的電漿乾式製程平台(Plasma Modular Processing Platform)之上。該平台整合高密度電漿生成模

組、精密氣體流場設計、RF電場控制系統與真空腔體熱場整合機制，形成一套高度模組化、可擴展且具跨產業應用潛力的技術基礎。整體技術可分為三大核心層面：

(A)自主電漿模組架構設計：

該公司不依賴現有外部平台或進口設備改裝，而是完全自主設計與建構等離子體產生模組，涵蓋感應耦合電漿(ICP)、微波電漿(MTP)、大氣壓電漿(AP)等系列架構，並可依據不同製程需求，彈性設計腔體結構與能量分布控制系統。

(B)多製程參數整合能力：

該公司具備對氣體組成、腔體壓力、能量密度、電漿均勻性及材料熱衝擊等參數的協同控制能力，可靈活應用於多種乾式製程，包括清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理及高溫裂解等製程，顯示出技術應用層面之廣泛延展性。

(C)先進封裝與精密加工的高度適配性：

該公司產品具備處理3D結構及高深寬比結構的能力，對於奈米級線寬、表面粗糙度與蝕刻選擇性具備高解析調控能力，能有效支援先進晶圓封裝、ABF載板蝕刻與FPC模組加工等關鍵核心製程，為高階半導體應用提供技術支撐。

B.產品生產開發技術之來源

該公司關鍵核心開發技術100%來自公司之研發團隊，以總經理為首帶領擁有產業豐富經驗，並涵蓋電漿物理、化學工程、機構設計、材料科學與系統整合等專業之團隊，以實務經驗及專業知識將設計思想轉變為具可實施性的產業技術。技術研發以電漿製程為主軸，且並非單一用途開發，而係以「核心平台+應用模組」方式設計，具備高度再利用與產業轉移能力，且技術基礎由研發部門統一維護，由研發單位人員與生產部電控及機構設計單位依產業需求開展應用專案，確保既有核心可持續深化，亦能快速響應市場趨勢。而智慧財產專利權佈局則包含等離子體產生模組、射頻功率控制、氣體導流腔體設計、感測監控系統與多段製程控制架構等，均由該公司之經營及研發團隊完成。

C.產品生產開發技術之確保

該公司針對其自主開發之電漿乾式製程，已建構完善的技術保護策略。該公司已於內部控制制度之研發循環中訂定有關智慧財產權之取得、維護及運用作業予以規範，並於每一個新技術、新改善方案建立時，申請專利權保護或列為公司營業秘密完善保存，並建立智慧財產權清單定期更新盤點，其相關文件之傳遞、保存及銷毀均須依管理作業程序辦理，嚴格控管該公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，且該公司員工均有

簽屬保密協議，藉以控管及保護該公司重要專利技術。除此之外亦透過資深研發人員之經驗傳承，同時積極延攬人才組建技術團隊，以確保核心技術持續提升。

D. 產品生產開發技術之提升

該公司持續投入研發人力及經費於電漿多樣化應用領域(如：半導體、封裝載板、OLED、ESG氫能等)之技術開發，以利該公司能於早期掌握產品關鍵技術，並確保持續領先同業推出更全方位之產品，同時該公司透過與國際大廠客戶建立協同開發計畫，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化，並透過產學合作進行前瞻研究，以促進技術進化。此外，該公司將積極延攬人才，並輔以參考職務承擔責任及貢獻度發放獎酬，兼顧人才招募及留任，俾利該公司所具有之關鍵核心技術得以持續提升。

(2) 現在主要產品之競爭優勢、生命週期及持續發展性評估

A. 現在主要產品之競爭優勢

(A) 專精利基與研發創新：

該公司聚焦於電漿表面處理這一利基市場，投入高度研發創新，掌握高密度電漿源設計等核心技術。在先進封裝、IC載板等新興應用上推出創新解決方案。相較之下，國際大廠雖規模龐大，但產品線廣泛，未必能迅速客製因應這些特殊製程需求。該公司擁有專業電漿技術團隊與多項專利，加上高度彈性客製化及製程整合能力，能依客戶製程需求提供專屬模組設計、製程參數優化與材料測試服務，滿足不同產業的特殊要求。

(B) 產品組合與跨領域應用：

該公司以高密度電漿乾式表面處理製程技術平台為核心，將自主設計的基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空與溫控系統等依需求彈性，搭配結合成為高度可擴展性的設備模組系統，並根據不同應用領域進行模組重組與流程優化。該公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域，同時在半導體、PCB、光電乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使該公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用該公司電漿設備等實績中，顯示該公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

B. 現在主要產品之生命週期暨持續發展性

該公司旗下產品依據其技術成熟度與市場接受程度，主要可區分為三大生命週期階段：

(A) 成熟期產品

該公司部分傳統型電漿設備，如電漿清洗機、去膠渣機等通用型真空

和常壓電漿設備，已進入產品生命週期之成熟階段。該類產品市場需求相對穩定，競爭者眾，產品同質性高。為維持競爭優勢，該公司將持續透過技術升級與彈性化客戶製程設計服務，延伸產品生命週期並鞏固客戶關係。

(B)成長期產品

應用於先進封裝(如 FOWLP、FOPLP、Hybrid Bonding)、晶圓再生與ABF載板全乾式處理等新興應用所開發的電漿設備，目前正處於高速成長階段，尚無週期性之問題。隨著AI、5G、高效運算(HPC)等科技發展推升半導體製程升級，相關需求持續擴大。該公司憑藉自主電漿模組設計能力，於此領域建立技術領先地位，提高市場滲透率。

(C)導入期產品

應用於新能源與環保領域之電漿設備，包括高溫電漿火炬(用於甲烷裂解產氫)、固體廢棄物處理及溫室氣體減排等系統，現階段尚處於導入初期。儘管市場尚未全面成熟，但因應全球能源轉型與淨零碳排目標，相關產業前景可期。該公司將持續投入研發與驗證資源，並積極拓展相關市場。

(3)新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

A.新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

該公司致力於擴展核心製程技術的深度與廣度，全面強化奈米級清洗、蝕刻與表面控制等關鍵能力，以因應先進封裝製程對精密度與材料適應性的高度要求。同時，該公司積極發展跨材料整合技術，導入適用於Epoxy +SiO₂、Glass +Cu等異質材料的複合材蝕刻與活化解決方案，提升設備對新型封裝結構的製程相容性。在綠色製程方面，該公司推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、高效率氫能火炬與高GWP尾氣處理等創新設備之商品化，強化ESG製程落實與碳排管理能力。此外，為加速數位轉型，該公司亦已導入智慧製造技術，包括建立製程參數AI學習模型、建置虛擬量產平台與智慧維運系統，提升製程穩定性、良率與運營效率。

新產品預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性如下：

核心策略	計畫開發之新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擴展核心製程技術深度 ◆ 跨材料整合與異材製程 	大面積大氣電漿噴頭開發	114年底	半導體製程	中頻寬幅電漿頭開發，業界首創320mm有效處理範圍，透過去除銅腳表面氧化物，提高銅-銅高密度鍵合可靠度，此設備技術符合未來5G與AI晶片封裝微線道、高密度堆疊的製程發展趨勢，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司

核心策略	計畫開發之新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
				營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擴展核心製程技術深度 ◆ 跨材料整合與異材製程 ◆ 綠色製程技術創新 	ABF乾式蝕刻設備	114年第四季	半導體製程	ABF乾式蝕刻設備為該公司針對ABF載板設計之關鍵設備，能以乾式製程技術高選擇性地去除Epoxy與SiO ₂ 材料，解決濕蝕刻工法無法滿足細線與高密度載板需求的痛點。隨著AI與5G帶動封裝微型化趨勢，該設備具備成為先進載板加工標準設備的潛力，並能協助客戶朝向乾式低碳製程轉型，隨著新產品之設計、開發及推廣，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擴展核心製程技術深度 ◆ 智慧製造導入 	Underfill前清潔 (針對晶圓級極小Gap產品)	115年底	半導體製程	高密度微波電漿機台開發，主要目的為消除半導體封裝製程中underfill灌膠過程中之產生之空孔缺陷。此設備技術符合未來5G與AI晶片封裝微線道、高密度堆疊的製程發展趨勢，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 綠色製程技術創新 ◆ 智慧製造導入 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 高溫微波電漿火炬系統(MTP) ◆ 先進半導體製程廢氣電漿淨化器(高GWP氣體即時處理設備) 	115年第四季	ESG減碳	此系統為高溫微波電漿設備，主要應用於甲烷裂解製氫(CH ₄ → C + 2H ₂)，以及高GWP氣體(如SF ₆ 、NF ₃)與工廠/醫療固體廢棄物之即時熱裂解處理。設備具備高溫(>2000°C)反應效率與氣旋場穩定結構，能廣泛應用於氫能產業、碳中和場域、能源工業與ESG減碳設備中，該設備亦具進入碳稅交易平台與補助計畫的技術潛力，為未來能源轉型的關鍵設備之一，目前已進入政府單位、能源與材料廠區測試，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擴展核心製程技術深度 ◆ 跨材料整合與異材製程 ◆ 綠色製程技術創新 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 高效深孔電漿蝕刻設備(Green DRIE for TSV/TGV) ◆ 次微米級高精度ABF載板乾蝕設備(支援2μm/2μm線寬線距，兼容玻璃基板) 	116年第一季 116年第二季	半導體製程	先進封裝產業在115年之後預計將持續蓬勃發展，高階運算(HPC)與AI晶片對封裝的密度和性能要求越來越高。尤其是在封裝基板方面，ABF載板目前量產線寬/線距約10μm，但下一代晶片需要2μm及以下的極細路。為因應此趨勢，全球封裝基板技術正從傳統有芯ABF朝向無芯ABF與甚至玻璃基板演進：如欣興開發無芯ABF可實現3μm線寬線距；三星亦組建聯盟加速研發玻璃基板，預計115年即商業化此革命性技術，以因應多晶粒系統級封裝需求。英特爾則計畫119年前導入玻璃基板，使封裝互連密度大幅提升。總體而言，更高密度、更大尺寸的封裝基板將成為未來主

核心策略	計畫開發之新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
				流，帶動相關設備需求激增。 新產品構想針對電漿製程未來需求而設計：既解決技術瓶頸，又響應良率、效率、低碳排、環保與智慧化的產業趨勢。隨著先進封裝在AI、高性能計算領域的蓬勃發展，這些創新電漿設備與方案有望成為關鍵使能技術，將可挹注該公司營收及獲利。

資料來源：該公司提供

B.研究發展之內部控制暨保全措施

該公司已建立完整之內部控制，研發循環之內部控制制度包括基礎研究作業、產品設計、技術研發、產品試作與測試作業、研發記錄與文件保管作業及智慧財產權之取得、維護及運用作業。各項研發階段所製作之文件經過適當審核程序後，由研發部門存查，任何研發文件之查詢、借閱需經研發部門主管核准後才准予借調，以落實研發文件之保存。該公司亦導入PLM(Product Lifecycle Management)管理系統，所有技術文件、研發專案設計、版本紀錄均納入PLM平台控管，確保從概念設計至工程導入可完整追溯；而材料BOM表與製程紀錄雙系統整合，將技術開發所涉材料、模組組裝與氣體流道設定皆同步至ERP系統與MES製造執行系統，落實生產過程的可視化、可控化與可追溯化，降低因人異動造成製程資訊中斷的風險。此外，該公司之技術設計圖、實驗參數及測試紀錄皆透過該公司雲端系統進行每日備份，具備災難復原與異地調閱能力，所有研發設計文件亦依涉密等級分類，具備防擷取、防儲存、防列印、防傳輸等技術保護。

11.以創新板申請上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

(1)參與經營決策之董事、監察人、持股5%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例與實際投入經營之時間與情形

該公司無以專利權或專門技術出資之股東，並設有審計委員會取代監察人。茲將該公司董事、持股5%以上股東，及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例與實際投入經營之時間與情形列示如下：

114年5月31日；單位：年；%

職稱	姓名	主要學經歷	職位年資	持股比例
董事長暨 5% 以上股東	宋俊毅	國立臺灣科技大學電子系 基丞科技(股)公司-總經理	23	11.14
董事暨 5% 以上股東	基丞科技(股)公司	—	—	15.12
	代表人： 江少杰	內湖高工機械科 新群科技(股)公司-董事長 新杰科技(股)公司-董事長 基丞科技(股)公司-董事長	23	—
董事	曾坤燦	正修科大電子工程學系 江陰新杰科技有限公司-總經理 江陰新基電子設備有限公司-總經理 基丞科技(股)公司-副總經理	23	7.27
董事暨總經理	許嘉元	成功大學化學工程學系研究所博士 成功大學化學工程學系學士 暉盛科技(股)公司-總經理	23	4.32
獨立董事	顏盟峯	英國雷汀大學財務金融博士 英國雷汀大學國際證券、投資暨銀行學碩士 國立清華大學電機工程學系 國立成功大學會計學系兼財務金融研究所教授 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院-董事 申豐特用應材(股)公司-獨立董事 中華郵政股份有限公司-外部專家董事 國立成功大學會計學系-系主任兼財務金融研究所-所長	1	—
獨立董事	黃蕙玲	高雄第一科技大學財務管理系碩士 逢甲大學會計系 怡和國際能源(股)公司-財會處長 元山科技(股)公司-總管理處處長兼財務長 台新證券(股)公司-資深協理 綠需能源(股)公司-財務長	1	—

職稱	姓名	主要學經歷	職位年資	持股比率
獨立董事	何志文	國立臺灣大學機械工程研究所材料組碩士 國立成功大學機械工程學系 飛信半導體(股)公司-副總經理、總經理	1	—
5%以上股東	矽格聯測(股)公司	—	—	8.73
生產部主管	符永豪	成功大學資源工程所碩士 成功大學資源工程系學士 鈦昇科技(股)公司—研發工程師	23	0.87
研發部主管	梁國超	成功大學化學工程學系研究所博士 成功大學化學工程學系研究所碩士 台灣科技大學化學工程學系肄業 核能研究所副研員	6	0.83

資料來源：該公司提供

(2)參與經營決策之董事、監察人、持股5%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，最近兩年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：股

職稱	姓名	111年	112年度		113年度		114年5月31日止	
		期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數
董事長暨5%以上股東	宋俊毅	1,581,973	1,780,000	3,361,973	(146,000)	3,215,973	—	3,215,973
董事暨5%以上股東	基丞科技(股)公司	4,617,756	—	4,617,756	(255,000)	4,362,756	—	4,362,756
	代表人：江少杰	—	—	—	—	—	—	—
董事	曾坤燦	1,822,235	400,000	2,222,235	(123,000)	2,099,235	—	2,099,235
董事暨總經理	許嘉元	1,089,650	230,000	1,319,650	(73,000)	1,246,650	—	1,246,650
董事	蔡秉儒	710,424	800,000	1,510,424	(註1)	(註1)	(註1)	(註1)
獨立董事	顏盟峯	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
獨立董事	黃蕙玲	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
獨立董事	何志文	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
5%以上股東	矽格聯測(股)公司	2,664,090	—	2,664,090	(146,000)	2,518,090	—	2,518,090
生產部主管	符永豪	—	250,000	250,000	—	250,000	—	250,000
研發部主管	梁國超	—	250,000	250,000	(10,000)	240,000	3	240,003

資料來源：該公司提供。

註1：該董事於112.12.11辭任，故不揭露後續期間之持股變動。

註2：獨立董事皆係於113年1月26日股東臨時會增選就任。

該公司於112年12月6日辦理股票公開發行，並於113年3月18日登錄興櫃。該公司於112年度員工行使員工認股權為2,604千股，且大股東日立先端科技(股)公司轉讓其持股3,595千股予董事及經理人，故112年度之股權異動係因員工行使員工認股權以及認購大股東所轉讓之持股所致；該公司於113年度申請登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第八條及「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，由董事、法人股東及內部人提撥共計1,007千股予主辦、協辦輔導推薦證券商及投保

中心認購。除上述原因之異動外，其餘變動主係股東間交易及自身理財投資規劃因素致持股異動。

- (3)參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等，若未能繼續參與經營對公司之營運風險，及其因應之措施

該公司並無以專利權或專門技術出資之股東，該公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，其主要透過董事會運作進行對該公司之重大決策及監督公司營運方向，並無單一董事或集團控制該公司經營或日常運作之情事；而該公司因無以專門技術出資之股東，該公司產品專案開發資料包括材料測試驗證數據及生產工程技術等文件，前述所有已建檔之生產文件所有權均歸屬於該公司，並非由單一個人能完全掌握且無技術集中於特定人士或組織之情事。綜上所述，如若未來參與經營決策之董事或經理人未來不繼續參與公司之經營，因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，公司治理仍能有效實施；此外，該公司等重要營業文件保存均依內部控制相關管理辦法施行，使得其設計及開發成果得以保留於公司內部，並嚴格控管存取人員權限，以確保資料的完整性及機密性，研發工作得以延續，經評估該公司之因應措施尚屬健全可行，對該公司之財務業務應無重大影響。

- 12.以創新板申請上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者申請創新板上市，故不適用此項評估。

(三)人力資源分析

1.最近二年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等，以評估離職率之變化情形及對該公司之營運風險

(1)員工總人數及變動情形

單位：人

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 5 月底
期初員工人數		64	66	67
本期新進人數		9	9	13
離職人員	主管級人員	2	1	—
	直接人員	4	4	1
	間接人員	1	3	5
	合計	7	8	6
資遣人數		—	—	—
退休人數		—	—	—
期末員工人數	主管級人員	16	17	21
	直接人員	26	24	28
	間接人員	24	26	25
	合計	66	67	74
平均服務年齡(歲)		40.12	40.63	40.93
平均服務年資(年)		8.06	8.56	7.87

資料來源：該公司提供。

註：新進、離職及資遣人員不包含試用期未滿即離職者。

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年截至 5 月底之期末員工人數分別為 66 人、67 人及 74 人，平均服務年資分別為 8.06 年、8.56 年及 7.87 年。該公司為持續因應未來營運規模成長而擴充人資、財會及業務相關部門人力；而員工平均年齡約為 40 歲左右，平均年資則為 7.87~8.56 年，顯示該公司員工主要為青壯年階層，人員流動情形尚屬穩定，對該公司及其子公司營運之穩定及成長應有助益。整體而言，該公司及其子公司最近二年度及最近期之人員變動情形尚屬合理，尚不致對其營運狀況產生重大不利影響。

(2)離職人員分佈情形

單位：人；%

項目 \ 年度	112 年度			113 年度			114 年截至 5 月底		
	期末 人數	離職 人數	離職率 (%)	期末 人數	離職 人數	離職率 (%)	期末 人數	離職 人數	離職率 (%)
主管級人員	16	2	11.11	17	1	5.56	21	—	0.00
直接人員	26	4	13.33	24	4	14.29	28	1	3.45
間接人員	24	1	4.00	26	3	10.34	25	5	16.67
合計	66	7	9.59	67	8	10.67	74	6	7.50

資料來源：該公司提供。

註：離職率=離職人數(含資遣及退休)/(期末人數+離職人數(含資遣及退休))。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年截至 5 月底止之離職人員分別為 7 人、8 人及 6 人，離職率分別為 9.59%、10.67%及 7.50%。管理人員(包含經理人)方面，112 年度有兩位管理人員離職，其中一位研發主管因生涯規劃離職，而該公司尚有一位資深研發經理，該資深研發經理對研發產品特性與規格、市場需求與產業概況具相當經驗，對該公司研發業務尚不致產生重大影響，另該公司董事長宋俊毅先生原兼任執行長職務，於 112 年 10 月辭任，原職務由該公司總經理承接；113 年度一位管理人員任職未滿一年，因職涯規劃離職。基層員工方面，主係產線員工及業務人員對工作環境不適應、生涯規劃及家庭因素等而提請離職。由於離職員工多為基層員工，故不影響日常營運決策執行或技術深化發展，另離職人員皆已妥善完成交接作業、招募新進員工遞補缺額尚無困難，故對公司營運發展尚無重大影響。整體而言，該公司及其子公司離職率變化情形尚屬合理，且無因人員異動而對其營運產生重大不利之影響。

(3)員工學歷分析

單位：人；%

項目/年度	112 年底		113 年底		114 年截至 5 月底	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	3	4.55	3	4.48	4	5.41
碩士	12	18.18	16	23.88	16	21.62
大學(含大專)	48	72.72	45	67.16	51	68.92
高中職(含)以下	3	4.55	3	4.48	3	4.05
合計	66	100.00	67	100.00	74	100.00

資料來源：該公司提供

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年截至 5 月底止之員工學歷為大學(專)以上者分別為 63 人、64 人及 71 人，分別占總員工數之 95.45%、95.52%及 95.95%，該公司及其子公司之員工九成以上具有大學以上學歷，其中碩博士學歷之員工人數占全體員工比例為 22.73%、28.36%及 27.03%，均在二成以上，顯示該公司及其子公司對工作內容需具知識含量較高層次之人才專業背景要求，整體而言，該公司及其子公司員工學歷結構與其工作性質分布尚無重大異常，係有助其營運能力及市場競爭力。

(四)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近二個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

單位：新台幣千元

產品	年度	112 年度		113 年度		114 年第一季	
		金額	%	金額	%	金額	%
電漿去膠渣及蝕刻機	直接原料	292,262	82.68	203,826	79.18	24,908	81.78
	直接人工	33,904	9.59	34,092	13.24	3,344	10.98
	製造費用	27,327	7.73	19,500	7.58	2,205	7.24
	小計	353,493	100.00	257,418	100.00	30,457	100.00
其他電漿設備	直接原料	42,155	80.40	48,993	75.95	5,546	78.21
	直接人工	5,527	10.55	9,791	15.18	927	13.07
	製造費用	4,747	9.05	5,720	8.87	618	8.72
	小計	52,429	100.00	64,504	100.00	7,091	100.00
合計	直接原料	334,417	82.39	252,819	78.54	30,454	81.11
	直接人工	39,431	9.71	43,883	13.63	4,271	11.37
	製造費用	32,074	7.90	25,220	7.83	2,823	7.52
	總計	405,922	100.00	321,922	100.00	37,548	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司及其子公司主要從事各式電漿設備及相關零配件之研發、製造與銷售。主要產品為電漿去膠渣及蝕刻機與其他電漿設備，其他電漿設備則包含常壓/真空電漿清洗機、電漿極化機及其他各式電漿相關設備。該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季直接原料占製成品總成本比重分別為 82.39%、78.54%及 81.11%；直接人工占製成品總成本比重分別為 9.71%、13.63%及 11.37%；製造費用占製成品總成本比重分別為 7.90%、7.83%及 7.52%。

該公司採訂單式生產，各期產品成本金額主係受公司營運訂單增減所變動。就直接原料占比而言，112~113 年度及 114 年第一季電漿去膠渣及蝕刻機設備直接原料占該產品總成本分別為 82.68%、79.18%及 81.78%，其他電漿設備則為 80.40%、75.95%及 78.21%，顯示其主要產品結構中均係以直接原物料占最大宗，約為 75~83%，而主要原物料組成係客製化機構元件、真空元件與幫浦及電源供應器等，所占比重會隨銷售產品組合及設計規劃的不同而波動；直接人工部分，112~113 年度及 114 年第一季電漿去膠渣及蝕刻機設備直接人工占該產品總成本分別為 9.59%、13.24%及 10.98%，其他電漿設備則為 10.55%、15.18%及 13.07%。

113 年度電漿去膠渣及蝕刻機設備直接原料占比較 112 年度下降，直接人工占比上升，主係 113 年度搭載高成本自動化手臂機台數減少，故直接原料占比下降，直接人工相對上升。114 年第一季該品項設備型號多為續訂訂單，製程已相對穩定故無需額外投入人力改機，故直接人工占比較 113 年度下降，直接原料占比相對提升。其他電漿設備部分，112 年度因銷售組合包含高單價之電漿極化機，其直接原料成本亦較高，拉升直接原料占比，113 年度則多為直接原料成本相對較低之清洗

機，故直接原料及直接人工占比有所消長，114 年第一季該類別設備組成主係原物料成本較高之連續式電漿設備，故直接原料占比較 113 年度略為提高。製造費用主係耗材使用及相關費用分攤，就製造費用占比而言，112~113 年度及 114 年第一季均各占比不到 10%且變動不大。

整體而言，各主要產品之原料、直接人工及製造費用等成本結構略有不同，主要係因不同項目產品之原物料價格波動、製程及人力投入等各項因素而略有差異，其原物料、直接人工及製造費用比率之變化情形尚無重大異常。

2.符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理

該公司非屬「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司，故不適用。

(五)匯率變動情形

就發行公司最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以分析匯率變動對發行公司營運之風險，及發行公司之避險措施。

1.最近期及最近二個會計年度內外銷、內外購比率分析

內外銷金額及其比率

單位：新台幣千元；%

年度 項目	112 年度		113 年度		114 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	293,679	38.54	261,590	47.77	64,759	77.90
外銷	468,360	61.46	286,040	52.23	18,372	22.10
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	83,131	100.00

資料來源：該公司提供；各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

內外購金額及其比率

單位：新台幣千元；%

年度 項目	112 年度		113 年度		114 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
內購	241,614	98.22	197,322	92.07	66,092	97.55
外購	4,382	1.78	17,002	7.93	1,663	2.45
合計	245,996	100.00	214,324	100.00	67,755	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之外銷佔整體營業收入比重分別為 61.46%、52.23%及 22.10%，該公司及其子公司外銷市場主要以中國大陸為主，其他則銷往美國、歐洲及東南亞國家，主要以美元為計價幣別，少部分採人民幣及日幣計價。113 年及 114 年第一季因主要來自海外主要客戶擴廠需求訂單大多已於 112 年完成，加上全球 IC 載板及印刷電路板產業庫存去化及積極擴廠後而終端需求不如預期，以致供過於求，IC 載板及印刷電路板客戶因業績下滑而放緩資

本支出，使外銷金額下滑。

在採購方面，112~113 年度及 114 年第一季之內購比重分別為 98.22%、92.07%、97.55%，其比重皆維持在九成以上，主係該公司及其子公司大部份原料需求由國內廠商供應即可滿足需求以及考量交期配合度，致該公司及其子公司外購比例占整體進貨比例較低，採購付款幣別主要以新台幣為主，少部分為美元、歐元及日幣計價。

綜上所述，該公司及其子公司外幣收入遠大於外幣支出，以美元資產部位為主，因此新台幣兌美元波動與該公司及其子公司營收及獲利息息相關，此匯率波動對該公司及其子公司之損益有相當之影響，該公司及其子公司隨時留意美元匯率以決定適當兌換時機，來降低匯率波動造成之風險。

2. 最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業收入及營業利益之比例

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度	113 年度	114 年第一季
		金額	金額	金額
兌換(損)益		3,170	22,349	4,357
營業收入		762,039	547,630	83,131
營業利益		166,599	87,039	(1,339)
兌換(損)益/營業收入(%)		0.42	4.08	5.24
兌換(損)益/營業利益(%)		1.90	25.68	(325.39)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之兌換(損)益分別為 3,170 千元、22,349 千元及 4,357 千元，占各年度或當期之營業收入之比率分別為 0.42%、4.08%及 5.24%；占各年度或當期之營業利益之比率分別為 1.90%、25.68%及 (325.39)%。該公司及其子公司產品交易型態係多為外銷，具重大影響之外幣主係為美元，匯兌損益主要隨其淨外幣資產部位之增減變動及匯率走勢而變化。

112 年度因美國聯準會採取升息政策趨勢放緩，使美元兌新台幣呈現先升後貶，致 112 年度產生淨兌換利益 3,170 千元；113 年度因全球通貨膨脹降溫緩慢，美國聯準會延後降息，美元仍維持強勢，致 113 年度產生淨兌換利益 22,349 千元；114 年第一季因美國聯準會升息政策，美元持續強勢，致 114 年第一季產生淨兌換利益 4,357 千元。整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季兌換(損)益隨外幣匯率之變化而有所波動，其變動原因尚屬合理。

該公司及其子公司兌換(損)益之變化情形主係隨著美元匯率變化所致，與匯率變動趨勢相較尚屬合理，各年度及當期之兌換損益占該公司及其子公司營業收入比例甚微，兌換(損)益占營業利益比率 112 年度比例微小，113 年及 114 年第一季因主要來自海外主要客戶擴廠需求訂單大多已於 112 年完成，加上全球 IC 載板及印刷電路板產業庫存去化及積極擴廠後而終端需求不如預期，以致供過於求，IC 載板及印刷電路板客戶因業績下滑而放緩資本支出，使得該公司接單情況不如預期，該公司及其子公司營收下滑進而造成 113 年度營業利益減少及 114 年第一季產生

營業損失，使兌換損益占營業利益比率變動較大，整體而言，匯率變動對該公司及其子公司獲利尚未構成重大風險負擔，該公司及其子公司將持續觀察國際總體經濟情勢及匯率走勢，以採取必要避險之措施，降低匯率變動風險對公司產生之影響。

3.該公司因應匯率變動之避險措施

- (1)該公司部分採取外幣應收付款項相互沖抵，以降低曝險部位達到自然避險效果降低匯率風險。
- (2)財務部門與金融機構保持密切關係，藉由銀行提供之匯率變動分析及諮詢服務，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，同時隨時密切注意匯率變化資訊及持續觀察國際總體經濟情勢，除採適度保留外幣資產以支應外幣需求外，配合公司資金需求，適時換匯調節外幣部位。
- (3)該公司依股東會決議通過之「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性金融商品相關作業程序，必要時得視外幣部位及匯率變動情形由財務主管採取適當避險措施，承作適當的金融商品，以降低該公司業務經營所產生之匯率風險。

綜上所述，該公司在外幣資金管理上採取穩健保守原則，已採取相當必要且適當措施以降低匯率變動產生之風險，因此該公司之相關匯兌避險措施，應能適切控管並降低其匯兌風險變動之可能衝擊，故匯率變動對該公司應未產生重大營運風險。

參、業務狀況

一、營業概況

(一)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象(年度前十名或占年度營業收入淨額百分之五以上者)之變化分析—應列明最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策。

1.最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣千元；%

排名	112 年度				113 年度				114 年第一季			
	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係
1	A1	127,069	16.67	無	A11	78,619	14.36	無	A2	25,685	30.90	無
2	A2	107,190	14.07	無	A7	66,002	12.05	無	A17	23,631	28.43	無
3	A3	67,666	8.88	無	A12	46,202	8.44	無	A18	8,870	10.67	無
4	A4	57,255	7.51	無	A13	46,051	8.41	無	A19	7,023	8.45	無
5	A5	55,193	7.24	無	A1	42,662	7.79	無	A20	5,500	6.62	無
6	A6	50,151	6.58	無	A3	36,002	6.57	無	A11	2,949	3.55	無
7	A7	43,824	5.75	無	A14	25,890	4.73	無	A21	2,371	2.85	無
8	A8	34,821	4.57	無	A6	23,682	4.32	無	A22	1,408	1.69	無
9	A9	33,000	4.33	無	A15	23,193	4.24	無	A23	721	0.87	無
10	A10	20,610	2.70	無	A16	22,047	4.03	無	A24	667	0.80	無
	小計	596,779	78.30		小計	410,350	74.94		小計	78,825	94.83	
	其他	165,260	21.70		其他	137,280	25.06		其他	4,306	5.17	
	銷貨淨額	762,039	100.00		銷貨淨額	547,630	100.00		銷貨淨額	83,131	100.00	

資料來源：該公司提供。

(2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司及其子公司致力於提供半導體產業、IC 載板與印刷電路板(以下簡稱 PCB)產業、平面顯示器與 LED 等光電產業、非電子業及民生工業、太陽能產業、新能源與環保產業及通訊產業等各式製程間，所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質之解決方案與電漿設備等研發、生產及銷售。該公司透過持股 100%之投資公司 Stable Promise Group Co., Ltd 轉投資中國昆山金暉盛電子商貿有限公司(以下簡稱：金暉盛公司)，由暉盛公司負責電漿設備之研發、生產及銷售，並由金暉盛公司負責中國地區客戶之售後維護。該公司及其子公司主要客戶遍布國內外且多為知名大廠，銷售地區主要為台灣、中國、歐美及日本等地區。112~113 年度及 114 年第一季對前十大主要銷貨對象之銷售金額分別為 596,779 千元、410,350 千元及 78,755 千元，占當期營業收入比率分別為 78.30%、74.94%及 94.75%，銷售對象之消長情形主係受市場總體環境、半導體市場發展趨勢、終端客戶需求、客戶資本支出政策及客戶營運狀況等因素影響。以下茲就該公司 112~113 年度及 114 年第一季主要銷售對象變化情形分析如下：

A1. A1公司

A1公司位於中國，成立於2021年，主要從事封裝基板的研發、生產、加工與銷售，該公司於111年開始與A1公司交易往來，主要銷售產品為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A1公司銷售淨額分別為127,069千元、42,662千元及65千元，占各年度銷貨比重分別為16.67%、7.79%及0.08%。隨著中國近年大力推動半導體產業及國產晶片自主化，在國家補助下進一步推升其載板業務的成長，而A1公司係中系PCB龍頭首次跨足到高階ABF載板量產領域所設立之公司，故112年度受益於A1公司產能建設完成並加大市場拓展力度，需求機台較多，且多為單價較高之連續式自動化電漿設備，故銷貨金額增加成為第一大客戶；113年度受新設產線建置已陸續完成，僅餘後續少數機台需求，故對該客戶之銷貨金額減少，降為第五大客戶；114年第一季僅有維修收入，機台銷售作業尚未完成，故退出前十大之列，其變動尚屬合理。

A2. A2公司

A2公司為國內上市公司，主要從事印刷電路板(PCB)、高密度連接板(HDI PCB)、軟板(FPC)、軟硬複合板 (Rigid-flex PCB)、載板(IC Carrier)與IC測試及預燒系統之開發、製造、加工與銷售等業務。該公司與A2公司自92年即開始往來，主要銷售品項為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A2公司銷售淨額分別為107,190千

元、18,912千元及25,685千元，占各年度銷貨比重分別為14.07%、3.45%及30.90%。A2公司因110及111年度積極擴充ABF載板產能，銷售之設備陸續於111及112年交機確認完成，故112年度為第二大客戶，112~113年度受全球電子業景氣下行影響，ABF載板需求疲弱，A2公司業績衰退下亦暫緩資本支出，故當年度僅有維修收入交易並退出銷售前十大之列；114年第一季因PCB客戶去化庫存進入尾聲，出貨恢復，市場對於ABF載板與HDI(高密度連接板)需求穩健成長，資本支出亦提升，故A2公司對暉盛公司之採購增加，成為第一大銷售客戶，經評估其變動尚屬合理。

A3. A3公司

A3公司為國內上市公司，主要從事電子零組件製造業，專注於積體電路(IC)封裝用載板的製造與銷售，其產品主要應用領域涵蓋手機、GPU、基地台、消費性產品、網通設備等。該公司與A3公司自91年即開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A3公司銷售淨額分別為67,666千元、36,002千元及502千元，占各年度銷貨比重分別為8.88%、6.57%及0.60%。該公司113年度對A3公司之銷售較112年度下滑，主係112年度A3公司採購之機台多為高單價之自動化電漿設備，故銷售金額較高，為該年度第三大客戶，然A3公司至113年度向該公司採購數量減少且以較低單價之手動型機台為主，銷貨金額減少退居為第六大客戶，114年第一季尚僅有維修收入交易，而退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A4. A4公司

A4公司為美國掛牌公司，係全球最大的半導體公司之一，主要從事電腦中央處理器(CPU)、顯示卡(GPU)與加速晶片及晶片組之生產與銷售。該公司與A4公司自99年開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112及113年度該公司對A4公司銷售淨額分別為57,255千元及307千元，占各年度銷貨比重分別為7.51%及0.06%。112年度採購品項為生產下世代先進封裝之玻璃基板所需之搭配自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)之去膠渣電漿設備，其高單價特性使其成為該年度第四大客戶，爾後受全球PC與伺服器市場需求疲弱、庫存過高及產能利用率下降影響，以及AI領域面臨市場競爭加劇，致A4公司整體營運狀況不佳，且玻璃基板之先進封裝尚未量產，故自113年度起退出前十大，114年第一季尚未有銷售金額，經評估其變動尚屬合理。

A5. A5公司

A5公司於2011年成立於中國，主要從事AMOLED(主動矩陣有機發

光二極體顯示器)相關產品生產。該公司與A5公司自110年開始往來，主要銷售項目為電漿極化機及維修零配件。112及113年度該公司對A5公司銷售淨額分別為55,193千元及227千元，占各年度銷貨比重分別為7.24%及0.04%。其母公司集團為全球智慧手機晶片製造商之供應鏈廠商，為其專案開發超音波指紋辨識模組製程之常壓電漿極化機，致112年度為第五大客戶，113年度暫無採購需求，僅有維修零配件收入並退出前十大，114年第一季尚未有銷售金額，經評估其變動尚屬合理。

A6. A6公司

A6公司於1968年成立於奧地利，主要從事機械和材料的貿易，業務涵蓋印刷電路板、電子裝配自動化、標籤與包裝印刷。該公司與A6公司自107年開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112及113年度該公司對A6公司銷售淨額分別為50,151千元及23,682千元，占各年度銷貨比重分別為6.58%及4.32%，分別為第六大及第八大銷售客戶。A6公司為該公司拓展奧地利上市印刷電路板和IC載板大廠業務之銷售經銷商，受景氣影響新機需求減緩，故經銷商A6公司向該公司採購數量亦減少，114年第一季則尚未有銷售金額，經評估其變動尚屬合理。

A7. A7公司

A7公司於2019年成立於中國，為上市公司之子公司，主要從事高階半導體封裝載板之生產，產品主要用於高速運算、5G、AI、IoT、車用電子等市場應用。該公司自110年開始與A7公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A7公司銷售淨額分別為43,824千元、66,002千元及153千元，占各年度銷貨比重分別為5.75%、12.05%及0.18%，112及113年度分別為第七大及第二大銷售客戶。

A7公司於111年度建設BT及ABF載板新廠，故訂購多台電漿設備，預計於111~112年度間分批交貨，惟後續受全球半導體市場需求不振影響，A7公司與該公司協商遞延交貨時程，使較多機台於113年度認列收入，因新廠計畫剛完成，故114年第一季僅有維修收入並退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A8. A8公司

A8公司於2021年成立於馬來西亞，母公司為歐系高階印刷電路板和IC載板的領導製造商，A8公司為母公司100%持有之轉投資公司，主要從事高階半導體封裝載板生產製造。該公司於111年開始與A8公司交易

往來，主要銷售項目主要為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A8公司銷售淨額分別為34,821千元、21,218千元及290千元，占各年度銷貨比重分別為4.57%、3.87%及0.35%。

A8公司主係其集團因應處理器大廠產品生產線所設立，於113年開始營運，因此陸續於112及113年銷售機台，因大多於112年交機，112年度為第八大銷售客戶，113年度數量較少而退出前十大之列，114年第一季僅有維修收入，經評估其變動尚屬合理。

A9. A9公司

A9公司於民國105年設立，為上市公司之子公司，於111年設立南科分公司，主要從事軟性印刷電路板(FPC)及SMT表面貼裝服務之設計與製造，產品運用鎖定AR/VR/MR、家用智慧裝置、光模組及車用電子。該公司自112年開始與A9公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112及114年第一季該公司對A9公司銷售淨額分別為33,000千元及101千元，占各年度銷貨比重分別為4.33%及0.12%。

A9公司南科廠之定位為生產更高端、結構和精密度要求更複雜的軟板產品，112年度因設廠需求採購品項為較高單價之卷對卷設備，為該年度第九大銷售客戶，113年度無新機採購需求，114年第一季僅有維修訂單，經評估其變動尚屬合理。

A10. A10公司

A10公司於2011年成立於中國，母公司為歐系高階印刷電路板和IC載板的領導製造商，A10公司為母公司100%持有之轉投資公司，主要從事高密度印刷電路板(HDI PCB)和高端半導體封裝載板的開發、設計、生產與銷售。該公司與A10公司於104年開始交易往來，主要銷售項目主要為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A10公司銷售淨額分別為20,610千元、2,116千元及49千元，占各年度銷貨比重分別為2.70%、0.39%及0.06%。112年度A10公司為提升產能需求，採購高單價之電漿設備故成為第十大客戶，113年度起則為維修訂單，故退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A11. A11公司

A11公司於民國94年設立，主要從事半導體生產設備、液晶生產設備、半導體實裝設備、遮斷器設備、電子零組件、材料、資訊設備等的銷售、進出口、安裝和維護。該公司自102年開始與A11公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機、電漿蝕刻機及維修零配件。112~113年度

及114年第一季該公司對A11公司銷售淨額分別為19,008千元、78,619千元及2,949千元，占各年度銷貨比重分別為2.49%、14.36%及3.55%。

A11公司為該公司拓展日系客戶之經銷商，主要負責再銷售該公司設備至日本客戶，核心客戶包含日系PCB及IC載板大廠。因日系大廠終端客戶對於先進半導體所需晶片封裝基板之需求，113年度對透過A11公司下單需求增加，且多為高單價之連續式電漿設備，故成為113年度第一大銷貨客戶，114年第一季因尚未交機而僅有維修收入，退居第六大，經評估其變動尚屬合理。

A12.A12公司

A12公司於2022年成立於中國，母公司為中國領先高密度互連(HDI)與半導體封裝基板製造商之一，產品涵蓋載板、類載板、高階及任意層互連HDI、軟硬結合板及軟板、貼片及組裝、動力電池模塊等。A12公司係其集團設立於廈門的子公司，專注於高端封裝基板和高密度互連(HDI)技術的研發與製造，為其集團在中國半導體封裝基板領域的重要佈局，113年度受益於集團生產設備資本支出建設之規劃，開始與該公司交易往來，採購項目為高單價之連續式電漿設備，交易金額為46,202千元，成為113年度第三大銷貨客戶，114年第一季僅有維修收入6千元，故退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A13.A13公司

A13公司於2023年成立於中國，母公司為專注於顯示產業雷射修復與切割自動化設備的高新技術企業，產品涵蓋LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等全製程雷射精密修復與切割設備。A13公司為該公司中國地區經銷商之一，113年首度將暉盛機台成功銷售至大陸半導體面板級封裝客戶，且為高單價之連續式且搭配自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)之電漿蝕刻機設備，銷售金額46,051千元，占比8.41%，為該年度第四大銷售客戶，114年第一季則尚未有機台及維修訂單交易，經評估其變動尚屬合理。

A14.A14公司

A14公司為國內上櫃公司，主要從事精密化學品之生產製造與銷售，為台灣半導體特殊氣體及先進材料供應商，與該公司自113年度開始交易，主要銷售項目為電漿蝕刻機。113年度該公司為A14公司開發出應用於晶圓重生代工產品線之自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)電漿蝕刻機，銷售金額為25,890千元，占比4.73%，使其成為113年度第七大銷售

客戶，114年第一季則尚未有交易往來，經評估其變動尚屬合理。

A15.A15公司

A15公司為國內上市公司，主要從事衛星通訊系列產品之生產製造與銷售，產品涵蓋Wi-Fi、5G、車聯網、衛星通訊等領域，與該公司自105年度開始交易，主要銷售項目為電漿清洗機及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A15公司銷售淨額分別為6,139千元、23,193千元及206千元，占各年度銷貨比重分別為0.81%、4.24%及0.25%。

112年度因Wi-Fi 6/6E產品出貨增加、車用通訊電子模組需求上升，以及低軌道衛星通訊產品的導入，而向該公司採購設備，113年度因其車用產品出貨量回升，而增加對該公司電漿設備之需求，故成為第九大銷售客戶；此外，A15公司為低軌衛星業者台廠供應鏈業者之一，因應地緣政治問題，業者要求供應商需擴大兩岸以外的產能，近年A15公司積極擴大越南產能，114年第一季主要由越南子公司與該公司交易，故僅有維修收入而退出前十大，經評估其變動尚屬合理。

A16.A16公司

A16公司於2013年成立於中國，主要從事電子產品的研發、加工與銷售；機電設備及配件的製造、銷售與維修。該公司自108年與A16公司交易往來，其為該公司於中國地區經銷商之一，112及113年度主要向該公司採購電漿去膠渣設備，銷售淨額分別為14,225千元及22,047千元，占各年度銷貨比重分別為1.87%及4.03%。113年度A16公司主要採購項目為大陸知名封裝基板廠所需設備，該封裝基板廠113年度因量產啟動與市場拓展需求設備較多，故透過A16公司採購機台增加，該公司對A16公司銷售金額成長，為該年度第十大客戶；114年第一季則尚未有機台及維修零配件之交易，經評估其變動尚屬合理。

A17.A17公司

A17公司為國內上櫃公司，主要從事印刷電路板之製造及買賣，產品應用於網通產品、工業電腦、AI伺服器產品、半導體設備等，與該公司自111年度開始交易，主要銷售項目為電漿去膠渣及維修零配件。112~113年度及114年第一季該公司對A17公司銷售淨額分別為21千元、6,582千元及23,631千元，占各年度銷貨比重分別為0.00%、1.20%及28.43%。113年度下半年起受益於高速運算(HPC)趨勢帶動交換器升級及AI應用的興起，A17公司營運回升跡象明顯，啟動擴產計畫，故對該公司採購設備隨之增加，於114年第一季成為第二大銷售客戶，經評估其變

動尚屬合理。

A18.A18公司

A18公司於2018年成立於新加坡，主要從事工業機械與設備的安裝、機械工程作業。該公司自107年與A18公司交易往來，其為該公司於新加坡地區經銷商，112~113年度及114年第一季主要向該公司採購電漿去膠渣設備及維修零配件，銷售淨額分別為9,646千元、980千元及8,870千元，占各年度銷貨比重分別為1.27%、0.18%及10.67%。A18公司主係採購該公司設備並再銷售予日本PCB製造商其新加坡子公司之業務。近年隨著AI、電動車和高效能運算等新興技術的發展，新加坡PCB商營運尚屬穩定發展，該公司各年度對A18公司的銷貨收入主係受新加坡終端客戶需求變動，經評估其變動尚屬合理。

A19.A19公司

A19公司為國內上市公司100%轉投資之越南子公司，主要從事衛星通訊系列產品及移動通訊系列產品之製造與銷售。雙方自109年開始交易往來，112及113年度未有訂單交易，母公司A15公司為低軌衛星業者台廠供應鏈業者之一，因應地緣政治問題，低軌衛星業者要求供應商需擴大兩岸以外的產能，近年A15公司積極擴大越南產能，114年第一季主要由越南子公司A19公司與該公司交易，主要採購連續式電漿清洗機，銷售金額為7,023千元，占比8.45%，成為第四大客戶，經評估其變動尚屬合理。

A20.A20公司

A20公司為國內上市公司，主要從事小訊號產品之後段晶片封裝與檢測，聚焦於開發與生產小型且薄型化封裝產品，產品廣泛應用於車用、工業、通訊與AI伺服器等領域，與該公司自113年度開始往來，主要銷售項目為電漿清洗機。受益於市場景氣回升，A20公司在車用與AI應用市場的布局逐漸發酵，自113年起營運逐步回升資本支出增加而向暉盛公司下單採購，114年第一季該公司對A20公司銷售淨額為5,500千元，占銷貨比重為6.62%，為該年度第五大銷售客戶，經評估其變動尚屬合理。

A21.A21公司

A21公司為國內上櫃公司，主要從事檢測分析服務，專注於晶圓級可靠度測試、失效分析、材料分析等技術，服務對象涵蓋晶圓代工、IC設計、封裝測試、車用電子與AI晶片等領域。與該公司自101年度開始往來，主要銷售項目為手動式電漿清洗機及維修零配件。因A21公司主營

檢測業務，對該公司新機需求不大，故112及113年度僅有維修收入，分別為5千元及214千元，113年下半年隨半導體產業景氣回溫，受惠於AI晶片與車用電子需求持續強勁，A21公司積極投資先進測試設備，114年第一季銷售金額增加至2,371千元，占比2.85%，為第七大客戶，經評估其變動尚屬合理。

A22.A22公司

A22公司為國內上市公司，主要從事彩色濾光膜產品相關之研究、設計、製造、銷售及封裝測試，主要客戶涵蓋晶圓代工、IC設計、車用電子及AI晶片等領域。與該公司自109年度開始往來，112~113年度及114年第一季主要向該公司採購維修零配件，銷售淨額分別為1,652千元、4,099千元及1,408千元，占各年度銷貨比重分別為0.22%、0.75%及1.69%，114年第一季為第八大客戶。A22公司近年將舊機台進行參數優化，暫無採購設備之需求，僅有維修零配件之銷售，經評估其變動尚屬合理。

A23.A23公司

A23公司於2022年設立，主要從事封裝基板的研發、生產、加工與銷售，為該集團為優化資源配置，將高階IC載板實施主體由其他子公司改為A23公司主導所設立。該公司於112年開始與A23公司交易往來，112~113年度及114年第一季銷售A23公司之項目主係維修零配件，銷售淨額分別為603千元、2,926千元及721千元，占各年度銷貨比重分別為0.08%、0.53%及0.87%，114年第一季為該公司第九大客戶，經評估其變動尚屬合理。

A24.A24公司

A24公司於2022年設立，主要從事封裝基板的研發、生產、加工與銷售，為該集團拓展在深圳地區的業務所設立。該公司於112年開始與A24公司交易往來，112~113年度及114年第一季銷售A24公司之項目主係維修零配件，銷售淨額分別為116千元、1,432千元及667千元，占各年度銷貨比重分別為0.02%、0.26%及0.80%，114年第一季為該公司第十大客戶，經評估其變動尚屬合理。

綜上所述，該公司 112~113 年度及 114 年第一季之主要銷售對象變化之情形尚屬合理，並無重大異常情形。

(3)是否有銷貨集中之風險

暉盛公司主要從事電漿製程設備之開發、製造與銷售，並提供相關製程參數優化、客製模組整合與智慧化維運服務。產品廣泛應用於半導體晶圓、先進封裝、載板、再生晶圓、感測器等產業，其銷售對象係以國內外於半導體、印刷電路板(PCB)、光電等產業大廠。112~113 年度及 114 年第一季對前十大主要銷貨對象之銷售比率分別為 78.30%、74.94%及 94.75%；其中各年度銷售與最大客戶占整體營收比例分別為 16.67%、14.36%及 30.90%。該公司於半導體及 PCB 產業深耕多年，主要客戶多為產業大廠，品質深獲肯定，且該公司產品多為通過合格認證後始成為長期往來供應商，然各年度銷貨排行易受銷售客戶之擴廠需求或產線擴充資本支出計畫、銷售產品規格不同及半導體市場發展趨勢等因素影響。112 及 113 年度未有銷售客戶占比超過 30% 而產生銷貨集中之情形；114 年第一季則有銷貨集中之情事，係因該公司當期營收規模較小，故使銷售對象及金額分佈易因單一客戶銷貨金額較高產生較大波動及銷貨集中情形，隨著高效能人工運算及 AI 應用崛起，帶動先進封裝製程設備需求持續成長，國內封測廠紛紛投入建置相關製程產能，將帶動該公司營運成長，可改善單一客戶集中之問題。

(4)發行公司之銷售政策

該公司深耕電漿製程設備之設計、製造組裝、銷售及售後服務已超過二十年，其技術、品質及服務在市場占有一席之地，未來擬透過下列銷售政策，以持續拓展公司業務並維繫公司競爭利基：

A.持續深耕半導體、IC 載板、PCB 及光電產業，以掌握製程發展趨勢

針對產業日益月新技術所帶來製程變化，該公司以長期累積之設備高彈性客製化開發能力，配合既有客戶新製程彈性化設計開發新設備，以擴大市場占有率，並同時以既有產品開拓潛在新客戶及積極參與重要商展，強化產品於市場之曝光度與口碑。

B.運用既有核心技術，積極拓展新產品新產業應用領域

為降低以往銷售客戶集中於半導體等產業之現象，該公司持續投入研發資源開發綠色製程技術，如：氫能源應用、廢棄物與尾氣裂解處理及低碳製程替代方案等，可有效提升資源運用效率，協助客戶製程或產品符合環保法規並減輕對環境的負荷，於減廢節能環保同時並響應 ESG 永續發展趨勢。

C.以「以質取勝」策略推廣市場

該公司憑藉扎實技術能力於台灣、中國、歐美及日本等知名國際半導體、PCB 及光電產業之供應鏈中站穩腳步，近年來更成功取得國際頂尖廠商特定製程之認證與認可。該公司可提供彈性並多樣之解決方案，未來將以更先進技術及高彈性客製化服務提高客戶黏著度，並積極拓展具有發展潛力之客戶群，持續擴大公司之營運規模，為整體營收及獲利能力挹注成長動能。

2.最近期及最近二個會計年度主要供應商（年度前十名或占年度進貨淨額百分之五以上者）之變化分析—應列明最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

(1)最近期及最近二個會計年度主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年第一季			
	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係
1	B1	36,704	14.92	無	B3	27,743	12.94	無	B3	11,340	16.74	無
2	B2	31,327	12.74	無	B4	24,485	11.43	無	B4	9,742	14.38	無
3	B3	27,617	11.23	無	B1	20,926	9.76	無	B1	9,620	14.20	無
4	B4	27,415	11.14	無	B5	19,714	9.20	無	B5	7,078	10.45	無
5	B5	15,187	6.17	無	B11	12,795	5.97	無	B9	3,533	5.21	無
6	B6	14,055	5.71	無	B2	12,414	5.79	無	B10	3,053	4.50	無
7	B7	10,491	4.26	無	B12	9,650	4.50	無	B13	2,242	3.31	無
8	B8	8,820	3.59	無	B7	6,998	3.27	無	B14	1,665	2.46	無
9	B9	7,137	2.90	無	B9	6,695	3.12	無	B15	1,580	2.33	無
10	B10	6,289	2.56	無	B10	5,913	2.76	無	B16	1,539	2.27	無
	其他	60,954	24.78		其他	66,991	31.26		其他	16,363	24.15	
	進貨淨額	245,996	100.00		進貨淨額	214,324	100.00		進貨淨額	67,755	100.00	

資料來源：該公司提供。

(2)最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

該公司主要從事各式電漿設備之研發、製造與銷售，主要原物料為構件、真空幫浦、電源供應器、真空元件及流量計等。該公司以訂單式生產為主，除部分交期較長之共用性原物料，如電源供應器及真空幫浦，為確保原物料交期穩定而採一次性批量購買，多數原物料皆為接單後始進行下單採購，故進貨金額主係受公司營運訂單增減所變動。112~113 年度及 114 年第一季之前十大供應商進貨金額占各年度進貨淨額比重分別為 75.22%、68.74%及 75.85%，茲就該公司主要供應商之變化情形分析說明如下：

A.B1 公司

B1公司於民國98年設立，主要從事自動化機械設備及零件之銷售，該公司自98年開始與B1公司交易，主要向其採購自動化設備如自動化輸送機。112~113 年度及 114 年第一季之進貨金額分別為36,704千元、20,926千元及9,620千元。因B1公司在自動化設備領域擁有優良之技術，產品品質良好，故為該公司自動化機械設備主要供應商，分別為各年度第一大、第三大及第三大供應商。112年度因該公司營運表現佳故進貨金額較高；113年度受該公司業績下滑影響採購金額較112年減少；114年第一季因預計出貨之自動化單雙腔及連續式清洗機訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額提升，整體而言變化情形尚屬合理。

B.B2 公司

B2公司於民國96年設立，主要從事各式自動化設備之製造與銷售。該公司自109年開始與B2公司交易，主要向其採購項目為自動上下料機械設備。112~113 年度及 114 年第一季之進貨金額分別為31,327千元、12,414千元及542千元，112~113 年度為第二大及第六大供應商，114 年第一季則退出前十大供應商。113 年度起因受該公司業績下滑，且搭載自動上下料性能之設備訂單減少，整體而言變化情形尚屬合理。

C.B3 公司

B3公司於民國92年設立，主要從事真空腔體及真空管路等零件加工與銷售。該公司自94年開始與B3公司交易，主要向其採購真空腔體、真空管路及真空元件。112~113 年度及 114 年第一季之進貨金額分別為27,617千元、27,743千元及11,340千元，分別為各年度第三大、第一大及第一大供應商。112~113 年度進貨金額變化不大；114 年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

D.B4 公司

B4公司於民國87年設立，主要從事各式幫浦系統、測試儀器及零配件等之製造與銷售。該公司自94年開始與B4公司交易，主要向其採購真空幫浦。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為27,415千元、24,485千元及9,742千元，分別為各年度第四大、第二大及第二大供應商。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，且該公司採訂單式生產故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

E.B5 公司

B5公司於民國68年設立，為國內上櫃公司，主要從事晶圓再生、半導體濕製程設備、LED、太陽能與FPD製程設備製造與銷售，及代理銷售電源供應器。該公司自102年開始與B5公司交易，主要向其採購電源供應器。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為15,187千元、19,714千元及7,078千元，分別為各年度第五大、第四大及第四大供應商。113年度因採用高單價電源供應器訂單需求占比增加，以及因應客製化需求添購B5公司代理之真空設備機械手臂，故採購金額較112年增加；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，且該公司採訂單式生產故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

F.B6 公司

B6公司於民國99年設立，主要從事自動化設備及五金零件之製造與銷售。該公司自107年開始與B6公司交易，主要向其採購項目為自動化單腔設備。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為14,055千元、1,139千元及1,019千元。113年度因受該公司自動化單腔設備訂單減少，故採購金額下降；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，且該公司採訂單式生產故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

G.B7 公司

B7公司於民國77年設立，為國內上櫃公司，主要從事自動化設備及零件之製造與銷售。該公司自110年開始與B7公司交易，主要向其採購項目為自動化設備。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為10,491千元、6,998千元及0千元，112~113年度分別為第七大及第八大供應商，114年第一季暫無交易而退出前十大。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年第一季因無搭載B7公司自動化設備之訂單，故未向其採購，整體而言變化情形尚屬合理。

H.B8 公司

B8公司於民國100年設立，主要從事卷對卷製程設備之製造與銷售。該公司自112年開始與B8公司交易，主要向其採購卷對卷處理機。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為8,820千元、0千元及33千元。B8公司為國內卷對卷設備專業廠商，具備專業水平度/平行度校正技術及3D建構設計，因其技

術領先及交期可符合該公司要求，故於112年向其採購卷對卷處理機，擠身前十大供應商之列，113年度因受該公司業績下滑影響，113年尚無交易，114年第一季則僅向其購買機台料件，整體而言變化情形尚屬合理。

I.B9 公司

B9公司於民國93年設立，主要從事日本品牌空油壓元件與電動缸之代理、車銑床機械加工、機械五金及電控材料之製造與銷售。該公司自94年開始與B9公司交易，主要向其採購台車、邊框及車銑床零件。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為7,137千元、6,695千元及3,533千元，分別為各年度第九大、第九大及第五大供應商。112~113年度進貨金額變化不大；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

J.B10 公司

B10公司於民國103年設立，主要從事鈹金零件加工。該公司自103年開始與B10公司交易，主要向其採購項目為骨架、鋁電極及鈹金件等。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為6,289千元、5,913千元及3,053千元，分別為各年度第十大、第十大及第六大供應商。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

K.B11 公司

B11公司於民國107年設立，主要從事代理銷售電漿產生裝置及電源供應器。該公司自108年開始與B11公司交易，主要向其採購項目為電源供應器。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為586千元、12,795千元及1,122千元。113年度因應客製化訂單，採用B11公司代理之電源供應器需求增加，故採購金額上升成為第五大供應商；114年第一季搭載B11公司代理之電源供應器訂單減少，故採購金額下降，整體而言變化情形尚屬合理。

L.B12 公司

B12公司於民國78年設立，為國內上市公司，主要從事自動化設備開發及系統整合應用。該公司自112年開始與B12公司交易，主要向其採購上下料之自動化模組及加熱載台。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為1,000千元、9,650千元及0千元。113年因配合客戶指定上下料之自動化模組廠商採用B12公司產品，故進貨金額較高，擠身前十大供應商之列。114年第一季因無搭載B12公司上下料之自動化模組訂單，故未向其採購，整體而言變化情形尚屬合理。

M.B13 公司

B13公司於民國94年設立，主要從事電漿電源供應器之銷售。該公司自95年開始與B13公司交易，主要向其採購電源供應器。112~113年度及114年第一

季之進貨金額分別為1,860千元、5,203千元及2,242千元。113年度起因應客製化電漿清洗機訂單，採用B13公司代理之電源供應器需求增加，故採購金額逐期上升，整體而言變化情形尚屬合理。

N.B14 公司

B14公司於民國92年設立，主要從事代理流量計、濺鍍製程電源供應器、石墨及碳纖等銷售。該公司自94年開始與B14公司交易，主要向其採購流量計及真空元件。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為4,515千元、3,623千元及1,665千元。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

O.B15 公司

B15公司於民國85年設立，主要從事半導體生產設備、半導體用機械手臂、液晶顯示器、自動化機械設備、工業用機械手臂、工業型無線充電裝置、精密加工元件等產品之經銷、代理、進出口貿易。B15公司為該公司114年新增之機械手臂供應商，因其交期及成本能符合訂單需求，故於114年第一季向其採購機械手臂，金額為1,580千元，擠身前十大供應商之列，整體而言變化情形尚屬合理。

P.B16 公司

B16公司於民國86年設立，主要從事真空泵浦及零組件製造及銷售，以及設備及保修技術服務。該公司自91年開始與B16公司交易，主要向其採購真空元件。112~113年度及114年第一季之進貨金額分別為2,816千元、2,880千元及1,539千元。112~113年度進貨金額變化不大，故不擬分析；114年第一季因預計出貨之真空設備訂單增加，及該公司採訂單式生產故採購金額增加，成為第十大供應商，整體而言變化情形尚屬合理。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季對主要供應商之採購金額及比率變化，主要受客戶訂單、客戶預計訂單排程及進貨廠商交期配合度等因素之影響而有所變動。整體而言，該公司主要供應商及交易金額變化情形尚屬合理，並未發現有重大異常之情事。

(3)是否有進貨集中風險之評估

該公司主係依據產品品質、價格及交期配合度選擇進貨供應商，而電漿設備主要原料為機構件、真空幫浦及電源供應器等，主要原料均與兩家以上供應商維持往來關係，以達分散採購過度集中風險、確保供貨來源穩定性以及管控進貨成本之效，且該公司 112~113 年度及 114 年第一季均無對單一供應商進貨比重超過 30%以上之情事。綜合上述，該公司應尚無進貨集中之虞。

(4)公司之進貨政策

該公司之生產方式以訂單式生產為主，或依預估之客戶訂單量，參考現有庫存量依產能狀況排定採購計畫。該公司確保產品品質、價格合理、交貨配合及供貨穩定等因素作為遴選供應商及更換供應商之依據，主要原料皆至少維持二家以上供應商，以分散進料供應商原、物料短缺風險，並針對交期長且採購量大之原物料採一次性批量購買，並依生產排程及訂單交期分次進貨，以保障供貨品質及價格之穩定性。截至評估報告出具日止，該公司與各供應商均能維持良好合作關係，並未有供貨中斷或短缺之情事，其進貨政策尚無重大異常。

(二)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.應收款項變動之合理性

單位：新台幣千元

財報類型		合併財務報告			個體財務報告		
年度/項目		112 年度	113 年度	114年 第一季	112 年度	113 年度	114年 第一季
營業收入淨額		762,039	547,630	83,131	762,120	546,155	81,955
應收款項 總額(A)	應收票據	47	195	333	47	195	333
	應收帳款	274,566	236,942	227,215	273,765	234,781	226,000
	應收帳款-關係人	—	—	—	1,068	1,806	532
	應收款項總額	274,613	237,137	227,548	274,880	236,782	226,865
減：備抵呆帳提列數(B)		6,289	4,123	6,186	6,281	4,117	6,177
應收款項淨額(A)-(B)		268,324	233,014	221,362	268,599	232,665	220,688
備抵損失提列比率(B)/(A)%		2.29	1.74	2.72	2.28	1.74	2.72
應收款項週轉率(次)		2.73	2.14	1.43	2.74	2.13	1.41
應收款項收現天數(天)		134	171	256	134	172	259
授信條件		依該公司「授信管理辦法」規定，由業務部門考量客戶營運規模、財務狀況、歷史交易紀錄等提出信用額度評估，經業務權責主管核准後，會簽財會部門表示專業意見，並視個別合約或訂單約定不同階段收取之訂金款、交機款、驗收款及保固款之收款條件，其收款條件主要如下： 1.非關係人：國內依發票日、國外依客戶通知起，月結 30~180 日。 2.關係人：月結 90 日。					

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告；該公司提供。

註 1：應收款項週轉率均係以應收款項總額計算。

(1)合併

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季合併營業收入淨額分別為 762,039 千元、547,630 千元及 83,131 千元，期末應收款項總額分別為 274,613 千元、237,137 千元及 227,548 千元。112 年度受消費性電子市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板及印刷電路板供過於求使得 IC 載板及印刷電路板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自 112 年度起出現訂單推遲現象，113 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致該公司 113 年度及 114 年第一季營業收入皆較前年同期減少，並導致 113 年底期末應收款項總額隨營業收入下滑而較 112 年底減少 13.65%，114 年 3 月底則較 113 年底應收款項總額減少 4.04%。

依應收款項週轉率觀之，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季合併應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 1.43 次，應收款項收款天數分別為 134 天、171 天及 256 天。受營業收入持續減少影響，該公司及其子公司應收款項週轉率呈持續下滑情形。因該公司及其子公司主要營收來源為精密電漿設備銷售，其應收款項帳齡較長部分主要來自設備銷售尾款(驗收款或保固款)，受

產業特性影響，驗收款須待客戶產線運作順暢或結合其他製程段設備偕同生產無虞後，依其內部作業程序啟動驗收流程並進行付款程序，依客戶別不同，通常需待交機完成日後約 1 年內始進行驗收，客戶才會依交易條件支付。保固款則須待提供之保固期滿(普遍保固期為 1 年，部分客戶為 2 年)才進行收款，故銷售尾款帳齡普遍較長。整體而言，該公司因行業特性應收款項餘額高低係隨著設備銷售收入增減，進而影響應收帳款週轉率之變化，經評估，該公司及其子公司 112~113 年及 114 年第一季合併應收款項總額及週轉率變動情形應屬合理，尚無發現重大異常之情事。

(2)個體

該公司 112~113 年度及 114 年第一季個體營業收入淨額分別為 762,120 千元、546,155 千元及 81,955 千元，期末應收款項總額分別為 274,880 千元、236,782 千元及 226,865 千元，個體應收款項週轉率分別為 2.74 次、2.13 次及 1.41 次，應收款項收款天數分別為 134 天、172 天及 259 天，由於個體各期營業收入、應收款項總額、應收款項週轉率之變化原因皆與合併數相同，故不另行分析。

綜上所述，經評估該公司 112~113 年度及 114 年第一季之合併及個體應收款項及應收款項週轉率變動，並無發現重大異常，其變動尚屬合理。

2.合併及個體備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1)合併及個體備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用國際財務會計準則 IFRS9 之相關規定，採用簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收票據及應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務及產經狀況等。因該公司及其子公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。綜上考量後，將應提列備抵呆帳金額與帳上已認列之備抵呆帳餘額比較；如有不足，應將不足部分認列當期預期信用減損損失；如帳上已認列餘額較多時，則將超過部分當期迴轉預期信用減損損失。茲就該公司及其子公司之預期信用損失率彙整如下：

逾期天數	30天以下	31-90天	91-180天	181-365天	一年以上	已有減損跡象
提列比率	0%~1%	0%~1%	0%~5%	0%~20%	0%~50%	100%

資料來源：該公司提供。

綜上所述，該公司及其子公司多與國內外知名企業進行交易，經參酌個別客戶之信用狀況、收款情形及過去有無實際發生呆帳之經驗後，於期末依應收帳款逾期天數之預期信用損失率評估備抵呆帳，經評估其備抵損失提列政策尚屬合理。

(2)合併及個體備抵損失提列之適足性

單位：新台幣千元

項目	合併財務報表			個體財務報表		
	112 年底	113 年底	114 年 3 月底	112 年底	113 年底	114 年 3 月底
備抵損失金額(A)	6,289	4,123	6,186	6,281	4,117	6,177
應收款項總額(B)	274,613	237,137	227,548	274,880	236,782	226,865
提列比率(A)/(B)	2.29	1.74	2.72	2.28	1.74	2.72

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司提供。

A.合併

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之合併備抵損失占應收款項總額比率分別為 2.29%、1.74%及 2.72%，經核閱該公司應收帳款帳齡表，該公司主要客戶多為長期往來對象及國內外知名企業及產業指標性龍頭廠商，其歷史收款紀錄良好。112~113 年度及 114 年第一季期間，該公司銷售客戶因申請破產重整，其帳款經評估收回可能性微小，故於 112 年將該客戶已 100%提列之備抵損失 62 千元之應收帳款全數沖銷；113 年另筆泰國客戶產品因退運進行銷毀，無法向客戶收取之應收款項 23 千元亦予沖銷外，其餘應收款項並未實際發生壞帳而有無法收回之情事，前述實際發生之壞帳金額微小，壞帳產生原因亦屬合理，尚無重大異常情事。

B.個體

該公司 112~113 年底及 114 年第一季底之個體備抵損失占應收款項總額比率分別為 2.28%、1.74%及 2.72%，該公司 112~113 年度及 114 年第一季期間，除 113 年將泰國客戶無法收取之應收款項 23 千元沖銷外，其餘並無實際發生壞帳費用之情事，且已發生之壞帳金額尚不重大，原因亦屬合理，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司業已針對客戶的規模、營運情況、交易金額及未來訂單需求之不同給予適當的授信條件，定期檢視個別客戶經營狀況以確保帳款之收回可能性，故其合併及個體備抵損失提列金額尚屬合理，應足以涵蓋應收款項可能發生壞帳之風險，適足性尚無疑慮。

(3)應收款項收回可行性之評估

單位：新台幣千元

項 目		年度	114 年 3 月底 金額	114 年截至 5 月底 收回情形		114 年截至 5 月底 未收回情形	
				金額	比率(%)	金額	比率(%)
合併 財務報告	應收票據		333	333	100.00	—	—
	應收帳款		227,215	82,728	36.41	144,487	63.59
	合 計		227,548	83,061	36.50	144,487	63.50
個體 財務報告	應收票據		333	333	100.00	—	—
	應收帳款		226,000	81,657	36.13	144,343	63.87
	應收帳款-關係人		532	420	78.95	112	21.05
	合 計		226,865	82,410	36.33	144,455	63.67

資料來源：該公司經會計師核閱之財務報告；該公司提供之自結數

A. 合併

該公司及其子公司 114 年 3 月底合併之應收款項總額共計 227,548 千元，截至 114 年 5 月 31 日止，應收票據已全數收回；應收帳款已收回 82,728 千元，收回比例為 36.41%，未收回金額為 144,487 千元，未收回比率為 63.59%，而未收回款項中 69,692 千元係屬未逾期之款項，另逾期款項主係為驗收款，共計 74,795 千元，其中 12,558 千元為已驗收機台驗收款(預計 6~7 月收款)，餘 62,237 千元須待客戶驗收後依訂單或合約所載之收款天數內收款。因產業特性通常客戶係於交機完成日後 1 年始進行機台驗收並啟動驗收付款程序，保固款則須待驗收後起算保固年限，惟依該公司之授信政策超過授信期限之帳款仍列為逾期款進行追蹤。

綜上所述，逾期應收款項尚未收回原因尚屬合理。惟該公司及其子公司仍透過業務人員跟催掌握客戶付款時程及即時追蹤客戶尚未付款原因，並依信用管理作業按授信額度控管後續交易情形，業已依政策提列適足備抵損失。此外，該公司之銷售客戶多數往來已久，根據產業特性、授信條件及以往收款經驗觀之，應收款項期後收款情形尚屬良好，經評估該公司應收款項之收回可能性尚無重大疑慮。

B. 個體

該公司 114 年 3 月底個體之應收款項總額共計 226,865 千元，截至 114 年 5 月 31 日止，應收票據已全數收回；應收關係人帳款已收回 420 千元，未收回 112 千元並未逾期；應收帳款已收回 81,657 千元，收回比例為 36.13%，未收回金額為 144,343 千元，未收回比率為 63.87%。該公司個體應收款項逾期未收回之原因與合併數相同，故不另行分析。

3.與同業比較

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度		113 年度		114 年第一季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
營業收入 淨額	暉盛	762,039	762,120	547,630	546,155	83,131	81,955
	志聖	3,625,801	1,892,397	4,818,209	2,785,622	1,309,089	註 1
	友威科	744,579	611,134	660,171	574,462	91,433	註 1
	鈦昇	1,549,374	1,154,330	1,644,908	1,329,088	314,912	註 1
應收款項 總額(B)	暉盛	274,613	274,880	237,137	236,782	227,548	226,865
	志聖	2,022,428	972,865	2,115,172	954,022	2,255,138	註 1
	友威科	270,942	157,806	209,702	165,710	173,995	註 1
	鈦昇	452,066	397,592	536,589	499,378	506,450	註 1
備抵損失 (A)	暉盛	6,289	6,281	4,123	4,117	6,186	6,177
	志聖	276,026	163,203	285,827	189,130	298,226	註 1
	友威科	22,792	20,826	50,090	49,929	38,466	註 1
	鈦昇	10,737	7,370	4,824	2,602	7,296	註 1
備抵損失 提列比率 %(A)/(B)	暉盛	2.29	2.28	1.74	1.74	2.72	2.72
	志聖	13.65	16.78	13.51	19.82	13.22	註 1
	友威科	8.41	13.20	23.89	30.13	22.11	註 1
	鈦昇	2.38	1.85	0.90	0.52	1.44	註 1
應收款項 週轉率 (次)	暉盛	2.73	2.74	2.14	2.13	1.43	1.41
	志聖	1.54	1.54	2.33	2.89	2.40	註 1
	友威科	2.88	4.01	2.75	3.55	1.91	註 1
	鈦昇	2.50	2.02	3.33	2.96	2.42	註 1
應收款項 收現天數 (天)	暉盛	134	134	171	172	256	259
	志聖	238	238	157	127	153	註 1
	友威科	127	92	133	103	192	註 1
	鈦昇	146	181	110	124	151	註 1

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告暨該公司提供之資料。

註 1：採樣同業並無出具經會計師核閱之個體財務報告。

(1)應收款項週轉率及週轉天數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之合併應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 1.43 次，合併應收款項平均收款天數則分別為 134 天、171 天及 256 天；個體應收款項週轉率分別為 2.74 次、2.13 次及 1.41 次，個體應收款項平均收款天數則分別為 134 天、172 天及 259 天。與採樣同業相較，該公司 112 年度合併及個體應收款項週轉率僅次於友威科，優於志聖及鈦昇；113 年度因營收下滑，故合併及個體應收款項週轉率皆略低於採樣同業；114 年第一季受客戶下單動能影響營業收入尚未有顯著回升，致合併週轉率低於採樣同業。然應收款項週轉率主係受各採樣公司之營業屬性及其授信政策之不同而有所差異，整體而言應無重大異常情事。

(2)備抵損失提列之適足性評估

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底合併提列之備抵損失金

額分別為 6,289 千元、4,123 千元及 6,186 千元，占合併應收款項總額之比率分別為 2.29%、1.74%及 2.27%；個體提列之備抵損失金額分別為 6,281 千元、4,117 千元及 6,177 千元，占個體應收款項總額之比率分別為 2.28%、1.74%及 2.72%。與採樣同業相比，112 年底合併備抵損失提列比率均低於採樣同業；112 年底個體、113 年底合併及個體、114 年第一季底合併之備抵損失提列比率均高於鈦昇，均低於志聖及友威科，經評估該公司備抵損失提列比率與同業相比尚屬允當，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司歷年來收款情形平穩，應收款項收現天數尚能符合其訂定之授信期間，顯見該公司對於應收款項之控管尚屬穩健，而其應收款項週轉率及備抵損失提列之適足性與採樣同業相較亦無重大異常之情事。

二、存貨概況

(一)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

1.財務報告存貨淨額變動之合理性

單位：新台幣千元

項目	期間	合併財務報告			個體財務報告		
		112 年度	113 年度	114 年 第一季	112 年度	113 年度	114 年 第一季
營業收入		762,039	547,630	83,131	762,120	546,155	81,955
營業成本		470,536	332,690	47,869	469,860	336,907	47,171
原物料		38,666	34,720	41,809	38,666	34,720	41,809
在製品		109,421	33,245	60,058	109,421	33,245	60,058
製成品		2,286	911	911	2,286	911	911
商品		4,230	6,831	5,621	—	—	—
期末存貨總額		154,603	75,707	108,399	150,373	68,876	102,778
備抵存貨跌價及呆滯損失		17,661	13,093	14,103	16,120	11,266	11,988
期末存貨淨額		136,942	62,614	94,296	134,253	57,610	90,790
存貨週轉率(次)(註)		2.21	3.33	2.44	2.23	3.51	2.54
存貨週轉天數(天)		166	110	150	164	104	144

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告暨該公司提供

註：存貨週轉率係採平均存貨淨額計算之

該公司及其子公司合併財務報告編製主體包括該公司本身暨其轉投資公司 Stable 公司及金暉盛公司，Stable 公司係以控股為主，無實質營運活動，暉盛公司從事各式電漿設備之研發、生產及銷售，子公司金暉盛公司則負責中國大陸市場銷售設備售服及維修業務，故該公司之合併存貨來自該公司及金暉盛公司，而該公司存貨即占九成以上。存貨之原物料為各式電漿設備機構件、真空幫浦及電源供應器等。依製令投入產生後至客戶對設備功能確認前之各式電漿設備機台及機構件帳列為在製品，機台完工並經客戶確認交機完成後，由在製品轉為製成品旋即出貨轉入銷貨成本，而帳列之製成品為客戶退回重新整備之電漿設備機台，商品則為大陸子公司進行設備售服、維修業務之料件。該公司採接單式生產，依客戶訂單需求進行備料及投產，業務具高度彈性客製化特性，故該公司之存貨變化與客戶訂單需求關係密切，茲就該公司存貨淨額及存貨週轉率變動之合理性說明如下：

(1)合併存貨淨額及存貨週轉率變動之合理性說明

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年 3 月底合併存貨淨額分別為 136,942 千元、62,614 千元及 94,296 千元。113 年底存貨淨額較 112 年底減少，主要係 113 年受美系電腦處理器(CPU)大廠業績不佳，進而影響 CPU 供應鏈之 IC 載板產業景氣下滑，來自主要客戶載板廠之設備訂單需求減少，導致該公司依訂單投入生產中的在製品存貨金額較 112 年底減少 69.62%，使存貨淨額較 112 年底減少 54.28%。114 年 3 月底合併存貨淨額較 113 年底增加，係因預計 114

年第二季起交貨之客戶訂單回溫，為因應客戶訂單需求而備料並陸續投入生產，使原物料及在製品分別較 113 年底增加 20.42%及 80.65%，並使存貨淨額較 113 年底增加 50.60%。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年第一季之合併存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 2.44 次，存貨週轉天數分別為 166 天、110 天及 150 天。受客戶訂單縮減影響 113 年營收規模減少，營業成本隨之下滑，113 年度營業成本減少 29.30%，而 113 年底因客戶資本支出計劃延宕，考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，存貨淨額減少 54.28%，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度，致存貨週轉率較 112 年度上升，存貨週轉天數減少。114 年第一季因主要 IC 載板廠資本支出計劃延宕，受交機時程影響，部分客戶交機檢驗時程延遲，故換算後營業成本較 113 年度減少，致存貨週轉率較 113 年度下降，平均存貨週轉天數上升。

(2)個體存貨淨額及週轉率變動之合理性說明

該公司 112~113 年底及 114 年 3 月底個體存貨淨額分別為 134,253 千元、57,610 千元及 90,790 千元。在個體存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年第一季之個體存貨週轉率分別為 2.23 次、3.51 次及 2.54 次，存貨週轉天數分別為 164 天、104 天及 144 天，由於個體各期存貨淨額及週轉率變動與合併報表變動原因相同，因此不另行分析。

綜上所述，該公司及其子公司採訂單性生產，112~113 年度及 114 年第一季之存貨淨額以及存貨週轉率變動情形主係隨客戶訂單及市場需求而有所變動，經評估尚無重大異常之情事。

2.備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

(1)備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策合理性

存貨跌價損失方面，該公司及其子公司存貨以取得成本為入帳基礎，成本之計算係採加權平均法，後續衡量係針對庫齡 180 天內之存貨係採成本與淨變現價值孰低法，比較成本與淨變現價值孰低時，係採逐項比較法為基礎。淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入估計之成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

存貨呆滯損失方面，原物料主要為設備料件，係為了配合電漿設備生產製造所需，及設備使用後維修或零件更換所使用，非屬快速汰換之產品，故除不良品提列 100%外，針對庫齡逾 181 天以上之存貨採個別認定，並依提列政策提列備抵存貨呆滯損失，其呆滯提列政策如下：

庫齡天數	1-180 天	181-360 天	361-720 天	721-1440 天	1441 天以上	不良品
提列比率	0%	10%	20%	50%	100%	100%

資料來源：該公司提供

該公司在製品與製成品存貨係屬客製化接單生產，原則上投產時係依客戶訂單需求，故無呆滯之情事，惟如遇客戶取消、變更訂單或銷貨退回等情事時，造成該在製品或製成品已無有效對應之訂單時，則採逐項檢視，經評估如有減損跡象，則依據提列政策提列備抵存貨呆滯損失。商品主要為子公司帳列供大陸客戶修繕料件之備品，係由母公司提供，子公司按庫齡依提列政策提列備抵存貨呆滯損失。

綜上所述，該公司及其子公司除對於存貨淨變現價值低於成本者提列存貨跌價損失外，並針對不同庫齡區間之存貨訂定呆滯提列比率，其比率之訂定係綜合考量所屬行業特性、原物料保存期限、存貨未來銷售可能性及相關營運風險等因素訂定評價政策。整體而言，其存貨跌價與呆滯提列政策應尚屬合理。

(2)備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列適足性之評估

單位：新台幣千元

項目	年度	合併財務報告			個體財務報告		
		112 年底	113 年底	114 年 3 月底	112 年底	113 年底	114 年 3 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失		17,661	13,093	14,103	16,120	11,266	11,988
期末存貨總額		154,603	75,707	108,399	150,373	68,876	102,778
備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率(%)		11.42	17.29	13.01	10.72	16.36	11.66

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

A.合併備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

該公司及其子公司112~113年底及114年3月底之合併備抵存貨跌價及呆滯損失分別為17,661千元、13,093千元及14,103千元，占期末存貨總額之比率分別為11.42%、17.29%及13.01%。113年因應客戶資本支出計畫延宕，訂單需求減少降低存貨備料，使113年12月底期末存貨餘額減少，雖部分原物料因辦理存貨報廢及因陸續去化而認列存貨回升利益，使得備抵存貨跌價損失金額下降，然期末存貨餘額減少幅度大於備抵存貨跌價損失減少幅度，以致備抵存貨跌價及呆滯損失占期末存貨總額之比率較112年底上升；114年第一季因應客戶訂單需求增加而備料投入生產，致114年3月底存貨餘額增加，備抵存貨跌價及呆滯損失則未明顯變化，以致114年3月底之合併備抵存貨跌價及呆滯損失占合併期末存貨總額之比率較113年底下降。

B.個體備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

該公司112~113年底及114年3月底之個體備抵存貨跌價及呆滯損失分別為16,120千元、11,266千元及11,988千元，占個體期末存貨總額之比率分別為10.72%、16.36%及11.66%，由於個體備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列與合併報表原因相同，因此不另行分析。

整體而言，該公司及其子公司最近二個會計年度及申請年度最近期之合併

及個體存貨跌價損失與呆滯損失依該公司提列政策予以執行，並經簽證會計師查核簽證或核閱完竣，經評估尚無提列不足之情事，存貨備抵提列應尚屬適足。

3.最近期存貨去化情形

(1)合併存貨去化情形

單位：新台幣千元

項 目	114 年 3 月 底 存 貨 金 額	114 年 截 至 5 月 底 存 貨 去 化 情 形		114 年 截 至 5 月 底 未 去 化 情 形	
		金 額	比 率 (%)	金 額	比 率 (%)
原 料	41,809	26,211	62.69	15,598	37.31
在 製 品	60,058	35,383	58.91	24,675	41.09
製 成 品	911	911	100.00	—	—
商 品	5,621	187	3.33	5,434	96.67
合 計	108,399	62,692	57.83	45,707	42.17

資料來源：該公司提供。

該公司及其子公司 114 年截至 3 月底之合併存貨總額為 108,399 千元，截至 114 年 5 月 31 日止之存貨去化金額為 62,692 千元，去化比率為 57.83%，未去化金額為 45,707 千元，未去化比率為 42.17%，茲就各項存貨之去化情形分別說明如下：

A.原物料

114年3月底之原料總額為41,809千元，截至114年5月31日止之未去化金額為15,598千元，未去化比率為37.31%。由於該公司為確保製程順暢並備供替換所需，會根據客戶訂單及備貨需求、考量原物料批次訂購量及採購前置時間等而進行備貨，原物料隨著生產耗用逐漸消化，部份因原物料因訂單調整或生產設計變更等導致其去化較慢，未去化原物料已依存貨政策提列呆滯損失，整體而言，原物料去化情形尚無重大異常之情事。

B.在製品

該公司在製品主係依製令投入產生後至客戶功能確認前之各式電漿設備機台及機構件。114年3月底之在製品總額為60,058千元，截至114年5月31日止之未去化金額為24,675千元，未去化比率為41.09%。未去化存貨多為尚在組裝或待客戶交機確認之產品，待完工或客戶確認後即可去化，尚無重大異常之情事。

C.製成品

該公司114年3月底之製成品為911千元，主係為客戶退回重新整備之電漿設備機台，截至114年5月31日止已因應其他客戶訂單需求進行拆解整備後投入生產使用而去化，部分無法使用之機構件則進行報廢處理，其去化情形尚無重大異常。

D.商品

商品主係子公司提供中國大陸電漿設備客戶之售後維修之零配件。114年3月底之商品總額為5,621千元，截至114年5月31日止之未去化金額為5,434千元，未去化比率為96.67%，尚未去化之商品，主係維修料件之備品，係隨當地客戶維修需求而耗用，使用之時機及數量較難以預估，該公司已依存貨備抵提列政策提列呆滯，未來將依客戶維修需求投入使用，商品去化情形尚無重大異常。

(2)個體存貨去化情形

單位：新台幣千元

項目	114年3月底 存貨金額	114年截至5月底 存貨去化情形		114年截至5月底 未去化情形	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
原 料	41,809	26,211	62.69	15,598	37.31
在 製 品	60,058	35,383	58.91	24,675	41.09
製 成 品	911	911	100.00	—	—
合 計	102,778	62,505	60.82	40,273	39.18

資料來源：該公司提供。

該公司個體存貨去化情形及原因與合併存貨去化情形相同，請詳前段之說明。

4.與同業比較評估

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112年度		113年度		114年第一季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
營業 成本	暉盛	470,536	469,860	332,690	336,907	47,869	47,171
	志聖	2,119,643	1,115,421	2,835,109	1,657,644	745,882	註1
	友威科	433,846	299,780	374,054	296,475	57,552	註1
	鈦昇	935,093	568,874	1,047,264	757,151	215,751	註1
期末存貨 總額(B)	暉盛	154,603	150,373	75,707	68,876	108,399	102,778
	志聖	1,007,521	653,629	1,347,403	754,616	1,679,955	註1
	友威科	註2	317,484	註2	207,800	註2	註1
	鈦昇	註2	註2	註2	註2	註2	註1
備抵存貨 跌價 及呆滯損 失(A)	暉盛	17,661	16,120	13,093	11,266	14,103	11,988
	志聖	289,071	203,498	276,846	185,888	285,833	註1
	友威科	註2	96,807	註2	88,112	註2	註1
	鈦昇	註2	註2	註2	註2	註2	註1
期末存貨 淨額	暉盛	136,942	134,253	62,614	57,610	94,296	90,790
	志聖	718,450	450,131	1,070,557	568,728	1,394,122	註1
	友威科	226,887	220,677	124,956	119,688	120,968	註1
	鈦昇	1,038,844	928,279	897,451	781,627	868,582	註1

項目	年度	112 年度		113 年度		114 年第一季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率(%)(A)/(B)	暉盛	11.42	10.72	17.29	16.36	13.01	11.66
	志聖	28.69	31.13	20.55	24.63	17.01	註 1
	友威科	註 2	30.49	註 2	42.40	註 2	註 1
	鈦昇	註 2	註 2	註 2	註 2	註 2	註 1
存貨週轉率(次)	暉盛	2.21	2.23	3.33	3.51	2.44	2.54
	志聖	2.54	2.38	3.17	3.25	2.42	註 1
	友威科	1.67	1.19	2.13	1.74	1.87	註 1
	鈦昇	0.84	0.58	1.08	0.89	0.98	註 1
存貨週轉天數(天)	暉盛	166	164	110	104	150	144
	志聖	144	154	116	113	151	註 1
	友威科	219	307	172	210	196	註 1
	鈦昇	435	630	338	411	373	註 1

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 1：採樣同業並無出具經會計師查核簽證之個體財務報告。

註 2：採樣同業經會計師查核簽證或核閱之合併或個體財務報告未揭露期末存貨總額與備抵存貨跌價及呆滯損失，故無法計算提列比率。

(1)合併

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之合併存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 2.44 次，合併存貨週轉天數分別 166 天、110 天及 150 天；與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 年度合併存貨週轉率低於志聖且優於友威科及及鈦昇，113 年度及 114 年第一季則優於同業，顯示該公司庫存控管情況良好，經評估尚無重大異常之情事。

合併備抵存貨跌價及呆滯損失占合併存貨總額比率方面，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底分別為 11.42%、17.29%及 13.01%。惟因除志聖公司外之採樣同業，其各年度財務報告存貨金額係以淨額表達，並未揭露有關備抵存貨跌價及呆滯損失之金額，故僅與志聖公司比較，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底提列比率皆低於志聖公司。該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失之提列係以國際會計準則為依據，依成本與淨變現價值孰低逐項比較衡量，提列備抵存貨跌價損失，並參酌過去經營經驗，以擬定存貨呆滯提列政策，且亦已針對庫齡較久之呆滯存貨定期進行檢討，並加強存貨管理，經評估尚無重大異常之情事。

(2)個體

個體存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年第一季分別為 2.23 次、3.51 次及 2.54 次，存貨週轉天數分別為 164 天、104 天及 144 天。與採樣同業相較，112 年度個體存貨週轉率低於志聖且優於友威科及及鈦昇，113 年度則優於同業，114 年第一季採樣同業因無出具個體財務報告，故無

法比較。經參閱該公司合併存貨週轉率及存貨週轉天數與其他同業相較之說明，尚無重大異常之情事。

個體備抵存貨跌價及呆滯損失占個體存貨總額比率方面，該公司 112~113 年底及 114 年第一季底分別為 10.72%、16.36%及 11.66%。與採樣同業相較，除鈦昇公司各年度未揭露相關資訊及各採樣同業 114 年第一季財務報告未揭露相關資訊故無法比較外，112~113 年底提列比率均低於採樣同業，該公司已針對庫齡較久之呆滯存貨定期進行檢討，加強存貨管理，控管存貨庫齡管理尚無發現重大異常之情事，且依相關政策進行提列，故 112~113 年底及 114 年第一季底之個體備抵存貨跌價及呆滯損失提列尚無重大異常。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之合併及個體存貨金額變動、存貨週轉率之變化、備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策之提列情形以及與同業相較，尚屬合理允當，尚未發現重大異常之情事。

三、最近期及最近二個會計年度之業績概況

(一)列表並說明發行公司最近期及最近二個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣千元

年度		112年度	113年度		113年 第一季	114年第一季	
項目	公司名稱	金額	金額	成長率(%)	金額	金額	成長率(%)
營業 收入	暉盛	762,039	547,630	(28.14)	157,673	83,131	(47.28)
	志聖	3,625,801	4,818,209	32.89	1,080,021	1,309,089	21.21
	友威科	744,579	660,171	(11.34)	102,548	91,433	(10.84)
	鈦昇	1,549,374	1,644,908	6.17	287,847	314,912	9.40
營業 毛利	暉盛	291,503	214,940	(26.26)	59,793	35,262	(41.03)
	志聖	1,506,158	1,983,100	31.67	466,606	563,207	20.70
	友威科	310,733	286,117	(7.92)	27,459	33,881	23.39
	鈦昇	614,281	597,644	(2.71)	92,914	99,161	6.72
營業 利益 (損失)	暉盛	166,599	87,039	(47.76)	12,824	(1,339)	(110.44)
	志聖	402,656	635,996	57.95	154,944	180,329	16.38
	友威科	123,054	98,462	(19.98)	(19,969)	12,155	160.87
	鈦昇	16,828	(118,939)	(806.79)	(72,299)	(75,536)	(4.48)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司專注開發與製造電漿乾式表面處理設備，可進行蝕刻、去膠、活化、極化、清洗與高溫裂解等各式製程應用，提供半導體晶圓製造、先進封裝、IC 載板、PCB、再生晶圓及新能源生產等電漿設備，並提供符合 ESG 低碳製程要求的解決方案。綜觀目前國內已上市、上櫃公司中，並無完全與該公司市場業務及定位內容相同之公司，故經綜合考量業務內容、市場定位、產品應用、營運規模及資本額條件等要素，選擇目前上市櫃公司中志聖工業(股)公司(股票代號：2467，以下簡稱：志聖)、友威科技(股)公司(股票代號：3580，以下簡稱：友威科)及鈦昇科技(股)公司(股票代號：8027，以下簡稱：鈦昇)等三家做為採樣同業。志聖主要從事研發及生產紫

外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程設備，應用於 PCB 電路板、IC 載板、FPD 面板及半導體高階封裝生產製程；友威科主要從事真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，應用於 IC 載板封裝電漿濺鍍、電漿蝕刻處理及光學 5G 蓋板、載板、汽車、各類銅製程鍍膜；鈦昇主要從事半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與 SMD 包裝材料設計與製造，應用於 IC 製造及封測、LED 封測之雷射加工及電漿清洗、蝕刻處理。茲就該公司及其子公司與採樣同業之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

1.營業收入

電漿製程相較傳統濕製程具備多項關鍵優勢，特別是在製程微縮、環保要求與材料多樣性日益提升的趨勢下，成為產業升級的重要技術選項。傳統濕製程雖因設備成本較低與工藝成熟，長期為主流，但其對微細結構控制不易，且需大量化學藥液，衍生高廢水處理成本與環保負擔。電漿製程則為乾式處理，可精準應對 3D 結構、高深寬比特徵與奈米級元件加工需求，過往不採用電漿的製程，亦因製程良率與品質需求提升而逐漸導入電漿設備，隨設備穩定性與成本效益改善，電漿技術已逐漸取代部分濕製程，成為先進半導體、封裝與光電產業不可或缺的核心製程工具。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業收入分別為 762,039 千元、547,630 千元及 83,131 千元，113 年度營業收入較 112 年度減少 214,409 千元，114 年第一季較 113 年同期減少 74,542 千元。111 及 112 年度因 ABF 載板需求大增，帶動封裝基板市場快速成長，產業鏈紛紛擴大產能以因應高階晶片封裝需求。由於 ABF 載板製程對表面處理與微細線路加工要求提升，需導入高精度電漿設備以確保良率與品質，因此各大廠對電漿設備投入成本顯著提高。112 年度受消費性電子市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板及印刷電路板業績下滑，先前因大多集中於 111 及 112 年度擴產，以致供過於求使得 IC 載板及印刷電路板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自 112 年度起出現訂單推遲現象，113 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，且 114 年第一季因部分客戶交機檢驗時程延遲，致該公司 113 年度及 114 年第一季營業收入皆較前年同期減少，經評估該公司之營收變化情形，主係受產業景氣影響客戶下單動能資本支出規劃及交機遞延所致，若以 113 年度相較 110 年度營業收入 450,936 千元仍成長 21.44%，尚無重大異常之情事。

與採樣同業相較，各家同業營運模式、產品性質及應用領域與該公司各有相近之處亦有各自特殊性，故各公司營收結構亦有差異。就營收成長率分析，該公司 113 年度及 114 年第一季營收成長率皆低於採樣同業。友威科因延續企業轉型成果，積極深耕半導體設備領域，CoWoS 先進封裝產能持續擴增，且 FOPLP 客戶維持穩定訂單，113 年度來自半導體業務營收占比已較 112 年度進一步提升，惟因仍須等待終端客戶擴產開出新需求，113 年度整體營收仍受機台出貨趨緩影響較 112 年度下降，其市場屬性與該公司較為相近，故各期營收成長率變動方向與該公司大致相當。志聖部分，受益於 AI、大數據、高性能計算等市場需求之提高，其在半導體製程設備業績增加，故 113 年度及 114 年第一季營收成長率較比較同期有所增加；鈦昇

部分，受益於電子產業因 AI 浪潮，高階半導體等相關設備投資續增加，先進製程市場規模持續擴大，對其雷射打印、雷射微加工及電漿微加工等設備需求增加，故 113 年度及 114 年第一季營收成長率較比較同期維持小幅成長。

整體而言，該公司及其子公司整體而言，該公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業收入變化情形尚屬合理，且與同業相較，尚無發現有重大異常之情事。

2.營業毛利

單位：%

公司名稱		年度			
		112 年度	113 年度	113 年第一季	114 年第一季
營業 毛利率	暉盛	38.25	39.25	37.92	42.42
	志聖	41.54	41.16	43.20	43.02
	友威科	41.73	43.34	26.78	37.06
	鈦昇	39.65	36.33	32.28	31.49

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業毛利分別為 291,503 千元、214,940 千元及 35,262 千元，營業毛利率分別為 38.25%、39.25%及 42.42%。整體而言，該公司營業毛利主要隨營業收入變動而有所起伏，而毛利率則主要受到產品組合變化所影響。相較 112 年度，113 年度之營業毛利率變動幅度不大，並無重大異動；114 年第一季毛利率較 113 年同期提升，主要係因高毛利產品銷售占比上升所致。綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業毛利率均穩定維持在 38%至 42%區間，整體變動幅度有限，顯示毛利結構具一定穩定性。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 年度之營業毛利率略低於採樣同業，113 年度優於鈦昇，114 年第一季則優於友威科及鈦昇，由於各公司之核心技術、產品組合、市場競爭及業務銷售模式均不盡相同，故毛利率存有差異。

整體而言，該公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業毛利變動情形與採樣同業相較，尚無發現重大異常之情事。

3.營業利益

單位：%

公司名稱		年度			
		112 年度	113 年度	113 年第一季	114 年第一季
營業 利益(損 失)率	暉盛	21.86	15.89	8.13	(1.61)
	志聖	11.11	13.20	14.35	13.78
	友威科	16.53	14.91	(19.47)	13.29
	鈦昇	1.09	(7.23)	(25.12)	(23.99)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業利益(損失)分別為 166,599 千元、87,039 千元及(1,339)千元，營業利益(損失)率分別為 21.86%、15.89%及(1.61)%。113 年度營業利益較 112 年度大幅減少，主要係受到產業景氣低迷影

響，導致全年設備銷售數量較 112 年度下滑，進而使營業毛利金額減少。此外，該公司營業費用中因積極參展、拍攝形象影片之廣告費及拓展業務支付之佣金費用及勞務費增加，致使營業費用較 112 年度略增，但因營業收入下降使得營業利益率降至 15.89%；114 年第一季，相較 113 年同期營業利益減少 14,163 千元，主係受客戶資本支出仍保守且交機檢驗時程延遲，營業毛利隨營業收入減少，導致營業毛利較上年同期減少 24,531 千元，雖樽節支出，營業費用較去年同期減少 10,368 千元，但在營業收入下降幅度較大的情況下，使得營業費用占營收比重反而成長達 44.03%，並產生 1,339 千元之營業損失，營業利益率降為(1.61)%。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 及 113 年度營業利益率皆優於採樣同業，顯示該公司樽節支出，營業費用率 112 及 113 年度皆低於同業；114 年第一季雖受營業收入下滑幅度較大影響，仍優於鈦昇，低於志聖及友威科。因各公司之核心技術、產品組合、市場競爭及業務銷售模式不盡相同，使整體毛利率有所差異，且該公司營業利益受業績變化影響而有所減少，經評估，與採樣同業相較，尚無發現重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業收入、營業毛利及營業利益之變化情形應尚屬合理。

(二)列表並說明最近期及最近二個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

1.主要產品別營業收入變動表

單位：新台幣千元；%

年度 產品別	112 年度		113 年度		114 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
電漿去膠渣及蝕刻機	596,295	78.25	400,570	73.15	50,473	60.72
其他電漿設備	103,871	13.63	83,499	15.25	14,822	17.83
其他	61,873	8.12	63,561	11.60	17,836	21.45
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	83,131	100.00

資料來源：該公司提供。

2.主要產品別營業成本變動表

單位：新台幣千元；%

年度 產品別	112 年度		113 年度		114 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
電漿去膠渣及蝕刻機	381,070	80.99	255,308	76.74	30,908	64.57
其他電漿設備	54,412	11.57	47,131	14.17	7,197	15.03
其他	35,054	7.44	30,251	9.09	9,764	20.40
合計	470,536	100.00	332,690	100.00	47,869	100.00

資料來源：該公司提供。

3.主要產品別營業毛利變動表

單位：新台幣千元；%

產品別	年度	112 年度		113 年度		114 年第一季	
		金額	%	金額	%	金額	%
電漿去膠渣及蝕刻機		215,225	73.83	145,262	67.58	19,565	55.48
其他電漿設備		49,459	16.97	36,368	16.92	7,625	21.63
其他		26,819	9.20	33,310	15.50	8,072	22.89
合計		291,503	100.00	214,940	100.00	35,262	100.00

資料來源：該公司提供。

4.主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明

該公司及其子公司主要係從事各式高彈性客製化電漿設備之設計及製造，茲就各主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形分析說明如下：

(1)電漿去膠渣及蝕刻機

該公司及其子公司之電漿去膠渣及蝕刻機產品，主要包含各式電漿去膠渣機與電漿蝕刻機。該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季電漿去膠渣及蝕刻機產品之營業收入金額分別為 596,295 千元、400,570 千元及 50,473 千元，占整體營收比重分別為 78.25%、73.15%及 60.72%。113 年度營業收入較 112 年度減少 32.82%，主係受整體產業景氣趨緩、市場需求放緩以及客戶資本支出計畫延後等因素影響，導致機台銷售數量下滑；114 年第一季營業收入較 113 年同期減少 61.67%，主要原因為 114 年第一季銷售以單價較低之手動式電漿設備為主，對營收貢獻相對有限所致。

在營業成本與營業毛利部分，該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年第一季之電漿去膠渣及蝕刻機產品之營業成本分別為 381,070 千元、255,308 千元及 30,908 千元，營業毛利金額分別為 215,225 千元、145,262 千元及 19,565 千元，毛利率則分別為 36.09%、36.26%及 38.76%。113 年度營業毛利較 112 年度減少 69,963 千元，主要係因 IC 載板客戶大多集中 111 及 112 年度擴產，以致供過於求，113 年度客戶資本支出下修並趨保守，機台銷售數量減少所致，惟毛利率變動幅度不大；114 年第一季營業毛利較 113 年同期減少 24,943 千元，主因本期銷售以單價相對較低之手動式電漿設備為主，導致營業收入下滑，然而由於該類機台毛利相對較高，故毛利率較 113 年增加。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之電漿去膠渣及蝕刻機類產品之營業收入、營業成本及毛利變化情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

(2)其他電漿設備

其他電漿設備產品主要包括常壓/真空電漿清洗機、電漿極化機及其他各式電漿相關設備。該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年第一季之其他電漿設備營業收入分別為 103,871 千元、83,499 千元及 14,822 千元，占整體營業收入比重分別為 13.63%、15.25%及 17.83%。113 年度營業收入較 112 年度減少

19.61%，主要係受產業景氣轉弱、市場需求趨緩及客戶資本支出計畫延後影響，導致機台銷售數量減少；而在 114 年第一季，其他電漿設備之營業收入較 113 年同期大幅成長 98.61%，主係當期銷售品項以單價較高之真空電漿清洗機為主，較 113 年同期以常壓電漿清洗機為主之銷售組合具有更高營收貢獻，故該類別營業收入增加。

在營業成本與營業毛利變化方面，該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年第一季之其他電漿設備產品營業成本分別為 54,412 千元、47,131 千元及 7,197 千元，對應之營業毛利分別為 49,459 千元、36,368 千元及 7,625 千元，毛利率則分別為 47.62%、43.56%及 51.44%。113 年度毛利率較 112 年度下滑，由 47.62% 降至 43.56%，主要係 112 年度之銷售組合中包含高單價、高毛利的電漿極化機，拉升整體平均毛利率，而 113 年度主要銷售項目為毛利相對較低的常壓電漿清洗機，導致整體毛利率下降。114 年第一季部分，營業毛利率為 51.44%，較 113 年度上升，主因當期銷售以真空電漿清洗機為主，其毛利率優於 113 年同期所銷售之常壓機型，使整體毛利率上升。

整體而言，該公司及其子公司最近期及最近二年度之其他電漿設備產品之營業收入、營業成本及毛利變化情形尚屬合理。

(3)其他

其他產品項目主要包含維修、售後服務及相關零配件等營業收入。該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年第一季來自該項目的營業收入分別為 61,873 千元、63,561 千元及 17,836 千元，占整體營業收入比重分別為 8.12%、11.60%及 21.45%；對應之營業成本分別為 35,054 千元、30,251 千元及 9,764 千元，營業毛利為 26,819 千元、33,310 千元及 8,072 千元，毛利率則分別為 43.35%、52.41%及 45.26%。

各期營業收入、營業成本及營業毛利之變動，主要係依客戶機台維護與服務需求波動而有所增減。由於該類產品涵蓋零件品項繁多、單價差異大，且維修服務難易度不同，報價亦有所差異，故各期間之毛利率亦有所變化，經評估尚無重大異常情事。

(三)最近期及最近二個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

單位：新台幣千元；%

項目	年度	113 年度		113 年第一季	114 年第一季	
	金額	金額	變動率(%)	金額	金額	變動率(%)
營業收入	762,039	547,630	(28.14)	157,673	83,131	(47.28)
營業毛利率(%)	38.25	39.25	2.61	37.92	42.42	11.87

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

由上表得知，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季與 113 年同期之營業收入變動率分別為(28.14)%及(47.28)%，而毛利率變動率分別為 2.61%及 11.87%，上述區間之營業收入變動率均有達 20%以上之情形，故就主要產品進行價量分析。惟因其他類別主係為維修、售後服務及相關零配件等，因規格種類繁多、屬性不同、

無一致之數量統計單位，分析不具意義，故不擬分析產品價量變動。茲針對該公司之電漿去膠渣及蝕刻機及其他電漿設備之價量變動情形及合理性分析說明如下：

1. 主要產品別之價量分析

單位：新台幣千元

分析項目		112 年度及 113 年度	113 第一季及 114 年第一季
電漿去膠渣及 蝕刻機	營業收入差異分析：		
	P(Q'-Q)	(236,034)	(14,630)
	Q(P'-P)	66,718	(74,890)
	(P'-P)(Q'-Q)	(26,409)	8,321
	P'Q'-PQ	(195,725)	(81,199)
	營業成本差異分析：		
	P(Q'-Q)	(150,840)	(9,685)
	Q(P'-P)	41,508	(52,393)
	(P'-P)(Q'-Q)	(16,430)	5,822
	P'Q'-PQ	(125,762)	(56,256)
毛利變動金額：	(69,963)	(24,943)	
其他電漿設備	營業收入差異分析：		
	P(Q'-Q)	(38,952)	(1,866)
	Q(P'-P)	29,727	12,302
	(P'-P)(Q'-Q)	(11,147)	(3,076)
	P'Q'-PQ	(20,372)	7,360
	營業成本差異分析：		
	P(Q'-Q)	(20,405)	(665)
	Q(P'-P)	20,998	6,936
	(P'-P)(Q'-Q)	(7,874)	(1,734)
	P'Q'-PQ	(7,281)	4,537
毛利變動金額：	(13,091)	2,823	

資料來源：該公司提供。

註：P'Q'：最近年度單價、數量；PQ：上一年度單價、數量。

2. 主要產品價量差分析說明

(1) 電漿去膠渣及蝕刻機

A. 112年度及113年度

(A) 營業收入減少195,725千元

- a. 不利數量差異 236,034 千元，主係受景氣波動及客戶資本支出計畫延宕影響下單動能，機台銷售數量減少所致。
- b. 有利價格差異 66,718 千元，主係因 112 年度該類產品組合中包含單價較低之手動解框機，拉低整體平均銷售單價，致使 113 年度平均銷售單價相較 112 年度提高，產生有利之價格差異。
- c. 不利組合差異 26,409 千元，綜上所述，雖平均銷售單價有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生不利組合差異。

(B)營業成本減少125,762千元

- a.有利數量差異 150,840 千元，因前述機台銷售數量減少，故造成數量有利差異。
- b.不利價格差異 41,508 千元，主係因 112 年度該類產品組合中包含成本較低之搭載設備手動解框機，致使當年度整體平均單位成本偏低，進而使 113 年度平均單位成本相較 112 年度上升，產生不利之成本差異。
- c.有利組合差異 16,430 千元，綜上所述，雖平均單位成本有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生有利組合差異。

綜上所述，該公司113年度電漿去膠渣及蝕刻機設備產品因營業收入及營業成本減少，致營業毛利較112年度減少69,963千元。

B.113年第一季及114年第一季

(A)營業收入減少81,199千元

- a.不利數量差異 14,630 千元，主係受景氣波動及客戶資本支出計畫延宕影響下單動能，機台銷售數量減少所致。
- b.不利價格差異 74,890 千元，主係 113 年第一季產品組合以單價較高的連續式自動化電漿設備為主，整體平均銷售單價相對較高；而 114 年第一季則以單價相對較低之手動型電漿設備為主力產品，致使平均售價下降，產生不利之價格差異。
- c.有利組合差異 8,321 千元，綜上所述，因銷售數量減少，且平均銷售單價降低下，致產生有利組合差異。

(B)營業成本減少56,256千元

- a.有利數量差異 9,685 千元，因前述機台銷售數量減少，故造成數量有利差異。
- b.有利價格差異 52,393 千元，主係 113 年第一季產品組合以成本較高的連續式自動化電漿設備為主，整體平均單位成本相對較高；而 114 年第一季則以成本相對較低之手動型電漿設備為主力產品，致使平均單位成本下降，產生有利之成本差異。
- c.不利組合差異 5,822 千元，綜上所述，因銷售數量減少且平均單位成本降低，致產生不利組合差異。

綜上所述，該公司114年第一季電漿去膠渣及蝕刻機設備產品因營業收入及營業成本減少，致營業毛利較113年第一季下滑24,943千元。

(2)其他電漿設備

A.112年度及113年度

(A)營業收入減少20,372千元

- a.不利數量差異 38,952 千元，主係受景氣波動及客戶資本支出計畫延宕影響下單動能，機台銷售數量減少所致。
- b.有利價格差異 29,727 千元，主係因 112 年度該類產品組合中單價較低之常壓電漿清洗機品項銷售數量較多，拉低整體平均銷售單價，致使 113 年度平均銷售單價相較 112 年度提高，產生有利之價格差異。
- c.不利組合差異 11,147 千元，綜上所述，雖平均銷售單價有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生不利組合差異。

(B)營業成本減少7,281千元

- a.有利數量差異 20,405 千元，因前述機台銷售數量減少，故造成數量有利差異。
- b.不利價格差異 20,998 千元，主係因 112 年度該類產品組合中成本較低之常壓電漿設備品項銷售數量較多，致使當年度整體平均單位成本偏低，進而使 113 年度平均單位成本相較 112 年度上升，產生不利之成本差異。
- c.有利組合差異 7,874 千元，綜上所述，雖平均單位成本有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生有利組合差異。

綜上所述，該公司113年度其他電漿設備產品因營業收入及營業成本減少，致營業毛利較112年度下滑13,091千元。

B.113年第一季及114年第一季

(A)營業收入增加7,360千元

- a.不利數量差異 1,866 千元，主係受景氣波動及客戶資本支出計畫延宕影響下單動能，機台銷售數量減少所致。
- b.有利價格差異 12,302 千元，主係 114 年第一季銷售品項以單價較高之真空電漿清洗機為主，較 113 年第一季主要銷售之常壓電漿清洗機單價相對提高，挹注較多營業收入，產生有利之價格差異。
- c.不利組合差異 3,076 千元，綜上所述，雖平均銷售單價有所提升，然因銷售數量減少，致產生不利組合差異。

(B)營業成本增加4,537千元

- a.有利數量差異 665 千元，因前述機台銷售數量減少，故造成數量有利差異。
- b.不利價格差異 6,936 千元，主係 114 年第一季銷售品項以平均單位成本較高之真空電漿清洗機為主，較 113 年第一季主要銷售之常壓電漿清洗機而言，平均單位成本相對提高，產生不利之價格差異。
- c.有利組合差異 1,734 千元，綜上所述，雖平均單位成本有所提升，然因銷售數量減少，致產生有利組合差異。

綜上所述，該公司 114 年第一季其他電漿設備產品之營業毛利較 113 年第一季增加 2,823 千元。

四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素

經核閱該公司最近一年度董事會及股東會會議紀錄、主管機關核准變更登記函及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，截至評估報告出具日止，該公司最近一會計年度內並無購併他公司之情事，故不適用本項評估。

肆、財務狀況

一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力

(一)選擇採樣公司之理由

該公司主要從事開發先進電漿技術及研發、生產及銷售各式電漿設備，提供半導體產業、IC 載板與印刷電路板產業、平面顯示器與 LED 等光電產業、非電子業、民生工業及綠能產業等各式製程所需的電漿清潔、蝕刻以及表面改質之解決方案。綜觀目前國內已上市、上櫃公司中，並無完全與該公司所營事業及產品比重相似之公司，經綜合考量產品類型、應用領域、營運規模及資本額後，選取較為相似之志聖、友威科及鈦昇為其採樣同業。

志聖主要從事研發及生產紫外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程設備，應用於 PCB 電路板、IC 載板、FPD 面板及半導體高階封裝生產製程；友威科主要從事真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，應用於 IC 載板封裝電漿濺鍍、電漿蝕刻處理及光學 5G 蓋板、載板、汽車、各類銅製程鍍膜；鈦昇主要從事半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與 SMD 包裝材料設計與製造，應用於 IC 製造及封測、LED 封測之雷射加工及電漿清洗、蝕刻處理。此外，同業平均之財務比率則參考財團法人金融聯合徵信中心出版「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中之「C29 機械設備製造業」，統計數採綜合平均數，作為分析所引用之比較依據。

(二)最近期及最近二個會計年度之財務比率分析及與同業之比較

分析項目		年度	112 年度	113 年度	114 年第一季
		公司別			
財務結構	負債占資產比率(%)	暉盛	34.85	31.37	35.17
		志聖	57.34	51.26	61.44
		友威科	50.58	35.49	35.20
		鈦昇	43.51	32.65	33.50
		同業平均	43.50	註 1	註 1
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	暉盛	335.93	338.37	329.88
		志聖	650.72	719.74	467.12
		友威科	300.66	292.90	293.19
		鈦昇	481.08	294.26	275.20
		同業平均	193.05	註 1	註 1
償債能力	流動比率(%)	暉盛	384.85	430.15	346.08
		志聖	160.89	198.76	165.03
		友威科	210.87	391.51	423.24
		鈦昇	564.41	527.83	476.10
		同業平均	190.90	註 1	註 1
	速動比率(%)	暉盛	314.60	390.46	299.70
		志聖	134.36	162.68	127.31
		友威科	175.65	341.14	370.41

分析項目	年度		112 年度	113 年度	114 年第一季	
	公司別					
利息保障倍數(倍)	鈦昇		362.92	326.85	289.60	
	同業平均		131.40	註 1	註 1	
	暉盛		54.80	35.24	5.45	
	志聖		18.32	19.76	18.03	
	友威科		19.28	38.28	12.58	
	鈦昇		2.78	(1.62)	(12.18)	
	同業平均		1,569.00	註 1	註 1	
應收款項週轉率(次) (註 6)	暉盛		2.73	2.14	1.43	
	志聖		1.54	2.33	2.40	
	友威科		2.88	2.75	1.91	
	鈦昇		2.50	3.33	2.42	
	同業平均		3.30	註 1	註 1	
應收款項收款天數 (天)	暉盛		134	171	256	
	志聖		238	157	153	
	友威科		127	133	192	
	鈦昇		146	110	151	
	同業平均		111	註 1	註 1	
存貨週轉率 (次)(註 7)	暉盛		2.21	3.33	2.44	
	志聖		2.54	3.17	2.42	
	友威科		1.67	2.13	1.87	
	鈦昇		0.84	1.08	0.98	
	同業平均		2.00	註 1	註 1	
平均售貨天數(天)	暉盛		166	110	150	
	志聖		144	116	151	
	友威科		219	172	196	
	鈦昇		435	338	373	
	同業平均		183	註 1	註 1	
不動產、廠房及設備 週轉率(次)	暉盛		2.83	2.06	1.25	
	志聖		4.58	5.25	4.04	
	友威科		3.30	1.53	0.75	
	鈦昇		2.33	1.64	0.98	
	同業平均		1.50	註 1	註 1	
總資產週轉率(次)	暉盛		0.68	0.50	0.30	
	志聖		0.45	0.51	0.48	
	友威科		0.37	0.38	0.22	
	鈦昇		0.35	0.39	0.30	
	同業平均		0.50	註 1	註 1	
獲利能力	資產報酬率(%)	暉盛		12.09	8.19	1.29
		志聖		6.88	8.50	6.33
		友威科		5.30	11.66	3.67
		鈦昇		0.92	(1.02)	(5.59)
		同業平均		5.30	註 1	註 1
	權益報酬率(%)	暉盛		21.03	11.89	1.57

分析項目		年度		112 年度	113 年度	114 年第一季
		公司別				
占實收資本比率(%)		志聖		15.38	17.46	13.58
		友威科		11.05	20.29	5.20
		鈦昇		0.95	(2.27)	(8.90)
		同業平均		8.80	註 1	註 1
		暉盛		57.73	30.16	(1.86)
	營業利益	志聖		25.69	40.57	46.02
		友威科		31.18	24.95	12.32
		鈦昇		1.71	(10.97)	(27.85)
		同業平均		註 2	註 2	註 2
	稅前純益	暉盛		59.58	39.15	5.05
		志聖		37.26	62.49	61.17
		友威科		33.78	33.60	18.65
		鈦昇		3.89	(4.92)	(23.18)
	同業平均		註 2	註 2	註 2	
	純益率(%)	暉盛		17.49	15.88	3.46
		志聖		14.62	15.70	12.37
		友威科		13.73	30.02	15.36
		鈦昇		1.52	(3.58)	(19.80)
		同業平均		9.40	註 1	註 1
	每股盈餘(元)	暉盛		5.00	3.01	0.10
志聖			3.12	4.80	1.00	
友威科			2.63	5.08	0.36	
鈦昇			0.32	(0.51)	(0.57)	
同業平均			註 2	註 2	註 2	
現金流量(%)	現金流量比率(%)	暉盛		64.26	93.36	1.79
		志聖		33.49	27.79	0.92
		友威科		註 3	82.94	8.95
		鈦昇		45.13	71.69	22.57
		同業平均		13.50	註 1	註 1
	現金流量允當比率(%)	暉盛		註 4	104.98	126.07
		志聖		125.95	115.48	註 5
		友威科		95.01	96.24	註 5
		鈦昇		14.82	15.88	註 5
	同業平均		註 2	註 2	註 2	
	現金再投資比率(%)	暉盛		11.72	12.09	0.46
		志聖		7.94	5.36	註 5
		友威科		註 3	8.45	註 5
		鈦昇		1.16	7.65	註 5
		同業平均		5.00	註 1	註 1

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站，並經福邦證券計算整理；同業資料則參考財團法人金融聯合徵信中心之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中「C29 機械設備製造業」之財務比率，統計數採綜合平均數。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心未出具 113 年度及 114 年第一季之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心編印之「IFRSs 合併財報財務比率」未揭露該等資訊。

註3：採樣同業營業活動淨現金流量為流出數，不具比較意義，故不予列示相關比率。

註4：該公司於112年公開發行，故未有完整5年之IFRS現金流量資訊，故不予計算該比率。

註5：截至評估報告出具日止，同業公司尚未公告於公開資訊觀測站揭露之財務比率數據。

註6：應收款項週轉率及收現天數係以應收款項總額計算。

註7：存貨週轉率及銷貨日數係以存貨淨額計算。

註8：各項財務分析比率之計算方式，列式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(3)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(4)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3)營業利益占實收資本額比率=營業利益/期末實收資本額。

(4)稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/期末實收資本額。

(5)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(6)每股稅後盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

(三)財務比率變動分析與同業比較

1.財務結構

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之負債占資產比率分別為 34.85%、31.37%及 35.17%。113 年底較 112 年底下降，主係因陸續償還長期借款，及受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致負債總額較 112 年底減少所致；114 年第一季底較 113 年底上升，主係該公司陸續接单收取訂金款及依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使合約負債及應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，故負債總額較 113 年底上升，經評估其變動情形尚屬合理。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司負債占資產比率 112~113 年底均優於採樣同業及同業平均，114 年第一季底僅遜於鈦昇而優於志聖及友威科，該公司及其子公司負債占資產比率尚屬健全，且未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情事，經評估尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 335.93%、338.37%及 329.88%。該公司及其子公司之長期資金占不動產、廠房及設備比率各年度變化不大，主係該公司及子公司營運持續穩定獲利使整體權益金額增加所致，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年底長期資金占不動產、廠房及設備比率優於友威科及同業平均而低於志聖及鈦昇；113 年底及 114 年第一季底僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，且各年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆優於 100%，顯示其長期資金足以支應資本支出及營運所需，長期資金結構尚屬健全，經評估無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底財務結構各項財務指標變化情形尚屬合理，財務結構尚屬健全，經評估尚無重大異常之情事。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第一季底之流動比率分別為 384.85%、430.15%及 346.08%；速動比率分別為 314.60%、390.46%及 299.70%。113 年底較 112 年底上升，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應

付款減少，致流動負債較 112 年底減少，流動比率及速動比率因此分別上升至 430.15%及 390.46%；114 年第一季底較 113 年底減少，主係該公司陸續接單收取訂金款及依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使合約負債及應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，致流動負債較 113 年底增加，流動比率及速動比率因此分別下降至 346.08%及 299.70%。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年底流動比率僅低於鈦昇而優於志聖、友威科及同業平均；114 年第一季底優於志聖而低於友威科及鈦昇。速動比率 112 年底僅低於鈦昇而優於志聖、友威科及同業平均；113 年底優於採樣同業；114 年第一季底僅低於友威科而優於志聖及鈦昇，顯示該公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，償債能力尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

(2)利息保障倍數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之利息保障倍數分別為 54.80 倍、35.24 倍及 5.45 倍。該公司及其子公司之利息保障倍數呈現逐年下降趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致稅前利益隨營業收入持續下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度利息保障倍數優於採樣同業而不及同業平均；113 年度僅低於友威科而優於志聖及鈦昇；114 年第一季優於鈦昇而低於志聖及友威科，該公司及其子公司因營運獲利穩定而償債能力尚屬穩健，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季償債能力各項財務指標變化情形尚屬合理，償債能力尚屬良好，經評估尚無重大異常之情事。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率及平均收現日數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 1.43 次，平均收現天數分別為 134 天、171 天及 256 天。該公司及其子公司之應收款項週轉率呈現逐年下滑趨勢，平均收現日數則逐年上升，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業收入持續下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度應收款項週轉率及平均收現日數優於志聖及鈦昇而低於友威科及同業平均；113 年度及 114 年第一季均低於採樣同業，主係受各採樣公司之營業屬性、銷售區域組成、收款方式之不同而有所差異，尚無重大異常情事。

(2)存貨週轉率及平均銷貨日數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 2.44 次，平均銷售天數分別為 166 天、110 天及 150 天。113 年度因受客戶資本支出趨於保守，使得訂單縮減影響營收減少，營業成本隨之下滑，113 年度營業成本減少 29.30%，而 113 年度因客戶資本支出計畫延宕，考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，存貨淨額減少 54.28%，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度，致存貨週轉率較 112 年度上升，存貨週轉天數減少；114 年第一季因 IC 載板廠資本支出計劃延宕，受交機時程影響，部分客戶交機檢驗時程延遲，故換算全年營業成本較 113 年度減少，致存貨週轉率較 113 年度下降，平均存貨週轉天數上升。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度存貨週轉率及平均銷貨日數僅低於志聖而優於友威科、鈦昇及同業平均；113 年度及 114 年第一季均優於採樣公司，顯示該公司存貨控管良好，經評估尚無重大異常之情事。

(3)不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 2.83 次、2.06 次及 1.25 次，總資產週轉率分別為 0.68 次、0.50 次及 0.30 次，該公司及其子公司之不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率均呈現逐年下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業收入持續下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度不動產、廠房及設備週轉率優於鈦昇及同業平均而低於志聖及友威科；113 年度及 114 年第一季均僅低於志聖而優於友威科及鈦昇。112 年度總資產週轉率優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年第一季均僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，整體而言，該公司之資產管理情形尚屬穩健，尚無重大異常情形。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季經營能力各項財務指標變化情形尚屬合理，經營能力尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1)資產報酬率及權益報酬率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之資產報酬率分別為 12.09%、8.19%及 1.29%，權益報酬率分別為 21.03%、11.89%及 1.57%。該公司及其子公司之資產報酬率及權益報酬率均呈現逐年下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致稅後純益隨營業收入持續下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度資產報酬率及權益報酬率均優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年第一季均優於鈦昇而低於志聖及友威科，整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

(2)營業利益及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之營業利益占實收資本比率分別為 57.73%、30.16%及(1.86)%；稅前純益占實收資本額比率分別為 59.58%、39.15%及 5.05%。該公司及其子公司之營業利益及稅前純益占實收資本額比率均呈現逐年下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業利益及稅前純益隨營業收入持續下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度營業利益及稅前純益占實收資本額比率均優於採樣同業；113 年度僅低於志聖而優於友威科及鈦昇；114 年第一季優於鈦昇而低於志聖及友威科，整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

(3)純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之純益率分別為 17.49%、15.88%及 3.46%，每股盈餘分別為 5.00 元、3.01 元及 0.10 元。該公司及其子公司之純益率及每股稅後盈餘均呈現持續下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守使得營業收入減少，進而減少稅後純益所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度純益率優於採樣同業及同業平均；113 年度僅低於友威科而優於志聖及鈦昇；114 年第一季優於鈦昇而低於志聖及友威科。112 年度每股稅後盈餘優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年第一季均優於鈦昇而低於志聖及友威科，整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季獲利能力各項指標之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

5.現金流量

(1)現金流量比率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之現金流量比率分別為 64.26%、93.36%及 1.79%。113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使

得其他應付款減少，致流動負債較 112 年底減少，而該公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加，致現金流量比率上升至 93.36%；114 年第一季主係該公司陸續接單收取訂金款及依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使合約負債及應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，致流動負債較 113 年底增加，惟受 IC 載板廠資本支出計劃延宕，交機時程受影響，部分客戶交機檢驗時程延遲，致稅前純益受營業收入影響而下滑，使營業活動淨現金流入較 113 年度減少，致現金流量比率下降至 1.79%。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年度現金流量比率均優於採樣同業及同業平均；114 年第一季優於志聖而低於友威科及鈦昇，經評估尚無重大異常之情事。

(2)現金流量允當比率

該公司及其子公司 112 年度無法計算前 5 年之營運活動現金流量，因採用國際財務報導準則之財務報表未滿 5 年資料，故不予計算，113 年度及 114 年第一季之現金流量允當比率分別為 104.98%及 126.07%。主係該公司營運獲利持續穩定，使營業活動現金持續流入，在近三年未有大量之資本支出，且存貨未大幅增加之狀況下，該公司及其子公司之現金流量允當比率逐年上升，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司相較，該公司及其子公司除 112 年度因採用國際財務報導準則之財務報表未滿 5 年，無法計算前 5 年之營運活動現金流量外，113 年度之現金流量允當比率僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，114 年第一季現金流量允當比率因採樣同業未公布資料故不予比較，經評估尚無重大異常之情事。

(3)現金再投資比率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第一季之現金再投資比率分別為 11.72%、12.09%及 0.46%。113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，而該公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加，致現金再投資比率上升至 12.09%；114 年第一季主係受 IC 載板廠資本支出計劃延宕，交機時程受影響，部分客戶交機檢驗時程延遲，致稅前純益受營業收入影響而下滑，使營業活動淨現金流入較 113 年度減少，致現金再投資比率下降至 0.46%。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年度現金再投資比率均優於採樣同業及同業平均，114 年第一季現金再投資比率因採樣同業未公布資料故不予比較，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司112~113年度及114年第一季各項現金流量各項指標變化情形尚屬合理，其現金餘額尚足以支應該公司營運所需，經評估尚無重大異常之情事。

- (四)依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第4條第2項或第3項或第28條之1第5項或第6項或科技事業或文化創意事業申請股票上市者，應另列明其最近一會計年度及最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益，暨評估其申請上市年度及未來一年度歸屬於母公司業主之權益繼續達實收資本額三分之二以上之可能性。無面額或每股面額非屬新台幣十元之發行人，應評估未來一年度歸屬於母公司業主之權益低於股本加計資本公積－發行溢價之合計數三分之二之可能性

該公司非以「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第4條第2項或第3項或第28條之1第5項或第6項或科技事業或文化創意事業申請股票上市，且亦非屬無面額或每股面額非屬新台幣十元之發行人，故不適用。

- (五)若屬申請創新板上市者，應另列明申請上市月份至預計掛牌後12個月之各月份現金收支預測表，暨評估其是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條第一項第三款之規定

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條第一項第三款之規定，申請公司市值達新台幣十億元以上，最近四季財務報告所示之營業收入合計不低於新台幣一億元，需證明有足供上市掛牌後十二個月之營運資金。該公司申請上市時股數為28,859,776股，承銷價格暫定為58元，申請上市日(暫以114.6.20為基準日)之前30個、90個、120個營業日電腦議價點選成交之興櫃收盤平均價格分別為97.12元、98.07元及99.60元，市值已達新台幣十億元以上；另該公司最近四季(113.4.1~114.3.31)之財務報告營業收入金額為473,088千元，亦符合營業收入不低於新台幣一億元之規定；此外，經檢視該公司自114年12月(預計掛牌次月)至115年11月(掛牌後十二個月)之現金收支預測表，該公司預計於掛牌後十二個月內之非融資性總支出為721,704千元，其編製原則主係以購置原物料、相關支出及資本支出款項所需支付資金，並考量薪資勞健保等用人費用及營運支出編製而成，經檢視其編製底稿，尚屬合理。該公司預計114年11月掛牌，掛牌次月期初之現金及約當現金為443,072千元，掛牌後12個月(114/12~115/11)之非融資性收入為843,174千元、融資淨支出為92,373千元，合計金額為1,193,873千元，占掛牌後12個月之非融資性支出721,704千元的165.42%。經評估，該公司已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條第一項第三款之規定，未有重大異常之情事。

申請上市月份至預計掛牌後 12 個月之各月現金收支預測表

單位:新台幣千元

項 目	114/06 (申請月份)	114/07	114/08	114/09	114/10	114/11 (掛牌當月)
期初現金及約當現金餘額(1)	452,295	423,533	382,856	377,245	324,255	296,538
加：非融資性收入						
應收帳款收現	20,693	42,463	52,839	39,606	40,009	68,656
其他	663	387	255	401	256	357
合計(2)	21,356	42,850	53,094	40,007	40,265	69,013
減：非融資性支出						
廠商付款	23,722	37,202	41,308	54,261	49,368	29,273
用人支出	7,003	6,773	6,705	15,396	6,652	6,584
所得稅費用	8,701	—	—	9,648	—	—
利息費用	236	236	236	236	236	236
取得不動產、廠房及設備	—	—	—	3,000	1,270	1,500
其他	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891
合計(3)	48,553	53,102	57,140	91,432	66,417	46,484
融資淨額						
發行新股	—	—	—	—	—	125,570
發放現金股利	—	(28,860)	—	—	—	—
銀行借款	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)
合計(4)	(1,565)	(30,425)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	124,005
期末現金及約當現金餘額(5)=(1)+(2)-(3)+(4)	423,533	382,856	377,245	324,255	296,538	443,072

資料來源:該公司提供

申請上市月份至預計掛牌後 12 個月之各月現金收支預測表

單位:新台幣千元

項 目	114/11 (掛牌當月)	114/12	115/01	115/02	115/03	115/04	115/05	115/06	115/07	115/08	115/09	115/10	115/11
期初現金及約當現金餘額(1)	296,538	443,072	447,657	448,519	459,069	522,162	519,742	508,071	465,533	461,817	475,754	475,547	464,564
加：非融資性收入													
應收帳款收現	68,656	52,342	36,379	89,450	104,770	84,398	58,749	37,335	53,301	68,152	85,386	41,169	127,872
其他	357	663	255	255	254	255	255	659	255	255	255	255	255
合計(2)	69,013	53,005	36,634	89,705	105,024	84,653	59,004	37,994	53,556	68,407	85,641	41,424	128,127
減：非融資性支出													
廠商付款	29,273	25,371	17,196	39,527	24,416	68,252	27,146	60,190	39,929	37,194	48,052	33,861	28,153
用人支出	6,584	12,357	6,584	26,936	6,823	6,629	10,634	9,650	6,651	6,584	11,378	6,584	6,584
所得稅費用	—	—	—	—	—	—	20,203	—	—	—	14,926	—	—
利息費用	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
取得不動產、廠房及設備	1,500	—	1,300	2,000	—	1,500	2,000	—	—	—	800	1,270	1,500
其他	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891
合計(3)	46,484	46,855	34,207	77,590	40,366	85,508	69,110	78,967	55,707	52,905	84,283	50,842	45,364
融資淨額													
發行新股	125,570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(73,593)
銀行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)
合計(4)	124,005	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(75,158)
期末現金及約當現金餘額 (5)=(1)+(2)-(3)+(4)	443,072	447,657	448,519	459,069	522,162	519,742	508,071	465,533	461,817	475,754	475,547	464,564	472,169

資料來源:該公司提供

二、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響

(一)背書保證之情形

該公司經董事會決議通過及該公司其子公司執行董事決議通過，該公司及其子公司不擬從事背書保證，得依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定免予訂定背書保證作業程序及建立背書保證備查簿。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站背書保證公告申報資訊等資料，該公司及其子公司並無為他人背書保證之情事。

(二)重大承諾之情形

該公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，業經董事會決議通過，以做為負債承諾及或有事項管理之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司重大承諾事項，主係該公司依銷售機台保固合約於保固期間開立保證票據，保證金額分別為0千元、489千元及489千元。整體而言，重大承諾事項係因正常營業活動所產生，並無異常之情事，尚不致對該公司財務狀況產生重大不利影響。

(三)資金貸與他人之情形

該公司經董事會決議通過及該公司其子公司執行董事決議通過，該公司及其子公司不擬從事從事資金貸與他人，得依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定免予訂定資金貸與他人作業程序及建立資金貸與他人備查簿。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站資金貸與他人公告申報資訊等資料，該公司及其子公司並無資金貸與他人之情事。

(四)衍生性商品交易之情形

該公司經111年12月22日董事會決議通過及其子公司經執行董事決議通過，不擬從事衍生性商品交易。然因應營運需要，以規避風險為原則，經113年3月27日董事會決議及提報113年6月28日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」，作為該公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、衍生性商品備查簿，並檢視公開資訊觀測站衍生性商品公告申報資訊等資料，該公司並無從事衍生性商品交易之情事。

(五)重大資產交易之情形

該公司訂有「取得或處分資產處理程序」，業經董事會決議並提報股東會通過，以作為該公司從事重大資產交易之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站取得或處分資產公告申報資訊等資料，該公司並未有重大資產交易之情事。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止並無從事資金貸與他人、背書保證、衍生性商品及重大資產之交易，而該公司重大承諾皆為正常營運發展所需，經核對相關資料尚屬合理，尚無發現重大異常之情事，且該公司及其子公司並無重大訴訟案件或財務週轉困難之情事，故對該公司及子公司之財務業務尚無重大影響。

三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

該公司申請年度截至最近期止，尚無擴廠計畫，經評估尚無發現重大異常之情事。

四、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之轉投資事業

(一)列明申請年度截至最近期財務報告止概況並評估重要轉投資事業(持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣五仟萬元以上)最近期及最近一個會計年度之營運及獲利情形、最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)，若有利利用發行公司資源及技術之情形，其給付對價或技術報酬金之合理性，若截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，並應評估對發行公司之影響

1.轉投資事業概況

(1)重要轉投資事業圖

114年3月31日

<p style="text-align: center;">暉盛科技股份有限公司</p> <p>公司簡稱：暉盛 成立日期：91年06月 所營業務：各式電漿設備之研發、生產及銷售 資本額：新台幣288,598千元 所在地：臺灣</p>	
	持股比例:100%
<p style="text-align: center;">Stable Promise Group Co., Ltd.</p> <p>公司簡稱：Stable 成立日期：99年06月 所營業務：一般投資業 資本額：USD 500千元 所在地：塞席爾群島</p>	
	持股比例:100%
<p style="text-align: center;">昆山金暉盛電子商貿有限公司</p> <p>公司簡稱：金暉盛 成立日期：99年12月 所營業務：電子零組件貿易與售後服務 資本額：USD 500千元 所在地：中國大陸江蘇省昆山市</p>	

資料來源：該公司提供

(2)重要轉投資事業概況

直接轉投資事業

單位：千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	評價方法	原始投資狀況			114年3月31日				
					金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值
Stable Promise Group Co., Ltd.	一般投資業	塞席爾群島	99	權益法	15,178 (USD 500)	500	100%	6,070	500	100%	USD 1	6,070

資料來源：114年第一季經會計師核閱之財務報告

間接轉投資事業

單位：千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	評價方法	原始投資狀況			114年3月31日				
					金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值
昆山金暉盛電子商貿有限公司	電子零組件貿易與售後服務	中國大陸江蘇省昆山市	99	權益法	15,178 (RMB 3,318)	註	100%	6,070	註	100%	註	6,070

資料來源：114年第一季經會計師核閱之財務報告

註：係有限公司，故無面額及股數

該公司截至114年3月31日止，帳列採權益法投資金額為6,070千元，占實收資本額288,598千元之2.10%，並未超過實收資本額40%之限制，且該公司之公司章程第二條之一載明「本公司轉投資不受公司法第十三條有關轉投資總額不得超過實收股本百分之四十規定之限制。」，故該公司尚無違反公司法第十三條之情事。

2.重要轉投資事業之投資過程

該公司截至114年3月31日止，持股比例達20%以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣五千萬元以上之重要轉投資事業為Stable Promise Group Co., Ltd.及昆山金暉盛電子商貿有限公司，茲將該公司主要轉投資事業之投資目的、決策過程及股權取得情形敘明如下：

(1) Stable Promise Group Co., Ltd.

單位：外幣千元

投資目的及變動原因	取得持股比例 (%)	投資方式	該公司董事會通過日期	投資金額變動情形	股權價格評估依據	款項匯出日期
轉投資大陸金暉盛公司	100	原始設立	99.05.18	USD 100	股票面額	99.11.22
				USD 60		100.01.21
轉投資大陸金暉盛公司	100	現金增資	102.04.03	USD 160	股票面額	102.07.31
轉投資大陸金暉盛公司	100	現金增資	112.11.08	USD 180	股票面額	113.01.04

資料來源：該公司提供

A. 轉投資目的

該公司主要從事各式電漿設備及其製程方案之研發、製造與銷售，為拓展各式電漿設備大陸地區市場及整合大陸地區機台售後服務，而透過第三地先設立 Stable 公司，再由 Stable 公司於中國大陸江蘇省昆山市設立間接 100% 持股之金暉盛公司，經評估其轉投資目的尚屬合理。

B. 決策過程

該公司於 99 年 5 月 18 日董事會決議通過成立 Stable 公司，總投資金額 160 千美元，持股比例 100%，99 年 6 月於塞席爾群島完成 Stable 公司註冊登記，先由該公司董事長宋俊毅先生登記為代表人，尚未實際出資，並於 99 年 10 月將所有權移轉予該公司，該公司分別於 99 年 11 月及 100 年 1 月出資 100 千美元及 60 千美元，並由 Stable 公司前往中國大陸江蘇省昆山市轉投資設立間接控股 100% 之金暉盛公司，而後因持續拓展大陸地區業務而充實營運資金，分別於 102 年 7 月及 113 年 1 月再投資 160 千美元及 180 千美元，增資後持股比例皆維持不變，增資款均隨即轉投資金暉盛公司。整體而言，該公司對 Stable 公司持股變化之投資決策過程係經其董事會通過，且上述對 Stable 公司之增資過程均申報經濟部投審會備查之，其投資決策過程尚無重大異常之情事。

C. 取得價格合理性

該公司對 Stable 公司出資以及後續增資，其價格均係其股票面額之每股 1 美元，故其股權取得價格尚屬合理。

(2) 昆山金暉盛電子商貿有限公司

單位：外幣千元

投資目的及變動原因	取得持股比例(%)	投資方式	該公司董事會通過日期	投資金額變動情形	股權價格評估依據(註)	款項匯出日期
擴展大陸業務	100	原始設立	99.05.18	USD 160	投資金額	100.02.23
營運發展	100	現金增資	102.04.03	USD 160	投資金額	102.08.01
營運發展	100	現金增資	112.11.08	USD 180	投資金額	113.01.05

資料來源：該公司提供

註：係有限公司，故無股數

A. 轉投資目的

該公司主要從事各式電漿設備及其製程方案之研發、製造與銷售，為拓展各式電漿設備大陸地區市場及整合大陸地區機台售後服務，而透過第三地先設立 Stable 公司，再由 Stable 公司於中國大陸江蘇省昆山市設立間接 100% 持股之轉投資金暉盛公司，經評估其轉投資目的尚屬合理。

B. 決策過程

由於金暉盛公司為透過 Stable 公司於中國大陸江蘇省昆山市所設立之 100% 轉投資公司，故該公司對其歷次增資過程係與上述 Stable 公司相同，故不再贅述之。另該公司對金暉盛公司轉投資決策係經其董事會通過，且均已申報經濟部投審會備查之，整體而言，其投資決策過程尚無重大異常之情事。

C. 取得價格合理性

該公司係透過 Stable 公司以原始投資設立及增資方式取得金暉盛公司 100% 股權，其股權取得價格尚屬合理。

3. 重要轉投資事業股權變動情形

(1) 股東組成及持有情形

114 年 3 月 31 日

轉投資事業	主要股東	持有股數(千股)	持股比率
Stable 公司	暉盛科技(股)公司	500	100%
金暉盛公司	Stable 公司	註	100%

資料來源：該公司提供。

註：係有限公司，故無股數

(2) 股權變動情形如下：

單位：外幣千元；千股；%

轉投資事業	原始投資				股權增減情形					114年3月31日		
	年度	金額	股數	持股比例(%)	年度	變動原因	金額	股數	持股比例(%)	累計投資金額	股數	持股比例
Stable 公司	99	USD 100	160	100	102	現金增資	USD 160	160	100	USD 500	500	100
	100	USD 60			113	現金增資	USD 180	180	100			
金暉盛公司	100	USD 160	註	100	102	現金增資	USD 160	註	100	USD 500	註	100
					113	現金增資	USD 180	註	100			

資料來源：該公司提供

註：係有限公司，故無面額及股數

該公司轉投資事業係考量公司未來整體營運及業務發展之投資，其持股變動係因應集團營運策略所需，經評估該公司轉投資事業之股權變動情形，尚無重大異常之情事。

4. 對轉投資事業之管理政策

該公司轉投資計畫係依照該公司內控制度所制定之「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」規定辦理。而該公司訂有「對子公司之監督及管理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」，作為管理轉投資事業之財務業務依據，已確保公司之健全經營。該公司定期取得各轉投資事業之營運及財務資料，除可持續瞭解各轉投資公司財務或業務狀況之外，亦可確實有效的控管其經營績效，另該公司稽核人員依其執行計畫執行子公司內部控制稽核作業，並追蹤其內部控制缺失及異常事項改善情形，藉以掌控轉投資事業之營運情形。

5. 重要轉投資事業最近期及最近一個會計年度之營運及獲利情形

該公司採權益法認列之轉投資事業其最近年度及申請年度截至最近期止營運情形及獲利能力列示如下：

單位：新台幣千元

轉投資公司	投資年度	持股比例(%)	損益認列方式	113年度					114年第一季				
				營業收入	營業毛利(損)	營業(損)益	稅後(損)益	該公司認列之投資(損)益	營業收入	營業毛利(損)	營業(損)益	稅後(損)益	該公司認列之投資(損)益
Stable 公司	99	100	權益法	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	(269)	(269)	(269)	(269)	(269)
金暉盛公司	100	100	權益法	20,288	5,691	948	1,142	1,142	4,339	479	(296)	(269)	(269)

資料來源：該公司提供；113年度及114年第一季經會計師查核簽證及核閱之財務報告

(1) Stable 公司

Stable 主係為該公司投資海外轉投資事業之投資控股公司，本身並無實際營運活動，獲利能力隨金暉盛公司營運狀況影響，故 113 年度及 114 年第一季

獲利能力請詳金暉盛公司說明。

(2)金暉盛公司

金暉盛公司係該公司透過第三地 Stable 公司於中國大陸江蘇省昆山市設立間接 100%持股之轉投資公司，主要業務為提供大陸地區機台技術與後續服務及電漿設備零組件買賣。113 年度營業收入、營業毛利、營業利益及稅後淨利分別為 20,288 千元、5,691 千元、948 千元及 1,142 千元，114 年第一季營業收入、營業毛利、營業利益及稅後淨利分別為 4,339 千元、479 千元、(296)千元及(269)千元，113 年度隨著銷售予中國大陸之機台越來越多，金暉盛公司銷售維修零配件亦隨之增加，使營業收入及稅後純益成長；114 年第一季營收略減，因維修需求較為減弱，且進貨成本受匯率波動影響而增加使得營業成本增加，毛利率減少，進而造成整體營業損失及稅後純損，惟金額尚不重大，整體而言，經評估其營運狀況尚屬穩健，尚無營運或財務週轉困難之情事。

6.最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)

單位：新台幣千元

被轉投資事業	採用權益法認列之子公司、關聯企業、及合資損益之份額			股利分配情形			海外轉投資事業之獲利匯回		
	112 年度	113 年度	114 年第一季	112 年度	113 年度	114 年第一季	112 年度	113 年度	114 年第一季
Stable 公司	(5,316)	1,142	(269)	—	—	—	—	—	—
金暉盛公司	(5,316)	1,142	(269)	—	—	—	—	—	—

資料來源：112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證及核閱之財務報告

該公司對 112~113 年度及 114 年第一季認列之投資損益分別為(5,316)千元、1,142千元及(269)千元，112 年度主係估列 110~112 年度金暉盛公司員工五險一金使營業成本大幅增加，致產生稅後純損；113 年度隨著銷售予中國大陸之機台越來越多，金暉盛公司銷售維修零配件亦隨之增加，使營業收入及稅後純益成長；114 年第一季營收略減，因維修需求較為減弱，且進貨成本受匯率波動影響而增加使得營業成本增加，毛利率減少，進而造成整體營業損失及稅後純損，此外，該公司轉投資事業 Stable 公司及金暉盛公司，均無分派現金股利予母公司以及海外轉投資事業獲利匯回之情事，經評估尚無重大異常之情事。

7.若有利用發行公司資源及技術之情形，其給付對價或技術報酬金之合理性

截至評估報告出具日止，該公司之轉投資事業並無利用該公司資源及技術，而有給付該公司技術報酬金之情事。

8.截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難之情事，並應評估其對發行人之影響

經查閱該公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關資料，該公

司之轉投資事業並無營運或財務週轉困難之情事。

- (二)已赴或擬赴大陸地區從事投資者，應敘明其投資情況與最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、獲利匯回金額，並評估其對發行人財務狀況之影響

該公司最近期及最近二個會計年度已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，其投資情況、投資損益金額、獲利匯回金額及對發行人財務狀況之影響，已詳述於「肆、財務狀況、四、(一)、6、最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形」，大陸轉投資公司金暉盛係主要提供大陸地區機台售後服務所成立，該公司持續透過強化營運管理與成本控管改善營運狀況，對發行人財務狀況尚無重大不利之影響。

- (三)申請年度截至最近期財務報告止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一個會計年度實收資本額百分之二十以上，或逾新台幣五億元者，應就下列事項詳加評估說明；無面額或每股面額非屬新台幣十元之發行人，前開有關實收資本額百分之二十之計算應以歸屬於母公司業主之權益百分之十替代之

截至評估報告出具日止，該公司並無尚未完成且其預估總投資金額占最近一個會計年度實收資本額百分之二十以上，或逾新台幣五億元之投資案，故不適用本項評估。

- 五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

截至評估報告出具日止，該公司尚未有符合「臺灣證券交易所股份有限公司證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條及「會計師受託查核簽證財務報表規則」第三條第二項規定之重要子公司，故不適用本項評估。

- 六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響

該公司截至評估報告出具日止，並無已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法之情事，故不適用本項之評估。

- 七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非公營事業申請股票上市，故不適用本項評估。

- 八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額

該公司非屬金融事業申請股票上市，故不適用本項評估。

九、承銷商應評估外國發行公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響。

該公司非屬外國申請公司申請股票上市，故不適用本項評估。

伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估

本證券承銷商並無委請專家出具審查意見書之情事，故不適用本項評估。

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素

經本承銷商參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，對該公司、其現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內是否違反相關法令規章，而有違誠信原則或影響職務之行使，該公司之著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權是否侵權，繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，以及重大勞資糾紛或污染環境事件表示意見，茲就律師意見書及本承銷商評估對公司營運影響彙總說明如下：

一、發行公司是否違反相關法令規章

(一)發行公司所屬行業之目的事業中央主管機關及影響發行公司所屬行業之重要法律與相關規章

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及查閱主管機關往來函文，該公司除下列(三)之案件，並無違反該行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章之情事。

(二)發行公司依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，評估是否依其法令辦理

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及查閱主管機關往來函文，並查核其資訊公開作業實際辦理情形，該公司自 112 年 12 月 6 日辦理公開發行以來，皆依相關法令規章規定，定期或不定期向主管機關辦理應公告申報事項，並無重大異常之處，故該公司依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，尚依相關規定辦理，尚無重大異常之情事。

(三)其他法令規章

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及查閱主管機關往來函文，該公司尚無違反其他重大法令規章以致影響財務、業務正常運作之情事，相關說明如下：

臺南市政府勞工局及臺南市職安健康處對該公司實施勞動檢查後，因發現該公司

有違反職業安全衛生法令之情事，故函請該公司依限改善。該公司針對前述缺失情事，除已完成改善外，並已加強相關人員專業訓練及行政管理。該公司上述違反情節尚屬輕微，且不致對公司營運、財務、業務狀況、獲利情形、證券價格有重大影響，亦無危及市場秩序或有嚴重損害公益之虞。

二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，查閱該公司 111~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及司法院法學資料檢索系統公開之資訊，並取具該公司董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人之聲明書、稅捐稽徵機關之無欠稅證明、財團法人金融聯合徵信中心當事人綜合信用報告及第一類票據信用資料查覆單等文件，截至評估報告出具日止，該公司及其董事、總經理、持股百分之十以上股東以及實質負責人尚無因違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務行使之情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並查閱司法院法學資料檢索系統，該公司 111~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止，該公司於 112 年度因引用他公司網頁圖片而與其他公司有著作權侵權爭議，惟雙方業於 112 年 11 月 23 日協議和解，該公司亦已依協議內容履行，未再衍生其餘爭訟，經評估對該公司財務業務尚無重大不利之影響，尚無發現該公司有違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，查閱司法院法學資料檢索系統及詢問該公司相關人員，審閱該公司所提供之相關文件以及取具該公司及其董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人所出具之聲明書，該公司 111~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止，該公司及現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

五、重大勞資糾紛或污染環境事件

經取得該公司出具之聲明書及發函行政院勞動部、台南市政府勞工局、勞動部職業安全衛生署、台南市職安健康處、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署及台南市政府環保局，並參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司 111~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止，未有重大勞資爭議或污染環境事件。

柒、列明申請創新板上市之發行公司有無臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

一、申請創新板上市之發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見

該公司並無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事，評估意見請參閱附件一。

二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

該公司董事會設有七席董事，其中黃蕙玲、何志文及顏盟峯三席為獨立董事，另該公司於112年12月27日成立薪酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」，本屆薪資報酬委員會成員由112年12月27日董事會決議委任之，委員皆由獨立董事擔任，茲就該公司獨立董事及薪資報酬委員會成員之專業資格、職權行使及相關事項之評估如下：

(一)成員之專業資格

經檢視該公司獨立董事及薪資報酬委員會委員之學經歷資料，該公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之專業資格；另該公司薪資報酬委員會之成員亦符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」對於薪資報酬委員會成員專業資格條件規範之情事。

(二)職權行使及相關事項

經查閱該公司董事會議事錄並以實地觀察董事會運作情形，獨立董事參與董事會之議案討論及表決，尚未發現有重大異常情事，其職權行使等相關事項皆符合「公開發行公司董事會議事辦法」及相關法令規定。該公司薪資報酬委員會已依「薪資報酬委員會組織章程」規定每年至少召開二次會議，針對董事及經理人之薪資報酬與員工分紅情形等討論並決議，經評估該公司薪資報酬委員會之職權行使及相關事項，尚符合證券交易法第14-6條及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。

綜上，該公司設有三席獨立董事，且已依證券交易法第14-6條規定設置薪資報酬委員會，並已訂定「薪資報酬委員會組織規程」，而獨立董事及薪資報酬委員會之成員專業資格、所定職權之行使、人數及相關事項之辦法，業已依規定辦理，尚無重大異常之情事。

捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定

一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定

(一)集團企業之認定標準

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第六條之規定，集團企業係指於申請上市會計年度及其最近一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。其具體認定標準如下：

1.具有下列各款情事之一者，即認定其彼此間具有控制或從屬關係：

認定標準	符合集團企業標準之公司	評估說明
(1)屬於母公司及其所有子公司關係者。	(1) Stable Promise Group Co., Ltd. (以下簡稱 Stable Promise) (2) 昆山金暉盛電子商貿有限公司(以下簡稱金暉盛公司)	(1)經查閱該公司 113 年度及 114 年截至評估報告出具日之主要股東名冊，該公司並無直接或間接持股 50%以上或具實質控制力之法人股東，故該公司並無母公司。 (2)經查閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司直接或間接持有 50%以上或具實質控制力之轉投資公司計有 Stable Promise 及金暉盛公司等 2 家公司。 綜上所述，符合此項認定標準之集團企業共計 2 家公司。
(2)申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。其判斷標準如下：		
①取得對方過半數之董事席位。	(1)Stable Promise (2)金暉盛公司	(1)經查閱該公司變更登記表，並無他公司取得該公司過半數董事席次之情事。 (2)經查閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及各轉投資公司之董事名單，該公司直接或間接取得對方過半數之董事席位者計有 Stable Promise 及金暉盛

認定標準	符合集團企業標準之公司	評估說明
		<p>公司等 2 家公司。</p> <p>綜上所述，符合此項認定標準之集團企業共計 2 家公司。</p>
<p>②指派人員獲聘為對方總經理者。</p>	<p>金暉盛公司</p>	<p>(1)經查閱該公司董事會議事錄，該公司總經理係經董事會決議後聘任，非由他公司指派。</p> <p>(2)經查閱該公司董事會議事錄及各轉投資事業之設立資料，該公司之子公司 Stable Promise 並無設置總經理一職；另其孫公司金暉盛公司總經理係由母公司董事長兼任，故符合本款認定標準者計有左列 1 家。</p>
<p>③依合資經營契約規定擁有對方經營權者。</p>	<p>無</p>	<p>經查閱該公司董事會議事錄及現行有效契約，尚未發現有依合資經營契約規定擁有對方經營權或他公司擁有該公司經營權之情事。</p>
<p>④為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。</p>	<p>無</p>	<p>經查閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議事錄及其他負債科目明細帳，尚未發現該公司有為他公司或他公司為該公司資金融通金額達對方總資產三分之一以上之情事。</p>
<p>⑤為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者。</p>	<p>無</p>	<p>經查閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及 114 年截至評估報告出具日止之銀行借款契約及董事會議事錄，尚未發現該公司及其子公司有對外背書保證之情事；另尚未發現有他公司為該公司背書保證之情事。</p>
<p>(3)申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。</p>	<p>無</p>	<p>(1)經查閱該公司 113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主要股東名冊，並無持有該公司有表決權股份總數或資本總額三分之一以上之股東。</p> <p>(2)經查閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查</p>

認定標準	符合集團企業標準之公司	評估說明
		核簽證或核閱之財務報告，該公司投資他公司持股總數或資本總額超過三分之一者計有 Stable Promise 及金暉盛公司，惟上述轉投資公司並無持有該公司股份之情形，故無符合本款之集團企業。

2.申請上市會計年度及其最近一個會計年度內，申請公司與他公司間有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係。但申請公司檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

認定標準	符合集團企業標準之公司	評估說明
(1)申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內親屬關係者在內。	無	經查閱該公司董事、總經理及其配偶、子女及具二親等以內之親屬表及轉投資聲明書，該公司並無與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同之情形，故無符合本款之集團企業。
(2)申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	無	經查閱該公司董事及總經理之二親等以內之親屬表及轉投資聲明書，及該公司 113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主要股東名冊，分析該公司主要股東持股情形，該公司並無與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額半數以上為相同之股東持有或出資，故無符合本款之集團企業。
(3)對申請公司採權益法評價之他投資公司，與其之關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。	(1)Stable Promise (2)金暉盛公司	經查閱該公司 113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主要股東名冊、經會計師查核簽證之財務報告及董事、持股 10%以上大股東之轉投資聲明書： (1)並無對該公司採權益法評價之他投資公司，故無符合本款之集團企業。 (2)該公司採權益法評價之他投資公司且持有超過半數之已發行有表決權股份者計有 Stable Promise 及金暉盛公司等 2 家公司。 綜上所述，符合此項認定標準之集團企業共計 2 家公司。

經依上述標準逐一評估後，符合集團企業認定標準者計有 Stable Promise 及金暉盛公司，共計 2 家公司。

(二)集團企業中之本國發行公司或外國發行人申請股票在創新板上市，雖合於本準則有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市

1.申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或主要商品，無相互競爭之情形。但申請公司具獨立經營決策能力者，不在此限。

該公司之集團企業計有 Stable Promise 及金暉盛公司計 2 家公司，皆為該公司之子公司，茲就該公司集團企業主要業務說明如下：

企業簡稱	主營業項目	集團定位	有無相互競爭
Stable Promise	投資控股	投資控股公司	無
金暉盛公司	電子零組件貿易與售後服務	提供中國地區售後維修服務	無

資料來源：該公司提供

該公司主要從事各式電漿設備及其製程方案之研發、製造與銷售，主力產品為電漿表面處理之乾性設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質之處理，電漿設備應用廣泛，公司目前產品主要應用於半導體、PCB 及光電等電子產業；該公司直接持有投資控股公司 Stable Promise 100%股權，再間接投資金暉盛公司。Stable Promise 及金暉盛公司主係為服務中國大陸電漿設備客戶之售後維修，而透過於第三地先設立 Stable Promise，再由 Stable Promise 於中國大陸昆山市設立間接 100%持股之轉投資公司金暉盛公司，Stable Promise 本身除投資外，並無從事營業活動。金暉盛公司設立於中國大陸昆山市，主要定位為提供中國大陸電漿設備客戶之售後維修服務之據點，電子零組件之銷售則係以設備維修零件為主，並未提供整機之研發、製造及銷售，其功能定位及銷售產品均與該公司不同，故該公司與集團企業間並無主要業務或主要商品相互競爭之情形。

2.申請公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過外，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具書面，承諾日後有往來時必無非常規交易之情事

該公司及子公司金暉盛針對集團企業、特定公司及關係人之業務及財務往來已訂定「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」，並分別於 112 年 12 月 27 日經董事會決議及執行董事通過，以規範該公司與集團企業間之財務業務往來事宜。此外，該公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，雙方均已出具財務、業務往來無非常規交易情事之書面聲明；而針對無財務、業務往來之集團企業，該公司亦已出具書面承諾書，承諾日後有往來時必無非常規交易情事。

3.其財務業務狀況及前述之作業辦法應無重大異常情事

經核閱該公司經會計師出具之內控專案審查報告，該公司與集團企業間之各

項財務業務交易，均依內部控制制度及相關作業辦法程序予以執行，另該公司之「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」係依據主管機關公告之「股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範」參考範例，並參酌該公司本身營運狀況而予以訂定，其財務業務狀況與所訂之作業程序與法規範例相較，並無重大異常之情事。

4.其對於銷售予集團企業公司之產品，應具有獨立行銷之開發潛力

經檢視該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司帳冊，該公司之業務由其自行主導及統籌，其訂單均為該公司自行承接，應足以證明該公司具有獨立行銷之開發潛力。

5.申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之進貨金額未超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，得不適用之。

經查閱該公司及其子公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司 113 年度及 114 年第一季與集團企業間之進貨金額來自 100% 持股之子公司之進貨交易，故不適用本項評估。

6.申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額未超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額未超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，得不適用之。

經查閱該公司及其子公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司 113 年度及 114 年第一季止與集團企業間之營業收入金額均屬母、子公司間之銷貨交易，故不適用本項評估。

綜上所述，該公司尚符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」中有關集團企業申請上市之規定。

(三)申請時屬於母子公司關係之子公司申請其股票在創新板上市，雖合於本準則有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市

該公司非以母子公司關係之子公司申請創新板上市，故不適用「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十三條各款情事之規定。

二、評估是否符合建設公司、投資控股公司、金融控股公司或其他特定組織型態公司申請股票上市之規定。

該公司非屬建設公司、投資控股公司、金融控股公司或其他特定組織型態公司申請股票上市，故不適用。

玖、評估發行公司是否依臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

一、評估發行公司是否依臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形

經檢視該公司出具之初次申請有價證券上市公開說明書，已依照臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。

二、評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

該公司係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條申請股票在創新板上市，惟已依照「上市上櫃公司治理實務守則」之規範逐步推行公司治理。經檢視該公司出具之公司治理評鑑自評報告，該公司業已依臺灣證券交易所股份有限公司公告之「114 年度公司治理評鑑指標」進行逐項評估，包括以下各項指標：

(一)維護股東權益及平等對待股東

該公司重視股東權益，每年依照公司法及相關法規召開股東會，並自公開發行後於開會前上傳年報與議事手冊於「公開資訊觀測站」，以確保股東對公司重大事項享有充分知悉權利，股東會之議程係依據「股東會議事規則」進行，對於報告及討論事項，均給予股東適當發言及充分參與討論之機會，並妥善處理股東建議，股東會開會之過程均已錄音或錄影留存，並將股東會所決議事項作成股東會議事錄妥善保存，揭露於「公開資訊觀測站」。另該公司已建置對外專屬網站，並於「公開資訊觀測站」按規定揭露有關財務業務等資訊，該公司亦設置發言人及代理發言人制度，可妥善解答股東之疑義及建議，以保障該公司股東之權益。

(二)強化董事會結構與運作

該公司目前設有七席董事，其中含三席為獨立董事，此三席獨立董事係依公司法第 192 之 1 條規定，採候選人提名制度進行提名選舉，符合上市上櫃公司治理實務守則之規定。該公司在遴選獨立董事時除獨立性外，並充分考量獨立董事之學經歷背景，以期能發揮獨立董事應有之功能。該公司亦設置審計委員會取代監察人制度，審計委員會係由全體獨立董事組成，符合審查準則暨相關法令之規定。另該公司設有薪資報酬委員會，由三位獨立董事組成，該公司亦訂有「薪資報酬委員會組織規程」。

該公司董事會成員分別具備營運判斷能力、財務專業分析能力、經營管理能力、產業相關資訊等執行職務所必須之知識、技能及素養，依「董事會議事規範」至少每季召開董事會一次，有效運作董事會，遇有緊急情事時則隨時召集之，董事會議過程全程錄音或錄影，相關會議紀錄皆依規定辦理保存。全體董事會成員對於公司之經營

策略、風險管理、年度預算、業務績效等重大事項善盡職責。董事會成員於任期中亦持續參加公司治理主題相關之財務、業務、商務、會計或法律等進修課程，以提高董事會成員對公司治理之認知與落實。

(三)提升資訊透明度

該公司重視資訊公開之責任，除建立發言人制度，使股東及利害關係人能即時並充分瞭解公司財務業務狀況外，該公司亦於公司網站建置投資人專區，列示公司財務業務重大訊息並提供股東及利害關係人資訊。該公司依據主管機關及法令規定，已指定專人負責在規定期限內將重要財務業務資訊揭露於公開資訊網路申報作業系統，以利股東及利害關係人參考，此外，該公司過去一年未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情事發生。

(四)推動永續發展

該公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」並經董事會通過，作為該公司與關係企業間財務與業務往來之依據。該公司已訂有「員工工作規則」作為勞資雙方權利義務之規範。該公司已訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」等相關辦法並執行之。在落實企業社會責任方面，該公司之公司治理評鑑自評報告尚能表達該公司之公司治理運作情形，善盡公司對社會之責任。

綜上所述，經本證券承銷商逐條核閱該公司各評鑑指標之自我評估結果，該公司之公司治理評鑑自評報告已敘明目前實際運作之情形，經評估尚無重大異常之情事。

拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估

該公司截至評估報告出具日止尚無重大期後事項。

拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見

該公司非以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市，故不適用。

拾貳、本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市(櫃)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施

該公司非本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市，故不適用。

拾參、其他補充揭露事項

無。

附件一、依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>一、遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p>		是	
<p>(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p>	<p>(一)經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之收發文記錄、董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、營業外支出及勞務費明細帳，查詢司法院法學資料檢索系統，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取具該公司出具之聲明書，該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止，尚無訴訟或非訟案件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益者。</p>		
<p>(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p>	<p>(二)經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、現行有效之重要契約、主管機關往來函文及營業外支出明細帳，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並取具財團法人金融聯合徵信中心信用報告、臺灣票據交換所之信用查覆單，以及該公司出具之聲明書，尚未發現該公司有重大災害、簽訂重要契約、發生特殊事故、改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p>		
<p>(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p>	<p>(三)經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、主管機關往來函文及營業外支出明細帳，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，以及該公司出具之聲明書，尚未發現有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
	<p>市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>綜上評估，該公司尚無違反證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p>		
<p>二、財務業務未能與他人公司獨立劃分者。</p>		是	
<p>(一) 資金來源過度集中於非金融機構者。</p>	<p>(一)經參閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、相關會計科目明細帳及取得該公司之聲明書，該公司並無資金來自於非金融機構之情形，故無資金來源過度集中於非金融機構之情事。</p>		
<p>(二) 申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。</p>	<p>(二)經核閱該公司現行有效之重要契約，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書及取得該公司之聲明書，並無發現與他人簽訂對該公司營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之情事。</p>		
<p>(三) 與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者。但母子公司間共用貸款額度，不在此限。</p>	<p>(三)經核閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告與銀行借款合同及借閱會計師工作底稿，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。</p>		
<p>(四) 申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用之。</p>	<p>(四)經核閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及進貨廠商彙總表，該公司並無來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十之情事。</p>		
<p>(五) 申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十。但基於行業特</p>	<p>(五)經核閱該公司 113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及銷售客戶彙總表，該公司合併之前十大銷售客戶均非該公司之關係人，故經評估該公司未有來自非屬集團企業公司之關係人之營業利益超過百分之五十之情事；另該公司技術來源為自行開發，故未有利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生之營業收入。</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用之。			
	綜上評估，該公司尚無財務或業務未能與他人獨立劃分之情事。		
三、有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境情事，尚未改善者。		是	
(一) 所規定「足以影響公司財務業務正常營運重大勞資糾紛」，係指下列情事之一：	(一) 重大勞資糾紛		
1. 發生重大勞資爭議者。	1. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、勞動部違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開說明書、營業外收支明細帳、取得該公司出具之聲明書，另訪談管理階層及員工暨參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並函詢台南市政府勞工局，該公司並無發生重大勞資爭議之情事。		
2. 因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格者。但經申請由檢查機構複查合格者，不在此限。	2. 經取得該公司出具之聲明書、訪談該公司管理階層、查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、查閱營業外收支及其他費用明細帳，並參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司經臺南市政府勞工局及勞動部職業安全衛生署對該公司實施勞動檢查後，針對違反職業安全衛生法令缺失限期改善情事，已完成改善，並無處以罰鍰情事，另已加強相關人員專業訓練及行政管理。該公司尚無因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反勞工安全衛生法被處以部分或全部停工；或設置危險性機械、設備未檢查合格之情事。		
3. 積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納者。	3. 經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，函詢勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署南區業務組，並抽核該公司勞工保險費及健康保險費繳納情形，該公司並無積欠勞健保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納之情事。		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
(二) 所規定「足以影響財務業務正常營運之重大污染環境」，係指公司或其事業活動相關場廠有下列情事之一：	(二) 重大環境污染		
1. 依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得者。	1. 該公司主要產品為各式電漿設備之研發、生產及銷售，營業過程中亦無產生汙染環境之情事，故無需取得固定污染源設置許可證、水污染防治措施計畫及水污染防治許可證及事業廢棄物清理計畫書核准函，且亦無依廢棄物清理法第 28 條及行政院環保署-指定公告應置廢棄物專業技術人員之事業之情事，故該公司尚無依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得之情事。		
2. 曾因環境污染，於申請上市會計年度或最近二會計年度，各該年度經環保機關按日連續處罰者或經限期改善，而未完成改善者。	2. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、營業外支出及其他費用明細帳、公開說明書、函詢主管機關及取得該公司出具之聲明書，並詢問管理階層暨參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，尚無發現該公司有環境污染而受環保機關按日連續處罰或經限期改善而未完成改善之情事。		
3. 有公害糾紛事件而無有效污染設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者。	3. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、詢問相關人員、核閱該公司之年報、公開說明書暨參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，並函詢台南市政府環境保護局，該公司未有發生公害糾紛事件，亦無需依法設置污染防治設備之情事。		
4. 有環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證者。	4. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、詢問該公司相關人員、函詢主管機關、參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，該公司並無因環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情事。		
5. 廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者。	5. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，該公司所產生之廢棄物委託合格廢棄物處理廠商進行清運，尚未有廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
	造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者之情事。		
6. 經土壤及地下水污染整治法主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址者。但污染控制計畫或調查及評估計畫經環保機關核定、整治費用已依一般公認會計原則認列且對營運無重大影響者，不在此限。	6. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，並查詢行政院環保署土壤及地下水污染整治基金管理會網頁資訊，該公司非屬中央主管機關指定公告之事業，並無土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。		
7. 法人有製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定者。	7. 經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、函詢主管機關及取得該公司出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司並無製造、加工、或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人亦無經判刑確定之情事。		
(三) 所規定「尚未改善者」，係指在臺灣證券交易所股份有限公司受理其股票上市申請案之日以後仍有上開情事者。	(三) 該公司截至評估報告出具日止，尚無發生重大勞資糾紛或重大污染環境之情事，故不適用本項評估。		
(四) 但前(二)第二款之重大環境污染情事，以其已委託經環保機關認可之檢測機構，進行檢測及提出檢測結果報告書，並據以向環保機關申報污染改善完成報告書，於申報後三個月內未再續遭處罰者，作為是否改善之認定標準。	(四) 該公司截至評估報告出具日止，尚無發生重大勞資糾紛或重大污染環境之情事，故不適用本項評估。		
	綜上評估，該公司尚無發生足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境而尚未改善之情事。		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>四、經發現有重大非常規交易，尚未改善者。</p> <p>(一)所稱「重大非常規交易」係指申請公司有下列各款情事之一者，但公營事業依審計法規辦理者，不在此限：</p>		是	
<p>1. 進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。</p>	<p>1.經參閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並抽核關係人及主要進銷貨往來廠商及客戶之交易憑證與傳票，並未發現該公司有進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序與一般正常交易有顯不相當或顯欠合理而尚未改善之情事。</p>		
<p>2. 依主管機關訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性者。</p>	<p>2.該公司已遵循主管機關訂頒之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，訂定「取得或處分資產處理程序」，且經董事會及股東會通過。經參閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開資訊觀測站公告紀錄、財產目錄、董事會及股東會議事錄，未有達應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，經檢視其內部決定過程之合法性、交易之必要性、報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性，尚無發現重大異常之情事。</p>		
<p>3. 以簽約日為計算基準，其最近五年內買賣不動產有下列情形之一者：</p>			
<p>(1)向關係人購買不動產，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為低，且未符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十七條規定者。</p>	<p>(1)經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止土地、房屋及建築物之財產目錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年度及申請年度未有向關係人購買不動產之情事，故不適用。</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
(2) 出售不動產予關係人，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為高者。	(2) 經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止土地、房屋及建築物之財產目錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年度及申請年度未有向關係人出售不動產之情事，故不適用。		
(3) 向關係人買賣不動產，收付款條件明顯異於一般交易，而未有適當理由者。	(3) 經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止土地、房屋及建築物之財產目錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年度及申請年度未有向關係人買賣不動產之情事，故不適用。		
(4) 申請公司所買賣土地與關係人於相近時期買賣鄰近土地，價格有明顯差異而未有適當理由者。	(4) 經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止土地、房屋及建築物之財產目錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年度及申請年度未有買賣土地之情事，故不適用。		
(5) 最近五個會計年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十，而未有適當理由者。	(5) 經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止經會計師查核簽證或核閱之財務報表，該公司未有銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入逾年度營業收入百分之二十之情事，故不適用。		
(6) 向非關係人買賣不動產，有其他資料顯示買賣不動產交易明顯異於一般交易而無適當理由者。	(6) 經參閱該公司 109~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止土地、房屋及建築物之財產目錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司 111 年度以自地委由非關係人興建現有台南廠房，經檢視交易合約，抽核交易憑證，尚無重大異常情事。		
4. 非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人者。	4. 該公司已於 111 年 12 月 22 日經董事會通過不擬從事資金貸與及背書保證交易。經查閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會議事錄、公開資訊觀測站並檢視相關帳冊，該公司未有資金貸與他人之情事。		
5. 其他各項關係人交易及財務業務往來，未能合理證明其交易必要性、決策過程合法性，暨價格與款	5. 經參閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、關係人交易彙總表、董事會及股東會議事錄，並經抽核該公司與關係人交易之相關憑證，該公司其他各項關係人交易及財務業務往來		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
項收付情形之合理性者	尚具必要性、決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性。		
(二) 前項第三款關於向關係人買賣不動產之規定，對於最近五年內其交易對象之前手或前前手有關係人身份時，亦應比照適用之。但買賣不動產之交易，其交易對象簽約取得時間，至本次交易簽約日止超過五年者，可免適用之。	(二) 該檢視該公司最近五年內取得之不動產歷史異動紀錄，該公司並無向關係人買賣不動產之情事，故不適用。		
(三) 前二項規定所涉之「關係人」，其範圍應依證券發行人財務報告編製準則第十八條定義，並包括下列各款情形，但申請公司能證明不具控制、聯合控制及重大影響者，不在此限：	(三) 該公司關係人交易對象屬證券發行人財務報告編製準則第十八條定義及左列各款情形定義者，均已依前二項規定納入評估，經評估尚無發現重大異常情事。		
1. 申請公司及與申請公司為公司法第六章之一所稱之關係企業(下稱關係企業)，其持股超過百分之十之股東。			
2. 與申請公司之董事、監察人、經理人具有下列關係者： (1) 與本人或其配偶(含相當於配偶之同居伴侶，本項以下同)具二親等以內關係之人員。 (2) 本人係屬法人者，其母公司、子公司或與其受同一公司或個人股東控制之公司。			

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>3. 與申請公司之持股超過百分之十之股東或與關係企業之董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東具有下列關係者：</p> <p>(1) 配偶。</p> <p>(2) 與本人或其配偶具二親等以內關係之人員。</p> <p>(3) 本人係屬法人者，其母公司、子公司或與其受同一公司或個人股東控制之公司。</p>			
<p>4. 申請公司、其母公司及其重要子公司之董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東個別或與之具有配偶或前二款關係之人合計直接或間接持有表決數之股份總數或資本總額達二分之一以上之被投資公司及該被投資公司之子公司。</p>			
<p>(四) 申請公司有(一)所定情事，致獲得利益者，經將所獲得利益予以扣除設算後，其獲利能力仍應符合上市條件。</p>	<p>(四)該公司未有第(一)項所定之情事，故不適用。</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>(五) 所稱「尚未改善」，其改善之認定係指符合下列情事之一者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因非常規交易而致申請公司以外之人獲得利益者，該獲得利益之人已將所得利益歸還應得之人者。 2. 該非常規交易行為經檢調或司法單位確定無犯罪情事。 3. 該非常規交易已恢復原狀者。 	<p>(五) 綜上評估，該公司尚無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。</p>		
<p>五、有迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度或不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告等情事，情節重大者。</p>		是	
<p>(一) 所規定「不依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告」係指有下列情事之一者：</p>	<p>是否不依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告之評估如下：</p>		
<p>1. 財務報告未依有關法令及一般公認會計原則編製，經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者。</p>	<p>1. 經參閱該公司 112~113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司之財務報告編製均依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編制，並無經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書，或經會計師出具保留意見之查核報告書，而影響其財務報告允當表達之情事。</p>		
<p>2. 財務報告經主管機關函示應改進而未改進者。</p>	<p>2. 經參閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、與主管機關之往來函文，並無發現財務報告有經主管機關函示應改進而未改進之情事。</p>		
<p>3. 簽證會計師查核工作底稿，經臺灣證券交易所股份有限公司調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當</p>	<p>3. 經詢問該公司管理階層，並參閱 112~113 年度及 114 年第一季會計師財務報告查核及核閱之工作底稿，並未有經主管機關調閱發現重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達之情事。</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
表達者。			
(二)所規定「迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度」係指有下列情事之一者：	是否迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度之評估如下：		
1. 在申請上市年度未依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則或內部控制相關法令規定，建立健全書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度。	1.經取得該公司之書面會計制度、內部控制制度及內部稽核制度，該公司已依「證券發行人財務報告編製準則」建立健全書面會計制度，另其內部控制制度及內部稽核制度已依相關法令規定編製，並經董事會通過。		
2. 經臺灣證券交易所股份有限公司實地查核，發現未依書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度合理運作者。	2.經查閱該公司112~113年度會計師出具之內部控制制度建議書，並未發現有重大缺失及尚未改善之情事。另國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師及李國銘會計師已針對該公司之內部控制及內部稽核作業執行情形進行專案審查(審查期間為113年10月1日至114年3月31日)，並於114年6月24日出具合理確信之內部控制制度審查報告。		
	綜上所述，該公司已依相關法令及會計原則編製財務報告，且書面會計、內部控制及內部稽核制度亦已建立且有效執行。		
六、所營事業嚴重衰退者 (一)所規定「嚴重衰退」，係指有下列情事之一者，但申請股票上市公司最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二；於股票採行無面額或每股面額非屬新臺幣十元之公司最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占淨值比率不低於百分之六者，不適用之：	經查閱該公司113年度經會計師查核簽證之合併財務報告之營業利益及稅前淨利分別為87,039千元及112,983千元，占113年底之股本288,598千元之比重分別為30.16%及39.15%，已超過12%以上，故不適用所營事業嚴重衰退之評估。	是	
1. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。			

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
2. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之稅前淨利與同業比較，顯有重大衰退者。			
3. 最近三個會計年度之營業收入及營業利益，均連續呈現負成長情形者。			
4. 最近三個會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者			
5. 產品或技術已過時，而未有改善計畫者。			
(二) 前項各款規定，對於依本準則第四條第二項、第三項或第五條規定申請股票上市公司，經提出合理性說明者，得不適用之。			
(三) 第一項第一、二款所規定「同業比較」，證券承銷商應評估說明所採樣同業之合理性。			
(四) 第一項第三、四款之規定，對於已有具體改善計畫並產生效益者，不適用之。			
(五) 第三十一條第六款所規定「所營事業嚴重衰退」，經申請有價證券在創新板上市、創新板第一上市者提出合理性說明後，得不準用第十四條、第二十八條規定。			
七、申請公司或其現任董事、總經理或實質負責人於最近三年內，有違反誠信原則之行為者。		是	
(一) 公司部分 1. 所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金	(一) 公司部分 1. 經查閱該公司出具之聲明書、莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書、董事會議事錄、第一類票據信用資料查覆單及財團法人金融聯合徵信中		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經註銷者。	心出具之信用報告，該公司 111 年迄今並無所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經註銷之情事。		
2. 向金融機構貸款有逾期還款之情形。	2. 經查閱該公司財團法人金融聯合徵信中心出具之信用報告及該公司出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司 111 年迄今並無向金融機構貸款有逾期還款之情形。		
3. 違反勞動基準法被處以刑罰確定者，但最近二年內經檢查機構複查已改善者，不在此限。	3. 經查閱該公司主管機關往來函文、函詢勞工主管機關及該公司出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司並無違反勞動基準法被處以刑罰確定之情事。		
4. 違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者。	4. 經查閱該公司主管機關往來函文、取得國稅局與稅捐稽徵機關無違章欠稅紀錄之回函及該公司出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司並無違反稅捐稽徵法經判決有罪確定之情事。		
5. 違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項者。	5. 經查閱該公司出具無違反誠信原則行為之聲明書並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司並無違反申請創新版上市時所出具聲明書之聲明事項之情事。		
6. 有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。	6. 經查閱該公司主管機關往來函文、董事會與股東會議事錄、會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司出具之聲明書，檢視司法院法學資料檢索裁判書系統查詢資料並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司並無其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益或股東權益或公眾利益之情事。		
(二) 董事、總經理或實質負責人部分 1. 同前款第(一)、(二)、(三)、(四)及(五)目。但屬向金融機構貸款逾期者，倘逾期還款情節非屬重大或有合理事由者，不在此	(二) 董事、總經理或實質負責人部分 1. 經取得董事、總經理或負責人之第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心出具之信用報告、國稅局與稅捐稽徵機關無違章欠稅紀錄之回函及前述人員出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司之董事、總經理或負責人並未發現有所開立之支票存款戶經		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
限。	票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記者、向金融機構貸款有逾期還款之情形者、違反勞動基準法被處以刑罰確定者、違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者及違反申請創新版上市時所出具聲明書之聲明事項者之情事。		
2. 犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。	2. 經查閱該公司公開說明書及年報，查詢司法院法學資料檢索系統及取得該公司董事、總經理或負責人出具之聲明書，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事、總經理或負責人未發現有犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法及票券金融管理法等商事法規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		
3. 有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者。	3. 經取得該公司董事、總經理或負責人出具之聲明書並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事、總經理或負責人最近三年內未有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者之情事。		
4. 有其他重大違反法令或誠實信用原則之行為者。	4. 經取得該公司董事、總經理或負責人出具之聲明書並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事、總經理或負責人未有其他重大違反法令或誠實信用原則行為之情事。		
	綜上評估，該公司及其現任董事、總經理或負責人於最近三年內並無違反誠信原則之行為。		
八、申請公司之董事會成員少於五人或為單一性別，獨立董事人數少於三人或少於董事席次三分之一；其董事會有無法獨立執行其職務；或未依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會者。另所選任獨立董事其中至少一人須為會計或財務專業人士。但本國發行公司申請股票上	經檢視該公司最近期經濟部變更事項登記表，該公司目前設有七席董事(其中包括三席獨立董事)，已符合董事成員不少於五人或為單一性別，獨立董事人數不少於三人或少於董事席次三分之一之規定；該公司七席董事彼此間並無超過半數之席次具有配偶、二親等以內親屬及同一法人之代表人之關係，故該公司並未有董事無法獨立執行其職務之情事；另該公司業已依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並經董事會決議委任三名獨立董事擔任薪資報酬委員會委	是	

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>市前，其股票未登錄為興櫃股票櫃檯買賣者，經承諾至遲於股票上市買賣前完成獨立董事之選任及功能性委員會之設置者，不在此限。</p> <p>所規定「董事會有無法獨立執行其職務」，係指不得具有下列情事之一者：</p>	<p>員。所選獨立董事黃蕙玲及顏盟峯為會計或財務專業人士，符合獨立董事至少一人應具備會計或財務專業人士之規定。</p>		
<p>(一) 擔任申請公司獨立董事，有不合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之要件者。</p>	<p>(一) 該公司係依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂要件選任獨立董事三席，茲說明如下：</p>		
<p>1. 擔任申請公司獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</p> <p>(1) 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。</p> <p>(2) 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</p> <p>(3) 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。</p>	<p>1. 專業資格條件：</p> <p>(1) 該公司獨立董事黃蕙玲曾任大眾證券(股)公司承銷部及台新證券(股)公司資本市場事業處資深協理，任職期間為民國 102 年 6 月~民國 111 年 3 月，具備商務、法務、財務、會計或公司業務 5 年以上工作經驗。</p> <p>(2) 該公司獨立董事何志文曾任飛信半導體(股)公司總經理及副總經理，任職期間為民國 93 年 5 月~民國 99 年 3 月，具備商務、法務、財務、會計或公司業務 5 年以上工作經驗。</p> <p>(3) 該公司獨立董事顏盟峯現任國立成功大學會計學系兼財務金融研究所教授，任職期間為民國 107 年 8 月迄今，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上之工作經驗；另顏盟峯曾任中華郵政股份有限公司董事，任職期間為民國 107 年 5 月~民國 108 年 7 月，並曾任戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院董事，任職期間為民國 110 年 3 月迄今，具備商務、財務、會計或公司業務 5 年以上工作經驗。</p>		
<p>2. 有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任：</p> <p>(1) 有公司法第三十條各</p>	<p>2. 經檢視該公司最近期經濟部變更登記事項表，取得獨立董事出具之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心出具之信用報告及票據交換所出具之票據信用</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>款情事之一。</p> <p>(2)依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> <p>(3)違反本辦法所定獨立董事之資格。</p>	<p>資料查覆單，並查詢司法院法學檢索系統，並未發現該公司獨立董事有公司法第三十條各款所列情事，且三位獨立董事皆以自然人身份當選，非為公司法第二十七條規定之法人或其代表人，亦無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所定獨立董事資格之情事。</p>		
<p>3.擔任申請公司獨立董事於選任前二年及任職期間無下列情事之一：</p> <p>(1)申請公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2)公司或其關係企業之董事或監察人。</p> <p>(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4)第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>	<p>3.茲就該公司獨立董事選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)，評估是否符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項各款之獨立性規定：</p> <p>(1)經取具獨立董事出具之聲明書、學經歷及該公司員工名冊，該公司之獨立董事於選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)並非申請公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2)經參閱該公司及關係企業公示資料董監名單、獨立董事出具之聲明書、轉投資及學經歷相關資料，該公司之獨立董事於選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)並非該公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(3)經取具該公司股東名冊、獨立董事出具之聲明書、親屬表及轉投資聲明書等資料，該公司獨立董事於選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)並無以本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有該公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。</p> <p>(4)經取得該公司獨立董事出具之聲明書、親屬表及該公司股東名冊、董監名單及員工名冊，該公司獨立董事之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬於獨立董事選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)，並非為該公司或其關係企業之董監事或經理人，亦非為持有該公司已發行</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>(5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6)公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p> <p>(8)與申請公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。</p>	<p>股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人。</p> <p>(5)經取得該公司股東名冊，直接持有該公司已發行股份總額百分之五以上及持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人名單，並取得該公司獨立董事聲明書、轉投資聲明書等資料及任職他公司之相關資料，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間非為直接持有該公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6)經取得該公司股東名冊及公司登記資料，未有他公司董事席次或有表決權之股份超過半數由同一人控制之情事，故該公司獨立董事於選任前二年及任職期間非為公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(7)經取得該公司公司登記資料，董事長及總經理之轉投資聲明，與申請公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司之公司登記資料，並取得獨立董事聲明書及學經歷文件，該公司獨立董事於選任前二年(111~112年)及任職期間(113年度及114年截至評估報告出具日止)非為該公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人之情事。</p> <p>(8)茲就特定公司評估說明如下： A.經取得該公司股東名冊，該公司未有持有該公司已發行股份總數百分之二十以上法人股東之情事。 B.經取得該公司股東名冊，並查詢法人股東公司登記之董監事持股情形，未有他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有該公司已發行股份</p>		

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>公開發行公司之獨立董事曾任第一項第二款或第八款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用第一項於選任前二年之規定。</p>	<p>總額百分之三十以上。</p> <p>C.取得該公司 111~113 年度及 114 年截至 3 月底止之前十大客戶營收排名表，營業收入有來自他公司及其集團公司達百分之三十以上之公司計有 A2 公司 1 家。</p> <p>D.取得該公司 111~113 年度及 114 年截至 3 月底止之供應商明細表，該公司主要產品各式電漿設備之主要原料為構構件，其數量或總進貨金額未有來自他公司及其集團公司達 50%以上者。</p> <p>綜合以上，符合條件之特定公司計有 A2 公司 1 家，經查詢上述特定公司之公司登記資料並取得獨立董事出具之聲明書、學經歷文件及轉投資聲明書，該公司股東名冊及進銷貨前十大名單，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間均未擔任與該公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>(9)經取得該公司獨立董事出具之聲明書及學經歷文件，並查閱該公司及關係企業相關帳冊，並未發現該公司獨立董事於選任前二年(111~112 年)及任職期間(113 年度及 114 年截至評估報告出具日止)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p>		


項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
4. 兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。	4. 經取具該公司獨立董事出具之聲明書及學經歷資料，並檢視公開資訊觀測站揭露資訊，該公司獨立董事未有兼任其他公開發行公司之獨立董事超過三家以上之情事。		
5. 公開發行公司獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。	5. 經檢視該公司之公司章程及股東會議事錄，該公司獨立董事之選舉，係依公司法 192 條之 1 規定採候選人提名制度，並載於公司章程第十五條，該公司依規定期限內受理持股 1% 以上之股東提名獨立董事候選人，並經 113 年 1 月 26 日股東臨時會選任，故該公司獨立董事之選舉程序符合相關規定。		
(二) 擔任申請公司獨立董事者，未於該公司簽訂輔導契約當年度起進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一、二、四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件。	(二) 經取得該公司三位獨立董事之進修相關證明文件，該公司獨立董事已於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一、二、四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件。		
(三) 申請公司之董事彼此間有超過半數之席次，具有下列關係之一： 1. 配偶。 2. 二親等以內之親屬。 3. 同一法人之代表人。 前項第(三)款之規定，對於政府或法人為股東，以政府或法人身分當選為董事，而指派代表行使職務之自然人；暨由其代表人當選為董事之代表人，亦適用之。董事間有超過半數之席次具有第(三)款第3目之關係，經目的事業主管機關核准者，不適用之。	(三) 經取得該公司最新公司變更登記表及該公司董事之親屬表與其所出具之聲明書等資料，該公司董事彼此間未具有配偶、二親等以內之親屬及同一法人之代表人有超過半數之席次。 綜上所述，該公司董事會未有無法獨立執行其職務之情事。		
九、申請公司於申請上市會計年度及其最近一個會計年度已登錄為興櫃股票櫃檯買賣者，於掛牌日起，其現任	該公司於 113 年 3 月 18 日登錄為興櫃股票櫃檯買賣，經取得該公司現任董事及持股超過 10% 以上股東出具之聲明書並查閱公開資訊觀測站-內部人持股異動申報資料、股東	是	

項目	就上市審查準則暨其補充規定逐項評估情形	是否適宜上市	備註
<p>董事及持股超過其發行股份總額百分之十之股東有未於興櫃股票市場買賣申請公司發行之股票情事者。但因依第三十六條規定辦理之上市前公開銷售或有其他正當事由者，不在此限。</p>	<p>持有股數資料表等股票興櫃期間之股權變動資料，該公司現任董事及持股超過 10%以上股東於股票興櫃期間持有股數均未異動，且未發現有未於興櫃股票市場而買賣該公司股票之情事。</p>		
<p>十、申請公司之股份為上市(櫃)公司持有且合於下列條件之一者，該上市(櫃)公司最近三年內為降低對申請公司之持股比例所進行之股權移轉，未採公司原有股東優先認購或其他不損害公司股東權益方式：</p> <p>(一)申請公司係屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司。</p> <p>(二)申請公司係屬上市(櫃)公司子公司，於申請上市前三年內，上市(櫃)公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。</p>	<p>該公司非屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司，亦非屬上市(櫃)公司之子公司，有於申請上市前三年內，上市(櫃)公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上之情事，故不適用本項評估。</p>	是	
<p>十一、其他因事業範圍、性質或特殊狀況，臺灣證券交易所股份有限公司認為不宜上市者。</p>	<p>尚未發現該公司有其他因事業範圍、性質或特殊情況，而不宜創櫃上市之情事。</p>	是	


主辦證券承銷商：福邦證券股份有限公司



評估人簽章：謝灼梅 

林瑋薇 

蘇牧得 

黃元鴻 

單位主管簽章：藍順得 

負責人簽章：黃炳鈞 

中華民國 114 年 0 月 25 日

(本用印頁僅限於暉盛科技股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：元大證券股份有限公司



評估人簽章：



單位主管簽章：



負責人簽章：陳修偉



中華民國 114 年 6 月 25 日

(本用印頁僅限於暉盛科技股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

附件十七

創ใหม่上市前現金增資發行新股證 券承銷商評估報告

暉盛科技股份有限公司

創新板上市前現金增資發行新股

證券承銷商評估報告

主辦證券承銷商：福邦證券股份有限公司



中華民國一十四年九月十日

暉盛科技股份有限公司

目錄

頁次

壹、承銷商總結意見	1
貳、評估報告內容摘要	2
一、產業概況	2
二、發行人競爭地位及營運風險	14
三、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益	43
參、發行人之業務財務狀況	44
一、業務狀況	44
二、財務狀況	78
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	96
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫	96
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益	96
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響	96
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事	96
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開	96
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	97
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行	97
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事	97
三、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事	106
四、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定	106
五、法令之遵循及對公司營運影響	116
六、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列情事	120
陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	121
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有可行性、必要性及合理性	121
一之一、總括申報發行新股案件者，應另提供評估說明	123
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估	123
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性	124
三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性	130
四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性	130

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響	130
六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項	130
七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期還款之來源及如何取得人民幣資金等)	131
陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項	132
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果	132
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
拾貳、拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	132
拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估	132

壹、承銷商總結意見

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」或「暉盛公司」)本次為辦理初次創新板上市前現金增資發行普通股 2,165 千股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總面額為新台幣 21,650 千元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地瞭解暉盛公司之營運狀況，與該公司董事、經理人及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，暉盛公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

福邦證券股份有限公司



負責人：黃炳鈞



承銷部門主管：藍順得



中 華 民 國 一 一 四 年 九 月 十 日

貳、評估報告內容摘要

本承銷商經依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定辦理進行查核，所獲結論如下：

一、產業概況

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛公司或該公司)，成立於 2002 年，以開發先進電漿(Plasma)技術及製作各式電漿設備為營運主軸。電漿又稱做等離子體，是在固態、液態和氣態以外的第四大物質狀態。當氣體在高溫或強電磁場下，將促使氣體內的電子與中性原子互相撞擊，如此反覆撞擊並達到崩潰效應後，即形成由離子、電子與中性的原子或分子所組成的狀態，即為電漿。電漿具有高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，使得電漿在科學及工業技術中應用廣泛，包括半導體製程(蝕刻、清洗及表面改質等)、能源環保(核融合、廢氣廢水處理、創造乾淨新能源等)、醫療生技(醫材改質、消毒等)及日常消費性產品(如鞋業、高爾夫球、車用製品、紡織等)等各項領域。

該公司專注將電漿技術開發，憑藉優越的電漿製程及設備開發能力，專注於發展高效能的工業級表面處理解決方案，其產品應用於半導體產業，並聚焦於先進封裝領域，另亦專注於 IC 載板及印刷電路板(以下簡稱 PCB)產業之應用，其他應用領域則有平面顯示器與 LED 等光電產業、新能源與環保產業、非電子業及民生工業等，並以各式製程間所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質為主。電漿清洗/蝕刻是一種經過驗證、有效、經濟且環保的關鍵表面處理方法，與傳統的濕式清潔方法相比，使用電漿進行離子清洗可藉由高溫或強電磁場使物質解離，釋放出離子和自由基，破壞樣品表面上有機污染物或無機物之鍵結，此時腔體中所通入的反應氣體離化產生正負離子、自由基等粒子，這些粒子會與有機污染物或無機物的鍵結結合，形成氣態之化合物如 CO_2 和 H_2O ，再藉由幫浦抽離腔體。電漿清洗優點在於不會造成環境污染，經電漿清洗，表面回歸未受污染狀態，可在無有害廢料情況下進行黏合或進一步製程。電漿蝕刻是製作半導體元件經常需要用到的技術，讓物件的表面用反應氣體來進行蝕刻，清除表面污染。表面的材料被蝕刻後，轉化為氣體並由真空系統去除，表面積增加可提高表面性能。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，半導體晶圓加工製程已由微米尺度微縮為奈米尺度之精準度，相關製程技術之規格亦愈來愈高。在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢，除於半導體製程不斷精進與突破之外，在 ESG 潮流趨勢下，乾式電漿蝕刻無污染之優勢，使其在其他新興產業之應用亦越趨廣泛。而電漿表面改質技術，則能於材料表面形成特定官能基，來達到黏合或接著度的需求。材料經電漿處理後，能於分子結構中，產生自由基，有助於改善材料表面之其他材料相容性。

茲就該公司及其子公司所屬產業概況及行業營運風險說明如下：

(一) 產業之現況及發展趨勢

1. 半導體產業及設備

(1) 半導體產業

半導體產業為現代科技與經濟發展的核心趨動力，並廣泛應用於消費電子、通訊、汽車、工業設備及人工智慧(AI)等領域，其發展趨勢受多重因素影響，包括技術創新、材料科學、政策變遷、商業模式演變及終端用戶需求等。半導體產業需要鉅額資金投入研發和製造，同時依賴高度專業的技術知識，具有相當高的進入門檻。產業鏈包括上游的 IC 設計公司專注於高效能半導體晶片的研發設計，國際代表性公司如英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)及超微(AMD)等；中游的晶圓製造與代工公司負責通過先進的製造技術將設計圖轉換為實際的晶片，國際代表性公司如台積電(TSMC)及三星(Samsung)；下游的 IC 封裝測試公司如日月光(ASE)負責將晶片進行封裝，確保其在使用過程中的穩定性和耐用性，並進行測試以確認每個晶片的功能和性能均符合標準。半導體設備產業則是在半導體製造及封裝過程中所需的各種設備和工具的總稱，包括製程設備(如光刻機、蝕刻機、去膠機等)和測試設備(如測試儀器、封裝測試等)，近年成長主要受到新興技術驅動，包括人工智慧(AI)、5G、物聯網(IoT)和自動駕駛技術等，以及更先進半導體製程節點所對應之高精密度製造技術的需求，催生了對於更高效能、更低功耗的半導體器件的需求，進而推動半導體設備的需求。

2023 年全球半導體產業進入景氣下行與調整期，隨著全球經濟放緩，終端市場需求顯著減弱，再加上供應鏈中的庫存過高，半導體市場呈現明顯衰退跡象，然而 2024 年隨著人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的蓬勃發展，NVIDIA、超微等 AI 伺服器用 GPU 需求仍強，而客製化的 AI 運算晶片以及支援 AI 運算的網通晶片也將成為高成長的產品；伴隨全球半導體景氣逐漸回溫，化合物半導體取其材料特性，在通訊、功率、車用、儲能等應用領域具備相當發展潛力。

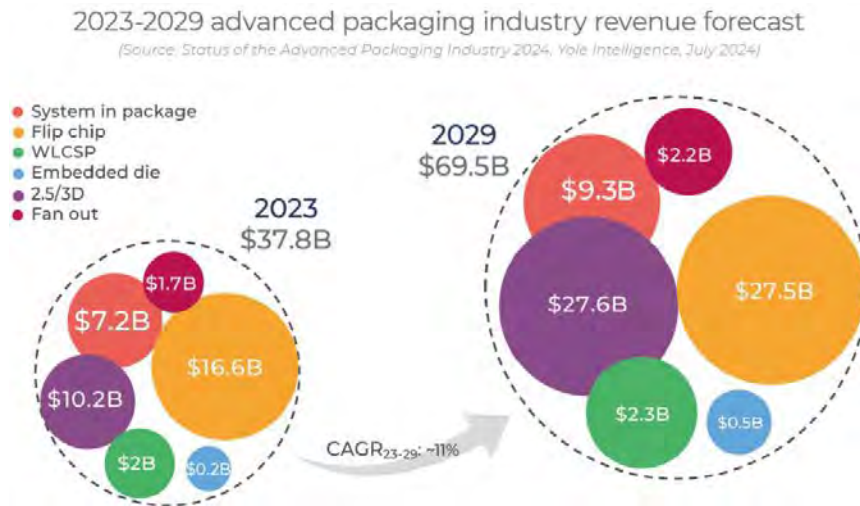
市場研究公司國際數據公司(IDC)2024 年 12 月最新發布的《全球半導體供應鏈追蹤情報》報告顯示全球對 AI 和高效能運算(HPC)的需求將繼續上升，2025 年全球半導體市場預估將增長超過 15%，記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI 加速器(AI Accelerator)需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 年下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。這意味著儘管整體半導體產業將持續擴展，但其增長重點將集中在高附加價值的技術領域，特別是記憶體和邏輯產品在未來的發展中將扮演更為關鍵的角色。全球半導體市場正逐步向先進技術轉型，未來幾年將進一步鞏固其在全球科技產業中的核心地位。

(2) 先進封裝產業

先進封裝(Advanced Packaging)是將多個半導體晶片或器件整合到單一封裝中，與傳統封裝技術僅封裝單一晶片有所區別，並藉此提高系統性能、縮小體積、降低功耗、提升整合度。先進封裝技術可以透過在三個維度中排列多個晶

片，並在晶片之間與過渡的積體電路中直接建立連接，以消除摩爾定律之製造瓶頸並降低成本，因此先進封裝技術在半導體產業中扮演著越來越重要的角色，尤其在需要高密度、高性能、高整合度的應用領域，如 AI、高性能運算、高效能通信等。根據 Yole Group 預估，2023 年先進封裝市場規模為 378 億美元，占整體 IC 封裝市場的 44%，但成長速度明顯放緩，預計至 2029 年達到 695 億美元，複合年增長率為 11%(詳見圖一)。

圖一：2023-2029 年先進封裝產值及年增率預估



資料來源：Yole Group，2024 年 7 月

先進封裝市場參與者包括晶圓代工暨 IDM 廠，以及專業封裝測試(OSAT)廠商。台積電、英特爾、三星等領先晶圓廠投入巨資研發先進封裝技術(如台積電的 CoWoS、英特爾 Foveros 等)，大幅擴充先進封裝產能以承接 HPC/AI 訂單。同時，全球封裝代工產能主要集中於少數 OSAT 龍頭：日月光投控(ASE)為全球最大封測服務供應商，艾克爾(Amkor)與矽品(SPII)分列第二、三位，前三大廠合計市占率約 40%。這些龍頭廠商憑藉晶圓級封裝(WLP)、覆晶封裝(Flip-Chip)等先進製程的佈局，營收增速持續領先業界平均。展望未來，各大廠無不將先進封裝視為兵家必爭之地，積極擴產佈局以保持技術與產能領先

2023 年，全球先進封裝市場面臨挑戰，主要是受到消費性電子需求減弱的影響，包括智慧型手機、個人電腦與伺服器領等領域。根據 TechInsights 的分析，2023 年先進封裝市場收入下滑了 16.3%，為近年來最大跌幅之一。歷經 2023 年庫存調整，隨著終端市場復甦，以及 AI 裝置與資料中心對高效能與高輸出入能力的需求增加，2024 年先進封裝市場規模成長 3.7%。展望 2025 年，由於來自 AI 裝置與資料中心對高效能封裝解決方案的需求增加，TechInsights 預測先進封裝市場將增長 19.2%。Yole Group 亦預估，2025 年先進封裝市場規模將達到約 475 億美元，持續擴大在整體封裝市場的占比並達到 51.03%。

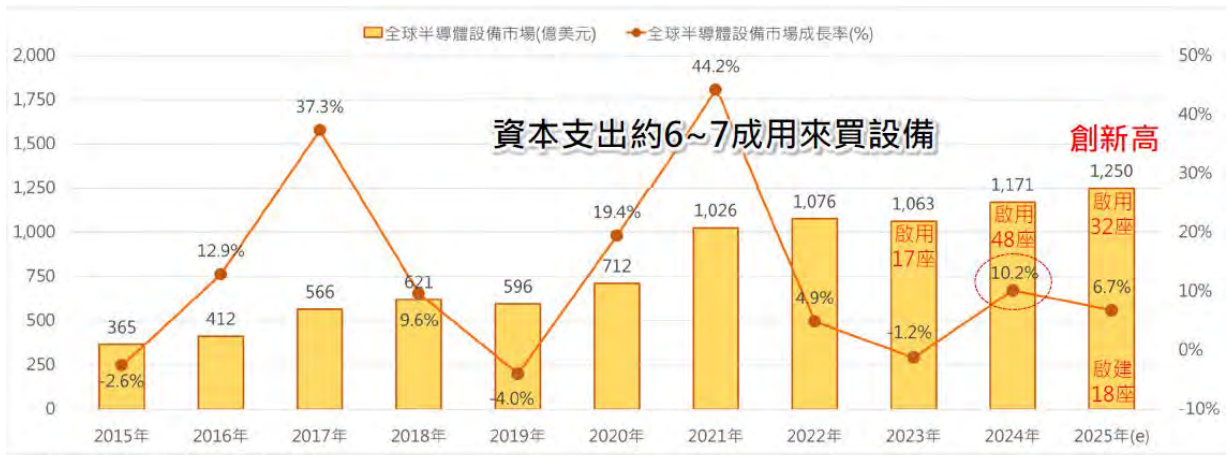
該公司聚焦於先進封裝所需的電漿乾式製程設備，並應用於 Hybrid Bonding、FOPLP 等先進封裝製程。根據 Yole Group 報告顯示(詳見圖一)，由於 AI、HPC、

資料中心、感測器和行動裝置等領域需求提升，2.5D/3D 封裝技術(Hybrid Bonding 之應用)的市場規模預計從 2023 年的 102 億美元增至 2029 年的 276 億美元。此外，扇外型封裝(Fan-Out)技術的市場規模也將從 2023 年 17 億美元增至 2029 年 22 億美元。顯示該公司產品之應用具有極大潛力。

(3)半導體設備

根據國際半導體產業協會(SEMI)公布之全球晶圓廠預測報告指出，2024 年全球半導體製造設備銷售額達 1171 億美元，成長 10.2%(詳見圖二)，主要是受惠先進製程、成熟製程、先進封裝和高頻寬記憶體(HBM)擴產，以及中國大幅增加投資，2024 年前段半導體設備市場顯著成長，晶圓製程設備銷售額增長 9%，其他前段設備成長 5%。後段設備部分，在人工智慧和 HBM 製造日趨複雜，以及需求不斷增加推升下，2024 年後段設備銷售額強勁成長，封裝設備增長 25%，測試設備增長 20%。從地區來看，中國、韓國和台灣仍是半導體設備支出前三大市場，合計占全球市場達 74%。中國產能積極擴張，加上政府強化晶片國內生產的各式計畫齊發，投資額達 496 億美元，較去年同比增長 35%，穩居半導體設備市場領先地位；第二大市場韓國的設備支出則因記憶體市場趨於穩定以及高頻寬記憶體需求飆升，小幅成長 3%，來到 205 億美元。相較之下，台灣設備銷售額受到新產能需求放緩影響，由 2023 年之 196 億美元下滑 16%至 2024 年之 166 億美元(詳見表一)。

圖二：全球半導體設備市場



資料來源：SEMI · MIC整理 · 2025年5月

表一：各地區半導體設備市場規模比較

單位：十億美元

Region	2024	2023	(YoY) %
China	\$49.55	\$36.60	35%
Korea	\$20.47	\$19.94	3%
Taiwan	\$16.56	\$19.62	-16%
North America	\$13.69	\$12.05	14%
Japan	\$7.83	\$7.93	-1%
Europe	\$4.85	\$6.46	-25%
Rest of the World	\$4.19	\$3.65	15%
Total	\$117.14	\$106.25	10%

資料來源：SEMI 及 SEAJ；2025 年 4 月

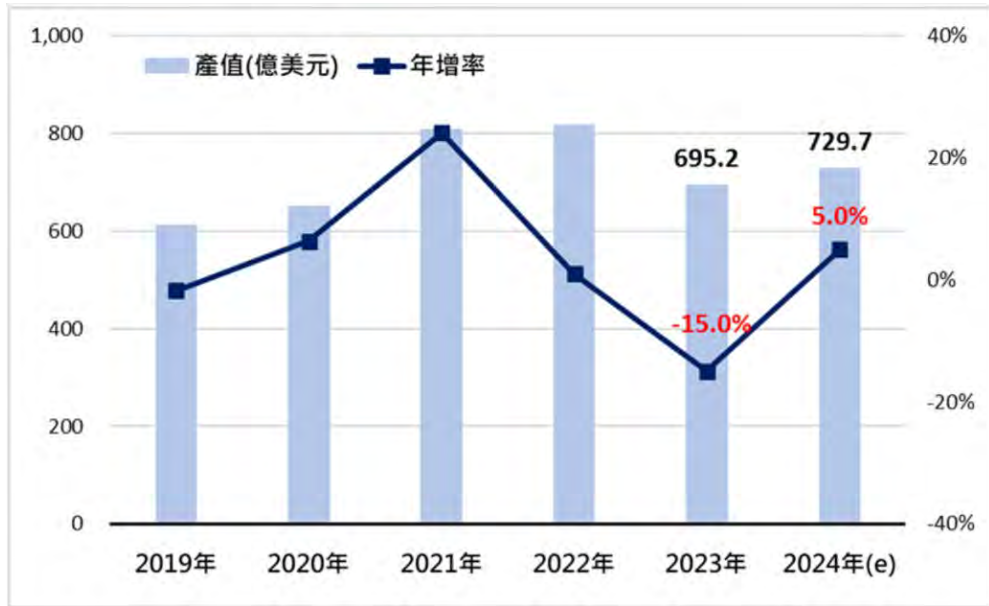
展望 2025 年，SEMI 預估晶圓廠設備支出將達 1,250 億美元，成長 6.7%，主要是因邏輯微元件(Logic & Micro)類別在 2 奈米製程和晶背供電技術(Backside Power Delivery Technology)等先進技術投資推波助瀾下，成為晶圓廠投資成長的關鍵驅動力。從地區來看，中國仍穩居全球半導體設備支出龍頭，然 2025 年總值為 380 億美元，較 2024 年總值 500 億美元下降 24%，台灣則為了滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求，晶片廠持續加強先進技術及先進製程推進，2025 年晶圓廠設備支出預估將達 210 億美元，較 2024 年總值 166 億美元成長 26.51%。

2.PCB 產業及設備

(1)PCB 產業

2022 年下半年以來，全球終端電子產品市場需求轉趨下滑，促使印刷電路板等電子零組件廠商開始進入庫存調整階段。2023 年面對終端消費意願疲弱，衝擊智慧手機、個人電腦等應用領域需求，IC 載板市場供需轉而呈現供過於求，車用板價格競爭加劇，故 2023 年全球 PCB 產業產值為 695.2 億美元，降至疫情前的水準，並較 2022 年衰退 15.0%(詳見圖三)。就 2023 年各項 PCB 產品產值表現觀之，IC 載板因 ABF 載板市場供需出現明顯反轉，產值年減幅度近三成，表現最為弱勢，軟板、硬板因智慧手機、個人電腦應用需求下滑、車用板價格競爭加劇，產值年減幅度相對較大；HDI 板雖受手機應用需求走弱，產值呈現衰退，但因車用需求相對具有支撐，AI 伺服器應用漸趨浮現，產值衰退幅度相對緩和。

圖三：全球 PCB 產業產值及年增率走勢



資料來源：Prismark、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2024 年 8 月

2024 年有鑑於消費應用回補庫存需求漸趨浮現，且汽車電子、AI 伺服器、AI PC 及低軌衛星等新興應用需求轉趨增溫，帶動 2024 年全球 PCB 產業產值止跌回升，根據國際研究機構 Prismark 的估計，2024 年全球 PCB 產業產值緩步回升至 729.7 億美元，較 2023 年成長 5%(詳見圖三)；其中 HDI 板、多層板因車用、AI 應用及衛星應用需求增溫，估計 2024 年產值成長力道相對強勁；軟板及 IC 載板因手機復甦力道相對有限、市場供需仍未能回到平衡狀態，產值僅能呈現微幅反彈。

展望 2025 年，受惠於全球電動車市場規模持續成長、生成式 AI 應用風潮席捲全球，導入範圍逐步由伺服器、交換器等資料中心基礎設施設備逐步延伸至 AI 手機、AI PC 等消費性終端裝置，加上網通設備應用需求漸趨回溫、美系廠商持續投入低軌衛星的部署下，有望推升 2025 年全球 PCB 產業需求明顯增溫。Prismark 估計 2025 年全球 PCB 產值預估年增 6.2%，其中 HDI 與 IC 載板的年複合成長率將達 7.6%，顯示產品需求持續增長。產業趨勢方面，Intel 與 AMD 將推出新一代平台—Birch Stream 與 Turin，預計於 2025 年上半年進入小量生產，下半年實現量產。屆時，CCL 等級將升級至 M7，板層數進一步提升至 20 層以上，帶來 PCB 產業的全面換代升級，將不僅滿足新一代伺服器的高效能需求，亦將顯著提升相關供應鏈廠商的產品價值與市場競爭力。

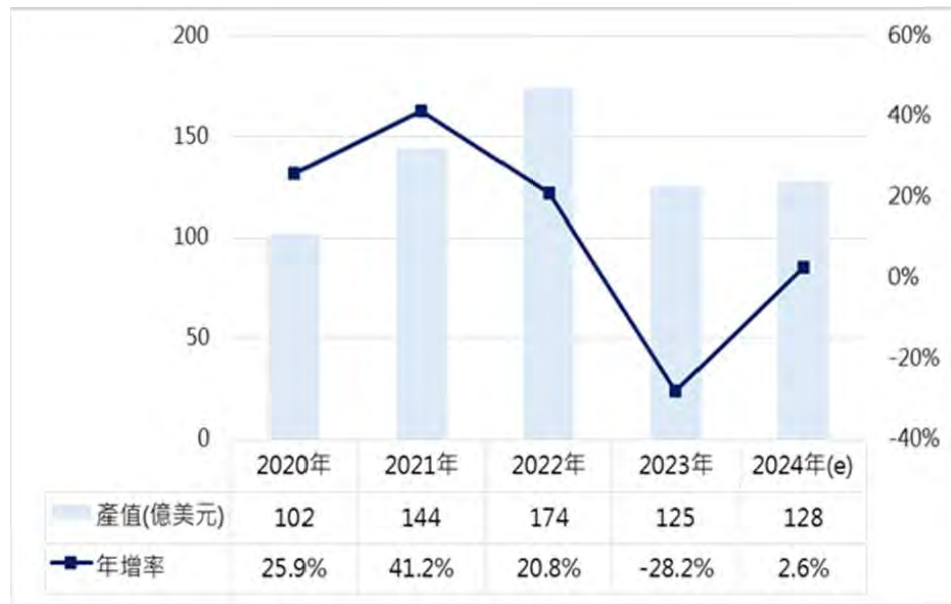
就我國 PCB 業在台灣境內生產之各細項產品銷售值變化趨勢分析，我國 PCB 製造業主要可區分為上游的銅箔基板，中游的印刷電路板、IC 載板，以及下游的印刷電路板加工，其中印刷電路板可進一步區分為多層板、軟板、高密度互連板(HDI)等產品，主要應用產品包括智慧型手機、筆記型電腦、汽車、穿戴式裝置、伺服器等產品，其中 HDI 受到 ADAS 自駕系統與高速傳輸 HPC 需求帶動占比漸增，而 IC 載板則應用於 CPU、GPU、記憶體、MCU 等，主要可

作為半導體封裝測試的上游零件組件，故我國 PCB 業銷售值比重主要以印刷電路板及 IC 載板占最大宗，根據台灣經濟研究院產經資料庫資料顯示，2024 前三季分別達 53.48%及 29.28%，囊括八成以上的銷售市場。

綜觀 IC 載板的產品與應用，目前材質以 ABF、BT 為大宗，BT 主要用在記憶體、手機等，ABF 則是應用在客製化 IC(ASIC)、顯示卡(GPU)、中央處理器(CPU)、大型高端晶片等。觀察全球 IC 載板製造業，由於 HPC、5G、AI、資料中心使 ABF 載板需求激增，IC 載板產業於 2021~2022 年進行大規模擴產與設備投資，然受到通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致 PC、智慧手機等消費性應用需求自 2022 年下半年起明顯走弱，終端客戶進行嚴格的庫存修正，加上台廠新產能陸續開出，使得 IC 載板市場供需出現反轉，轉而呈現供過於求的態勢，而各國央行持續升息、全球經濟景氣成長力道放緩，科技大廠陸續進行裁員，導致企業下修資本支出，促使伺服器、網通設備等需求下修，更進一步衝擊 IC 載板市場需求。2024 年受惠於生成式 AI 風潮席捲全球，主要雲端服務大廠積極導入 AI 伺服器，帶動 AI 伺服器及高頻寬記憶體(HBM)出貨漸趨放量，推升高階載板需求增溫，加上終端庫存去化告一段落，回補庫存需求浮現，加上品牌大廠競相推出 AI 手機有效刺激市場需求復甦，BT 載板出貨表現呈現止跌回升，推升 2024 年全球 IC 載板產值止跌回穩。根據 PrismaMark 的估計，2024 年全球 IC 載板產值緩步回升至 128 億美元，較 2023 年微幅成長 2.6%(詳見圖四)，漸趨走出 2023 年大幅衰退的陰霾。ABF 載板部分，2024 年受到歐美電信商 5G 投資高峰已過，資本支出多聚焦於資料中心相關應用，電信設備投資相對審慎，在庫存難以去化之下，網通應用需求明顯下滑，加上 AIPC 效應並未明顯發酵，PC 應用需求仍顯疲弱，以致 ABF 載板市場仍持續面臨供過於求的挑戰，進而使得全球 IC 載板產值雖重回成長軌道，但復甦力道相對有限。

然有鑑於生成式 AI 風潮席捲全球，GPU 效能不斷提升，引領 AI 伺服器逐步崛起，且 AI 應用逐步由伺服器延伸至高階交換器、AIPC、AI 手機等。為滿足高階運算需求，驅使小晶片(Chiplet)、先進封裝需求隨之攀高，使得高階 ABF 載板面積放大至 120mmx140mm，層數提升至 28 層以上，朝向大面積、多層數、細線路方向發展，顯見 ABF 載板生產難度明顯提高，在半導體先進製程中扮演的角色更顯重要，因而吸引 Ibiden、SEMCO、臻鼎、欣興、南電等國內外 IC 載板廠商積極搶進，爭取高階 ABF 載板市場商機。展望 2025 年，受惠於各國積極鼓勵 AI 資料中心的建置，帶動 Nvidia 旗下 GPU 出貨持續增溫，加上 AWS、Microsoft、Meta 及 Google 等美系雲端服務大廠持續投入自研 ASIC 的開發，資料中心加速導入 800G 交換器，均有助於推升高階 ABF 載板需求的持續增溫。

圖四：全球 IC 載板產值及年增率走勢



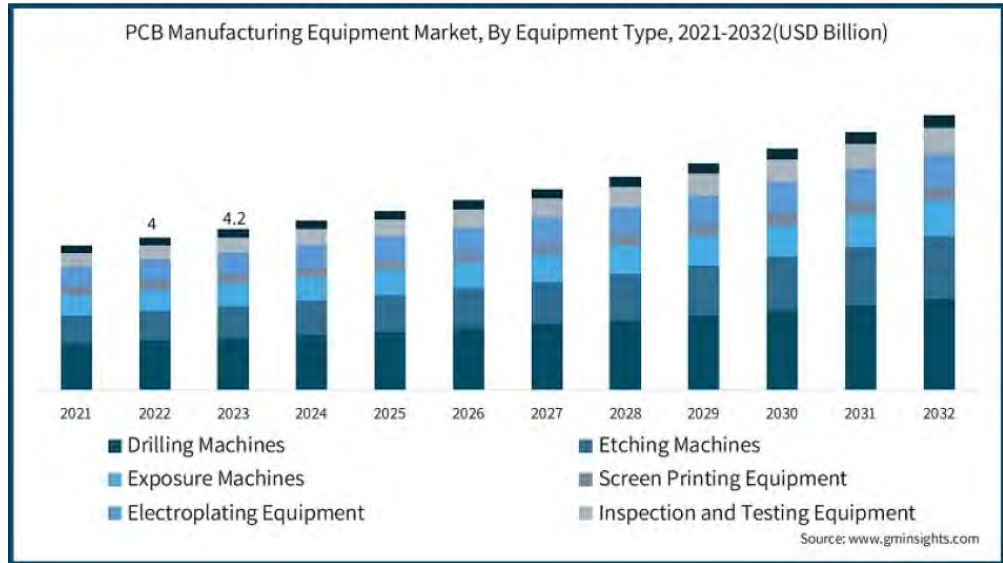
資料來源：Prismark(2024.09)、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2025年1月

(2)PCB 設備

隨著電子產品日益輕薄短小與功能複雜化，PCB 產業持續升級轉型，帶動 PCB 設備市場穩定成長。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球 PCB 設備市場規模在 2024 年達 42 億美元，預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算(HPC)、電動車(EV)及先進封裝等新興應用領域。

PCB 設備依製程階段可大致分為鑽孔機、蝕刻機、曝光機、電鍍與化學處理設備、AOI 光學檢測系統、自動化搬運設備(如上下板機、輸送帶)等。近年來，以雷射鑽孔機、蝕刻機及 LDI(Laser Direct Imaging)曝光機為代表的高階設備需求快速上升(詳見圖五)，特別是在 HDI、載板(IC Substrate)、類載板(SLP)等製程中扮演關鍵角色。其中蝕刻機為 PCB 製造過程中關鍵的核心設備之一，無論是傳統多層板製程或先進 IC 載板製程，皆高度依賴濕式與乾式蝕刻設備來精準移除導體層，形成精細電路圖形。隨著線寬微縮與高密度需求提升，蝕刻設備的自動化、均勻性控制與化學品管理能力成為投資重點。蝕刻設備廠商持續投入模組化蝕刻線與智慧製造技術，提升良率與產能效率，未來占比預期仍將維持高位。

圖五：各類 PCB 製造設備市場規模



資料來源：Global Market Insights，2024 年 11 月。

未來，隨著 ABF 載板產能擴張、AI 伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階 PCB 設備的投資比重。設備商亦積極導入自動化、數位監控與智慧製造技術，提升產能效率並強化良率控管。整體而言，PCB 設備市場正逐步由傳統標準機種轉向客製化與智能化發展，產業競爭力與技術門檻同步升高。

我國 IC 載板產業於 2021~2022 年進行大規模擴產與設備投資，自 2022 年下半年起受到全球通膨高漲衝擊終端消費意願、宅經濟效應明顯退燒，以致 PC、智慧手機等消費性應用需求明顯走弱，呈現供過於求的態勢，導致企業下修資本支出。根據台灣印刷電路板協會(PCA)統計，我國 2023 年 PCB 設備產值為 560 億元，較 2022 年減少 16.8%。來到 2024 年，隨著 AI 應用之 PCB 製程設備對高層與高密度之需求提升，2024 年台灣 PCB 設備產值規模達 595 億元，年成長 6.3%，有谷底復甦之態。展望 2025 年，在高階製程與東南亞新產能陸續量產推動下，2025 年我國 PCB 設備產值預估為新台幣 639 億元，年成長率達 7.4%，我國 PCB 設備業預計將持續擴張。

3. 電漿設備

電漿由於其高能高溫、導電性佳、電磁可控性、化學活性及輻射之特性，因此在各項領域應用廣泛，然而由於電漿設備通常對於真空環境、電源供應穩定性要求高，導致設備成本造價昂貴，企業若未具一定資本門檻將難以大量採用，而隨著科技技術的進步，以及受電子、醫療保健和製造等行業對先進材料日益增長的需求推動，電漿技術廣泛的應用潛力逐步受到重視，全球電漿設備市場預計將逐步成長。根據研調機構 VMR(Verified market Report)指出，2024 年電漿設備市場規模達 45 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 5.5%的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 72 億美元。

依照各應用領域區分，根據 VMR 報告指出 2023 年電漿設備市場應用中，工業領域占比 50%，商業占比 30%、住宅占比 15%，其他應用占比 5%。其中工業領域涵蓋半導體、汽車、航空航太等工業科技產業。工業領域中，智慧型設備和自動化的興起進一步刺激了對電漿設備的需求。電漿技術的創新提高了電子設備所用組件的性能和效率，使製造商能夠生產出更小、更強大的設備。電漿處理製程是這一領域的關鍵，它可以改善材料的表面特性，確保更好的附著力、潤濕性和產品的整體性能。這項工藝在汽車、航空航太和包裝等各行業中都不可或缺。根據 VMR 報告，由於電子、航空航太、汽車和醫療保健等各行各業對高精度清潔解決方案的需求不斷增長，電漿表面處理設備於 2024 年市場規模為 12 億美元，預計 2026 年至 2033 年將以 9.2% 的複合年增長率成長，到 2033 年將達到 25 億美元。

電漿技術的跨產業應用在電漿表面處理市場方面發揮重要的作用。在電子產業，電漿表面處理設備對於在組件組裝前去除基材上的污染物，以確保其可靠性能。在汽車行業，塗層和黏合過程之前，電漿可用於表面處理。在醫療保健領域，電漿表面處理設備用於準備手術器械和醫療器械，以確保無菌性和病患安全，在紡織業，低溫電漿在處理防護衣和無菌材料的親水化過程中發揮重要作用，有助於減少微生物。若按設備類型劃分，市場份額最大的是電漿蝕刻設備，約占 45%，其次是電漿改質清洗設備占 35%，電漿沉積濺鍍設備占 20%，其中電漿蝕刻及電漿改質清洗設備為半導體及 PCB 產業最為關鍵重要的製程之一，且由於晶片製造技術的進步，需要更為精密的表面處理技術，使半導體產業占有電漿表面處理設備市場的最大份額，占比約為 40%。

然而，由於電漿表面處理設備在輕量化材料和電動車零件中的應用日益增多，預計汽車產業將以最快的速度成長，2023 年至 2030 年的複合年增長率將達到 9%。此外，醫療保健產業在滅菌和醫療器材製造中對電漿技術的日益依賴，也推動了市場的成長，低溫電漿(cold plasma)由於能消滅細菌，尤其是抗藥性菌株，使得電漿成為有助於預防感染疾病和治療慢性傷口的解決方案。近年，隨著各行各業持續專注於永續發展，電漿表面處理製程提供比傳統清洗方法更環保的替代方案，可最大限度地減少浪費和有害化學品的使用，電漿技術更已擴展至新能源、綠色科技與環保應用，例如在氫能產業中，低溫電漿被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。為了遵守嚴格的行業法規和標準，越來越多的企業採用電漿表面處理解決方案，以確保最佳的表面處理和附著力，從而降低產品故障相關的風險，電漿表面處理設備市場需求及應用未來將更為廣泛。

(二)所屬行業營運風險

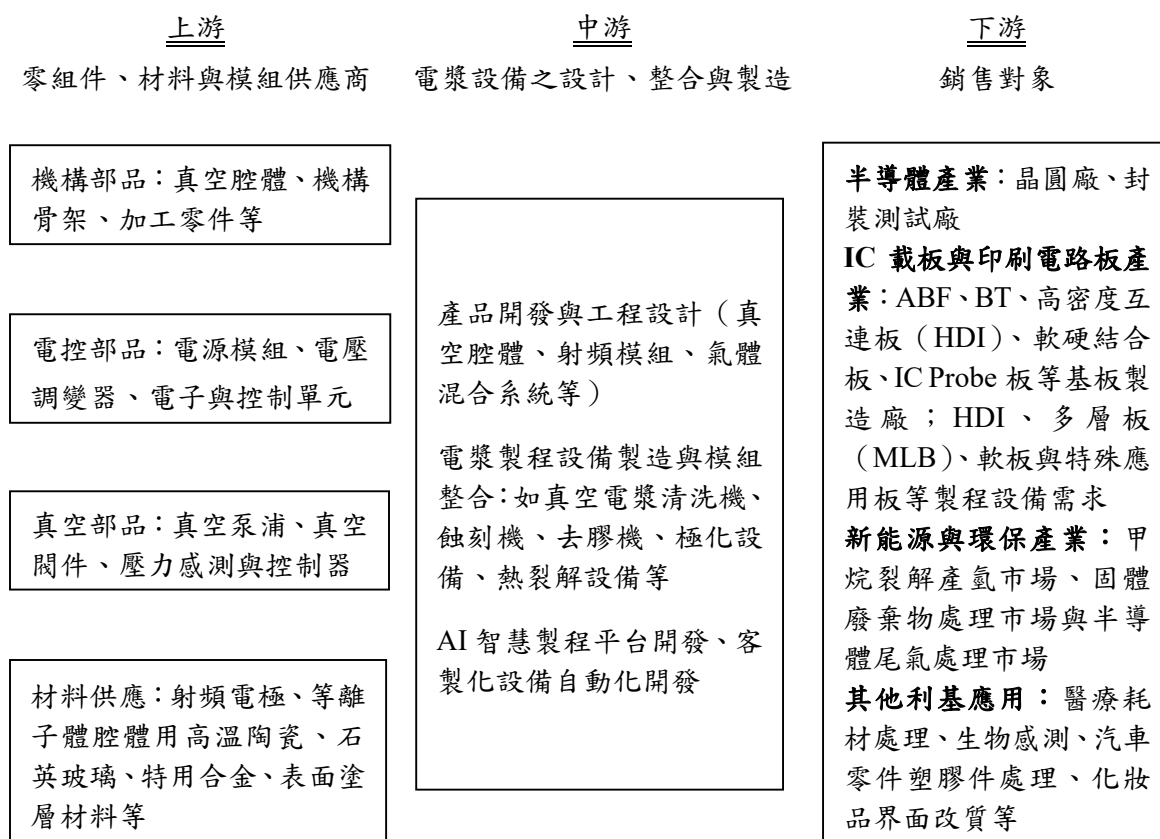
1. 景氣循環之營運風險

該公司業務係多以應用於半導體晶圓封測產業及 PCB(IC 載板)產業之電漿設備之研發、製造與銷售為主，所生產之電漿設備主係銷售予國內外半導體廠商與 PCB 製造大廠，故該公司業績較易受到半導體產業及 PCB 產業資本支出需求狀況

影響。此外，受到全球通貨膨脹、俄烏戰爭與各國陸續升息等因素影響，消費性產品需求轉為疲弱，造成廠商庫存水位上升，半導體產業及 PCB 產業亦受到總體經濟環境影響而波動。惟該公司持續精進電漿設備應用於半導體封測設備及 PCB 製程設備之技術研發，延伸其產品應用，切入先進封裝及半導體蝕刻製程，加上未來 5G、HPC、AI 等技術發展使得半導體市場及 PCB 市場規模可望持續擴大，將帶動相關資本支出增加，有利於電漿設備出貨增長，且該公司持續開發電漿新應用，切入新能源製氫領域，以降低單一產業景氣影響，故該公司受景氣循環所面臨之營運風險尚屬有限。

2. 行業上、中、下游變化之營運風險

電漿設備之上游為材料供應商，其零組件依據功能別可概分機構部品、電控部品、真空部品及加工部品，其中又以機構部品所占產值較大，包含真空腔體及骨架等，中游則為電漿設備設計、開發、製造及組裝，再銷售至下游半導體晶圓廠、封測廠、PCB 廠、新能源與環保產業及其他產業等，詳細之產業關聯圖如下圖所示：



資料來源：該公司提供

3. 行業未來發展之營運風險

該公司致力於電漿表面處理技術開發及電漿設備製造，其產品應用聚焦半導體先進封裝產業及 PCB 產業，近年亦開發新能源與環保產業應用領域，其電漿設備主要係用於各式製程間所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質。茲就其各應用領域之未來發展趨勢說明如下：

(1)電漿技術應用新領域

電漿技術作為一種先進的材料表面處理與改質工具，廣泛應用於半導體製程、PCB 製程、汽車工業、航太領域以及醫療領域中。隨著全球 ESG 趨勢及綠色產業發展，電漿技術正逐步擴展至新能源、綠色科技與環保應用。例如在氫能產業中，低溫電漿(Cold Plasma)被用於氫氣分解與燃料電池膜處理，提升能源效率；在水處理與空氣淨化領域，電漿可用來分解有機污染物與殺菌消毒。此外，柔性電子、顯示器、可撓式太陽能電池等新興材料與製程對低溫、非破壞性加工技術的需求日益上升，電漿技術的優勢更加明顯。未來隨著設備成本降低與應用技術成熟，電漿有望在更多高附加價值的領域發揮其潛力。

(2)先進製程持續演進

隨著 AI、5G 技術裝置的快速發展，HPC 需求增長推動更高效能及更低功耗的半導體製造技術，隨著摩爾定律在物理限制上瀕臨極限，各大半導體大廠轉向透過先進封裝技術及創新晶片架構等發展，其中先進封裝在一個封裝內整合多種晶片與元件，透過將晶片與其他元件緊密結合，減少互連的距離，從而降低延遲並提高數據傳輸速度和整體性能，為連接 IC 及 PCB 尺度差異的關鍵技術，隨著 2.5D/3D IC 封裝技術、扇外型晶圓級封裝(FOWLP)、扇外型面板級封裝(FOPLP)及 Chiplet 架構快速發展，電漿技術由於其較高的介面附著力、以及可精準控制蝕刻深度與表面改質，將在多晶片整合、先進接合製程與低溫封裝應用中扮演更重要的角色，進一步提升半導體元件的性能與可靠度。根據市場調研機構 YOLE 的報告，先進封裝市場將於未來幾年快速成長，市場規模將由 2023 年 378 億美元至 2029 年達到 695 億美元，複合年增長率為 11%(詳見圖一)。

過往 PCB 及 IC 載板產業在載板封裝過程中對於精度要求較低，乾式製程由於成本高、生產效率較低，業界普遍採用傳統濕製程，隨 AI、5G 熱潮崛起，為滿足高階運算需求，驅使小晶片(Chiplet)、先進封裝需求隨之攀高，使得高階 ABF 載板朝向大面積、多層數、細線路方向發展，必須具備更高密度、更精細線路與更優異的電氣特性才能配合。乾式電漿蝕刻技術相較傳統濕式技術可實現高度精確的蝕刻，可以在微米和奈米尺度上創建結構和圖案，提高訊號線寬及線距之精度，並支援微細圖形製程，逐漸為 IC 載板廠所採用；PCB 產業在邁向高階 HDI/mSAP 板領域所用電路需要非常細小的微盲孔，化學液體難以完全清洗，常造成殘膠與污染，乾式去膠渣由於可深入孔洞清潔，因此乾式製程亦逐漸被導入，因此在製程技術不斷提升下，各廠商對於電漿技術設備需求將持續增加。

(3)新產品應用需求旺盛

新產品應用需求正以空前速度成長，受惠於技術變革與市場需求的強力驅動。隨著智慧型手機持續向 5G 普及化邁進，未來 6G 與 7G 技術將進一步推動手機功能與電池效能的升級，並結合人工智慧應用服務，帶動智慧型手機市場

發展。同時，物聯網應用日益多元，從穿戴式裝置、醫療監測到智慧家庭與智慧城市等領域需求持續增加。電動車市場快速擴展，加上先進駕駛輔助系統(ADAS)與車用電子系統升級，使每輛車子半導體用量大幅攀升。這些新興應用皆需仰賴高效能半導體產品，亦推動高階 IC 載板需求持續成長。未來在高速運算、人工智慧及電動車等應用推動下，半導體及 IC 載板製程技術將持續升級，並為相關設備與材料供應商創造龐大商機。

4. 產品可替代性之營運風險

電漿技術於現代工業應用極廣，尤其在半導體產業及 PCB 產業中扮演關鍵角色，其主要應用於表面處理、清潔、蝕刻及薄膜沉積等製程，與傳統的濕式技術相比，電漿技術具備環保無污染、高精度控制、低溫製程及材料選擇性高等特點，由於全球 ESG 趨勢發展下各國政府訂立日趨嚴格的環保政策，電漿技術逐漸成為製程首選。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，半導體為追求元件積集密度並降低功耗而不斷微縮，相關製程技術之規格亦愈來愈高，在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢下，乾式電漿蝕刻技術相較濕式技術可實現高度精確的蝕刻，可以在微米和奈米尺度上創建結構和圖案，因此逐漸成為半導體廠首選。在未來 AI、5G 技術、物聯網(IoT)、電動車、高效能運算(HPC)及新能源等新興技術蓬勃發展，以及 ESG 潮流帶動下，電漿技術應用將更為廣泛，其相關產品尚無被替代之風險。

二、發行人競爭地位及營運風險

(一) 競爭地位

該公司為生產各式電漿設備之專業廠商，主要應用於半導體先進封裝、IC 載板、及 PCB 等電子產業，目前國內的競爭者有志聖、友威科、鈦昇及旭鼎等，國外則是有韓商 Jesagi Hankook Ltd、美商 Nordson March 及日商日新離子機械株式會社、中國商珠海寶豐堂半導體(股)公司。依研調機構 VMR 報告，2024 年全球電漿蝕刻及電漿改質清洗設備市場規模達 9.6 億美元，根據美國國家稅務局(IRS)公布 2024 年平均匯率 32.117 換算為新台幣 308 億元，該公司 2024 年電漿設備銷售金額為 4.9 億元，在全球市場的市占率約為 1.59%，整體而言仍有極大的成長空間。

(二) 發行人之營運風險

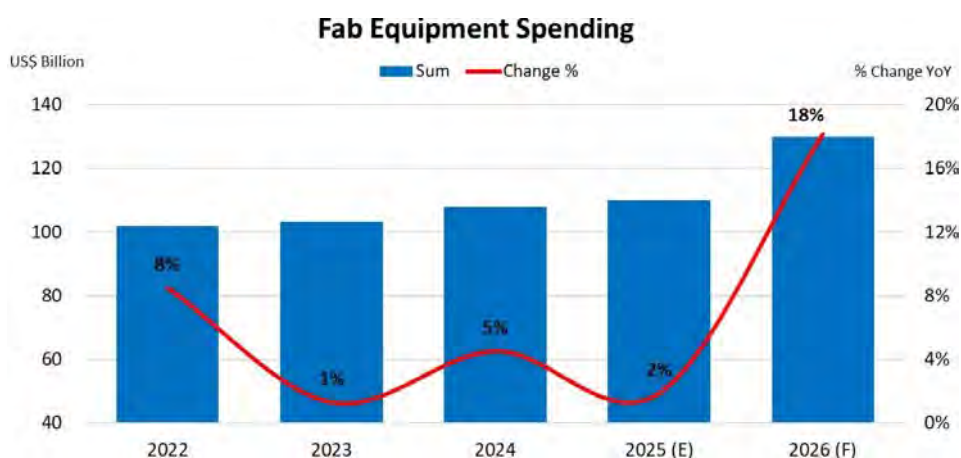
1. 市場未來供需變化情形

(1) 半導體產業

該公司成立以來，半導體產業以後段封裝應用客戶為市場開發重點，近年來亦開發多款電漿蝕刻設備，逐漸將版圖擴展至半導體前段晶圓廠客戶。乾式電漿蝕刻技術於半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，相關製程技術之規格亦愈來愈高，隨著半導體廠商競爭先進製程研發，也使製程所需設備成為大廠擴建產能的產業發展關鍵。根據國際半導體

產業協會(SEMI)統計(詳見圖六),由於高效能運算(HPC)和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動,更受惠於 AI 人工智慧整合度不斷提高,從而讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升,全球用於前端設施晶圓廠設備支出預估將在 2025 年成長 2%至 1,100 億美元,2026 年更將一舉成長至 1,300 億美元,成長 18%。我國方面則受惠於高效能運算(HPC)應用帶動先進製程節點推進擴張和記憶體市場復甦,設備支出預計將從 2024 年的 166 億美元增加到 2025 年的 210 億美元,2026 年更再增加至 245 億美元,因此在全球半導體業者資本支出增加下,以及國內業者競爭力提升下,預計 2025 年我國半導體生產用設備及零組件業的銷售值可望上揚。

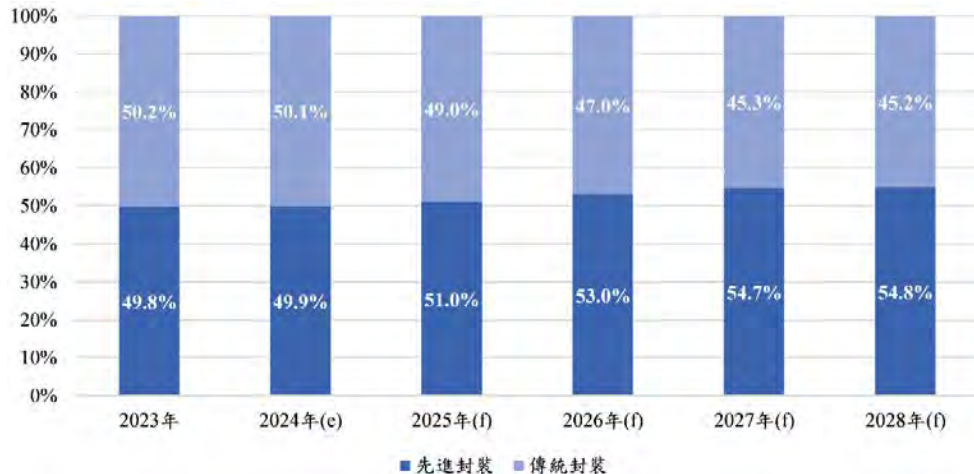
圖六：全球晶圓廠設備支出及成長率預估



資料來源：SEMI，2025 年 3 月

半導體封裝方面,受惠於 AI、智慧汽車、5G 通訊等技術的發展,使得終端客戶對於高效能、低功耗晶片需求增加,進而帶動先進封裝需求顯著成長,根據工研院產科國際所估計,2025 年先進封裝市場規模比重將超過傳統封裝,達 51.0%,且比重將逐年增加(詳見圖七),為了因應龐大需求,世界主要晶圓代工廠和封測廠正共同加速先進封裝技術的投資,晶圓龍頭大廠台積電宣布 2025 年資本支出達 380~420 億,其中 10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。國內封測大廠日月光及力成等亦紛紛投入 2.5D、3D、FOPLP 等封裝技術,國外封測廠 Amkor 則預計 2025 年資本支出約 8.5 億美元,其中 70%用於擴展 2.5D、SiP、RDL 等先進封裝技術,顯示該技術趨勢明確,半導體封測業者普遍加大 2025 年對先進封裝技術的投資。該公司所開發之電漿清洗設備及電漿蝕刻設備可應用於先進封裝基板之表面處理,隨著先進封裝市場持續擴大,對於公司業績可望帶來助益。

圖七：全球半導體封裝市場規模比重分布概況



資料來源:工研院產科國際所，台經院產經資料庫整理，2024年10月

(2)PCB 產業

該公司提供 PCB 製程的電漿表面處理與微蝕刻設備，並且針對 ABF 載板製造開發了全乾式電漿處理技術，包括電漿清洗設備、電漿鑽孔設備及電漿蝕刻設備。為了因應地緣政治的趨勢，大多數的 PCB 廠都已赴東南亞建廠，部分新廠已在 2024 年完工，2025 年進入設備導入的支出高峰期，新產能的貢獻在上半年陸續驗證後，下半年可望加入量產行列。PCB 廠龍頭臻鼎泰國新廠第一期將於 2025 年試產，同時第二期廠房也將動土，再加上高雄 AI 園區及中國廠區再擴充，2025 年估資本支出達約 250 億元。PCB 廠高技為迎合快速增長的急單需求和長期訂單積極擴充產能，預計 2025 年資本支出約 10 億元，較 2024 年大幅增加三倍以上。IC 載板廠方面，由於 2019-2022 年的大幅度擴廠，2025 年載板市場雖會自谷底回溫，但仍未完全復甦，包括欣興、南電、景碩資本支出都會較 2024 年減少，但以欣興來說，2025 年資本支出仍有 186 億元的水準，載板約占 45%。

展望未來，隨著 ABF 載板產能擴張、AI 伺服器需求激增與電動車電子化程度提高，將進一步推升高階 PCB 設備的投資比重。根據 Global Market Insights 資料顯示，全球 PCB 設備市場規模在 2024 年達 42 億美元，預計在 2024 至 2032 年複合增長率為 6.2%。成長動能主要來自 5G 通訊、高效運算(HPC)、電動車(EV)及先進封裝等新興應用領域傳統。該公司專注於高階 IC 載板及 HDI 板之設備應用，未來市場需求仍然可期。

2.影響發行公司未來發展之有利與不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

A.產品微細化

電漿解決方案為微米級，乃至於奈米級的乾式環保處理方式，隨著電子產品日趨精細，傳統濕式(酸液或鹼液)處理方式已逐漸無法因應，以印刷電路

板產業為例，盲埋孔孔徑日漸縮小，酸液或鹼液進入孔內難度增高，因而無法完全將孔內膠渣清除乾淨。電漿係採用原子級的離子或自由基來進行膠渣的處理，因此電漿製程可以處理極小孔徑，引進電漿製程有其必要性。該公司為專業電漿技術及設備開發製造商，具有領先之電漿製程技術，先進製程產品為提高效能而走向奈米級，將可望持續提升電漿製程的重要性。

B. 半導體及先進封裝產業持續成長

受AI、高效運算(HPC)、5G、自駕車、物聯網(IoT)等應用驅動，全球半導體產值持續增長，在製程技術講究高效率及低能耗趨勢下，先進封裝技術需求擴大，該公司之產品如高效能電漿去膠渣機、晶圓清洗蝕刻機、極化處理模組等已具多國客戶導入實績，提前為下一代先進製程提供關鍵解決方案，隨著FOPLP、FOWLPL、CoWoS、Hybrid Bonding、晶圓再生、Chiplet結構等先進封裝技術逐步導入量產，對乾式表面處理的需求持續上升。因此，即便全球總體經濟仍存在不確定性，隨著人類文明持續追求高度智慧化及便利性的科技產品，將提供半導體產業更大的商機及成長機會。

C. 環保要求日益嚴格，電漿製程符合ESG趨勢

隨著各國政府日趨嚴格的環保政策，傳統濕式處理方式面臨廢液處理、化學品大量消耗、高能耗、佔地及人力需求大的不良因素，電漿處理方式是低能耗的製程方案，例如IC載板大廠目前針對ABF載板蝕刻係採乾溼製程並行，惟該公司針對ABF載板開發了全乾式電漿處理技術，可提升蝕刻速率，並可精確控制表面粗糙度，可有效降低能耗，減少了傳統化學濕製程對環境與良率的負面影響，因此未來IC載板廠採用全乾式電漿處理市場潛力龐大。除了降低能源損耗及碳排放外，該公司自研之高效電漿火焰處理設備可應用於甲烷裂解產氫與PFC廢氣分解、醫療/工業廢棄物即時裂解等領域，可用來進行除碳創造乾淨能源，因此乾淨的乾式電漿處理方式可提供更環保的解決方案。因此，全球的節能減碳趨勢成為企業供應鏈選擇的重要指標，由於綠色製造與低碳技術需求增加，電漿應用有機會成為關鍵方案，將有助於該公司取得國際大廠的供應鏈機會。

D. 工業4.0及生產監控需求

全球企業和供應鏈因應產品精細化避免污染特性、生產有效管理、節能減碳及降低人力等需求，客戶逐漸重視工業4.0及生產監控的引進。該公司10多年前已進行生產監控標準的軟、硬體開發，可望迅速地滿足客戶關於生產監控的需求，並提高新的競爭者的跨入門檻。

E. 各國半導體供應鏈在地化

半導體現今已成為重要戰略物資，各國紛紛推動晶片生產在地化，美國2022年推出規模達527億美元的晶片與科學法案(Chips and Science Act)，其中390億美元將用於補助興建半導體廠房及購置設備，132億美元用於先進製程

的研發與人才培訓；歐盟則於2022年通過規模430億歐元的歐盟晶片法案(European Chips Act)，將用於半導體製程研發與建廠補貼；日本政府修訂了其半導體戰略，目標是到2030年，將國內生產的半導體銷售額增加兩倍至15兆日元以上，將晶片置於其經濟安全政策的核心位置；中國政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高10年免稅，全力推升成熟製程晶片市場的發展。因此在各國強力發展半導體產業下，對於半導體設備需求日漸升高，將對半導體設備廠商增添營運成長動能。

(2)不利因素

A.人才取得及留任

該公司位於台南產業園區，鄰近南部科學園區、安平工業區、永康工業區，近年國際大型科技企業大舉進駐台南，人才招募競爭激烈，公司之規模及品牌不及該區域其他大型企業與國際大廠，導致優秀的技術或專業人員在招募上增加了困難度，故人才之取得及留任為公司挑戰及努力的方向。

因應對策：

該公司推行人性化管理制度，致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度，強調職場間關係與互信，工作環境溫暖及重視合作和團隊精神之企業經營理念。另外提供具市場競爭力之薪酬待遇與完善的福利制度，並結合員工認股等激勵制度，提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對公司的認可與向心力，以降低員工流動率。公司正積極申請股票上市、擴大公司知名度以吸引優秀人才。

B.客戶對國產設備信心不足

國內半導體客戶過去習慣使用進口設備，對國產設備的信心度有待加強，對成熟製程更換設備的動機不足，對先進製程使用國產設備的信心不足，需要時間跟使用經驗逐步轉變觀念。

因應對策：

該公司在累積多年半導體設備經驗後，已自行研發出先進封裝感應耦合電漿蝕刻設備、自動化線上電漿製程系統及電漿晶圓清潔設備等設備，且生產過程中大多使用國內生產之原物料，供貨短缺或中斷的風險較低。該公司之設備，已成功打入各產業的標竿企業，建立市場形象及客戶信心，未來以標竿企業的口碑來進行業務推廣，將可進一步打開市占率。

C.營運易受半導體市場景氣波動影響，且半導體供應鏈將從過去全球化分工，走向區域化

該公司主要業務為各式電漿設備之研發設計、製造與銷售，主要服務對

象為半導體上中下游之供應鏈廠商，因此該公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響；另地緣政治風險使得全球半導體業未來將從全球化分工走向區域化，供應鏈在地化將是未來半導體產業發展之趨勢，而臺灣產業大廠應各國邀請前往當地設廠，各大廠資本支出可能會分散到海外各廠。

因應對策：

- (A)該公司產品應用領域廣泛，除現有半導體、PCB及光電產業之客戶產品應用外，近期亦開發能源領域及綠色環保產業之應用，並將持續開發客戶產業製程設備產品以擴大產業應用領域，期透過產業及產品之分散，降低半導體產業景氣波動對業績衝擊之影響。
- (B)該公司著眼海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業代理商合作，提供半導體大廠客戶完善的地緣服務，以降低單一區域景氣循環之風險。

3.該公司之競爭利基

(1)研發團隊完整且經驗豐富

該公司目前經營及技術團隊在電漿技術領域已有 20 年以上之產業經驗，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，並充份了解產品製程所需面對之問題，即時提供客戶專業電漿技術解決方案，並建構專業實驗室，配備完整測試設備，全方位支援客戶進行樣品分析與製程研究，對該公司現有產品推廣、新產品開發具有相當助益。

(2)自有先進電漿技術與專利

該公司以自主開發高密度電漿源結構、多階段電場控制系統、真空腔體設計與複雜製程整合，及高度複雜製程整合能力，涵蓋清洗、蝕刻、活化、極化及高溫裂解等應用，導入半導體晶圓、先進封裝、IC 載板、PCB、感測器模組市場，並運用所開發之高效電漿火焰技術進入新能源產業及廢棄物處理等循環經濟領域之創新技術開發，另該公司於 ABF 載板領域開發高均勻、高選擇及高精度之乾式蝕刻製程技術，可處理大面積 850×750mm 載板規格，領先業界 700x700mm 規格，同時亦切入 Hybrid Bonding 及再生晶圓薄膜去除技術，並取得國內大廠採用。該公司各式電漿技術均積極取得相關專利與認證，並取得經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)認可並核定補助，以確保該公司電漿設備與技術領先業界，並持續開發符合市場趨勢之利基市場新產品，避免成熟領域削價競爭。

(3)市場進入門檻高，供應鏈競爭居領先地位

該公司針對產業鏈的上游歐美或日本著名品牌客戶，於產品開發階段即密集進行電漿技術討論、測試、合作與認證，協同客戶共同開發合作取得設備的

各式安規、環保、電氣法規認證，及早進入市場以提高競爭者的進入障礙，且一旦取得認證，客戶為確保製程穩定，亦不易更換供應商，以確保該公司在該產業鏈的銷售地位。

(4)產品組合與跨領域應用

該公司以高密度電漿乾式表面處理製程技術平台為核心，將自主設計的基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空與溫控系統等依需求彈性，搭配結合成為高度可擴展性的設備模組系統，並根據不同應用領域進行模組重組與流程優化。該公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域，同時在半導體先進封裝、IC 載板及 PCB 乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使該公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用該公司電漿設備等實績中，顯示該公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

(三)技術能力、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見佐證

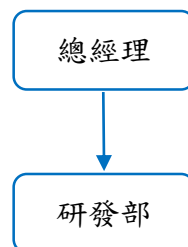
本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就其技術研發能力出具意見或報告，故不適用。

2.研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近期及最近二個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對發行公司之營運風險

(1)研究發展部門之沿革及組織

該公司成立於民國 91 年，專注於半導體與印刷電路板等產業之電漿設備應用開發，向來重視核心技術能力的研發與創新，並積極延攬具專業背景之研發人才。研發團隊由總經理親自領軍，成員涵蓋化學工程、電子工程、材料科學工程等領域之專家，長期深耕於電漿技術應用的研究與創新，並積極拓展新興應用領域。在產品設計與開發方面，研發部門亦與生產部門之電控及機構設計單位密切合作，透過跨部門協同研討，共同推動能靈活匹配客戶製程參數需求之產品開發與技術應用。以下為該公司研發單位之組織架構與主要職掌說明：

A. 研發部門組織圖



資料來源：該公司提供

B.研發單位職掌

部門	工作職掌
研發部	<ul style="list-style-type: none"> ◆新技術與新產品之研發規劃、原型機測試及導入生產製程 ◆協助生產製程及產品品質改進 ◆協助技術發展優化及智慧財產權之申請 ◆針對現行真空型、大氣行電漿設備之效能提升及問題改進

資料來源：該公司提供。

(2)研發人員學歷分佈、平均年資、流動情形及離職率暨評估研發人員離職對該公司之營運風險

單位：人；%

項目		年度	112 年度	113 年度	114 年截至 8 月底
期初人數			9	9	10
本期新進			1	2	4
部門調入			—	—	—
部門調出			—	—	—
本期離職			1	1	4
資遣及退休人員			—	—	—
期末人數			9	10	10
平均服務年資(年)			5.68	6.05	5.68
離職率(%)(註 1)			10.00%	9.09%	28.57%
學歷分佈	博士		2	2	2
	碩士		5	6	6
	大學(專)		2	2	2
	高中職(含)以下		—	—	—

資料來源：該公司提供

註 1：離職率=(離職人數+退休及資遣人數)/(期末人數+離職人數+退休及資遣人數)

註 2：新進、離職及資遣人員不包含試用期未滿即離職者。

該公司致力於各式電漿設備之研發、生產及銷售。該公司 112~113 年底及 114 年截至 8 月底之研發人員分別為 9 人、10 人及 10 人，平均年資則分別為 5.68 年、6.05 年及 5.68 年，研發人員之學歷皆為大學(專)以上，該公司以聘任大學(專)學歷以上之研發人員及具備相關資歷專長人員為主，其中擁有碩博士學歷者更高達八成以上，顯示該公司對於研發部門之發展及研發人員之素質相當重視。

研發人員異動情形部分，112~113 年底及 114 年截至 8 月底離職率分別為 10.00%、9.09%及 28.57%，114 年截至 8 月底離職率提升，主係包括一入職，未達半年即離職之人員，該公司研發離職人員主係因員工個人生涯規劃或家庭因素等原因而自行離職，且人員遞補及訓練上尚無困難，另該公司針對新進研發人員皆要求簽署保密協議，不得以任何方式洩漏予第三人或對外發表，且研發人員在職期間之相關研發成果皆屬該公司所擁有。為避免人員流動造成研發中

斷風險，該公司之研發工作均已建立資料保存管理制度，離職人員需依部門要求進行工作及資料交接，且研發人員離職後之工作皆由適任人選銜接。此外，該公司主要研發主管於具備資深學經歷背景，研發團隊對該公司產品、研究及開發等亦已累積豐富經驗，有利於該公司研發能量之積累與傳承，故研發人員之工作異動尚不致對該公司核心研發能力產生負面影響，對該公司之營運亦無重大影響。

(3)最近期及最近二個會計年度研發費用

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112年度	113年度	114年前二季
研發費用	27,880	23,958	13,993
營業收入	762,039	547,630	255,655
占當年度營業收入比率(%)	3.66	4.37	5.47

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司之研發費用主要包括研發人員的薪資、獎金、差旅費、研發設備之折舊及研發消耗品等支出，112~113 年度及 114 年前二季之研發費用分別為 27,880 千元、23,958 千元及 13,993 千元，占各年度營業收入淨額之比率分別為 3.66%、4.37%及 5.47%。該公司對於研究開發投入相當重視，各年度皆有一定比重之研發支出投入，112~113 年度因營收規模受景氣影響而下滑，及 114 年前二季因研發新型設備，研發用領料量增加，致研發費用占營業收入比重逐年上升，經評估其變動情形尚無重大異常之情事。

(4)重要研發成果

該公司自成立以來，即不斷要求提升自身研發能力，憑藉自身完整的研發能力及製造能力，持續取得國內多項專利肯定，其研發成果均來自自行研發。茲將該公司最近二年度及最近期截至評估報告出具日止之重要研發成果相關內容列示如下：

年度	研發成果/產品別
109 年	◆晶圓背面高分子殘留物去除之大氣電漿設備 ◆用於非等向性乾式蝕刻製程之感應式高密度電漿-反應性離子蝕刻設備
110 年	◆用於金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備
111 年	◆用於甲烷裂解產氫之電弧式大氣電漿設備 ◆用於甲烷轉化之介電質放電式大氣電漿設備
112 年	◆寬幅型金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備 ◆用於甲烷裂解產氫之微波電漿火炬設備
113 年	◆大面積陣列式微波電漿系統
114 年	◆用於金屬氧化物去除之中頻大氣電漿設備

資料來源：該公司提供。

3.主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司認為只有不斷創新獨特的設計，才有持續突破的創造技術，主要技術來源係該公司之研發團隊所開發之自有專利技術，以其專業且豐富之學經歷知識，並汲取過去產業經驗及彙整該公司之研發經驗，開發適用於各產業製程設備等相關產品。截至評估報告出具日止，並無與他人簽訂重要技術授權合作契約，亦無支付技術報酬金或權利金之情事。

4.研發工作未來發展方向

隨著科技產品不斷演進，半導體、PCB 等產業製程設備不斷升級更新，隨智能化製造的發展，電漿設備將更強調自動化控制和智能化管理，以適應更加精細和複雜的工藝要求，此外，減碳議題亦受到各國高度重視，因此該公司為配合高科技製程需求及追求環境永續發展，致力於設備技術升級及開發，目前主要進行中研發之計畫包括以下項目：

核心策略	計畫目標說明
擴展核心製程技術深度	強化奈米級清洗、蝕刻與表面能控制能力，以支援先進封裝需求
跨材料整合與異材製程	佈局多元材料組合之製程挑戰，發展具選擇性與高精度控制能力的電漿蝕刻技術，針對不同介面結構進行有效處理
綠色製程技術創新	推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、氫能火炬、高 GWP 尾氣處理設備商品化
智慧製造導入	建立製程參數 AI 學習模型，導入虛擬量產平台與智慧維運(e-maintenance)

資料來源：該公司提供。

5.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權等情事，暨因應措施是否合理有效

截至評估報告出具日止，該公司並無因侵權而有訴訟之情形，亦無因涉及違反專利權、商標權及著作權而對其財務、業務有重大影響之情事。茲就該公司截至評估報告出具日止，現存已取得及申請中之專利權及商標權列示如下：

(1)專利權

A.截至評估報告出具日止，該公司已取得之專利權如下：

項次	專利名稱	申請國家	專利類型	專利權號	申請日	專利權迄日
1	空氣清淨機	台灣	新型	M531565	105/5/27	115/5/26
2	自動化線上電漿製程系統	台灣	發明	I457972	101/10/12	121/10/11
3	電漿晶圓清潔機及使用其清潔晶圓的方法	台灣	發明	I748741	109/11/11	129/11/10
4	卷對卷式電漿去膠渣機	台灣	發明	I789144	110/12/3	130/12/2
5	壓電材料卷對卷極化設備	台灣	發明	I805299	111/3/31	131/3/30
6	壓電材料極化設備	台灣	發明	I814323	111/3/31	131/3/30

項次	專利名稱	申請國家	專利類型	專利權號	申請日	專利權迄日
7	氣體分解裝置(一)	台灣	發明	I842523	112/5/11	132/5/10
8	氣體分解裝置(二)	台灣	發明	I842524	112/5/11	132/5/10
9	感應耦合電漿蝕刻設備及其多迴圈式電極	台灣	發明	I863178	112/3/21	132/3/20
10	電漿晶圓清潔設備	台灣	發明	I894854	114/8/21	133/3/11

資料來源：該公司提供。

B.截至評估報告出具日止，該公司申請中之專利權如下：

項次	專利名稱	申請國家	專利類型	專利申請日
1	氣體分解裝置(三)	台灣	發明	113/09/26
2	真空電漿蝕刻之薄板定位裝置	台灣	發明	113/12/27
3	電漿氧化還原裝置及方法	台灣	發明	114/04/11

資料來源：該公司提供。

(2)商標權

截至評估報告出具日止，該公司無申請中商標權，已取得商標權列示如下：

序號	商標名稱	商標權名稱及圖樣	國家/地區	商標註冊號	專用期限
1	NEMS tek 設計圖		台灣	01041913	122/4/30
2	NEMS tek 設計圖		台灣	00182253	122/05/31
3	NEMS tek 設計圖		台灣	00182252	122/05/31
4	NEMS tek 設計圖		台灣	00184847	122/07/31
5	暉盛	暉盛	台灣	00182251	122/05/31
6	暉盛	暉盛	台灣	00184846	122/07/31
7	暉盛	暉盛	台灣	01041912	122/04/30
8	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02270156	121/12/15
9	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02268200	121/12/15

序號	商標名稱	商標權名稱及圖樣	國家/地區	商標註冊號	專用期限
10	NEMS tek 設計圖 GLOW THE FUTURE		台灣	02279227	122/01/31

資料來源：該公司提供。

(3)著作權：

該公司最近二年度及申請年度截至最近期止，並無取得或申請中的著作權。

6.取得重要技術合作契約，就其內容評估對發行公司之營運風險

契約名稱	合作對象	契約起迄日	內容摘要	技術權利金及費用支付方式及金額	對營運之影響或限制條款
委託合約書	國立虎尾科技大學	114.06.01~ 114.12.31	共濺鍍銀-鈦合金薄膜製作與特性分析之研究	計畫經費計新台幣500千元，已支付完畢。	該計畫之研究成果及智慧財產權歸屬虎尾科技大學，暉盛擁有技術移轉優先授權之權利。

該公司之核心技術主要來自研發部門自行開發，114年度與國立虎尾科技大學進行產學合作研究計畫，針對封測產業探針產品之鍍膜技術進行合作研究開發，上述重要技術合作契約對公司營運發展應有正面助益。

7.以創新板申請上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施加以評估

(1)關鍵核心技術

電漿乾式清洗工藝在PCB製造與半導體先進封裝製程中，能提供卓越的清潔與表面活化效果，對確保高精度製程的良率與可靠性至關重要。相較於傳統濕式清洗方式，容易產生清洗劑殘留，且受限於液體表面張力，難以深入微細孔洞與複雜結構，電漿技術則具備高度穿透性與均勻性，能有效覆蓋3D結構並清潔微奈米間隙，是確保先進製程品質不可或缺的關鍵步驟。

該公司以高密度電漿乾式表面處理技術為核心，由研發團隊自主設計涵蓋基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空系統與溫控單元等關鍵子系統，並依應用需求彈性整合成高模組化、可擴展的設備平台，可針對不同產業領域進行模組重組與製程優化。其相關設計均已申請專利保護，專利技術涵蓋機構模組、電漿腔體設計、等離子生成模組、氣體流場控制、感測監控機制等，皆為該公司研發團隊開創擁有，為設備製造關鍵門檻，存續中有效專利包含1項新型專利、9項發明專利及3項申請中專利。核心技術包括：

A.ICP-RIE 電漿蝕刻系統(感應耦合電漿反應式離子蝕刻)：

該公司自研高密度電漿源結構，並導入多階段電場控制技術。相較同業

普遍採用單輸出電源，易受限於製程均勻性與參數調控彈性，該公司創新設計多輸出電源模組，可分區動態調整電漿密度與功率分佈，依不同蝕刻階段精準調控，大幅提升製程穩定性與蝕刻均勻度，滿足高精度、大面積與高難度製程需求。

B.常壓電漿極化：

該公司為某美系半導體大廠唯一委託開發該項技術的供應商，專用於PVDF(聚偏二氟乙烯)與PZT(鋁鈦酸鉛)等壓電材料表面改性。透過電漿處理改變材料表面電子排列，造成壓電效應，此技術已成功應用於超音波指紋辨識模組之製程(如：智慧型手機中的螢幕下指紋感測器)。電漿極化技術可有效活化壓電材料性能，使感測訊號更清晰，辨識更準確。此外，常壓電漿亦可應用於電子元件散熱，無須額外風扇或液冷元件的被動式散熱方式，可有效降低系統功耗與體積。

C.Hybrid Bonding(混合鍵合技術)－大氣電漿處理技術：

Hybrid Bonding為先進封裝製程關鍵技術之一，該公司為因應Hybrid Bonding先進封裝所需開發之大氣電漿處理，將預計於2025年9月底在美國聖地牙哥舉行的IMAPS國際會議正式發表。該技術將應用於晶片堆疊前之表面清潔與活化處理，針對SiO₂-SiO₂與Cu-Cu介面進行低損傷乾式去氧化與表面活化，可顯著增強晶片鍵合強度與傳輸效能，並有效解決封裝過程中界面污染問題，支撐新一代封裝技術之可靠性與性能需求。

D.高效電漿火焰技術(Microwave Thermal Plasma)：

由中研院委託該公司研發，協助能源機構建構應對減碳挑戰之先進設備。透過微波電磁場耦合模組與氣旋式腔體設計，實現甲烷(天然氣)裂解產生氫之高效反應路徑。傳統碳捕捉多屬「事後處理」技術，常以氣體形式收集二氧化碳，再進行儲存或處理，面臨高壓壓縮與儲存瓶頸，該技術於反應初期即直接將碳轉化為穩定固體形式，簡化後段處理流程。未來亦可應用於裂解半導體製程中產生的溫室氣體(如SF₆、NF₃、CF₄)，以實現更具環境效益的製程減排方案。

該公司擁有電漿表面處理關鍵核心技術，憑藉多年研發積累取得多項電漿相關專利技術，建立起明確的技術門檻與壁壘。目前所開發之高密度電漿設備已廣泛應用於高階半導體、先進封裝及新興綠色製程中，具有他人難以替代的獨特性。此外，該公司分別於109年及111年通過經濟部中小及新創企業署-小型企業創新研發計畫(SBIR)機械領域核定補助名單，該計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營，顯示該公司技術創新獲得認可。

(2)創新能力或創新營運模式

該公司之創新能力主要體現在自主開發的高密度電漿乾式表面處理技術架構，並以此核心開發出一系列具高度可擴展性的模組化系統設備，提供客戶完整製程解決方案及技術服務。該公司持續投入創新研發及前瞻性應用開發，並憑藉電漿技術在半導體製程中具備低污染、高效率製程處理等優勢，持續拓展應用層面，在全球推動 ESG 永續發展的潮流趨勢下，逐步取代傳統高污染及高耗能的製程設備。

A.暉盛公司現有核心技術之突破性應用：

(A)卷對卷式電漿去膠設備：

將電漿應用在3C與行動裝置軟性電路板的表面清潔及去膠處理，已為科技大廠其軟性電路板供應商指定使用。

(B)ABF載板乾式蝕刻與表面處理：

領先同業於載板製程導入ICP-RIE及高效電漿火焰處理技術，具備高蝕刻選擇性與高均勻性，能精準處理ABF基板中之SiO₂填料與環氧基質，有效克服傳統濕式蝕刻難以達成之精細控制，目前可處理尺寸最大已達850×750mm。

(C)Hybrid Bonding(混合鍵合技術)—技術上之領先更新：

本系統具320mm大面積有效處理範圍，可於單一製程步驟內同時完成多重處理，大幅縮短製程處理時間，並能無縫整合於下游封裝製程，提升整體生產效率。另外，不同於傳統微波或RF電漿系統，該公司採用中頻常壓介電阻擋放電(MF AP-DBD)技術，突破業界對高成本氬氣的依賴，成功實現以高濃度氮氣(N₂)作為主要工作氣體，不僅具備等效甚至優於傳統系統之處理效果，也大幅降低營運成本。

(D)先進封裝電漿處理設備應用(FOWLP/FOPLP)

針對晶圓級(FOWLP)與面板級(FOPLP)封裝技術日益精細之需求，該公司開發對應的低損傷電漿表面活化與蝕刻設備，可有效改善封裝層間附著力與金屬導通孔(RDL)清潔品質。設備支援300mm晶圓及610×610mm面板，具備大面積均勻性、高重現性與製程彈性，已成功導入多家先進封裝客戶之製程產線，協助提升封裝良率與可靠度，並可依不同材料堆疊需求進行多氣體、階段式或選擇性處理，滿足未來高頻、高密度、高散熱的異質整合封裝技術挑戰。

(E)再生晶圓薄膜去除：

結合ICP-RIE及高效電漿火焰處理技術，開發出低損傷乾式清膜模組，有效降低再生製程成本並提升再生晶圓品質，目前已獲台灣晶圓封測大廠

採用。

B. 前瞻性應用：

- (A) 第三代半導體應用延伸(SiC蝕刻/GaN表面處理)：已完成初步模組開發，計畫配合功率晶片製造擴展應用。
- (B) 微型感測器與 PVDF(聚偏二氟乙烯)與PZT(銦鈦酸鉛)電漿極化封裝技術：支援次世代智慧穿戴裝置之壓電模組封裝。
- (C) 工業廢氣/醫療廢棄物電漿即時裂解設備：應用高效電漿火焰模組實現ESG減碳需求。
- (D) AI製程參數學習平台：建構預測性良率模組，預計進一步商業化至數據服務平台。

C. 減碳排廢應用的創新實踐

該公司除了在半導體及電子資訊產業持續著墨於綠色製程技術的研發與應用外，在減碳排廢應用上同樣展現創新作為。

(A) 減廢製氫能源應用創新及永續設備設計：

面對全球減碳趨勢，該公司投入電漿裂解甲烷製氫技術之研發，不僅減少溫室氣體排放，同時開創潔淨能源生產新路徑。此技術提供了一種低碳的氫能生產方案，符合未來氫經濟的綠色發展方向；此外，該公司亦已研發出直流電漿火炬系統，採用熱效率電極設計，可延長電漿設備電極使用壽命，使設備能長時間穩定運行且維護成本低，強化企業ESG表現。

(B) 工業廢氣與製程尾氣裂解處理：

該公司研發工業污染氣體電漿防治設備，可串接於製程排氣系統中解決工業製程中的廢氣，將廢氣中的有害成分高效分解降低污染物排放，協助企業符合環保法規並減輕環境負荷。

(C) 低碳製程替代方案：

針對傳統濕式化學製程的高污染與高耗能問題，該公司研發全乾式電漿去膠渣及蝕刻製程，成功取代需耗用大量化學藥劑的傳統製程。此乾式製程不僅符合半導體高精度製程需求，亦大幅降低製程廢液及能源消耗，符合節能減碳與綠色製造趨勢。

綜上所述，該公司掌握高密度電漿源設計等核心技術，展現出持續創新能力、能靈活匹配客戶製程參數需求，因應客戶特殊製程需求推出創新解決方案及跨產業應用拓展力與國際競爭力，不僅擁有關鍵核心技術，更具備技術領先性與產業影響力。

(3)因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施：

A.技術及產品變化之風險

全球半導體技術迭代迅速，包括AI晶片、先進封裝、Chiplet架構與第三代半導體材料持續突破，終端應用需求亦快速轉變。若該公司未能同步升級核心技術，產品規格或製程能力未能即時滿足客戶需求，恐面臨產品被取代或喪失技術領先地位之風險，訂單取得與市場滲透率亦將受影響，尤以先進封裝、高頻載板與環保設備領域為甚。

因應對策：

該公司每年投入約營業收入5%作為研發支出，確保持續性創新動能，並與生產部電控及機構設計單位密切合作，積極強化高彈性客製化產品設計能力，導入製程即服務(PaaS)模式以提升市場變動適應速度與彈性，並藉由客戶客製需求，共同開發新產品，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化並同步累積特殊材料或應用端Know-how。此外，該公司核心團隊所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，以對市場敏銳度積極投入新產品研發以推出符合市場需求之產品，同時積極申請專利保護，並發展具差異化的技術方案，如ABF全乾式蝕刻與高溫電漿火炬系統，形塑技術壁壘，提升市場競爭力。

B.政策與貿易變化風險

2025年4月2日川普以各國對美龐大貿易逆差為由，實施10%的全面進口關稅，同時公佈約60個國家的進口貨品將加徵對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。如若關稅實施，將推高公司產品在美國市場的售價，削弱價格競爭力。

因應對策：

指定窗口密切關注美國相關機構之政策公告，掌握第一手關稅與出口管制動向，確保對應製程、產品或客戶交易行為符合最新規範，並留意主要客戶應用產品之關稅變化可能造成之後續影響，降低法律與商業風險。結合ERP/CRM系統即時回饋進口稅率、運費與原物料價格變動對產品售價的影響，讓銷售團隊與財務部門可依據區域與客戶別調整報價策略，避免毛利率大幅波動。此外，配合地緣政治變化，加速全球非美市場多元化策略，重點佈局東南亞(如越南、馬來西亞)及歐洲先進製造供應鏈，透過與當地專業經銷商合作，提升在地即時支援能力。

C.核心技術人員變動風險

若關鍵研發人員離職，可能影響新技術開發及現有技術整合及發展。

因應對策：

該公司持續積極培養核心技術相關人才，所有研發專案皆採「雙人制度」與交叉備援機制，以分散關鍵技術集中風險，確保技術傳承不中斷。研發人員在職期間所產出的技術成果均已全面專利化，並導入文件加密與權限控管系統，有效保障智慧財產安全，即便核心技術人員離職，對公司整體營運影響尚屬有限。在內部人才培育方面，該公司已建構知識系統化平台，並定期進行技術交接與內部經驗分享，此外，該公司同時實施具吸引力之獎酬與留才制度，以進一步提升人才的穩定性。

8.以創新板申請上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升

A.產品生產開發技術之層次

該公司產品生產與技術開發的核心，建立於其自主研發的電漿乾式製程平台(Plasma Modular Processing Platform)之上。該平台整合高密度電漿生成模組、精密氣體流場設計、RF電場控制系統與真空腔體熱場整合機制，形成一套高度模組化、可擴展且具跨產業應用潛力的技術基礎。整體技術可分為三大核心層面：

(A)自主電漿模組架構設計：

該公司不依賴現有外部平台或進口設備改裝，而是完全自主設計與建構等離子體產生模組，涵蓋感應耦合電漿(ICP)、微波電漿(MTP)、大氣壓電漿(AP)等系列架構，並可依據不同製程需求，彈性設計腔體結構與能量分布控制系統。

(B)多製程參數整合能力：

該公司具備對氣體組成、腔體壓力、能量密度、電漿均勻性及材料熱衝擊等參數的協同控制能力，可靈活應用於多種乾式製程，包括清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理及高溫裂解等製程，顯示出技術應用層面之廣泛延展性。

(C)先進封裝與精密加工的高度適配性：

該公司產品具備處理3D結構及高深寬比結構的能力，對於奈米級線寬、表面粗糙度與蝕刻選擇性具備高解析調控能力，能有效支援先進晶圓封裝、ABF載板蝕刻與FPC模組加工等關鍵核心製程，為高階半導體應用提供技術支撐。

B. 產品生產開發技術之來源

該公司關鍵核心開發技術100%來自公司之研發團隊，以總經理為首帶領擁有產業豐富經驗，並涵蓋電漿物理、化學工程、機構設計、材料科學與系統整合等專業之團隊，以實務經驗及專業知識將設計思想轉變為具可實施性的產業技術。技術研發以電漿製程為主軸，且並非單一用途開發，而係以「核心平台+應用模組」方式設計，具備高度再利用與產業轉移能力，且技術基礎由研發部門統一維護，由研發單位人員與生產部電控及機構設計單位依產業需求開展應用專案，確保既有核心可持續深化，亦能快速響應市場趨勢。而智慧財產專利權佈局則包含等離子體產生模組、射頻功率控制、氣體導流腔體設計、感測監控系統與多段製程控制架構等，均由該公司之經營及研發團隊完成。

C. 產品生產開發技術之確保

該公司針對其自主開發之電漿乾式製程，已建構完善的技術保護策略。該公司已於內部控制制度之研發循環中訂定有關智慧財產權之取得、維護及運用作業予以規範，並於每一個新技術、新改善方案建立時，申請專利權保護或列為公司營業秘密完善保存，並建立智慧財產權清單定期更新盤點，其相關文件之傳遞、保存及銷毀均須依管理作業程序辦理，嚴格控管該公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，且該公司員工均有簽屬保密協議，藉以控管及保護該公司重要專利技術。除此之外亦透過資深研發人員之經驗傳承，同時積極延攬人才組建技術團隊，以確保核心技術持續提升。

D. 產品生產開發技術之提升

該公司持續投入研發人力及經費於電漿多樣化應用領域(如：半導體、封裝載板、OLED、ESG氫能等)之技術開發，以利該公司能於早期掌握產品關鍵技術，並確保持續領先同業推出更全方位之產品，同時該公司透過與國際大廠客戶建立協同開發計畫，透過實際應用場域共同定義製程需求與參數開發，加速技術商品化，並透過產學合作進行前瞻研究，以促進技術進化。此外，該公司將積極延攬人才，並輔以參考職務承擔責任及貢獻度發放獎酬，兼顧人才招募及留任，俾利該公司所具有之關鍵核心技術得以持續提升。

(2) 現在主要產品之競爭優勢、生命週期及持續發展性評估

A. 現在主要產品之競爭優勢

(A) 專精利基與研發創新：

該公司聚焦於電漿表面處理這一利基市場，投入高度研發創新，掌握高密度電漿源設計等核心技術。在先進封裝、IC載板等新興應用上推出創新解決方案。相較之下，國際大廠雖規模龐大，但產品線廣泛，未必能迅

速客製因應這些特殊製程需求。該公司擁有專業電漿技術團隊與多項專利，加上高度彈性客製化及製程整合能力，能依客戶製程需求提供專屬模組設計、製程參數優化與材料測試服務，滿足不同產業的特殊要求。

(B)產品組合與跨領域應用：

該公司以高密度電漿乾式表面處理製程技術平台為核心，將自主設計的基礎機構、電磁場控制、氣體混合、真空與溫控系統等依需求彈性，搭配結合成為高度可擴展性的設備模組系統，並根據不同應用領域進行模組重組與流程優化。該公司的產品線涵蓋真空電漿設備與大氣電漿設備，以及電漿應用於污染防治、新能源等多元領域，同時在半導體、PCB、光電乃至能源等產業均有技術布局。擁有跨產業的技術服務能力，使該公司能夠在全球供應鏈中扮演多元角色，減少對單一市場的依賴並拓大商機來源。從國際大廠採用該公司電漿設備等實績中，顯示該公司的技術實力已獲得國際頂尖科技大廠認同。

B.現在主要產品之生命週期暨持續發展性

該公司旗下產品依據其技術成熟度與市場接受程度，主要可區分為三大生命週期階段：

(A)成熟期產品

該公司部分傳統型電漿設備，如電漿清洗機、去膠渣機等通用型真空和常壓電漿設備，已進入產品生命週期之成熟階段。該類產品市場需求相對穩定，競爭者眾，產品同質性高。為維持競爭優勢，該公司將持續透過技術升級與彈性化客戶製程設計服務，延伸產品生命週期並鞏固客戶關係。

(B)成長期產品

應用於先進封裝(如 FOWLP、FOPLP、Hybrid Bonding)、晶圓再生與ABF載板全乾式處理等新興應用所開發的電漿設備，目前正處於高速成長階段，尚無週期性之問題。隨著AI、5G、高效運算(HPC)等科技發展推升半導體製程升級，相關需求持續擴大。該公司憑藉自主電漿模組設計能力，於此領域建立技術領先地位，提高市場滲透率。

(C)導入期產品

應用於新能源與環保領域之電漿設備，包括高溫電漿火炬(用於甲烷裂解產氫)、固體廢棄物處理及溫室氣體減排等系統，現階段尚處於導入初期。儘管市場尚未全面成熟，但因應全球能源轉型與淨零碳排目標，相關產業前景可期。該公司將持續投入研發與驗證資源，並積極拓展相關市場。

(3)新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

A.新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

該公司致力於擴展核心製程技術的深度與廣度，全面強化奈米級清洗、蝕刻與表面控制等關鍵能力，以因應先進封裝製程對精密度與材料適應性的高度要求。同時，該公司積極發展跨材料整合技術，導入適用於Epoxy+SiO₂、Glass+Cu等異質材料的複合材蝕刻與活化解決方案，提升設備對新型封裝結構的製程相容性。在綠色製程方面，該公司推動全乾式去膠、低耗能蝕刻、高效率氬能火炬與高GWP尾氣處理等創新設備之商品化，強化ESG製程落實與碳排管理能力。此外，為加速數位轉型，該公司亦已導入智慧製造技術，包括建立製程參數AI學習模型、建置虛擬量產平台與智慧維運系統，提升製程穩定性、良率與運營效率。

新產品預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性如下：

核心策略	計畫開發之新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
<ul style="list-style-type: none"> ◆擴展核心製程技術深度 ◆跨材料整合與異材製程 	大面積大氣電漿噴頭開發	114年底	半導體製程	中頻寬幅電漿頭開發，業界首創320mm有效處理範圍，透過去除銅腳表面氧化物，提高銅-銅高密度鍵合可靠度，此設備技術符合未來5G與AI晶片封裝微線道、高密度堆疊的製程發展趨勢，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆擴展核心製程技術深度 ◆跨材料整合與異材製程 ◆綠色製程技術創新 	ABF乾式蝕刻設備	114年第四季	半導體製程	ABF乾式蝕刻設備為該公司針對ABF載板設計之關鍵設備，能以乾式製程技術高選擇性地去除Epoxy與SiO ₂ 材料，解決濕蝕刻工法無法滿足細線與高密度載板需求的痛點。隨著AI與5G帶動封裝微型化趨勢，該設備具備成為先進載板加工標準設備的潛力，並能協助客戶朝向乾式低碳製程轉型，隨著新產品之設計、開發及推廣，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆擴展核心製程技術深度 ◆智慧製造導入 	Underfill前清潔(針對晶圓級極小Gap產品)	115年底	半導體製程	高密度微波電漿機台開發，主要目的為消除半導體封裝製程中underfill灌膠過程中之產生之空孔缺陷。此設備技術符合未來5G與AI晶片封裝微線道、高密度堆疊的製程發展趨勢，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。

核心策略	計畫開發之新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 綠色製程技術創新 ◆ 智慧製造導入 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 高溫微波電漿火炬系統 (MTP) ◆ 先進半導體製程廢氣電漿淨化器(高GWP氣體即時處理設備) 	115年第四季	ESG減碳	此系統為高溫微波電漿設備，主要應用於甲烷裂解製氫($CH_4 \rightarrow C + 2H_2$)，以及高GWP氣體(如 SF_6 、 NF_3)與工廠/醫療固體廢棄物之即時熱裂解處理。設備具備高溫(>2000°C)反應效率與氣旋場穩定結構，能廣泛應用於氫能產業、碳中和場域、能源工業與ESG減碳設備中，該設備亦具進入碳稅交易平台與補助計畫的技術潛力，為未來能源轉型的關鍵設備之一，目前已進入政府單位、能源與材料廠區測試，預計在新產品陸續通過客戶驗證及量產後，將可挹注該公司營收及獲利。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擴展核心製程技術深度 ◆ 跨材料整合與異材製程 ◆ 綠色製程技術創新 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 高效深孔電漿蝕刻設備 (Green DRIE for TSV/TGV) ◆ 次微米級高精度ABF載板乾蝕設備(支援2μm/2μm線寬線距，兼容玻璃基板) 	116年第一季 116年第二季	半導體製程	先進封裝產業在115年之後預計將持續蓬勃發展，高階運算(HPC)與AI晶片對封裝的密度和性能要求越來越高。尤其是在封裝基板方面，ABF載板目前量產線寬/線距約10 μ m，但下一代晶片需要2 μ m及以下的極細路。為因應此趨勢，全球封裝基板技術正從傳統有芯ABF朝向無芯ABF與甚至玻璃基板演進：如欣興開發無芯ABF可實現3 μ m線寬線距；三星亦組建聯盟加速研發玻璃基板，預計115年即商業化此革命性技術，以因應多晶粒系統級封裝需求。英特爾則計畫119年前導入玻璃基板，使封裝互連密度大幅提升。總體而言，更高密度、更大尺寸的封裝基板將成為未來主流，帶動相關設備需求激增。 新產品構想針對電漿製程未來需求而設計：既解決技術瓶頸，又響應良率、效率、低碳排、環保與智慧化的產業趨勢。隨著先進封裝在AI、高性能計算領域的蓬勃發展，這些創新電漿設備與方案有望成為關鍵使能技術，將可挹注該公司營收及獲利。

資料來源：該公司提供

B. 研究發展之內部控制暨保全措施

該公司已建立完整之內部控制，研發循環之內部控制制度包括基礎研究作業、產品設計、技術研發、產品試作與測試作業、研發記錄與文件保管作業及智慧財產權之取得、維護及運用作業。各項研發階段所製作之文件經過適當審核程序後，由研發部門存查，任何研發文件之查詢、借閱需經研發部門主管核准後才准予借調，以落實研發文件之保存。該公司亦導入PLM(Product Lifecycle Management)管理系統，所有技術文件、研發專案設計、版本紀錄均納入PLM平台控管，確保從概念設計至工程導入可完整追溯；而

材料BOM表與製程紀錄雙系統整合，將技術開發所涉材料、模組組裝與氣體流道設定皆同步至ERP系統與MES製造執行系統，落實生產過程的可視化、可控化與可追溯化，降低因人異動造成製程資訊中斷的風險。此外，該公司之技術設計圖、實驗參數及測試紀錄皆透過該公司雲端系統進行每日備份，具備災難復原與異地調閱能力，所有研發設計文件亦依涉密等級分類，具備防擷取、防儲存、防列印、防傳輸等技術保護。

9.以創新板申請上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

(1)參與經營決策之董事、監察人、持股5%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例與實際投入經營之時間與情形

該公司無以專利權或專門技術出資之股東，並設有審計委員會取代監察人。茲將該公司董事、持股5%以上股東，及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例與實際投入經營之時間與情形列示如下：

114年8月31日；單位：年；%

職稱	姓名	主要學經歷	職位年資	持股比率
董事長暨 5%以上股東	宋俊毅	國立臺灣科技大學電子系 基丞科技(股)公司-總經理	23	11.14
董事暨 5%以上股東	基丞科技 (股)公司	—	—	15.12
	代表人： 江少杰	內湖高工機械科 新群科技(股)公司-董事長 新杰科技(股)公司-董事長 基丞科技(股)公司-董事長	23	—
董事	曾坤燦	正修科大電子工程學系 江陰新杰科技有限公司-總經理 江陰新基電子設備有限公司-總經理 基丞科技(股)公司-副總經理	23	7.27
董事暨 總經理	許嘉元	成功大學化學工程學系研究所博士 成功大學化學工程學系學士 暉盛科技(股)公司-總經理	23	4.32
獨立董事	顏盟峯	英國雷汀大學財務金融博士 英國雷汀大學國際證券、投資暨銀行學碩士 國立清華大學電機工程學系 國立成功大學會計學系兼財務金融研究所教授 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院-董事 申豐特用應材(股)公司-獨立董事 中華郵政股份有限公司-外部專家董事	1	—

職稱	姓名	主要學經歷	職位年資	持股比率
		國立成功大學會計學系-系主任兼財務金融研究所-所長		
獨立董事	黃蕙玲	高雄第一科技大學財務管理系碩士 逢甲大學會計系 怡和國際能源(股)公司-財會處長 元山科技(股)公司-總管理處處長兼財務長 台新證券(股)公司-資深協理 綠需能源(股)公司-財務長	1	—
獨立董事	何志文	國立臺灣大學機械工程研究所材料組碩士 國立成功大學機械工程學系 飛信半導體(股)公司-副總經理、總經理	1	—
5%以上股東	矽格聯測(股)公司	—	—	8.73
生產部主管	符永豪	成功大學資源工程所碩士 成功大學資源工程系學士 鈦昇科技(股)公司—研發工程師	23	0.87
研發部主管	梁國超	成功大學化學工程學系研究所博士 成功大學化學工程學系研究所碩士 台灣科技大學化學工程學系肄業 核能研究所副研員	6	0.83

資料來源：該公司提供

(2)參與經營決策之董事、監察人、持股5%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，最近兩年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：股

職稱	姓名	111年	112年度		113年度		114年8月31日止	
		期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數	持有股數 增(減)數	期末持有股數
董事長暨5%以上股東	宋俊毅	1,581,973	1,780,000	3,361,973	(146,000)	3,215,973	643,224	3,859,197
董事暨5%以上股東	基丞科技(股)公司	4,617,756	—	4,617,756	(255,000)	4,362,756	872,551	5,235,307
	代表人：江少杰	—	—	—	—	—	—	—
董事	曾坤燦	1,822,235	400,000	2,222,235	(123,000)	2,099,235	419,847	2,519,082
董事暨總經理	許嘉元	1,089,650	230,000	1,319,650	(73,000)	1,246,650	249,330	1,495,980
董事	蔡秉儒	710,424	800,000	1,510,424	(註1)	(註1)	(註1)	(註1)
獨立董事	顏盟峯	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
獨立董事	黃蕙玲	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
獨立董事	何志文	(註2)	(註2)	(註2)	—	—	—	—
5%以上股東	矽格聯測(股)公司	2,664,090	—	2,664,090	(146,000)	2,518,090	503,618	3,021,708
生產部主管	符永豪	—	250,000	250,000	—	250,000	50,000	300,000
研發部主管	梁國超	—	250,000	250,000	(10,000)	240,000	48,008	288,008

資料來源：該公司提供。

註1：該董事於112.12.11辭任，故不揭露後續期間之持股變動。

註2：獨立董事皆係於113年1月26日股東臨時會增選就任。

該公司於 112 年 12 月 6 日辦理股票公開發行，並於 113 年 3 月 18 日登錄興櫃。該公司於 112 年度員工行使員工認股權為 2,604 千股，且大股東日立先端科技(股)公司轉讓其持股 3,595 千股予董事及經理人，故 112 年度之股權異動係因員工行使員工認股權以及認購大股東所轉讓之持股所致；該公司於 113 年度申請登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第八條及「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，由董事、法人股東及內部人提撥共計 1,007 千股予主辦、協辦輔導推薦證券商及投保中心認購；該公司 114 年 6 月經股東會通過盈餘轉增資，每股配發 2 元，故 114 年截至 8 月底之股權異動主係股利分派所致。除上述原因之異動外，其餘變動主係股東間交易及自身理財投資規劃因素致持股異動。

- (3)參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等，若未能繼續參與經營對公司之營運風險，及其因應之措施

該公司並無以專利權或專門技術出資之股東，該公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，其主要透過董事會運作進行對該公司之重大決策及監督公司營運方向，並無單一董事或集團控制該公司經營或日常運作之情事；而該公司因無以專門技術出資之股東，該公司產品專案開發資料包括材料測試驗證數據及生產工程技術等文件，前述所有已建檔之生產文件所有權均歸屬於該公司，並非由單一個人能完全掌握且無技術集中於特定人士或組織之情事。綜上所述，如若未來參與經營決策之董事或經理人未來不繼續參與公司之經營，因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，公司治理仍能有效實施；此外，該公司等重要營業文件保存均依內部控制相關管理辦法施行，使得其設計及開發成果得以保留於公司內部，並嚴格控管存取人員權限，以確保資料的完整性及機密性，研發工作得以延續，經評估該公司之因應措施尚屬健全可行，對該公司之財務業務應無重大影響。

- 10.以創新板申請上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者申請創新板上市，故不適用此項評估。

(四)人力資源之營運風險

最近二年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等，以評估離職率之變化情形之合理性及對該公司之營運風險。

1.員工總人數及變動情形

單位：人

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 8 月底
期初員工人數		64	66	67
本期新進人數		9	9	19
離職人員	主管級人員	2	1	—
	直接人員	4	4	1
	間接人員	1	3	7
	合計	7	8	8
資遣人數		—	—	—
退休人數		—	—	—
期末員工人數	主管級人員	16	17	21
	直接人員	26	24	29
	間接人員	24	26	28
	合計	66	67	78
平均服務年齡(歲)		40.12	40.63	41.08
平均服務年資(年)		8.06	8.56	7.60

資料來源：該公司提供。

註：新進、離職及資遣人員不包含試用期未滿即離職者。

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年截至 8 月底之期末員工人數分別為 66 人、67 人及 78 人，平均服務年資分別為 8.06 年、8.56 年及 7.60 年。該公司為持續因應未來營運規模成長而擴充人資、財會及業務相關部門人力；而員工平均年齡約為 40 歲左右，平均年資則為 7.60~8.56 年，顯示該公司員工主要為青壯年階層，人員流動情形尚屬穩定，對該公司及其子公司營運之穩定及成長應有助益。整體而言，該公司及其子公司最近二年度及最近期之人員變動情形尚屬合理，尚不致對其營運狀況產生重大不利影響。

2.離職人員分佈情形

單位：人；%

項目 \ 年度	112 年度			113 年度			114 年截至 8 月底		
	期末人數	離職人數	離職率 (%)	期末人數	離職人數	離職率 (%)	期末人數	離職人數	離職率 (%)
主管級人員	16	2	11.11	17	1	5.56	21	—	0.00
直接人員	26	4	13.33	24	4	14.29	29	1	3.33
間接人員	24	1	4.00	26	3	10.34	28	7	20.00
合計	66	7	9.59	67	8	10.67	78	8	9.30

資料來源：該公司提供。

註：離職率 = 離職人數(含資遣及退休) / (期末人數 + 離職人數(含資遣及退休))。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年截至 8 月底止之離職人員分別為 7 人、8 人及 8 人，離職率分別為 9.59%、10.67%及 9.30%。管理人員(包含經理人)方面，112 年度有兩位管理人員離職，其中一位研發主管因生涯規劃離職，而該公司尚有一位資深研發經理，該資深研發經理對研發產品特性與規格、市場需求與產業概況具相當經驗，對該公司研發業務尚不致產生重大影響，另該公司董事長宋俊毅先生原兼任執行長職務，於 112 年 10 月辭任，原職務由該公司總經理承接；113 年度一位管理人員任職未滿一年，因職涯規劃離職。基層員工方面，主係產線員工及業務人員對工作環境不適應、生涯規劃及家庭因素等而提請離職。由於離職員工多為基層員工，故不影響日常營運決策執行或技術深化發展，另離職人員皆已妥善完成交接作業、招募新進員工遞補缺額尚無困難，故對公司營運發展尚無重大影響。整體而言，該公司及其子公司離職率變化情形尚屬合理，且無因人員異動而對其營運產生重大不利之影響。

3.員工學歷分析

單位：人；%

項目/年度	112 年度		113 年度		114 年截至 8 月底	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	3	4.55	3	4.48	4	5.13
碩士	12	18.18	16	23.88	16	20.51
大學(含大專)	48	72.72	45	67.16	55	70.51
高中職(含)以下	3	4.55	3	4.48	3	3.85
合計	66	100.00	67	100.00	78	100.00

資料來源：該公司提供

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年截至 8 月底之員工學歷為大學(專)以上者分別為 63 人、64 人及 75 人，分別占總員工數之 95.45%、95.52%及 96.15%，該公司及其子公司之員工九成以上具有大學以上學歷，其中碩博士學歷之員工人數占全體員工比例為 22.73%、28.36%及 25.64%，均在二成以上，顯示該公司及其子公司對工作內容需具知識含量較高層次之人才專業背景要求，整體而言，該公司及其子公司員工學歷結構與其工作性質分布尚無重大異常，係有助其營運能力及市場競爭力。

(五)各主要產品之成本分析

- 1.最近期及最近二個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

單位：新台幣千元

產品	年度	112 年度		113 年度		114 年前二季	
		金額	%	金額	%	金額	%
各式 電漿設備	直接原料	334,417	82.39	252,819	78.54	101,063	81.92
	直接人工	39,431	9.71	43,883	13.63	13,118	10.63
	製造費用	32,074	7.90	25,220	7.83	9,192	7.45
	總計	405,922	100.00	321,922	100.00	123,373	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司及其子公司主要從事各式電漿設備及相關零配件之研發、製造與銷售。主要產品為電漿去膠渣及蝕刻機、常壓/真空電漿清洗機、電漿極化機及其他各式電漿相關設備。該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季直接原料占製成品總成本比重分別為 82.39%、78.54%及 81.92%；直接人工占製成品總成本比重分別為 9.71%、13.63%及 10.63%；製造費用占製成品總成本比重分別為 7.90%、7.83%及 7.45%。

該公司採訂單式生產，各期產品成本金額主係受公司營運訂單增減所變動。就直接原料占比而言，顯示其主要產品結構中均係以直接原物料占最大宗，約為 78~83%，而主要原物料組成係客製化機構元件、真空元件與幫浦及電源供應器等，所占比重會隨銷售產品組合及設計規劃的不同而波動。

113 年度直接原料占比較 112 年度下降，直接人工占比上升，主係 113 年度搭載高成本自動化手臂機台數減少及原料成本相對較低之清洗機銷售數量增加，故直接原料占比下降，直接人工相對上升。114 年前二季設備型號多為續訂訂單，製程已相對穩定故無需額外投入人力改機，故直接人工占比較 113 年度下降，直接原料占比相對提升。製造費用主係耗材使用及相關費用分攤，就製造費用占比而言，112~113 年度及 114 年前二季均各占比不到 10%且變動不大。

整體而言，各主要產品之原料、直接人工及製造費用等成本結構略有不同，主要係因不同項目產品之原物料價格波動、製程及人力投入等各項因素而略有差異，其原物料、直接人工及製造費用比率之變化情形尚無重大異常。

- 2.建設公司申報募集與發行案件者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，公司與地主之分配比率是否合理

該公司非屬建設公司，故不適用本項評估。

(六)匯率變動情形

就發行公司最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業利益之比率及內外銷、

內外購比率以分析匯率變動對發行公司營運之風險，及發行公司之避險措施。

1. 最近期及最近二個會計年度內外銷、內外購比率分析

內外銷金額及其比率

單位：新台幣千元；%

年度 項目	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	293,679	38.54	261,590	47.77	148,278	58.00
外銷	468,360	61.46	286,040	52.23	107,377	42.00
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	255,655	100.00

資料來源：該公司提供；各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

內外購金額及其比率

單位：新台幣千元；%

年度 項目	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
內購	241,614	98.22	197,322	92.07	119,664	97.49
外購	4,382	1.78	17,002	7.93	3,081	2.51
合計	245,996	100.00	214,324	100.00	122,745	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之外銷佔整體營業收入比重分別為 61.46%、52.23%及 42.00%，該公司及其子公司外銷市場主要以中國大陸為主，其他則銷往美國、歐洲及東南亞國家，主要以美元為計價幣別，少部分採人民幣及日幣計價。113 年及 114 年前二季因主要來自海外主要客戶擴廠需求訂單大多已於 112 年完成，加上全球 IC 載板及印刷電路板產業庫存去化及積極擴廠後而終端需求不如預期，以致供過於求，IC 載板及印刷電路板客戶因業績下滑而放緩資本支出，使外銷金額下滑。

在採購方面，112~113 年度及 114 年前二季之內購比重分別為 98.22%、92.07%、97.49%，其比重皆維持在九成以上，主係該公司及其子公司大部份原料需求由國內廠商供應即可滿足需求以及考量交期配合度，致該公司及其子公司外購比例占整體進貨比例較低，採購付款幣別主要以新台幣為主，少部分為美元、歐元及日幣計價。

綜上所述，該公司及其子公司外幣收入遠大於外幣支出，以美元資產部位為主，因此新台幣兌美元波動與該公司及其子公司營收及獲利息息相關，此匯率波動對該公司及其子公司之損益有相當之影響，該公司及其子公司隨時留意美元匯率以決定適當兌換時機，來降低匯率波動造成之風險。

2. 最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業收入及營業利益之比例

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度	113 年度	114 年前二季
		金額	金額	金額
兌換(損)益		3,170	22,349	(19,429)
營業收入		762,039	547,630	255,655
營業利益		166,599	87,039	37,438
兌換(損)益/營業收入(%)		0.42	4.08	(7.60)
兌換(損)益/營業利益(%)		1.90	25.68	(51.90)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之兌換(損)益分別為 3,170 千元、22,349 千元及(19,429)千元，占各年度或當期之營業收入之比率分別為 0.42%、4.08%及(7.60)%；占各年度或當期之營業利益之比率分別為 1.90%、25.68%及(51.90)%。該公司及其子公司產品交易型態係多為外銷，具重大影響之外幣主係為美元，匯兌損益主要隨其淨外幣資產部位之增減變動及匯率走勢而變化。

112 年度因美國聯準會採取升息政策趨勢放緩，使美元兌新台幣呈現先升後貶，致 112 年度產生淨兌換利益 3,170 千元；113 年度因全球通貨膨脹降溫緩慢，美國聯準會延後降息，美元仍維持強勢，致 113 年度產生淨兌換利益 22,349 千元；114 年前二季因美國關稅政策以及預期美國聯準會將實施降息政策影響，市場美元避險資金外流使得美元大幅貶值，致 114 年前二季產生淨兌換損失 19,429 千元。整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季兌換(損)益隨外幣匯率之變化而有所波動，其變動原因尚屬合理。

該公司及其子公司兌換(損)益之變化情形主係隨著美元匯率變化所致，與匯率變動趨勢相較尚屬合理，各年度及當期之兌換損益占該公司及其子公司營業收入比例甚微，兌換(損)益占營業利益比率 112 年度比例微小，113 年及 114 年前二季因主要來自海外主要客戶擴廠需求訂單大多已於 112 年完成，加上全球 IC 載板及印刷電路板產業庫存去化及積極擴廠後而終端需求不如預期，以致供過於求，IC 載板及印刷電路板客戶因業績下滑而放緩資本支出，使得該公司接單情況不如預期，該公司及其子公司營收下滑進而造成 113 年度及 114 年前二季營業利益減少，使兌換損益占營業利益比率變動較大，整體而言，匯率變動對該公司及其子公司獲利尚未構成重大風險負擔，該公司及其子公司將持續觀察國際總體經濟情勢及匯率走勢，以採取必要避險之措施，降低匯率變動風險對公司產生之影響。

3. 該公司因應匯率變動之避險措施

- (1) 該公司部分採取外幣應收付款項相互沖抵，以降低曝險部位達到自然避險效果降低匯率風險。
- (2) 該公司將匯率影響反應於新訂單之報價，並加強高附加價值設備之銷售，進行嚴格之成本控管，以提升毛利率降低匯率之影響。

- (3)財務部門與金融機構保持密切關係，藉由銀行提供之匯率變動分析及諮詢服務，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，同時隨時密切注意匯率變化資訊及持續觀察國際總體經濟情勢，定期彙整曝險部位並提報管理階層，除採適度保留外幣資產以支應外幣需求外，配合公司資金需求，適時換匯調節外幣部位。
- (4)該公司依股東會決議通過之「取得或處分資產處理程序」，其中規範衍生性金融商品相關評估及作業程序，必要時得視外幣部位及匯率變動情形，由財務主管採取適當避險措施，並選擇合適之金融商品進行承作，以降低業務經營所產生之匯率風險。

綜上所述，該公司在外幣資金管理上採取穩健保守原則，已採取相當必要且適當措施以降低匯率變動產生之風險，因此該公司之相關匯兌避險措施，應能適切控管並降低其匯兌風險變動之可能衝擊，故匯率變動對該公司應未產生重大營運風險。

三、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

參、發行人之業務財務狀況

一、業務狀況

(一)最近期及最近二個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

1.最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣千元；%

排名	112 年度				113 年度				114 年前二季			
	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係	名稱	金額	占營業收入淨額比例	與該公司之關係
1	A1	127,069	16.67	無	A11	78,619	14.36	無	A17	36,152	14.14	無
2	A2	107,190	14.07	無	A7	66,002	12.05	無	A2	28,096	10.99	無
3	A3	67,666	8.88	無	A12	46,202	8.44	無	A18	23,737	9.28	無
4	A4	57,255	7.51	無	A13	46,051	8.41	無	A19	22,286	8.72	無
5	A5	55,193	7.24	無	A1	42,662	7.79	無	A20	21,141	8.27	無
6	A6	50,151	6.58	無	A3	36,002	6.57	無	A3	21,007	8.22	無
7	A7	43,824	5.75	無	A14	25,890	4.73	無	A11	17,784	6.96	無
8	A8	34,821	4.57	無	A6	23,682	4.32	無	A1	15,090	5.90	無
9	A9	33,000	4.33	無	A15	23,193	4.24	無	A21	9,765	3.82	無
10	A10	20,610	2.70	無	A16	22,047	4.03	無	A22	8,928	3.49	無
	其他	165,260	21.70		其他	137,280	25.06		其他	51,669	20.21	
	銷貨淨額	762,039	100.00		銷貨淨額	547,630	100.00		銷貨淨額	255,655	100.00	

資料來源：該公司提供。

(2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司及其子公司致力於提供半導體產業、IC 載板與印刷電路板(以下簡稱 PCB)產業、平面顯示器與 LED 等光電產業、非電子業及民生工業、太陽能產業、新能源與環保產業及通訊產業等各式製程間，所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質之解決方案與電漿設備等研發、生產及銷售。該公司透過持股 100%之投資公司 Stable Promise Group Co., Ltd 轉投資中國昆山金暉盛電子商貿有限公司(以下簡稱：金暉盛公司)，由暉盛公司負責電漿設備之研發、生產及銷售，並由金暉盛公司負責中國地區客戶之售後維護。該公司及其子公司主要客戶遍布國內外且多為知名大廠，銷售地區主要為台灣、中國、歐美及日本等地區。112~113 年度及 114 年前二季對前十大主要銷貨對象之銷售金額分別為 596,779 千元、410,350 千元及 203,986 千元，占當期營業收入比率分別為 78.30%、74.94%及 79.79%，銷售對象之消長情形主係受市場總體環境、半導體市場發展趨勢、終端客戶需求、客戶資本支出政策及客戶營運狀況等因素影響。以下茲就該公司 112~113 年度及 114 年前二季主要銷售對象變化情形分析如下：

A1. A1公司

A1公司位於中國，成立於2021年，主要從事封裝基板的研發、生產、加工與銷售，該公司於111年開始與A1公司交易往來，主要銷售產品為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A1公司銷售淨額分別為127,069千元、42,662千元及15,090千元，占各年度銷貨比重分別為16.67%、7.79%及5.90%。隨著中國近年大力推動半導體產業及國產晶片自主化，在國家補助下進一步推升其載板業務的成長，而A1公司係中系PCB龍頭首次跨足到高階ABF載板量產領域所設立之公司，故112年度受益於A1公司產能建設完成並加大市場拓展力度，需求機台較多，且多為單價較高之連續式自動化電漿設備，故銷貨金額增加成為第一大客戶；113年度受新設產線建置已陸續完成，僅餘後續少數機台需求，故對該客戶之銷貨金額減少，降為第五大客戶；114年前二季則降為第八大客戶，其變動尚屬合理。

A2. A2公司

A2公司於民國79年設立，主要從事印刷電路板(PCB)、高密度連接板(HDI PCB)、軟板(FPC)、軟硬複合板(Rigid-flex PCB)、載板(IC Carrier)與IC測試及預燒系統之開發、製造、加工與銷售等業務。該公司與A2公司自92年即開始往來，主要銷售品項為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A2公司銷售淨額分別為107,190千元、18,912千元及28,096千元，占各年度銷貨比重分別為14.07%、3.45%及10.99%。A2公司因110及111年度積極擴充ABF載板產能，銷售之設備陸續於111及112年交機確認完成，故112年度為第二大客戶，112~113年度受全球電子業景氣下行影響，ABF載板需求疲弱，A2公司業績衰退下亦暫緩資本支出，故

當年度僅有維修收入交易並退出銷售前十大之列；114年前二季因PCB客戶去化庫存進入尾聲，出貨恢復，市場對於ABF載板與HDI(高密度連接板)需求穩健成長，資本支出亦提升，故A2公司對暉盛公司之採購增加，成為第二大銷售客戶，經評估其變動尚屬合理。

A3. A3公司

A3公司於民國89年設立，主要從事電子零組件製造業，專注於積體電路(IC)封裝用載板的製造與銷售，其產品主要應用領域涵蓋手機、GPU、基地台、消費性產品、網通設備等。該公司與A3公司自91年即開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A3公司銷售淨額分別為67,666千元、36,002千元及21,007千元，占各年度銷貨比重分別為8.88%、6.57%及8.22%。該公司113年度對A3公司之銷售較112年度下滑，主係112年度A3公司採購之機台多為高單價之自動化電漿設備，故銷售金額較高，為該年度第三大客戶，然A3公司至113年度向該公司採購數量減少且以較低單價之手動型機台為主，銷貨金額減少退居為第六大客戶，114年前二季主係銷售全自動電漿去膠渣機，維持第六大之列，經評估其變動尚屬合理。

A4. A4公司

A4公司於1968年成立於美國，係全球最大的半導體公司之一，主要從事電腦中央處理器(CPU)、顯示卡(GPU)與加速晶片及晶片組之生產與銷售。該公司與A4公司自99年開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A4公司銷售淨額分別為57,255千元、307千元及57千元，占各年度銷貨比重分別為7.51%、0.06%及0.02%。112年度採購品項為生產下世代先進封裝之玻璃基板所需之搭配自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)之去膠渣電漿設備，其高單價特性使其成為該年度第四大客戶，爾後受全球PC與伺服器市場需求疲弱、庫存過高及產能利用率下降影響，以及AI領域面臨市場競爭加劇，致A4公司整體營運狀況不佳，且玻璃基板之先進封裝尚未量產，故自113年度起退出前十大，經評估其變動尚屬合理。

A5. A5公司

A5公司於2011年成立於中國，主要從事AMOLED(主動矩陣有機發光二極體顯示器)相關產品生產。該公司與A5公司自110年開始往來，主要銷售項目為電漿極化機及維修零配件。112及113年度該公司對A5公司銷售淨額分別為55,193千元及227千元，占各年度銷貨比重分別為7.24%及0.04%。其母公司集團為全球智慧手機晶片製造商之供應鏈廠商，為其專案開發超音波指紋辨識模組製程之常壓電漿極化機，致112年度為第五大客戶，113年度暫無採購需求，僅有維修零配件收入並退出前十大，114年前二季尚未

有銷售金額，經評估其變動尚屬合理。

A6. A6公司

A6公司於1968年成立於奧地利，主要從事機械和材料的貿易，業務涵蓋印刷電路板、電子裝配自動化、標籤與包裝印刷。該公司與A6公司自107年開始往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A6公司銷售淨額分別為50,151千元、23,682千元及438千元，占各年度銷貨比重分別為6.58%、4.32%及0.17%，112及113年度分別為第六大及第八大銷售客戶。A6公司為該公司在奧地利的合作經銷商，主要負責再銷售至歐洲客戶，受景氣影響新機需求減緩，故經銷商A6公司向該公司採購數量亦減少，114年前二季則僅有維修收入並退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A7. A7公司

A7公司於2019年成立於中國，為上市公司之子公司，主要從事高階半導體封裝載板之生產，產品主要用於高速運算、5G、AI、IoT、車用電子等市場應用。該公司自110年開始與A7公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A7公司銷售淨額分別為43,824千元、66,002千元及282千元，占各年度銷貨比重分別為5.75%、12.05%及0.11%，112及113年度分別為第七大及第二大銷售客戶。

A7公司於111年度建設BT及ABF載板新廠，故訂購多台電漿設備，預計於111~112年度間分批交貨，惟後續受全球半導體市場需求不振影響，A7公司與該公司協商遞延交貨時程，使較多機台於113年度認列收入，因新廠計畫剛完成，故114年前二季僅有維修收入並退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A8. A8公司

A8公司於2021年成立於馬來西亞，母公司為歐系高階印刷電路板和IC載板的領導製造商，A8公司為母公司100%持有之轉投資公司，主要從事高階半導體封裝載板生產製造。該公司於111年開始與A8公司交易往來，主要銷售項目主要為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A8公司銷售淨額分別為34,821千元、21,218千元及3,286千元，占各年度銷貨比重分別為4.57%、3.87%及1.29%。

A8公司主係其集團因應處理器大廠產品生產線所設立，於113年開始營運，因此陸續於112及113年銷售機台，因大多於112年交機，112年度為第八大銷售客戶，113年度數量較少而退出前十大之列，114年前二季僅有維修收入，經評估其變動尚屬合理。

A9. A9公司

A9公司於民國105年設立，為上市公司之子公司，於111年設立南科分公司，主要從事軟性印刷電路板(FPC)及SMT表面貼裝服務之設計與製造，產品運用鎖定AR/VR/MR、家用智慧裝置、光模組及車用電子。該公司自112年開始與A9公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機及維修零配件。112及114年前二季該公司對A9公司銷售淨額分別為33,000千元及260千元，占各年度銷貨比重分別為4.33%及0.10%。

A9公司南科廠之定位為生產更高端、結構和精密度要求更複雜的軟板產品，112年度因設廠需求採購品項為較高單價之卷對卷設備，為該年度第九大銷售客戶，113年度無新機採購需求，114年前二季僅有維修訂單，經評估其變動尚屬合理。

A10.A10公司

A10公司於2011年成立於中國，母公司為歐系高階印刷電路板和IC載板的領導製造商，A10公司為母公司100%持有之轉投資公司，主要從事高密度印刷電路板(HDI PCB)和高端半導體封裝載板的開發、設計、生產與銷售。該公司與A10公司於104年開始交易往來，主要銷售項目主要為電漿去膠渣機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A10公司銷售淨額分別為20,610千元、2,116千元及49千元，占各年度銷貨比重分別為2.70%、0.39%及0.02%。112年度A10公司為提升產能需求，採購高單價之電漿設備故成為第十大客戶，113年度起則為維修訂單，故退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A11.A11公司

A11公司於民國94年設立，主要從事半導體生產設備、液晶生產設備、半導體實裝設備、遮斷器設備、電子零組件、材料、資訊設備等的銷售、進出口、安裝和維護。該公司自102年開始與A11公司交易往來，主要銷售項目為電漿去膠渣機、電漿蝕刻機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A11公司銷售淨額分別為19,008千元、78,619千元及17,784千元，占各年度銷貨比重分別為2.49%、14.36%及6.96%。

A11公司為該公司拓展日系客戶之經銷商，主要負責再銷售該公司設備至日本客戶，核心客戶包含日系PCB及IC載板大廠。受益於日系大廠終端客戶對於先進半導體所需晶片封裝基板之需求，113年度對透過A11公司下單需求增加，且多為高單價之連續式電漿設備，故成為113年度第一大銷貨客戶，114年前二季因銷售機台數量減少，退居第七大，經評估其變動尚屬合理。

A12.A12公司

A12公司於2022年成立於中國，母公司為中國領先高密度互連(HDI)與

半導體封裝基板製造商之一，產品涵蓋載板、類載板、高階及任意層互連HDI、軟硬結合板及軟板、貼片及組裝、動力電池模塊等。A12公司係集團設立於廈門的子公司，專注於高端封裝基板和高密度互連（HDI）技術的研發與製造，為集團在中國半導體封裝基板領域的重要佈局，113年度受益於集團生產設備資本支出建設之規劃，開始與該公司交易往來，採購項目為高單價之連續式電漿設備，交易金額為46,202千元，成為113年度第三大銷貨客戶，114年前二季僅有維修收入6千元，故退出前十大之列，經評估其變動尚屬合理。

A13.A13公司

A13公司於2023年成立於中國，母公司為專注於顯示產業雷射修復與切割自動化設備的高新技術企業，產品涵蓋LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等全製程雷射精密修復與切割設備。A13公司為該公司中國地區經銷商之一，113年首度將暉盛機台成功銷售至大陸半導體面板級封裝客戶，且為高單價之連續式且搭配自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)之電漿蝕刻機設備，銷售金額46,051千元，占比8.41%，為該年度第四大銷售客戶，114年前二季則尚未有機台及維修訂單交易，經評估其變動尚屬合理。

A14.A14公司

A14公司於民國99年設立，主要從事精密化學品之生產製造與銷售，為台灣半導體特殊氣體及先進材料供應商，與該公司自113年度開始交易，主要銷售項目為電漿蝕刻機。113年度該公司為A14公司開發出應用於晶圓重生代工產品線之自動化晶圓載卸檢測設備(EFEM)電漿蝕刻機，銷售金額為25,890千元，占比4.73%，使其成為113年度第七大銷售客戶，114年前二季則尚未有交易往來，經評估其變動尚屬合理。

A15.A15公司

A15公司於民國85年設立，主要從事衛星通訊系列產品之生產製造與銷售，產品涵蓋Wi-Fi、5G、車聯網、衛星通訊等領域，與該公司自105年度開始交易，主要銷售項目為電漿清洗機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A15公司銷售淨額分別為6,139千元、23,193千元及6,598千元，占各年度銷貨比重分別為0.81%、4.24%及2.58%。

112年度因Wi-Fi 6/6E產品出貨增加、車用通訊電子模組需求上升，以及低軌道衛星通訊產品的導入，而向該公司採購設備，113年度因其車用產品出貨量回升，而增加對該公司電漿設備之需求，故成為第九大銷售客戶；此外，A15公司為低軌衛星業者台廠供應鏈業者之一，因應地緣政治問題，業者要求供應商需擴大兩岸以外的產能，近年A15公司積極擴大越南產能，114年前二季主要由越南子公司與該公司交易，銷售機台數量減少而退出前十大，經評估其變動尚屬合理。

A16.A16公司

A16公司於2013年成立於中國，主要從事電子產品的研發、加工與銷售；機電設備及配件的製造、銷售與維修。該公司自108年與A16公司交易往來，其為該公司於中國地區經銷商之一，112及113年度主要向該公司採購電漿去膠渣設備，銷售淨額分別為14,225千元及22,047千元，占各年度銷貨比重分別為1.87%及4.03%。113年度A16公司主要採購項目為封裝基板廠所需設備，該封裝基板廠113年度因量產啟動與市場拓展需求設備較多，故透過A16公司採購機台增加，該公司對A16公司銷售金額成長，為該年度第十大客戶；114年前二季則尚未有機台及維修零配件之交易，經評估其變動尚屬合理。

A17.A17公司

A17公司於2023年成立於中國，並自114年起與該公司展開交易往來，主要採購產品為電漿去膠渣設備，銷售淨額為36,152千元，占114年前二季銷貨比重14.14%。A17公司主營業務為生產與銷售 FC-BGA(ABF)高端封裝基板，應用領域涵蓋 CPU、GPU、AI 晶片及車載高算力晶片封裝。自113年啟動三期建設計畫以來，第一期高端載板專案的推進帶動其對該公司產品需求增加，致使其於114年前二季成為該公司第一大客戶，經評估變動尚屬合理。

A18.A18公司

A18公司於民國77年設立，主要從事印刷電路板之製造及買賣，產品應用於網通產品、工業電腦、AI伺服器產品、半導體設備等，與該公司自111年度開始交易，主要銷售項目為電漿去膠渣及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A18公司銷售淨額分別為21千元、6,582千元及23,737千元，占各年度銷貨比重分別為0.00%、1.20%及9.28%。113年度下半年起受益於高速運算(HPC)趨勢帶動交換器升級及AI應用的興起，A18公司營運回升跡象明顯，啟動擴產計畫，故對該公司採購設備隨之增加，於114年前二季成為第三大銷售客戶，經評估其變動尚屬合理。

A19.A19公司

A19公司於2023年設立，主要從事PCB之製造與銷售，主要以記憶卡、遊戲機與高階工業應用用板為主。近年因應地緣政治問題，許多國際大廠將東南亞視為未來3~5年的首選生產基地，其母公司亦開始積極擴大海外產能，114年前二季因泰國新廠啟用，故對該公司機台需求增加，主要採購電漿去膠渣設備，銷貨金額為22,286千元，占比8.72%，成為第四大客戶，經評估其變動尚屬合理。

A20.A20公司

A20公司於民國91年設立，主要從事視覺與自動化設備之研發、製造及銷售暨代理，與該公司自96年度開始交易，主要銷售項目為電漿去膠渣機、電漿清洗機及維修零配件。112~113年度及114年前二季該公司對A20公司銷售淨額分別為16,472千元、436千元及21,141千元，占各年度銷貨比重分別為2.16%、0.08%及8.27%。A20公司主係採購該公司設備並再銷售予從事印刷電路板及IC載板製造之客戶，113年度受消費性電子淡季影響，對該公司設備需求減少僅有維修收入；114年前二季受益消費性電子與網通交換器帶動ABF載板銷售復甦，對該公司採購設備隨之增加，於114年前二季成為第五大銷售客戶，經評估其變動尚屬合理。

A21.A21公司

A21公司於1984年設立於美國，主要專注於為半導體與平面顯示產業提供高純度化學解決方案，產品涵蓋顯影液、銅電鍍液與添加劑，已廣泛使用於半導體相關先進製程。該公司自114年度與A21公司開始交易，114年前二季該公司對A21公司銷售淨額為9,765千元，占銷貨比重為3.82%，A21公司向該公司主要採購電漿去膠渣機設備，作為模擬終端客戶IC載板製程，在使用化學品前進行測試之用，114年前二季成為第九大客戶，經評估其變動尚屬合理。

A22.A22公司

A22公司於2018年成立於新加坡，主要從事工業機械與設備的安裝、機械工程作業。該公司自107年與A22公司交易往來，其為該公司於新加坡地區經銷商，112~113年度及114年前二季主要向該公司採購電漿去膠渣設備及維修零配件，銷售淨額分別為9,646千元、980千元及8,928千元，占各年度銷貨比重分別為1.27%、0.18%及3.49%。A22公司主係採購該公司設備並再銷售予日本PCB製造公司之新加坡子公司。近年隨著AI、電動車和高效能運算等新興技術的發展，新加坡PCB商營運尚屬穩定發展，該公司各年度對A22公司的銷貨收入主係受新加坡PCB商需求變動，經評估其變動尚屬合理。

綜上所述，該公司112~113年度及114年前二季之主要銷售對象變化之情形尚屬合理，並無重大異常情形。

(3)是否有銷售集中之風險

暉盛公司主要從事電漿製程設備之開發、製造與銷售，並提供相關製程參數優化、客製模組整合與智慧化維運服務。產品廣泛應用於半導體晶圓、先進封裝、載板、再生晶圓、感測器等產業，其銷售對象係以國內外於半導體、印刷電路板(PCB)、光電等產業大廠。112~113年度及114年前二季對前十大主要銷貨對象之銷售比率分別為78.30%、74.94%及79.79%；其中各年度銷售與最大客戶占整體營收比例分別為16.67%、14.36%及14.14%，112~113年度及114

年前二季未有銷售客戶占比超過 30%而產生銷貨集中之情形。該公司於半導體及 PCB 產業深耕多年，主要客戶多為產業大廠，品質深獲肯定，且該公司產品多為通過合格認證後始成為長期往來供應商，各年度銷貨排行易受銷售客戶之擴廠需求或產線擴充資本支出計畫、銷售產品規格不同及半導體市場發展趨勢等因素影響。

(4)發行公司之銷售政策

該公司深耕電漿製程設備之設計、製造組裝、銷售及售後服務已超過二十年，其技術、品質及服務在市場占有一席之地，未來擬透過下列銷售政策，以持續拓展公司業務並維繫公司競爭利基：

A.持續深耕半導體、IC 載板、PCB 及光電產業，以掌握製程發展趨勢

針對產業日益月新技術所帶來製程變化，該公司以長期累積之設備高彈性客製化開發能力，配合既有客戶新製程彈性化設計開發新設備，以擴大市場占有率，並同時以既有產品開拓潛在新客戶及積極參與重要商展，強化產品於市場之曝光度與口碑。

B.運用既有核心技術，積極拓展新產品新產業應用領域

為降低以往銷售客戶集中於半導體等產業之現象，該公司持續投入研發資源開發綠色製程技術，如：氫能源應用、廢棄物與尾氣裂解處理及低碳製程替代方案等，可有效提升資源運用效率，協助客戶製程或產品符合環保法規並減輕對環境的負荷，於減廢節能環保同時並響應 ESG 永續發展趨勢。

C.以「以質取勝」策略推廣市場

該公司憑藉扎實技術能力於台灣、中國、歐美及日本等知名國際半導體、PCB 及光電產業之供應鏈中站穩腳步，近年來更成功取得國際頂尖廠商特定製程之認證與認可。該公司可提供彈性並多樣之解決方案，未來將以更先進技術及高彈性客製化服務提高客戶黏著度，並積極拓展具有發展潛力之客戶群，持續擴大公司之營運規模，為整體營收及獲利能力挹注成長動能。

2.最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

(1)最近期及最近二個會計年度主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年前二季			
	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人關係
1	B1	36,704	14.92	無	B3	27,743	12.94	無	B3	16,161	13.17	無
2	B2	31,327	12.74	無	B4	24,485	11.43	無	B4	15,784	12.86	無
3	B3	27,617	11.23	無	B1	20,926	9.76	無	B1	12,087	9.85	無
4	B4	27,415	11.14	無	B5	19,714	9.20	無	B2	11,061	9.01	無
5	B5	15,187	6.17	無	B11	12,795	5.97	無	B5	10,244	8.35	無
6	B6	14,055	5.71	無	B2	12,414	5.79	無	B9	5,230	4.26	無
7	B7	10,491	4.26	無	B12	9,650	4.50	無	B13	4,980	4.06	無
8	B8	8,820	3.59	無	B7	6,998	3.27	無	B8	4,323	3.52	無
9	B9	7,137	2.90	無	B9	6,695	3.12	無	B10	3,845	3.13	無
10	B10	6,289	2.56	無	B10	5,913	2.76	無	B14	3,843	3.13	無
	其他	60,954	24.78		其他	66,991	31.26		其他	35,187	28.66	
	進貨淨額	245,996	100.00		進貨淨額	214,324	100.00		進貨淨額	122,745	100.00	

資料來源：該公司提供。

(2)最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

該公司主要從事各式電漿設備之研發、製造與銷售，主要原物料為機構件、真空幫浦、電源供應器、真空元件及流量計等。該公司以訂單式生產為主，除部分交期較長之共用性原物料，如電源供應器及真空幫浦，為確保原物料交期穩定而採一次性批量購買，多數原物料皆為接單後始進行下單採購，故進貨金額主係受公司營運訂單增減所變動。112~113 年度及 114 年前二季之前十大供應商進貨金額占各年度進貨淨額比重分別為 75.22%、68.74%及 71.34%，茲就該公司主要供應商之變化情形分析說明如下：

A.B1 公司

B1公司於民國98年設立，主要從事自動化機械設備及零件之銷售，該公司自98年開始與B1公司交易，主要向其採購自動化設備如自動化輸送機。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為36,704千元、20,926千元及12,087千元。因B1公司在自動化設備領域擁有優良之技術，產品品質良好，故為該公司自動化機械設備主要供應商，分別為各年度第一大、第三大及第三大供應商。112年度因該公司營運表現佳故進貨金額較高；113年度受該公司業績下滑影響採購金額較112年減少；114年前二季因預計出貨自動化單雙腔及連續式清洗機訂單增加，致採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

B.B2 公司

B2公司於民國96年設立，主要從事各式自動化設備之製造與銷售。該公司自109年開始與B2公司交易，主要向其採購項目為自動上下料機械設備。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為31,327千元、12,414千元及11,061千元，分別為各年度第二大、第六大及第四大供應商。113年度因受該公司業績下滑，且搭載自動上下料性能之設備訂單減少，致採購金額減少；114年前二季因該公司業績回升，搭載自動上下料性能訂單增加，致採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

C.B3 公司

B3公司於民國92年設立，主要從事真空腔體及真空管路等零件加工與銷售。該公司自94年開始與B3公司交易，主要向其採購真空腔體、真空管路及真空元件。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為27,617千元、27,743千元及16,161千元，分別為各年度第三大、第一大及第一大供應商。112~113年度進貨金額變化不大；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

D.B4 公司

B4公司於民國87年設立，主要從事各式幫浦系統、測試儀器及零配件等之製造與銷售。該公司自94年開始與B4公司交易，主要向其採購真空幫浦。

112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為27,415千元、24,485千元及15,784千元，分別為各年度第四大、第二大及第二大供應商。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

E.B5 公司

B5公司於民國68年設立，為國內上櫃公司，主要從事晶圓再生、半導體濕製程設備、LED、太陽能與FPD製程設備製造與銷售，及代理銷售電源供應器。該公司自102年開始與B5公司交易，主要向其採購電源供應器。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為15,187千元、19,714千元、10,244千元，分別為各年度第五大、第四大及第五大供應商。113年度因採用高單價電源供應器訂單需求占比增加，以及因應客製化需求添購B5公司代理之真空設備機械手臂，故採購金額較112年增加；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

F.B6 公司

B6公司於民國99年設立，主要從事自動化設備及五金零件之製造與銷售。該公司自107年開始與B6公司交易，主要向其採購項目為自動化單腔設備。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為14,055千元、1,139千元及1,481千元。113年度因受該公司自動化單腔設備訂單減少，故採購金額下降；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額上升，整體而言變化情形尚屬合理。

G.B7 公司

B7公司於民國77年設立，為國內上櫃公司，主要從事自動化設備及零件之製造與銷售。該公司自110年開始與B7公司交易，主要向其採購項目為自動化設備。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為10,491千元、6,998千元及0千元，112~113年度分別為第七大及第八大供應商，114年前二季暫無交易而退出前十大。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年前二季因無搭載B7公司自動化設備之訂單，故未向其採購，整體而言變化情形尚屬合理。

H.B8 公司

B8公司於民國100年設立，主要從事卷對卷製程設備之製造與銷售。該公司自112年開始與B8公司交易，主要向其採購卷對卷處理機。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為8,820千元、0千元及4,323千元。B8公司為國內卷對卷設備專業廠商，具備專業水平度/平行度校正技術及3D建構設計，因其技術領先及交期可符合該公司要求，故於112年向其採購卷對卷處理機，擠身前十大供應商之列，113年度因受該公司業績下滑影響，113年尚無交易，114

年前二季因搭載卷對卷處理機之設備訂單增加，致採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

I.B9 公司

B9公司於民國93年設立，主要從事日本品牌空油壓元件與電動缸之代理、車銑床機械加工、機械五金及電控材料之製造與銷售。該公司自94年開始與B9公司交易，主要向其採購台車、邊框及車銑床零件。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為7,137千元、6,695千元及5,230千元，分別為各年度第九大、第九大及第六大供應商。112~113年度進貨金額變化不大；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

J.B10 公司

B10公司於民國103年設立，主要從事鈹金零件加工。該公司自103年開始與B10公司交易，主要向其採購項目為骨架、鋁電極及鈹金件等。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為6,289千元、5,913千元及3,845千元，分別為各年度第十大、第十大及第九大供應商。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

K.B11 公司

B11公司於民國107年設立，主要從事代理銷售電漿產生裝置及電源供應器。該公司自108年開始與B11公司交易，主要向其採購項目為電源供應器。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為586千元、12,795千元及1,122千元。113年度因應客製化訂單，採用B11公司代理之電源供應器需求增加，故採購金額上升成為第五大供應商；114年前二季搭載B11公司代理之電源供應器訂單減少，故採購金額下降，整體而言變化情形尚屬合理。

L.B12 公司

B12公司於民國78年設立，為國內上市公司，主要從事自動化設備開發及系統整合應用。該公司自112年開始與B12公司交易，主要向其採購上下料之自動化模組及加熱載台。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為1,000千元、9,650千元及0千元。113年因配合客戶指定上下料之自動化模組廠商採用B12公司產品，故進貨金額較高，擠身前十大供應商之列。114年前二季因無搭載B12公司上下料之自動化模組訂單，故未向其採購，整體而言變化情形尚屬合理。

M.B13 公司

B13公司於民國94年設立，主要從事電漿電源供應器之銷售。該公司自95年開始與B13公司交易，主要向其採購電源供應器。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為1,860千元、5,203千元及4,980千元。113年度起因應客製化電漿清洗機訂單，採用B13公司代理之電源供應器需求增加，故採購金額逐期上升，整體而言變化情形尚屬合理。

N.B14 公司

B14公司於民國92年設立，主要從事代理流量計、濺鍍製程電源供應器、石墨及碳纖等銷售。該公司自94年開始與B14公司交易，主要向其採購流量計及真空元件。112~113年度及114年前二季之進貨金額分別為4,515千元、3,623千元及3,843千元。113年度因受該公司業績下滑，故採購金額下降；114年前二季因預計出貨之真空設備訂單增加，故採購金額增加，整體而言變化情形尚屬合理。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季對主要供應商之採購金額及比率變化，主要受客戶訂單、客戶預計訂單排程及進貨廠商交期配合度等因素之影響而有所變動。整體而言，該公司主要供應商及交易金額變化情形尚屬合理，並未發現有重大異常之情事。

(3)是否有進貨集中風險之評估

該公司主係依據產品品質、價格及交期配合度選擇進貨供應商，而電漿設備主要原料為機構件、真空幫浦及電源供應器等，主要原料均與兩家以上供應商維持往來關係，以達分散採購過度集中風險、確保供貨來源穩定性以及管控進貨成本之效，且該公司 112~113 年度及 114 年前二季均無對單一供應商進貨比重超過 30%以上之情事。綜合上述，該公司應尚無進貨集中之虞。

(4)公司之進貨政策

該公司之生產方式以訂單式生產為主，或依預估之客戶訂單量，參考現有庫存量依產能狀況排定採購計畫。該公司確保產品品質、價格合理、交貨配合及供貨穩定等因素作為遴選供應商及更換供應商之依據，主要原料皆至少維持二家以上供應商，以分散進料供應商原、物料短缺風險，並針對交期長且採購量大之原物料採一次性批量購買，並依生產排程及訂單交期分次進貨，以保障供貨品質及價格之穩定性。截至評估報告出具日止，該公司與各供應商均能維持良好合作關係，並未有供貨中斷或短缺之情事，其進貨政策尚無重大異常。

(二)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、母子公司備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.應收款項變動之合理性

單位：新台幣千元

財報類型		合併財務報告			個體財務報告		
年度/項目		112年度	113年度	114年前二季	112年度	113年度	114年前二季
營業收入淨額		762,039	547,630	255,655	762,120	546,155	254,257
應收款項 總額(A)	應收票據	47	195	—	47	195	—
	應收帳款	274,566	236,942	249,851	273,765	234,781	248,626
	應收帳款-關係人	—	—	—	1,068	1,806	1,048
	應收款項總額	274,613	237,137	249,851	274,880	236,782	249,674
減：備抵呆帳提列數(B)		6,289	4,123	4,222	6,281	4,117	4,214
應收款項淨額(A)-(B)		268,324	233,014	245,629	268,599	232,665	245,460
備抵損失提列比率(B)/(A)%		2.29	1.74	1.69	2.28	1.74	1.69
應收款項週轉率(次)		2.73	2.14	2.10	2.74	2.13	2.09
應收款項收現天數(天)		134	171	174	134	172	175
授信條件		依該公司「授信管理辦法」規定，由業務部門考量客戶營運規模、財務狀況、歷史交易紀錄等提出信用額度評估，經業務權責主管核准後，會簽財會部門表示專業意見，並視個別合約或訂單約定不同階段收取之訂金款、交機款、驗收款及保固款之收款條件，其收款條件主要如下： 1.非關係人：國內依發票日、國外依客戶通知起，月結30~180日。 2.關係人：月結90日。					

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告；該公司提供。

註1：應收款項週轉率均係以應收款項總額計算。

(1)合併

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季合併營業收入淨額分別為 762,039 千元、547,630 千元及 255,655 千元，期末應收款項總額分別為 274,613 千元、237,137 千元及 249,851 千元。112 年度受消費性電子市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板及印刷電路板供過於求使得 IC 載板及印刷電路板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自 112 年度起出現訂單推遲現象，113 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致該公司 113 年度營業收入較前年同期減少，並導致 113 年底期末應收款項總額隨營業收入下滑而較 112 年底減少 13.65%；而至 114 年 6 月底，原期初遞延交機之客戶已於第二季陸續完成出貨並確認交機入帳，隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，帶動 114 年前二季營業收入已有逐步回穩之跡象，114 年 6 月底應收款項餘額較 113 年底應收款項總額增加 5.36%。

依應收款項週轉率觀之，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季

合併應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 2.10 次，應收款項收款天數分別為 134 天、171 天及 174 天。受營業收入持續減少影響，該公司及其子公司應收款項週轉率呈持續下滑情形。因該公司及其子公司主要營收來源為精密電漿設備銷售，其應收款項帳齡較長部分主要來自設備銷售尾款(驗收款或保固款)，受產業特性影響，驗收款須待客戶產線運作順暢或結合其他製程段設備偕同生產無虞後，依其內部作業程序啟動驗收流程並進行付款程序，依客戶別不同，通常需待交機完成日後約 1 年內始進行驗收，客戶才會依交易條件支付。保固款則須待提供之保固期滿(普遍保固期為 1 年，部分客戶為 2 年)才進行收款，故銷售尾款帳齡普遍較長。整體而言，該公司因行業特性應收款項餘額高低係隨著設備銷售收入增減，進而影響應收帳款週轉率之變化，經評估，該公司及其子公司 112~113 年及 114 年前二季合併應收款項總額及週轉率變動情形應屬合理，尚無發現重大異常之情事。

(2)個體

該公司 112~113 年度及 114 年前二季個體營業收入淨額分別為 762,120 千元、546,155 千元及 254,257 千元，期末應收款項總額分別為 274,880 千元、236,782 千元及 249,674 千元，個體應收款項週轉率分別為 2.74 次、2.13 次及 2.09 次，應收款項收款天數分別為 134 天、172 天及 175 天，由於個體各期營業收入、應收款項總額、應收款項週轉率之變化原因皆與合併數相同，故不另行分析。

綜上所述，經評估該公司 112~113 年度及 114 年前二季之合併及個體應收款項及應收款項週轉率變動，並無發現重大異常，其變動尚屬合理。

2.合併及個體備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1)合併及個體備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用國際財務會計準則 IFRS9 之相關規定，採用簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收票據及應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務及產經狀況等。112、113 年度及 114 年第一季該公司及其子公司依信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率；114 年第二季起，該公司及其子公司按客戶所在地區之貿易信用風險特性將對客戶之應收款項分組，並以應收票據及應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。綜上考量後，將應提列備抵呆帳金額與帳上已認列之備抵呆帳餘額比較；如有不足，應將不足部分認列當期預期信用減損損失；如帳上已認列餘額較多時，則將超過部分當期迴轉預期信用減損損失。茲就該公司及其子公司之預期信用損失率彙整如下：

A.112、113年度及114年第一季

逾期天數	30天以下	31-90天	91-180天	181-365天	一年以上	已有減損跡象
提列比率	0%~1%	0%~1%	0%~5%	0%~20%	0%~50%	100%

資料來源：該公司提供。

B.114年第二季

依據客戶交易往來紀錄、市場地位及所在地區等進行信用風險評比，區分客戶信用風險等級為低及中風險客戶群

(A)低風險客戶群

逾期天數	30天以下	31-90天	91-180天	181-365天	一年以上	二年以上
提列比率	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	25%	50%

資料來源：該公司提供。

(B)中風險客戶群

逾期天數	30天以下	31-90天	91-180天	181-365天	一年以上	二年以上
提列比率	1%	1%	5%	20%	50%	100%

資料來源：該公司提供。

綜上所述，該公司及其子公司多與國內外知名企業進行交易，經參酌個別客戶之信用狀況、收款情形及過去有無實際發生呆帳之經驗後，於期末依應收帳款逾期天數之預期信用損失率評估備抵呆帳，經評估其備抵損失提列政策尚屬合理。

(2)合併及個體備抵損失提列之適足性

單位：新台幣千元

項目	合併財務報表			個體財務報表		
	112 年底	113 年底	114 年 6 月底	112 年底	113 年底	114 年 6 月底
備抵損失金額(A)	6,289	4,123	4,222	6,281	4,117	4,214
應收款項總額(B)	274,613	237,137	249,851	274,880	236,782	249,674
提列比率(A)/(B)	2.29	1.74	1.69	2.28	1.74	1.69

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司提供。

A.合併

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年 6 月底之合併備抵損失占應收款項總額比率分別為 2.29%、1.74%及 1.69%，經核閱該公司應收帳款帳齡表，該公司主要客戶多為長期往來對象及國內外知名企業及產業指標性龍頭廠商，其歷史收款紀錄良好。112~113 年度及 114 年前二期期間，該公司銷售客戶因申請破產重整，其帳款經評估收回可能性微小，故於 112 年將該客戶已 100%提列之備抵損失 62 千元之應收帳款全數沖銷；113 年另筆泰國客戶產品因退運進行銷毀，無法向客戶收取之應收款項 23 千元亦予沖銷外，其餘應

收款項並未實際發生壞帳而有無法收回之情事，前述實際發生之壞帳金額微小，壞帳產生原因亦屬合理，尚無重大異常情事。

B. 個體

該公司 112~113 年底及 114 年 6 月底之個體備抵損失占應收款項總額比率分別為 2.28%、1.74%及 1.69%，該公司 112~113 年度及 114 年前二期期間，除 113 年將泰國客戶無法收取之應收款項 23 千元沖銷外，其餘並無實際發生壞帳費用之情事，且已發生之壞帳金額尚不重大，原因亦屬合理，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司業已針對客戶的規模、營運情況、交易金額及未來訂單需求之不同給予適當的授信條件，定期檢視個別客戶經營狀況以確保帳款之收回可能性，故其合併及個體備抵損失提列金額尚屬合理，應足以涵蓋應收款項可能發生壞帳之風險，適足性尚無疑慮。

(3) 應收款項收回可行性之評估

單位：新台幣千元

項 目	年度	114 年 6 月底 金額	114 年截至 8 月底 收回情形		114 年截至 8 月底 未收回情形	
			金額	比率(%)	金額	比率(%)
合併 財務報告	應收票據	—	—	—	—	—
	應收帳款	249,851	103,772	41.53	146,079	58.47
	合 計	249,851	103,772	41.53	146,079	58.47
個體 財務報告	應收票據	—	—	—	—	—
	應收帳款	248,626	102,547	41.25	146,079	58.75
	應收帳款-關係人	1,048	1,048	100.00	—	—
	合 計	249,674	103,595	41.49	146,079	58.51

資料來源：該公司經會計師核閱之財務報告；該公司提供之自結數

A. 合併

該公司及其子公司 114 年 6 月底合併之應收款項總額共計 249,851 千元，截至 114 年 8 月 31 日止，應收帳款已收回 103,772 千元，收回比例為 41.53%，未收回金額為 146,079 千元，未收回比率為 58.47%，而未收回款項中 123,917 千元係屬未逾期之款項，另逾期款項包含交機款 12,945 千元、待驗收後請款之驗收款 6,327 千元及保固款 2,890 千元，共計 22,162 千元，須待客戶內部檢驗流程、驗收後及保固期滿後依訂單或合約所載之收款天數內收款。因產業特性通常客戶係於交機完成日後 1 年始進行機台驗收並啟動驗收付款程序，保固款則須待驗收後起算保固年限，惟依該公司之授信政策超過授信期限之帳款仍列為逾期款進行追蹤。

綜上所述，逾期應收款項尚未收回原因尚屬合理。惟該公司及其子公司仍透過業務人員跟催掌握客戶付款時程及即時追蹤客戶尚未付款原因，並依信用管理作業按授信額度控管後續交易情形，業已依政策提列適足備抵損失。

此外，該公司之銷售客戶多數往來已久，根據產業特性、授信條件及以往收款經驗觀之，應收款項期後收款情形尚屬良好，經評估該公司應收款項之收回可能性尚無重大疑慮。

B.個體

該公司 114 年 6 月底個體之應收款項總額共計 249,674 千元，截至 114 年 8 月 31 日止，應收關係人帳款已全數收回；應收帳款已收回 102,547 千元，收回比例為 41.25%，未收回金額為 146,079 千元，未收回比率為 58.75%。該公司個體應收款項逾期未收回之原因與合併數相同，故不另行分析。

3.與同業比較

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度		113 年度		114 年前二季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
營業收入 淨額	暉盛	762,039	762,120	547,630	546,155	255,655	254,257
	志聖	3,625,801	1,892,397	4,818,209	2,785,622	2,819,153	註 1
	友威科	744,579	611,134	660,171	574,462	203,939	註 1
	鈦昇	1,549,374	1,154,330	1,644,908	1,329,088	689,431	註 1
應收款項 總額(B)	暉盛	274,613	274,880	237,137	236,782	249,851	249,674
	志聖	2,022,428	972,865	2,115,172	954,022	2,159,067	註 1
	友威科	270,942	157,806	209,702	165,710	141,520	註 1
	鈦昇	452,066	397,592	536,589	499,378	497,192	註 1
備抵損失 (A)	暉盛	6,289	6,281	4,123	4,117	4,222	4,214
	志聖	276,026	163,203	285,827	189,130	293,317	註 1
	友威科	22,792	20,826	50,090	49,929	29,862	註 1
	鈦昇	10,737	7,370	4,824	2,602	10,528	註 1
備抵損失 提列比率 %(A)/(B)	暉盛	2.29	2.28	1.74	1.74	1.69	1.69
	志聖	13.65	16.78	13.51	19.82	13.59	註 1
	友威科	8.41	13.20	23.89	30.13	21.10	註 1
	鈦昇	2.38	1.85	0.90	0.52	2.12	註 1
應收款項 週轉率 (次)	暉盛	2.73	2.74	2.14	2.13	2.10	2.09
	志聖	1.54	1.54	2.33	2.89	2.64	註 1
	友威科	2.88	4.01	2.75	3.55	2.32	註 1
	鈦昇	2.50	2.02	3.33	2.96	2.67	註 1
應收款項 收現天數 (天)	暉盛	134	134	171	172	174	175
	志聖	238	238	157	127	139	註 1
	友威科	127	92	133	103	158	註 1
	鈦昇	146	181	110	124	137	註 1

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告暨該公司提供之資料。

註 1：採樣同業並無出具經會計師核閱之個體財務報告。

(1)應收款項週轉率及週轉天數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之合併應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 2.10 次，合併應收款項平均收款天數則分別為 134 天、

171 天及 174 天；個體應收款項週轉率分別為 2.74 次、2.13 次及 2.09 次，個體應收款項平均收款天數則分別為 134 天、172 天及 175 天。與採樣同業相較，該公司 112 年度合併及個體應收款項週轉率僅次於友威科，優於志聖及鈦昇；113 年度因營收下滑，故合併及個體應收款項週轉率皆略低於採樣同業；114 年前二季受客戶下單動能影響營業收入於第二季始逐步回升，致 114 年前二季合併週轉率略低於採樣同業。然應收款項週轉率主係受各採樣公司之營業屬性與授信政策之不同而有所差異，整體而言應無重大異常情事。

(2) 備抵損失提列之適足性評估

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年 6 月底合併提列之備抵損失金額分別為 6,289 千元、4,123 千元及 4,222 千元，占合併應收款項總額之比率分別為 2.29%、1.74% 及 1.69%；個體提列之備抵損失金額分別為 6,281 千元、4,117 千元及 4,214 千元，占個體應收款項總額之比率分別為 2.28%、1.74% 及 1.69%。與採樣同業相比，112 年底及 114 年 6 月底合併備抵損失提列比率均低於採樣同業；112 年底個體、113 年底合併及個體之備抵損失提列比率均高於鈦昇，均低於志聖及友威科，經評估該公司備抵損失提列比率與同業相比尚屬允當，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司歷年來收款情形平穩，應收款項收現天數尚能符合其訂定之授信期間，顯見該公司對於應收款項之控管尚屬穩健，而其應收款項週轉率及備抵損失提列之適足性與採樣同業相較亦無重大異常之情事。

(三) 最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

1. 財務報告存貨淨額變動之合理性

單位：新台幣千元

項目	期間	合併財務報告			個體財務報告		
		112 年度	113 年度	114 年前二季	112 年度	113 年度	114 年前二季
營業收入		762,039	547,630	255,655	762,120	546,155	254,257
營業成本		470,536	332,690	144,513	469,860	336,907	144,071
原物料		38,666	34,720	32,738	38,666	34,720	32,738
在製品		109,421	33,245	38,947	109,421	33,245	38,947
製成品		2,286	911	—	2,286	911	—
商品		4,230	6,831	4,451	—	—	—
期末存貨總額		154,603	75,707	76,136	150,373	68,876	71,685
備抵存貨跌價及呆滯損失		17,661	13,093	10,974	16,120	11,266	9,667
期末存貨淨額		136,942	62,614	65,162	134,253	57,610	62,018
存貨週轉率(次)(註)		2.21	3.33	4.52	2.23	3.51	4.82
存貨週轉天數(天)		166	110	81	164	104	76

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告暨該公司提供
註：存貨週轉率係採平均存貨淨額計算之

該公司及其子公司合併財務報告編製主體包括該公司本身暨其轉投資公司 Stable 公司及金暉盛公司，Stable 公司係以控股為主，無實質營運活動，暉盛公司從事各式電漿設備之研發、生產及銷售，子公司金暉盛公司則負責中國大陸市場銷售設備售服及維修業務，故該公司之合併存貨來自該公司及金暉盛公司，而該公司存貨即占九成以上。存貨之原物料為各式電漿設備構件、真空幫浦及電源供應器等。依製令投入產生後至客戶對設備功能確認前之各式電漿設備機台及構件帳列為在製品，機台完工並經客戶確認交機完成後，由在製品轉為製成品旋即出貨轉入銷貨成本，而帳列之製成品為客戶退回重新整備之電漿設備機台，商品則為大陸子公司進行設備售服、維修業務之料件。該公司採接單式生產，依客戶訂單需求進行備料及投產，業務具高度客製化特性，故該公司之存貨變化與客戶訂單需求關係密切，茲就該公司存貨淨額及存貨週轉率變動之合理性說明如下：

(1)合併存貨淨額及存貨週轉率變動之合理性說明

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年 6 月底合併存貨淨額分別為 136,942 千元、62,614 千元及 65,162 千元。113 年底存貨淨額較 112 年底減少，主要係 113 年受美系電腦處理器(CPU)大廠業績不佳，進而影響 CPU 供應鏈之 IC 載板產業景氣下滑，來自主要客戶載板廠之設備訂單需求減少，導致該公司依訂單投入生產中的在製品存貨金額較 112 年底減少 69.62%，使存貨淨額較 112 年底減少 54.28%。114 年 6 月底合併存貨淨額較 113 年底增加，係因預計 114 年第三季起交貨之客戶訂單回溫，為因應客戶訂單需求而備料並陸續投入生產，使在製品較 113 年底增加 17.15%，並使存貨淨額較 113 年底增加 4.07%。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年前二季之合併存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 4.52 次，存貨週轉天數分別為 166 天、110 天及 81 天。受客戶訂單縮減影響 113 年營收規模減少，營業成本隨之下滑，113 年度營業成本減少 29.30%，而 113 年底因客戶資本支出計劃延宕，考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，存貨淨額減少 54.28%，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度，致存貨週轉率較 112 年度上升，存貨週轉天數減少。114 年前二季存貨週轉率較 113 年度上升，平均存貨週轉天數下降，主係受 112 年底存貨基期較高影響，平均存貨下降所致。

(2)個體存貨淨額及週轉率變動之合理性說明

該公司 112~113 年底及 114 年 6 月底個體存貨淨額分別為 134,253 千元、57,610 千元及 62,018 千元。在個體存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年前二季之個體存貨週轉率分別為 2.23 次、3.51 次及 4.82 次，存貨週轉天數分別為 164 天、104 天及 76 天，由於個體各期存貨淨額及週轉率變動與合併報表變動原因相同，因此不另行分析。

綜上所述，該公司及其子公司採訂單性生產，112~113 年度及 114 年第二季

之存貨淨額以及存貨週轉率變動情形主係隨客戶訂單及市場需求而有所變動，經評估尚無重大異常之情事。

2. 備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

(1) 備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策合理性

存貨跌價損失方面，該公司及其子公司存貨以取得成本為入帳基礎，成本之計算係採加權平均法，後續衡量係針對庫齡 180 天內之存貨係採成本與淨變現價值孰低法，比較成本與淨變現價值孰低時，係採逐項比較法為基礎。淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入估計之成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

存貨呆滯損失方面，原物料主要為設備料件，係為了配合電漿設備生產製造所需，及設備使用後維修或零件更換所使用，非屬快速汰換之產品，故除不良品提列 100% 外，針對庫齡逾 181 天以上之存貨採個別認定，並依提列政策提列備抵存貨呆滯損失，其呆滯提列政策如下：

庫齡天數	1-180 天	181-360 天	361-720 天	721-1440 天	1441 天以上	不良品
提列比率	0%	10%	20%	50%	100%	100%

資料來源：該公司提供

該公司在製品與製成品存貨係屬客製化接單生產，原則上投產時係依客戶訂單需求，故無呆滯之情事，惟如遇客戶取消、變更訂單或銷貨退回等情事時，造成該在製品或製成品已無有效對應之訂單時，則採逐項檢視，經評估如有減損跡象，則依據提列政策提列備抵存貨呆滯損失。商品主要為子公司帳列供大陸客戶修繕料件之備品，係由母公司提供，子公司按庫齡依提列政策提列備抵存貨呆滯損失。

綜上所述，該公司及其子公司除對於存貨淨變現價值低於成本者提列存貨跌價損失外，並針對不同庫齡區間之存貨訂定呆滯提列比率，其比率之訂定係綜合考量所屬行業特性、原物料保存期限、存貨未來銷售可能性及相關營運風險等因素訂定評價政策。整體而言，其存貨跌價與呆滯提列政策應尚屬合理。

(2) 備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列適足性之評估

單位：新台幣千元

項目	年度	合併財務報告			個體財務報告		
		112 年底	113 年底	114 年 6 月底	112 年底	113 年底	114 年 6 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失		17,661	13,093	10,974	16,120	11,266	9,667
期末存貨總額		154,603	75,707	76,136	150,373	68,876	71,685
備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率(%)		11.42	17.29	14.41	10.72	16.36	13.49

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告暨該公司提供。

A. 合併備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

該公司及其子公司112~113年底及114年6月底之合併備抵存貨跌價及呆滯損失分別為17,661千元、13,093千元及10,974千元，占期末存貨總額之比率分別為11.42%、17.29%及14.41%。113年因應客戶資本支出計畫延宕，訂單需求減少降低存貨備料，使113年12月底期末存貨餘額減少，雖部分原物料因辦理存貨報廢及因陸續去化而認列存貨回升利益，使得備抵存貨跌價損失金額下降，然期末存貨餘額減少幅度大於備抵存貨跌價損失減少幅度，以致備抵存貨跌價及呆滯損失占期末存貨總額之比率較112年底上升；114年第二季因應客戶訂單需求增加而備料投入生產，致114年6月底存貨餘額增加，另該公司隨訂單回溫，持續去化庫齡較長之電源供應器等原物料，使備抵存貨呆滯損失下降，以致114年6月底之合併備抵存貨跌價及呆滯損失占合併期末存貨總額之比率較113年底下降。

B. 個體備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

該公司112~113年底及114年6月底之個體備抵存貨跌價及呆滯損失分別為16,120千元、11,266千元及9,667千元，占個體期末存貨總額之比率分別為10.72%、16.36%及13.49%，由於個體備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列與合併報表原因相同，因此不另行分析。

整體而言，該公司及其子公司最近二個會計年度及申請年度最近期之合併及個體存貨跌價損失與呆滯損失依該公司提列政策予以執行，並經簽證會計師查核簽證或核閱完竣，經評估尚無提列不足之情事，存貨備抵提列應尚屬適足。

3. 與同業比較評估

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度		113 年度		114 年前二季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
營業成本	暉盛	470,536	469,860	332,690	336,907	144,513	144,071
	志聖	2,119,643	1,115,421	2,835,109	1,657,644	1,625,253	註 1
	友威科	433,846	299,780	374,054	296,475	104,580	註 1
	鈦昇	935,093	568,874	1,047,264	757,151	455,061	註 1
期末存貨總額(B)	暉盛	154,603	150,373	75,707	68,876	76,136	71,685
	志聖	1,007,521	653,629	1,347,403	754,616	1,843,168	註 1
	友威科	註 2	317,484	註 2	207,800	註 2	註 1
	鈦昇	註 2	註 2	註 2	註 2	註 2	註 1
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	暉盛	17,661	16,120	13,093	11,266	10,974	9,667
	志聖	289,071	203,498	276,846	185,888	288,288	註 1
	友威科	註 2	96,807	註 2	88,112	註 2	註 1
	鈦昇	註 2	註 2	註 2	註 2	註 2	註 1

項目	年度	112 年度		113 年度		114 年前二季	
		合併	個體	合併	個體	合併	個體
期末存貨 淨額	暉盛	136,942	134,253	62,614	57,610	65,162	62,018
	志聖	718,450	450,131	1,070,557	568,728	1,554,880	註 1
	友威科	226,887	220,677	124,956	119,688	98,259	註 1
	鈦昇	1,038,844	928,279	897,451	781,627	792,715	註 1
備抵存貨 跌價及呆 滯損失提 列比率(% (A)/(B))	暉盛	11.42	10.72	17.29	16.36	14.41	13.49
	志聖	28.69	31.13	20.55	24.63	15.64	註 1
	友威科	註 2	30.49	註 2	42.40	註 2	註 1
	鈦昇	註 2	註 2	註 2	註 2	註 2	註 1
存貨週轉 率(次)	暉盛	2.21	2.23	3.33	3.51	4.52	4.82
	志聖	2.54	2.38	3.17	3.25	2.48	註 1
	友威科	1.67	1.19	2.13	1.74	1.87	註 1
	鈦昇	0.84	0.58	1.08	0.89	1.08	註 1
存貨週轉 天數(天)	暉盛	166	164	110	104	81	76
	志聖	144	154	116	113	148	註 1
	友威科	219	307	172	210	196	註 1
	鈦昇	435	630	338	411	338	註 1

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 1：採樣同業並無出具經會計師查核簽證之個體財務報告。

註 2：採樣同業經會計師查核簽證或核閱之合併或個體財務報告未揭露期末存貨總額與備抵存貨跌價及呆滯損失，故無法計算提列比率。

(1)合併

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第二季之合併存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 4.52 次，合併存貨週轉天數分別 166 天、110 天及 81 天；與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 年度合併存貨週轉率低於志聖且優於友威科及鈦昇，113 年度及 114 年前二季則優於同業，顯示該公司庫存控管情況良好，經評估尚無重大異常之情事。

合併備抵存貨跌價及呆滯損失占合併存貨總額比率方面，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底分別為 11.42%、17.29%及 14.41%。惟因除志聖公司外之採樣同業，其各年度財務報告存貨金額係以淨額表達，並未揭露有關備抵存貨跌價及呆滯損失之金額，故僅與志聖公司比較，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底提列比率皆低於志聖公司。該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失之提列係以國際會計準則為依據，依成本與淨變現價值孰低逐項比較衡量，提列備抵存貨跌價損失，並參酌過去經營經驗，以擬定存貨呆滯提列政策，且亦已針對庫齡較久之呆滯存貨定期進行檢討，並加強存貨管理，經評估尚無重大異常之情事。

(2)個體

個體存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 112~113 年度及 114 年第二季分別為 2.23 次、3.51 次及 4.82 次，存貨週轉天數分別為 164 天、104 天及 76 天。與採樣同業相較，112 年度個體存貨週轉率低於志聖且優於友威科及及鈦昇，113 年度則優於同業，114 年前二季採樣同業因無出具個體財務報告，故無法比較。經參閱該公司合併存貨週轉率及存貨週轉天數與其他同業相較之說明，尚無重大異常之情事。

個體備抵存貨跌價及呆滯損失占個體存貨總額比率方面，該公司 112~113 年底及 114 年第二季底分別為 10.72%、16.36%及 13.49%。與採樣同業相較，除鈦昇公司各年度未揭露相關資訊及各採樣同業 114 年第二季財務報告未揭露相關資訊故無法比較外，112~113 年底提列比率均低於採樣同業，該公司已針對庫齡較久之呆滯存貨定期進行檢討，加強存貨管理，控管存貨庫齡管理尚無發現重大異常之情事，且依相關政策進行提列，故 112~113 年底及 114 年第二季底之個體備抵存貨跌價及呆滯損失提列尚無重大異常。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年第二季之合併及個體存貨金額變動、存貨週轉率之變化、備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策之提列情形以及與同業相較，尚屬合理允當，尚未發現重大異常之情事。

(四)發行人最近期及最近二個會計年度財務報告之業績概況

- 1.列表並說明最近期及最近二個會計年度財務報告營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形。

單位：新台幣千元

年度		112年度	113年度		113年前二季	114年前二季	
項目	公司名稱	金額	金額	成長率(%)	金額	金額	成長率(%)
營業收入	暉盛	762,039	547,630	(28.14)	263,460	255,655	(2.96)
	志聖	3,625,801	4,818,209	32.89	2,429,353	2,819,153	16.05
	友威科	744,579	660,171	(11.34)	342,292	203,939	(40.42)
	鈦昇	1,549,374	1,644,908	6.17	791,743	689,431	(12.92)
營業毛利	暉盛	291,503	214,940	(26.26)	105,335	111,142	5.51
	志聖	1,506,158	1,983,100	31.67	979,573	1,193,900	21.88
	友威科	310,733	286,117	(7.92)	148,019	99,359	(32.87)
	鈦昇	614,281	597,644	(2.71)	290,669	234,370	(19.37)
營業利益(損失)	暉盛	166,599	87,039	(47.76)	33,028	37,438	13.35
	志聖	402,656	635,996	57.95	331,997	453,059	36.46
	友威科	123,054	98,462	(19.98)	58,966	57,118	(3.13)
	鈦昇	16,828	(118,939)	(806.79)	(50,003)	(119,911)	(139.81)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司專注開發與製造電漿乾式表面處理設備，可進行蝕刻、去膠、活化、極化、清洗與高溫裂解等各式製程應用，提供半導體晶圓製造、先進封裝、IC 載板、PCB、再生晶圓及新能源生產等電漿設備，並提供符合 ESG 低碳製程要

求的解決方案。綜觀目前國內已上市、上櫃公司中，並無完全與該公司市場業務及定位內容相同之公司，故經綜合考量業務內容、市場定位、產品應用、營運規模及資本額條件等要素，選擇目前上市櫃公司中志聖工業(股)公司(股票代號：2467，以下簡稱：志聖)、友威科技(股)公司(股票代號：3580，以下簡稱：友威科)及鈦昇科技(股)公司(股票代號：8027，以下簡稱：鈦昇)等三家做為採樣同業。志聖主要從事研發及生產紫外光製程、烘烤製程、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程設備，應用於PCB 電路板、IC 載板、FPD 面板及半導體高階封裝生產製程；友威科主要從事真空濺鍍製程技術及鍍膜系統設計及開發，應用於IC 載板封裝電漿濺鍍、電漿蝕刻處理及光學5G 蓋板、載板、汽車、各類銅製程鍍膜；鈦昇主要從事半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與SMD 包裝材料設計與製造，應用於IC 製造及封測、LED 封測之雷射加工及電漿清洗、蝕刻處理。茲就該公司及其子公司與採樣同業之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

(1)營業收入

電漿製程相較傳統濕製程具備多項關鍵優勢，特別是在製程微縮、環保要求與材料多樣性日益提升的趨勢下，成為產業升級的重要技術選項。傳統濕製程雖因設備成本較低與工藝成熟，長期為主流，但其對微細結構控制不易，且需大量化學藥液，衍生高廢水處理成本與環保負擔。電漿製程則為乾式處理，可精準應對3D 結構、高深寬比特徵與奈米級元件加工需求，過往不採用電漿的製程，亦因製程良率與品質需求提升而逐漸導入電漿設備，隨設備穩定性與成本效益改善，電漿技術已逐漸取代部分濕製程，成為先進半導體、封裝與光電產業不可或缺的核心製程工具。

該公司及其子公司112~113 年度及114 年前二季之營業收入分別為762,039 千元、547,630 千元及255,655 千元，113 年度營業收入較112 年度減少214,409 千元，114 年前二季較113 年同期減少7,805 千元。111 及112 年度因ABF 載板需求大增，帶動封裝基板市場快速成長，產業鏈紛紛擴大產能以因應高階晶片封裝需求。由於ABF 載板製程對表面處理與微細線路加工要求提升，需導入高精度電漿設備以確保良率與品質，因此各大廠對電漿設備投入成本顯著提高。112 年度受消費性電子市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板及印刷電路板業績下滑，先前因大多集中於111 及112 年度擴產，以致供過於求使得IC 載板及印刷電路板大廠延後及下修資本支出，致相關供應鏈設備廠自112 年度起出現訂單推遲現象，113 年下半年度產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致該公司113 年度營業收入皆較前年同期減少；而114 年於第一季遞延交機之客戶已於第二季陸續完成出貨並確認交機入帳，且隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，帶動114 年前二季營業收入較113 年同期僅變動(2.96)%，整體營運已有逐步回穩之跡象。

經評估該公司之營收變化情形，主係受產業景氣影響客戶下單動能及資本支出規劃所致，尚無重大異常之情事。

與採樣同業相較，各家同業營運模式、產品性質及應用領域與該公司各有相近之處亦有各自特殊性，故各公司營收結構亦有差異。就營收成長率分析，該公司 113 年度營收成長率低於採樣同業，114 年前二季在營運逐步回升下，僅低於志聖，並優於友威科及鈦昇。友威科因延續企業轉型成果，積極深耕半導體設備領域，CoWoS 先進封裝產能持續擴增，且 FOPLP 客戶維持穩定訂單，113 年度來自半導體業務營收占比已較 112 年度進一步提升，惟因仍須等待終端客戶擴產開出新需求，113 年度及 114 年前二季整體營收仍受機台出貨趨緩影響較比較同期下降，其市場屬性與該公司較為相近，故 113 年度營收成長率變動方向與該公司大致相當。志聖部分，受益於 AI、大數據、高性能計算等市場需求之提高，其在中半導體製程設備業績增加，故 113 年度及 114 年前二季營收成長率較比較同期有所增加；鈦昇部分，受益於電子產業因 AI 浪潮，高階半導體等相關設備投資續增加，先進製程市場規模持續擴大，對其雷射打印、雷射微加工及電漿微加工等設備需求增加，故 113 年度營收成長率較比較同期維持小幅成長，114 年前二季受中美貿易議題及關稅不確定性等影響，營業收入比較同期衰退。

整體而言，該公司及其子公司整體而言，該公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業收入變化情形尚屬合理，且與同業相較，尚無發現有重大異常之情事。

(2)營業毛利

單位：%

公司名稱	年度	112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
	營業 毛利率	暉盛	38.25	39.25	39.98
	志聖	41.54	41.16	40.32	42.35
	友威科	41.73	43.34	43.24	48.72
	鈦昇	39.65	36.33	36.71	33.99

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業毛利分別為 291,503 千元、214,940 千元及 111,142 千元，營業毛利率分別為 38.25%、39.25%及 43.47%。整體而言，該公司營業毛利主要隨營業收入變動而有所起伏，而毛利率則主要受到產品組合變化所影響。相較 112 年度，113 年度之營業毛利率變動幅度不大，並無重大異動；114 年前二季毛利率較 113 年同期提升，主係多為續訂型號訂單產品毛利較高，高毛利產品銷售占比上升所致。綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業毛利率均穩定維持在 38%至 44%區間，整體變動幅度有限，顯示毛利結構具一定穩定性。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 年度之營業毛利率略低於採樣同業，113 年度優於鈦昇，114 年前二季則優於志聖及鈦昇，由於各公司之核心技術、產品組合、市場競爭及業務銷售模式均不盡相同，故毛利率存有差異。

整體而言，該公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業毛利變動情形與採

樣同業相較，尚無發現重大異常之情事。

(3)營業利益

單位：%

公司名稱		年度		112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
		暉盛	志聖	友威科	鈦昇		
營業 利益(損 失)率	暉盛	21.86	15.89	12.54	14.64		
	志聖	11.11	13.20	13.67	16.07		
	友威科	16.53	14.91	17.23	28.01		
	鈦昇	1.09	(7.23)	(6.32)	(17.39)		

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業利益分別為 166,599 千元、87,039 千元及 37,438 千元，營業利益(損失)率分別為 21.86%、15.89%及 14.64%。113 年度營業利益較 112 年度大幅減少，主要係受到產業景氣低迷影響，導致全年設備銷售數量較 112 年度下滑，進而使營業毛利金額減少。此外，該公司營業費用中因積極參展、拍攝形象影片之廣告費及拓展業務支付之佣金費用及勞務費增加，致使營業費用較 112 年度略增，但因營業收入下降使得營業利益率降至 15.89%；114 年前二季因高毛利產品銷售占比上升，營業毛利率成長，營業毛利較 113 年同期成長 5.51%，營業利益隨之較 113 年同期成長 13.35%，營業利益率較 113 年同期成長至 14.64%。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 112 及 113 年度營業利益率皆優於採樣同業，顯示該公司樽節支出，營業費用率 112 及 113 年度皆低於同業；114 年前二季優於鈦昇，低於志聖及友威科。因各公司之之核心技術、產品組合、市場競爭及業務銷售模式不盡相同，使整體毛利率有所差異，且該公司營業利益受業績變化影響而有所減少，經評估，與採樣同業相較，尚無發現重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業收入、營業毛利及營業利益之變化情形應尚屬合理。

2.列表並說明最近期及最近二個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

(1)主要產品別營業收入變動表

單位：新台幣千元；%

產品別	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備	700,166	91.88	484,069	88.40	217,257	84.98
其他	61,873	8.12	63,561	11.60	38,398	15.02
合計	762,039	100.00	547,630	100.00	255,655	100.00

資料來源：該公司提供。

(2)主要產品別營業成本變動表

單位：新台幣千元；%

年度 產品別	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備	435,482	92.56	302,439	90.91	123,691	85.59
其他	35,054	7.44	30,251	9.09	20,822	14.41
合計	470,536	100.00	332,690	100.00	144,513	100.00

資料來源：該公司提供。

(3)主要產品別營業毛利變動表

單位：新台幣千元；%

年度 產品別	112 年度		113 年度		114 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
電漿設備	264,684	90.80	181,630	84.50	93,566	84.19
其他	26,819	9.20	33,310	15.50	17,576	15.81
合計	291,503	100.00	214,940	100.00	111,142	100.00

資料來源：該公司提供。

(4)主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明

該公司及其子公司主要係從事各式高彈性客製化電漿設備之設計及製造，茲就各主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形分析說明如下：

A. 電漿設備

該公司及其子公司之電漿設備包含電漿去膠渣機、電漿蝕刻機、常壓/真空電漿清洗機、電漿極化機及其他各式電漿相關設備。該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季電漿設備之營業收入金額分別為 700,166 千元、484,069 千元及 217,257 千元，占整體營收比重分別為 91.88%、88.40%及 84.98%。

113 年度營業收入較 112 年度減少 30.86%，主係受整體產業景氣趨緩、市場需求放緩以及客戶資本支出計畫延後等因素影響，導致機台銷售數量下滑；114 年前二季隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，且原遞延交機之客戶已於第二季陸續完成出貨並確認交機入帳，營業收入較 113 年同期變動(4.26)%，顯示整體營運已有逐步回穩之跡象。

在營業成本與營業毛利部分，該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年前二季之電漿設備之營業成本分別為 435,482 千元、302,439 千元及 123,691 千元，營業毛利金額分別為 264,684 千元、181,630 千元及 93,566 千元，毛利率則分別為 37.80%、37.52%及 43.07%。由於該公司採訂單式生產，各期產品成本金額主係受公司營運訂單增減所變動，而設備客製化程度復又因客戶需求不同而異，其中產品成本結構中以直接原物料占最大宗，主要原物料組成爲客製化機構元件、真空元件與幫浦及電源供應器等，平均約占八成左右，隨銷售產品組合及設計規劃的不同而波動。整體而言，各主要產品之成本結構略有不同主要係因不同項目產品之原物料價格波動、製程及人力投入等各

項因素而略有差異，114 年前二季毛利率較 113 年同期增加 14.79%，主係續訂型號訂單產品毛利較高，高毛利產品銷售占比上升所致，惟該公司毛利率維持 37%至 44%之間，毛利率具一定穩定性。

綜上所述，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之電漿設備之營業收入、營業成本及毛利變化情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

B.其他

其他產品項目主要包含維修、售後服務及相關零配件等營業收入。該公司及其子公司於 112~113 年度及 114 年前二季來自該項目的營業收入分別為 61,873 千元、63,561 千元及 38,398 千元，占整體營業收入比重分別為 8.12%、11.60%及 15.02%；對應之營業成本分別為 35,054 千元、30,251 千元及 20,822 千元，營業毛利為 26,819 千元、33,310 千元及 17,576 千元，毛利率則分別為 43.35%、52.41%及 45.77%。

各期營業收入、營業成本及營業毛利之變動，主要係依客戶機台維護與服務需求波動而有所增減。由於該類產品涵蓋零件品項繁多、單價差異大，且維修服務難易度不同，報價亦有所差異，故各期間之毛利率亦有所變化，經評估尚無重大異常情事。

3.最近期及最近二個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度		113 年前二季	114 年前二季	
	金額	金額	變動率(%)	金額	金額	變動率(%)
營業收入	762,039	547,630	(28.14)	263,460	255,655	(2.96)
營業毛利率(%)	38.25	39.25	2.61	39.98	43.47	8.73

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

由上表得知，該公司及其子公司 112 及 113 年度、114 年前二季與 113 年同期之營業收入變動率分別為(28.14)%及(2.96)%，而毛利率變動率分別為 2.61%及 8.73%，113 年度之營業收入變動率與 112 年度相比有達 20%以上之情形，故就 112 及 113 年度主要產品進行價量分析。惟因其他類別主係為維修、售後服務及相關零配件等，因規格種類繁多、屬性不同、無一致之數量統計單位，分析不具意義，故不擬分析產品價量變動。茲針對該公司之電漿設備之價量變動情形及合理性分析說明如下：

(1)主要產品別之價量分析

單位：新台幣千元

分析項目		112 年度及 113 年度
電漿設備	營業收入差異分析：	
	P(Q'-Q)	(270,519)
	Q(P'-P)	88,687
	(P'-P)(Q'-Q)	(34,265)
	P'Q'-PQ	(216,097)
	營業成本差異分析：	
	P(Q'-Q)	(168,255)
	Q(P'-P)	57,382
	(P'-P)(Q'-Q)	(22,170)
	P'Q'-PQ	(133,043)
	毛利變動金額：	(83,054)

資料來源：該公司提供。

註：P'Q'：最近年度單價、數量；PQ：上一年度單價、數量。

(2)主要產品價量差分析說明

A.營業收入減少216,097千元

- a.不利數量差異 270,519 千元，主係受景氣波動及客戶資本支出計畫延宕影響下單動能，機台銷售數量減少所致。
- b.有利價格差異 88,687 千元，主係因 112 年度該類產品組合中包含單價較低之手動解框機及常壓電漿清洗機，拉低整體平均銷售單價，致使 113 年度平均銷售單價相較 112 年度提高，產生有利之價格差異。
- c.不利組合差異 34,265 千元，綜上所述，雖平均銷售單價有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生不利組合差異。

B.營業成本減少133,043千元

- a.有利數量差異 168,255 千元，因前述機台銷售數量減少，故造成數量有利差異。
- b.不利價格差異 57,382 千元，主係因 112 年度該類產品組合中包含成本較低之搭載設備手動解框機及常壓電漿設備，致使當年度整體平均單位成本偏低，進而使 113 年度平均單位成本相較 112 年度上升，產生不利之成本差異。
- c.有利組合差異 22,170 千元，綜上所述，雖平均單位成本有所提升，惟其銷售數量大幅減少，致產生有利組合差異。

綜上所述，該公司113年度電漿設備產品因營業收入及營業成本減少，致營業毛利較112年度減少83,054千元。

(五)最近二個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）與關係人交易之評估

1.與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性

(1)關係人之名稱及關係

經參閱該公司 112~113 年度及 114 年前二季合併及個體之財務報告，該公司有交易往來之關係人如下：

關係人名稱(簡稱)	與暉盛之關係
個體：	
STABLE PROMISE GROUP CO.,LTD.(STABLE)	子公司
昆山金暉盛電子商貿有限公司(昆山金暉盛)	孫公司
欣大宇室內裝修工程行(欣大宇)	其他關係人
合併：	
欣大宇室內裝修工程行(欣大宇)	其他關係人

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告

(2)與關係人間業務交易往來情形

A.個體財務報告與關係人間重大交易事項

(A)銷貨收入及應收款項

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
銷貨收入	昆山金暉盛	2,173	8,025	1,601

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年底	113 年底	114 年 6 月底
應收帳款	昆山金暉盛	1,068	1,806	1,048

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

為強化市場競爭力與全球品牌佈局，該公司於99年設立子公司 STABLE，並於100年轉投資昆山金暉盛，協助該公司產品中國區售後服務。該公司負責產品的開發、設計與製造，而昆山金暉盛則專注於售後服務，若當地客戶有維修零配件之需求，則由該公司出售昆山金暉盛，並由昆山金暉盛提供第一線之維護服務，確保客戶能獲得即時且高品質的產品與技術支援並擴展市場占有率。

112~113年度及114年前二季，該公司對昆山金暉盛銷貨之金額分別為2,173千元、8,025千元及1,601千元。該公司對昆山金暉盛之訂價方式係以終端客戶報價之75%~80%，收款條件為月結90天。經檢視該公司訂定之「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」，與昆山金暉盛

間之業務往來皆有明確之規範，該公司對關係人之應收帳款均係銷售需求交易所產生，經抽核其銷貨交易憑證及收款情形，整體而言，其交易價格皆符合訂價策略，該公司對關係人之營收及應收帳款尚無重大異常情形。

(B)進貨及應付款項

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
進貨	昆山金暉盛	—	20	27

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年底	113 年底	114 年 6 月底
應付帳款	昆山金暉盛	—	—	26

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

113年度及114年前二季，該公司向昆山金暉盛進貨金額分別為20千元及27千元，主要為代採購生產設備所需之零配件。113年度委由昆山金暉盛代採購隔離集線器，114年前二季主係代採購絕緣環、套環等，因中國供應商具備價格優勢且僅能採用人民幣交易，故委由昆山金暉盛從中國地區代為採購。該公司向昆山金暉盛採購價格係以金暉盛採購價加計一定利潤供其維持業務執行及營運所需，再轉售予暉盛。經評估，該公司向關係人進貨屬正常之商品交易，具有其必要性及合理性，上述應付帳款均係該公司與孫公司間因進貨所產生之應付款項，經抽核相關支付憑證，並與類似產品價格比較，尚未發現有重大異常之情事。

(C)財產交易、各項費用及其他應付款

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
其他設備 辦公設備	欣大宇	575	—	750

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

主係委由欣大宇處理廠房及研發無塵室相關水電及隔間工程之支出，經評估其交易緣由尚屬合理且尚無重大異常之情事。

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
修繕費	欣大宇	64	126	318

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

主係委由欣大宇處理廠房相關廠務修繕之支出，經評估其交易緣由尚屬合理且尚無重大異常之情事。

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
其他應付款	欣大宇	668	—	266

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

主係委由欣大宇處理上述廠房水電設備、辦公設備及廠務修繕交易產生之應付款項，經評估其交易緣由尚屬合理且尚無重大異常之情事。

單位：新台幣千元

會計科目	交易對象	112 年度	113 年度	114 年前二季
製-勞務費	昆山金暉盛	12,050	11,495	5,069

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告及該公司提供

主係委由昆山金暉盛協助該公司產品中國區售後服務之費用，112~113 年度每月勞務費金額為USD30,000，採2個月支付1次，自113年3月起改為每月支付，經評估尚無重大異常之情事。

B. 合併財務報告與關係人間重大交易事項

合併財務報告中該公司與關係人交易均為母公司與其他關係人交易，因此相關交易內容與個體財報內容均相同，說明請詳 A. 個體財報與關係人間重大交易事項之評估說明。

2. 發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無相互競爭之情形。

關係企業名稱(簡稱)	主要營業或生產項目	有無相互競爭
STABLE PROMISE GROUP CO.,LTD.(STABLE)	投資控股業	無
昆山金暉盛電子商貿有限公司(昆山金暉盛)	買賣業	無

資料來源：該公司提供

該公司主要從事開發先進電漿技術及研發、生產及銷售各式電漿設備，提供半導體產業、IC 載板與印刷電路板產業、平面顯示器與 LED 等光電產業、非電子業、民生工業及綠能產業等各式製程所需的電漿清潔、蝕刻以及表面改質之解決方案；該公司為拓展各式電漿設備大陸地區市場及整合大陸地區機台售後服務，於 99 年透過第三地先設立投資控股公司 STABLE 公司，再由 STABLE 公司於中國大陸江蘇省昆山市設立間接 100% 持股之昆山金暉盛公司。STABLE 公司本身除投資外，並無從事營業活動。昆山金暉盛公司主要定位為提供中國大陸電漿設備客戶之售後維修服務之據點，電子零組件之銷售則係以設備維修零件為主，並未提供整機之研發、製造及銷售，其功能定位及銷售產品均與該公司不同，故該公司與集團企業間並無主要業務或主要商品相互競爭之情形。

二、財務狀況

(一)應列明發行人最近期及最近二個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並作變動分析與同業比較

1.最近期及最近二個會計年度之損益狀況及其變動分析與同業比較

單位：新台幣千元；%

項目	年度 公司別	112 年度		113 年度		113 年度 前二季	114 年前二季		
		金額	金額	註 1	註 2(%)	金額	金額	註 1	註 2(%)
營業 收入	暉盛	762,039	547,630	(214,409)	(28.14)	263,460	255,655	(7,805)	(2.96)
	志聖	3,625,801	4,818,209	1,192,408	32.89	2,429,353	2,819,153	389,800	16.05
	友威科	744,579	660,171	(84,408)	(11.34)	342,292	203,939	(138,353)	(40.42)
	鈦昇	1,549,374	1,644,908	95,534	6.17	791,743	689,431	(102,312)	(12.92)
營業 成本	暉盛	470,536	332,690	(137,846)	(29.30)	158,125	144,513	(13,612)	(8.61)
	志聖	2,119,643	2,835,109	715,466	33.75	1,449,780	1,625,253	175,473	12.10
	友威科	433,846	374,054	(59,792)	(13.78)	194,273	104,580	(89,693)	(46.17)
	鈦昇	935,093	1,047,264	112,171	12.00	501,074	455,061	(46,013)	(9.18)
營業 毛利	暉盛	291,503	214,940	(76,563)	(26.26)	105,335	111,142	5,807	5.51
	志聖	1,506,158	1,983,100	476,942	31.67	979,573	1,193,900	214,327	21.88
	友威科	310,733	286,117	(24,616)	(7.92)	148,019	99,359	(48,660)	(32.87)
	鈦昇	614,281	597,644	(16,637)	(2.71)	290,669	234,370	(56,299)	(19.37)
營業 費用	暉盛	124,904	127,901	2,997	2.40	72,307	73,704	1,397	1.93
	志聖	1,103,502	1,347,104	243,602	22.08	647,576	740,841	93,265	14.40
	友威科	187,679	187,655	(24)	(0.01)	89,053	42,241	(46,812)	(52.57)
	鈦昇	597,453	716,583	119,130	19.94	340,672	354,281	13,609	3.99
營業 利益 (損失)	暉盛	166,599	87,039	(79,560)	(47.76)	33,028	37,438	4,410	13.35
	志聖	402,656	635,996	233,340	57.95	331,997	453,059	121,062	36.46
	友威科	123,054	98,462	(24,592)	(19.98)	58,966	57,118	(1,848)	(3.13)
	鈦昇	16,828	(118,939)	(135,767)	(806.79)	(50,003)	(119,911)	(69,908)	(139.81)
營業外 收入 (支出)	暉盛	5,344	25,944	20,600	385.48	20,648	(18,337)	(38,985)	(188.81)
	志聖	181,376	343,568	162,192	89.42	149,944	54,061	(95,883)	(63.95)
	友威科	10,289	34,156	23,867	231.97	23,394	(4,664)	(28,058)	(119.94)
	鈦昇	21,487	65,593	44,106	205.27	49,585	(83,816)	(133,401)	(269.03)
本期 淨利 (損)	暉盛	133,261	86,950	(46,311)	(34.75)	39,394	15,148	(24,246)	(61.55)
	志聖	530,121	756,575	226,454	42.72	376,867	379,322	2,455	0.65
	友威科	102,216	198,176	95,960	93.88	61,851	38,008	(23,843)	(38.55)
	鈦昇	23,575	(58,859)	(82,434)	(349.67)	(1,472)	(183,049)	(181,577)	(12,335.39)
本期其 他綜合 損益 (稅後 淨額)	暉盛	(46)	135	181	393.48	91	(483)	(574)	(630.77)
	志聖	396,705	1,537,875	1,141,170	287.66	1,297,734	(508,242)	(1,805,976)	(139.16)
	友威科	(3,344)	20,469	23,813	712.11	16,865	(34,980)	(51,845)	(307.41)
	鈦昇	3,278	28,995	25,717	784.53	28,276	(25,357)	(53,633)	(189.68)
本期綜 合損益	暉盛	133,215	87,085	(46,130)	(34.63)	39,485	14,665	(24,820)	(62.86)
	志聖	926,826	2,294,450	1,367,624	147.56	1,674,601	(128,920)	(1,803,521)	(107.70)

項目	年度 公司別	112 年度	113 年度			113 年度 前二季	114 年前二季		
		金額	金額	註 1	註 2(%)	金額	金額	註 1	註 2(%)
總額	友威科	98,872	218,645	119,773	121.14	78,716	3,028	(75,688)	(96.15)
	鈦昇	26,853	(29,864)	(56,717)	(211.21)	26,804	(208,406)	(235,210)	(877.52)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註 1：為較前一年度相同期間之增減金額。

註 2：為較前一年度相同期間之增減比率。

(1)營業收入、營業成本、營業毛利

請參閱本評估報告「參、一、業務狀況（四）、1~2」之說明。

(2)營業費用及營業利益

【營業費用明細】

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度		113 年度		113 年前二季		114 年前二季	
	金額	占營收	金額	占營收	金額	占營收	金額	占營收
推銷費用	37,613	4.93	40,868	7.46	21,395	8.12	26,465	10.35
管理費用	62,764	8.24	65,218	11.91	35,128	13.33	33,147	12.97
研究發展費用	27,880	3.66	23,958	4.38	11,243	4.27	13,993	5.47
預期信用減損損失(利益)	(3,353)	(0.44)	(2,143)	(0.39)	4,541	1.72	99	0.04
營業費用合計	124,904	16.39	127,901	23.36	72,307	27.44	73,704	28.83

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

【營業費用率】

單位：%

年度		112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
公司名稱	暉盛	16.39	23.36	27.44	28.83
	志聖	30.43	27.96	26.66	26.28
	友威科	25.21	28.43	26.02	20.71
	鈦昇	38.56	43.56	43.03	51.39

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業費用分別為 124,904 千元、127,901 千元及 73,704 千元，營業費用率分別為 16.39%、23.36%及 28.83%。茲就推銷費用、管理費用及研發費用之變動說明如下：

A.推銷費用

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之推銷費用分別為 37,613 千元、40,868 千元及 26,465 千元。113 年度推銷費用較 112 年度增加，主係 113 年度因積極參展之廣告費、拓展業務支付之佣金性質費用增加所致；114 年前二季推銷費用較 113 年同期增加 23.70%，係受業績逐步回升影響，拓展業務支付之佣金性質支出增加所致，其變動情形尚無重大異常之情事。

B.管理費用

該公司 112~113 年度及 114 年前二季之管理費用分別為 62,764 千元、65,218 千元及 33,147 千元。113 年度管理費用與 112 年度相較略為增加，係因 113 年度拍攝形象影片使廣告費增加；114 年前二季之管理費用較去年同期減少 5.64%，主係無大額廣告費產生所致，其變動情形尚無重大異常之情事。

C.研發費用

該公司 112~113 年度及 114 年前二季之研發費用分別為 27,880 千元、23,958 千元及 13,993 千元。113 年度研發費用較 112 年度減少，主係受業績減少影響，提列之員工酬勞及年終獎金減少；114 年前二季研發費用較 113 年同期增加 24.46%，主係研發新型設備所需，研發領料增加所致，其變動情形尚無重大異常之情事。

與採樣公司相較，該公司及其子公司營業費用率 112 及 113 年度均低於採樣同業，114 年前二季高於志聖及友威科，低於鈦昇。該公司及其子公司營業費用率主要係受該公司營運狀況影響廣告費、佣金性質費用、員工薪資及研發領用費用之增減，經評估，與採樣同業相較，尚無發現重大異常之情事。

營業利益變動分析請參閱本評估報告「參、一、業務概況(四)、1、(3)」之說明。

(3)營業外收入及支出

【營業外收入及支出明細表】

單位：新台幣千元

年度		112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
利息收入		2,837	4,112	2,101	2,393
其他收入	補助收入—低利貸款補助	946	946	473	473
	補助收入—其他補助	375	354	—	—
	售電收入	667	721	328	302
	其他	402	444	339	184
	其他收入小計	2,390	2,465	1,140	959
其他利益及損失	淨外幣兌換利益	3,170	22,349	18,811	(19,429)
	透過損益按公允價值衡量金融資產評價(損)益	236	419	276	(554)
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	—	(43)	2	—
	其他	(93)	(58)	(49)	(69)
	其他利益及損失小計	3,313	22,667	19,040	(20,052)
財務成本		(3,196)	(3,300)	1,633	1,637
合計		5,344	25,944	20,648	(18,337)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

【營業外收入及支出占營收比重同業比較表】

單位：%

公司名稱		年度	112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
營業外收入 及支出占營 收比重	暉盛		0.70	4.74	7.84	(7.17)
	志聖		5.00	7.13	6.17	1.92
	友威科		1.38	5.17	6.83	(2.29)
	鈦昇		1.39	3.99	6.26	(12.16)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業外收入及支出淨額分別為 5,344 千元、25,944 千元及(18,337)千元，占營收比重分別為 0.70%、4.74% 及(7.17)%，其主要組成項目為利息收入、其他收入、其他利益及損失及財務成本，茲就各項分述如下：

A.利息收入

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之利息收入分別為 2,837 千元、4,112 千元及 2,393 千元，主係銀行存款所產生之利息收入，屬營運活動所衍生之收益項目，尚無重大異常。

B.其他收入

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之其他收入分別為 2,390 千元、2,465 千元及 959 千元，主係補助收入、售電收入及其他收入。

(A)補助收入—低利貸款補助：係依 IAS20 第 12 段規定，政府補助應於其意圖補償之相關成本於企業認列為費用之期間內，依有系統之基礎認列於損益。該公司係依前述規定，將優惠建廠融資貸款低於市場利率之利益 13,405 千元按剩餘借款期間按月認列。

(B)其餘其他收入尚包含申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)與勞動部企業人力資源提升計畫所獲補助款之補助收入及該公司自行裝置太陽能板產生之售電收入等等。

C.其他利益及損失

主係各年度淨外幣兌換利益(損失)及投資基金受益憑證所認列之淨(損)益。兌換利益(損失)方面，該公司及其子公司外銷占比約五~六成且主要以美元為計價幣別，採購付款幣別則以新台幣為主，故外幣收入遠大於外幣支出，並以美元資產部位為主，因此新台幣兌美元對該公司獲利衍生出一定程度之波動。112 年度因美國聯準會採取升息政策趨勢放緩，使美元兌新台幣呈現先升後貶，致 112 年度產生淨兌換利益 3,170 千元；113 年度因全球通貨膨脹降溫緩慢，美國聯準會延後降息，美元仍維持強勢，致 113 年度產生淨兌換利

益 22,349 千元；而受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，114 年前二季美元呈現走弱趨勢，致使該公司於該期間產生淨兌換損失 19,429 千元。

D.財務成本

主係銀行借款之利息，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季財務成本分別為 3,196 千元、3,300 千元及 1,637 千元，尚無重大差異。

與採樣公司相較，112 年度營業外收支占營收比率均低於採樣同業；113 年度較鈦昇為高，低於志聖及友威科；114 年前二季則高於鈦昇，較志聖及友威科為低，係因該公司營業外收支主要受到外幣波動影響所致。整體而言，因各公司進銷貨幣別不同而各有起伏，且該公司已透過外匯部位控管及適時換匯，積極降低匯兌損失對整體獲利之影響，且其變化情形尚屬合理，尚無重大異常之情事。

(4)本期淨利、本期綜合損益總額

【本期淨利、本期綜合損益總額占營收比重同業比較表】

單位：%

公司名稱		年度	112 年度	113 年度	113 年前二季	114 年前二季
本期淨利率	暉盛		17.49	15.88	14.95	5.93
	志聖		14.62	15.70	15.51	13.46
	友威科		13.73	30.02	18.07	18.64
	鈦昇		1.52	(3.58)	(0.19)	(26.55)
本期 綜合損益率	暉盛		17.48	15.90	14.99	5.74
	志聖		25.56	47.62	68.93	(4.57)
	友威科		13.28	33.12	23.00	1.48
	鈦昇		1.73	(1.82)	3.39	(30.23)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之本期淨利則分別為 133,261 千元、86,950 千元及 15,148 千元，本期綜合損益總額分別為 133,215 千元、87,085 千元、及 14,665 千元；本期淨利率分別為 17.49%、15.88%及 5.93%，本期綜合損益總額占營收比重分別為 17.48%、15.90%及 5.74%。112~113 年度及 114 年前二季本期淨利逐期減少，主係受到產業景氣影響半導體、IC 載板及 PCB 等產業大廠之資本支出計畫，致 113 年度電漿設備營業收入及毛利逐期減少所影響；而 114 年前二季隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，營業收入、營業毛利及營業利益已有逐步回穩之跡象，然受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，進而產生兌換損失，故使本期淨利及本期綜合損益總額較 113 年同期分別減少 61.55%及 62.86%，整體變動情形尚屬合理。

與採樣公司相較，112 年度本期淨利率優於所有採樣同業，本期綜合損益率優於友威科及鈦昇，較志聖低；113 年度本期淨利率優於志聖及鈦昇，較友威科

為低，本期綜合損益率則優於鈦昇，較志聖及友威科為低；114 年前二季本期淨利率優於鈦昇，較志聖及友威科為低，本期綜合損益率則優於所有採樣同業。

整體而言，該公司及其子公司之本期淨利率及本期綜合損益率變動情形主係隨整體產業環境及自身產品與採樣公司產品別應用領域及客戶別不盡相同而有所變化，其變動原因尚屬合理，尚無發現重大異常之情事。

2.發行人最近期及最近二個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之財務比率，並作變動分析與採樣公司比較

(1)112~113 年度及 114 年前二季之財務比率

分析項目		年度		112 年度	113 年度	114 年前二季
		公司別				
財務結構 (%)	占資產 比率	權益	暉盛	65.15	68.63	67.73
			志聖	42.66	48.74	39.52
			友威科	49.42	64.51	56.55
			鈦昇	56.49	67.35	63.00
			同業平均	56.50	註 1	註 1
		負債	暉盛	34.85	31.37	32.27
			志聖	57.34	51.26	60.48
			友威科	50.58	35.49	43.45
			鈦昇	43.51	32.65	37.00
			同業平均	43.50	註 1	註 1
	長期資金占不動 產、廠房及設備	暉盛	335.93	338.37	336.67	
		志聖	650.72	719.74	456.57	
		友威科	300.66	292.90	242.93	
		鈦昇	481.08	294.26	245.11	
		同業平均	193.05	註 1	註 1	
償債能力 (%)	流動比率	暉盛	384.85	430.15	398.34	
		志聖	160.89	198.76	132.73	
		友威科	210.87	391.51	262.51	
		鈦昇	564.41	527.83	315.39	
		同業平均	190.90	註 1	註 1	
	速動比率	暉盛	314.60	390.46	358.37	
		志聖	134.36	162.68	93.40	
		友威科	175.65	341.14	234.05	
		鈦昇	362.92	326.85	190.08	
		同業平均	131.40	註 1	註 1	
經營能力	應收款項週轉率 (次)(註 7)	暉盛	2.73	2.14	2.10	
		志聖	1.54	2.33	2.64	
		友威科	2.88	2.75	2.32	
		鈦昇	2.50	3.33	2.67	
		同業平均	3.30	註 1	註 1	
	應收款項收款天數	暉盛	134	171	174	
		志聖	238	157	139	

分析項目	年度		112 年度	113 年度	114 年前二季	
	公司別					
		友威科	127	133	158	
		鈦昇	146	110	137	
		同業平均	111	註 1	註 1	
	存貨週轉率 (次)(註 8)	暉盛	2.21	3.33	4.52	
		志聖	2.54	3.17	2.48	
		友威科	1.67	2.13	1.87	
		鈦昇	0.84	1.08	1.08	
	平均售貨天數	同業平均	2.00	註 1	註 1	
		暉盛	166	110	81	
		志聖	144	116	148	
		友威科	219	172	196	
		鈦昇	435	338	338	
	不動產、廠房及設 備週轉率(次)	同業平均	183	註 1	註 1	
		暉盛	2.83	2.06	1.94	
		志聖	4.58	5.25	4.29	
		友威科	3.30	1.53	0.79	
		鈦昇	2.33	1.64	1.06	
	獲利能力	資產報酬率 (%)	同業平均	1.50	註 1	註 1
			暉盛	12.09	8.19	3.04
			志聖	6.88	8.50	7.28
友威科			5.30	11.66	4.85	
鈦昇			0.92	(1.02)	(8.54)	
權益報酬率 (%)		同業平均	5.30	註 1	註 1	
		暉盛	21.03	11.89	4.10	
		志聖	15.38	17.46	15.57	
		友威科	11.05	20.29	7.51	
		鈦昇	0.95	(2.27)	(13.61)	
占實收 資本 比率 (%)		營業利益	同業平均	8.80	註 1	註 1
			暉盛	57.73	30.16	21.62
			志聖	25.69	40.57	57.80
			友威科	31.18	24.95	28.94
			鈦昇	1.71	(10.97)	(22.03)
		稅前純益	同業平均	註 2	註 2	註 2
			暉盛	59.58	39.15	11.03
			志聖	37.26	62.49	64.70
			友威科	33.78	33.60	26.58
			鈦昇	3.89	(4.92)	(37.44)
純益率(%)	同業平均	註 2	註 2	註 2		
	暉盛	17.49	15.88	5.93		
	志聖	14.62	15.70	13.46		
	友威科	13.73	30.02	18.64		
	鈦昇	1.52	(3.58)	(26.55)		
同業平均	9.40	註 1	註 1			

分析項目	公司別	年度	112 年度	113 年度	114 年前二季
每股盈餘(元)	暉盛		5.00	3.01	0.44
	志聖		3.12	4.80	2.38
	友威科		2.63	5.08	0.96
	鈦昇		0.32	(0.51)	(1.71)
	同業平均		註 2	註 2	註 2
現金流量 (%)	現金流量比率 (%)	暉盛	64.26	93.36	註 3
		志聖	33.49	27.79	1.44
		友威科	註 3	82.94	19.91
		鈦昇	45.13	71.69	4.22
		同業平均	13.50	註 1	註 1
	現金流量 允當比率 (%)	暉盛	註 4	104.98	133.23
		志聖	125.95	115.48	註 5
		友威科	95.01	96.24	註 5
		鈦昇	14.82	15.88	註 5
	現金再投資比率 (%)	同業平均	註 2	註 2	註 2
		暉盛	11.72	12.09	註 3
		志聖	7.94	5.36	註 5
		友威科	註 3	8.45	註 5
		鈦昇	1.16	7.65	註 5
	槓桿度	營運槓桿度	同業平均	5.00	註 1
暉盛			1.91	2.50	2.75
志聖			1.20	註 5	註 5
友威科			2.53	註 5	註 5
鈦昇			36.59	註 5	註 5
財務槓桿度		同業平均	註 2	註 2	註 2
		暉盛	1.02	1.04	1.05
		志聖	1.09	1.09	1.07
		友威科	1.06	1.04	1.06
		鈦昇	(3.61)	註 6	註 6
同業平均	註 2	註 2	註 2		

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開資訊觀測站及股東會年報，並經福邦證券計算整理；同業資料則參考財團法人金融聯合徵信中心之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中「C29 機械設備製造業」之財務比率，統計數採綜合平均數。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心未出具 113 年度及 114 年前二季之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心編印之「IFRSs 合併財報財務比率」未揭露該等資訊。

註 3：該公司及採樣同業營業活動淨現金流量為流出數，不具比較意義，故不予列示相關比率。

註 4：該公司於 112 年公開發行，故未有完整 5 年之 IFRS 現金流量資訊，故不予計算該比率。

註 5：截至評估報告出具日止，採樣同業尚未公告於公開資訊觀測站揭露之財務比率數據。

註 6：採樣同業為營業損失，故不予計算該比率。

註 7：應收款項週轉率及收現天數係以應收款項總額計算。

註 8：存貨週轉率及銷貨日數係以存貨淨額計算。

註 9：各項財務分析比率之計算方式，列式如下：

1. 財務結構

(1) 權益占資產比率 = 權益總額 / 資產總額。

(2) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(3)長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2)速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

3.經營能力

(1)應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 餘額。

(2)平均收現天數 = 365 / 應收款項週轉率

(3)存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4)平均銷貨天數 = 365 / 存貨週轉率

(5)不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2)權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3)營業利益占實收資本額比率 = 營業利益 / 期末實收資本額。

(4)稅前純益占實收資本額比率 = 稅前純益 / 期末實收資本額。

(5)純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(6)每股稅後盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2)現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3)現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2)財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

(2)最近期及最近二年度財務比率與採樣公司比較分析

A.財務結構

(A)權益占資產比率及負債占資產比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底之權益占資產比率分別為 65.15%、68.63%及 67.73%；負債占資產比率分別為 34.85%、31.37%及 32.27%。113 年底權益占資產比率較 112 年底上升及負債占資產比率較 112 年底下降，主係因陸續償還長期借款，及受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致負債總額較 112 年底減少所致；114 年第二季底權益占資產比率較 113 年底下降及負債占資產比率較 113 年底上升，主係該公司隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，故負債總額較 113 年底上升，經評估其變動情形尚屬合理。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司權益及負債占資產比率 112~113 年底及 114 年第二季底均優於採樣同業及同業平均，該公司及其子公司負債占資產比率尚屬健全，且未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情事，經評估尚無重大異常之情事。

(B)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 335.93%、338.37%及 336.67%。該公司及其子公司之長期資金占不動產、廠房及設備比率各年度變化不大，主係該公司及子公司營運持續穩定獲利以及陸續償還長期借款，使得長期資金僅微幅變動所致，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年底長期資金占不動產、廠房及設備比率優於友威科及同業平均而低於志聖及鈦昇；113 年底及 114 年第二季底僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，且各年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆優於 100%，顯示其長期資金足以支應資本支出及營運所需，長期資金結構尚屬健全，經評估無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底財務結構各項財務指標變化情形尚屬合理，財務結構尚屬健全，經評估尚無重大異常之情事。

B.償債能力

(A)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底之流動比率分別為

384.85%、430.15%及 398.34%；速動比率分別為 314.60%、390.46%及 358.37%。113 年底較 112 年底上升，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致流動負債較 112 年底減少，流動比率及速動比率因此分別上升至 430.15%及 390.46%；114 年第二季底較 113 年底減少，主係該公司隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，依訂單交期持續投產使原物料採購增加，使應付款項增加，以及 113 年度盈餘分配發放現金股利，使得應付股利增加，致流動負債較 113 年底增加，流動比率及速動比率因此分別下降至 398.34%及 358.37%。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年底流動比率僅低於鈦昇而優於志聖、友威科及同業平均；114 年第二季底優於採樣同業。速動比率 112 年底僅低於鈦昇而優於志聖、友威科及同業平均；113 年底及 114 年第二季底優於採樣同業，顯示該公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，償債能力尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年底及 114 年第二季底償債能力各項財務指標變化情形尚屬合理，償債能力尚屬良好，經評估尚無重大異常之情事。

C.經營能力

(A)應收款項週轉率及平均收現日數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之應收款項週轉率分別為 2.73 次、2.14 次及 2.10 次，平均收現天數分別為 134 天、171 天及 174 天。該公司及其子公司之應收款項週轉率呈現逐年下滑趨勢，平均收現日數則逐年上升，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業收入下滑所致；114 年前二季主係隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，以及遞延交機之客戶已陸續完成出貨及交機確認，致營業收入小幅下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度應收款項週轉率及平均收現日數優於志聖及鈦昇而低於友威科及同業平均；113 年度及 114 年前二季均低於採樣同業，主係受各採樣公司之營業屬性、銷售區域組成、收款方式之不同而有所差異，尚無重大異常情事。

(B)存貨週轉率及平均銷貨日數

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之存貨週轉率分別為 2.21 次、3.33 次及 4.52 次，平均銷售天數分別為 166 天、110 天及 81 天。該公司及其子公司之存貨週轉率呈現逐年上升趨勢，平均銷貨日數則逐年

下滑，113 年度因受客戶資本支出趨於保守，使得訂單縮減影響營收減少，營業成本隨之下滑，113 年度營業成本減少 29.30%，而 113 年底因客戶資本支出計畫延宕，考量在手訂單，備料及投產金額隨之降低，存貨淨額減少 54.28%，因平均存貨淨額減少幅度大於營業成本減少幅度，致存貨週轉率較 112 年度上升，存貨週轉天數減少；114 年前二季因遞延交機之客戶陸續完成出貨並確認交機，存貨逐步去化，並依訂單交期持續投產，使得第二季底存貨僅微幅上升，平均存貨淨額較 113 年度減少，致存貨週轉率較 113 年度上升，平均存貨週轉天數減少。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度存貨週轉率及平均銷貨日數僅低於志聖而優於友威科、鈦昇及同業平均；113 年度及 114 年前二季均優於採樣公司，顯示該公司存貨控管良好，經評估尚無重大異常之情事。

(C) 不動產、廠房及設備週轉率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 2.83 次、2.06 次及 1.94 次，該公司及其子公司之不動產、廠房及設備週轉率呈現逐年下滑趨勢，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業收入持續下滑所致；114 年前二季主係隨著產業景氣逐步回溫，客戶下單動能亦逐漸恢復，以及遞延交機之客戶已陸續完成出貨及交機確認，致營業收入小幅下滑所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度不動產、廠房及設備週轉率優於鈦昇及同業平均而低於志聖及友威科；113 年度及 114 年前二季均僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，整體而言，該公司之資產管理情形尚屬穩健，尚無重大異常情形。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季經營能力各項財務指標變化情形尚屬合理，經營能力尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

D. 獲利能力

(A) 資產報酬率及權益報酬率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之資產報酬率分別為 12.09%、8.19% 及 3.04%，權益報酬率分別為 21.03%、11.89% 及 4.10%。該公司及其子公司之資產報酬率及權益報酬率均呈現逐年下滑趨勢，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致稅後純益隨營業收入持續下滑所致；114 年前二季係受美國關稅政策變動及市場預期聯

準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使稅後純益減少所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度資產報酬率及權益報酬率均優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年前二季均優於鈦昇而低於志聖及友威科，整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

(B)營業利益及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營業利益占實收資本比率分別為 57.73%、30.16%及 21.62%；稅前純益占實收資本額比率分別為 59.58%、39.15%及 11.03%。該公司及其子公司之營業利益及稅前純益占實收資本額比率均呈現逐年下滑趨勢，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守，致營業利益及稅前純益隨營業收入持續下滑所致；114 年前二季係因隨著產業景氣逐步回溫，拓展業務之佣金支出增加，以及研發新型設備致營業費用增加，使得營業利益下滑，以及受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使稅前純益減少所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度營業利益及稅前純益占實收資本額比率均優於採樣同業；113 年度僅低於志聖而優於友威科及鈦昇；114 年前二季優於鈦昇而低於志聖及友威科，整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

(C)純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之純益率分別為 17.49%、15.88%及 5.93%，每股盈餘分別為 5.00 元、3.01 元及 0.44 元。該公司及其子公司之純益率及每股稅後盈餘均呈現持續下滑趨勢，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，113 年下半年產業庫存雖已逐漸去化，然因該公司主要銷售客戶資本支出仍趨保守使得營業收入減少，進而減少稅後純益所致；114 年前二季係受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使稅後純益減少所致。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112 年度純益率優於採樣同業及同業平均；113 年度僅低於友威科而優於志聖及鈦昇；114 年前二季優於鈦昇而低於志聖及友威科。112 年度每股稅後盈餘優於採樣同業及同業平均；113 年度及 114 年前二季均優於鈦昇而低於志聖及友威科，

整體而言，該公司獲利能力尚屬穩定，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季獲利能力各項指標之變化尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

E. 現金流量

(A) 現金流量比率

該公司及其子公司 112~113 年度之現金流量比率分別為 64.26% 及 93.36%，114 年前二季因營業活動淨現金流量為淨流出，故不予計算。113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，致流動負債較 112 年底減少，而該公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加，致現金流量比率上升至 93.36%；114 年前二季係受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使稅前純益減少所致，使營業活動產生淨現金流出。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年度現金流量比率均優於採樣同業及同業平均；114 年前二季因產生營業活動淨現金流出，然同業亦均呈大幅下降趨勢，經評估尚無重大異常之情事。

(B) 現金流量允當比率

該公司及其子公司 112 年度無法計算前 5 年之營運活動現金流量，因採用國際財務報導準則之財務報表未滿 5 年資料，故不予計算，113 年度及 114 年前二季之現金流量允當比率分別為 104.98% 及 133.23%。主係該公司營運獲利持續穩定，在近三年未有大量之資本支出，且存貨未大幅增加之狀況下，該公司及其子公司之現金流量允當比率逐年上升，經評估尚無重大異常之情事。

與採樣公司相較，該公司及其子公司除 112 年度因採用國際財務報導準則之財務報表未滿 5 年，無法計算前 5 年之營運活動現金流量外，113 年度之現金流量允當比率僅低於志聖而優於友威科及鈦昇，114 年前二季現金流量允當比率因採樣同業未公布資料故無法比較，經評估尚無重大異常之情事。

(C) 現金再投資比率

該公司及其子公司 112~113 年度之現金再投資比率分別為 11.72% 及 12.09%，114 年前二季因營業活動淨現金流量為淨流出，故不予計算。113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，致該公司員工年終獎金、員

工紅利及董監酬勞及所得稅費用隨業績及獲利下滑而使得其他應付款減少，而該公司隨接單減少使原物料採購放緩及存貨生產成本減少，且應收款項隨陸續交機及驗收完成收款，使營業活動淨現金流入較 112 年度增加，致現金再投資比率上升至 12.09%；114 年前二季係受美國關稅政策變動及市場預期聯準會將實施降息影響，導致美元避險資金外流、美元走貶，美元淨資產進而產生較大兌換損失，使稅前純益減少所致，使營業活動產生淨現金流出。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 112~113 年度現金再投資比率均優於採樣同業及同業平均，114 年前二季因產生營業活動淨現金流出故不予比較，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季各項現金流量各項指標變化情形尚屬合理，其現金餘額尚足以支應該公司營運所需，經評估尚無重大異常之情事。

F. 槓桿度

(A) 營運槓桿度

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之營運槓桿度分別為 1.91 倍、2.50 倍及 2.75 倍，該公司及其子公司之營運槓桿度逐年上升，113 年度主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC 載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，使營業利益隨營業收入減少；114 年前二季係因隨著產業景氣逐步回溫，拓展業務之佣金支出增加，以及研發新型設備致營業費用增加，使得營業利益下滑，致營運槓桿度逐年提高。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司營運槓桿度 112 年度高於志聖而低於友威科及鈦昇，113 年度及 114 年前二季因採樣同業未公布資料故無法比較，經評估尚無重大異常之情事。

(B) 財務槓桿度

該公司及其子公司 112~113 年度及 114 年前二季之財務槓桿度分別為 1.02 倍、1.04 倍及 1.05 倍，該公司及其子公司之財務槓桿度逐年微幅上升，113 年度主係受美國逐步升息使該公司借款之財務成本微幅提高；114 年前二季係因隨著產業景氣逐步回溫，拓展業務之佣金支出增加，以及研發新型設備致營業費用增加，使得營業利益下滑，故使該公司及其子公司財務槓桿度逐年微幅提升。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司財務槓桿度 112 年度及 114 年前二季均優於採樣同業，113 年度與友威科相當而優於志聖，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司之營運槓桿度及財務槓桿度之變化情形尚

屬合理，尚無重大異常情形。

(二)發行人及其各子公司(包括母子公司間交易事項)最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

1.背書保證之情形

該公司經董事會決議通過及該公司其子公司執行董事決議通過，該公司及其子公司不擬從事背書保證，得依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定免予訂定背書保證作業程序及建立背書保證備查簿。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站背書保證公告申報資訊等資料，該公司及其子公司並無為他人背書保證之情事。

2.重大承諾之情形

該公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，業經董事會決議通過，以做為負債承諾及或有事項管理之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司重大承諾事項，主係該公司依銷售機台保固合約於保固期間開立保證票據，保證金額分別為0千元、489千元及489千元。整體而言，重大承諾事項係因正常營業活動所產生，並無異常之情事，尚不致對該公司財務狀況產生重大不利影響。

3.資金貸與他人之情形

該公司經董事會決議通過及該公司其子公司執行董事決議通過，該公司及其子公司不擬從事從事資金貸與他人，得依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定免予訂定資金貸與他人作業程序及建立資金貸與他人備查簿。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站資金貸與他人公告申報資訊等資料，該公司及其子公司並無資金貸與他人之情事。

4.衍生性商品交易之情形

該公司經111年12月22日董事會決議通過及其子公司經執行董事決議通過，不擬從事衍生性商品交易。然因應營運需要，以規避風險為原則，經113年3月27日董事會決議及提報113年6月28日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」，作為該公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、衍生性商品備查簿，並檢視公開資訊觀測站衍生性商品公告申報資訊等資料，該公司並無從事衍生性商品交易之情事。

5.重大資產交易之情形

該公司訂有「取得或處分資產處理程序」，業經董事會決議並提報股東會通過，以作為該公司從事重大資產交易之依據。經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、112~113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視公開資訊觀測站取得或處分資產公告申報資訊等資料，該公司並未有重大資產交易之情事。

綜上所述，該公司及其子公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止並無從事資金貸與他人、背書保證、衍生性商品及重大資產之交易，而該公司重大承諾皆為正常營運發展所需，經核對相關資料尚屬合理，尚無發現重大異常之情事，且該公司及其子公司並無重大訴訟案件或財務週轉困難之情事，故對該公司及子公司之財務業務尚無重大影響。

(三)發行人最近期及最近二個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

1.最近期及最近二個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：新台幣千元

項目/年度	112 年度	113 年度	114 年前二季
期初股本	262,558	288,598	288,598
員工酬勞成本發行新股	26,040	—	—
期末股本	288,598	288,598	288,598
營業收入	762,039	547,630	255,655
稅後純益	133,261	86,950	15,148
基本每股盈餘(元)	5.00	3.01	0.44

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

2.所募集資金是否允當運用並產生合理效益及對每股盈餘稀釋之影響

該公司112~113年底及114年第二季末之期末普通股股本皆為288,598千元，該公司股本之變化主係因112年度發行員工認股權憑證並行使2,604千股所致。

該公司112~113年度及114年第二季基本每股盈餘分別為5.00元、3.01元及0.44元，該公司獲利能力呈現逐步下滑趨勢，主係受市場景氣低迷需求疲弱及半導體產業進行庫存調整影響，IC載板廠因市場供過於求而延後及下修資本支出，使113年度營業收入下滑，另受中美貿易議題及關稅不確定性影響，美元呈現走弱趨勢，致該公司114年前二季匯兌損失增加，致112~113年度及114年前二季稅後淨利及每股盈餘均較比較同期下滑。整體而言，該公司最近期及最近二年度每股盈餘變動主要係受公司營運及獲利狀況影響，未有因資金募集致每股盈餘大幅稀釋之情形。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

該公司本次募資計畫用於充實營運資金，依其編製之 114 及 115 年度現金收支預測表，114 年 1~8 月係實際數，而 114 年 9~12 月至 115 年 12 月係預估數，該公司現金收支預測表中並無新增長期股權投資，該公司預估 114 年 9~12 月及 115 年度相關資本支出合計為 19,140 千元，未達本次募資金額之 60%，故不適用本項評估。

(五)前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

經查閱該公司 112~113 年度及 114 年前二季董事會議事錄、股東會議事錄、公開資訊觀測站募資計畫執行專區及私募專區公告及各年度年報等資料，該公司截至評估報告出具日止，並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之情事，而前各次現金增資發行新股計畫均已執行完畢並已逾三年，故不適用本項評估。

(六)發行人其他特殊財務狀況

經查閱該公司及其子公司最近期及最近二個會計年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，尚未發現其他特殊財務狀況之情事。

肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

- 一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

經查閱該公司董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站募資計畫執行專區與私募專區公告，該公司截至評估報告出具日止，並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之情事，且該公司前各次現金增資發行新股計畫均已執行完畢，尚無執行進度未達預計目標之情事，故不適用本項評估。

- 二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

經查閱該公司董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站募資計畫執行專區與私募專區公告，該公司截至評估報告出具日止，並無辦理現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之計畫經重大變更且尚未完成之情事，故不適用本項評估。

- 三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

經查閱該公司董事會議事錄、股東會議事錄、公開資訊觀測站募資計畫執行專區及私募專區公告，該公司截至評估報告出具日止，並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之情事，而前各次現金增資發行新股資金運用計畫實際完成日距本次申報時皆逾三年，故不適用本項查核程序。

- 四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事

經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、會計師查核簽證或核閱之財務報告、股東會年報，查詢公開資訊觀測站重大訊息公告，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無發行公司債或舉借長期債務未如期還本付息之情事，且相關借款契約並無對該公司目前財務、業務或其他事項有重大限制條款。另查閱該公司聯徵中心及票據交換所資料，該公司並無退票或有延遲繳息之債信不良之情形，故最近期及最近二個會計年度並無財務週轉困難之情事。

- 五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

該公司截至評估報告出具日止，並無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

- 一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股以供初次上市前公開承銷使用，並非屬同準則第六條第二項第一款或第四款募集與發行有價證券，故不適用本項「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列情事之評估。

- 二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1. 簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，簽證會計師並無出具無法表示意見或否定意見之查核或核閱報告，故無左列情事。
2. 簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，簽證會計師並無出具保留意見之查核或核閱報告，故無左列之情事。
3. 發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。			✓	該公司本次辦理現金增資發行新股係作為創新板初次上市公開銷售之用，依法令規定無須出具簽證會計師複核或主辦承銷商出具之案件檢查表，故不適用。
4. 律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		✓		經取具翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表，並無左列情事。
5. 證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		✓		該公司本次係辦理現金增資發行新股之案件，依本承銷商出具之評估報告，已明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性及合理性，而因該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用關於必要性之評估。詳細說明請參閱評估報告「陸、本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之查核說明。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
6.經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件，發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。		✓		經查閱該公司之董事會議事錄及與金管會之往來函文，查詢證期局網頁公告訊息，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其申報(請)案件之情事。
7.申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		✓		(1)該公司本次現金增資發行新股辦理創新版股票上市前公開承銷之資金用途為充實營運資金，並非直接或間接赴大陸地區投資。 (2)經查閱該公司 114 年第二季經會計師核閱之財務報告，該公司直接或間接赴大陸地區投資金額累計為 15,178 千元(500 千美元)，並未超過依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額 439,114 千元，故無違反左列情事。
8.上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依證券交易法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		✓		經查閱該公司董事會議事錄及查詢公開資訊觀測站相關資訊，該公司業已依法設置薪資報酬委員會，並委任三席獨立董事擔任薪資報酬委員會，其成員資格、職權行使及會議召開業已依相關法令規定辦理，故無左列情事。
9.未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		✓		經檢視該公司之公司章程及 114 年度股東會開會通知，該公司已將電子方式列為股東行使表決權管道之一，故無左列情事。
10.違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		✓		經查閱該公司與主管機關之往來函文、董事會議事錄，並取具該公司出具之聲明書，截至本評估報告出具日止，並未發現該公司有違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，而有情節重大之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
11.經金管會發現有違反法令，情節重大者。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及董事會議事錄及金管會及公開資訊觀測站重大裁罰公佈，並取得該公司出具之聲明書，並無發現左列之情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1.申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一規定。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止董事會及股東會議事錄、變更事項登記表及公開資訊觀測站之重大訊息公告，茲就申報年度及前二年度董事之變動情形說明如下： (1) 該公司董事因任期屆滿於 112 年 5 月 30 日股東常會進行全面改選，5 席董事均未有異動。 (2) 112 年 12 月 11 日，接獲董事蔡秉儒先生辭任董事一職，並於 113 年 1 月 26 日股東臨時會選任 3 席獨立董事，分別由顏盟峯、黃蕙玲及何志文擔任，董事席次增加至 7 席，變動董事席次共計 3 席。 綜上，申報年度及前二年度該公司董事變動未達二分之一以上之情事，另查閱證期局裁罰案件公告及公開資訊觀測站依證交法第 43 條之 1 第 1 項取得股份公告，並取得該公司出具之聲明書，並無發現其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一情事，故應無左列情事。
2.上市或上櫃公司有證券交易法第一百五十六條各款情事之一者。但依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣，不在此限。				經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、與證券主管機關往來函文，該公司並無證券主管機關依證券交易法第一百三十九條第二項之規定限制上市買賣之情事。另該公司並無證券交易法第一百五十六條各款之情事，評估依據說明如下：
(1)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。				該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，取得該公司出具之聲明書，以及詢問該公司相關人員，該公司並無遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產之情事。
(2)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、目前存續之重要契約、臺灣票據交換所之信用資料查覆單及財團法人金融聯合徵信中心信用報告，並取得該公司出具之聲明書，尚未發現該公司有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之情事。
(3)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，尚未發現該公司有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格而及於市場秩序或損害公益之情事。
(4)該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		✓		經查詢證券櫃檯買賣中心公布之注意股票及處置股票訊息，經評估該公司有價證券之市場價格尚無發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌，而有影響市場秩序或損害公益之虞之情事。
(5)發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		✓		經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文、董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無發生重大公害或食品藥物安全事件，而有影響市場秩序或損害公

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
				益之情事。
(6)其他重大情事。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，及取得該公司出具之聲明書，尚無發現該公司存有其他重大情事，而有影響市場秩序或損害公益之情事。
3.本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		✓		該公司本次募集與發行有價證券計畫，經本證券承銷商評估，本次募集與發行有價證券計畫確具可行性，其資金用途、運用進度與預計可能產生效益亦具合理性，而因該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用關於必要性之評估。評估過程請詳本評估報告「陸、本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之評估說明。
4.前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：			✓	經查閱該公司112~113年度及114年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、公開資訊觀測站募資計畫執行專區及私募專區之公告資料，該公司未曾辦理私募有價證券，另自公開發行後該公司並無辦理募集與發行有價證券之情事，而該公司前各次現金增資計畫均已執行完畢。
(1)無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。			✓	該公司前各次現金增資計畫之執行並未發生無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成之情事，故不適用左列評估。
(2)無正當理由計畫經重大變更。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。			✓	該公司前各次現金增資計畫並無重大變更之情事，且各次現金增資發行新股資金運用計畫實際完成日距本次申報時皆逾三年，故不適用左列評估。
(3)募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。			✓	該公司前各次現金增資計畫並無重大變更之情事，故不適用左列評估。
(4)最近一年內未確實依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款及「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第十一			✓	經查詢該公司與主管機關之往來函文、公開資訊觀測站募資計畫執行專區，該公司並無左列最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款規定辦理之情事。另該公司並無募集與

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
條規定辦理。				發行海外有價證券之情事。
(5)未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。			✓	經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄，查詢公開資訊觀測站之私募專區，該公司未曾辦理私募有價證券，故不適用該項評估。
(6)未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。			✓	該公司前各次募集與發行及私募有價證券並無未能產生合理效益且無正當理由之情事，且各次現金增資發行新股資金運用計畫實際完成日距本次申報時皆逾三年，故不適用左列評估。
5.本次募集與發行有價證券計畫之重要內容（如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等）未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。		✓		該公司本次募集與發行有價證券之計畫及相關重要內容，業已列成議案經 114 年 9 月 5 日董事會討論並決議通過，故無左列之情事。
6.非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		✓		經查閱公開資訊觀測站資金貸放金額公告，查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄，該公司並無資金貸與他人之情形。
7.有重大非常規交易，迄未改善者。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之律師法律意見書及法律事項檢查表、該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、取具該公司出具之聲明書，並未發現有重大非常規交易，迄未改善之情事。
8.持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司債者。但所募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備或用於合併非以買賣有價證券為主要業務之公司，且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。			✓	該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定辦理現金增資發行新股以供辦理初次上市前公開承銷使用，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條第四項規定，不適用左列評估。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
9. 本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。		✓		該公司本次辦理現金增資發行新股之資金運用計畫為充實營運資金，並非轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故無左列之情事。
10. 不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司均依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，並無左列之情事。
11. 違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定情事者。		✓		經取得該公司出具之聲明書，承諾該公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定，自申報日起至申報生效日止，除依法令發布之資訊外，不得對特定或不特定人說明或發布財務業務之預測性資訊。
12. 內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		✓		經查閱該公司內部稽核報告、該公司出具之內部控制制度聲明書及會計師出具之內部控制制度建議書及內部控制制度專案審查報告，並未發現其內部控制制度之設計或執行有重大缺失之情事。
13. 申報日前一個月，其股價變化異常者。		✓		經查閱申報日前一個月證券櫃檯買賣中心公告之興櫃達通知標準及公布注意股票資訊及興櫃處置股票資訊，該公司並無股價變化異常而被列入注意股票或處置股票。
14. 公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(1) 違反證券交易法第二十六條規定，經金融監督管理委員會通知補足持股尚未補足。		✓		該公司已設置審計委員會取代監察人職責，故不適用有關監察人持股成數規定。另經查詢公開資訊觀測站董監事持股餘額明細資料，該公司截至送件日止，全體董事持股總數為 13,109,566 股，占已發行股份總數 34,631,731 股之 37.85%，經評估符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列之情事。
(2) 加計本次申報發行股份後，未符證券交易法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，		✓		該公司截至評估報告出具日已發行股數為 34,631,731 股，加計本次現金增資預計發行 2,165,000 股，增資後股本為 36,796,731 股，而截至送件日止該

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
不在此限。				公司全體董事持股總數為 13,109,566 股，占其現金增資後發行股數之 35.63%，符合證券交易法第二十六條之規定，故無左列情事。
(3)申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。		✓		經查詢公開資訊觀測站「董事、監察人持股不足法定成數彙總表」，該公司申報年度及前一年度公司全體董事持股成數均符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。
15.發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、財團法人金融聯合徵信中心信用報告、臺灣票據交換所票信查詢資料、司法院法學資料檢索系統，並取具該公司出具之聲明書，該公司、現任董事長及總經理於最近三年內並無左列情事。
16.因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		✓		經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，查詢司法院法學資料檢索系統，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行之情事。
17.為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄，查詢公開資訊觀測站背書保證資訊，該公司未有背書保證之情事。
18.合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一： (1)違反金管會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節規定，情節重大。 (2)受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流			✓	該公司本次辦理上市前現金增資發行新股計畫，非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股，故不適用左列規定。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
<p>動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。</p> <p>(3) 受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。</p> <p>(4) 違反公司法第一百六十七條第三項及第四項規定。</p> <p>(5) 被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。</p>				
<p>19. 有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一：</p> <p>(1) 申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。</p> <p>(2) 申報發行轉換公司債或附認股權公司債，未於發行辦法明定應募人應自前揭公司債發行日起將公司債及嗣後所轉換或認購之股份送交證券集中保管事業保管一年。</p>			✓	該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目之所列情事，故不適用左列之評估。
<p>20. 證券承銷商於發行人申報時最近一年內經金管會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但發行人辦理現金發行新股為初次上市、上櫃公開銷售者，不在此限。</p>			✓	該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用左列之規定。
<p>21. 其他金管會為保護公益認為有必要者。</p>		✓		經查閱該公司 112~113 年度及 114 年度截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文，並未發現有左列之情事。

綜上評估，該公司本次辦理現金增資發行普通股案並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條各款所列之情事。

三、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股以供初次上市前公開承銷使用，並非屬總括申報發行新股案件者，故不適用「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及第十九條之二所列情事之評估。

四、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

該公司本次辦理現金增資發行普通股，故針對「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則第一條至第四條及第貳章現金增資普通股第五條至第九條之規定，逐條評估如下：

	自律規則	說明
第壹章 總則		
第一條	為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，本公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商輔導該公司辦理本次募集與發行有價證券相關事宜，謹遵守本自律規則辦理。
第二條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。 七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。	經查閱本承銷商與該公司之董事名單、112~113 年度及 114 第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，另取得本承銷商與該公司針對左列各款所出具之聲明書，並無左列各款情事。

	自律規則	說明
	<p>八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。</p> <p>發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。</p> <p>本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。</p>	
第二條之一	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書：</p> <p>一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。</p> <p>二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。</p> <p>依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與行政院金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。</p>	<p>經取具該公司洽請本次填報檢查表並出具法律意見書之翰辰法律事務所彭義誠律師出具之聲明書，業已聲明最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且與該公司、會計師及本承銷商並無左列關係之情事。</p>
第三條	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；總括申報追補發行新股案件，前開聲明書之聲明期間為自承銷商出具評估總結意見之日起至繳款截止日止，承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。</p> <p>前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。</p> <p>經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者，第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。</p>	<p>本承銷商與該公司皆已出具聲明書，聲明於向臺灣證券交易所申報案件日至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限，且不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。</p>
第四條	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券（員工認股權憑證除外），加計其前各次（含其所私募</p>	<p>該公司本次係辦理創新版初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。</p>

	自律規則	說明
	<p>者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數,不得逾已發行股數之百分之五十。</p> <p>發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者,其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。</p>	
第四條之一	<p>承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券,以新發行之股份履行轉換義務或履約者,承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度,惟自九十五年七月一日起,上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付,不印製實體方式為之。</p> <p>承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付,除外國發行人註冊地國另有規定外,應以帳簿劃撥方式為之。</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件,故不適用左列規定。
第四條之二	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券,應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止,辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止,不得請求轉換(認購)」規定;另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日、股票變更面額之停止轉換(認購)起始日起暫停轉換(認購)期間與前各次具轉換(認股、交換)有價證券到期日前之停止轉換(認股、交換)期間接續,及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者,如遇普通股除息、除權或現金增資認股時,應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。</p> <p>前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換(認購)期間。</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件,故不適用左列規定。
第四條之三	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券,自發行日後屆滿一定期間起,除依法停止過戶期間外,持有人得依發行人所定之發行及轉換(認股、交換)辦法請求轉換(認股、交換);但發行公司或外國發行人為未上市(櫃)、未登錄興櫃之公開發行公司者,轉換(認股、交換)期間</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件,故不適用左列規定。

	自律規則	說明
	<p>自發行日後屆滿一定期間至 到期日前十日止為限。</p> <p>前項依法停止過戶期間不得轉換（認股、交換）之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。</p> <p>第一項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換（認購、交換）辦法中訂定之。</p>	
第四條之五	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。</p> <p>對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。</p>
第四條之六	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，非發行海外有價證券，故不適用左列規定。</p>
第四條之七	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換（認購）辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報（請）發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換（認購）辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整）並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。</p>

	自律規則	說明
	依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。	
第四條之八	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。
第四條之九	除上市（櫃）公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。 承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說電子檔傳送至金管會指定之網站。 第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，且擬採競價拍賣方式辦理公開承銷，將依左列規定辦理。
第四條之十	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換（認購、交換）性質之各種有價證券，應注意發行與轉換（認購、交換）辦法中應訂明下列事項： 一、債券到期還本付息之款項支付日。 二、發行條件中包含債券持有人之賣回權者，應訂明行使賣回權之款項支付日。 三、發行條件中包含發行公司之收回權者，應訂明行使收回權利之款項或有價證券交付日。 四、發行條件中包含交換權者，應訂明投資人行使交換權之有價證券交付日。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。
第四條之十一	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第 34 及 36 號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第 249 條第 2 款及第 250 條第 2 款之規定。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。
第四條之十二	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回本公司股份。 現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件已出具承諾書，承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回該公司股份，故符合左列之規定。

	自律規則	說明
	總括申報發行新股案件，第一項承諾書應承諾首次發行自申報日起及各次追補發行自承銷商出具評估總結意見之日起，至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	
第四條之十三	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。	該公司本次非募集人民幣計價海外公司債，故不適用左列規定。
第四條之十四	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。	<p>1. 本承銷商輔導該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，已取具該公司及該公司之董事、總經理、財務主管以及與該公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人出具聲明書，聲明上述人員絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人，並將上開該等人員出具之聲明書彙編於公開說明書中，故符合左列規定。</p> <p>2. 該公司申報本次募資案件時所檢附之公開說明書及簡式公開說明書，業依「公司募集與發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製，經檢核該上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容已具完整性。另於向證券商同業公會申報承銷契約前，亦將依左列規定辦理。</p>
第四條之十五	承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。 承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子(分)行並依計劃支用。承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估。 承銷商依前項輔導外國發行人申報在臺募集與發行公司債案件，擔保銀行及受託銀行限於在我國設有營業據點之銀行。	該公司本次非屬外國發行人募資案件，故不適用左列規定。
第四條之十六	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募	該公司本次係辦理創新板初次上

	自律規則	說明
	資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	市前現金增資發行新股案件，故不適用左列之規定。
第四條之十七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認股、交換)辦法中應訂明債券持有人請求轉換(認股、交換)之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列之規定。
第四條之十八	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應將發行公司或外國發行人辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，並協助其依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。	該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。
第四條之十九	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報募資案件時，應出具發行公司或外國發行人是否應依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證券監督管理委員會辦理備案之意見。 承銷商應取得發行公司之說明意見，且發行公司應出具說明內容無虛偽、隱匿之聲明。	本承銷商輔導該公司發行創新板初次上市前現金增資發行新股案件，經查閱該公司 113 年度經會計師查核簽證之財務報告及股東會年報，取得該公司之說明意見及聲明書，該公司未符合「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」之標準，無須向中國證券監督管理委員會辦理備案。
第四條之二十	承銷商輔導外國發行人募集與發行國際債券，得與註冊於國際證券管理機構組織(IOSCO)多邊瞭解備忘錄(MMoU)簽署會員地，領有金融業務執照且受當地主管機關監理之境外金融機構簽訂契約引介發行人予承銷商，承銷商得以所收取之手續費給付報酬予該機構。 承銷商應於契約明訂雙方之權利義務及手續費分潤之條件。 第一項所稱國際債券以「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」第三條第一項第一款、第六款及第七款所指之債券為限。	該公司本次非屬外國發行人募資案件，故不適用左列規定。
第貳章 現金增資普通股		
第五條	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書，如屬總括申報發行新股案件，並應承諾不得參與首次發行及各次追補發行之新股認購。	該公司非屬上市(櫃)公司、創新板上市公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用左列規定。
第五條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，並無

	自律規則	說明
	募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	公佈財務預測，故不適用左列之規定。
第五條之二	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市（櫃）案件、股票申請創新版初次上市案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成；如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p> <p>以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃、股票申請創新版上市前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。</p>	<p>該公司本次辦理現金增資發行普通股，係作為申請創新版初次上市公開承銷之用，該公司與本承銷商間業已依合理之方式制定暫定之承銷價格，且亦於評估報告中敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，請參閱本評估報告「陸、本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之說明；待本案實際發行價格確定後，本承銷商謹遵循本自律規則之規定，輔導公司於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p> <p>另本承銷商已與該公司簽訂過額配售協議書，並依「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理相關作業。</p>
第六條	<p>承銷商輔導上市（櫃）承銷商輔導上市（櫃）公司、創新版上市公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。</p> <p>承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評</p>	該公司非屬上市(櫃)公司、創新版上市公司，且本次現增案係屬創新版初次上市前現金增資發行普通股案件，故不適用左列之規定。

	自律規則	說明
	估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	
第六條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。	該公司非屬上市(櫃)公司、創新板上市公司，且本次現增案係屬創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，故不適用左列之規定。
第七條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導創新板上市公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非屬上市(櫃)公司，本次現增案係屬創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，故不適用左列之規定。
第七條之一	承銷商輔導上櫃（市）公司申請轉上市（櫃）為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購	該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件非屬上櫃（市）公司申請轉上市（櫃）為達股權分散標準而辦理，故不適用左列規定。

	自律規則	說明
	<p>公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	
第八條	<p>採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料：</p> <p>一、詢價圈購之相關資料（含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之成數等資料）。</p> <p>二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。</p> <p>承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。</p>	本承銷商輔導該公司辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件係採全數競價拍賣方式辦理承銷，故不適用左列規定。
第八條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理總括申報發行新股案件，準用第六條、第六條之一、第七條及第八條規定。	該公司非為上市（櫃）公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，非總括申報發行新股案件，故不適用左列規定。
第九條	<p>承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。</p> <p>承銷商輔導上市（櫃）公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。</p> <p>實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前</p>	該公司非為上市（櫃）公司、創新板上市公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，並非參與發行海外存託憑證之用，故不適用左列規定。

	自律規則	說明
	<p>一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。</p> <p>前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，承銷商並應輔導上市（櫃）公司於發行計畫及存託契約中載明。</p> <p>創板上市公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案件，前各項規定準用之。</p>	

綜上評估，該公司本次辦理現金增資發行普通股，業已符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行新股亦將依自律規則之規定予以辦理。

五、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事。

法律條文	是否符合規定			說明
	是	否	不適用	
<p><u>公司法第 129 條</u> 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章： 一、公司名稱。 二、所營事業。 三、採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 四、本公司所在地。 五、董事及監察人之人數及任期。 六、訂立章程之年、月、日。</p>	✓			該公司已於章程內載明公司法第 129 條之事項，故無違反左列規定。
<p><u>公司法第 130 條</u> 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： 一、分公司之設立。 二、解散之事由。 三、特別股之種類及其權利義務。 四、發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。 前項第四款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。</p>	✓			該公司已於章程內載明公司法第 130 條第一項第一款之事項，且自該公司設立以來，尚無解散、發行特別股與發起人所得受之特別利益，故無違反左列之規定。
<p><u>公司法第 156 條第 5 項</u> 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨</p>			✓	該公司本次申報辦理現金增資發行普通股，並未以現金以外之出資抵充情形，故

法律條文	是否符合規定			說明
	是	否	不適用	
幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。				不適用左列評估。
<u>公司法第167條第3項</u> 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。 <u>公司法第167條第4項</u> 前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。	✓			經參閱該公司112~113年及114年第二季經會計師核閱之財務報告及股東名冊，取得該公司出具之聲明書，並未發現該公司之從屬公司有左列之情事。
<u>公司法第246條</u> 公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。
<u>公司法第247條</u> 公開發行股票公司之公司債總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。
<u>證券交易法第28條之4</u> 已依證券交易法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制： 一、有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。 二、前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。
<u>公司法第249條</u> 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結，自了結之日起三年內。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債，應負擔年息總額之百分之一百五十。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。
<u>公司法第250條</u> 公司有左列情形之一者，不得發行公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務有違			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。

法律條文	是否符合規定			說明
	是	否	不適用	
約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。				
<u>公司法第 269 條</u> 公司有左列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股： 一、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。 二、對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行普通股案，故不適用左列評估。
<u>公司法第 270 條</u> 公司有下列情形之一者，不得公開發行新股： 一、最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 二、資產不足抵償債務者。	✓			1.經查閱該公司 112~113 年度經會計師查核簽證之個體財務報告，該公司 112 及 113 年度稅後淨利分別為 133,261 千元及 86,950 千元，並無連續二年度虧損之情事。 2.經查閱該公司 114 年第二季經會計師核閱之財務報告，資產總額為 1,080,511 千元，負債總額為 348,654 千元，並無資產不足抵償債務之情形。

綜上評估，該公司對上述各項應遵循之法令並未有違反情事，故對該公司之營運及本次有價證券之募集與發行尚不致產生不利影響。

(二)是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

該公司未有證券交易法第一百五十六條第一項各款之情事，相關評估請詳本評估報告「伍、二、(二)、2」之說明。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、112~113 年度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、查詢司法院法學資料檢索系統、詢問該公司相關人員，並取得該公司及其現任董事、持股百分之十以上之大股東及總經理等相關人員出具之聲明書，該公司及其現任董事、總經理、持股百分之十以上之大股東及實質負責人最近三個會計年度至評估報告出具日止，並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、112~113 度及 114 年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、查詢司法院法學資料檢索系統，並取得該公司及其現任董事、總經理出具之聲明書，該公司及其現任董事、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至評估報告出具日止，尚未發現有經法院判決有期徒刑以上之情事。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	國泰世華商業銀行	111.02.20-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	國泰世華商業銀行	109.10.12-126.02.20	中期擔保借款	土地及廠房抵押擔保；承諾於借款期間，自 112 年度財務報告日起，應維持流動比率不低於 150%及負債比率不高於 120%
授信合約	國泰世華商業銀行	110.02.01-114.10.12	短期擔保借款(週轉金)	土地及廠房抵押擔保；承諾於借款期間，自 112 年度財務報告日起，應維持流動比率不低於 150%及負債比率不高於 120%
授信合約	永豐商業銀行	114.06.30-115.06.30	短期擔保借款(週轉金)	依債務餘額徵十足定存單設質擔保
授信合約	元大商業銀行	113.11.18-114.11.17	衍生性金融商品(避險額度)美元參拾萬元	提供美元定期存單擔保
授信合約	元大商業銀行	113.11.18-114.11.17	中期擔保借款	—

資料來源：該公司提供

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經參閱翰辰法律事務所彭義誠律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、112~113 度及 114 年截至評估報告出具日止之主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無發生重大勞資糾紛或污染環境事件對財務業務造成重大影響之情事。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次資金用途為充實營運資金，無須經目的事業主管機關同意，故不適用本項評估。

六、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列情事

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒。

(二)與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

1.依主管機關訂頒之各業別財務報告編制準則所規範之關係人關係。

2.其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經者。

經取得翰辰法律事務所彭義誠律師出具之聲明書，該律師並無於最近一年內受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務報告簽證會計師及本承銷商間具有主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有可行性、必要性及合理性

(一)本次計畫之資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

1.本次計畫所需資金總額：新台幣 155,880 千元。

2.本次計畫資金來源

(1)辦理現金增資發行普通股 2,165 千股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格暫定為新台幣 72 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣 155,880 千元整。

(2)本次現金增資發行普通股，如實際發行總額若因市場狀況變動而調降發行價格，致募集資金不足時，則將減少充實營運資金金額；另若因調升發行價格而致募集資金增加時，增加之資金將用於充實營運資金。

3.計畫項目及預計資金運用進度

單位：新台幣千元

項目	預計 完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			114 年度	115 年
			第四季	第一季
充實營運資金	115 年第一季	155,880	100,000	55,880

資料來源：該公司提供

4.預計可能產生之效益

該公司本次募集資金 155,880 千元擬全數用以充實營運資金，預計於 114 年第四季完成募集，於資金到位後隨即投入支應公司營運所需之相關資金需求，除可增加長期資金穩定性外，亦可強化財務結構、提升償債能力並降低公司經營風險，更有助於提高公司資金靈活調度之彈性及未來中長期發展，對該公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

(二)本次募集與發行有價證券計畫之可行性評估

1.法定程序上之可行性評估

該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股計畫，業經 113 年 6 月 28 日股東常會決議通過全體股東放棄優先認購權，作為初次上市前公開承銷之股份來源，並於 114 年 9 月 5 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，有關現金增資計畫之發行價格、發行條件及其他相關事宜，如因主管機關指示或基於客觀環境改變而需要修正時，已授權該公司董事長全權處理。經查閱其內容及決議程序，均符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」

及其他相關法令之規定，另參酌該公司委任之翰辰法律事務所彭義誠律師對本次現金增資發行新股計畫出具之法律意見書，顯示本次募集與發行有價證券計畫確已符合相關法令之規定，故該公司本次現金增資發行新股計畫於法定程序上應屬適法可行。

2. 資金募集完成之可行性評估

該公司本次辦理現金增資計畫發行普通股 2,165 千股，每股面額新臺幣 10 元，暫定以每股新臺幣 72 元發行，預計募集總金額 155,880 千元。本次現金增資發行新股除依公司法第 267 條保留 15%，計 324 千股由員工認購外，其餘 1,841 千股則依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17 條之 1 規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，並按證券交易法第 28-1 條規定，經 113 年 6 月 28 日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，全數委託承銷商辦理創新版上市前公開承銷。

本次辦理創新版初次上市前現金增資發行新股係採全數競價拍賣方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購之，而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保本次資金募集完成，故該公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

3. 資金運用計畫之可行性評估

該公司本次辦理現金增資發行新股所募集金額為新台幣 155,880 千元，擬全數用於充實營運資金，考量主管機關審查與承銷作業時程，預計於 114 年第四季募集完成，旋即可將資金挹注於營運週轉需求，以因應該公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，除可強化該公司財務結構之外，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業之經營及健全財務結構均有正面助益，故本次籌資用於充實營運資金應屬合理可行。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股計畫，就其法定程序、資金取得及資金運用計畫等各方面評估均具可行性，故整體而言，該公司本次籌資計畫應屬可行。

(三) 本次募集與發行有價證券資金計畫之必要性評估

該公司本次現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條規定，以現金增資發行新股方式，委託證券承銷商辦理創新版上市前公開承銷，另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 8 條第 3 項及「中華民國證券商業同業公會發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」規定，得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

(四)本次計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性

1.資金運用計畫及預計進度之合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理創新板初次上市前公開承銷之用，預計募集資金共計新台幣 155,880 千元，資金運用目的為充實營運資金，以因應該公司營運週轉及業務成長所產生之資金需求，並提高自有資本比率及強化財務結構，提升資金靈活調度之彈性，另考量主管機關之審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程，預計於 114 年第四季完成資金募集作業後，即依本次募集計畫之預定進度，於 114 年第四季及 115 年第一季投入充實營運資金，故該公司之資金運用計畫及預計進度應屬合理。

2.預計可能產生效益之合理性

單位：%

項目		年度	籌資前 114 年 6 月底	籌資後 (預估)(註)
財務結構	負債比率		31.89	27.85
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		336.74	396.32
償債能力	流動比率		405.28	485.85
	速動比率		365.78	446.35

資料來源：該公司提供

註：係以 114 年第二季個體自結財務數字為基礎，按充實營運資金 155,880 千元後設算。

該公司本次辦理現金增資發行新股募集 155,880 千元，預計於 114 年第四季募集完成，並於 114 年第四季及 115 年第一季投入充實營運資金。若以該計畫募集完成後之財務結構及償債能力觀之，其負債比率可由增資前 31.89% 降至 27.85%，長期資金占不動產、廠房及設備比率、流動比率及速動比率將分別上升至 396.32%、485.85% 及 446.35%，將可強化財務結構及提升償債能力，故有助於該公司靈活調度資金，故本次現金增資計畫之效益應屬合理。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資，資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益應具合理性。

一之一、總括申報發行新股案件者，應另提供評估說明

該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股供上市前公開承銷，非屬總括申報發行新股案，故不適用本項評估。

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上市前之公開銷售作業，故僅就

發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

該公司本次辦理現金增資發行普通股 2,165 千股，加計目前流通在外股數為 34,632 千股，辦理增資後股數為 36,797 千股，每股盈餘將因現金增資後股權稀釋比率為 5.88%【2,165 千股/(34,632 千股+2,165 千股)】，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋影響尚屬有限。

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資之評估

該公司本次計畫之資金用途為充實營運資金，故不適用本項之評估。

(二)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於償債或用於充實營運資金之評估

1.查閱發行人最近一個會計年度個體財務報告暨申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表，以了解發行人之營業特性、應收帳款收款、應付帳款付款政策、資本支出計畫與前揭現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並分析本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性。前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

(1)營業特性

該公司主要從事各式電漿設備之研發、製造與銷售，故該公司主要現金流入係銷售電漿設備及相關維修、售後服務及相關零配件銷售所產生之應收帳款收現，而現金流出則為應付款項付現及薪資等維持日常營運所需。該公司所編製之 114 及 115 年度各月份之現金收支預測表，係依據 114 年 1~8 月之實際營運情況，並綜合評估其產業特性、已接單及預計接單情形、產品結構、歷史營運情形、未來營運計畫及該公司收付款政策等，且考量產業未來發展趨勢等因素，推估各月份收入及支出情形，其編製之假設基礎尚屬合理。

(2)應收帳款收款與應付帳款付款政策

A.應收帳款收款政策

該公司應收帳款政策係依據個別客戶營運規模、信用紀錄及過去往來交易情形給予不同之授信條件，並視個別合約或訂單約定不同階段所需收取之訂金款、交機款、驗收款及保固款，主要收款條件國內依發票日，國外客戶依其通知起，月結 30~180 天收款。該公司預計 114 年及 115 年度對銷售客戶之收款政策變化不大，故以此作為預估 114 年 9~12 月及 115 年度現金收支預測表各月份應收帳款之收款情形，其編製基礎尚屬合理。

B.應付帳款付款政策

應付帳款部分，該公司購料支出主要係應付採購原物料之款項，目前與主要供應商之付款政策，係依產品之市場供需關係，與供應商訂定合理之付款條件。該公司目前主要供應商付款條件為月結 30~120 天付款為主，經考量備貨作業時間及實際付款情形及付款政策，該公司乃據以作為編制 114 年 9~12 月及 115 年度現金收支預測表之基礎，尚屬合理。

(3)資本支出計畫

該公司之資本支出計畫係依公司未來經營策略及營運計畫予以擬定，以因應營運規模之擴展，該公司現金收支表之主要資本支出項係用於設備汰舊換新，而前述增添之設備資本支出所需資金係以自有資金支應，與本次募集資金用途並無直接關聯，故其現金收支預測表之編製基礎尚屬合理。

(4)申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性

經檢視該公司編製之現金收支預測表，該公司 114 年度現金收支預測表中，1~8 月份各項金額係實際數，114 年 9~12 月及 115 年度則為預估數，其預估基礎係參酌產業發展趨勢、該公司預計之營運狀況已接單及預計接單情形、與各供應商及一般客戶之收付款條件、資本支出計畫及資金運用規劃等因素編製。經核對 114 年期初現金餘額數 458,858 千元與 113 年度經會計師查核簽證之個體財務報告相符，且其所編製之現金收支預測表中，與本次發行普通股籌資款項之資金流入及本次資金運用計畫進度一致。整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎尚屬合理。

另該公司並無對外公佈財務預測，故不適用現金收支預測表與財務預測之關聯性評估。

(5)分析本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性

就該公司編製 114 年度及 115 年度各月份之現金收支預測表觀之，考量該公司未來業績成長所需之營運資金將增加，故本次現金增資計畫用於充實營運資金，以提升財務調度靈活性，藉以增加其競爭力及強化財務結構。另本次現金增資主係配合承銷制度之規定，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17 條之 1 之規定，以現金增資發行新股之方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，故本次增資計畫應有必要性及其合理性。

(6)未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

經檢視該公司 114 年度及 115 年度各月份現金收支預測表中，尚無重大資

本支出或長期股權投資合計之金額達本次募集金額百分之六十之情形，故不適用本項評估。

綜上，該公司 114 年度及 115 年度現金收支預測表之預估已考量該公司以往年度之實際狀況與 114 年度及 115 年度之營運預測，配合各該年度之資金狀況編製，其整體預估尚屬合理。

114 年度現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目/月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	458,858	462,693	463,483	458,323	475,594	445,394	442,656	411,575	391,390	380,737	299,572	438,635	458,858
加：非融資性收入													
應收帳款收現	60,910	34,318	31,011	50,008	12,738	49,343	79,321	51,049	37,474	62,778	32,985	32,051	533,986
其他	284	391	314	316	323	761	360	256	400	256	356	663	4,680
非融資性收入合計(2)	61,194	34,709	31,325	50,324	13,061	50,104	79,681	51,305	37,874	63,034	33,341	32,714	538,666
減：非融資性支出													
廠商付款	21,048	18,932	21,858	20,221	30,101	29,440	30,310	24,962	18,702	17,266	31,382	35,956	300,178
用人費用	25,361	4,051	6,018	6,425	7,896	8,181	6,342	6,871	6,485	12,971	6,584	6,584	103,769
所得稅費用	—	—	—	—	—	8,701	—	—	9,648	—	—	—	18,349
利息支出	276	276	266	274	268	276	265	236	236	236	236	236	3,081
取得不動產、廠房及設備	1,965	—	750	260	129	200	754	105	3,000	1,270	1,500	—	9,933
取得金融資產(3個月以上之定存)	—	—	—	—	—	—	60,285	—	—	36,000	—	36,000	132,285
其他	7,790	9,095	6,028	4,308	3,302	4,479	11,241	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	90,698
非融資性支出合計(3)	56,440	32,354	34,920	31,488	41,696	51,277	109,197	41,065	46,962	76,634	48,593	87,667	658,293
要求最低現金餘額(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
所需資金總額(5=3+4)	156,440	132,354	134,920	131,488	141,696	151,277	209,197	141,065	146,962	176,634	148,593	187,667	758,293
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6=1+2-5)	363,612	365,048	359,888	377,159	346,959	344,221	313,140	321,815	282,302	267,137	184,320	283,682	239,231
融資淨額													
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,880	—	155,880
發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	(28,860)	—	—	—	—	(28,860)
銀行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(919)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(67,565)	(1,565)	(1,565)	(84,134)
融資淨額合計(7)	(919)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(30,425)	(1,565)	(67,565)	154,315	(1,565)	42,886
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	462,693	463,483	458,323	475,594	445,394	442,656	411,575	391,390	380,737	299,572	438,635	382,117	382,117

資料來源：該公司提供

115 年度現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目/月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	382,117	404,291	356,228	346,404	361,344	343,269	316,295	303,795	318,875	306,001	331,265	238,665	382,117
加：非融資性收入													
應收帳款收現	67,981	51,709	63,596	85,108	44,044	24,193	26,719	55,995	44,427	64,729	36,921	36,773	602,195
其他	255	255	255	255	255	660	255	255	255	255	255	660	3,870
非融資性收入合計(2)	68,236	51,964	63,851	85,363	44,299	24,853	26,974	56,250	44,682	64,984	37,176	37,433	606,065
減：非融資性支出													
廠商付款	26,827	24,399	19,477	15,271	22,338	31,484	17,800	22,577	21,507	19,857	36,090	41,350	298,977
用人費用	7,243	26,936	7,506	6,960	10,634	9,651	7,982	7,901	11,378	7,901	7,901	13,857	125,850
所得稅費用	—	—	—	—	16,710	—	—	—	13,179	—	—	—	29,889
利息支出	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	2,832
取得不動產、廠房及設備	1,300	2,000	—	1,500	2,000	—	3,000	—	800	1,270	1,500	—	13,370
取得金融資產(3個月以上之定存)	—	36,000	36,000	36,000	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000
其他	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	8,891	106,692
非融資性支出合計(3)	44,497	98,462	72,110	68,858	60,809	50,262	37,909	39,605	55,991	38,155	54,618	64,334	685,610
要求最低現金餘額(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
所需資金總額(5=3+4)	144,497	198,462	172,110	168,858	160,809	150,262	137,909	139,605	155,991	138,155	154,618	164,334	785,610
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6=1+2-5)	305,856	257,793	247,969	262,909	244,834	217,860	205,360	220,440	207,566	232,830	213,823	111,764	202,572
融資淨額													
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(73,593)	—	(73,593)
銀行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
償還銀行借款	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(18,780)
融資淨額合計(7)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(1,565)	(75,158)	(1,565)	(92,373)
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	404,291	356,228	346,404	361,344	343,269	316,295	303,795	318,875	306,001	331,265	238,665	210,199	210,199

資料來源：該公司提供

2.發行人申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用必要性之評估，僅針對合理性評估如下：

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	114 年前二季
財務槓桿度(倍)(註)	1.02	1.04	1.04
負債比率(%)	30.57	35.03	31.89
營業收入	762,120	546,155	254,257
本期淨利	133,261	86,950	15,148
每股盈餘(元)	5.00	3.01	0.44

資料來源：112 及 113 年度經會計師查核簽證之個體財務報告及 114 年前二季個體自結財務報表。
註：財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

(1)財務槓桿及負債比率

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益影響之程度，該項指標數值愈高，表示公司所承擔之財務風險愈大。該公司 112~113 年度及 114 年前二季之財務槓桿度分別為 1.02 倍、1.04 倍及 1.04 倍，顯示該公司之財務風險控管尚屬穩健；就財務結構而言，負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，該公司 112 年底、113 年底及 114 年第二季底之負債比率分別為 30.57%、35.03%及 31.89%，其數值尚屬穩健，預計本次辦理現金增資發行新股充實營運資金後，可降低該公司負債比率及增加資金調度之彈性，亦可提升償債能力及改善財務結構，對於強化財務結構及降低營運風險均有正面之助益。

(2)營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋

該公司本次資金用於充實營運資金，除可強化財務結構、提升自有資金比率及償債能力，降低公司經營風險，並維持公司正常營運所需資金靈活調度之彈性及未來中長期發展，對該公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益，此外，該公司本次辦理現金增資發行新股，預計於 114 年第四季募集完成，目前流通在外股數為 34,632 千股，本次擬發行 2,165 千股，合計 36,797 千股，股本增加比率為 5.88%，雖造成股本膨脹，惟此次所募集之款項用於充實營運資金，將對該公司業績之持續成長有所助益，預計其未來獲利能力尚不致因股本膨脹而對股東權益產生重大不利之影響，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋之影響尚屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資募集資金計畫用以充實營運資金，對其財務槓桿、負債比率、營業收入及獲利能力皆有正面效益，且對每股盈餘稀釋效果尚無重大影響，故本次現金增資計畫實有其必要性及合理性。

3.本次增資計畫如用於償債者，取得該公司償債之相關明細，以了解原借款用途之必要性、合理性及顯現之效益

該公司本次募集資金計畫係用以充實營運資金，故不適用本項評估。

(三)本次增資計畫如用於購買營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次計畫之資金用途為充實營運資金，故不適用本項之評估。

(四)本次增資計畫如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其賣方轉讓之理由、受讓價格之依據及其合理性，評估受讓過程是否適法及對契約相對人權利義務之影響

該公司本次計畫之資金用途為充實營運資金，故不適用本項之評估。

三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次增資計畫係以現金出資，故不適用本項評估。

四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性

該公司本次辦理籌資計畫，並無併同減資計畫辦理，故不適用本項評估。

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次辦理增資發行新股係以溢價發行，故不適用本項評估。

六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性

該公司為現金增資發行新股申請股票創新板初次上市之公司，故不適用本項評估。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。及暫定發行股數區間是否符合公司法第一百二十九條第三款規定之情事

該公司為現金增資發行新股申請股票創新板初次上市之公司，故不適用本項評估。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

1.暫定價格之訂定

該公司於 114 年 9 月 5 日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 2,165 千股，每股面額 10 元，暫定每股之發行價格為新台幣 72 元，係依一般市場承銷價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量法等股價評價方法及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，推算合理之承銷價格，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業、經營績效、競爭利基、產業未來發展前景及未來投資人認購意願等因素後，由本承銷商與該公司共同議定之。而實際每股發行價格待主管機關核准後，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，並依該公司實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，與該公司另行議定創新板上市掛牌承銷價格。

2.募集資金不足時之處理

該公司於本案件生效後，若實際發行價格低於暫定發行價格，致募集資金不足時，擬維持原預定募集股份 2,165 千股，其資金不足部分則將減少充實營運資金之金額。

3.募集資金增加時之資金用途、預計效益及其適法性及合理性

本次現金增資實際發行時如因競價拍賣結果之最後訂價變動，使得每股實際發行價格高於暫定承銷價格時，將維持原預定募集股數，並將高於原預定募集總金額全數用於充實營運資金，以進一步提高該公司流動比率及速動比率，降低負債占資產總額之比率，進而強化公司長期競爭力，其適法性及合理性於本評估報告「伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」已評估其皆已適法及合理，其所導致募集資金增加時之資金用途及預計效益亦應屬合理。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期還款之來源及如何取得人民幣資金等)。

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，並非申報發行人民幣債券，故不適用本項評估。

陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

捌、就本次公司債發行（及轉換）辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

拾、就本次發行公司債債權確保情形（列明有無擔保、擔保品種類與價值等）蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

拾貳、拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理初次創新板上市前現金增資發行新股案件，故不適用本項評估。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

無。

拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估

截止本評估報告出具止，除該公司本次辦理現金增資發行普通股外，該公司尚無重大期後事項，故不適用。

主辦承銷商：福邦證券股份有限公司



負責人：黃炳鈞



中華民國一十四年九月十日

(僅限於暉盛科技股份有限公司初次創新板上市前現金增資發行新股承銷商評估報告使用)

暉盛科技股份有限公司



負責人：宋俊毅

